

AM69x 处理器，器件修订版本 1.0

1 特性

处理器内核：

- 多达八核 64 位 Arm® Cortex®-A72 微处理器子系统，性能高达 2GHz
 - 每个四核 Cortex®-A72 集群共享 2MB L2 高速缓存
 - 每个 Cortex®-A72 内核具有 32KB L1 数据高速缓存和 48KB L1 指令高速缓存
- 多达四个深度学习加速器：
 - 每个加速器高达 8 万亿次每秒运算 (TOPS)
 - 总计 32 万亿次每秒运算 (32TOPS)
- 双核 Arm® Cortex®-R5F MCU，在具有 FFI 的通用计算分区中性能高达 1.0GHz
 - 16KB L1 数据高速缓存、16KB L1 指令高速缓存和 64KB L2 TCM
- 双核 Arm® Cortex®-R5F MCU，性能高达 1.0GHz，支持器件管理
 - 32K L1 数据高速缓存、32K 指令高速缓存和 64K L2 TCM，所有存储器上都有 SECDED ECC
- 最多两个具有图像信号处理器 (ISP) 和多个视觉辅助加速器的视觉处理加速器 (VPAC)
 - ISP 每秒处理 4.8 亿像素
 - 支持多达 16 位的输入 RAW 格式
 - 宽动态范围 (WDR)、镜头失真校正 (LDC)、视觉成像子系统 (VISS) 和多标量 (MSC) 支持
 - 输出颜色格式：8 位、12 位，以及 YUV 4:2:2、YUV 4:2:0、RGB、HSV/HSL
- 多媒体：
 - 显示子系统支持：
 - 最多 4 台显示器
 - 最多两个 DSI 4L TX (高达 2.5K)
 - 一个 eDP 4L
 - 一个 DPI 24 位 RGB 并行接口
 - 定帧检测和 MISR 数据检查等安全功能
 - 3D 图形处理单元
 - IMG BXS-4-64，高达 800MHz
 - 50GFLOPS，4GTexels/s
 - 支持 API OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2
 - 三个 CSI2.0 4L 摄像头串行接口 RX (CSI-RX) 以及两个具有 DPHY 的 CSI2.0 4L TX (CSI-TX)
 - 符合 MIPI CSI 1.3 标准 + MIPI-DPHY 1.2
 - CSI-RX 支持 1、2、3 或 4 数据通道模式，每通道速率高达 2.5Gbps

- CSI-TX 支持 1、2 或 4 数据通道模式，每通道速率高达 2.5Gbps
- 两个视频编码器/解码器模块
 - 支持 5.1 级高阶的 HEVC (H.265) Main 配置文件
 - 支持 5.2 级的 H.264 BaseLine/Main/High 配置文件
 - 每个模块支持高达 4K 超高清分辨率 (3840 × 2160)
 - 每个模块支持 4K60 H.264/H.265 编码/解码 (高达 480MP/s)

存储器子系统：

- 高达 8MB 的片上 L3 RAM (具有 ECC 和一致性)
 - ECC 错误保护
 - 共享一致性高速缓存
 - 支持内部 DMA 引擎
- 多达四个具有 ECC 的外部存储器接口 (EMIF) 模块
 - 支持 LPDDR4 存储器类型
 - 支持高达 4266MT/s 的速度
 - 多达 4 个具有内联 ECC 的 32 位总线，速率高达 68GB/s
- 通用存储器控制器 (GPMC)
- MAIN 域中有 512KB 片上 SRAM，受 ECC 保护
- 符合 AEC-Q100 标准 (以 Q1 结尾的器件型号)

器件安全：

- 安全启动，提供安全运行时支持
- 客户可编程的根密钥，级别高达 RSA-4K 或 ECC-512
- 嵌入式硬件安全模块
- 加密硬件加速器 - 带 ECC 的 PKA、AES、SHA、RNG、DES 和 3DES

高速串行接口：

- 集成以太网交换机，支持最多 8 个外部端口
 - 有两个端口支持 5Gb、10Gb USXGMII 或 5Gb XFI
 - 所有端口均支持 1Gb、2.5Gb SGMII
 - 所有端口均可支持 QSGMII。最多可启用 2 个 QSGMII 并使用所有 8 个内部通道。1 个 QSGMII 接口使用 4 个内部通道。



- 多达 4 个 2L/2 个 4L PCI-Express® (PCIe) 第 3 代控制器
 - 第 1 代 (2.5GT/s)、第 2 代 (5.0GT/s) 和第 3 代 (8.0GT/s) 运行，具有自动协商功能
- 一个 USB 3.0 双重角色设备 (DRD) 子系统
 - 增强型超高速第一代端口
 - 支持 Type-C 开关
 - 可独立配置为 USB 主机、USB 外设或 USB DRD

以太网

- 两个 RGMII/RMII 接口

汽车接口：

- 20 个模块化控制器局域网 (MCAN) 模块，具有完整 CAN-FD 支持

音频接口：

- 5 个多通道音频串行端口 (MCASP) 模块

2 应用

- 工业:
- 机器视觉摄像机和计算机
- 智能购物车
- 零售自动化
- 智能农业
- 视频监控
- 交通监控
- 自主移动机器人 (AMR)
- 无人机
- 工业运输
- 工业人机界面 (HMI)
- 工业 PC
- 单板计算机
- 患者监护和医疗设备

闪存接口：

- 嵌入式多媒体卡接口 (eMMC™ 5.1)
- 一个安全数字® 3.0/安全数字输入输出 3.0 接口 (SD3.0/SDIO3.0)
- 具有 2 个通道的通用闪存 (UFS 2.1) 接口
- 两个独立闪存接口，配置为
 - 一个 OSPI 或 HyperBus™ 或 QSPI 闪存接口，以及
 - 一个 QSPI 闪存接口

片上系统 (SoC) 架构：

- 16nm FinFET 技术
- 31mm × 31mm、0.8mm 间距、1414 引脚 FCBGA (ALY)，可实现 IPC 3 级 PCB 布线

TPS6594-Q1 配套电源管理 IC (PMIC)：

- 功能安全最高支持 ASIL-D/SIL-3
- 灵活的映射，可支持不同的用例

3 说明

AM69、AM69A 可扩展处理器系列采用不断发展的 Jacinto™ 7 架构，面向智能视觉摄像头应用，基于 TI 在视觉处理器市场上十多年所积累的广泛先进市场知识而构建。AM69x 系列专为工厂自动化、楼宇自动化和其他市场中广泛的成本敏感型高性能计算应用而构建。

AM69、AM69A 以业界卓越的功耗/性能比为传统和深度学习算法提供高性能计算技术，并且系统集成度高，可为高级视觉摄像头应用实现可扩展性和更低的成本。关键内核包括用于常规计算的新款 Arm 和 GPU 处理器、具有标量和矢量内核的下一代 DSP、专用深度学习和传统算法加速器、集成的下一代成像子系统 (ISP)、视频编解码器和隔离式 MCU 岛。所有这些都由工业级安全硬件加速器提供保护。

通用计算内核和集成概述： Arm® Cortex®-A72 的两个四核集群配置 (共 8 个内核) 有助于实现多操作系统应用，且对软件管理程序的需求非常低。最多两个双核 (共 4 个内核) Arm® Cortex®-R5F 子系统能够管理低级的时序关键型处理任务，使 Arm® Cortex®-A72 内核不受应用的影响。TI 的第 7 代 ISP 以现有出色的 ISP 为基础，能够灵活地处理更广泛的传感器套件，支持更高的位深度，并且具有面向分析应用的特性。集成的诊断和安全功能可支持高达 SIL-2 级别的运行，同时集成的安全功能可保护数据免受现代攻击。CSI2.0 端口支持多传感器输入。

主要高性能内核概述： C7000™ DSP 下一代内核 (“C7x”) 将 TI 先进的 DSP 和 EVE 内核整合到性能更高的单个内核中，并增加了浮点矢量计算功能，可实现对旧代码的向后兼容性，同时简化软件编程。即使在 105°C 和 125°C 的最坏情况结温下运行，四个 “MMAv2” 深度学习加速器也可在业界超低功率范围内实现高达 32 万亿次每秒运算 (TOPS) [每内核 8TOPS] 的性能。专用的视觉硬件加速器可提供视觉预处理，而不会影响系统性能。C7x/MMA 内核仅可用于 AM69、AM69A 级处理器中的深度学习功能。

封装信息

| 器件型号 | 封装 ⁽¹⁾ | 封装尺寸 ⁽²⁾ |
|---------|-------------------|---------------------|
| AM69A98 | ALY (FCBGA, 1414) | 31mm x 31mm |
| AM69A78 | ALY (FCBGA, 1414) | 31mm x 31mm |
| AM6958 | ALY (FCBGA, 1414) | 31mm x 31mm |
| XJ784S4 | ALY (FCBGA, 1414) | 31mm x 31mm |

- (1) 有关更多信息，请参阅 [机械、封装和可订购信息](#) 部分。
 (2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值，并包括引脚 (如适用)。

3.1 功能方框图

图 3-1 是器件的功能方框图。

备注

要了解 TI 软件开发套件 (SDK) 目前支持哪些器件功能，请参阅 [AM69 软件构建表 \(PROCESSOR-SDK-AM69\)](#) 和 [AM69A 软件构建表 \(PROCESSOR-SDK-AM69A\)](#)。

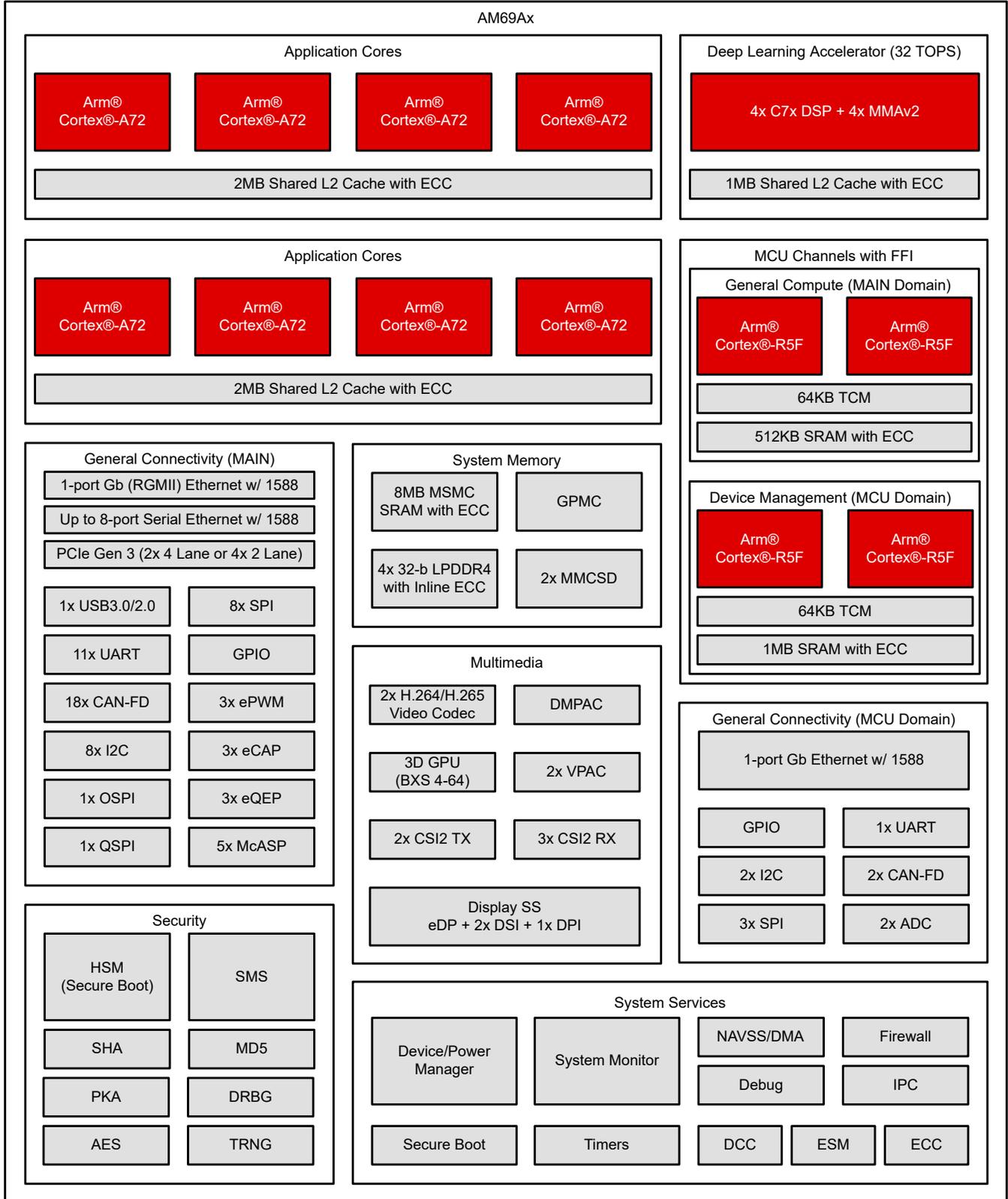


图 3-1. 功能方框图

内容

| | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| 1 特性 | 1 | 8 应用、实施和布局 | 295 |
| 2 应用 | 2 | 9 器件连接和布局基本准则 | 296 |
| 3 说明 | 3 | 9.1 电源去耦和大容量电容..... | 296 |
| 3.1 功能方框图..... | 3 | 9.2 外部振荡器..... | 296 |
| 4 器件比较 | 6 | 9.3 JTAG 和 EMU..... | 296 |
| 5 端子配置和功能 | 9 | 9.4 复位..... | 296 |
| 5.1 引脚图..... | 9 | 9.5 未使用的引脚..... | 296 |
| 5.2 引脚属性..... | 10 | 9.6 Jacinto™ 7 器件硬件设计指南..... | 296 |
| 5.3 信号说明..... | 92 | 10 外设和接口的相關设计信息 | 297 |
| 5.4 引脚连接要求..... | 139 | 10.1 LPDDR4 电路板设计和布局布线指南..... | 297 |
| 6 规格 | 144 | 10.2 OSPI 和 QSPI 电路板设计和布局指南..... | 297 |
| 6.1 绝对最大额定值..... | 144 | 10.3 USB VBUS 设计指南..... | 299 |
| 6.2 ESD 等级..... | 145 | 10.4 使用 VMON/POK 的系统电源监测设计指南..... | 300 |
| 6.3 通电时间 (POH) 限制..... | 146 | 10.5 高速差分信号布线指南..... | 301 |
| 6.4 建议运行条件..... | 146 | 10.6 散热解决方案指导..... | 301 |
| 6.5 运行性能点..... | 148 | 11 器件和文档支持 | 302 |
| 6.6 电气特性..... | 149 | 11.1 器件命名规则..... | 302 |
| 6.7 一次性可编程 (OTP) 电子保险丝的 VPP 规格..... | 155 | 11.2 工具与软件..... | 305 |
| 6.8 热阻特性..... | 157 | 11.3 文档支持..... | 305 |
| 6.9 温度传感器特性..... | 158 | 11.4 支持资源..... | 305 |
| 6.10 时序和开关特性..... | 159 | 11.5 商标..... | 305 |
| 7 详细说明 | 284 | 11.6 静电放电警告..... | 305 |
| 7.1 概述..... | 284 | 11.7 术语表..... | 305 |
| 7.2 功能方框图..... | 284 | 12 修订历史记录 | 306 |
| 7.3 处理器子系统..... | 286 | 13 机械、封装和可订购信息 | 307 |
| 7.4 加速器和协处理器..... | 287 | 13.1 封装信息..... | 307 |
| 7.5 其他子系统..... | 288 | | |

4 器件比较

表 4-1 展示了 SoC 的特性。

备注

要了解 TI 软件开发套件 (SDK) 目前支持哪些器件功能，请参阅 [AM69 软件构建表 \(PROCESSOR-SDK-AM69\)](#) 和 [AM69A 软件构建表 \(PROCESSOR-SDK-AM69A\)](#)。

表 4-1. 器件比较

| 特性 ⁽¹⁰⁾ | 参考名称 | AM69A98 | AM69A78 | AM6958 |
|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| 特性 | | | | |
| WKUP_CTRL_MMR_CFG0_JTAG_USER_ID[31:16] DEVICE_ID 寄存器位字段值 ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ | | 0x2BE0 | 0x2BE2 | 0x2BE3 |
| 处理器和加速器 | | | | |
| 速度等级 | | T | | |
| Arm Cortex-A72 微处理器子系统 | Arm A72 | 八核 | 八核 | 八核 |
| Arm Cortex-R5F | Arm R5F 器件管理 | 双核 ⁽¹²⁾ | | |
| | Arm R5F 通用计算 | 双核 ⁽¹²⁾ | | |
| 安全管理子系统 | SMS | 是 | | |
| 安全加速器 | SA | 是 | | |
| 深度学习加速器 (32 TOPS) | C7x DSP + MMA | 四核 ⁽¹³⁾ | 四核 ⁽¹³⁾ | 否 |
| 图形加速器 IMG BXS-4-64 | GPU | 是 | 否 | 是 |
| 深度和运动处理加速器 | DMPAC | 是 | | 否 |
| 视觉处理加速器 | VPAC | 2 | 2 | 否 |
| 视频编码器/解码器 | VENC/VDEC | 2 × 编码/解码 | 2 × 编码/解码 | |
| 安全与安防 | | | | |
| 以符合安全标准为目标 | 安全 | 否 ⁽¹⁾ | | |
| 器件安全性 | 安全性 | 可选 ⁽²⁾ | | |
| 符合 AEC-Q100 标准 | Q1 | 可选 ⁽³⁾ | | |
| 程序和数据存储 | | | | |
| MAIN 域中的片上共享存储器 (RAM) | OCSRAM | 512KB SRAM | | |
| MCU 域中的片上共享存储器 (RAM) | MCU_MSRAM | 1MB SRAM | | |
| 多核共享存储器控制器 | MSMC | 8MB (带 ECC 的片上 SRAM) | 8MB (带 ECC 的片上 SRAM) | |
| LPDDR4 DDR 子系统 | DDRSS0 ⁽⁵⁾ | 高达 8GB (32 位数据)，具有内联 ECC | | |
| | DDRSS1 ⁽⁵⁾ | 高达 8GB (32 位数据)，具有内联 ECC | | |
| | DDRSS2 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ | 高达 8GB (32 位数据)，具有内联 ECC | 高达 8GB (32 位数据)，具有内联 ECC | |
| | DDRSS3 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ | 高达 8GB (32 位数据)，具有内联 ECC | 高达 8GB (32 位数据)，具有内联 ECC | |
| | SECDED | 是 | | |
| 通用存储器控制器 | GPMC | 高达 1GB，具有 ECC | | |

表 4-1. 器件比较 (续)

| 特性 ⁽¹⁰⁾ | 参考名称 | AM69A98 | AM69A78 | AM6958 |
|--|-----------------------|--|---|--------|
| 外设 | | | | |
| 显示子系统 | DSS | | 是 | |
| | DSI 4L TX | | 2 | |
| | eDP 4L | | 1 | |
| | DPI | | 1 | |
| 模块化控制器区域网接口, 具有完整 CAN-FD 支持 | MCAN | | 20 | |
| 通用 I/O | GPIO | | 155 | |
| 内部集成电路接口 | I2C | | 10 | |
| 改进了内部集成电路接口 | I3C | | 1 | |
| 模数转换器 | ADC | | 2 | |
| 带摄像头串行接口的捕获子系统 (CSI2) | CSI2.0 4L RX | | 3 | |
| | CSI2.0 4L TX | | 2 | |
| 多通道串行外设接口 | MCSPi | | 11 | |
| 多通道音频串行端口 | MCASP0 | | 16 个串行器 | |
| | MCASP1 | | 5 个串行器 | |
| | MCASP2 | | 5 个串行器 | |
| | MCASP3 | | 3 个串行器 | |
| | MCASP4 | | 5 个串行器 | |
| 多媒体卡/安全数字接口 | MMCSD0 | | eMMC (8 位) | |
| | MMCSD1 | | SD/SDIO (4 位) | |
| 通用闪存存储 | UFS 2L | | 否 | |
| 闪存子系统 (FSS) | OSPI0 | | 8 位 ⁽⁸⁾ | |
| | OSPI1 ⁽¹¹⁾ | | 4 位 | |
| | HyperBus | | 是 ⁽⁸⁾ | |
| 4 个具有集成 PHY 的 PCI Express 端口 | PCIe | | 2x4L 或 4x2L ⁽⁶⁾ | |
| 以太网接口 | MCU CPSW2G | | RMII 或 RGMII | |
| | MAIN CPSW2G | | RMII 或 RGMII | |
| | CPSW9G | 8 端口串行器/解串器 ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ | 8 端口串行器/解串器 ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ | |
| 通用计时器 | 计时器 | | 30 | |
| 增强型高分辨率脉宽调制器模块 | eHRPWM | | 6 | |
| 增强型捕获模块 | eCAP | | 3 | |
| 增强型正交编码器脉冲模块 | eQEP | | 3 | |
| 通用异步接收器/发送器 | UART | | 12 | |
| 具有 SS PHY 的通用串行总线 (USB3.1) 超高速双角色设备 (DRD) 端口 | USB0 | | 是 ⁽⁶⁾ | |

- (1) 此器件系列不支持功能安全, 如果对此特性感兴趣, 请参阅 [TDA4VH 器件系列](#)。
- (2) 器件安全特性 (包括安全启动和客户可编程密钥) 适用于如 [命名规则说明表](#) 中的器件类型 (Y) 标识符所示的部分器件型号变体
- (3) 通过 AEC-Q100 认证适用于如 [命名规则说明表](#) 中的汽车标识符 (Q1) 标识符所示的部分器件型号变体
- (4) 此 SoC 的 27mm 封装型号不提供 DDRSS2 和 DDRSS3。如果希望与使用 27mm 封装的系统具有软件兼容性, 则不应使用 DDR2/DDR3
- (5) 必须始终按递增顺序使用 DDRSS0、DDRSS1、DDRSS2 和 DDRSS3。例如, 使用单个 LPDDR 元件时, 该元件必须连接到 DDR0_* 接口。当使用两个 LPDDR 元件时, 它们必须连接到 DDR0_* 和 DDR1_* 接口, 依此类推。
- (6) DP、SGMII、USB3.0 和 PCIe 共用总共 16 个串行器/解串器通道 (31mm 封装) 或 8 个串行器/解串器通道 (27mm 封装型号)。此 SoC 的 27mm 封装型号不提供 **SERDES0** 和 **SERDES2**。

(7) AM69、AM69A (31mm) CPSW 使用以下实例、信号和运行模式支持最多 8 个端口：

- PORT1 信号：SGMII1，模式：5Gb、10Gb USXGMII/XFI、2.5Gb SGMII/XAUI、1Gb SGMII、5Gb QSGMII 之一
- PORT2 信号：SGMII2，模式：5Gb、10Gb USXGMII/XFI、2.5Gb SGMII/XAUI、1Gb SGMII、5Gb QSGMII 之一
- PORTn (n=3 至 8) 信号：SGMII_n，模式：2.5Gb SGMII/XAUI、1Gb SGMII、5Gb QSGMII 之一

如果 QSGMII 用于 SGMII 端口 1 至 4 中的任一个，则 SGMII1/2/3/4 不能用于以太网功能，因为所有 4 个内部 CPSW 端口都映射到选定的 QSGMII SERDES 端口。

如果 QSGMII 用在 SGMII 端口 5 至 8 中的任一个上，则 SGMII5/6/7/8 不能用于以太网功能，因为所有 4 个内部 CPSW 端口都映射到选定的 QSGMII SERDES 端口。

- (8) 2 个同步闪存接口，配置为 OSPI0 和 OSPI1 或 HyperBus 和 OSPI1。
- (9) 有关 WKUP_CTRL_MMR_CFG0_JTAG_USER_ID 寄存器和 DEVICE_ID 位字段的更多详细信息，请参阅器件 TRM。
- (10) J784S4 是超集器件的基本器件型号。软件应限制用于匹配预期生产器件的功能。(WKUP_CTRL_MMR_CFG0_JTAG_USER_ID[31:16] "DEVICE_ID" 寄存器位字段值：0x2B21。)
- (11) OSPI1 模块仅对 4 个引脚进行引脚分配，在一些上下文中被称为 QSPI。
- (12) MCU_R5FSS0 包括提供器件管理功能的双核 R5F，保留用于执行 TI 提供的代码。
R5FSS1 是提供多媒体控制功能的双核 R5F，保留用于执行 TI 提供的代码。
- (13) 深度学习加速器 C7x + MMA 保留用于执行 TI 提供的代码，不可用于自定义代码。

5 端子配置和功能

5.1 引脚图

备注

在整个文档中，术语“焊球”、“引脚”和“端子”可互换使用。仅在提及物理封装时才尝试使用“焊球”。

图 5-1 展示了 1414 球倒装晶片球栅阵列 (FCBGA) 封装的焊球位置，用以快速找到信号名称和球栅编号。该图应与表 5-1 至表 5-121 (引脚属性表和所有信号说明表，包括引脚连接要求表) 配合使用。

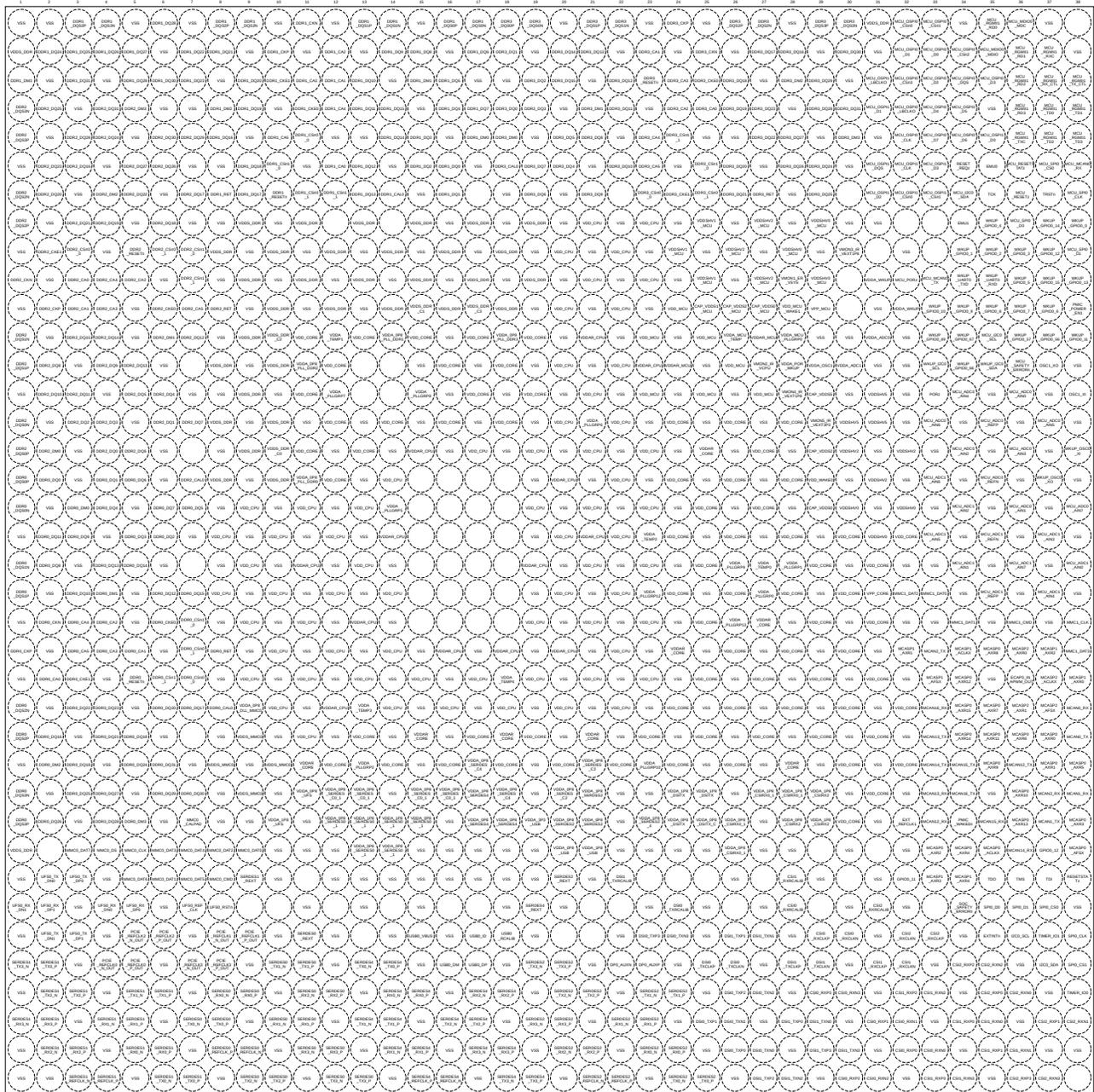


图 5-1. ALY FCBGA-N1414 引脚图 (顶视图)

5.2 引脚属性

1. **焊球编号**：分配给 Ball Grid Array 封装每个端子的焊球编号。
2. **焊球名称**：分配给 Ball Grid Array 封装每个端子的焊球名称（该名称通常取自自主 MUXMODE 0 信号功能）。
3. **信号名称**：与焊球相关的所有专用和引脚多路复用信号功能的信号名称。

备注

引脚属性 表定义了引脚上实现的 SoC 引脚多路复用信号功能，而未定义器件子系统中实现的信号功能的次级多路复用。该表未说明信号功能的次级多路复用。有关辅助多路复用信号功能的更多信息，请参阅器件 TRM 的相应外设章节。

4. **多路复用模式**：与每个引脚多路复用信号功能相关的 MUXMODE 值：
 - MUXMODE 0 是主要引脚多路复用信号功能。然而，主要引脚多路复用信号功能不一定是默认引脚多路复用信号功能。
 - MUXMODE 值 1 至 15 可用于引脚多路复用信号功能。然而，并非所有 MUXMODE 值都已实现。仅有的有效 MUXMODE 值是引脚属性表中定义为引脚多路复用信号功能的值。只能使用 MUXMODE 的有效值。
 - 自举定义了 SOC 配置引脚，其中应用于每个引脚的逻辑状态在 PORz_OUT 的上升沿被锁存。这些输入信号功能固定到各自的引脚，不能通过 MUXMODE 进行编程。
 - 空框或“-”表示不适用。

备注

- “复位之后的多路复用模式”列中的值定义了 MCU_PORz 被置为无效时选择的默认引脚多路复用信号功能。
 - 将两个引脚配置为相同的引脚多路复用信号功能可能会产生意外结果，因此不受支持。适当的软件配置可以防止这种情况发生。
 - 将焊盘配置为未定义的多路复用模式会导致未定义的行为，因此必须避免。
-

5. **信号类型**：信号类型和方向：
 - I = 输入
 - O = 输出
 - OD = 输出，具有开漏输出功能
 - IO = 输入、输出或同时输入和输出
 - IOD = 输入、输出或同时输入和输出，具有开漏输出功能
 - IOZ = 输入、输出或同时输入和输出，具有三态输出功能
 - OZ = 具有三态输出功能的输出
 - A = 模拟
 - CAP = LDO 电容器
 - PWR = 电源
 - GND = 接地
6. **I/O 电压值**：此列说明了 IO 电压值（相应的电源）。空框表示不适用。
7. **复位期间的焊球状态 (RX/TX/拉动)**：MCU_PORz 被置为有效时的端子状态，其中 RX 定义输入缓冲器的状态，TX 定义输出缓冲器的状态，“拉动”定义内部拉动电阻器的状态：
 - RX (输入缓冲器)
 - 关闭：输入缓冲器被禁用。
 - 开启：输入缓冲器被启用。
 - TX (输出缓冲器)
 - 关闭：输出缓冲器被禁用。

- 低电平：输出缓冲器被启用并驱动 V_{OL} 。
 - 高电平：输出缓冲器被启用并驱动 V_{OH} 。
 - 拉动 (内部拉电阻器)
 - 关闭：内部拉电阻器被关闭。
 - 上拉：内部上拉电阻器被开启。
 - 下拉：内部下拉电阻器被开启。
 - 不适用：无内部拉电阻器。
 - 空框或 “-” 表示不适用。
8. **复位之后的焊球状态 (RX/TX/拉动)**：MCU_PORz 被置为无效后的端子状态，其中 RX 定义输入缓冲器的状态，TX 定义输出缓冲器的状态，“拉动”定义内部拉动电阻器的状态：
- RX (输入缓冲器)
 - 关闭：输入缓冲器被禁用。
 - 开启：输入缓冲器被启用。
 - TX (输出缓冲器)
 - 关闭：输出缓冲器被禁用。
 - SS：使用 MUXMODE 选择的子系统决定输出缓冲器状态。
 - 拉动 (内部拉电阻器)
 - 关闭：内部拉电阻器被关闭。
 - 上拉：内部上拉电阻器被开启。
 - 下拉：内部下拉电阻器被开启。
 - 不适用：无内部拉电阻器。
 - 空框、不适用或 “-” 表示不适用。
9. **复位之后的多路复用模式**：该列中的值定义了 MCU_PORz 被置为无效后的默认引脚多路复用信号功能。
- 空框、不适用或 “-” 表示不适用。
10. **拉动类型**：指示存在内部上拉或下拉电阻器。可通过软件来启用或禁用上拉和下拉电阻器。
- PU：仅内部上拉电阻
 - PD：仅内部下拉电阻
 - PU/PD：内部上拉和下拉
 - 空框、NA 或 “-” 表示无内部拉动。

备注

不支持将两个引脚配置为同一引脚多路复用信号功能，因为这可能会产生意外结果。适当的软件配置可以轻松防止这种情况发生。

当某焊盘被设定为未由引脚多路复用定义的多路复用模式时，该焊盘的运行方式是未定义的。必须避免这种情况。

11. **电源**：相关 I/O 的电源 (如果适用)。
- 空框、不适用或 “-” 表示不适用。
12. **Hys**：指示与该 I/O 关联的输入缓冲器是否具有迟滞：
- 是：滞后支持
 - 否：无迟滞支持
 - 空框、不适用或 “-” 表示不适用。

有关更多信息，请参阅[电气特性](#)一节中的迟滞值。

13. **电压缓冲器类型**：该列定义与端子关联的缓冲器类型。该信息可用于确定适用的“电气特性”表。
- 空框、不适用或 “-” 表示不适用。

有关电气特性，请参阅[电气特性](#)一节中相应的缓冲器类型表。

14. **IO RET**：“是”意味着支持 WKUP 和 IO 保持。
15. **焊盘配置寄存器名称**：这是器件焊盘/引脚配置寄存器的名称。
16. **焊盘配置寄存器地址**：这是器件焊盘/引脚配置寄存器的存储器地址。

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|---------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|---|-------------|--------------------------------------|----------------|
| V29 | CAP_VDDS0 | CAP_VDDS0 | | CAP | | | | | | | | | |
| L27 | CAP_VDDS0_MCU | CAP_VDDS0_MCU | | CAP | | | | | | | | | |
| L25 | CAP_VDDS1_MCU | CAP_VDDS1_MCU | | CAP | | | | | | | | | |
| T29 | CAP_VDDS2 | CAP_VDDS2 | | CAP | | | | | | | | | |
| L26 | CAP_VDDS2_MCU | CAP_VDDS2_MCU | | CAP | | | | | | | | | |
| P29 | CAP_VDDS5 | CAP_VDDS5 | | CAP | | | | | | | | | |
| AN30 | CSI0_RXCLKN | CSI0_RXCLKN | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1 | | D-PHY | |
| AN29 | CSI0_RXCLKP | CSI0_RXCLKP | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1 | | D-PHY | |
| AM28 | CSI0_RXRCALIB | CSI0_RXRCALIB | | A | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1 | | D-PHY | |
| AP32 | CSI1_RXCLKN | CSI1_RXCLKN | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1 | | D-PHY | |
| AP31 | CSI1_RXCLKP | CSI1_RXCLKP | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1 | | D-PHY | |
| AL28 | CSI1_RXRCALIB | CSI1_RXRCALIB | | A | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1 | | D-PHY | |
| AN32 | CSI2_RXCLKN | CSI2_RXCLKN | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_C SIRX2/ VDDA_1P8_C SIRX2 | | D-PHY | |
| AN33 | CSI2_RXCLKP | CSI2_RXCLKP | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_C SIRX2/ VDDA_1P8_C SIRX2 | | D-PHY | |
| AM31 | CSI2_RXRCALIB | CSI2_RXRCALIB | | A | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_C SIRX2/ VDDA_1P8_C SIRX2 | | D-PHY | |
| AU33 | CSI0_RXN0 | CSI0_RXN0 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1 | | D-PHY | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|---|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AT32 | CSI0_RXN1 | CSI0_RXN1 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1 | | D-PHY | |
| AV31 | CSI0_RXN2 | CSI0_RXN2 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1 | | D-PHY | |
| AR30 | CSI0_RXN3 | CSI0_RXN3 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1 | | D-PHY | |
| AU32 | CSI0_RXP0 | CSI0_RXP0 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1 | | D-PHY | |
| AT31 | CSI0_RXP1 | CSI0_RXP1 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1 | | D-PHY | |
| AV30 | CSI0_RXP2 | CSI0_RXP2 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1 | | D-PHY | |
| AR29 | CSI0_RXP3 | CSI0_RXP3 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1 | | D-PHY | |
| AT35 | CSI1_RXN0 | CSI1_RXN0 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1 | | D-PHY | |
| AU36 | CSI1_RXN1 | CSI1_RXN1 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1 | | D-PHY | |
| AR33 | CSI1_RXN2 | CSI1_RXN2 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1 | | D-PHY | |
| AV34 | CSI1_RXN3 | CSI1_RXN3 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1 | | D-PHY | |
| AT34 | CSI1_RXP0 | CSI1_RXP0 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1 | | D-PHY | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|---|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AU35 | CSI1_RXP1 | CSI1_RXP1 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1 | | D-PHY | |
| AR32 | CSI1_RXP2 | CSI1_RXP2 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1 | | D-PHY | |
| AV33 | CSI1_RXP3 | CSI1_RXP3 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_C SIRX0_1/ VDDA_1P8_C SIRX0_1 | | D-PHY | |
| AR36 | CSI2_RXN0 | CSI2_RXN0 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_C SIRX2/ VDDA_1P8_C SIRX2 | | D-PHY | |
| AT38 | CSI2_RXN1 | CSI2_RXN1 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_C SIRX2/ VDDA_1P8_C SIRX2 | | D-PHY | |
| AP35 | CSI2_RXN2 | CSI2_RXN2 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_C SIRX2/ VDDA_1P8_C SIRX2 | | D-PHY | |
| AV37 | CSI2_RXN3 | CSI2_RXN3 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_C SIRX2/ VDDA_1P8_C SIRX2 | | D-PHY | |
| AR35 | CSI2_RXP0 | CSI2_RXP0 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_C SIRX2/ VDDA_1P8_C SIRX2 | | D-PHY | |
| AT37 | CSI2_RXP1 | CSI2_RXP1 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_C SIRX2/ VDDA_1P8_C SIRX2 | | D-PHY | |
| AP34 | CSI2_RXP2 | CSI2_RXP2 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_C SIRX2/ VDDA_1P8_C SIRX2 | | D-PHY | |
| AV36 | CSI2_RXP3 | CSI2_RXP3 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_C SIRX2/ VDDA_1P8_C SIRX2 | | D-PHY | |
| AB2 | DDR0_CKN | DDR0_CKN | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AC1 | DDR0_CKP | DDR0_CKP | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AD5 | DDR0_RESETh | DDR0_RESETh | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AC8 | DDR0_RET | DDR0_RET | | I | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| A11 | DDR1_CKN | DDR1_CKN | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| B10 | DDR1_CKP | DDR1_CKP | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| G10 | DDR1_RESETh | DDR1_RESETh | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| G8 | DDR1_RET | DDR1_RET | | I | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| K1 | DDR2_CKN | DDR2_CKN | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| L2 | DDR2_CKP | DDR2_CKP | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| J5 | DDR2_RESETh | DDR2_RESETh | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| L8 | DDR2_RET | DDR2_RET | | I | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| B25 | DDR3_CKN | DDR3_CKN | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| A24 | DDR3_CKP | DDR3_CKP | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| C23 | DDR3_RESETh | DDR3_RESETh | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| G27 | DDR3_RET | DDR3_RET | | I | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| AD2 | DDR0_CA0 | DDR0_CA0 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AC5 | DDR0_CA1 | DDR0_CA1 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AB4 | DDR0_CA2 | DDR0_CA2 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AC4 | DDR0_CA3 | DDR0_CA3 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AB3 | DDR0_CA4 | DDR0_CA4 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AC3 | DDR0_CA5 | DDR0_CA5 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AE8 | DDR0_CAL0 | DDR0_CAL0 | | A | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AB6 | DDR0_CKE0 | DDR0_CKE0 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AD3 | DDR0_CKE1 | DDR0_CKE1 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AD7 | DDR0_CSn0_0 | DDR0_CSn0_0 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AC7 | DDR0_CSn0_1 | DDR0_CSn0_1 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AB7 | DDR0_CSn1_0 | DDR0_CSn1_0 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AD6 | DDR0_CSn1_1 | DDR0_CSn1_1 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| V3 | DDR0_DM0 | DDR0_DM0 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AA4 | DDR0_DM1 | DDR0_DM1 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AG2 | DDR0_DM2 | DDR0_DM2 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AJ5 | DDR0_DM3 | DDR0_DM3 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| U2 | DDR0_DQ0 | DDR0_DQ0 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| U4 | DDR0_DQ1 | DDR0_DQ1 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| W6 | DDR0_DQ2 | DDR0_DQ2 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| W5 | DDR0_DQ3 | DDR0_DQ3 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| V4 | DDR0_DQ4 | DDR0_DQ4 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| V7 | DDR0_DQ5 | DDR0_DQ5 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| U5 | DDR0_DQ6 | DDR0_DQ6 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| V6 | DDR0_DQ7 | DDR0_DQ7 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| Y2 | DDR0_DQ8 | DDR0_DQ8 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| W3 | DDR0_DQ9 | DDR0_DQ9 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AA3 | DDR0_DQ10 | DDR0_DQ10 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| W2 | DDR0_DQ11 | DDR0_DQ11 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AA6 | DDR0_DQ12 | DDR0_DQ12 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| Y4 | DDR0_DQ13 | DDR0_DQ13 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| Y5 | DDR0_DQ14 | DDR0_DQ14 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AA7 | DDR0_DQ15 | DDR0_DQ15 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AF2 | DDR0_DQ16 | DDR0_DQ16 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AE7 | DDR0_DQ17 | DDR0_DQ17 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AG3 | DDR0_DQ18 | DDR0_DQ18 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AF5 | DDR0_DQ19 | DDR0_DQ19 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AE6 | DDR0_DQ20 | DDR0_DQ20 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AF4 | DDR0_DQ21 | DDR0_DQ21 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AE3 | DDR0_DQ22 | DDR0_DQ22 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AE4 | DDR0_DQ23 | DDR0_DQ23 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AG5 | DDR0_DQ24 | DDR0_DQ24 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AH3 | DDR0_DQ25 | DDR0_DQ25 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AJ2 | DDR0_DQ26 | DDR0_DQ26 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AH4 | DDR0_DQ27 | DDR0_DQ27 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AJ4 | DDR0_DQ28 | DDR0_DQ28 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AH6 | DDR0_DQ29 | DDR0_DQ29 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AH7 | DDR0_DQ30 | DDR0_DQ30 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AG6 | DDR0_DQ31 | DDR0_DQ31 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| V1 | DDR0_DQS0N | DDR0_DQS0N | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| U1 | DDR0_QQS0P | DDR0_QQS0P | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| Y1 | DDR0_QQS1N | DDR0_QQS1N | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AA1 | DDR0_QQS1P | DDR0_QQS1P | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AE1 | DDR0_QQS2N | DDR0_QQS2N | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AF1 | DDR0_QQS2P | DDR0_QQS2P | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AH1 | DDR0_QQS3N | DDR0_QQS3N | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| AJ1 | DDR0_QQS3P | DDR0_QQS3P | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C0 | | DDR | |
| F12 | DDR1_CA0 | DDR1_CA0 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| C12 | DDR1_CA1 | DDR1_CA1 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| B12 | DDR1_CA2 | DDR1_CA2 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| C11 | DDR1_CA3 | DDR1_CA3 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| D12 | DDR1_CA4 | DDR1_CA4 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| E10 | DDR1_CA5 | DDR1_CA5 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| G14 | DDR1_CAL0 | DDR1_CAL0 | | A | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| D11 | DDR1_CKE0 | DDR1_CKE0 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| C10 | DDR1_CKE1 | DDR1_CKE1 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| E11 | DDR1_CS0_0 | DDR1_CS0_0 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| G11 | DDR1_CS0_1 | DDR1_CS0_1 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| F10 | DDR1_CS1_0 | DDR1_CS1_0 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| G12 | DDR1_CS1_1 | DDR1_CS1_1 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| E17 | DDR1_DM0 | DDR1_DM0 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| C15 | DDR1_DM1 | DDR1_DM1 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| D8 | DDR1_DM2 | DDR1_DM2 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| C1 | DDR1_DM3 | DDR1_DM3 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| F16 | DDR1_DQ0 | DDR1_DQ0 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| G16 | DDR1_DQ1 | DDR1_DQ1 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| F15 | DDR1_DQ2 | DDR1_DQ2 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| E15 | DDR1_DQ3 | DDR1_DQ3 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| D16 | DDR1_DQ4 | DDR1_DQ4 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| C16 | DDR1_DQ5 | DDR1_DQ5 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| B17 | DDR1_DQ6 | DDR1_DQ6 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| D17 | DDR1_DQ7 | DDR1_DQ7 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| B15 | DDR1_DQ8 | DDR1_DQ8 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| B14 | DDR1_DQ9 | DDR1_DQ9 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| C13 | DDR1_DQ10 | DDR1_DQ10 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| D13 | DDR1_DQ11 | DDR1_DQ11 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| F13 | DDR1_DQ12 | DDR1_DQ12 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| G13 | DDR1_DQ13 | DDR1_DQ13 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| E14 | DDR1_DQ14 | DDR1_DQ14 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| D14 | DDR1_DQ15 | DDR1_DQ15 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| E8 | DDR1_DQ16 | DDR1_DQ16 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| G9 | DDR1_DQ17 | DDR1_DQ17 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| F9 | DDR1_DQ18 | DDR1_DQ18 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| D9 | DDR1_DQ19 | DDR1_DQ19 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| C9 | DDR1_DQ20 | DDR1_DQ20 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| B8 | DDR1_DQ21 | DDR1_DQ21 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| B7 | DDR1_DQ22 | DDR1_DQ22 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| C7 | DDR1_DQ23 | DDR1_DQ23 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉动 类型 [10] | 电源 [11] | Hys [12] | 电压 缓冲器 类型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------------|----------------|
| B2 | DDR1_DQ24 | DDR1_DQ24 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| B3 | DDR1_DQ25 | DDR1_DQ25 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| B4 | DDR1_DQ26 | DDR1_DQ26 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| B5 | DDR1_DQ27 | DDR1_DQ27 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| A6 | DDR1_DQ28 | DDR1_DQ28 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| C5 | DDR1_DQ29 | DDR1_DQ29 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| C6 | DDR1_DQ30 | DDR1_DQ30 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| C3 | DDR1_DQ31 | DDR1_DQ31 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| A17 | DDR1_QS0N | DDR1_QS0N | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| A16 | DDR1_QS0P | DDR1_QS0P | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| A14 | DDR1_QS1N | DDR1_QS1N | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| A13 | DDR1_QS1P | DDR1_QS1P | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| A9 | DDR1_QS2N | DDR1_QS2N | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| A8 | DDR1_QS2P | DDR1_QS2P | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| A4 | DDR1_QS3N | DDR1_QS3N | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |
| A3 | DDR1_QS3P | DDR1_QS3P | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C1 | | DDR | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| K3 | DDR2_CA0 | DDR2_CA0 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| L3 | DDR2_CA1 | DDR2_CA1 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| K5 | DDR2_CA2 | DDR2_CA2 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| L4 | DDR2_CA3 | DDR2_CA3 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| K4 | DDR2_CA4 | DDR2_CA4 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| L7 | DDR2_CA5 | DDR2_CA5 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| U7 | DDR2_CAL0 | DDR2_CAL0 | | A | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| L6 | DDR2_CKE0 | DDR2_CKE0 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| J2 | DDR2_CKE1 | DDR2_CKE1 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| J3 | DDR2_CSn0_0 | DDR2_CSn0_0 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| J6 | DDR2_CSn0_1 | DDR2_CSn0_1 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| J7 | DDR2_CSn1_0 | DDR2_CSn1_0 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| K7 | DDR2_CSn1_1 | DDR2_CSn1_1 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| T2 | DDR2_DM0 | DDR2_DM0 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| M6 | DDR2_DM1 | DDR2_DM1 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| G4 | DDR2_DM2 | DDR2_DM2 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| D5 | DDR2_DM3 | DDR2_DM3 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| T4 | DDR2_DQ0 | DDR2_DQ0 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| R6 | DDR2_DQ1 | DDR2_DQ1 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| R3 | DDR2_DQ2 | DDR2_DQ2 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| R4 | DDR2_DQ3 | DDR2_DQ3 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| P6 | DDR2_DQ4 | DDR2_DQ4 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| P5 | DDR2_DQ5 | DDR2_DQ5 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| T5 | DDR2_DQ6 | DDR2_DQ6 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| R7 | DDR2_DQ7 | DDR2_DQ7 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| N2 | DDR2_DQ8 | DDR2_DQ8 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| N4 | DDR2_DQ9 | DDR2_DQ9 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| P2 | DDR2_DQ10 | DDR2_DQ10 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| P3 | DDR2_DQ11 | DDR2_DQ11 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| M7 | DDR2_DQ12 | DDR2_DQ12 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| N5 | DDR2_DQ13 | DDR2_DQ13 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| M4 | DDR2_DQ14 | DDR2_DQ14 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| M3 | DDR2_DQ15 | DDR2_DQ15 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| F3 | DDR2_DQ16 | DDR2_DQ16 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| G7 | DDR2_DQ17 | DDR2_DQ17 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| H6 | DDR2_DQ18 | DDR2_DQ18 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| H4 | DDR2_DQ19 | DDR2_DQ19 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| G2 | DDR2_DQ20 | DDR2_DQ20 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| H3 | DDR2_DQ21 | DDR2_DQ21 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| G5 | DDR2_DQ22 | DDR2_DQ22 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| F2 | DDR2_DQ23 | DDR2_DQ23 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| E4 | DDR2_DQ24 | DDR2_DQ24 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| D2 | DDR2_DQ25 | DDR2_DQ25 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| F6 | DDR2_DQ26 | DDR2_DQ26 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| F5 | DDR2_DQ27 | DDR2_DQ27 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| E3 | DDR2_DQ28 | DDR2_DQ28 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| E7 | DDR2_DQ29 | DDR2_DQ29 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| E6 | DDR2_DQ30 | DDR2_DQ30 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| D4 | DDR2_DQ31 | DDR2_DQ31 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| R1 | DDR2_DQS0N | DDR2_DQS0N | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| T1 | DDR2_DQS0P | DDR2_DQS0P | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| M1 | DDR2_DQS1N | DDR2_DQS1N | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| N1 | DDR2_DQS1P | DDR2_DQS1P | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| G1 | DDR2_DQS2N | DDR2_DQS2N | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| H1 | DDR2_DQS2P | DDR2_DQS2P | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| D1 | DDR2_DQS3N | DDR2_DQS3N | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| E1 | DDR2_DQS3P | DDR2_DQS3P | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C2 | | DDR | |
| D25 | DDR3_CA0 | DDR3_CA0 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| B23 | DDR3_CA1 | DDR3_CA1 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| D24 | DDR3_CA2 | DDR3_CA2 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| C24 | DDR3_CA3 | DDR3_CA3 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| E23 | DDR3_CA4 | DDR3_CA4 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| F23 | DDR3_CA5 | DDR3_CA5 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| F18 | DDR3_CAL0 | DDR3_CAL0 | | A | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| C25 | DDR3_CKE0 | DDR3_CKE0 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| G24 | DDR3_CKE1 | DDR3_CKE1 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| G23 | DDR3_CSn0_0 | DDR3_CSn0_0 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| G25 | DDR3_CSn0_1 | DDR3_CSn0_1 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| F25 | DDR3_CSn1_0 | DDR3_CSn1_0 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| E24 | DDR3_CSn1_1 | DDR3_CSn1_1 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| E18 | DDR3_DM0 | DDR3_DM0 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| D21 | DDR3_DM1 | DDR3_DM1 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| C28 | DDR3_DM2 | DDR3_DM2 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| E30 | DDR3_DM3 | DDR3_DM3 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| D18 | DDR3_DQ0 | DDR3_DQ0 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| B18 | DDR3_DQ1 | DDR3_DQ1 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| C19 | DDR3_DQ2 | DDR3_DQ2 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| D19 | DDR3_DQ3 | DDR3_DQ3 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| F20 | DDR3_DQ4 | DDR3_DQ4 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| E20 | DDR3_DQ5 | DDR3_DQ5 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| G19 | DDR3_DQ6 | DDR3_DQ6 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| F19 | DDR3_DQ7 | DDR3_DQ7 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| E21 | DDR3_DQ8 | DDR3_DQ8 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| G21 | DDR3_DQ9 | DDR3_DQ9 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| F22 | DDR3_DQ10 | DDR3_DQ10 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| D22 | DDR3_DQ11 | DDR3_DQ11 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| C22 | DDR3_DQ12 | DDR3_DQ12 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| B21 | DDR3_DQ13 | DDR3_DQ13 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| B20 | DDR3_DQ14 | DDR3_DQ14 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| C20 | DDR3_DQ15 | DDR3_DQ15 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| B28 | DDR3_DQ16 | DDR3_DQ16 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| B27 | DDR3_DQ17 | DDR3_DQ17 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| C26 | DDR3_DQ18 | DDR3_DQ18 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| D26 | DDR3_DQ19 | DDR3_DQ19 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| F26 | DDR3_DQ20 | DDR3_DQ20 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| G26 | DDR3_DQ21 | DDR3_DQ21 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| E27 | DDR3_DQ22 | DDR3_DQ22 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| D27 | DDR3_DQ23 | DDR3_DQ23 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| F29 | DDR3_DQ24 | DDR3_DQ24 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| G29 | DDR3_DQ25 | DDR3_DQ25 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| F28 | DDR3_DQ26 | DDR3_DQ26 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| E28 | DDR3_DQ27 | DDR3_DQ27 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| D29 | DDR3_DQ28 | DDR3_DQ28 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| C29 | DDR3_DQ29 | DDR3_DQ29 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| B30 | DDR3_DQ30 | DDR3_DQ30 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| D30 | DDR3_DQ31 | DDR3_DQ31 | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| A19 | DDR3_DQS0N | DDR3_DQS0N | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| A18 | DDR3_DQS0P | DDR3_DQS0P | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| A22 | DDR3_DQS1N | DDR3_DQS1N | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| A21 | DDR3_DQS1P | DDR3_DQS1P | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| A27 | DDR3_DQS2N | DDR3_DQS2N | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| A26 | DDR3_DQS2P | DDR3_DQS2P | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|---------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------|--------------------------------------|----------------|
| A30 | DDR3_DQS3N | DDR3_DQS3N | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| A29 | DDR3_DQS3P | DDR3_DQS3P | | IO | 1.1V | | | | | VDDS_DDR/ VDDS_DDR_ C3 | | DDR | |
| AP22 | DP0_AUXN | DP0_AUXN | | IO | 1.8V | | | | | VDDA_1P8_S ERDES2_4 | | AUX-PHY | |
| AP23 | DP0_AUXP | DP0_AUXP | | IO | 1.8V | | | | | VDDA_1P8_S ERDES2_4 | | AUX-PHY | |
| AP26 | DSI0_TXCLKN | CSI0_TXCLKN | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX | | D-PHY | |
| | | DSI0_TXCLKN | | O | | | | | | | | | |
| AP25 | DSI0_TXCLKP | DSI0_TXCLKP | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX | | D-PHY | |
| | | CSI0_TXCLKP | | O | | | | | | | | | |
| AM24 | DSI0_TXRCALIB | DSI0_TXRCALIB | | A | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX | | D-PHY | |
| AP29 | DSI1_TXCLKN | DSI1_TXCLKN | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX | | D-PHY | |
| | | CSI1_TXCLKN | | O | | | | | | | | | |
| AP28 | DSI1_TXCLKP | CSI1_TXCLKP | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX | | D-PHY | |
| | | DSI1_TXCLKP | | O | | | | | | | | | |
| AL22 | DSI1_TXRCALIB | DSI1_TXRCALIB | | A | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX | | D-PHY | |
| AU27 | DSI0_TXN0 | CSI0_TXN0 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX | | D-PHY | |
| | | DSI0_TXN0 | | IO | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AT26 | DSI0_TXN1 | DSI0_TXN1 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX | | D-PHY | |
| | | CSI0_TXN1 | | O | | | | | | | | | |
| AR27 | DSI0_TXN2 | DSI0_TXN2 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX | | D-PHY | |
| | | CSI0_TXN2 | | O | | | | | | | | | |
| AN24 | DSI0_TXN3 | DSI0_TXN3 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX | | D-PHY | |
| | | CSI0_TXN3 | | O | | | | | | | | | |
| AU26 | DSI0_TXP0 | DSI0_TXP0 | | IO | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX | | D-PHY | |
| | | CSI0_TXP0 | | O | | | | | | | | | |
| AT25 | DSI0_TXP1 | DSI0_TXP1 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX | | D-PHY | |
| | | CSI0_TXP1 | | O | | | | | | | | | |
| AR26 | DSI0_TXP2 | CSI0_TXP2 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX | | D-PHY | |
| | | DSI0_TXP2 | | O | | | | | | | | | |
| AN23 | DSI0_TXP3 | CSI0_TXP3 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX | | D-PHY | |
| | | DSI0_TXP3 | | O | | | | | | | | | |
| AT29 | DSI1_TXN0 | CSI1_TXN0 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX | | D-PHY | |
| | | DSI1_TXN0 | | IO | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AN27 | DSI1_TXN1 | CSI1_TXN1 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX | | D-PHY | |
| | | DSI1_TXN1 | | O | | | | | | | | | |
| AV28 | DSI1_TXN2 | DSI1_TXN2 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX | | D-PHY | |
| | | CSI1_TXN2 | | O | | | | | | | | | |
| AU30 | DSI1_TXN3 | DSI1_TXN3 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX | | D-PHY | |
| | | CSI1_TXN3 | | O | | | | | | | | | |
| AT28 | DSI1_TXP0 | CSI1_TXP0 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX | | D-PHY | |
| | | DSI1_TXP0 | | IO | | | | | | | | | |
| AN26 | DSI1_TXP1 | DSI1_TXP1 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX | | D-PHY | |
| | | CSI1_TXP1 | | O | | | | | | | | | |
| AV27 | DSI1_TXP2 | DSI1_TXP2 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX | | D-PHY | |
| | | CSI1_TXP2 | | O | | | | | | | | | |
| AU29 | DSI1_TXP3 | CSI1_TXP3 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_D SITX/ VDDA_0P8_D SITX_C/ VDDA_1P8_D SITX | | D-PHY | |
| | | DSI1_TXP3 | | O | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用模 式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的焊 球状 态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的焊 球状 态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的多 路复 用模 式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|--|-------------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AD36 | ECAP0_IN_APWM_OUT PADCFG: PADCONFIG_49 0x0011C0C4 | ECAP0_IN_APWM_OUT | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCASP4_AXR2 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | CPTS0_RFT_CLK | 2 | I | | | | | | | | | |
| | | MCAN12_TX | 4 | O | | | | | | | | | |
| | | VOUT0_DATA23 | 5 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_AD5 | 6 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_49 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | SPI6_D0 | 8 | IO | | | | | | | | | |
| | | SYNC0_OUT | 9 | O | | | | | | | | | |
| | | TRC_DATA1 | 10 | O | | | | | | | | | |
| | | UART2_CTSn | 11 | I | | | | | | | | | |
| | | CPTS0_HW1TSPUSH | 12 | I | | | | | | | | | |
| | | I2C1_SCL | 13 | IOD | | | | | | | | | |
| | | UART3_RXD | 14 | I | | | | | | | | | |
| F35 | EMU0 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_75 0x4301C12C | EMU0 | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 开启/关闭/上拉 | 开启/关闭/上拉 | 0 | PU/PD | VDDSHV0_MCU | 是 | LVCMOS | 否 |
| H34 | EMU1 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_76 0x4301C130 | EMU1 | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 开启/关闭/上拉 | 开启/关闭/上拉 | 0 | PU/PD | VDDSHV0_MCU | 是 | LVCMOS | 否 |
| | | MCU_OBSCLK0 | 15 | O | | | | | | | | | |
| AN35 | EXTINTn PADCFG: PADCONFIG_0 0x0011C000 | EXTINTn | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/SS/关闭 | 7 | | VDDSHV0 | 是 | I2C 开漏 | 否 |
| | | GPIO0_0 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| AJ32 | EXT_REFCLK1 PADCFG: PADCONFIG_50 0x0011C0C8 | EXT_REFCLK1 | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCASP4_ACLKX | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | VOUT0_DATA16 | 2 | O | | | | | | | | | |
| | | MCAN1_RX | 4 | I | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_AD6 | 6 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_50 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | SYNC1_OUT | 9 | O | | | | | | | | | |
| | | TRC_CLK | 10 | O | | | | | | | | | |
| | | UART2_RTSn | 11 | O | | | | | | | | | |
| | | CPTS0_HW2TSPUSH | 12 | I | | | | | | | | | |
| | | I2C1_SDA | 13 | IOD | | | | | | | | | |
| | | UART3_TXD | 14 | O | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用模 式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [7] | 复位 之后 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [8] | 复位 之后 的多 路复 用模 式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AL32 | GPIO0_11 PADCFG: PADCONFIG_11 0x0011C02C | MCAN17_TX | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | VOUT0_DATA18 | 2 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_A14 | 6 | OZ | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_11 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | SPI7_CS3 | 8 | IO | | | | | | | | | |
| | | TRC_DATA25 | 10 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_CSn2 | 12 | O | | | | | | | | | |
| | | UART7_RXD | 13 | I | | | | | | | | | |
| USB0_DRVVBUS | 14 | O | | | | | | | | | | | |
| AK37 | GPIO0_12 PADCFG: PADCONFIG_12 0x0011C030 | MCAN12_RX | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | VOUT0_DATA17 | 2 | O | | | | | | | | | |
| | | VOUT0_DATA22 | 5 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_AD4 | 6 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_12 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | SPI6_CLK | 8 | IO | | | | | | | | | |
| | | EQEP1_I | 9 | IO | | | | | | | | | |
| | | TRC_DATA2 | 10 | O | | | | | | | | | |
| UART9_CTSn | 11 | I | | | | | | | | | | | |
| UART6_RXD | 12 | I | | | | | | | | | | | |
| AN36 | I2C0_SCL PADCFG: PADCONFIG_56 0x0011C0E0 | I2C0_SCL | 0 | IOD | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 开启/SS/关闭 | 7 | | VDDSHV0 | 是 | I2C 开漏 | 否 |
| | | GPIO0_56 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| AP37 | I2C0_SDA PADCFG: PADCONFIG_57 0x0011C0E4 | I2C0_SDA | 0 | IOD | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 开启/SS/关闭 | 7 | | VDDSHV0 | 是 | I2C 开漏 | 否 |
| | | GPIO0_57 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| AE38 | MCAN0_RX PADCFG: PADCONFIG_26 0x0011C068 | MCAN0_RX | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCASP4_AXR1 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | VOUT0_DATA3 | 2 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_AD15 | 6 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_26 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | SPI5_CS0 | 8 | IO | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM0_A | 9 | IO | | | | | | | | | |
| | | TRC_DATA16 | 10 | O | | | | | | | | | |
| | | UART2_TXD | 11 | O | | | | | | | | | |
| | | UART6_RTSn | 12 | O | | | | | | | | | |
| SPI7_D0 | 13 | IO | | | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用模 式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [7] | 复位 之后 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [8] | 复位 之后 的多 路复 用模 式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|-----------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AF38 | MCAN0_TX PADCFG: PADCONFIG_25 0x0011C064 | MCAN0_TX | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCASP2_AXR2 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | VOUT0_DATA4 | 2 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_AD14 | 6 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_25 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | SPI5_CS1 | 8 | IO | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM0_B | 9 | IO | | | | | | | | | |
| | | TRC_DATA11 | 10 | O | | | | | | | | | |
| | | UART2_RXD | 11 | I | | | | | | | | | |
| | | UART6_CTSn | 12 | I | | | | | | | | | |
| I2C3_SCL | 13 | IOD | | | | | | | | | | | |
| AH38 | MCAN1_RX PADCFG: PADCONFIG_28 0x0011C070 | MCAN1_RX | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCASP4_AXR3 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | VOUT0_DATA1 | 2 | O | | | | | | | | | |
| | | VOUT0_DATA19 | 5 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_BE0n_CLE | 6 | O | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_28 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | SPI5_D0 | 8 | IO | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM0_SYNCI | 9 | I | | | | | | | | | |
| | | TRC_DATA5 | 10 | O | | | | | | | | | |
| | | UART3_RTSn | 11 | O | | | | | | | | | |
| AJ37 | MCAN1_TX PADCFG: PADCONFIG_27 0x0011C06C | MCAN1_TX | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCASP4_AFSX | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | VOUT0_EXTPCLKIN | 2 | I | | | | | | | | | |
| | | DSS_FSYNCO | 4 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_AD7 | 6 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_27 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM_TZn_IN5 | 9 | I | | | | | | | | | |
| | | TRC_CTL | 10 | O | | | | | | | | | |
| | | UART6_TXD | 11 | O | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|-------------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AH37 | MCAN2_RX PADCFG: PADCONFIG_30 0x0011C078 | MCAN2_RX | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | AUDIO_EXT_REFCLK1 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | VOUT0_PCLK | 2 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_CSn1 | 6 | O | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_30 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | SPI6_CS1 | 8 | IO | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM4_B | 9 | IO | | | | | | | | | |
| | | TRC_DATA17 | 10 | O | | | | | | | | | |
| | | UART3_TXD | 11 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_DIR | 12 | O | | | | | | | | | |
| I2C5_SDA | 13 | IOD | | | | | | | | | | | |
| AC33 | MCAN2_TX PADCFG: PADCONFIG_29 0x0011C074 | MCAN2_TX | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCASP2_AXR3 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | VOUT0_DATA0 | 2 | O | | | | | | | | | |
| | | VOUT0_DATA18 | 5 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_WAIT0 | 6 | I | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_29 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | SPI6_D1 | 8 | IO | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM1_B | 9 | IO | | | | | | | | | |
| | | TRC_DATA3 | 10 | O | | | | | | | | | |
| | | UART3_RXD | 11 | I | | | | | | | | | |
| GPMC0_DIR | 12 | O | | | | | | | | | | | |
| I2C5_SCL | 13 | IOD | | | | | | | | | | | |
| AJ33 | MCAN12_RX PADCFG: PADCONFIG_2 0x0011C008 | MCAN12_RX | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | UART0_DCDn | 1 | I | | | | | | | | | |
| | | DSS_FSYNC1 | 3 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_A23 | 6 | OZ | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_2 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | TRC_CTL | 10 | O | | | | | | | | | |
| | | UART5_RXD | 11 | I | | | | | | | | | |
| GPMC0_CSn3 | 12 | O | | | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉动 类型 [10] | 电源 [11] | Hys [12] | 电压 缓冲器 类型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|---------|-------------|----------------------|----------------|
| AG36 | MCAN12_TX PADCFG: PADCONFIG_1 0x0011C004 | MCAN12_TX | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | DSS_FSYNC0 | 3 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_A24 | 6 | OZ | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_1 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | TRC_CLK | 10 | O | | | | | | | | | |
| | | UART5_TXD | 11 | O | | | | | | | | | |
| AH33 | MCAN13_RX PADCFG: PADCONFIG_4 0x0011C010 | MCAN13_RX | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | UART0_DTRn | 1 | O | | | | | | | | | |
| | | DSS_FSYNC3 | 3 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_A21 | 6 | OZ | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_4 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | I2C4_SDA | 8 | IOD | | | | | | | | | |
| | | TRC_DATA1 | 10 | O | | | | | | | | | |
| UART6_TXD | 11 | O | | | | | | | | | | | |
| AF33 | MCAN13_TX PADCFG: PADCONFIG_3 0x0011C00C | MCAN13_TX | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | UART0_DSRn | 1 | I | | | | | | | | | |
| | | DSS_FSYNC2 | 3 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_A22 | 6 | OZ | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_3 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | TRC_DATA0 | 10 | O | | | | | | | | | |
| | | UART4_TXD | 11 | O | | | | | | | | | |
| AK36 | MCAN14_RX PADCFG: PADCONFIG_6 0x0011C018 | MCAN14_RX | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | VOUT0_DATA23 | 2 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_A19 | 6 | OZ | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_6 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | I2C5_SDA | 8 | IOD | | | | | | | | | |
| | | TRC_DATA3 | 10 | O | | | | | | | | | |
| UART9_TXD | 11 | O | | | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用模 式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的焊 球状 态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的焊 球状 态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的多 路复 用模 式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|--|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AG33 | MCAN14_TX PADCFG: PADCONFIG_5 0x0011C014 | MCAN14_TX | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | UART0_RIn | 1 | I | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_A20 | 6 | OZ | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_5 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | I2C4_SCL | 8 | IOD | | | | | | | | | |
| | | TRC_DATA2 | 10 | O | | | | | | | | | |
| | | UART6_RXD | 11 | I | | | | | | | | | |
| DP0_HPDP | 13 | I | | | | | | | | | | | |
| AJ35 | MCAN15_RX PADCFG: PADCONFIG_8 0x0011C020 | MCAN15_RX | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | VOUT0_DATA21 | 2 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_A17 | 6 | OZ | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_8 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | SPI0_CS2 | 8 | IO | | | | | | | | | |
| | | TRC_DATA22 | 10 | O | | | | | | | | | |
| I2C1_SCL | 12 | IOD | | | | | | | | | | | |
| AG34 | MCAN15_TX PADCFG: PADCONFIG_7 0x0011C01C | MCAN15_TX | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | VOUT0_DATA22 | 2 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_A18 | 6 | OZ | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_7 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | I2C5_SCL | 8 | IOD | | | | | | | | | |
| | | TRC_DATA21 | 10 | O | | | | | | | | | |
| UART9_RXD | 11 | I | | | | | | | | | | | |
| AE33 | MCAN16_RX PADCFG: PADCONFIG_10 0x0011C028 | MCAN16_RX | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | VOUT0_DATA19 | 2 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_A15 | 6 | OZ | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_10 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | SPI0_CS3 | 8 | IO | | | | | | | | | |
| | | TRC_DATA24 | 10 | O | | | | | | | | | |
| GPMC0_WAIT1 | 12 | I | | | | | | | | | | | |
| AH34 | MCAN16_TX PADCFG: PADCONFIG_9 0x0011C024 | MCAN16_TX | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | VOUT0_DATA20 | 2 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_A16 | 6 | OZ | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_9 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | SPI1_CS3 | 8 | IO | | | | | | | | | |
| | | TRC_DATA23 | 10 | O | | | | | | | | | |
| I2C1_SDA | 12 | IOD | | | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|----------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AK35 | MCASP0_ACLKX PADCFG: PADCONFIG_14 0x0011C038 | MCAN5_TX | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCASP0_ACLKX | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | VOUT0_DATA15 | 2 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_AD0 | 6 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_14 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM_TZn_IN2 | 9 | I | | | | | | | | | |
| UART8_RXD | 11 | I | | | | | | | | | | | |
| AK38 | MCASP0_AFSX PADCFG: PADCONFIG_15 0x0011C03C | MCAN5_RX | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCASP0_AFSX | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | VOUT0_DATA14 | 2 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_AD1 | 6 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_15 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM2_B | 9 | IO | | | | | | | | | |
| UART8_TXD | 11 | O | | | | | | | | | | | |
| AC34 | MCASP1_ACLKX PADCFG: PADCONFIG_46 0x0011C0B8 | MCAN10_RX | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCASP1_ACLKX | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | DP0_HPD | 3 | I | | | | | | | | | |
| | | PCIE0_CLKREQn | 4 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_A11 | 5 | OZ | | | | | | | | | |
| | | RGMI1_RD0 | 6 | I | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_46 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | EQEP0_S | 9 | IO | | | | | | | | | |
| | | UART4_RTSn | 11 | O | | | | | | | | | |
| | | SPI3_CS3 | 12 | IO | | | | | | | | | |
| UART9_RTSn | 13 | O | | | | | | | | | | | |
| AD33 | MCASP1_AFSX PADCFG: PADCONFIG_47 0x0011C0BC | MCAN11_TX | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCASP1_AFSX | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_A12 | 5 | OZ | | | | | | | | | |
| | | MDIO0_MDIO | 6 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_47 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | SPI3_CS0 | 8 | IO | | | | | | | | | |
| | | EQEP0_I | 9 | IO | | | | | | | | | |
| UART0_RXD | 11 | I | | | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用模 式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [7] | 复位 之后 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [8] | 复位 之后 的多 路复 用模 式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AD37 | MCASP2_ACLKX PADCFG: PADCONFIG_21 0x0011C054 | MCAN8_RX | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCASP2_ACLKX | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | VOUT0_DATA8 | 2 | O | | | | | | | | | |
| | | VOUT0_DATA20 | 5 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_AD10 | 6 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_21 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | SPI5_CS2 | 8 | IO | | | | | | | | | |
| | | EQEP2_S | 9 | IO | | | | | | | | | |
| | | TRC_DATA4 | 10 | O | | | | | | | | | |
| | | UART1_RXD | 11 | I | | | | | | | | | |
| | | SPI7_CS1 | 13 | IO | | | | | | | | | |
| | | SYNC3_OUT | 14 | O | | | | | | | | | |
| AE37 | MCASP2_AFSX PADCFG: PADCONFIG_22 0x0011C058 | MCAN9_TX | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCASP2_AFSX | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | VOUT0_DATA7 | 2 | O | | | | | | | | | |
| | | MDIO1_MDC | 4 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_AD11 | 6 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_22 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | SPI5_CS3 | 8 | IO | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM_SOCA | 9 | O | | | | | | | | | |
| | | TRC_DATA9 | 10 | O | | | | | | | | | |
| | | UART1_TXD | 11 | O | | | | | | | | | |
| | | SPI7_CS2 | 13 | IO | | | | | | | | | |
| | | MCAN6_TX | 0 | O | | | | | | | | | |
| MCASP0_AXR0 | 1 | IO | | | | | | | | | | | |
| VOUT0_DATA13 | 2 | O | | | | | | | | | | | |
| GPMC0_AD2 | 6 | IO | | | | | | | | | | | |
| GPIO0_16 | 7 | IO | | | | | | | | | | | |
| SPI2_CS2 | 8 | IO | | | | | | | | | | | |
| EHRPWM2_A | 9 | IO | | | | | | | | | | | |
| TRC_DATA14 | 10 | O | | | | | | | | | | | |
| UART4_RXD | 11 | I | | | | | | | | | | | |
| SPI7_CLK | 13 | IO | | | | | | | | | | | |
| UART8_CTSn | 14 | I | | | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|--|----------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AG37 | MCASP0_AXR1 PADCFG: PADCONFIG_17 0x0011C044 | MCAN6_RX | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCASP0_AXR1 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | VOUT0_DATA12 | 2 | O | | | | | | | | | |
| | | OBSCLK1 | 4 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_AD3 | 6 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_17 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | SPI2_CS3 | 8 | IO | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM0_SYNC0 | 9 | O | | | | | | | | | |
| | | TRC_DATA12 | 10 | O | | | | | | | | | |
| | | UART4_TXD | 11 | O | | | | | | | | | |
| | | SPI7_CS0 | 13 | IO | | | | | | | | | |
| | | UART8_RTSn | 14 | O | | | | | | | | | |
| AK33 | MCASP0_AXR2 PADCFG: PADCONFIG_18 0x0011C048 | MCAN7_TX | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCASP0_AXR2 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | VOUT0_DATA11 | 2 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_ADVn_ALE | 6 | O | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_18 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | EQEP2_A | 9 | I | | | | | | | | | |
| | | TRC_DATA10 | 10 | O | | | | | | | | | |
| | | UART4_CTSn | 11 | I | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_WPn | 12 | O | | | | | | | | | |
| UART9_CTSn | 13 | I | | | | | | | | | | | |
| AJ38 | MCASP0_AXR3 PADCFG: PADCONFIG_31 0x0011C07C | MCAN3_TX | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCASP0_AXR3 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | VOUT0_DATA2 | 2 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_BE1n | 6 | O | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_31 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | SPI5_CLK | 8 | IO | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM_TZn_IN0 | 9 | I | | | | | | | | | |
| | | TRC_DATA7 | 10 | O | | | | | | | | | |
| | | UART3_CTSn | 11 | I | | | | | | | | | |
| | | SPI3_CS1 | 12 | IO | | | | | | | | | |
| SPI7_D1 | 13 | IO | | | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用模 式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [7] | 复位 之后 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [8] | 复位 之后 的多 路复 用模 式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|----------------|--|-----------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AK34 | MCASP0_AXR4 PADCFG: PADCONFIG_32 0x0011C080 | MCAN3_RX | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVC MOS | 是 |
| | | MCASP0_AXR4 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | VOUT0_HSYNC | 2 | O | | | | | | | | | |
| | | VOUT0_VP0_HSYNC | 4 | O | | | | | | | | | |
| | | VOUT0_VP2_HSYNC | 5 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_OEn_REn | 6 | O | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_32 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | SPI6_CS2 | 8 | IO | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM5_B | 9 | IO | | | | | | | | | |
| | | TRC_DATA18 | 10 | O | | | | | | | | | |
| | | I2C4_SDA | 13 | IOD | | | | | | | | | |
| AG38 | MCASP0_AXR5 PADCFG: PADCONFIG_33 0x0011C084 | MCAN4_TX | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVC MOS | 是 |
| | | MCASP0_AXR5 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | VOUT0_DE | 2 | O | | | | | | | | | |
| | | MCASP1_ACLKR | 3 | IO | | | | | | | | | |
| | | VOUT0_VP0_DE | 4 | O | | | | | | | | | |
| | | VOUT0_VP2_DE | 5 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_CSn0 | 6 | O | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_33 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | SPI6_CS3 | 8 | IO | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM5_A | 9 | IO | | | | | | | | | |
| | | TRC_DATA19 | 10 | O | | | | | | | | | |
| I2C4_SCL | 13 | IOD | | | | | | | | | | | |
| AF36 | MCASP0_AXR6 PADCFG: PADCONFIG_34 0x0011C088 | MCAN4_RX | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVC MOS | 是 |
| | | MCASP0_AXR6 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | VOUT0_VSYNC | 2 | O | | | | | | | | | |
| | | MCASP1_AFSR | 3 | IO | | | | | | | | | |
| | | VOUT0_VP0_VSYNC | 4 | O | | | | | | | | | |
| | | VOUT0_VP2_VSYNC | 5 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_CLKOUT | 6 | O | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_34 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | SPI3_CS2 | 8 | IO | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM_TZn_IN4 | 9 | I | | | | | | | | | |
| | | TRC_DATA20 | 10 | O | | | | | | | | | |
| SPI5_D1 | 11 | IO | | | | | | | | | | | |
| GPMC0_FCLK_MUX | 12 | O | | | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用模 式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [7] | 复位 之后 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [8] | 复位 之后 的多 路复 用模 式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|--|----------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AE35 | MCASP0_AXR7 PADCFG: PADCONFIG_35 0x0011C08C | MCAN5_TX | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCASP0_AXR7 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | MCASP4_ACLKR | 3 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_A0 | 5 | OZ | | | | | | | | | |
| | | RGMII1_TD0 | 6 | O | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_35 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_A14 | 8 | OZ | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM3_A | 9 | IO | | | | | | | | | |
| | | UART4_RXD | 11 | I | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_CSn2 | 12 | O | | | | | | | | | |
| USB0_DRVVBUS | 14 | O | | | | | | | | | | | |
| AC35 | MCASP0_AXR8 PADCFG: PADCONFIG_36 0x0011C090 | MCAN5_RX | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCASP0_AXR8 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | MCASP4_AFSR | 3 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_A1 | 5 | OZ | | | | | | | | | |
| | | RGMII1_TD1 | 6 | O | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_36 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | RMII1_RXD0 | 8 | I | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM_TZn_IN3 | 9 | I | | | | | | | | | |
| UART4_TXD | 11 | O | | | | | | | | | | | |
| AG35 | MCASP0_AXR9 PADCFG: PADCONFIG_37 0x0011C094 | MCAN6_TX | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCASP0_AXR9 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | MCASP4_AXR4 | 2 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_A2 | 5 | OZ | | | | | | | | | |
| | | RGMII1_TD2 | 6 | O | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_37 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | RMII1_RXD1 | 8 | I | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM3_SYNC0 | 9 | O | | | | | | | | | |
| | | UART4_CTSn | 11 | I | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉动 类型 [10] | 电源 [11] | Hys [12] | 电压 缓冲器 类型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|---------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|---------|-------------|----------------------|----------------|
| AH36 | MCASP0_AXR10 PADCFG: PADCONFIG_38 0x0011C098 | MCAN6_RX | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCASP0_AXR10 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_A3 | 5 | OZ | | | | | | | | | |
| | | RGMII1_TD3 | 6 | O | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_38 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | RMII1_CRSDV | 8 | I | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM3_SYNCI | 9 | I | | | | | | | | | |
| | | UART4_RTSn | 11 | O | | | | | | | | | |
| AF35 | MCASP0_AXR11 PADCFG: PADCONFIG_39 0x0011C09C | MCAN7_TX | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCASP0_AXR11 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | DSS_FSYNC2 | 4 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_A4 | 5 | OZ | | | | | | | | | |
| | | RGMII1_TX_CTL | 6 | O | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_39 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | RMII1_RX_ER | 8 | I | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM3_B | 9 | IO | | | | | | | | | |
| | | SPI2_CS1 | 10 | IO | | | | | | | | | |
| | | UART5_RXD | 11 | I | | | | | | | | | |
| AD34 | MCASP0_AXR12 PADCFG: PADCONFIG_40 0x0011C0A0 | MCAN7_RX | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCASP0_AXR12 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | MCASP2_ACLKR | 3 | IO | | | | | | | | | |
| | | DSS_FSYNC3 | 4 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_A5 | 5 | OZ | | | | | | | | | |
| | | RGMII1_RD1 | 6 | I | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_40 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | RMII1_TXD0 | 8 | O | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM_SOCB | 9 | O | | | | | | | | | |
| | | SPI2_CLK | 10 | IO | | | | | | | | | |
| | | UART5_TXD | 11 | O | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用模 式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [7] | 复位 之后 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [8] | 复位 之后 的多 路复 用模 式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|---------------|---|--------------|---|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AJ36 | MCASP0_AXR13 PADCFG: PADCONFIG_41 0x0011C0A4 | MCAN8_TX | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCASP0_AXR13 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | MCASP2_AFSR | 3 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_A6 | 5 | OZ | | | | | | | | | |
| | | RGMII1_RD2 | 6 | I | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_41 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | RMII_REF_CLK | 8 | I | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM4_A | 9 | IO | | | | | | | | | |
| | | SPI2_CS0 | 10 | IO | | | | | | | | | |
| | | UART5_CTSn | 11 | I | | | | | | | | | |
| | | UART7_RXD | 13 | I | | | | | | | | | |
| AF34 | MCASP0_AXR14 PADCFG: PADCONFIG_42 0x0011C0A8 | MCAN8_RX | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCASP0_AXR14 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | MCASP2_AXR4 | 2 | IO | | | | | | | | | |
| | | MCASP0_ACLKR | 3 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_A7 | 5 | OZ | | | | | | | | | |
| | | RGMII1_RD3 | 6 | I | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_42 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | CLKOUT | 8 | IO | | | | | | | | | |
| | | EQEP0_A | 9 | I | | | | | | | | | |
| | | SPI2_D0 | 10 | IO | | | | | | | | | |
| | | UART5_RTSn | 11 | O | | | | | | | | | |
| | | UART7_TXD | 13 | O | | | | | | | | | |
| | | AE34 | MCASP0_AXR15 PADCFG: PADCONFIG_43 0x0011C0AC | MCAN9_TX | | | | | | | | | |
| MCASP0_AXR15 | 1 | | | IO | | | | | | | | | |
| MCASP0_AFSR | 3 | | | IO | | | | | | | | | |
| GPMC0_A8 | 5 | | | OZ | | | | | | | | | |
| RGMII1_RX_CTL | 6 | | | I | | | | | | | | | |
| GPIO0_43 | 7 | | | IO | | | | | | | | | |
| RMII1_TX_EN | 8 | | | O | | | | | | | | | |
| EQEP0_B | 9 | | | I | | | | | | | | | |
| SPI2_D1 | 10 | | | IO | | | | | | | | | |
| UART8_RXD | 11 | | | I | | | | | | | | | |
| I2C1_SCL | 13 | | | IOD | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用模 式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [7] | 复位 之后 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [8] | 复位 之后 的多 路复 用模 式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|--|----------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AD38 | MCASP1_AXR0 PADCFG: PADCONFIG_48 0x0011C0C0 | MCAN11_RX | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCASP1_AXR0 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_A13 | 5 | OZ | | | | | | | | | |
| | | MDIO0_MDC | 6 | O | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_48 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | SPI3_CLK | 8 | IO | | | | | | | | | |
| | | EQEP1_S | 9 | IO | | | | | | | | | |
| | | UART0_TXD | 11 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_WAIT3 | 12 | I | | | | | | | | | |
| SYNC2_OUT | 14 | O | | | | | | | | | | | |
| AC32 | MCASP1_AXR1 PADCFG: PADCONFIG_19 0x0011C04C | MCAN7_RX | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCASP1_AXR1 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | VOUT0_DATA10 | 2 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_AD8 | 6 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_19 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | SPI3_D0 | 8 | IO | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM_TZn_IN1 | 9 | I | | | | | | | | | |
| | | TRC_DATA8 | 10 | O | | | | | | | | | |
| | | UART0_CTSn | 11 | I | | | | | | | | | |
| | | UART9_RXD | 12 | I | | | | | | | | | |
| I2C2_SCL | 13 | IOD | | | | | | | | | | | |
| AC37 | MCASP1_AXR2 PADCFG: PADCONFIG_20 0x0011C050 | MCAN8_TX | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCASP1_AXR2 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | VOUT0_DATA9 | 2 | O | | | | | | | | | |
| | | VOUT0_DATA21 | 5 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_AD9 | 6 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_20 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | SPI3_D1 | 8 | IO | | | | | | | | | |
| | | EQEP2_B | 9 | I | | | | | | | | | |
| | | TRC_DATA6 | 10 | O | | | | | | | | | |
| | | UART0_RTSn | 11 | O | | | | | | | | | |
| | | UART9_TXD | 12 | O | | | | | | | | | |
| I2C2_SDA | 13 | IOD | | | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用模 式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [7] | 复位 之后 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [8] | 复位 之后 的多 路复 用模 式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|--|---------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AL33 | MCASP1_AXR3 PADCFG: PADCONFIG_44 0x0011C0B0 | MCAN9_RX | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCASP1_AXR3 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | PCIE2_CLKREQn | 4 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_A9 | 5 | OZ | | | | | | | | | |
| | | RGMII1_RXC | 6 | I | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_44 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | RMII1_TXD1 | 8 | O | | | | | | | | | |
| | | EQEP1_A | 9 | I | | | | | | | | | |
| | | UART8_TXD | 11 | O | | | | | | | | | |
| I2C1_SDA | 13 | IOD | | | | | | | | | | | |
| AL34 | MCASP1_AXR4 PADCFG: PADCONFIG_45 0x0011C0B4 | MCAN10_TX | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCASP1_AXR4 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | PCIE3_CLKREQn | 4 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_A10 | 5 | OZ | | | | | | | | | |
| | | RGMII1_TXC | 6 | O | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_45 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | EQEP1_B | 9 | I | | | | | | | | | |
| | | UART4_RXD | 11 | I | | | | | | | | | |
| AC36 | MCASP2_AXR0 PADCFG: PADCONFIG_23 0x0011C05C | MCAN9_RX | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCASP2_AXR0 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | VOUT0_DATA6 | 2 | O | | | | | | | | | |
| | | MDIO1_MDIO | 4 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_AD12 | 6 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_23 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | EQEP2_I | 9 | IO | | | | | | | | | |
| | | TRC_DATA15 | 10 | O | | | | | | | | | |
| | | UART1_CTSn | 11 | I | | | | | | | | | |
| | | UART6_RXD | 12 | I | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用模 式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [7] | 复位 之后 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [8] | 复位 之后 的多 路复 用模 式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|---------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AE36 | MCASP2_AXR1 PADCFG: PADCONFIG_24 0x0011C060 | MCAN17_RX | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCASP2_AXR1 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | VOU0_DATA5 | 2 | O | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_AD13 | 6 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_24 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM1_A | 9 | IO | | | | | | | | | |
| | | TRC_DATA13 | 10 | O | | | | | | | | | |
| | | UART1_RTSn | 11 | O | | | | | | | | | |
| | | UART6_TXD | 12 | O | | | | | | | | | |
| | | I2C3_SDA | 13 | IOD | | | | | | | | | |
| U35 | MCU_ADC0_REFN | MCU_ADC0_REFN | | A | 1.8V | | | | VDDA_ADC0 | | | ADC12B | 否 |
| R35 | MCU_ADC0_REFP | MCU_ADC0_REFP | | A | 1.8V | | | | VDDA_ADC0 | | | ADC12B | 否 |
| W35 | MCU_ADC1_REFN | MCU_ADC1_REFN | | A | 1.8V | | | | VDDA_ADC1 | | | ADC12B | 否 |
| AA35 | MCU_ADC1_REFP | MCU_ADC1_REFP | | A | 1.8V | | | | VDDA_ADC1 | | | ADC12B | 否 |
| P36 | MCU_ADC0_AIN0 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_77 0x4301C134 | MCU_ADC0_AIN0 | 0 | A | 1.8V | | | 0 | | VDDA_ADC0 | | ADC12B | 否 |
| | | WKUP_GPIO0_71 | 7 (1) | I | | | | | | | | | |
| V36 | MCU_ADC0_AIN1 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_78 0x4301C138 | MCU_ADC0_AIN1 | 0 | A | 1.8V | | | 0 | | VDDA_ADC0 | | ADC12B | 否 |
| | | WKUP_GPIO0_72 | 7 (1) | I | | | | | | | | | |
| T34 | MCU_ADC0_AIN2 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_79 0x4301C13C | MCU_ADC0_AIN2 | 0 | A | 1.8V | | | 0 | | VDDA_ADC0 | | ADC12B | 否 |
| | | WKUP_GPIO0_73 | 7 (1) | I | | | | | | | | | |
| T36 | MCU_ADC0_AIN3 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_80 0x4301C140 | MCU_ADC0_AIN3 | 0 | A | 1.8V | | | 0 | | VDDA_ADC0 | | ADC12B | 否 |
| | | WKUP_GPIO0_74 | 7 (1) | I | | | | | | | | | |
| P34 | MCU_ADC0_AIN4 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_81 0x4301C144 | MCU_ADC0_AIN4 | 0 | A | 1.8V | | | 0 | | VDDA_ADC0 | | ADC12B | 否 |
| | | WKUP_GPIO0_75 | 7 (1) | I | | | | | | | | | |
| R37 | MCU_ADC0_AIN5 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_82 0x4301C148 | MCU_ADC0_AIN5 | 0 | A | 1.8V | | | 0 | | VDDA_ADC0 | | ADC12B | 否 |
| | | WKUP_GPIO0_76 | 7 (1) | I | | | | | | | | | |
| R33 | MCU_ADC0_AIN6 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_83 0x4301C14C | MCU_ADC0_AIN6 | 0 | A | 1.8V | | | 0 | | VDDA_ADC0 | | ADC12B | 否 |
| | | WKUP_GPIO0_77 | 7 (1) | I | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用模 式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [7] | 复位 之后 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [8] | 复位 之后 的多 路复 用模 式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|---------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| V38 | MCU_ADC0_AIN7 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_84 0x4301C150 | MCU_ADC0_AIN7 | 0 | A | 1.8V | | | 0 | | VDDA_ADC0 | | ADC12B | 否 |
| | | WKUP_GPIO0_78 | 7 (1) | I | | | | | | | | | |
| Y38 | MCU_ADC1_AIN0 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_85 0x4301C154 | MCU_ADC1_AIN0 | 0 | A | 1.8V | | | 0 | | VDDA_ADC1 | | ADC12B | 否 |
| | | WKUP_GPIO0_79 | 7 (1) | I | | | | | | | | | |
| Y34 | MCU_ADC1_AIN1 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_86 0x4301C158 | MCU_ADC1_AIN1 | 0 | A | 1.8V | | | 0 | | VDDA_ADC1 | | ADC12B | 否 |
| | | WKUP_GPIO0_80 | 7 (1) | I | | | | | | | | | |
| V34 | MCU_ADC1_AIN2 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_87 0x4301C15C | MCU_ADC1_AIN2 | 0 | A | 1.8V | | | 0 | | VDDA_ADC1 | | ADC12B | 否 |
| | | WKUP_GPIO0_81 | 7 (1) | I | | | | | | | | | |
| W37 | MCU_ADC1_AIN3 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_88 0x4301C160 | MCU_ADC1_AIN3 | 0 | A | 1.8V | | | 0 | | VDDA_ADC1 | | ADC12B | 否 |
| | | WKUP_GPIO0_82 | 7 (1) | I | | | | | | | | | |
| AA37 | MCU_ADC1_AIN4 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_89 0x4301C164 | MCU_ADC1_AIN4 | 0 | A | 1.8V | | | 0 | | VDDA_ADC1 | | ADC12B | 否 |
| | | WKUP_GPIO0_83 | 7 (1) | I | | | | | | | | | |
| W33 | MCU_ADC1_AIN5 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_90 0x4301C168 | MCU_ADC1_AIN5 | 0 | A | 1.8V | | | 0 | | VDDA_ADC1 | | ADC12B | 否 |
| | | WKUP_GPIO0_84 | 7 (1) | I | | | | | | | | | |
| U33 | MCU_ADC1_AIN6 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_91 0x4301C16C | MCU_ADC1_AIN6 | 0 | A | 1.8V | | | 0 | | VDDA_ADC1 | | ADC12B | 否 |
| | | WKUP_GPIO0_85 | 7 (1) | I | | | | | | | | | |
| Y36 | MCU_ADC1_AIN7 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_92 0x4301C170 | MCU_ADC1_AIN7 | 0 | A | 1.8V | | | 0 | | VDDA_ADC1 | | ADC12B | 否 |
| | | WKUP_GPIO0_86 | 7 (1) | I | | | | | | | | | |
| M35 | MCU_I2C0_SCL PADCFG: WKUP_PADCONFIG_66 0x4301C108 | MCU_I2C0_SCL | 0 | IOD | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 开启/SS/关闭 | 0 | | VDDSHV0_M CU | 是 | I2C 开漏 | 是 |
| | | WKUP_GPIO0_65 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| G34 | MCU_I2C0_SDA PADCFG: WKUP_PADCONFIG_67 0x4301C10C | MCU_I2C0_SDA | 0 | IOD | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 开启/SS/关闭 | 0 | | VDDSHV0_M CU | 是 | I2C 开漏 | 是 |
| | | WKUP_GPIO0_87 | 7 | IO | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| F38 | MCU_MCAN0_RX PADCFG: WKUP_PADCONFIG_47 0x4301C0BC | MCU_MCAN0_RX | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | WKUP_GPIO0_61 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| K33 | MCU_MCAN0_TX PADCFG: WKUP_PADCONFIG_46 0x4301C0B8 | MCU_MCAN0_TX | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | WKUP_GPIO0_60 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| A36 | MCU_MDIO0_MDC PADCFG: WKUP_PADCONFIG_39 0x4301C09C | MCU_MDIO0_MDC | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2_M CU | 是 | LVCMOS | 否 |
| | | WKUP_GPIO0_53 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| B35 | MCU_MDIO0_MDIO PADCFG: WKUP_PADCONFIG_38 0x4301C098 | MCU_MDIO0_MDIO | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2_M CU | 是 | LVCMOS | 否 |
| | | WKUP_GPIO0_52 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| E32 | MCU_OSPI0_CLK PADCFG: WKUP_PADCONFIG_0 0x4301C000 | MCU_OSPI0_CLK | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV1_M CU | 是 | LVCMOS | 否 |
| | | MCU_HYPERBUS0_CK | 1 | O | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_16 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| C34 | MCU_OSPI0_DQS PADCFG: WKUP_PADCONFIG_2 0x4301C008 | MCU_OSPI0_DQS | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV1_M CU | 是 | LVCMOS | 否 |
| | | MCU_HYPERBUS0_RWDS | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_18 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| D32 | MCU_OSPI0_LBCLKO PADCFG: WKUP_PADCONFIG_1 0x4301C004 | MCU_OSPI0_LBCLKO | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 开启/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV1_M CU | 是 | LVCMOS | 否 |
| | | MCU_HYPERBUS0_CK _n | 1 | O | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_17 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| F32 | MCU_OSPI1_CLK PADCFG: WKUP_PADCONFIG_16 0x4301C040 | MCU_OSPI1_CLK | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV1_M CU | 是 | LVCMOS | 否 |
| | | WKUP_GPIO0_31 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| F31 | MCU_OSPI1_DQS PADCFG: WKUP_PADCONFIG_18 0x4301C048 | MCU_OSPI1_DQS | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV1_M CU | 是 | LVCMOS | 否 |
| | | MCU_OSPI0_CSn3 | 1 | O | | | | | | | | | |
| | | MCU_HYPERBUS0_INT _n | 2 | I | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_33 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| C31 | MCU_OSPI1_LBCLKO PADCFG: WKUP_PADCONFIG_17 0x4301C044 | MCU_OSPI1_LBCLKO | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 开启/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV1_M CU | 是 | LVCMOS | 否 |
| | | MCU_OSPI0_CSn2 | 1 | O | | | | | | | | | |
| | | MCU_HYPERBUS0_RESETO _n | 2 | I | | | | | | | | | |
| | | MCU_OSPI0_RESET_OUT0 | 6 | O | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_32 | 7 | IO | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用模 式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的焊 球状 态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的焊 球状 态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|---------------|--|-----------------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| A32 | MCU_OSPI0_CSn0 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_11 0x4301C02C | MCU_OSPI0_CSn0 | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV1_M CU | 是 | LVCMOS | 否 |
| | | MCU_HYPERBUS0_CSn0 | 1 | O | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_27 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| A33 | MCU_OSPI0_CSn1 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_12 0x4301C030 | MCU_OSPI0_CSn1 | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV1_M CU | 是 | LVCMOS | 否 |
| | | MCU_HYPERBUS0_RESETEn | 1 | O | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_28 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| B34 | MCU_OSPI0_CSn2 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_14 0x4301C038 | MCU_OSPI0_CSn2 | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV1_M CU | 是 | LVCMOS | 否 |
| | | MCU_OSPI0_CSn2 | 1 | O | | | | | | | | | |
| | | MCU_HYPERBUS0_RESETEn | 2 | I | | | | | | | | | |
| | | MCU_HYPERBUS0_WPn | 3 | O | | | | | | | | | |
| | | MCU_HYPERBUS0_CSn1 | 4 | O | | | | | | | | | |
| | | MCU_OSPI0_RESET_OUT0 | 6 | O | | | | | | | | | |
| WKUP_GPIO0_29 | 7 | IO | | | | | | | | | | | |
| C32 | MCU_OSPI0_CSn3 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_15 0x4301C03C | MCU_OSPI0_CSn3 | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV1_M CU | 是 | LVCMOS | 否 |
| | | MCU_OSPI0_CSn3 | 1 | O | | | | | | | | | |
| | | MCU_HYPERBUS0_INTn | 2 | I | | | | | | | | | |
| | | MCU_HYPERBUS0_WPn | 3 | O | | | | | | | | | |
| | | MCU_OSPI0_RESET_OUT1 | 5 | O | | | | | | | | | |
| | | MCU_OSPI0_ECC_FAIL | 6 | I | | | | | | | | | |
| WKUP_GPIO0_30 | 7 | IO | | | | | | | | | | | |
| B33 | MCU_OSPI0_D0 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_3 0x4301C00C | MCU_OSPI0_D0 | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 开启/关闭/关闭 | 开启/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV1_M CU | 是 | LVCMOS | 否 |
| | | MCU_HYPERBUS0_DQ0 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_19 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | BOOTMODE00 | 自动加 载 | I | | | | | | | | | |
| B32 | MCU_OSPI0_D1 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_4 0x4301C010 | MCU_OSPI0_D1 | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 开启/关闭/关闭 | 开启/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV1_M CU | 是 | LVCMOS | 否 |
| | | MCU_HYPERBUS0_DQ1 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_20 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | BOOTMODE01 | 自动加 载 | I | | | | | | | | | |
| C33 | MCU_OSPI0_D2 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_5 0x4301C014 | MCU_OSPI0_D2 | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV1_M CU | 是 | LVCMOS | 否 |
| | | MCU_HYPERBUS0_DQ2 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_21 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| C35 | MCU_OSPI0_D3 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_6 0x4301C018 | MCU_OSPI0_D3 | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV1_M CU | 是 | LVCMOS | 否 |
| | | MCU_HYPERBUS0_DQ3 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_22 | 7 | IO | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用模 式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [7] | 复位 之后 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [8] | 复位 之后 的多 路复 用模 式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|---------------|--|----------------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| D33 | MCU_OSPI0_D4 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_7 0x4301C01C | MCU_OSPI0_D4 | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 开启/关闭/关闭 | 开启/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV1_M CU | 是 | LVC MOS | 否 |
| | | MCU_HYPERBUS0_DQ4 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_23 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | BOOTMODE02 | 自动加 载 | I | | | | | | | | | |
| D34 | MCU_OSPI0_D5 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_8 0x4301C020 | MCU_OSPI0_D5 | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 开启/关闭/关闭 | 开启/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV1_M CU | 是 | LVC MOS | 否 |
| | | MCU_HYPERBUS0_DQ5 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_24 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | BOOTMODE03 | 自动加 载 | I | | | | | | | | | |
| E34 | MCU_OSPI0_D6 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_9 0x4301C024 | MCU_OSPI0_D6 | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV1_M CU | 是 | LVC MOS | 否 |
| | | MCU_HYPERBUS0_DQ6 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_25 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| E33 | MCU_OSPI0_D7 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_10 0x4301C028 | MCU_OSPI0_D7 | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV1_M CU | 是 | LVC MOS | 否 |
| | | MCU_HYPERBUS0_DQ7 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_26 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| G32 | MCU_OSPI1_CSn0 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_23 0x4301C05C | MCU_OSPI1_CSn0 | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV1_M CU | 是 | LVC MOS | 否 |
| | | WKUP_GPIO0_38 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| G33 | MCU_OSPI1_CSn1 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_24 0x4301C060 | MCU_OSPI1_CSn1 | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV1_M CU | 是 | LVC MOS | 否 |
| | | MCU_HYPERBUS0_WPn | 1 | O | | | | | | | | | |
| | | MCU_TIMER_IO0 | 2 | IO | | | | | | | | | |
| | | MCU_HYPERBUS0_CSn1 | 3 | O | | | | | | | | | |
| | | MCU_UART0_RTSn | 4 | O | | | | | | | | | |
| | | MCU_SPI0_CS2 | 5 | IO | | | | | | | | | |
| | | MCU_OSPI0_RESET_OUT1 | 6 | O | | | | | | | | | |
| WKUP_GPIO0_39 | 7 | IO | | | | | | | | | | | |
| E35 | MCU_OSPI1_D0 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_19 0x4301C04C | MCU_OSPI1_D0 | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV1_M CU | 是 | LVC MOS | 否 |
| | | WKUP_GPIO0_34 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| D31 | MCU_OSPI1_D1 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_20 0x4301C050 | MCU_OSPI1_D1 | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV1_M CU | 是 | LVC MOS | 否 |
| | | MCU_UART0_RXD | 4 | I | | | | | | | | | |
| | | MCU_SPI1_CS1 | 5 | IO | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_35 | 7 | IO | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用模 式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [7] | 复位 之后 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [8] | 复位 之后 的多 路复 用模 式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|-------------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| G31 | MCU_OSP11_D2 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_21 0x4301C054 | MCU_OSP11_D2 | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV1_M CU | 是 | LVC MOS | 否 |
| | | MCU_UART0_TXD | 4 | O | | | | | | | | | |
| | | MCU_SPI1_CS2 | 5 | IO | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_36 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| F33 | MCU_OSP11_D3 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_22 0x4301C058 | MCU_OSP11_D3 | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV1_M CU | 是 | LVC MOS | 否 |
| | | MCU_UART0_CTSn | 4 | I | | | | | | | | | |
| | | MCU_SPI0_CS1 | 5 | IO | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_37 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| K32 | MCU_PORz | MCU_PORz | | I | 1.8V | | | | VDDA_WKUP | 是 | FS_RESET | 否 | |
| F36 | MCU_RESETSTATz PADCFG: WKUP_PADCONFIG_71 0x4301C11C | MCU_RESETSTATz | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/低电平/关 闭 | 关闭/SS/关闭 | 0 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVC MOS | 否 |
| | | WKUP_GPIO0_68 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| G36 | MCU_RESETz PADCFG: WKUP_PADCONFIG_70 0x4301C118 | MCU_RESETz | 0 | I | 1.8V/3.3V | 开启/NA/上拉 | 开启/关闭/上拉 | 0 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVC MOS | 否 |
| B37 | MCU_RGMII1_RXC PADCFG: WKUP_PADCONFIG_33 0x4301C084 | MCU_RGMII1_RXC | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2_M CU | 是 | LVC MOS | 否 |
| | | MCU_RMII1_REF_CLK | 1 | I | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_47 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| C37 | MCU_RGMII1_RX_CTL PADCFG: WKUP_PADCONFIG_27 0x4301C06C | MCU_RGMII1_RX_CTL | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2_M CU | 是 | LVC MOS | 否 |
| | | MCU_RMII1_RX_ER | 1 | I | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_41 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| E36 | MCU_RGMII1_TXC PADCFG: WKUP_PADCONFIG_32 0x4301C080 | MCU_RGMII1_TXC | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2_M CU | 是 | LVC MOS | 否 |
| | | MCU_RMII1_TX_EN | 1 | O | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_46 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| C38 | MCU_RGMII1_TX_CTL PADCFG: WKUP_PADCONFIG_26 0x4301C068 | MCU_RGMII1_TX_CTL | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2_M CU | 是 | LVC MOS | 否 |
| | | MCU_RMII1_CRS_DV | 1 | I | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_40 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| A35 | MCU_RGMII1_RD0 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_37 0x4301C094 | MCU_RGMII1_RD0 | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2_M CU | 是 | LVC MOS | 否 |
| | | MCU_RMII1_RXD0 | 1 | I | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_51 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| B36 | MCU_RGMII1_RD1 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_36 0x4301C090 | MCU_RGMII1_RD1 | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2_M CU | 是 | LVC MOS | 否 |
| | | MCU_RMII1_RXD1 | 1 | I | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_50 | 7 | IO | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用模 式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [7] | 复位 之后 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [8] | 复位 之后 的多 路复 用模 式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|----------------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| C36 | MCU_RGMII1_RD2 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_35 0x4301C08C | MCU_RGMII1_RD2 | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2_M CU | 是 | LVCMOS | 否 |
| | | MCU_TIMER_IO5 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_62 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| D36 | MCU_RGMII1_RD3 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_34 0x4301C088 | MCU_RGMII1_RD3 | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2_M CU | 是 | LVCMOS | 否 |
| | | MCU_TIMER_IO4 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_48 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| D37 | MCU_RGMII1_TD0 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_31 0x4301C07C | MCU_RGMII1_TD0 | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2_M CU | 是 | LVCMOS | 否 |
| | | MCU_RMII1_TXD0 | 1 | O | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_45 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| D38 | MCU_RGMII1_TD1 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_30 0x4301C078 | MCU_RGMII1_TD1 | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2_M CU | 是 | LVCMOS | 否 |
| | | MCU_RMII1_TXD1 | 1 | O | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_44 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| E37 | MCU_RGMII1_TD2 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_29 0x4301C074 | MCU_RGMII1_TD2 | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2_M CU | 是 | LVCMOS | 否 |
| | | MCU_TIMER_IO3 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | MCU_ADC_EXT_TRIGGER1 | 3 | I | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_43 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| E38 | MCU_RGMII1_TD3 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_28 0x4301C070 | MCU_RGMII1_TD3 | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2_M CU | 是 | LVCMOS | 否 |
| | | MCU_TIMER_IO2 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | MCU_ADC_EXT_TRIGGER0 | 3 | I | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_42 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| N36 | MCU_SAFETY_ERRORn PADCFG: WKUP_PADCONFIG_69 0x4301C114 | MCU_SAFETY_ERRORn | 0 | IO | 1.8V | 关闭/关闭/下拉 | 开启/SS/下拉 | 0 | PU/PD | VDDA_WKUP | 是 | LVCMOS | 否 |
| G38 | MCU_SPI0_CLK PADCFG: WKUP_PADCONFIG_40 0x4301C0A0 | MCU_SPI0_CLK | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 开启/关闭/关闭 | 开启/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | WKUP_GPIO0_54 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | MCU_BOOTMODE00 | 自动加 载 | I | | | | | | | | | |
| F37 | MCU_SPI0_CS0 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_43 0x4301C0AC | MCU_SPI0_CS0 | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCU_TIMER_IO1 | 4 | IO | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_70 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| H36 | MCU_SPI0_D0 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_41 0x4301C0A4 | MCU_SPI0_D0 | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 开启/关闭/关闭 | 开启/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | WKUP_GPIO0_55 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | MCU_BOOTMODE01 | 自动加 载 | I | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用模 式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [7] | 复位 之后 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [8] | 复位 之后 的多 路复 用模 式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|---------------|---|----------------|--------------------|--------------|---------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| J38 | MCU_SPI0_D1 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_42 0x4301C0A8 | MCU_SPI0_D1 | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 开启/关闭/关闭 | 开启/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVC MOS | 是 |
| | | MCU_TIMER_IO0 | 4 | IO | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_69 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | MCU_BOOTMODE02 | 自动加 载 | I | | | | | | | | | |
| AJ7 | MMC0_CALPAD | MMC0_CALPAD | | A | 1.8V | | | | PU/PD | VDDSD_MMC0 | | eMMC PHY | 否 |
| AK5 | MMC0_CLK | MMC0_CLK | | O | 1.8V | 开启/低电平/关 闭 | 开启/SS/关闭 | | PU/PD | VDDSD_MMC0 | | eMMC PHY | 否 |
| AL8 | MMC0_CMD | MMC0_CMD | | IO | 1.8V | 开启/关闭/上拉 | 开启/SS/上拉 | | PU/PD | VDDSD_MMC0 | | eMMC PHY | 否 |
| AK4 | MMC0_DS | MMC0_DS | | IO | 1.8V | 开启/关闭/下拉 | 开启/关闭/下拉 | | PU/PD | VDDSD_MMC0 | | eMMC PHY | 否 |
| AB38 | MMC1_CLK PADCFG: PADCONFIG_65 0x0011C104 | MMC1_CLK | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV5 | 是 | SDIO | 否 |
| | | UART8_RXD | 1 | I | | | | | | | | | |
| | | TIMER_IO6 | 3 | IO | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM2_B | 4 | IO | | | | | | | | | |
| | | UART4_CTSn | 5 | I | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM5_A | 6 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_64 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | SPI1_CLK | 8 | IO | | | | | | | | | |
| | | UART0_RTSn | 9 | O | | | | | | | | | |
| | | I2C6_SDA | 10 | IOD | | | | | | | | | |
| | | MCAN15_TX | 11 | O | | | | | | | | | |
| PCIE2_CLKREQn | 12 | IO | | | | | | | | | | | |
| AB36 | MMC1_CMD PADCFG: PADCONFIG_66 0x0011C108 | MMC1_CMD | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV5 | 是 | SDIO | 否 |
| | | UART8_TXD | 1 | O | | | | | | | | | |
| | | TIMER_IO7 | 3 | IO | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM2_A | 4 | IO | | | | | | | | | |
| | | UART4_RTSn | 5 | O | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_65 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | SPI1_D1 | 8 | IO | | | | | | | | | |
| | | I2C6_SCL | 10 | IOD | | | | | | | | | |
| | | MCAN15_RX | 11 | I | | | | | | | | | |
| | | PCIE3_CLKREQn | 12 | IO | | | | | | | | | |
| | | AK9 | MMC0_DAT0 | MMC0_DAT0 | | | | | | | | | |
| AL6 | MMC0_DAT1 | MMC0_DAT1 | | IO | 1.8V | 开启/关闭/上拉 | 开启/SS/上拉 | | PU/PD | VDDSD_MMC0 | | eMMC PHY | 否 |
| AK8 | MMC0_DAT2 | MMC0_DAT2 | | IO | 1.8V | 开启/关闭/上拉 | 开启/SS/上拉 | | PU/PD | VDDSD_MMC0 | | eMMC PHY | 否 |
| AK6 | MMC0_DAT3 | MMC0_DAT3 | | IO | 1.8V | 开启/关闭/上拉 | 开启/SS/上拉 | | PU/PD | VDDSD_MMC0 | | eMMC PHY | 否 |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用模 式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [7] | 复位 之后 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [8] | 复位 之后 的多 路复 用模 式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|--|-------------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AK7 | MMC0_DAT4 | MMC0_DAT4 | | IO | 1.8V | 开启/关闭/上拉 | 开启/SS/上拉 | | PU/PD | VDDS_MMC0 | | eMMCPHY | 否 |
| AL7 | MMC0_DAT5 | MMC0_DAT5 | | IO | 1.8V | 开启/关闭/上拉 | 开启/SS/上拉 | | PU/PD | VDDS_MMC0 | | eMMCPHY | 否 |
| AL5 | MMC0_DAT6 | MMC0_DAT6 | | IO | 1.8V | 开启/关闭/上拉 | 开启/SS/上拉 | | PU/PD | VDDS_MMC0 | | eMMCPHY | 否 |
| AK3 | MMC0_DAT7 | MMC0_DAT7 | | IO | 1.8V | 开启/关闭/上拉 | 开启/SS/上拉 | | PU/PD | VDDS_MMC0 | | eMMCPHY | 否 |
| AA33 | MMC1_DAT0 PADCFG: PADCONFIG_63 0x0011C0FC | MMC1_DAT0 | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV5 | 是 | SDIO | 否 |
| | | UART7_RTSn | 1 | O | | | | | | | | | |
| | | ECAP1_IN_APWM_OUT | 2 | IO | | | | | | | | | |
| | | TIMER_IO5 | 3 | IO | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM1_A | 4 | IO | | | | | | | | | |
| | | UART4_TXD | 5 | O | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_63 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | SPI1_D0 | 8 | IO | | | | | | | | | |
| | | UART5_RTSn | 9 | O | | | | | | | | | |
| | | I2C4_SCL | 10 | IOD | | | | | | | | | |
| UART2_TXD | 11 | O | | | | | | | | | | | |
| AB34 | MMC1_DAT1 PADCFG: PADCONFIG_62 0x0011C0F8 | MMC1_DAT1 | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV5 | 是 | SDIO | 否 |
| | | UART7_CTSn | 1 | I | | | | | | | | | |
| | | ECAP0_IN_APWM_OUT | 2 | IO | | | | | | | | | |
| | | TIMER_IO4 | 3 | IO | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM1_B | 4 | IO | | | | | | | | | |
| | | UART4_RXD | 5 | I | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM4_A | 6 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_62 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | SPI1_CS2 | 8 | IO | | | | | | | | | |
| | | UART5_CTSn | 9 | I | | | | | | | | | |
| | | I2C4_SDA | 10 | IOD | | | | | | | | | |
| UART2_RXD | 11 | I | | | | | | | | | | | |
| AA32 | MMC1_DAT2 PADCFG: PADCONFIG_61 0x0011C0F4 | MMC1_DAT2 | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV5 | 是 | SDIO | 否 |
| | | UART7_TXD | 1 | O | | | | | | | | | |
| | | TIMER_IO3 | 3 | IO | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM0_A | 4 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_61 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | SPI1_CS1 | 8 | IO | | | | | | | | | |
| | | CPTS0_TS_SYNC | 9 | O | | | | | | | | | |
| | | I2C3_SDA | 10 | IOD | | | | | | | | | |
| UART5_TXD | 11 | O | | | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用模 式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [7] | 复位 之后 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [8] | 复位 之后 的多 路复 用模 式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--|-------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AC38 | MMC1_DAT3 PADCFG: PADCONFIG_60 0x0011C0F0 | MMC1_DAT3 | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV5 | 是 | SDIO | 否 |
| | | UART7_RXD | 1 | I | | | | | | | | | |
| | | PCIE1_CLKREQn | 2 | IO | | | | | | | | | |
| | | TIMER_IO2 | 3 | IO | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM0_B | 4 | IO | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM3_A | 6 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_60 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | SPI1_CS0 | 8 | IO | | | | | | | | | |
| | | UART0_CTSn | 9 | I | | | | | | | | | |
| | | I2C3_SCL | 10 | IOD | | | | | | | | | |
| UART5_RXD | 11 | I | | | | | | | | | | | |
| P38 | OSC1_XI | OSC1_XI | | I | 1.8V | | | | VDDA_OSC1 | 是 | HFXOSC | | |
| N37 | OSC1_XO | OSC1_XO | | O | 1.8V | | | | VDDA_OSC1 | 是 | HFXOSC | | |
| AP4 | PCIE_REFCLK0_N_OUT | PCIE_REFCLK0_N_OUT | | O | 1.8V | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | | |
| AP5 | PCIE_REFCLK0_P_OUT | PCIE_REFCLK0_P_OUT | | O | 1.8V | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | | |
| AN8 | PCIE_REFCLK1_N_OUT | PCIE_REFCLK1_N_OUT | | O | 1.8V | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | | |
| AN9 | PCIE_REFCLK1_P_OUT | PCIE_REFCLK1_P_OUT | | O | 1.8V | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|-------------------|--|--------------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AN5 | PCIE_REFCLK2_N_OUT | PCIE_REFCLK2_N_OUT | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| AN6 | PCIE_REFCLK2_P_OUT | PCIE_REFCLK2_P_OUT | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| AP7 | PCIE_REFCLK3_N_OUT | PCIE_REFCLK3_N_OUT | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| AP8 | PCIE_REFCLK3_P_OUT | PCIE_REFCLK3_P_OUT | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| L38 | PMIC_POWER_EN1 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_68 0x4301C110 | PMIC_POWER_EN1 | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCU_I3C0_SDAPULLEN | 5 | OD | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_88 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| AJ34 | PMIC_WAKE0n PADCFG: PADCONFIG_13 0x0011C034 | PMIC_WAKE0n | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV2 | 是 | LVCMOS | 否 |
| | | MCASP4_AXR0 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | DSS_FSYNC1 | 4 | O | | | | | | | | | |
| | | MCAN17_RX | 5 | I | | | | | | | | | |
| | | GPMC0_WEn | 6 | O | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_13 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | SPI6_CS0 | 8 | IO | | | | | | | | | |
| | | TRC_DATA0 | 10 | O | | | | | | | | | |
| | | UART9_RTSn | 11 | O | | | | | | | | | |
| | | UART7_TXD | 13 | O | | | | | | | | | |
| AUDIO_EXT_REFCLK0 | 14 | IO | | | | | | | | | | | |
| P33 | PORz PADCFG: WKUP_PADCONFIG_94 0x4301C178 | PORz | 0 | I | 1.8V | | | 0 | VDDA_WKUP | 是 | FS_RESET | 否 | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路复用 模式 [9] | 拉动 类型 [10] | 电源 [11] | Hys [12] | 电压 缓冲器 类型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|--|------------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|---------------------------------|------------------|--|-------------|----------------------|----------------|
| AL38 | RESETSTATz PADCFG: PADCONFIG_67 0x0011C10C | RESETSTATz | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/低电平/关 闭 | 关闭/SS/关闭 | 0 | PU/PD | VDDSHV0 | 是 | LVC MOS | 否 |
| F34 | RESET_REQz PADCFG: WKUP_PADCONFIG_93 0x4301C174 | RESET_REQz | 0 | I | 1.8V/3.3V | 开启/关闭/上拉 | 开启/关闭/上拉 | 0 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVC MOS | 否 |
| AU9 | SERDES0_REFCLK_N | SERDES0_REFCLK_N | | IO | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| AU8 | SERDES0_REFCLK_P | SERDES0_REFCLK_P | | IO | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| AN11 | SERDES0_REXT | SERDES0_REXT | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| AV3 | SERDES1_REFCLK_N | SERDES1_REFCLK_N | | IO | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| AV4 | SERDES1_REFCLK_P | SERDES1_REFCLK_P | | IO | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| AL9 | SERDES1_REXT | SERDES1_REXT | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|------------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AV21 | SERDES2_REFCLK_N | SERDES2_REFCLK_N | | IO | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2 | | 4L_PHY | |
| AV22 | SERDES2_REFCLK_P | SERDES2_REFCLK_P | | IO | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2 | | 4L_PHY | |
| AL20 | SERDES2_REXT | SERDES2_REXT | | IO | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2 | | 4L_PHY | |
| AV16 | SERDES4_REFCLK_N | SERDES4_REFCLK_N | | IO | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4 | | 4L_PHY | |
| AV15 | SERDES4_REFCLK_P | SERDES4_REFCLK_P | | IO | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4 | | 4L_PHY | |
| AM19 | SERDES4_REXT | SERDES4_REXT | | IO | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4 | | 4L_PHY | |
| AR8 | SERDES0_RX0_N | PCIE1_RXN0 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| AR9 | SERDES0_RX0_P | PCIE1_RXP0 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AT10 | SERDES0_RX1_N | PCIE1_RXN1 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| AT11 | SERDES0_RX1_P | PCIE1_RXP1 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| AR11 | SERDES0_RX2_N | PCIE1_RXN2 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| | | PCIE3_RXN0 | | I | | | | | | | | | |
| | | USB0_SSRX1N | | I | | | | | | | | | |
| AR12 | SERDES0_RX2_P | PCIE1_RXP2 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| | | USB0_SSRX1P | | I | | | | | | | | | |
| | | PCIE3_RXP0 | | I | | | | | | | | | |
| AU11 | SERDES0_RX3_N | PCIE3_RXN1 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| | | USB0_SSRX2N | | I | | | | | | | | | |
| | | PCIE1_RXN3 | | I | | | | | | | | | |
| AU12 | SERDES0_RX3_P | USB0_SSRX2P | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| | | PCIE1_RXP3 | | I | | | | | | | | | |
| | | PCIE3_RXP1 | | I | | | | | | | | | |
| AT7 | SERDES0_TX0_N | PCIE1_TXN0 | | O | 1.8V | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AT8 | SERDES0_TX0_P | PCIE1_TXP0 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| AP10 | SERDES0_TX1_N | PCIE1_TXN1 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| AP11 | SERDES0_TX1_P | PCIE1_TXP1 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| AV9 | SERDES0_TX2_N | PCIE1_TXN2 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| | | PCIE3_TXN0 | | O | | | | | | | | | |
| | | USB0_SSTX1N | | O | | | | | | | | | |
| AV10 | SERDES0_TX2_P | PCIE3_TXP0 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| | | USB0_SSTX1P | | O | | | | | | | | | |
| | | PCIE1_TXP2 | | O | | | | | | | | | |
| AV12 | SERDES0_TX3_N | PCIE1_TXN3 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| | | PCIE3_TXN1 | | O | | | | | | | | | |
| | | USB0_SSTX2N | | O | | | | | | | | | |
| AV13 | SERDES0_TX3_P | USB0_SSTX2P | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| | | PCIE1_TXP3 | | O | | | | | | | | | |
| | | PCIE3_TXP1 | | O | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AU5 | SERDES1_RX0_N | SGMII3_RXN0 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| | | PCIE0_RXN0 | | I | | | | | | | | | |
| AU6 | SERDES1_RX0_P | PCIE0_RXP0 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| | | SGMII3_RXP0 | | I | | | | | | | | | |
| AT4 | SERDES1_RX1_N | PCIE0_RXN1 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| | | SGMII4_RXN0 | | I | | | | | | | | | |
| AT5 | SERDES1_RX1_P | SGMII4_RXP0 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| | | PCIE0_RXP1 | | I | | | | | | | | | |
| AU2 | SERDES1_RX2_N | PCIE2_RXN0 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| | | PCIE0_RXN2 | | I | | | | | | | | | |
| | | SGMII1_RXN0 | | I | | | | | | | | | |
| AU3 | SERDES1_RX2_P | SGMII1_RXP0 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| | | PCIE2_RXP0 | | I | | | | | | | | | |
| | | PCIE0_RXP2 | | I | | | | | | | | | |
| AT1 | SERDES1_RX3_N | SGMII2_RXN0 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| | | PCIE0_RXN3 | | I | | | | | | | | | |
| | | PCIE2_RXN1 | | I | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AT2 | SERDES1_RX3_P | PCIE2_RXP1 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| | | SGMII2_RXP0 | | I | | | | | | | | | |
| | | PCIE0_RXP3 | | I | | | | | | | | | |
| AV6 | SERDES1_TX0_N | PCIE0_TXN0 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| | | SGMII3_TXN0 | | O | | | | | | | | | |
| AV7 | SERDES1_TX0_P | PCIE0_TXP0 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| | | SGMII3_TXP0 | | O | | | | | | | | | |
| AR5 | SERDES1_TX1_N | SGMII4_TXN0 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| | | PCIE0_TXN1 | | O | | | | | | | | | |
| AR6 | SERDES1_TX1_P | PCIE0_TXP1 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| | | SGMII4_TXP0 | | O | | | | | | | | | |
| AR2 | SERDES1_TX2_N | PCIE0_TXN2 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| | | PCIE2_TXN0 | | O | | | | | | | | | |
| | | SGMII1_TXN0 | | O | | | | | | | | | |
| AR3 | SERDES1_TX2_P | SGMII1_TXP0 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| | | PCIE2_TXP0 | | O | | | | | | | | | |
| | | PCIE0_TXP2 | | O | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AP1 | SERDES1_TX3_N | PCIE2_TXN1 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| | | PCIE0_TXN3 | | O | | | | | | | | | |
| | | SGMII2_TXN0 | | O | | | | | | | | | |
| AP2 | SERDES1_TX3_P | PCIE2_TXP1 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES0_1/ VDDA_0P8_S ERDES_C0_1 / VDDA_1P8_S ERDES0_1 | | 4L_PHY | |
| | | SGMII2_TXP0 | | O | | | | | | | | | |
| | | PCIE0_TXP3 | | O | | | | | | | | | |
| AU23 | SERDES2_RX0_N | SGMII5_RXN0 | | I | 1.8V | | | | VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2 | | 4L_PHY | | |
| AU24 | SERDES2_RX0_P | SGMII5_RXP0 | | I | 1.8V | | | | VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2 | | 4L_PHY | | |
| AT22 | SERDES2_RX1_N | SGMII6_RXN0 | | I | 1.8V | | | | VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2 | | 4L_PHY | | |
| AT23 | SERDES2_RX1_P | SGMII6_RXP0 | | I | 1.8V | | | | VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2 | | 4L_PHY | | |
| AU20 | SERDES2_RX2_N | SGMII1_RXN0 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2 | | 4L_PHY | |
| | | SGMII7_RXN0 | | I | | | | | | | | | |
| AU21 | SERDES2_RX2_P | SGMII7_RXP0 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2 | | 4L_PHY | |
| | | SGMII1_RXP0 | | I | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AT19 | SERDES2_RX3_N | SGMII8_RXN0 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2 | | 4L_PHY | |
| | | SGMII2_RXN0 | | I | | | | | | | | | |
| AT20 | SERDES2_RX3_P | SGMII8_RXP0 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2 | | 4L_PHY | |
| | | SGMII2_RXP0 | | I | | | | | | | | | |
| AV24 | SERDES2_TX0_N | SGMII5_TXN0 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2 | | 4L_PHY | |
| AV25 | SERDES2_TX0_P | SGMII5_TXP0 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2 | | 4L_PHY | |
| AR23 | SERDES2_TX1_N | SGMII6_TXN0 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2 | | 4L_PHY | |
| AR24 | SERDES2_TX1_P | SGMII6_TXP0 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2 | | 4L_PHY | |
| AR20 | SERDES2_TX2_N | SGMII7_TXN0 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2 | | 4L_PHY | |
| | | SGMII1_TXN0 | | O | | | | | | | | | |
| AR21 | SERDES2_TX2_P | SGMII7_TXP0 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2 | | 4L_PHY | |
| | | SGMII1_TXP0 | | O | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AP19 | SERDES2_TX3_N | SGMII8_TXN0 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2 | | 4L_PHY | |
| | | SGMII2_TXN0 | | O | | | | | | | | | |
| AP20 | SERDES2_TX3_P | SGMII8_TXP0 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES2/ VDDA_0P8_S ERDES_C2/ VDDA_1P8_S ERDES2 | | 4L_PHY | |
| | | SGMII2_TXP0 | | O | | | | | | | | | |
| AR14 | SERDES4_RX0_N | SGMII5_RXN0 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4 | | 4L_PHY | |
| AR15 | SERDES4_RX0_P | SGMII5_RXP0 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4 | | 4L_PHY | |
| AU14 | SERDES4_RX1_N | SGMII6_RXN0 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4 | | 4L_PHY | |
| AU15 | SERDES4_RX1_P | SGMII6_RXP0 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4 | | 4L_PHY | |
| AR17 | SERDES4_RX2_N | USB0_SSRX1N | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4 | | 4L_PHY | |
| | | SGMII7_RXN0 | | I | | | | | | | | | |
| AR18 | SERDES4_RX2_P | USB0_SSRX1P | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4 | | 4L_PHY | |
| | | SGMII7_RXP0 | | I | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AU17 | SERDES4_RX3_N | USB0_SSRX2N | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4 | | 4L_PHY | |
| | | SGMII8_RXN0 | | I | | | | | | | | | |
| AU18 | SERDES4_RX3_P | USB0_SSRX2P | | I | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4 | | 4L_PHY | |
| | | SGMII8_RXP0 | | I | | | | | | | | | |
| AP13 | SERDES4_TX0_N | SGMII5_TXN0 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4 | | 4L_PHY | |
| | | DP0_TXN0 | | O | | | | | | | | | |
| AP14 | SERDES4_TX0_P | DP0_TXP0 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4 | | 4L_PHY | |
| | | SGMII5_TXP0 | | O | | | | | | | | | |
| AT13 | SERDES4_TX1_N | SGMII6_TXN0 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4 | | 4L_PHY | |
| | | DP0_TXN1 | | O | | | | | | | | | |
| AT14 | SERDES4_TX1_P | DP0_TXP1 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4 | | 4L_PHY | |
| | | SGMII6_TXP0 | | O | | | | | | | | | |
| AT16 | SERDES4_TX2_N | USB0_SSTX1N | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4 | | 4L_PHY | |
| | | DP0_TXN2 | | O | | | | | | | | | |
| | | SGMII7_TXN0 | | O | | | | | | | | | |
| AT17 | SERDES4_TX2_P | USB0_SSTX1P | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4 | | 4L_PHY | |
| | | SGMII7_TXP0 | | O | | | | | | | | | |
| | | DP0_TXP2 | | O | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|--|-------------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AV18 | SERDES4_TX3_N | USB0_SSTX2N | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4 | | 4L_PHY | |
| | | SGMII8_TXN0 | | O | | | | | | | | | |
| | | DP0_TXN3 | | O | | | | | | | | | |
| AV19 | SERDES4_TX3_P | SGMII8_TXP0 | | O | 1.8V | | | | | VDDA_0P8_S ERDES4/ VDDA_0P8_S ERDES_C4/ VDDA_1P8_S ERDES4 | | 4L_PHY | |
| | | DP0_TXP3 | | O | | | | | | | | | |
| | | USB0_SSTX2P | | O | | | | | | | | | |
| AM34 | SOC_SAFETY_ERRORn PADCFG: PADCONFIG_68 0x0011C110 | SOC_SAFETY_ERRORn | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/下拉 | 开启/SS/下拉 | 0 | PU/PD | VDDSHV0 | 是 | LVC MOS | 否 |
| AN38 | SPI0_CLK PADCFG: PADCONFIG_53 0x0011C0D4 | SPI0_CLK | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0 | 是 | LVC MOS | 否 |
| | | UART1_CTSn | 1 | I | | | | | | | | | |
| | | I2C2_SCL | 2 | IOD | | | | | | | | | |
| | | MCASP3_AXR0 | 3 | IO | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM2_A | 5 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_53 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| UART8_TXD | 11 | O | | | | | | | | | | | |
| AM37 | SPI0_CS0 PADCFG: PADCONFIG_51 0x0011C0CC | SPI0_CS0 | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0 | 是 | LVC MOS | 否 |
| | | MCASP3_ACLKX | 3 | IO | | | | | | | | | |
| | | MCASP3_ACLKR | 4 | IO | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM0_A | 5 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_51 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | MCAN14_TX | 9 | O | | | | | | | | | |
| DP0_HPDP | 12 | I | | | | | | | | | | | |
| AP38 | SPI0_CS1 PADCFG: PADCONFIG_52 0x0011C0D0 | SPI0_CS1 | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0 | 是 | LVC MOS | 否 |
| | | CPTS0_TS_COMP | 1 | O | | | | | | | | | |
| | | UART0_RTSn | 2 | O | | | | | | | | | |
| | | MCASP3_AFSX | 3 | IO | | | | | | | | | |
| | | MCASP3_AFSR | 4 | IO | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM1_A | 5 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_52 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | MCAN14_RX | 9 | I | | | | | | | | | |
| UART8_RXD | 11 | I | | | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用模 式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [7] | 复位 之后 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [8] | 复位 之后 的多 路复 用模 式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|--|-------------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AM35 | SPI0_D0 PADCFG: PADCONFIG_54 0x0011C0D8 | SPI0_D0 | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0 | 是 | LVCMOS | 否 |
| | | UART1_RTSn | 1 | O | | | | | | | | | |
| | | I2C2_SDA | 2 | IOD | | | | | | | | | |
| | | MCASP3_AXR1 | 3 | IO | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM3_A | 5 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_54 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| UART2_RXD | 11 | I | | | | | | | | | | | |
| AM36 | SPI0_D1 PADCFG: PADCONFIG_55 0x0011C0DC | SPI0_D1 | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0 | 是 | LVCMOS | 否 |
| | | MCASP3_AXR2 | 3 | IO | | | | | | | | | |
| | | EHRPWM4_A | 5 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_55 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| UART2_TXD | 11 | O | | | | | | | | | | | |
| G35 | TCK PADCFG: WKUP_PADCONFIG_73 0x4301C124 | TCK | 0 | I | 1.8V/3.3V | 开启/NA/上拉 | 开启/关闭/上拉 | 0 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVCMOS | 否 |
| AL37 | TDI PADCFG: PADCONFIG_69 0x0011C114 | TDI | 0 | I | 1.8V/3.3V | 开启/关闭/上拉 | 开启/关闭/上拉 | 0 | PU/PD | VDDSHV0 | 是 | LVCMOS | 否 |
| AL35 | TDO PADCFG: PADCONFIG_70 0x0011C118 | TDO | 0 | OZ | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/上拉 | 关闭/SS/上拉 | 0 | PU/PD | VDDSHV0 | 是 | LVCMOS | 否 |
| AR38 | TIMER_IO0 PADCFG: PADCONFIG_58 0x0011C0E8 | TIMER_IO0 | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0 | 是 | LVCMOS | 否 |
| | | ECAP1_IN_APWM_OUT | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | SYSCLKOUT0 | 2 | O | | | | | | | | | |
| | | UART3_RXD | 5 | I | | | | | | | | | |
| | | PCIE1_CLKREQn | 6 | IO | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_58 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | MMC1_SDCD | 8 | I | | | | | | | | | |
| | | MCAN13_TX | 9 | O | | | | | | | | | |
| I2C6_SDA | 13 | IOD | | | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用模 式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的焊 球状 态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的焊 球状 态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的多 路复 用模 式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|-------------------|--------------------|--------------|---------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AN37 | TIMER_IO1 PADCFG: PADCONFIG_59 0x0011C0EC | TIMER_IO1 | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0 | 是 | LVCMOS | 否 |
| | | ECAP2_IN_APWM_OUT | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | OBCLK0 | 2 | O | | | | | | | | | |
| | | UART3_TXD | 5 | O | | | | | | | | | |
| | | USB0_DRVVBUS | 6 | O | | | | | | | | | |
| | | GPIO0_59 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | MMC1_SDWP | 8 | I | | | | | | | | | |
| | | MCAN13_RX | 9 | I | | | | | | | | | |
| | | I2C6_SCL | 13 | IOD | | | | | | | | | |
| OBCLK0 | 15 | O | | | | | | | | | | | |
| AL36 | TMS PADCFG: PADCONFIG_71 0x0011C11C | TMS | 0 | I | 1.8V/3.3V | 开启/关闭/上拉 | 开启/关闭/上拉 | 0 | PU/PD | VDDSHV0 | 是 | LVCMOS | 否 |
| G37 | TRSTn PADCFG: WKUP_PADCONFIG_74 0x4301C128 | TRSTn | 0 | I | 1.8V/3.3V | 开启/NA/下拉 | 开启/关闭/下拉 | 0 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVCMOS | 否 |
| AM7 | UFS0_REF_CLK | UFS0_REF_CLK | | I | 1.2V | | | | | VDDA_1p8_U FS/ VDDA_0P8_U FS | | M-PHY | |
| AM8 | UFS0_RSTn | UFS0_RSTn | | I | 1.2V | | | | | VDDA_1p8_U FS/ VDDA_0P8_U FS | | M-PHY | |
| AM4 | UFS0_RX_DN0 | UFS0_RX_DN0 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_1p8_U FS/ VDDA_0P8_U FS | | M-PHY | |
| AM1 | UFS0_RX_DN1 | UFS0_RX_DN1 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_1p8_U FS/ VDDA_0P8_U FS | | M-PHY | |
| AM5 | UFS0_RX_DP0 | UFS0_RX_DP0 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_1p8_U FS/ VDDA_0P8_U FS | | M-PHY | |
| AM2 | UFS0_RX_DP1 | UFS0_RX_DP1 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_1p8_U FS/ VDDA_0P8_U FS | | M-PHY | |
| AL2 | UFS0_TX_DN0 | UFS0_TX_DN0 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_1p8_U FS/ VDDA_0P8_U FS | | M-PHY | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AN2 | UFS0_TX_DN1 | UFS0_TX_DN1 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_1p8_U FS/ VDDA_0P8_U FS | | M-PHY | |
| AL3 | UFS0_TX_DP0 | UFS0_TX_DP0 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_1p8_U FS/ VDDA_0P8_U FS | | M-PHY | |
| AN3 | UFS0_TX_DP1 | UFS0_TX_DP1 | | I | 1.8V | | | | | VDDA_1p8_U FS/ VDDA_0P8_U FS | | M-PHY | |
| AP16 | USB0_DM | USB0_DM | | IO | 3.3V | | | | | VDDA_0P8_U SB/ VDDA_1P8_U SB/ VDDA_3P3_U SB | | USB2PHY | |
| AP17 | USB0_DP | USB0_DP | | IO | 3.3V | | | | | VDDA_0P8_U SB/ VDDA_1P8_U SB/ VDDA_3P3_U SB | | USB2PHY | |
| AN17 | USB0_ID | USB0_ID | | A | 3.3V | | | | | VDDA_0P8_U SB/ VDDA_1P8_U SB/ VDDA_3P3_U SB | | USB2PHY | |
| AN18 | USB0_RCALIB | USB0_RCALIB | | A | 3.3V | | | | | VDDA_0P8_U SB/ VDDA_1P8_U SB/ VDDA_3P3_U SB | | USB2PHY | |
| AN15 | USB0_VBUS | USB0_VBUS | | A | 5.0V | | | | | VDDA_0P8_U SB/ VDDA_1P8_U SB/ VDDA_3P3_U SB | | DDR | |
| AB27、 AC24、 AF15、 AF18、 AF21、 AG11、 AG28、T25 | VDDAR_CORE | VDDAR_CORE | | PWR | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉动 类型 [10] | 电源 [11] | Hys [12] | 电压 缓冲器 类型 [13] | IO RET [14] |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|---------|-------------|----------------------|----------------|
| AB13、 AC16、 AC18、 AC20、 AE12、 M21、 N23、T15、 U20、 W14、 W21、 Y11、Y19 | VDDAR_CPU | VDDAR_CPU | | PWR | | | | | | | | | |
| M27、N24 | VDDAR_MCU | VDDAR_MCU | | PWR | | | | | | | | | |
| AJ24 | VDDA_0P8_DSITX | VDDA_0P8_DSITX | | PWR | | | | | | | | | |
| AJ25 | VDDA_0P8_DSITX_C | VDDA_0P8_DSITX_C | | PWR | | | | | | | | | |
| AH11 | VDDA_0P8_UFS | VDDA_0P8_UFS | | PWR | | | | | | | | | |
| AK20 | VDDA_0P8_USB | VDDA_0P8_USB | | PWR | | | | | | | | | |
| AJ28 | VDDA_0P8_CSIRX2 | VDDA_0P8_CSIRX2 | | PWR | | | | | | | | | |
| AJ26、AK26 | VDDA_0P8_CSIRX0_1 | VDDA_0P8_CSIRX0_1 | | PWR | | | | | | | | | |
| AE9 | VDDA_0P8_DLL_MMC0 | VDDA_0P8_DLL_MMC0 | | PWR | | | | | | | | | |
| U11 | VDDA_0P8_PLL_DDR0 | VDDA_0P8_PLL_DDR0 | | PWR | | | | | | | | | |
| M14 | VDDA_0P8_PLL_DDR1 | VDDA_0P8_PLL_DDR1 | | PWR | | | | | | | | | |
| N11 | VDDA_0P8_PLL_DDR2 | VDDA_0P8_PLL_DDR2 | | PWR | | | | | | | | | |
| M18 | VDDA_0P8_PLL_DDR3 | VDDA_0P8_PLL_DDR3 | | PWR | | | | | | | | | |
| AJ20、AJ21 | VDDA_0P8_SERDES2 | VDDA_0P8_SERDES2 | | PWR | | | | | | | | | |
| AJ17、AJ18 | VDDA_0P8_SERDES4 | VDDA_0P8_SERDES4 | | PWR | | | | | | | | | |
| AJ12、 AJ15、 AK13、 AK14 | VDDA_0P8_SERDES0_1 | VDDA_0P8_SERDES0_1 | | PWR | | | | | | | | | |
| AG21、 AH20 | VDDA_0P8_SERDES_C2 | VDDA_0P8_SERDES_C2 | | PWR | | | | | | | | | |
| AG17、 AH18 | VDDA_0P8_SERDES_C4 | VDDA_0P8_SERDES_C4 | | PWR | | | | | | | | | |
| AH12、 AH13、 AH15、 AH16 | VDDA_0P8_SERDES_C0_1 | VDDA_0P8_SERDES_C0_1 | | PWR | | | | | | | | | |
| AH24、 AH25 | VDDA_1P8_DSITX | VDDA_1P8_DSITX | | PWR | | | | | | | | | |
| AJ10 | VDDA_1P8_UFS | VDDA_1P8_UFS | | PWR | | | | | | | | | |
| AK21 | VDDA_1P8_USB | VDDA_1P8_USB | | PWR | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉 动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉 动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AH29、AJ29 | VDDA_1P8_CSIRX2 | VDDA_1P8_CSIRX2 | | PWR | | | | | | | | | |
| AH27、AH28 | VDDA_1P8_CSIRX0_1 | VDDA_1P8_CSIRX0_1 | | PWR | | | | | | | | | |
| AH21 | VDDA_1P8_SERDES2 | VDDA_1P8_SERDES2 | | PWR | | | | | | | | | |
| AH17 | VDDA_1P8_SERDES4 | VDDA_1P8_SERDES4 | | PWR | | | | | | | | | |
| AJ13、AJ14 | VDDA_1P8_SERDES0_1 | VDDA_1P8_SERDES0_1 | | PWR | | | | | | | | | |
| AJ23 | VDDA_1P8_SERDES2_4 | VDDA_1P8_SERDES2_4 | | PWR | | | | | | | | | |
| AJ19 | VDDA_3P3_USB | VDDA_3P3_USB | | PWR | | | | | | | | | |
| M31 | VDDA_ADC0 | VDDA_ADC0 | | PWR | | | | | | | | | |
| N30 | VDDA_ADC1 | VDDA_ADC1 | | PWR | | | | | | | | | |
| M28 | VDDA_MCU_PLLGRP0 | VDDA_MCU_PLLGRP0 | | PWR | | | | | | | | | |
| M26 | VDDA_MCU_TEMP | VDDA_MCU_TEMP | | PWR | | | | | | | | | |
| N29 | VDDA_OSC1 | VDDA_OSC1 | | PWR | | | | | | | | | |
| AA27 | VDDA_PLLGRP0 | VDDA_PLLGRP0 | | PWR | | | | | | | | | |
| Y28 | VDDA_PLLGRP1 | VDDA_PLLGRP1 | | PWR | | | | | | | | | |
| AG13 | VDDA_PLLGRP2 | VDDA_PLLGRP2 | | PWR | | | | | | | | | |
| V14 | VDDA_PLLGRP5 | VDDA_PLLGRP5 | | PWR | | | | | | | | | |
| R21 | VDDA_PLLGRP6 | VDDA_PLLGRP6 | | PWR | | | | | | | | | |
| P12 | VDDA_PLLGRP7 | VDDA_PLLGRP7 | | PWR | | | | | | | | | |
| P15 | VDDA_PLLGRP8 | VDDA_PLLGRP8 | | PWR | | | | | | | | | |
| Y26 | VDDA_PLLGRP9 | VDDA_PLLGRP9 | | PWR | | | | | | | | | |
| AG23 | VDDA_PLLGRP10 | VDDA_PLLGRP10 | | PWR | | | | | | | | | |
| AA23 | VDDA_PLLGRP12 | VDDA_PLLGRP12 | | PWR | | | | | | | | | |
| AB26 | VDDA_PLLGRP13 | VDDA_PLLGRP13 | | PWR | | | | | | | | | |
| N28 | VDDA_POR_WKUP | VDDA_POR_WKUP | | PWR | | | | | | | | | |
| Y27 | VDDA_TEMP0 | VDDA_TEMP0 | | PWR | | | | | | | | | |
| M12 | VDDA_TEMP1 | VDDA_TEMP1 | | PWR | | | | | | | | | |
| W23 | VDDA_TEMP2 | VDDA_TEMP2 | | PWR | | | | | | | | | |
| AE13 | VDDA_TEMP3 | VDDA_TEMP3 | | PWR | | | | | | | | | |
| AD18 | VDDA_TEMP4 | VDDA_TEMP4 | | PWR | | | | | | | | | |
| K31、L32 | VDDA_WKUP | VDDA_WKUP | | PWR | | | | | | | | | |
| V30、V32、W31 | VDDSHV0 | VDDSHV0 | | PWR | | | | | | | | | |
| H29、J28、K29 | VDDSHV0_MCU | VDDSHV0_MCU | | PWR | | | | | | | | | |
| H25、J24、K25 | VDDSHV1_MCU | VDDSHV1_MCU | | PWR | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后的 多路复用 模式 [9] | 拉动 类型 [10] | 电源 [11] | Hys [12] | 电压 缓冲器 类型 [13] | IO RET [14] |
|---|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-----------------------------|------------------|---------|-------------|----------------------|----------------|
| T30、T32、 U31 | VDDSHV2 | VDDSHV2 | | PWR | | | | | | | | | |
| H27、J26、 K27 | VDDSHV2_MCU | VDDSHV2_MCU | | PWR | | | | | | | | | |
| P31、R30、 R31 | VDDSHV5 | VDDSHV5 | | PWR | | | | | | | | | |
| A31、AK1、 B1、H11、 H13、H15、 H17、H19、 H9、J10、 J12、J14、 J16、J18、 J8、K11、 K13、K15、 K17、K19、 K9、L10、 L12、L14、 L16、L18、 M9、N10、 N8、P9、 R10、R8、 T9、U10、 U8 | VDDS_DDR | VDDS_DDR | | PWR | | | | | | | | | |
| T10 | VDDS_DDR_C0 | VDDS_DDR_C0 | | PWR | | | | | | | | | |
| L15 | VDDS_DDR_C1 | VDDS_DDR_C1 | | PWR | | | | | | | | | |
| M10 | VDDS_DDR_C2 | VDDS_DDR_C2 | | PWR | | | | | | | | | |
| L17 | VDDS_DDR_C3 | VDDS_DDR_C3 | | PWR | | | | | | | | | |
| AF9、 AG10、 AG8、AH9 | VDDS_MMC0 | VDDS_MMC0 | | PWR | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉动 类型 [10] | 电源 [11] | Hys [12] | 电压 缓冲器 类型 [13] | IO RET [14] |
|---|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|---------|-------------|----------------------|----------------|
| AA24、 AA26、 AA28、 AA30、 AB25、 AB29、 AB31、 AC26、 AC28、 AC30、 AD25、 AD27、 AD29、 AD31、 AE24、 AE26、 AE28、 AE30、 AE32、 AF13、 AF17、 AF19、 AF23、 AF25、 AF27、 AF29、 AF31、 AG12、 AG14、 AG16、 AG18、 AG20、 AG22、 AG24、 AG26、 AG30、 AG32、 AH31、 AJ30、 M11、 M13、 M15、 M17、 M19、 N12、N16、 N18、P11、 P17、P19、 R12、R14、 R16、R18、 R24、R26、 R28、T11、 T13、T27、 U12、U24、 | VDD_CORE | VDD_CORE | | PWR | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路复 用 模式 [9] | 拉动 类型 [10] | 电源 [11] | Hys [12] | 电压 缓冲器 类型 [13] | IO RET [14] |
|---|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|---------|-------------|----------------------|----------------|
| U26、U28、 V25、V27、 W24、 W26、 W28、 W30、 W32、 Y25、Y29、 Y31 | | | | | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉 动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉 动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|---|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| AA10、 AA12、 AA14、 AA20、 AA22、 AA8、 AB11、 AB19、 AB21、 AB23、 AB9、 AC10、 AC12、 AC14、 AC22、 AD11、 AD13、 AD15、 AD17、 AD19、 AD21、 AD23、 AD9、 AE10、 AE14、 AE16、 AE18、 AE20、 AE22、 AF11、 H21、H23、 J20、J22、 K21、K23、 L20、L22、 N20、N22、 P21、R20、 R22、T17、 T19、T21、 T23、U14、 U22、V11、 V13、V19、 V21、V23、 V9、W10、 W12、 W20、 W22、W8、 Y13、Y21、 Y23、Y9 | VDD_CPU | VDD_CPU | | PWR | | | | | | | | | |
| L24、M23、 M25、 N26、P23、 P25、P27 | VDD_MCU | VDD_MCU | | PWR | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用模 式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [7] | 复位 之后 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [8] | 复位 之后 的多 路复 用模 式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|--|----------------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| L28 | VDD_MCU_WAKE1 | VDD_MCU_WAKE1 | | PWR | | | | | | | | | |
| U29 | VDD_WAKE0 | VDD_WAKE0 | | PWR | | | | | | | | | |
| K28 | VMON1_ER_VSYS | VMON1_ER_VSYS | | A | | | | | | | | | |
| N27 | VMON2_IR_VCPU | VMON2_IR_VCPU | | A | | | | | | | | | |
| J30 | VMON3_IR_VEXT1P8 | VMON3_IR_VEXT1P8 | | A | | | | | | | | | |
| P28 | VMON4_IR_VEXT1P8 | VMON4_IR_VEXT1P8 | | A | | | | | | | | | |
| R29 | VMON5_IR_VEXT3P3 | VMON5_IR_VEXT3P3 | | A | | | | | | | | | |
| AA31 | VPP_CORE | VPP_CORE | | PWR | | | | | | | | | |
| L29 | VPP_MCU | VPP_MCU | | PWR | | | | | | | | | |
| H38 | WKUP_GPIO0_0 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_48 0x4301C0C0 | MCU_SPI1_CLK | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 开启/关闭/关闭 | 开启/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCU_SPI1_CLK | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_0 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | MCU_BOOTMODE03 | 自动加 载 | I | | | | | | | | | |
| J34 | WKUP_GPIO0_1 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_49 0x4301C0C4 | MCU_SPI1_D0 | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 开启/关闭/关闭 | 开启/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCU_SPI1_D0 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_1 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | MCU_BOOTMODE04 | 自动加 载 | I | | | | | | | | | |
| J35 | WKUP_GPIO0_2 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_50 0x4301C0C8 | MCU_SPI1_D1 | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 开启/关闭/关闭 | 开启/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCU_SPI1_D1 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_2 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | MCU_BOOTMODE05 | 自动加 载 | I | | | | | | | | | |
| J36 | WKUP_GPIO0_3 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_51 0x4301C0CC | MCU_SPI1_CS0 | 0 | IO | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCU_SPI1_CS0 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_3 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| H35 | WKUP_GPIO0_4 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_52 0x4301C0D0 | MCU_MCAN1_TX | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCU_MCAN1_TX | 1 | O | | | | | | | | | |
| | | MCU_SPI0_CS3 | 2 | IO | | | | | | | | | |
| | | MCU_ADC_EXT_TRIGGER0 | 3 | I | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_4 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| K36 | WKUP_GPIO0_5 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_53 0x4301C0D4 | MCU_MCAN1_RX | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCU_MCAN1_RX | 1 | I | | | | | | | | | |
| | | MCU_SPI1_CS3 | 2 | IO | | | | | | | | | |
| | | MCU_ADC_EXT_TRIGGER1 | 3 | I | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_5 | 7 | IO | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用模 式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [7] | 复位 之后 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [8] | 复位 之后 的多 路复 用模 式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|---|----------------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| L37 | WKUP_GPIO0_6 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_54 0x4301C0D8 | WKUP_UART0_CTSn | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | WKUP_UART0_CTSn | 1 | I | | | | | | | | | |
| | | MCU_CPTS0_HW1TSPUSH | 2 | I | | | | | | | | | |
| | | MCU_I2C1_SCL | 3 | IOD | | | | | | | | | |
| L36 | WKUP_GPIO0_7 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_55 0x4301C0DC | WKUP_UART0_RTSn | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | WKUP_UART0_RTSn | 1 | O | | | | | | | | | |
| | | MCU_CPTS0_HW2TSPUSH | 2 | I | | | | | | | | | |
| | | MCU_I2C1_SDA | 3 | IOD | | | | | | | | | |
| L35 | WKUP_GPIO0_8 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_56 0x4301C0E0 | MCU_I2C1_SCL | 0 | IOD | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCU_I2C1_SCL | 1 | IOD | | | | | | | | | |
| | | MCU_CPTS0_TS_SYNC | 2 | O | | | | | | | | | |
| | | MCU_I3C0_SCL | 3 | IO | | | | | | | | | |
| L34 | WKUP_GPIO0_9 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_57 0x4301C0E4 | MCU_TIMER_IO6 | 4 | IO | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCU_I2C1_SDA | 0 | IOD | | | | | | | | | |
| | | MCU_I2C1_SDA | 1 | IOD | | | | | | | | | |
| | | MCU_CPTS0_TS_COMP | 2 | O | | | | | | | | | |
| L33 | WKUP_GPIO0_10 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_58 0x4301C0E8 | MCU_I3C0_SDA | 3 | IO | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCU_TIMER_IO7 | 4 | IO | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_9 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | MCU_EXT_REFCLK0 | 0 | I | | | | | | | | | |
| L33 | WKUP_GPIO0_10 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_58 0x4301C0E8 | MCU_EXT_REFCLK0 | 1 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCU_UART0_TXD | 2 | O | | | | | | | | | |
| | | MCU_ADC_EXT_TRIGGER0 | 3 | I | | | | | | | | | |
| | | MCU_CPTS0_RFT_CLK | 4 | I | | | | | | | | | |
| | | MCU_SYCLKOUT0 | 5 | O | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_10 | 7 | IO | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用模 式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [7] | 复位 之后 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [8] | 复位 之后 的多 路复 用模 式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|---------------|--|----------------------|--------------------|--------------|---------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| M38 | WKUP_GPIO0_11 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_59 0x4301C0EC | MCU_OBSCLK0 | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCU_OBSCLK0 | 1 | O | | | | | | | | | |
| | | MCU_UART0_RXD | 2 | I | | | | | | | | | |
| | | MCU_ADC_EXT_TRIGGER1 | 3 | I | | | | | | | | | |
| | | MCU_TIMER_IO1 | 4 | IO | | | | | | | | | |
| | | MCU_I3C0_SDAPULLEN | 5 | OD | | | | | | | | | |
| | | MCU_CLKOUT0 | 6 | OZ | | | | | | | | | |
| WKUP_GPIO0_11 | 7 | IO | | | | | | | | | | | |
| J37 | WKUP_GPIO0_12 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_60 0x4301C0F0 | MCU_UART0_TXD | 0 | O | 1.8V/3.3V | 开启/关闭/关闭 | 开启/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCU_SPI0_CS1 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_12 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | MCU_BOOTMODE08 | 自动加 载 | I | | | | | | | | | |
| K38 | WKUP_GPIO0_13 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_61 0x4301C0F4 | MCU_UART0_RXD | 0 | I | 1.8V/3.3V | 开启/关闭/关闭 | 开启/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCU_SPI1_CS1 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_13 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | MCU_BOOTMODE09 | 自动加 载 | I | | | | | | | | | |
| H37 | WKUP_GPIO0_14 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_62 0x4301C0F8 | MCU_UART0_CTSn | 0 | I | 1.8V/3.3V | 开启/关闭/关闭 | 开启/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCU_SPI0_CS2 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | MCU_TIMER_IO8 | 4 | IO | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_14 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | MCU_BOOTMODE06 | 自动加 载 | I | | | | | | | | | |
| K37 | WKUP_GPIO0_15 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_63 0x4301C0FC | MCU_UART0_RTSn | 0 | O | 1.8V/3.3V | 开启/关闭/关闭 | 开启/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVCMOS | 是 |
| | | MCU_SPI1_CS2 | 1 | IO | | | | | | | | | |
| | | MCU_TIMER_IO9 | 4 | IO | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_15 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | MCU_BOOTMODE07 | 自动加 载 | I | | | | | | | | | |
| M33 | WKUP_GPIO0_49 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_100 0x4301C190 | PMIC_WAKE1n | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVCMOS | 否 |
| | | MCU_EXT_REFCLK0 | 1 | I | | | | | | | | | |
| | | MCU_CPTS0_RFT_CLK | 2 | I | | | | | | | | | |
| | | WKUP_GPIO0_49 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| M37 | WKUP_GPIO0_56 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_72 0x4301C120 | MCU_TIMER_IO6 | 4 | IO | 1.8V/3.3V | 开启/关闭/关闭 | 开启/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVCMOS | 否 |
| | | WKUP_GPIO0_56 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | BOOTMODE04 | 自动加 载 | I | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用模 式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [7] | 复位 之后 的焊 球状 态 (RX/TX/拉 动) [8] | 复位 之后 的多 路复 用模 式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|--------------|--|----------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| M36 | WKUP_GPIO0_57 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_95 0x4301C17C | MCU_TIMER_I07 | 4 | IO | 1.8V/3.3V | 开启/关闭/关闭 | 开启/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVC MOS | 否 |
| | | WKUP_GPIO0_57 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | BOOTMODE05 | 自动加 载 | I | | | | | | | | | |
| N34 | WKUP_GPIO0_66 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_96 0x4301C180 | WKUP_GPIO0_66 | 7 | IO | 1.8V/3.3V | 开启/关闭/关闭 | 开启/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVC MOS | 是 |
| | | BOOTMODE06 | 自动加 载 | I | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| M34 | WKUP_GPIO0_67 PADCFG: WKUP_PADCONFIG_97 0x4301C184 | WKUP_LF_CLKIN | 1 | I | 1.8V/3.3V | 开启/关闭/关闭 | 开启/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVC MOS | 是 |
| | | WKUP_GPIO0_67 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| | | BOOTMODE07 | 自动加 载 | I | | | | | | | | | |
| N33 | WKUP_I2C0_SCL PADCFG: WKUP_PADCONFIG_64 0x4301C100 | WKUP_I2C0_SCL | 0 | IOD | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 开启/SS/关闭 | 0 | | VDDSHV0_M CU | 是 | I2C 开漏 | 是 |
| | | WKUP_GPIO0_63 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| N35 | WKUP_I2C0_SDA PADCFG: WKUP_PADCONFIG_65 0x4301C104 | WKUP_I2C0_SDA | 0 | IOD | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 开启/SS/关闭 | 0 | | VDDSHV0_M CU | 是 | I2C 开漏 | 是 |
| | | WKUP_GPIO0_64 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| T38 | WKUP_OSC0_XI | WKUP_OSC0_XI | | I | 1.8V | | | | | VDDA_WKUP | 是 | HFXOSC | 否 |
| U37 | WKUP_OSC0_XO | WKUP_OSC0_XO | | O | 1.8V | | | | | VDDA_WKUP | 是 | HFXOSC | 否 |
| K35 | WKUP_UART0_RXD PADCFG: WKUP_PADCONFIG_44 0x4301C0B0 | WKUP_UART0_RXD | 0 | I | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVC MOS | 是 |
| | | WKUP_GPIO0_58 | 7 | IO | | | | | | | | | |
| K34 | WKUP_UART0_TXD PADCFG: WKUP_PADCONFIG_45 0x4301C0B4 | WKUP_UART0_TXD | 0 | O | 1.8V/3.3V | 关闭/关闭/关闭 | 关闭/关闭/关闭 | 7 | PU/PD | VDDSHV0_M CU | 是 | LVC MOS | 是 |
| | | WKUP_GPIO0_59 | 7 | IO | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路复 用 模式 [9] | 拉 动 类 型 [10] | 电 源 [11] | Hys [12] | 电 压 缓 冲 器 类 型 [13] | IO RET [14] |
|---|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| A1、A10、 A12、A15、 A2、A20、 A23、A25、 A28、A34、 A37、A5、 A7、AA11、 AA13、 AA19、 AA2、 AA21、 AA25、 AA29、 AA34、 AA36、 AA38、 AA5、 AA9、 AB1、 AB10、 AB12、 AB14、 AB20、 AB22、 AB24、 AB28、 AB30、 AB32、 AB33、 AB35、 AB37、 AB5、 AB8、 AC11、 AC13、 AC15、 AC17、 AC19、 AC2、 AC21、 AC23、 AC25、 AC27、 AC29、 AC31、 AC6、 AC9、 AD1、 AD10、 AD12、 AD14、 AD16、 AD20、 | VSS | VSS | | GND | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路复用 模式 [9] | 拉动 类型 [10] | 电源 [11] | Hys [12] | 电压 缓冲器 类型 [13] | IO RET [14] |
|--|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|---------------------------------|------------------|---------|-------------|----------------------|----------------|
| AD22、 AD24、 AD26、 AD28、 AD30、 AD32、 AD35、 AD4、 AD8、 AE11、 AE15、 AE17、 AE19、 AE2、 AE21、 AE23、 AE25、 AE27、 AE29、 AE31、 AE5、 AF10、 AF12、 AF14、 AF16、 AF20、 AF22、 AF24、 AF26、 AF28、 AF3、 AF30、 AF32、 AF6、AF8、 AG1、 AG15、 AG19、 AG25、 AG27、 AG29、 AG31、 AG4、 AG7、 AG9、 AH10、 AH14、 AH19、 AH2、 AH22、 AH23、 AH26、 AH30、 AH32、 | | | | | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉动 类型 [10] | 电源 [11] | Hys [12] | 电压 缓冲器 类型 [13] | IO RET [14] |
|---|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|---------|-------------|----------------------|----------------|
| AH35、 AH5、 AH8、 AJ11、 AJ16、 AJ22、 AJ27、 AJ3、 AJ31、 AJ6、AJ8、 AJ9、 AK10、 AK11、 AK12、 AK15、 AK16、 AK17、 AK18、 AK19、 AK22、 AK23、 AK24、 AK25、 AK27、 AK28、 AK30、 AK32、 AL1、 AL10、 AL12、 AL13、 AL14、 AL15、 AL16、 AL17、AL18 | | | | | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球编号 [1] | 焊球名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号名称 [3] | 多路复用模式 [4] | 信号类型 [5] | I/O 工作电压 [6] | 复位期间的焊球状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位之后的焊球状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位之后的多路复用模式 [9] | 拉动类型 [10] | 电源 [11] | Hys [12] | 电压缓冲器类型 [13] | IO RET [14] |
|---|---|----------|------------|----------|--------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|---------|----------|--------------|-------------|
| AL19、AL21、AL26、AL29、AL31、AL4、AM11、AM13、AM15、AM18、AM20、AM23、AM25、AM27、AM3、AM30、AM32、AM38、AM6、AN1、AN10、AN12、AN14、AN16、AN19、AN22、AN25、AN28、AN31、AN34、AN4、AN7、AP12、AP15、AP18、AP21、AP24、AP27、AP3、AP30、AP33、AP36、AP6、AP9、AR1、AR10、AR13、AR16、AR19、AR22、AR25、AR28、AR31、 | VSS (续) | VSS | | GND | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路复 用 模式 [9] | 拉动 类型 [10] | 电源 [11] | Hys [12] | 电压 缓冲器 类型 [13] | IO RET [14] |
|--|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|---------|-------------|----------------------|----------------|
| AR34、 AR37、 AR4、 AR7、 AT12、 AT15、 AT18、 AT21、 AT24、 AT27、 AT3、 AT30、 AT33、 AT36、 AT6、AT9、 AU1、 AU10、 AU13、 AU16、 AU19、 AU22、 AU25、 AU28、 AU31、 AU34、 AU37、 AU38、 AU4、 AU7、 AV1、 AV11、 AV14、 AV17、 AV2、 AV20、 AV23、 AV26、 AV29、 AV32、 AV35、 AV5、AV8、 B11、B13、 B16、B19、 B22、B24、 B26、B29、 B31、B38、 B6、B9、 C14、C17、 C18、C2、 C21、C27、 C30、C4、 C8、D10、 D15、D20、 | | | | | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉动 类型 [10] | 电源 [11] | Hys [12] | 电压 缓冲器 类型 [13] | IO RET [14] |
|---|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|---------|-------------|----------------------|----------------|
| D23、D28、 D3、D35、 D6、D7、 E12、E13、 E16、E19、 E2、E22、 E25、E26、 E29、E31、 E5、E9、 F1、F11、 F14、F17、 F21、F24、 F27、F30、 F4、F7、 F8、G15 | | | | | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉动 类型 [10] | 电源 [11] | Hys [12] | 电压 缓冲器 类型 [13] | IO RET [14] |
|--|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|---------|-------------|----------------------|----------------|
| G18、 G20、 G28、G3、 G6、H10、 H16、H18、 H2、H20、 H22、H24、 H26、H28、 H30、H31、 H5、H7、 H8、J1、 J11、J13、 J15、J17、 J19、J21、 J23、J25、 J27、J29、 J32、J4、 J9、K10、 K12、K14、 K16、K18、 K2、K20、 K22、K24、 K26、K6、 K8、L1、 L11、L13、 L19、L21、 L23、L31、 L5、L9、 M16、M2、 M20、 M22、 M24、 M29、 M30、 M32、M5、 M8、N15、 N17、N19、 N21、N25、 N3、N31、 N32、N38、 N6、N9、 P1、P10、 P16、P18、 P20、P22、 P24、P26、 P30、P32、 P35、P37、 P4、P7、 P8、R11、 R13、R15、 R17、R19、 R2、R23、 R25、R27、 | VSS (续) | VSS | | GND | | | | | | | | | |

表 5-1. 引脚属性 (ALY 封装) (续)

| 焊球 编号 [1] | 焊球 名称 [2] PADCFG 寄存器 [15] PADCFG 地址 [16] | 信号 名称 [3] | 多路复 用 模式 [4] | 信号 类型 [5] | I/O 工作 电压 [6] | 复位 期间 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [7] | 复位 之后 的 焊球 状态 (RX/TX/拉动) [8] | 复位 之后 的 多路 复用 模式 [9] | 拉动 类型 [10] | 电源 [11] | Hys [12] | 电压 缓冲器 类型 [13] | IO RET [14] |
|---|---|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|---------|-------------|----------------------|----------------|
| R32、R34、 R36、R38、 R5、R9、 T12、T14、 T16、T18、 T20、T22、 T24、T26、 T28、T3、 T31、T33、 T35、T37、 T6、T8、 U13、U19、 U21、U23、 U25、U27、 U3、U30、 U32、U34、 U36、U38、 U6、U9、 V10、V12、 V2、V20、 V22、V24、 V26、V28、 V31、V33、 V35、V37、 V5、V8、 W1 | | | | | | | | | | | | | |
| W11、 W13、 W19、 W25、 W27、 W29、 W34、 W36、 W38、W4、 W7、W9、 Y10、Y12、 Y14、Y20、 Y22、Y24、 Y3、Y30、 Y32、Y33、 Y35、Y37、 Y6、Y8 | VSS (续) | VSS | | GND | | | | | | | | | |

(1) “多路复用模式”字段不用于为该引脚选择多路复用信号功能。有关更多信息，请参阅器件 TRM 的器件配置一章中的 ADC 集成详细信息一节。

5.3 信号说明

1. 信号名称：通过引脚的信号的名称。

备注

每个信号说明表中提供的信号名称和说明表示在引脚上实现并通过 PADCONFIG 寄存器选择的引脚多路复用信号功能。器件子系统可以提供信号功能的二次多路复用，这些表中没有说明这些功能。有关辅助多路复用信号功能的更多信息，请参阅器件 TRM 的相应外设章节。

2. 引脚类型：信号方向和类型：

- I = 输入
- O = 输出
- OD = 输出，具有开漏输出功能
- IO = 输入、输出或同时输入和输出
- IOD = 输入、输出或同时输入和输出，具有开漏输出功能
- IOZ = 输入、输出或同时输入和输出，具有三态输出功能
- OZ = 具有三态输出功能的输出
- A = 模拟
- PWR = 电源
- GND = 接地
- CAP = LDO 电容器

3. 说明：信号说明

4. 焊球：与信号相关的球号

有关 IO 单元配置的更多信息，请参阅器件 TRM 的 *器件配置* 一章中的 *焊盘配置寄存器* 一节。

5.3.1 ADC

5.3.1.1 MCU 域

表 5-2. MCU_ADC 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------------------|----------|----------|-------------|
| MCU_ADC_EXT_TRIGGER0 | I | ADC 触发输入 | E38、H35、L33 |
| MCU_ADC_EXT_TRIGGER1 | I | ADC 触发输入 | E37、K36、M38 |

表 5-3. MCU_ADC0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|---------------|----------|------------|------------|
| MCU_ADC0_REFN | A | ADC 基准 (负) | U35 |
| MCU_ADC0_REFP | A | ADC 基准 (正) | R35 |
| MCU_ADC0_AIN0 | A | ADC 输入 0 | P36 |
| MCU_ADC0_AIN1 | A | ADC 输入 1 | V36 |
| MCU_ADC0_AIN2 | A | ADC 输入 2 | T34 |
| MCU_ADC0_AIN3 | A | ADC 输入 3 | T36 |
| MCU_ADC0_AIN4 | A | ADC 输入 4 | P34 |
| MCU_ADC0_AIN5 | A | ADC 输入 5 | R37 |
| MCU_ADC0_AIN6 | A | ADC 输入 6 | R33 |
| MCU_ADC0_AIN7 | A | ADC 输入 7 | V38 |

表 5-4. MCU_ADC1 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|---------------|----------|--------------|------------|
| MCU_ADC1_REFN | A | ADC 基准 (负) | W35 |
| MCU_ADC1_REFP | A | ADC 基准 (正) | AA35 |
| MCU_ADC1_AIN0 | A | ADC 输入 0 | Y38 |
| MCU_ADC1_AIN1 | A | ADC 输入 1 | Y34 |
| MCU_ADC1_AIN2 | A | ADC 输入 2 | V34 |
| MCU_ADC1_AIN3 | A | ADC 输入 3 | W37 |
| MCU_ADC1_AIN4 | A | ADC 输入 4 | AA37 |
| MCU_ADC1_AIN5 | A | ADC 输入 5 | W33 |
| MCU_ADC1_AIN6 | A | ADC 输入 6 | U33 |
| MCU_ADC1_AIN7 | A | ADC 输入 7 | Y36 |

5.3.2 DDRSS

5.3.2.1 MAIN 域

表 5-5. DDRSS0 信号说明

| 信号名称 [1] ⁽²⁾ | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|--------------------------|----------|------------------|------------|
| DDR0_CKN | IO | DDRSS 差分时钟 (负) | AB2 |
| DDR0_CKP | IO | DDRSS 差分时钟 (正) | AC1 |
| DDR0_RESETn | IO | DDRSS 复位 | AD5 |
| DDR0_RET | I | DDR 保持使能 | AC8 |
| DDR0_CA0 | IO | DDRSS 命令地址 | AD2 |
| DDR0_CA1 | IO | DDRSS 命令地址 | AC5 |
| DDR0_CA2 | IO | DDRSS 命令地址 | AB4 |
| DDR0_CA3 | IO | DDRSS 命令地址 | AC4 |
| DDR0_CA4 | IO | DDRSS 命令地址 | AB3 |
| DDR0_CA5 | IO | DDRSS 命令地址 | AC3 |
| DDR0_CAL0 ⁽¹⁾ | A | IO 焊盘校准电阻 | AE8 |
| DDR0_CKE0 | IO | DDRSS 时钟使能 | AB6 |
| DDR0_CKE1 | IO | DDRSS 时钟使能 | AD3 |
| DDR0_CSn0_0 | IO | DDRSS 片选 | AD7 |
| DDR0_CSn0_1 | IO | DDRSS 片选 | AC7 |
| DDR0_CSn1_0 | IO | DDRSS 片选 | AB7 |
| DDR0_CSn1_1 | IO | DDRSS 片选 | AD6 |
| DDR0_DM0 | IO | DDRSS 数据掩码 | V3 |
| DDR0_DM1 | IO | DDRSS 数据掩码 | AA4 |
| DDR0_DM2 | IO | DDRSS 数据掩码 | AG2 |
| DDR0_DM3 | IO | DDRSS 数据掩码 | AJ5 |
| DDR0_DQ0 | IO | DDRSS 数据 | U2 |
| DDR0_DQ1 | IO | DDRSS 数据 | U4 |
| DDR0_DQ2 | IO | DDRSS 数据 | W6 |
| DDR0_DQ3 | IO | DDRSS 数据 | W5 |
| DDR0_DQ4 | IO | DDRSS 数据 | V4 |
| DDR0_DQ5 | IO | DDRSS 数据 | V7 |

表 5-5. DDRSS0 信号说明 (续)

| 信号名称 [1] ⁽²⁾ | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-------------------------|----------|--------------|------------|
| DDR0_DQ6 | IO | DDRSS 数据 | U5 |
| DDR0_DQ7 | IO | DDRSS 数据 | V6 |
| DDR0_DQ8 | IO | DDRSS 数据 | Y2 |
| DDR0_DQ9 | IO | DDRSS 数据 | W3 |
| DDR0_DQ10 | IO | DDRSS 数据 | AA3 |
| DDR0_DQ11 | IO | DDRSS 数据 | W2 |
| DDR0_DQ12 | IO | DDRSS 数据 | AA6 |
| DDR0_DQ13 | IO | DDRSS 数据 | Y4 |
| DDR0_DQ14 | IO | DDRSS 数据 | Y5 |
| DDR0_DQ15 | IO | DDRSS 数据 | AA7 |
| DDR0_DQ16 | IO | DDRSS 数据 | AF2 |
| DDR0_DQ17 | IO | DDRSS 数据 | AE7 |
| DDR0_DQ18 | IO | DDRSS 数据 | AG3 |
| DDR0_DQ19 | IO | DDRSS 数据 | AF5 |
| DDR0_DQ20 | IO | DDRSS 数据 | AE6 |
| DDR0_DQ21 | IO | DDRSS 数据 | AF4 |
| DDR0_DQ22 | IO | DDRSS 数据 | AE3 |
| DDR0_DQ23 | IO | DDRSS 数据 | AE4 |
| DDR0_DQ24 | IO | DDRSS 数据 | AG5 |
| DDR0_DQ25 | IO | DDRSS 数据 | AH3 |
| DDR0_DQ26 | IO | DDRSS 数据 | AJ2 |
| DDR0_DQ27 | IO | DDRSS 数据 | AH4 |
| DDR0_DQ28 | IO | DDRSS 数据 | AJ4 |
| DDR0_DQ29 | IO | DDRSS 数据 | AH6 |
| DDR0_DQ30 | IO | DDRSS 数据 | AH7 |
| DDR0_DQ31 | IO | DDRSS 数据 | AG6 |
| DDR0_QS0N | IO | DDRSS 互补数据选通 | V1 |
| DDR0_QS0P | IO | DDRSS 数据选通 | U1 |
| DDR0_QS1N | IO | DDRSS 互补数据选通 | Y1 |
| DDR0_QS1P | IO | DDRSS 数据选通 | AA1 |
| DDR0_QS2N | IO | DDRSS 互补数据选通 | AE1 |
| DDR0_QS2P | IO | DDRSS 数据选通 | AF1 |
| DDR0_QS3N | IO | DDRSS 互补数据选通 | AH1 |
| DDR0_QS3P | IO | DDRSS 数据选通 | AJ1 |

(1) 必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部 $240\Omega \pm 1\%$ 电阻器。不应向该引脚施加外部电压。

(2) 必须始终按递增顺序使用 DDRSS0、DDRSS1、DDRSS2 和 DDRSS3。例如，使用单个 LPDDR 元件时，该元件必须连接到 DDR0_* 接口。当使用两个 LPDDR 元件时，它们必须连接到 DDR0_* 和 DDR1_* 接口，依此类推。

表 5-6. DDRSS1 信号说明

| 信号名称 [1] ⁽²⁾ | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-------------------------|----------|----------------|------------|
| DDR1_CKN | IO | DDRSS 差分时钟 (负) | A11 |
| DDR1_CKP | IO | DDRSS 差分时钟 (正) | B10 |
| DDR1_RESETn | IO | DDRSS 复位 | G10 |

表 5-6. DDRSS1 信号说明 (续)

| 信号名称 [1] (2) | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|---------------|----------|------------|------------|
| DDR1_RET | I | DDR 保持使能 | G8 |
| DDR1_CA0 | IO | DDRSS 命令地址 | F12 |
| DDR1_CA1 | IO | DDRSS 命令地址 | C12 |
| DDR1_CA2 | IO | DDRSS 命令地址 | B12 |
| DDR1_CA3 | IO | DDRSS 命令地址 | C11 |
| DDR1_CA4 | IO | DDRSS 命令地址 | D12 |
| DDR1_CA5 | IO | DDRSS 命令地址 | E10 |
| DDR1_CAL0 (1) | A | IO 焊盘校准电阻 | G14 |
| DDR1_CKE0 | IO | DDRSS 时钟使能 | D11 |
| DDR1_CKE1 | IO | DDRSS 时钟使能 | C10 |
| DDR1_CSn0_0 | IO | DDRSS 片选 | E11 |
| DDR1_CSn0_1 | IO | DDRSS 片选 | G11 |
| DDR1_CSn1_0 | IO | DDRSS 片选 | F10 |
| DDR1_CSn1_1 | IO | DDRSS 片选 | G12 |
| DDR1_DM0 | IO | DDRSS 数据掩码 | E17 |
| DDR1_DM1 | IO | DDRSS 数据掩码 | C15 |
| DDR1_DM2 | IO | DDRSS 数据掩码 | D8 |
| DDR1_DM3 | IO | DDRSS 数据掩码 | C1 |
| DDR1_DQ0 | IO | DDRSS 数据 | F16 |
| DDR1_DQ1 | IO | DDRSS 数据 | G16 |
| DDR1_DQ2 | IO | DDRSS 数据 | F15 |
| DDR1_DQ3 | IO | DDRSS 数据 | E15 |
| DDR1_DQ4 | IO | DDRSS 数据 | D16 |
| DDR1_DQ5 | IO | DDRSS 数据 | C16 |
| DDR1_DQ6 | IO | DDRSS 数据 | B17 |
| DDR1_DQ7 | IO | DDRSS 数据 | D17 |
| DDR1_DQ8 | IO | DDRSS 数据 | B15 |
| DDR1_DQ9 | IO | DDRSS 数据 | B14 |
| DDR1_DQ10 | IO | DDRSS 数据 | C13 |
| DDR1_DQ11 | IO | DDRSS 数据 | D13 |
| DDR1_DQ12 | IO | DDRSS 数据 | F13 |
| DDR1_DQ13 | IO | DDRSS 数据 | G13 |
| DDR1_DQ14 | IO | DDRSS 数据 | E14 |
| DDR1_DQ15 | IO | DDRSS 数据 | D14 |
| DDR1_DQ16 | IO | DDRSS 数据 | E8 |
| DDR1_DQ17 | IO | DDRSS 数据 | G9 |
| DDR1_DQ18 | IO | DDRSS 数据 | F9 |
| DDR1_DQ19 | IO | DDRSS 数据 | D9 |
| DDR1_DQ20 | IO | DDRSS 数据 | C9 |
| DDR1_DQ21 | IO | DDRSS 数据 | B8 |
| DDR1_DQ22 | IO | DDRSS 数据 | B7 |
| DDR1_DQ23 | IO | DDRSS 数据 | C7 |

表 5-6. DDRSS1 信号说明 (续)

| 信号名称 [1] ⁽²⁾ | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-------------------------|----------|--------------|------------|
| DDR1_DQ24 | IO | DDRSS 数据 | B2 |
| DDR1_DQ25 | IO | DDRSS 数据 | B3 |
| DDR1_DQ26 | IO | DDRSS 数据 | B4 |
| DDR1_DQ27 | IO | DDRSS 数据 | B5 |
| DDR1_DQ28 | IO | DDRSS 数据 | A6 |
| DDR1_DQ29 | IO | DDRSS 数据 | C5 |
| DDR1_DQ30 | IO | DDRSS 数据 | C6 |
| DDR1_DQ31 | IO | DDRSS 数据 | C3 |
| DDR1_QS0N | IO | DDRSS 互补数据选通 | A17 |
| DDR1_QS0P | IO | DDRSS 数据选通 | A16 |
| DDR1_QS1N | IO | DDRSS 互补数据选通 | A14 |
| DDR1_QS1P | IO | DDRSS 数据选通 | A13 |
| DDR1_QS2N | IO | DDRSS 互补数据选通 | A9 |
| DDR1_QS2P | IO | DDRSS 数据选通 | A8 |
| DDR1_QS3N | IO | DDRSS 互补数据选通 | A4 |
| DDR1_QS3P | IO | DDRSS 数据选通 | A3 |

(1) 必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部 $240\Omega \pm 1\%$ 电阻器。不应向该引脚施加外部电压。

(2) 必须始终按递增顺序使用 DDRSS0、DDRSS1、DDRSS2 和 DDRSS3。例如，使用单个 LPDDR 元件时，该元件必须连接到 DDR0_* 接口。当使用两个 LPDDR 元件时，它们必须连接到 DDR0_* 和 DDR1_* 接口，依此类推。

表 5-7. DDRSS2 信号说明

| 信号名称 [1] ⁽²⁾ ⁽³⁾ | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|--|----------|-----------------|------------|
| DDR2_CKN | IO | DDRSS 差分时钟 (负) | K1 |
| DDR2_CKP | IO | DDRSS 差分时钟 (正) | L2 |
| DDR2_RESETn | IO | DDRSS 复位 | J5 |
| DDR2_RET | I | DDR 保持使能 | L8 |
| DDR2_CA0 | IO | DDRS 命令地址 | K3 |
| DDR2_CA1 | IO | DDRS 命令地址 | L3 |
| DDR2_CA2 | IO | DDRS 命令地址 | K5 |
| DDR2_CA3 | IO | DDRS 命令地址 | L4 |
| DDR2_CA4 | IO | DDRS 命令地址 | K4 |
| DDR2_CA5 | IO | DDRS 命令地址 | L7 |
| DDR2_CAL0 ⁽¹⁾ | A | DDRSS IO 焊盘校准电阻 | U7 |
| DDR2_CKE0 | IO | DDR 时钟使能 | L6 |
| DDR2_CKE1 | IO | DDR 时钟使能 | J2 |
| DDR2_CSn0_0 | IO | DDRSS 片选 | J3 |
| DDR2_CSn0_1 | IO | DDRSS 片选 | J6 |
| DDR2_CSn1_0 | IO | DDRSS 片选 | J7 |
| DDR2_CSn1_1 | IO | DDRSS 片选 | K7 |
| DDR2_DM0 | IO | DDRSS 数据掩码 | T2 |
| DDR2_DM1 | IO | DDRSS 数据掩码 | M6 |
| DDR2_DM2 | IO | DDRSS 数据掩码 | G4 |
| DDR2_DM3 | IO | DDRSS 数据掩码 | D5 |

表 5-7. DDRSS2 信号说明 (续)

| 信号名称 [1] (2) (3) | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|------------------|----------|-------------|------------|
| DDR2_DQ0 | IO | DDRSS 数据 | T4 |
| DDR2_DQ1 | IO | DDRSS 数据 | R6 |
| DDR2_DQ2 | IO | DDRSS 数据 | R3 |
| DDR2_DQ3 | IO | DDRSS 数据 | R4 |
| DDR2_DQ4 | IO | DDRSS 数据 | P6 |
| DDR2_DQ5 | IO | DDRSS 数据 | P5 |
| DDR2_DQ6 | IO | DDRSS 数据 | T5 |
| DDR2_DQ7 | IO | DDRSS 数据 | R7 |
| DDR2_DQ8 | IO | DDRSS 数据 | N2 |
| DDR2_DQ9 | IO | DDRSS 数据 | N4 |
| DDR2_DQ10 | IO | DDRSS 数据 | P2 |
| DDR2_DQ11 | IO | DDRSS 数据 | P3 |
| DDR2_DQ12 | IO | DDRSS 数据 | M7 |
| DDR2_DQ13 | IO | DDRSS 数据 | N5 |
| DDR2_DQ14 | IO | DDRSS 数据 | M4 |
| DDR2_DQ15 | IO | DDRSS 数据 | M3 |
| DDR2_DQ16 | IO | DDRSS 数据 | F3 |
| DDR2_DQ17 | IO | DDRSS 数据 | G7 |
| DDR2_DQ18 | IO | DDRSS 数据 | H6 |
| DDR2_DQ19 | IO | DDRSS 数据 | H4 |
| DDR2_DQ20 | IO | DDRSS 数据 | G2 |
| DDR2_DQ21 | IO | DDRSS 数据 | H3 |
| DDR2_DQ22 | IO | DDRSS 数据 | G5 |
| DDR2_DQ23 | IO | DDRSS 数据 | F2 |
| DDR2_DQ24 | IO | DDRSS 数据 | E4 |
| DDR2_DQ25 | IO | DDRSS 数据 | D2 |
| DDR2_DQ26 | IO | DDRSS 数据 | F6 |
| DDR2_DQ27 | IO | DDRSS 数据 | F5 |
| DDR2_DQ28 | IO | DDRSS 数据 | E3 |
| DDR2_DQ29 | IO | DDRSS 数据 | E7 |
| DDR2_DQ30 | IO | DDRSS 数据 | E6 |
| DDR2_DQ31 | IO | DDRSS 数据 | D4 |
| DDR2_DQS0N | IO | DDRS 互补数据选通 | R1 |
| DDR2_DQS0P | IO | DDRS 数据选通 | T1 |
| DDR2_DQS1N | IO | DDRS 互补数据选通 | M1 |
| DDR2_DQS1P | IO | DDRS 数据选通 | N1 |
| DDR2_DQS2N | IO | DDRS 互补数据选通 | G1 |
| DDR2_DQS2P | IO | DDRS 数据选通 | H1 |
| DDR2_DQS3N | IO | DDRS 互补数据选通 | D1 |
| DDR2_DQS3P | IO | DDRS 数据选通 | E1 |

(1) 必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部 240Ω ±1% 电阻器。不应向该引脚施加外部电压。

(2) 必须始终按递增顺序使用 DDRSS0、DDRSS1、DDRSS2 和 DDRSS3。例如，使用单个 LPDDR 元件时，该元件必须连接到 DDR0_* 接口。当使用两个 LPDDR 元件时，它们必须连接到 DDR0_* 和 DDR1_* 接口，依此类推。

- (3) 此 SoC 的 27mm 封装型号不提供 DDRSS2、DDRSS3 和 SERDES2。如果希望与使用 27mm 封装的系统具有软件兼容性，则应避免使用 DDRSS2/DDRSS3/SERDES2。

表 5-8. DDRSS3 信号说明

| 信号名称 [1] (2) (3) | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|------------------|----------|------------------|------------|
| DDR3_CKN | IO | DDRSS 差分时钟 (负) | B25 |
| DDR3_CKP | IO | DDRSS 差分时钟 (正) | A24 |
| DDR3_RESETh | IO | DDRSS 复位 | C23 |
| DDR3_RET | I | DDR 保持使能 | G27 |
| DDR3_CA0 | IO | DDRSS 命令地址 | D25 |
| DDR3_CA1 | IO | DDRSS 命令地址 | B23 |
| DDR3_CA2 | IO | DDRSS 命令地址 | D24 |
| DDR3_CA3 | IO | DDRSS 命令地址 | C24 |
| DDR3_CA4 | IO | DDRSS 命令地址 | E23 |
| DDR3_CA5 | IO | DDRSS 命令地址 | F23 |
| DDR3_CAL0 (1) | A | DDRSS IO 焊盘校准电阻 | F18 |
| DDR3_CKE0 | IO | DDRSS 时钟使能 | C25 |
| DDR3_CKE1 | IO | DDRSS 时钟使能 | G24 |
| DDR3_CSn0_0 | IO | DDRSS 片选 | G23 |
| DDR3_CSn0_1 | IO | DDRSS 片选 | G25 |
| DDR3_CSn1_0 | IO | DDRSS 片选 | F25 |
| DDR3_CSn1_1 | IO | DDRSS 片选 | E24 |
| DDR3_DM0 | IO | DDRSS 数据掩码 | E18 |
| DDR3_DM1 | IO | DDRSS 数据掩码 | D21 |
| DDR3_DM2 | IO | DDRSS 数据掩码 | C28 |
| DDR3_DM3 | IO | DDRSS 数据掩码 | E30 |
| DDR3_DQ0 | IO | DDRSS 数据 | D18 |
| DDR3_DQ1 | IO | DDRSS 数据 | B18 |
| DDR3_DQ2 | IO | DDRSS 数据 | C19 |
| DDR3_DQ3 | IO | DDRSS 数据 | D19 |
| DDR3_DQ4 | IO | DDRSS 数据 | F20 |
| DDR3_DQ5 | IO | DDRSS 数据 | E20 |
| DDR3_DQ6 | IO | DDRSS 数据 | G19 |
| DDR3_DQ7 | IO | DDRSS 数据 | F19 |
| DDR3_DQ8 | IO | DDRSS 数据 | E21 |
| DDR3_DQ9 | IO | DDRSS 数据 | G21 |
| DDR3_DQ10 | IO | DDRSS 数据 | F22 |
| DDR3_DQ11 | IO | DDRSS 数据 | D22 |
| DDR3_DQ12 | IO | DDRSS 数据 | C22 |
| DDR3_DQ13 | IO | DDRSS 数据 | B21 |
| DDR3_DQ14 | IO | DDRSS 数据 | B20 |
| DDR3_DQ15 | IO | DDRSS 数据 | C20 |
| DDR3_DQ16 | IO | DDRSS 数据 | B28 |
| DDR3_DQ17 | IO | DDRSS 数据 | B27 |
| DDR3_DQ18 | IO | DDRSS 数据 | C26 |

表 5-8. DDRSS3 信号说明 (续)

| 信号名称 [1] (2) (3) | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|------------------|----------|--------------|------------|
| DDR3_DQ19 | IO | DDRSS 数据 | D26 |
| DDR3_DQ20 | IO | DDRSS 数据 | F26 |
| DDR3_DQ21 | IO | DDRSS 数据 | G26 |
| DDR3_DQ22 | IO | DDRSS 数据 | E27 |
| DDR3_DQ23 | IO | DDRSS 数据 | D27 |
| DDR3_DQ24 | IO | DDRSS 数据 | F29 |
| DDR3_DQ25 | IO | DDRSS 数据 | G29 |
| DDR3_DQ26 | IO | DDRSS 数据 | F28 |
| DDR3_DQ27 | IO | DDRSS 数据 | E28 |
| DDR3_DQ28 | IO | DDRSS 数据 | D29 |
| DDR3_DQ29 | IO | DDRSS 数据 | C29 |
| DDR3_DQ30 | IO | DDRSS 数据 | B30 |
| DDR3_DQ31 | IO | DDRSS 数据 | D30 |
| DDR3_DQS0N | IO | DDRSS 互补数据选通 | A19 |
| DDR3_DQS0P | IO | DDRSS 数据选通 | A18 |
| DDR3_DQS1N | IO | DDRSS 互补数据选通 | A22 |
| DDR3_DQS1P | IO | DDRSS 数据选通 | A21 |
| DDR3_DQS2N | IO | DDRSS 互补数据选通 | A27 |
| DDR3_DQS2P | IO | DDRSS 数据选通 | A26 |
| DDR3_DQS3N | IO | DDRSS 互补数据选通 | A30 |
| DDR3_DQS3P | IO | DDRSS 数据选通 | A29 |

- (1) 必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部 $240\Omega \pm 1\%$ 电阻器。不应向该引脚施加外部电压。
- (2) 必须始终按递增顺序使用 DDRSS0、DDRSS1、DDRSS2 和 DDRSS3。例如，使用单个 LPDDR 元件时，该元件必须连接到 DDR0_* 接口。当使用两个 LPDDR 元件时，它们必须连接到 DDR0_* 和 DDR1_* 接口，依此类推。
- (3) 此 SoC 的 27mm 封装型号不提供 DDRSS2、DDRSS3 和 SERDES2。如果希望与使用 27mm 封装的系统具有软件兼容性，则应避免使用 DDRSS2/DDRSS3/SERDES2。

5.3.3 GPIO

5.3.3.1 MAIN 域

表 5-9. GPIO0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|---------|------------|
| GPIO0_0 | IO | 通用输入/输出 | AN35 |
| GPIO0_1 | IO | 通用输入/输出 | AG36 |
| GPIO0_2 | IO | 通用输入/输出 | AJ33 |
| GPIO0_3 | IO | 通用输入/输出 | AF33 |
| GPIO0_4 | IO | 通用输入/输出 | AH33 |
| GPIO0_5 | IO | 通用输入/输出 | AG33 |
| GPIO0_6 | IO | 通用输入/输出 | AK36 |
| GPIO0_7 | IO | 通用输入/输出 | AG34 |
| GPIO0_8 | IO | 通用输入/输出 | AJ35 |
| GPIO0_9 | IO | 通用输入/输出 | AH34 |
| GPIO0_10 | IO | 通用输入/输出 | AE33 |
| GPIO0_11 | IO | 通用输入/输出 | AL32 |

表 5-9. GPIO0 信号说明 (续)

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|---------|------------|
| GPIO0_12 | IO | 通用输入/输出 | AK37 |
| GPIO0_13 | IO | 通用输入/输出 | AJ34 |
| GPIO0_14 | IO | 通用输入/输出 | AK35 |
| GPIO0_15 | IO | 通用输入/输出 | AK38 |
| GPIO0_16 | IO | 通用输入/输出 | AF37 |
| GPIO0_17 | IO | 通用输入/输出 | AG37 |
| GPIO0_18 | IO | 通用输入/输出 | AK33 |
| GPIO0_19 | IO | 通用输入/输出 | AC32 |
| GPIO0_20 | IO | 通用输入/输出 | AC37 |
| GPIO0_21 | IO | 通用输入/输出 | AD37 |
| GPIO0_22 | IO | 通用输入/输出 | AE37 |
| GPIO0_23 | IO | 通用输入/输出 | AC36 |
| GPIO0_24 | IO | 通用输入/输出 | AE36 |
| GPIO0_25 | IO | 通用输入/输出 | AF38 |
| GPIO0_26 | IO | 通用输入/输出 | AE38 |
| GPIO0_27 | IO | 通用输入/输出 | AJ37 |
| GPIO0_28 | IO | 通用输入/输出 | AH38 |
| GPIO0_29 | IO | 通用输入/输出 | AC33 |
| GPIO0_30 | IO | 通用输入/输出 | AH37 |
| GPIO0_31 | IO | 通用输入/输出 | AJ38 |
| GPIO0_32 | IO | 通用输入/输出 | AK34 |
| GPIO0_33 | IO | 通用输入/输出 | AG38 |
| GPIO0_34 | IO | 通用输入/输出 | AF36 |
| GPIO0_35 | IO | 通用输入/输出 | AE35 |
| GPIO0_36 | IO | 通用输入/输出 | AC35 |
| GPIO0_37 | IO | 通用输入/输出 | AG35 |
| GPIO0_38 | IO | 通用输入/输出 | AH36 |
| GPIO0_39 | IO | 通用输入/输出 | AF35 |
| GPIO0_40 | IO | 通用输入/输出 | AD34 |
| GPIO0_41 | IO | 通用输入/输出 | AJ36 |
| GPIO0_42 | IO | 通用输入/输出 | AF34 |
| GPIO0_43 | IO | 通用输入/输出 | AE34 |
| GPIO0_44 | IO | 通用输入/输出 | AL33 |
| GPIO0_45 | IO | 通用输入/输出 | AL34 |
| GPIO0_46 | IO | 通用输入/输出 | AC34 |
| GPIO0_47 | IO | 通用输入/输出 | AD33 |
| GPIO0_48 | IO | 通用输入/输出 | AD38 |
| GPIO0_49 | IO | 通用输入/输出 | AD36 |
| GPIO0_50 | IO | 通用输入/输出 | AJ32 |
| GPIO0_51 | IO | 通用输入/输出 | AM37 |
| GPIO0_52 | IO | 通用输入/输出 | AP38 |
| GPIO0_53 | IO | 通用输入/输出 | AN38 |

表 5-9. GPIO0 信号说明 (续)

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|---------|------------|
| GPIO0_54 | IO | 通用输入/输出 | AM35 |
| GPIO0_55 | IO | 通用输入/输出 | AM36 |
| GPIO0_56 | IO | 通用输入/输出 | AN36 |
| GPIO0_57 | IO | 通用输入/输出 | AP37 |
| GPIO0_58 | IO | 通用输入/输出 | AR38 |
| GPIO0_59 | IO | 通用输入/输出 | AN37 |
| GPIO0_60 | IO | 通用输入/输出 | AC38 |
| GPIO0_61 | IO | 通用输入/输出 | AA32 |
| GPIO0_62 | IO | 通用输入/输出 | AB34 |
| GPIO0_63 | IO | 通用输入/输出 | AA33 |
| GPIO0_64 | IO | 通用输入/输出 | AB38 |
| GPIO0_65 | IO | 通用输入/输出 | AB36 |

5.3.3.2 WKUP 域
表 5-10. WKUP_GPIO0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|---------------|----------|---------|------------|
| WKUP_GPIO0_0 | IO | 通用输入/输出 | H38 |
| WKUP_GPIO0_1 | IO | 通用输入/输出 | J34 |
| WKUP_GPIO0_2 | IO | 通用输入/输出 | J35 |
| WKUP_GPIO0_3 | IO | 通用输入/输出 | J36 |
| WKUP_GPIO0_4 | IO | 通用输入/输出 | H35 |
| WKUP_GPIO0_5 | IO | 通用输入/输出 | K36 |
| WKUP_GPIO0_6 | IO | 通用输入/输出 | L37 |
| WKUP_GPIO0_7 | IO | 通用输入/输出 | L36 |
| WKUP_GPIO0_8 | IO | 通用输入/输出 | L35 |
| WKUP_GPIO0_9 | IO | 通用输入/输出 | L34 |
| WKUP_GPIO0_10 | IO | 通用输入/输出 | L33 |
| WKUP_GPIO0_11 | IO | 通用输入/输出 | M38 |
| WKUP_GPIO0_12 | IO | 通用输入/输出 | J37 |
| WKUP_GPIO0_13 | IO | 通用输入/输出 | K38 |
| WKUP_GPIO0_14 | IO | 通用输入/输出 | H37 |
| WKUP_GPIO0_15 | IO | 通用输入/输出 | K37 |
| WKUP_GPIO0_16 | IO | 通用输入/输出 | E32 |
| WKUP_GPIO0_17 | IO | 通用输入/输出 | D32 |
| WKUP_GPIO0_18 | IO | 通用输入/输出 | C34 |
| WKUP_GPIO0_19 | IO | 通用输入/输出 | B33 |
| WKUP_GPIO0_20 | IO | 通用输入/输出 | B32 |
| WKUP_GPIO0_21 | IO | 通用输入/输出 | C33 |
| WKUP_GPIO0_22 | IO | 通用输入/输出 | C35 |
| WKUP_GPIO0_23 | IO | 通用输入/输出 | D33 |
| WKUP_GPIO0_24 | IO | 通用输入/输出 | D34 |
| WKUP_GPIO0_25 | IO | 通用输入/输出 | E34 |

表 5-10. WKUP_GPIO0 信号说明 (续)

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|---------------|----------|---------|------------|
| WKUP_GPIO0_26 | IO | 通用输入/输出 | E33 |
| WKUP_GPIO0_27 | IO | 通用输入/输出 | A32 |
| WKUP_GPIO0_28 | IO | 通用输入/输出 | A33 |
| WKUP_GPIO0_29 | IO | 通用输入/输出 | B34 |
| WKUP_GPIO0_30 | IO | 通用输入/输出 | C32 |
| WKUP_GPIO0_31 | IO | 通用输入/输出 | F32 |
| WKUP_GPIO0_32 | IO | 通用输入/输出 | C31 |
| WKUP_GPIO0_33 | IO | 通用输入/输出 | F31 |
| WKUP_GPIO0_34 | IO | 通用输入/输出 | E35 |
| WKUP_GPIO0_35 | IO | 通用输入/输出 | D31 |
| WKUP_GPIO0_36 | IO | 通用输入/输出 | G31 |
| WKUP_GPIO0_37 | IO | 通用输入/输出 | F33 |
| WKUP_GPIO0_38 | IO | 通用输入/输出 | G32 |
| WKUP_GPIO0_39 | IO | 通用输入/输出 | G33 |
| WKUP_GPIO0_40 | IO | 通用输入/输出 | C38 |
| WKUP_GPIO0_41 | IO | 通用输入/输出 | C37 |
| WKUP_GPIO0_42 | IO | 通用输入/输出 | E38 |
| WKUP_GPIO0_43 | IO | 通用输入/输出 | E37 |
| WKUP_GPIO0_44 | IO | 通用输入/输出 | D38 |
| WKUP_GPIO0_45 | IO | 通用输入/输出 | D37 |
| WKUP_GPIO0_46 | IO | 通用输入/输出 | E36 |
| WKUP_GPIO0_47 | IO | 通用输入/输出 | B37 |
| WKUP_GPIO0_48 | IO | 通用输入/输出 | D36 |
| WKUP_GPIO0_49 | IO | 通用输入/输出 | M33 |
| WKUP_GPIO0_50 | IO | 通用输入/输出 | B36 |
| WKUP_GPIO0_51 | IO | 通用输入/输出 | A35 |
| WKUP_GPIO0_52 | IO | 通用输入/输出 | B35 |
| WKUP_GPIO0_53 | IO | 通用输入/输出 | A36 |
| WKUP_GPIO0_54 | IO | 通用输入/输出 | G38 |
| WKUP_GPIO0_55 | IO | 通用输入/输出 | H36 |
| WKUP_GPIO0_56 | IO | 通用输入/输出 | M37 |
| WKUP_GPIO0_57 | IO | 通用输入/输出 | M36 |
| WKUP_GPIO0_58 | IO | 通用输入/输出 | K35 |
| WKUP_GPIO0_59 | IO | 通用输入/输出 | K34 |
| WKUP_GPIO0_60 | IO | 通用输入/输出 | K33 |
| WKUP_GPIO0_61 | IO | 通用输入/输出 | F38 |
| WKUP_GPIO0_62 | IO | 通用输入/输出 | C36 |
| WKUP_GPIO0_63 | IO | 通用输入/输出 | N33 |
| WKUP_GPIO0_64 | IO | 通用输入/输出 | N35 |
| WKUP_GPIO0_65 | IO | 通用输入/输出 | M35 |
| WKUP_GPIO0_66 | IO | 通用输入/输出 | N34 |
| WKUP_GPIO0_67 | IO | 通用输入/输出 | M34 |

表 5-10. WKUP_GPIO0 信号说明 (续)

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|---------------|----------|---------|------------|
| WKUP_GPIO0_68 | IO | 通用输入/输出 | F36 |
| WKUP_GPIO0_69 | IO | 通用输入/输出 | J38 |
| WKUP_GPIO0_70 | IO | 通用输入/输出 | F37 |
| WKUP_GPIO0_71 | I | 通用输入/输出 | P36 |
| WKUP_GPIO0_72 | I | 通用输入/输出 | V36 |
| WKUP_GPIO0_73 | I | 通用输入/输出 | T34 |
| WKUP_GPIO0_74 | I | 通用输入/输出 | T36 |
| WKUP_GPIO0_75 | I | 通用输入/输出 | P34 |
| WKUP_GPIO0_76 | I | 通用输入/输出 | R37 |
| WKUP_GPIO0_77 | I | 通用输入/输出 | R33 |
| WKUP_GPIO0_78 | I | 通用输入/输出 | V38 |
| WKUP_GPIO0_79 | I | 通用输入/输出 | Y38 |
| WKUP_GPIO0_80 | I | 通用输入/输出 | Y34 |
| WKUP_GPIO0_81 | I | 通用输入/输出 | V34 |
| WKUP_GPIO0_82 | I | 通用输入/输出 | W37 |
| WKUP_GPIO0_83 | I | 通用输入/输出 | AA37 |
| WKUP_GPIO0_84 | I | 通用输入/输出 | W33 |
| WKUP_GPIO0_85 | I | 通用输入/输出 | U33 |
| WKUP_GPIO0_86 | I | 通用输入/输出 | Y36 |
| WKUP_GPIO0_87 | IO | 通用输入/输出 | G34 |
| WKUP_GPIO0_88 | IO | 通用输入/输出 | L38 |

5.3.4 I2C

5.3.4.1 MAIN 域

表 5-11. I2C0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|--------|------------|
| I2C0_SCL | IOD | I2C 时钟 | AN36 |
| I2C0_SDA | IOD | I2C 数据 | AP37 |

表 5-12. I2C1 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|--------|----------------|
| I2C1_SCL | IOD | I2C 时钟 | AD36、AE34、AJ35 |
| I2C1_SDA | IOD | I2C 数据 | AH34、AJ32、AL33 |

表 5-13. I2C2 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|--------|------------|
| I2C2_SCL | IOD | I2C 时钟 | AC32、AN38 |
| I2C2_SDA | IOD | I2C 数据 | AC37、AM35 |

表 5-14. I2C3 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|--------|------------|
| I2C3_SCL | IOD | I2C 时钟 | AC38、AF38 |

表 5-14. I2C3 信号说明 (续)

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|--------|------------|
| I2C3_SDA | IOD | I2C 数据 | AA32、AE36 |

表 5-15. I2C4 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|--------|----------------|
| I2C4_SCL | IOD | I2C 时钟 | AA33、AG33、AG38 |
| I2C4_SDA | IOD | I2C 数据 | AB34、AH33、AK34 |

表 5-16. I2C5 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|--------|------------|
| I2C5_SCL | IOD | I2C 时钟 | AC33、AG34 |
| I2C5_SDA | IOD | I2C 数据 | AH37、AK36 |

表 5-17. I2C6 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|--------|------------|
| I2C6_SCL | IOD | I2C 时钟 | AB36、AN37 |
| I2C6_SDA | IOD | I2C 数据 | AB38、AR38 |

5.3.4.2 MCU 域

表 5-18. MCU_I2C0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|--------------|----------|--------|------------|
| MCU_I2C0_SCL | IOD | I2C 时钟 | M35 |
| MCU_I2C0_SDA | IOD | I2C 数据 | G34 |

表 5-19. MCU_I2C1 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|--------------|----------|--------|------------|
| MCU_I2C1_SCL | IOD | I2C 时钟 | L35、L37 |
| MCU_I2C1_SDA | IOD | I2C 数据 | L34、L36 |

5.3.4.3 WKUP 域

表 5-20. WKUP_I2C0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|---------------|----------|--------|------------|
| WKUP_I2C0_SCL | IOD | I2C 时钟 | N33 |
| WKUP_I2C0_SDA | IOD | I2C 数据 | N35 |

5.3.5 I3C

5.3.5.1 MCU 域

表 5-21. MCU_I3C0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|--------------------|----------|------------|------------|
| MCU_I3C0_SCL | IO | I3C 时钟 | L35 |
| MCU_I3C0_SDA | IO | I3C 数据 | L34 |
| MCU_I3C0_SDAPULLEN | OD | I3C 数据拉动使能 | L38、M38 |

5.3.6 MCAN

5.3.6.1 MAIN 域

表 5-22. MCAN0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|-----------|------------|
| MCAN0_RX | I | MCAN 接收数据 | AE38 |
| MCAN0_TX | O | MCAN 发送数据 | AF38 |

表 5-23. MCAN1 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|-----------|------------|
| MCAN1_RX | I | MCAN 接收数据 | AH38、AJ32 |
| MCAN1_TX | O | MCAN 发送数据 | AJ37 |

表 5-24. MCAN2 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|-----------|------------|
| MCAN2_RX | I | MCAN 接收数据 | AH37 |
| MCAN2_TX | O | MCAN 发送数据 | AC33 |

表 5-25. MCAN3 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|-----------|------------|
| MCAN3_RX | I | MCAN 接收数据 | AK34 |
| MCAN3_TX | O | MCAN 发送数据 | AJ38 |

表 5-26. MCAN4 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|-----------|------------|
| MCAN4_RX | I | MCAN 接收数据 | AF36 |
| MCAN4_TX | O | MCAN 发送数据 | AG38 |

表 5-27. MCAN5 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|-----------|------------|
| MCAN5_RX | I | MCAN 接收数据 | AC35、AK38 |
| MCAN5_TX | O | MCAN 发送数据 | AE35、AK35 |

表 5-28. MCAN6 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|-----------|------------|
| MCAN6_RX | I | MCAN 接收数据 | AG37、AH36 |
| MCAN6_TX | O | MCAN 发送数据 | AF37、AG35 |

表 5-29. MCAN7 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|-----------|------------|
| MCAN7_RX | I | MCAN 接收数据 | AC32、AD34 |
| MCAN7_TX | O | MCAN 发送数据 | AF35、AK33 |

表 5-30. MCAN8 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|-----------|------------|
| MCAN8_RX | I | MCAN 接收数据 | AD37、AF34 |
| MCAN8_TX | O | MCAN 发送数据 | AC37、AJ36 |

表 5-31. MCAN9 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|-----------|------------|
| MCAN9_RX | I | MCAN 接收数据 | AC36、AL33 |
| MCAN9_TX | O | MCAN 发送数据 | AE34、AE37 |

表 5-32. MCAN10 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-----------|----------|-----------|------------|
| MCAN10_RX | I | MCAN 接收数据 | AC34 |
| MCAN10_TX | O | MCAN 发送数据 | AL34 |

表 5-33. MCAN11 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-----------|----------|-----------|------------|
| MCAN11_RX | I | MCAN 接收数据 | AD38 |
| MCAN11_TX | O | MCAN 发送数据 | AD33 |

表 5-34. MCAN12 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-----------|----------|-----------|------------|
| MCAN12_RX | I | MCAN 接收数据 | AJ33、AK37 |
| MCAN12_TX | O | MCAN 发送数据 | AD36、AG36 |

表 5-35. MCAN13 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-----------|----------|-----------|------------|
| MCAN13_RX | I | MCAN 接收数据 | AH33、AN37 |
| MCAN13_TX | O | MCAN 发送数据 | AF33、AR38 |

表 5-36. MCAN14 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-----------|----------|-----------|------------|
| MCAN14_RX | I | MCAN 接收数据 | AK36、AP38 |
| MCAN14_TX | O | MCAN 发送数据 | AG33、AM37 |

表 5-37. MCAN15 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-----------|----------|-----------|------------|
| MCAN15_RX | I | MCAN 接收数据 | AB36、AJ35 |
| MCAN15_TX | O | MCAN 发送数据 | AB38、AG34 |

表 5-38. MCAN16 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-----------|----------|-----------|------------|
| MCAN16_RX | I | MCAN 接收数据 | AE33 |
| MCAN16_TX | O | MCAN 发送数据 | AH34 |

表 5-39. MCAN17 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-----------|----------|-----------|------------|
| MCAN17_RX | I | MCAN 接收数据 | AE36、AJ34 |
| MCAN17_TX | O | MCAN 发送数据 | AL32 |

5.3.6.2 MCU 域

表 5-40. MCU_MCAN0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|--------------|----------|-----------|------------|
| MCU_MCAN0_RX | I | MCAN 接收数据 | F38 |
| MCU_MCAN0_TX | O | MCAN 发送数据 | K33 |

表 5-41. MCU_MCAN1 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|--------------|----------|-----------|------------|
| MCU_MCAN1_RX | I | MCAN 接收数据 | K36 |
| MCU_MCAN1_TX | O | MCAN 发送数据 | H35 |

5.3.7 MCSPI

5.3.7.1 MAIN 域

表 5-42. MCSPI0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|----------|------------|
| SPI0_CLK | IO | SPI 时钟 | AN38 |
| SPI0_CS0 | IO | SPI 片选 0 | AM37 |
| SPI0_CS1 | IO | SPI 片选 1 | AP38 |
| SPI0_CS2 | IO | SPI 片选 2 | AJ35 |
| SPI0_CS3 | IO | SPI 片选 3 | AE33 |
| SPI0_D0 | IO | SPI 数据 0 | AM35 |
| SPI0_D1 | IO | SPI 数据 1 | AM36 |

表 5-43. MCSPI1 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|----------|------------|
| SPI1_CLK | IO | SPI 时钟 | AB38 |
| SPI1_CS0 | IO | SPI 片选 0 | AC38 |
| SPI1_CS1 | IO | SPI 片选 1 | AA32 |
| SPI1_CS2 | IO | SPI 片选 2 | AB34 |
| SPI1_CS3 | IO | SPI 片选 3 | AH34 |
| SPI1_D0 | IO | SPI 数据 0 | AA33 |
| SPI1_D1 | IO | SPI 数据 1 | AB36 |

表 5-44. MCSPI2 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|----------|------------|
| SPI2_CLK | IO | SPI 时钟 | AD34 |
| SPI2_CS0 | IO | SPI 片选 0 | AJ36 |
| SPI2_CS1 | IO | SPI 片选 1 | AF35 |
| SPI2_CS2 | IO | SPI 片选 2 | AF37 |
| SPI2_CS3 | IO | SPI 片选 3 | AG37 |

表 5-44. MCSPI2 信号说明 (续)

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|----------|------------|
| SPI2_D0 | IO | SPI 数据 0 | AF34 |
| SPI2_D1 | IO | SPI 数据 1 | AE34 |

表 5-45. MCSPI3 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|----------|------------|
| SPI3_CLK | IO | SPI 时钟 | AD38 |
| SPI3_CS0 | IO | SPI 片选 0 | AD33 |
| SPI3_CS1 | IO | SPI 片选 1 | AJ38 |
| SPI3_CS2 | IO | SPI 片选 2 | AF36 |
| SPI3_CS3 | IO | SPI 片选 3 | AC34 |
| SPI3_D0 | IO | SPI 数据 0 | AC32 |
| SPI3_D1 | IO | SPI 数据 1 | AC37 |

表 5-46. MCSPI5 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|----------|------------|
| SPI5_CLK | IO | SPI 时钟 | AJ38 |
| SPI5_CS0 | IO | SPI 片选 0 | AE38 |
| SPI5_CS1 | IO | SPI 片选 1 | AF38 |
| SPI5_CS2 | IO | SPI 片选 2 | AD37 |
| SPI5_CS3 | IO | SPI 片选 3 | AE37 |
| SPI5_D0 | IO | SPI 数据 0 | AH38 |
| SPI5_D1 | IO | SPI 数据 1 | AF36 |

表 5-47. MCSPI6 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|----------|------------|
| SPI6_CLK | IO | SPI 时钟 | AK37 |
| SPI6_CS0 | IO | SPI 片选 0 | AJ34 |
| SPI6_CS1 | IO | SPI 片选 1 | AH37 |
| SPI6_CS2 | IO | SPI 片选 2 | AK34 |
| SPI6_CS3 | IO | SPI 片选 3 | AG38 |
| SPI6_D0 | IO | SPI 数据 0 | AD36 |
| SPI6_D1 | IO | SPI 数据 1 | AC33 |

表 5-48. MCSPI7 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|----------|------------|
| SPI7_CLK | IO | SPI 时钟 | AF37 |
| SPI7_CS0 | IO | SPI 片选 0 | AG37 |
| SPI7_CS1 | IO | SPI 片选 1 | AD37 |
| SPI7_CS2 | IO | SPI 片选 2 | AE37 |
| SPI7_CS3 | IO | SPI 片选 3 | AL32 |
| SPI7_D0 | IO | SPI 数据 0 | AE38 |
| SPI7_D1 | IO | SPI 数据 1 | AJ38 |

5.3.7.2 MCU 域

表 5-49. MCU_MCSPi0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|--------------|----------|----------|------------|
| MCU_SPI0_CLK | IO | SPI 时钟 | G38 |
| MCU_SPI0_CS0 | IO | SPI 片选 0 | F37 |
| MCU_SPI0_CS1 | IO | SPI 片选 1 | F33、J37 |
| MCU_SPI0_CS2 | IO | SPI 片选 2 | G33、H37 |
| MCU_SPI0_CS3 | IO | SPI 片选 3 | H35 |
| MCU_SPI0_D0 | IO | SPI 数据 0 | H36 |
| MCU_SPI0_D1 | IO | SPI 数据 1 | J38 |

表 5-50. MCU_MCSPi1 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|--------------|----------|----------|------------|
| MCU_SPI1_CLK | IO | SPI 时钟 | H38 |
| MCU_SPI1_CS0 | IO | SPI 片选 0 | J36 |
| MCU_SPI1_CS1 | IO | SPI 片选 1 | D31、K38 |
| MCU_SPI1_CS2 | IO | SPI 片选 2 | G31、K37 |
| MCU_SPI1_CS3 | IO | SPI 片选 3 | K36 |
| MCU_SPI1_D0 | IO | SPI 数据 0 | J34 |
| MCU_SPI1_D1 | IO | SPI 数据 1 | J35 |

5.3.8 UART

5.3.8.1 MAIN 域

表 5-51. UART0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|------------|----------|---------------------|----------------|
| UART0_CTSn | I | UART 允许发送 (低电平有效) | AC32、AC38 |
| UART0_DCDn | I | UART 数据载波检测 (低电平有效) | AJ33 |
| UART0_DSRn | I | UART 数据集就绪 (低电平有效) | AF33 |
| UART0_DTRn | O | UART 数据终端就绪 (低电平有效) | AH33 |
| UART0_RIn | I | UART 振铃指示器 | AG33 |
| UART0_RTSn | O | UART 请求发送 (低电平有效) | AB38、AC37、AP38 |
| UART0_RXD | I | UART 接收数据 | AD33 |
| UART0_TXD | O | UART 发送数据 | AD38 |

表 5-52. UART1 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|------------|----------|-------------------|------------|
| UART1_CTSn | I | UART 允许发送 (低电平有效) | AC36、AN38 |
| UART1_RTSn | O | UART 请求发送 (低电平有效) | AE36、AM35 |
| UART1_RXD | I | UART 接收数据 | AD37 |
| UART1_TXD | O | UART 发送数据 | AE37 |

表 5-53. UART2 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|------------|----------|-------------------|------------|
| UART2_CTSn | I | UART 允许发送 (低电平有效) | AD36 |

表 5-53. UART2 信号说明 (续)

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|------------|----------|-------------------|----------------|
| UART2_RTSn | O | UART 请求发送 (低电平有效) | AJ32 |
| UART2_RXD | I | UART 接收数据 | AB34、AF38、AM35 |
| UART2_TXD | O | UART 发送数据 | AA33、AE38、AM36 |

表 5-54. UART3 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|------------|----------|-------------------|----------------|
| UART3_CTSn | I | UART 允许发送 (低电平有效) | AJ38 |
| UART3_RTSn | O | UART 请求发送 (低电平有效) | AH38 |
| UART3_RXD | I | UART 接收数据 | AC33、AD36、AR38 |
| UART3_TXD | O | UART 发送数据 | AH37、AJ32、AN37 |

表 5-55. UART4 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|------------|----------|-------------------|---------------------|
| UART4_CTSn | I | UART 允许发送 (低电平有效) | AB38、AG35、AK33 |
| UART4_RTSn | O | UART 请求发送 (低电平有效) | AB36、AC34、AH36 |
| UART4_RXD | I | UART 接收数据 | AB34、AE35、AF37、AL34 |
| UART4_TXD | O | UART 发送数据 | AA33、AC35、AF33、AG37 |

表 5-56. UART5 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|------------|----------|-------------------|----------------|
| UART5_CTSn | I | UART 允许发送 (低电平有效) | AB34、AJ36 |
| UART5_RTSn | O | UART 请求发送 (低电平有效) | AA33、AF34 |
| UART5_RXD | I | UART 接收数据 | AC38、AF35、AJ33 |
| UART5_TXD | O | UART 发送数据 | AA32、AD34、AG36 |

表 5-57. UART6 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|------------|----------|-------------------|----------------|
| UART6_CTSn | I | UART 允许发送 (低电平有效) | AF38 |
| UART6_RTSn | O | UART 请求发送 (低电平有效) | AE38 |
| UART6_RXD | I | UART 接收数据 | AC36、AG33、AK37 |
| UART6_TXD | O | UART 发送数据 | AE36、AH33、AJ37 |

表 5-58. UART7 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|------------|----------|-------------------|----------------|
| UART7_CTSn | I | UART 允许发送 (低电平有效) | AB34 |
| UART7_RTSn | O | UART 请求发送 (低电平有效) | AA33 |
| UART7_RXD | I | UART 接收数据 | AC38、AJ36、AL32 |
| UART7_TXD | O | UART 发送数据 | AA32、AF34、AJ34 |

表 5-59. UART8 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|------------|----------|-------------------|---------------------|
| UART8_CTSn | I | UART 允许发送 (低电平有效) | AF37 |
| UART8_RTSn | O | UART 请求发送 (低电平有效) | AG37 |
| UART8_RXD | I | UART 接收数据 | AB38、AE34、AK35、AP38 |
| UART8_TXD | O | UART 发送数据 | AB36、AK38、AL33、AN38 |

表 5-60. UART9 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|------------|----------|-------------------|------------|
| UART9_CTSn | I | UART 允许发送 (低电平有效) | AK33、AK37 |
| UART9_RTSn | O | UART 请求发送 (低电平有效) | AC34、AJ34 |
| UART9_RXD | I | UART 接收数据 | AC32、AG34 |
| UART9_TXD | O | UART 发送数据 | AC37、AK36 |

5.3.8.2 MCU 域

表 5-61. MCU_UART0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------------|----------|-------------------|-------------|
| MCU_UART0_CTSn | I | UART 允许发送 (低电平有效) | F33、H37 |
| MCU_UART0_RTSn | O | UART 请求发送 (低电平有效) | G33、K37 |
| MCU_UART0_RXD | I | UART 接收数据 | D31、K38、M38 |
| MCU_UART0_TXD | O | UART 发送数据 | G31、J37、L33 |

5.3.8.3 WKUP 域

表 5-62. WKUP_UART0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-----------------|----------|-------------------|------------|
| WKUP_UART0_CTSn | I | UART 允许发送 (低电平有效) | L37 |
| WKUP_UART0_RTSn | O | UART 请求发送 (低电平有效) | L36 |
| WKUP_UART0_RXD | I | UART 接收数据 | K35 |
| WKUP_UART0_TXD | O | UART 发送数据 | K34 |

5.3.9 MDIO

5.3.9.1 MAIN 域

表 5-63. MDIO0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|------------|----------|---------|------------|
| MDIO0_MDC | O | MDIO 时钟 | AD38 |
| MDIO0_MDIO | IO | MDIO 数据 | AD33 |

表 5-64. MDIO1 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|------------|----------|---------|------------|
| MDIO1_MDC | O | MDIO 时钟 | AE37 |
| MDIO1_MDIO | IO | MDIO 数据 | AC36 |

5.3.9.2 MCU 域

表 5-65. MCU_MDIO0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------------|----------|---------|------------|
| MCU_MDIO0_MDC | O | MDIO 时钟 | A36 |
| MCU_MDIO0_MDIO | IO | MDIO 数据 | B35 |

5.3.10 UFS

5.3.10.1 MAIN 域

表 5-66. UFS0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|--------------|----------|--------------|------------|
| UFS0_REF_CLK | I | UFS 基准时钟 | AM7 |
| UFS0_RSTn | I | UFS 复位 | AM8 |
| UFS0_RX_DN0 | I | UFS 接收数据 (负) | AM4 |
| UFS0_RX_DN1 | I | UFS 接收数据 (负) | AM1 |
| UFS0_RX_DP0 | I | UFS 接收数据 (正) | AM5 |
| UFS0_RX_DP1 | I | UFS 接收数据 (正) | AM2 |
| UFS0_TX_DN0 | I | UFS 发送数据 (负) | AL2 |
| UFS0_TX_DN1 | I | UFS 发送数据 (负) | AN2 |
| UFS0_TX_DP0 | I | UFS 发送数据 (正) | AL3 |
| UFS0_TX_DP1 | I | UFS 发送数据 (正) | AN3 |

5.3.11 CPSW2G

5.3.11.1 MAIN 域

表 5-67. CPSW2G0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|---------------|----------|----------------|------------|
| CLKOUT | IO | RMII 时钟输出 | AF34 |
| RGMII1_RXC | I | RGMII 接收时钟 | AL33 |
| RGMII1_RX_CTL | I | RGMII 接收控制 | AE34 |
| RGMII1_TXC | O | RGMII 发送时钟 | AL34 |
| RGMII1_TX_CTL | O | RGMII 发送控制 | AF35 |
| RGMII1_RD0 | I | RGMII 接收数据 0 | AC34 |
| RGMII1_RD1 | I | RGMII 接收数据 1 | AD34 |
| RGMII1_RD2 | I | RGMII 接收数据 2 | AJ36 |
| RGMII1_RD3 | I | RGMII 接收数据 3 | AF34 |
| RGMII1_TD0 | O | RGMII 发送数据 0 | AE35 |
| RGMII1_TD1 | O | RGMII 发送数据 1 | AC35 |
| RGMII1_TD2 | O | RGMII 发送数据 2 | AG35 |
| RGMII1_TD3 | O | RGMII 发送数据 3 | AH36 |
| RMII1_CRD_DV | I | RMII 载波侦听/数据有效 | AH36 |
| RMII1_RX_ER | I | RMII 接收数据错误 | AF35 |
| RMII1_TX_EN | O | RMII 发送使能 | AE34 |
| RMII1_RXD0 | I | RMII 接收数据 0 | AC35 |
| RMII1_RXD1 | I | RMII 接收数据 1 | AG35 |
| RMII1_TXD0 | O | RMII 发送数据 0 | AD34 |

表 5-67. CPSW2G0 信号说明 (续)

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|--------------|----------|-------------|------------|
| RMII1_TXD1 | O | RMII 发送数据 1 | AL33 |
| RMII_REF_CLK | I | RMII 基准时钟 | AJ36 |

5.3.11.2 MCU 域

表 5-68. MCU_CPSW2G0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-------------------|----------|----------------|------------|
| MCU_RGMII1_RXC | I | RGMII 接收时钟 | B37 |
| MCU_RGMII1_RX_CTL | I | RGMII 接收控制 | C37 |
| MCU_RGMII1_TXC | O | RGMII 发送时钟 | E36 |
| MCU_RGMII1_TX_CTL | O | RGMII 发送控制 | C38 |
| MCU_RGMII1_RD0 | I | RGMII 接收数据 0 | A35 |
| MCU_RGMII1_RD1 | I | RGMII 接收数据 1 | B36 |
| MCU_RGMII1_RD2 | I | RGMII 接收数据 2 | C36 |
| MCU_RGMII1_RD3 | I | RGMII 接收数据 3 | D36 |
| MCU_RGMII1_TD0 | O | RGMII 发送数据 0 | D37 |
| MCU_RGMII1_TD1 | O | RGMII 发送数据 1 | D38 |
| MCU_RGMII1_TD2 | O | RGMII 发送数据 2 | E37 |
| MCU_RGMII1_TD3 | O | RGMII 发送数据 3 | E38 |
| MCU_RMII1_CRS_DV | I | RMII 载波侦听/数据有效 | C38 |
| MCU_RMII1_REF_CLK | I | RMII 基准时钟 | B37 |
| MCU_RMII1_RX_ER | I | RMII 接收数据错误 | C37 |
| MCU_RMII1_TX_EN | O | RMII 发送使能 | E36 |
| MCU_RMII1_RXD0 | I | RMII 接收数据 0 | A35 |
| MCU_RMII1_RXD1 | I | RMII 接收数据 1 | B36 |
| MCU_RMII1_TXD0 | O | RMII 发送数据 0 | D37 |
| MCU_RMII1_TXD1 | O | RMII 发送数据 1 | D38 |

5.3.12 SGMII

5.3.12.1 MAIN 域

表 5-69. CPSW9X0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-------------|----------|--------------|------------|
| SGMII1_RXN0 | I | SGMII 接收 (负) | AU2、AU20 |
| SGMII1_RXP0 | I | SGMII 接收 (正) | AU21、AU3 |
| SGMII1_TXN0 | O | SGMII 发送 (负) | AR2、AR20 |
| SGMII1_TXP0 | O | SGMII 发送 (正) | AR21、AR3 |
| SGMII2_RXN0 | I | SGMII 接收 (负) | AT1、AT19 |
| SGMII2_RXP0 | I | SGMII 接收 (正) | AT2、AT20 |
| SGMII2_TXN0 | O | SGMII 发送 (负) | AP1、AP19 |
| SGMII2_TXP0 | O | SGMII 发送 (正) | AP2、AP20 |
| SGMII3_RXN0 | I | SGMII 接收 (负) | AU5 |
| SGMII3_RXP0 | I | SGMII 接收 (正) | AU6 |
| SGMII3_TXN0 | O | SGMII 发送 (负) | AV6 |

表 5-69. CPSW9X0 信号说明 (续)

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-------------|----------|--------------|------------|
| SGMII3_TXP0 | O | SGMII 发送 (正) | AV7 |
| SGMII4_RXN0 | I | SGMII 接收 (负) | AT4 |
| SGMII4_RXP0 | I | SGMII 接收 (正) | AT5 |
| SGMII4_TXN0 | O | SGMII 发送 (负) | AR5 |
| SGMII4_TXP0 | O | SGMII 发送 (正) | AR6 |
| SGMII5_RXN0 | I | SGMII 接收 (负) | AR14、AU23 |
| SGMII5_RXP0 | I | SGMII 接收 (正) | AR15、AU24 |
| SGMII5_TXN0 | O | SGMII 发送 (负) | AP13、AV24 |
| SGMII5_TXP0 | O | SGMII 发送 (正) | AP14、AV25 |
| SGMII6_RXN0 | I | SGMII 接收 (负) | AT22、AU14 |
| SGMII6_RXP0 | I | SGMII 接收 (正) | AT23、AU15 |
| SGMII6_TXN0 | O | SGMII 发送 (负) | AR23、AT13 |
| SGMII6_TXP0 | O | SGMII 发送 (正) | AR24、AT14 |
| SGMII7_RXN0 | I | SGMII 接收 (负) | AR17、AU20 |
| SGMII7_RXP0 | I | SGMII 接收 (正) | AR18、AU21 |
| SGMII7_TXN0 | O | SGMII 发送 (负) | AR20、AT16 |
| SGMII7_TXP0 | O | SGMII 发送 (正) | AR21、AT17 |
| SGMII8_RXN0 | I | SGMII 接收 (负) | AT19、AU17 |
| SGMII8_RXP0 | I | SGMII 接收 (正) | AT20、AU18 |
| SGMII8_TXN0 | O | SGMII 发送 (负) | AP19、AV18 |
| SGMII8_TXP0 | O | SGMII 发送 (正) | AP20、AV19 |

5.3.13 ECAP

5.3.13.1 MAIN 域

表 5-70. ECAP0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-------------------|----------|----------------------------------|------------|
| ECAP0_IN_APWM_OUT | IO | 增强型捕获 (ECAP) 输入或辅助 PWM (APWM) 输出 | AB34、AD36 |

表 5-71. ECAP1 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-------------------|----------|----------------------------------|------------|
| ECAP1_IN_APWM_OUT | IO | 增强型捕获 (ECAP) 输入或辅助 PWM (APWM) 输出 | AA33、AR38 |

表 5-72. ECAP2 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-------------------|----------|----------------------------------|------------|
| ECAP2_IN_APWM_OUT | IO | 增强型捕获 (ECAP) 输入或辅助 PWM (APWM) 输出 | AN37 |

5.3.14 EQEP

5.3.14.1 MAIN 域

表 5-73. EQEP0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|-------------|------------|
| EQEP0_A | I | EQEP 正交输入 A | AF34 |
| EQEP0_B | I | EQEP 正交输入 B | AE34 |
| EQEP0_I | IO | EQEP 索引 | AD33 |

表 5-73. EQEP0 信号说明 (续)

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|---------|------------|
| EQEP0_S | IO | EQEP 选通 | AC34 |

表 5-74. EQEP1 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|-------------|------------|
| EQEP1_A | I | EQEP 正交输入 A | AL33 |
| EQEP1_B | I | EQEP 正交输入 B | AL34 |
| EQEP1_I | IO | EQEP 索引 | AK37 |
| EQEP1_S | IO | EQEP 选通 | AD38 |

表 5-75. EQEP2 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|-------------|------------|
| EQEP2_A | I | EQEP 正交输入 A | AK33 |
| EQEP2_B | I | EQEP 正交输入 B | AC37 |
| EQEP2_I | IO | EQEP 索引 | AC36 |
| EQEP2_S | IO | EQEP 选通 | AD37 |

5.3.15 EPWM

5.3.15.1 MAIN 域

表 5-76. EPWM 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------------|----------|------------------------|------------|
| EHRPWM_SOC_A | O | EHRPWM 转换启动 A | AE37 |
| EHRPWM_SOC_B | O | EHRPWM 转换启动 B | AD34 |
| EHRPWM_TZn_IN0 | I | EHRPWM 触发区输入 0 (低电平有效) | AJ38 |
| EHRPWM_TZn_IN1 | I | EHRPWM 触发区输入 1 (低电平有效) | AC32 |
| EHRPWM_TZn_IN2 | I | EHRPWM 触发区输入 2 (低电平有效) | AK35 |
| EHRPWM_TZn_IN3 | I | EHRPWM 触发区输入 3 (低电平有效) | AC35 |
| EHRPWM_TZn_IN4 | I | EHRPWM 触发区输入 4 (低电平有效) | AF36 |
| EHRPWM_TZn_IN5 | I | EHRPWM 触发区输入 5 (低电平有效) | AJ37 |

表 5-77. EPWM0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|---------------|----------|-----------------------|----------------|
| EHRPWM0_A | IO | EHRPWM 输出 A | AA32、AE38、AM37 |
| EHRPWM0_B | IO | EHRPWM 输出 B | AC38、AF38 |
| EHRPWM0_SYNCI | I | 从外部引脚到 EHRPWM 模块的同步输入 | AH38 |
| EHRPWM0_SYNCO | O | 从 EHRPWM 模块到外部引脚的同步输出 | AG37 |

表 5-78. EPWM1 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-----------|----------|-------------|----------------|
| EHRPWM1_A | IO | EHRPWM 输出 A | AA33、AE36、AP38 |
| EHRPWM1_B | IO | EHRPWM 输出 B | AB34、AC33 |

表 5-79. EPWM2 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-----------|----------|-------------|----------------|
| EHRPWM2_A | IO | EHRPWM 输出 A | AB36、AF37、AN38 |
| EHRPWM2_B | IO | EHRPWM 输出 B | AB38、AK38 |

表 5-80. EPWM3 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|---------------|----------|-----------------------|----------------|
| EHRPWM3_A | IO | EHRPWM 输出 A | AC38、AE35、AM35 |
| EHRPWM3_B | IO | EHRPWM 输出 B | AF35 |
| EHRPWM3_SYNCI | I | 从外部引脚到 EHRPWM 模块的同步输入 | AH36 |
| EHRPWM3_SYNCO | O | 从 EHRPWM 模块到外部引脚的同步输出 | AG35 |

表 5-81. EPWM4 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-----------|----------|-------------|----------------|
| EHRPWM4_A | IO | EHRPWM 输出 A | AB34、AJ36、AM36 |
| EHRPWM4_B | IO | EHRPWM 输出 B | AH37 |

表 5-82. EPWM5 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-----------|----------|-------------|------------|
| EHRPWM5_A | IO | EHRPWM 输出 A | AB38、AG38 |
| EHRPWM5_B | IO | EHRPWM 输出 B | AK34 |

5.3.16 USB

5.3.16.1 MAIN 域

表 5-83. USB0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------------------------|----------|-------------------------|----------------|
| USB0_DM | IO | USB 2.0 差分数据 (负) | AP16 |
| USB0_DP | IO | USB 2.0 差分数据 (正) | AP17 |
| USB0_DRVVBUS | O | USB VBUS 控制输出 (高电平有效) | AE35、AL32、AN37 |
| USB0_ID | A | USB 2.0 双角色设备角色选择 | AN17 |
| USB0_RCALIB ⁽¹⁾ | A | 连接到校准电阻的引脚 | AN18 |
| USB0_VBUS ⁽²⁾ | A | USB 电平转换的 VBUS 检测器 | AN15 |
| USB0_SSRX1N | I | SERDES_USB 差分接收数据 (负) | AR11、AR17 |
| USB0_SSRX1P | I | SERDES_USB 差分接收数据 (正) | AR12、AR18 |
| USB0_SSRX2N | I | SERDES_USB 差分接收数据 (负) | AU11、AU17 |
| USB0_SSRX2P | I | SERDES_USB 差分接收数据 (正) | AU12、AU18 |
| USB0_SSTX1N | O | SERDES_USB 差分发送数据 (负) | AT16、AV9 |
| USB0_SSTX1P | O | SERDES_USB 差分发送数据 (正) | AT17、AV10 |
| USB0_SSTX2N | O | SERDES_USB 差分发送数据 (负) | AV12、AV18 |
| USB0_SSTX2P | O | SERDES_USB 差分发送数据 (正) | AV13、AV19 |

(1) 即使未使用该引脚，也必须在引脚和 VSS 之间连接一个外部 500 Ω ±1% 电阻器

(2) 需要使用外部电阻分压器来限制施加到该器件引脚的电压。有关更多信息，请参阅 *USB VBUS 设计指南*。

5.3.17 显示端口

5.3.17.1 MAIN 域

表 5-84. DP0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|------------------|----------------|
| DP0_AUXN | IO | 显示端口差分辅助数据 (负) | AP22 |
| DP0_AUXP | IO | 显示端口差分辅助数据 (正) | AP23 |
| DP0_HPD | I | 显示端口热插拔检测 | AC34、AG33、AM37 |
| DP0_TXN0 | O | 显示端口差分传输 (负) | AP13 |
| DP0_TXN1 | O | 显示端口差分传输 (负) | AT13 |
| DP0_TXN2 | O | 显示端口差分传输 (负) | AT16 |
| DP0_TXN3 | O | 显示端口差分传输 (负) | AV18 |
| DP0_TXP0 | O | 显示端口差分传输 (正) | AP14 |
| DP0_TXP1 | O | 显示端口差分传输 (正) | AT14 |
| DP0_TXP2 | O | 显示端口差分传输 (正) | AT17 |
| DP0_TXP3 | O | 显示端口差分传输 (正) | AV19 |

5.3.18 PCIE

5.3.18.1 MAIN 域

表 5-85. PCIE 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|---------------|----------|--------------------------|------------|
| PCIE0_CLKREQn | IO | PCIE 时钟请求信号 | AC34 |
| PCIE1_CLKREQn | IO | PCIE 时钟请求信号 | AC38、AR38 |
| PCIE2_CLKREQn | IO | PCIE 时钟请求信号 | AB38、AL33 |
| PCIE3_CLKREQn | IO | PCIE 时钟请求信号 | AB36、AL34 |
| PCIE0_RXN0 | I | SERDES_PCIE 差分接收数据 (负) | AU5 |
| PCIE0_RXN1 | I | SERDES_PCIE 差分接收数据 (负) | AT4 |
| PCIE0_RXN2 | I | SERDES_PCIE 差分接收数据 (负) | AU2 |
| PCIE0_RXN3 | I | SERDES_PCIE 差分接收数据 (负) | AT1 |
| PCIE0_RXP0 | I | SERDES_PCIE 差分接收数据 (正) | AU6 |
| PCIE0_RXP1 | I | SERDES_PCIE 差分接收数据 (正) | AT5 |
| PCIE0_RXP2 | I | SERDES_PCIE 差分接收数据 (正) | AU3 |
| PCIE0_RXP3 | I | SERDES_PCIE 差分接收数据 (正) | AT2 |
| PCIE0_TXN0 | O | SERDES_PCIE 差分发送数据 (负) | AV6 |
| PCIE0_TXN1 | O | SERDES_PCIE 差分发送数据 (负) | AR5 |
| PCIE0_TXN2 | O | SERDES_PCIE 差分发送数据 (负) | AR2 |
| PCIE0_TXN3 | O | SERDES_PCIE 差分发送数据 (正) | AP1 |
| PCIE0_TXP0 | O | SERDES_PCIE 差分发送数据 (正) | AV7 |
| PCIE0_TXP1 | O | SERDES_PCIE 差分发送数据 (正) | AR6 |
| PCIE0_TXP2 | O | SERDES_PCIE 差分发送数据 (正) | AR3 |
| PCIE0_TXP3 | O | SERDES_PCIE 差分发送数据 (正) | AP2 |
| PCIE1_RXN0 | I | SERDES_PCIE 差分接收数据 (负) | AR8 |
| PCIE1_RXN1 | I | SERDES_PCIE 差分接收数据 (负) | AT10 |
| PCIE1_RXN2 | I | SERDES_PCIE 差分接收数据 (负) | AR11 |
| PCIE1_RXN3 | I | SERDES_PCIE 差分接收数据 (负) | AU11 |

表 5-85. PCIE 信号说明 (续)

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|--------------------|----------|------------------------|------------|
| PCIE1_RXP0 | I | SERDES_PCIE 差分接收数据 (正) | AR9 |
| PCIE1_RXP1 | I | SERDES_PCIE 差分接收数据 (正) | AT11 |
| PCIE1_RXP2 | I | SERDES_PCIE 差分接收数据 (正) | AR12 |
| PCIE1_RXP3 | I | SERDES_PCIE 差分接收数据 (正) | AU12 |
| PCIE1_TXN0 | O | SERDES_PCIE 差分发送数据 (负) | AT7 |
| PCIE1_TXN1 | O | SERDES_PCIE 差分发送数据 (负) | AP10 |
| PCIE1_TXN2 | O | SERDES_PCIE 差分发送数据 (负) | AV9 |
| PCIE1_TXN3 | O | SERDES_PCIE 差分发送数据 (负) | AV12 |
| PCIE1_TXP0 | O | SERDES_PCIE 差分发送数据 (正) | AT8 |
| PCIE1_TXP1 | O | SERDES_PCIE 差分发送数据 (正) | AP11 |
| PCIE1_TXP2 | O | SERDES_PCIE 差分发送数据 (正) | AV10 |
| PCIE1_TXP3 | O | SERDES_PCIE 差分发送数据 (正) | AV13 |
| PCIE2_RXN0 | I | SERDES_PCIE 差分接收数据 (负) | AU2 |
| PCIE2_RXN1 | I | SERDES_PCIE 差分接收数据 (负) | AT1 |
| PCIE2_RXP0 | I | SERDES_PCIE 差分接收数据 (正) | AU3 |
| PCIE2_RXP1 | I | SERDES_PCIE 差分接收数据 (正) | AT2 |
| PCIE2_TXN0 | O | SERDES_PCIE 差分发送数据 (负) | AR2 |
| PCIE2_TXN1 | O | SERDES_PCIE 差分发送数据 (负) | AP1 |
| PCIE2_TXP0 | O | SERDES_PCIE 差分发送数据 (负) | AR3 |
| PCIE2_TXP1 | O | SERDES_PCIE 差分发送数据 (正) | AP2 |
| PCIE3_RXN0 | I | SERDES_PCIE 差分接收数据 (负) | AR11 |
| PCIE3_RXN1 | I | SERDES_PCIE 差分接收数据 (负) | AU11 |
| PCIE3_RXP0 | I | SERDES_PCIE 差分接收数据 (正) | AR12 |
| PCIE3_RXP1 | I | SERDES_PCIE 差分接收数据 (正) | AU12 |
| PCIE3_TXN0 | O | SERDES_PCIE 差分发送数据 (负) | AV9 |
| PCIE3_TXN1 | O | SERDES_PCIE 差分发送数据 (负) | AV12 |
| PCIE3_TXP0 | O | SERDES_PCIE 差分发送数据 (正) | AV10 |
| PCIE3_TXP1 | O | SERDES_PCIE 差分发送数据 (正) | AV13 |
| PCIE_REFCLK0_N_OUT | O | SERDES_PCIE 基准时钟 (负) | AP4 |
| PCIE_REFCLK0_P_OUT | O | SERDES_PCIE 基准时钟 (正) | AP5 |
| PCIE_REFCLK1_N_OUT | O | SERDES_PCIE 基准时钟输出 (负) | AN8 |
| PCIE_REFCLK1_P_OUT | O | SERDES_PCIE 基准时钟输出 (正) | AN9 |
| PCIE_REFCLK2_N_OUT | O | SERDES_PCIE 基准时钟输出 (负) | AN5 |
| PCIE_REFCLK2_P_OUT | O | SERDES_PCIE 基准时钟输出 (正) | AN6 |
| PCIE_REFCLK3_N_OUT | O | SERDES_PCIE 基准时钟输出 (负) | AP7 |
| PCIE_REFCLK3_P_OUT | O | SERDES_PCIE 基准时钟输出 (正) | AP8 |

5.3.19 SERDES

5.3.19.1 MAIN 域

表 5-86. SERDES0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|------------------|----------|----------------------|------------|
| SERDES0_REFCLK_N | IO | 串行器/解串器基准时钟输入/输出 (负) | AU9 |

表 5-86. SERDES0 信号说明 (续)

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-----------------------------|----------|----------------------|------------|
| SERDES0_REFCLK_P | IO | 串行器/解串器基准时钟输入/输出 (正) | AV8 |
| SERDES0_REXT ⁽¹⁾ | I | 外部校准电阻器 | AN11 |

(1) 必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部 3.01kΩ ±1% 电阻器。不应向该引脚施加外部电压。

表 5-87. SERDES1 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-----------------------------|----------|----------------------|------------|
| SERDES1_REFCLK_N | IO | 串行器/解串器基准时钟输入/输出 (负) | AV3 |
| SERDES1_REFCLK_P | IO | 串行器/解串器基准时钟输入/输出 (正) | AV4 |
| SERDES1_REXT ⁽¹⁾ | I | 外部校准电阻器 | AL9 |

(1) 必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部 3.01kΩ ±1% 电阻器。不应向该引脚施加外部电压。

表 5-88. SERDES2 信号说明

| 信号名称 [1] ⁽²⁾ | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-----------------------------|----------|----------------------|------------|
| SERDES2_REFCLK_N | IO | 串行器/解串器基准时钟输入/输出 (负) | AV21 |
| SERDES2_REFCLK_P | IO | 串行器/解串器基准时钟输入/输出 (正) | AV22 |
| SERDES2_REXT ⁽¹⁾ | IO | 外部校准电阻器 | AL20 |

(1) 必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部 3.01kΩ ±1% 电阻器。不应向该引脚施加外部电压。

(2) 此 SoC 的 27mm 封装型号不提供 DDRSS2、DDRSS3 和 SERDES2。如果希望与使用 27mm 封装的系统具有软件兼容性，则应避免使用 DDRSS2/DDRSS3/SERDES2。

表 5-89. SERDES4 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-----------------------------|----------|----------------------|------------|
| SERDES4_REFCLK_N | IO | 串行器/解串器基准时钟输入/输出 (负) | AV16 |
| SERDES4_REFCLK_P | IO | 串行器/解串器基准时钟输入/输出 (正) | AV15 |
| SERDES4_REXT ⁽¹⁾ | IO | 外部校准电阻器 | AM19 |

(1) 必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部 3.01kΩ ±1% 电阻器。不应向该引脚施加外部电压。

5.3.20 DSI

5.3.20.1 MAIN 域

表 5-90. DSI0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-------------|----------|------------------|------------|
| CSI0_TXCLKN | O | CSI 差分发送时钟输出 (负) | AP26 |
| CSI0_TXCLKP | O | CSI 差分发送时钟输出 (正) | AP25 |
| CSI0_TXN0 | O | CSI 差分发送输出 (负) | AU27 |
| CSI0_TXN1 | O | CSI 差分发送输出 (负) | AT26 |
| CSI0_TXN2 | O | CSI 差分发送输出 (负) | AR27 |
| CSI0_TXN3 | O | CSI 差分发送输出 (负) | AN24 |
| CSI0_TXP0 | O | CSI 差分发送输出 (正) | AU26 |
| CSI0_TXP1 | O | CSI 差分发送输出 (正) | AT25 |
| CSI0_TXP2 | O | CSI 差分发送输出 (正) | AR26 |
| CSI0_TXP3 | O | CSI 差分发送输出 (正) | AN23 |
| DSI0_TXCLKN | O | DSI 发送时钟 (负) | AP26 |
| DSI0_TXCLKP | O | DSI 发送时钟 (正) | AP25 |

表 5-90. DSI0 信号说明 (续)

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|------------------------------|----------|-------------|------------|
| DSI0_TXRCALIB ⁽¹⁾ | A | DSI 发送校准电阻器 | AM24 |
| DSI0_TXN0 | IO | DSI 发送 (负) | AU27 |
| DSI0_TXN1 | O | DSI 发送 (负) | AT26 |
| DSI0_TXN2 | O | DSI 发送 (负) | AR27 |
| DSI0_TXN3 | O | DSI 发送 (负) | AN24 |
| DSI0_TXP0 | IO | DSI 发送 (正) | AU26 |
| DSI0_TXP1 | O | DSI 发送 (正) | AT25 |
| DSI0_TXP2 | O | DSI 发送 (正) | AR26 |
| DSI0_TXP3 | O | DSI 发送 (正) | AN23 |

(1) 即使未使用该引脚, 也必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部 $500\Omega \pm 1\%$ 电阻器。

表 5-91. DSI1 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|------------------------------|----------|------------------|------------|
| CSI1_TXCLKN | O | CSI 差分发送时钟输出 (负) | AP29 |
| CSI1_TXCLKP | O | CSI 差分发送时钟输出 (正) | AP28 |
| CSI1_TXN0 | O | CSI 差分发送输出 (负) | AT29 |
| CSI1_TXN1 | O | CSI 差分发送输出 (负) | AN27 |
| CSI1_TXN2 | O | CSI 差分发送输出 (负) | AV28 |
| CSI1_TXN3 | O | CSI 差分发送输出 (负) | AU30 |
| CSI1_TXP0 | O | CSI 差分发送输出 (正) | AT28 |
| CSI1_TXP1 | O | CSI 差分发送输出 (正) | AN26 |
| CSI1_TXP2 | O | CSI 差分发送输出 (正) | AV27 |
| CSI1_TXP3 | O | CSI 差分发送输出 (正) | AU29 |
| DSI1_TXCLKN | O | DSI 发送时钟 (负) | AP29 |
| DSI1_TXCLKP | O | DSI 发送时钟 (正) | AP28 |
| DSI1_TXRCALIB ⁽¹⁾ | A | DSI 发送校准电阻器 | AL22 |
| DSI1_TXN0 | IO | DSI 发送 (负) | AT29 |
| DSI1_TXN1 | O | DSI 发送 (负) | AN27 |
| DSI1_TXN2 | O | DSI 发送 (负) | AV28 |
| DSI1_TXN3 | O | DSI 发送 (负) | AU30 |
| DSI1_TXP0 | IO | DSI 发送 (正) | AT28 |
| DSI1_TXP1 | O | DSI 发送 (正) | AN26 |
| DSI1_TXP2 | O | DSI 发送 (正) | AV27 |
| DSI1_TXP3 | O | DSI 发送 (正) | AU29 |

(1) 即使未使用该引脚, 也必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部 $500\Omega \pm 1\%$ 电阻器。

5.3.21 CSI

5.3.21.1 MAIN 域

表 5-92. CSI0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-------------|----------|------------------|------------|
| CSI0_RXCLKN | I | CSI 差分接收时钟输入 (负) | AN30 |
| CSI0_RXCLKP | I | CSI 差分接收时钟输入 (正) | AN29 |

表 5-92. CSI0 信号说明 (续)

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|------------------------------|----------|--------------------------|------------|
| CSI0_RXRCALIB ⁽¹⁾ | A | CSI 引脚连接到外部电阻器，用于片上电阻器校准 | AM28 |
| CSI0_RXN0 | I | CSI 差分接收输入 (负) | AU33 |
| CSI0_RXN1 | I | CSI 差分接收输入 (负) | AT32 |
| CSI0_RXN2 | I | CSI 差分接收输入 (负) | AV31 |
| CSI0_RXN3 | I | CSI 差分接收输入 (负) | AR30 |
| CSI0_RXP0 | I | CSI 差分接收输入 (正) | AU32 |
| CSI0_RXP1 | I | CSI 差分接收输入 (正) | AT31 |
| CSI0_RXP2 | I | CSI 差分接收输入 (正) | AV30 |
| CSI0_RXP3 | I | CSI 差分接收输入 (正) | AR29 |

(1) 即使未使用该引脚，也必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部 500 Ω ±1% 电阻器。

表 5-93. CSI1 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|------------------------------|----------|--------------------------|------------|
| CSI1_RXCLKN | I | CSI 差分接收时钟输入 (负) | AP32 |
| CSI1_RXCLKP | I | CSI 差分接收时钟输入 (正) | AP31 |
| CSI1_RXRCALIB ⁽¹⁾ | A | CSI 引脚连接到外部电阻器，用于片上电阻器校准 | AL28 |
| CSI1_RXN0 | I | CSI 差分接收输入 (负) | AT35 |
| CSI1_RXN1 | I | CSI 差分接收输入 (负) | AU36 |
| CSI1_RXN2 | I | CSI 差分接收输入 (负) | AR33 |
| CSI1_RXN3 | I | CSI 差分接收输入 (负) | AV34 |
| CSI1_RXP0 | I | CSI 差分接收输入 (正) | AT34 |
| CSI1_RXP1 | I | CSI 差分接收输入 (正) | AU35 |
| CSI1_RXP2 | I | CSI 差分接收输入 (正) | AR32 |
| CSI1_RXP3 | I | CSI 差分接收输入 (正) | AV33 |

(1) 即使未使用该引脚，也必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部 500 Ω ±1% 电阻器。

表 5-94. CSI2 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|------------------------------|----------|--------------------------|------------|
| CSI2_RXCLKN | I | CSI 差分接收时钟输入 (负) | AN32 |
| CSI2_RXCLKP | I | CSI 差分接收时钟输入 (正) | AN33 |
| CSI2_RXRCALIB ⁽¹⁾ | A | CSI 引脚连接到外部电阻器，用于片上电阻器校准 | AM31 |
| CSI2_RXN0 | I | CSI 差分接收输入 (负) | AR36 |
| CSI2_RXN1 | I | CSI 差分接收输入 (负) | AT38 |
| CSI2_RXN2 | I | CSI 差分接收输入 (负) | AP35 |
| CSI2_RXN3 | I | CSI 差分接收输入 (负) | AV37 |
| CSI2_RXP0 | I | CSI 差分接收输入 (正) | AR35 |
| CSI2_RXP1 | I | CSI 差分接收输入 (正) | AT37 |
| CSI2_RXP2 | I | CSI 差分接收输入 (正) | AP34 |
| CSI2_RXP3 | I | CSI 差分接收输入 (正) | AV36 |

(1) 即使未使用该引脚，也必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部 500 Ω ±1% 电阻器。

5.3.22 MCASP

5.3.22.1 MAIN 域

表 5-95. MCASP0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|--------------|----------|--------------------|------------|
| MCASP0_ACLKR | IO | MCASP 接收位时钟 | AF34 |
| MCASP0_ACLKX | IO | MCASP 发送位时钟 | AK35 |
| MCASP0_AFSR | IO | MCASP 接收帧同步 | AE34 |
| MCASP0_AFSX | IO | MCASP 发送帧同步 | AK38 |
| MCASP0_AXR0 | IO | MCASP 串行数据 (输入/输出) | AF37 |
| MCASP0_AXR1 | IO | MCASP 串行数据 (输入/输出) | AG37 |
| MCASP0_AXR2 | IO | MCASP 串行数据 (输入/输出) | AK33 |
| MCASP0_AXR3 | IO | MCASP 串行数据 (输入/输出) | AJ38 |
| MCASP0_AXR4 | IO | MCASP 串行数据 (输入/输出) | AK34 |
| MCASP0_AXR5 | IO | MCASP 串行数据 (输入/输出) | AG38 |
| MCASP0_AXR6 | IO | MCASP 串行数据 (输入/输出) | AF36 |
| MCASP0_AXR7 | IO | MCASP 串行数据 (输入/输出) | AE35 |
| MCASP0_AXR8 | IO | MCASP 串行数据 (输入/输出) | AC35 |
| MCASP0_AXR9 | IO | MCASP 串行数据 (输入/输出) | AG35 |
| MCASP0_AXR10 | IO | MCASP 串行数据 (输入/输出) | AH36 |
| MCASP0_AXR11 | IO | MCASP 串行数据 (输入/输出) | AF35 |
| MCASP0_AXR12 | IO | MCASP 串行数据 (输入/输出) | AD34 |
| MCASP0_AXR13 | IO | MCASP 串行数据 (输入/输出) | AJ36 |
| MCASP0_AXR14 | IO | MCASP 串行数据 (输入/输出) | AF34 |
| MCASP0_AXR15 | IO | MCASP 串行数据 (输入/输出) | AE34 |

表 5-96. MCASP1 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|--------------|----------|--------------------|------------|
| MCASP1_ACLKR | IO | MCASP 接收位时钟 | AG38 |
| MCASP1_ACLKX | IO | MCASP 发送位时钟 | AC34 |
| MCASP1_AFSR | IO | MCASP 接收帧同步 | AF36 |
| MCASP1_AFSX | IO | MCASP 发送帧同步 | AD33 |
| MCASP1_AXR0 | IO | MCASP 串行数据 (输入/输出) | AD38 |
| MCASP1_AXR1 | IO | MCASP 串行数据 (输入/输出) | AC32 |
| MCASP1_AXR2 | IO | MCASP 串行数据 (输入/输出) | AC37 |
| MCASP1_AXR3 | IO | MCASP 串行数据 (输入/输出) | AL33 |
| MCASP1_AXR4 | IO | MCASP 串行数据 (输入/输出) | AL34 |

表 5-97. MCASP2 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|--------------|----------|--------------------|------------|
| MCASP2_ACLKR | IO | MCASP 接收位时钟 | AD34 |
| MCASP2_ACLKX | IO | MCASP 发送位时钟 | AD37 |
| MCASP2_AFSR | IO | MCASP 接收帧同步 | AJ36 |
| MCASP2_AFSX | IO | MCASP 发送帧同步 | AE37 |
| MCASP2_AXR0 | IO | MCASP 串行数据 (输入/输出) | AC36 |

表 5-97. MCASP2 信号说明 (续)

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-------------|----------|--------------------|------------|
| MCASP2_AXR1 | IO | MCASP 串行数据 (输入/输出) | AE36 |
| MCASP2_AXR2 | IO | MCASP 串行数据 (输入/输出) | AF38 |
| MCASP2_AXR3 | IO | MCASP 串行数据 (输入/输出) | AC33 |
| MCASP2_AXR4 | IO | MCASP 串行数据 (输入/输出) | AF34 |

表 5-98. MCASP3 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|--------------|----------|--------------------|------------|
| MCASP3_ACLKR | IO | MCASP 接收位时钟 | AM37 |
| MCASP3_ACLKX | IO | MCASP 发送位时钟 | AM37 |
| MCASP3_AFSR | IO | MCASP 接收帧同步 | AP38 |
| MCASP3_AFSX | IO | MCASP 发送帧同步 | AP38 |
| MCASP3_AXR0 | IO | MCASP 串行数据 (输入/输出) | AN38 |
| MCASP3_AXR1 | IO | MCASP 串行数据 (输入/输出) | AM35 |
| MCASP3_AXR2 | IO | MCASP 串行数据 (输入/输出) | AM36 |

表 5-99. MCASP4 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|--------------|----------|---------------------|------------|
| MCASP4_ACLKR | IO | MCASP 接收位时钟 | AE35 |
| MCASP4_ACLKX | IO | MCASP 发送位时钟 | AJ32 |
| MCASP4_AFSR | IO | MCASP 接收帧同步 | AC35 |
| MCASP4_AFSX | IO | MCASP 发送帧同步 | AJ37 |
| MCASP4_AXR0 | IO | MCASP 串行数据 (输入/输出) | AJ34 |
| MCASP4_AXR1 | IO | MCASP 串行数据 (输入/输出) | AE38 |
| MCASP4_AXR2 | IO | MCASP 串行数据 (输入/输出) | AD36 |
| MCASP4_AXR3 | IO | MCASP 串行数据 (输入/输出) | AH38 |
| MCASP4_AXR4 | IO | MCASPI 串行数据 (输入/输出) | AG35 |

5.3.23 DMTIMER

5.3.23.1 MAIN 域

表 5-100. DMTIMER 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-----------|----------|---------------------------------|------------|
| TIMER_IO0 | IO | 计时器输入和输出 (可与任何 MAIN 域计时器实例配合使用) | AR38 |
| TIMER_IO1 | IO | 计时器输入和输出 (可与任何 MAIN 域计时器实例配合使用) | AN37 |
| TIMER_IO2 | IO | 计时器输入和输出 (可与任何 MAIN 域计时器实例配合使用) | AC38 |
| TIMER_IO3 | IO | 计时器输入和输出 (可与任何 MAIN 域计时器实例配合使用) | AA32 |
| TIMER_IO4 | IO | 计时器输入和输出 (可与任何 MAIN 域计时器实例配合使用) | AB34 |
| TIMER_IO5 | IO | 计时器输入和输出 (可与任何 MAIN 域计时器实例配合使用) | AA33 |

表 5-100. DMTIMER 信号说明 (续)

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-----------|----------|---------------------------------|------------|
| TIMER_IO6 | IO | 计时器输入和输出 (可与任何 MAIN 域计时器实例配合使用) | AB38 |
| TIMER_IO7 | IO | 计时器输入和输出 (可与任何 MAIN 域计时器实例配合使用) | AB36 |

5.3.23.2 MCU 域

表 5-101. MCU_DMTIMER 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|---------------|----------|---------------------------------|------------|
| MCU_TIMER_IO0 | IO | 计时器输入和输出 (可与任何 MCU 域计时器实例配合使用。) | G33、J38 |
| MCU_TIMER_IO1 | IO | 计时器输入和输出 (可与任何 MCU 域计时器实例配合使用。) | F37、M38 |
| MCU_TIMER_IO2 | IO | 计时器输入和输出 (可与任何 MCU 域计时器实例配合使用。) | E38 |
| MCU_TIMER_IO3 | IO | 计时器输入和输出 (可与任何 MCU 域计时器实例配合使用。) | E37 |
| MCU_TIMER_IO4 | IO | 计时器输入和输出 (可与任何 MCU 域计时器实例配合使用。) | D36 |
| MCU_TIMER_IO5 | IO | 计时器输入和输出 (可与任何 MCU 域计时器实例配合使用。) | C36 |
| MCU_TIMER_IO6 | IO | 计时器输入和输出 (可与任何 MCU 域计时器实例配合使用。) | L35、M37 |
| MCU_TIMER_IO7 | IO | 计时器输入和输出 (可与任何 MCU 域计时器实例配合使用。) | L34、M36 |
| MCU_TIMER_IO8 | IO | 计时器输入和输出 (可与任何 MCU 域计时器实例配合使用。) | H37 |
| MCU_TIMER_IO9 | IO | 计时器输入和输出 (可与任何 MCU 域计时器实例配合使用。) | K37 |

5.3.24 CPTS

5.3.24.1 MAIN 域

表 5-102. CPTS0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-----------------|----------|----------------|------------|
| CPTS0_RFT_CLK | I | CPTS 基准时钟 | AD36 |
| CPTS0_TS_COMP | O | CPTS 时间戳计数器比较 | AP38 |
| CPTS0_TS_SYNC | O | CPTS 时间戳计数器位 | AA32 |
| CPTS0_HW1TSPUSH | I | CPTS 硬件时间戳推送 1 | AD36 |
| CPTS0_HW2TSPUSH | I | CPTS 硬件时间戳推送 2 | AJ32 |

5.3.24.2 MCU 域

表 5-103. MCU_CPTS0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|---------------------|----------|----------------|------------|
| MCU_CPTS0_RFT_CLK | I | CPTS 基准时钟 | L33、M33 |
| MCU_CPTS0_TS_COMP | O | CPTS 时间戳计数器比较 | L34 |
| MCU_CPTS0_TS_SYNC | O | CPTS 时间戳计数器位 | L35 |
| MCU_CPTS0_HW1TSPUSH | I | CPTS 硬件时间戳推送 1 | L37 |

表 5-103. MCU_CPTS0 信号说明 (续)

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|---------------------|----------|----------------|------------|
| MCU_CPTS0_HW2TSPUSH | I | CPTS 硬件时间戳推送 2 | L36 |

5.3.25 DSS

5.3.25.1 MAIN 域

表 5-104. DSS0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-----------------|----------|--------------|------------|
| DSS_FSYNC0 | O | 视频输出帧同步 | AG36、AJ37 |
| DSS_FSYNC1 | O | 视频输出帧同步 | AJ33、AJ34 |
| DSS_FSYNC2 | O | 视频输出帧同步 | AF33、AF35 |
| DSS_FSYNC3 | O | 视频输出帧同步 | AD34、AH33 |
| VOUT0_DE | O | 视频输出数据使能 | AG38 |
| VOUT0_EXTPCLKIN | I | 视频输出外部像素时钟输入 | AJ37 |
| VOUT0_HSYNC | O | 视频输出水平同步 | AK34 |
| VOUT0_PCLK | O | 视频输出像素时钟输出 | AH37 |
| VOUT0_VSYNC | O | 视频输出垂直同步 | AF36 |
| VOUT0_DATA0 | O | 视频输出数据 0 | AC33 |
| VOUT0_DATA1 | O | 视频输出数据 1 | AH38 |
| VOUT0_DATA2 | O | 视频输出数据 2 | AJ38 |
| VOUT0_DATA3 | O | 视频输出数据 3 | AE38 |
| VOUT0_DATA4 | O | 视频输出数据 4 | AF38 |
| VOUT0_DATA5 | O | 视频输出数据 5 | AE36 |
| VOUT0_DATA6 | O | 视频输出数据 6 | AC36 |
| VOUT0_DATA7 | O | 视频输出数据 7 | AE37 |
| VOUT0_DATA8 | O | 视频输出数据 8 | AD37 |
| VOUT0_DATA9 | O | 视频输出数据 9 | AC37 |
| VOUT0_DATA10 | O | 视频输出数据 10 | AC32 |
| VOUT0_DATA11 | O | 视频输出数据 11 | AK33 |
| VOUT0_DATA12 | O | 视频输出数据 12 | AG37 |
| VOUT0_DATA13 | O | 视频输出数据 13 | AF37 |
| VOUT0_DATA14 | O | 视频输出数据 14 | AK38 |
| VOUT0_DATA15 | O | 视频输出数据 15 | AK35 |
| VOUT0_DATA16 | O | 视频输出数据 16 | AJ32 |
| VOUT0_DATA17 | O | 视频输出数据 17 | AK37 |
| VOUT0_DATA18 | O | 视频输出数据 18 | AC33、AL32 |
| VOUT0_DATA19 | O | 视频输出数据 19 | AE33、AH38 |
| VOUT0_DATA20 | O | 视频输出数据 20 | AD37、AH34 |
| VOUT0_DATA21 | O | 视频输出数据 21 | AC37、AJ35 |
| VOUT0_DATA22 | O | 视频输出数据 22 | AG34、AK37 |
| VOUT0_DATA23 | O | 视频输出数据 23 | AD36、AK36 |
| VOUT0_VP0_DE | O | 替代输出数据使能 | AG38 |
| VOUT0_VP0_HSYNC | O | 替代输出水平同步 | AK34 |
| VOUT0_VP0_VSYNC | O | 替代输出垂直同步 | AF36 |
| VOUT0_VP2_DE | O | 替代输出数据使能 | AG38 |

表 5-104. DSS0 信号说明 (续)

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------------|----------|----------|------------|
| VOU0_VP2_HSYNC | O | 替代输出水平同步 | AK34 |
| VOU0_VP2_VSYNC | O | 替代输出垂直同步 | AF36 |

5.3.26 GPMC

5.3.26.1 MAIN 域

表 5-105. GPMC0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------------|----------|--|------------|
| GPMC0_ADVn_ALE | O | GPMC 地址有效 (低电平有效) 或地址锁存使能 | AK33 |
| GPMC0_CLK | IO | GPMC 时钟 | AG36 |
| GPMC0_CLKOUT | O | 为外部同步生成的 GPMC 时钟 | AF36 |
| GPMC0_DIR | O | GPMC 数据总线信号方向控制 | AC33、AH37 |
| GPMC0_OEn_REn | O | GPMC 输出使能 (低电平有效) 或读取使能 (低电平有效) | AK34 |
| GPMC0_WEn | O | GPMC 写入使能 (低电平有效) | AJ34 |
| GPMC0_WPn | O | GPMC 闪存写保护 (低电平有效) | AK33 |
| GPMC0_A0 | OZ | GPMC 地址 0 输出。仅用于有效寻址 8 位数据非多路复用存储器 | AE35 |
| GPMC0_A1 | OZ | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 1 输出, A/D 多路复用模式下为地址 17 | AC35 |
| GPMC0_A2 | OZ | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 2 输出, A/D 多路复用模式下为地址 18 | AG35 |
| GPMC0_A3 | OZ | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 3 输出, A/D 多路复用模式下为地址 19 | AH36 |
| GPMC0_A4 | OZ | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 4 输出, A/D 多路复用模式下为地址 20 | AF35 |
| GPMC0_A5 | OZ | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 5 输出, A/D 多路复用模式下为地址 21 | AD34 |
| GPMC0_A6 | OZ | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 6 输出, A/D 多路复用模式下为地址 22 | AJ36 |
| GPMC0_A7 | OZ | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 7 输出, A/D 多路复用模式下为地址 23 | AF34 |
| GPMC0_A8 | OZ | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 8 输出, A/D 多路复用模式下为地址 24 | AE34 |
| GPMC0_A9 | OZ | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 9 输出, A/D 多路复用模式下为地址 25 | AL33 |
| GPMC0_A10 | OZ | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 10 输出, A/D 多路复用模式下为地址 26 | AL34 |
| GPMC0_A11 | OZ | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 11 输出, A/D 多路复用模式下未使用 | AC34 |
| GPMC0_A12 | OZ | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 12 输出, A/D 多路复用模式下未使用 | AD33 |
| GPMC0_A13 | OZ | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 13 输出, A/D 多路复用模式下未使用 | AD38 |
| GPMC0_A14 | OZ | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 14 输出, A/D 多路复用模式下未使用 | AE35、AL32 |
| GPMC0_A15 | OZ | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 15 输出, A/D 多路复用模式下未使用 | AE33 |

表 5-105. GPMC0 信号说明 (续)

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|------------|----------|---|------------|
| GPMC0_A16 | OZ | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 16 输出, A/D 多路复用模式下未使用 | AH34 |
| GPMC0_A17 | OZ | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 17 输出, A/D 多路复用模式下未使用 | AJ35 |
| GPMC0_A18 | OZ | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 18 输出, A/D 多路复用模式下未使用 | AG34 |
| GPMC0_A19 | OZ | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 19 输出, A/D 多路复用模式下未使用 | AK36 |
| GPMC0_A20 | OZ | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 20 输出, A/D 多路复用模式下未使用 | AG33 |
| GPMC0_A21 | OZ | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 21 输出, A/D 多路复用模式下未使用 | AH33 |
| GPMC0_A22 | OZ | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 22 输出, A/D 多路复用模式下未使用 | AF33 |
| GPMC0_A23 | OZ | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 23 输出, A/D 多路复用模式下未使用 | AJ33 |
| GPMC0_A24 | OZ | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 地址 24 输出, A/D 多路复用模式下未使用 | AG36 |
| GPMC0_AD0 | IO | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 数据 0 输入/输出, A/D 多路复用模式下为附加的地址 1 输出 | AK35 |
| GPMC0_AD1 | IO | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 数据 1 输入/输出, A/D 多路复用模式下为附加的地址 2 输出 | AK38 |
| GPMC0_AD2 | IO | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 数据 2 输入/输出, A/D 多路复用模式下为附加的地址 3 输出 | AF37 |
| GPMC0_AD3 | IO | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 数据 3 输入/输出, A/D 多路复用模式下为附加的地址 4 输出 | AG37 |
| GPMC0_AD4 | IO | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 数据 4 输入/输出, A/D 多路复用模式下为附加的地址 5 输出 | AK37 |
| GPMC0_AD5 | IO | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 数据 5 输入/输出, A/D 多路复用模式下为附加的地址 6 输出 | AD36 |
| GPMC0_AD6 | IO | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 数据 6 输入/输出, A/D 多路复用模式下为附加的地址 7 输出 | AJ32 |
| GPMC0_AD7 | IO | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 数据 7 输入/输出, A/D 多路复用模式下为附加的地址 8 输出 | AJ37 |
| GPMC0_AD8 | IO | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 数据 8 输入/输出, A/D 多路复用模式下为附加的地址 9 输出 | AC32 |
| GPMC0_AD9 | IO | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 数据 9 输入/输出, A/D 多路复用模式下为附加的地址 10 输出 | AC37 |
| GPMC0_AD10 | IO | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 数据 10 输入/输出, A/D 多路复用模式下为附加的地址 11 输出 | AD37 |
| GPMC0_AD11 | IO | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 数据 11 输入/输出, A/D 多路复用模式下为附加的地址 12 输出 | AE37 |
| GPMC0_AD12 | IO | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 数据 12 输入/输出, A/D 多路复用模式下为附加的地址 13 输出 | AC36 |
| GPMC0_AD13 | IO | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 数据 13 输入/输出, A/D 多路复用模式下为附加的地址 14 输出 | AE36 |
| GPMC0_AD14 | IO | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 数据 14 输入/输出, A/D 多路复用模式下为附加的地址 15 输出 | AF38 |
| GPMC0_AD15 | IO | A/D 非多路复用模式下为 GPMC 数据 15 输入/输出, A/D 多路复用模式下为附加的地址 16 输出 | AE38 |

表 5-105. GPMC0 信号说明 (续)

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------------|----------|-----------------------------|------------|
| GPMC0_BE0n_CLE | O | GPMC 低位字节使能 (低电平有效) 或命令锁存使能 | AH38 |
| GPMC0_BE1n | O | GPMC 高位字节使能 (低电平有效) | AJ38 |
| GPMC0_CSn0 | O | GPMC 片选 0 (低电平有效) | AG38 |
| GPMC0_CSn1 | O | GPMC 片选 1 (低电平有效) | AH37 |
| GPMC0_CSn2 | O | GPMC 片选 2 (低电平有效) | AE35、AL32 |
| GPMC0_CSn3 | O | GPMC 片选 3 (低电平有效) | AJ33 |
| GPMC0_WAIT0 | I | GPMC 外部等待指示 | AC33 |
| GPMC0_WAIT1 | I | GPMC 外部等待指示 | AE33 |
| GPMC0_WAIT2 | I | GPMC 外部等待指示 | AF33 |
| GPMC0_WAIT3 | I | GPMC 外部等待指示 | AD38 |

5.3.27 MMC

5.3.27.1 MAIN 域

表 5-106. MMC0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------------------------|----------|-------------------|------------|
| MMC0_CALPAD ⁽¹⁾ | A | MMC/SD/SDIO 校准电阻器 | AJ7 |
| MMC0_CLK | O | MMC/SD/SDIO 时钟 | AK5 |
| MMC0_CMD | IO | MMC/SD/SDIO 命令 | AL8 |
| MMC0_DS | IO | MMC 数据选通 | AK4 |
| MMC0_DAT0 | IO | MMC/SD/SDIO 数据 | AK9 |
| MMC0_DAT1 | IO | MMC/SD/SDIO 数据 | AL6 |
| MMC0_DAT2 | IO | MMC/SD/SDIO 数据 | AK8 |
| MMC0_DAT3 | IO | MMC/SD/SDIO 数据 | AK6 |
| MMC0_DAT4 | IO | MMC/SD/SDIO 数据 | AK7 |
| MMC0_DAT5 | IO | MMC/SD/SDIO 数据 | AL7 |
| MMC0_DAT6 | IO | MMC/SD/SDIO 数据 | AL5 |
| MMC0_DAT7 | IO | MMC/SD/SDIO 数据 | AK3 |

(1) 必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部 10kΩ ±1% 电阻器。不应向该引脚施加外部电压。

表 5-107. MMC1 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|--------------------------|----------|----------------|------------|
| MMC1_CLK ⁽²⁾ | IO | MMC/SD/SDIO 时钟 | AB38 |
| MMC1_CMD | IO | MMC/SD/SDIO 命令 | AB36 |
| MMC1_SDCD ⁽¹⁾ | I | SD 卡检测 | AR38 |
| MMC1_SDWP | I | SD 写保护 | AN37 |
| MMC1_DAT0 | IO | MMC/SD/SDIO 数据 | AA33 |
| MMC1_DAT1 | IO | MMC/SD/SDIO 数据 | AB34 |
| MMC1_DAT2 | IO | MMC/SD/SDIO 数据 | AA32 |
| MMC1_DAT3 | IO | MMC/SD/SDIO 数据 | AC38 |

(1) 为了从 MMC1 接口进行 ROM 引导以正常工作, 应使用一个电阻器从外部将 MMC1_SDCD 引脚拉至低电平, 以指示存在 SD 卡/存储器器件。

(2) 为了让 MMC1_CLK 信号正常工作, 出于重定时目的, CTRLMMR_PADCONFIG64 寄存器的 RXACTIVE 位应设置为 0x1。

5.3.28 OSPI

5.3.28.1 MCU 域

表 5-108. MCU_OSPI0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------------------|----------|-------------------------|------------|
| MCU_OSPI0_CLK | O | OSPI 时钟 | E32 |
| MCU_OSPI0_DQS | I | OSPI 数据选通 (DQS) 或环回时钟输入 | C34 |
| MCU_OSPI0_ECC_FAIL | I | OSPI ECC 状态 | C32、F31 |
| MCU_OSPI0_LBCLKO | IO | OSPI 环回时钟输出 | D32 |
| MCU_OSPI0_CSn0 | O | OSPI 片选 0 (低电平有效) | A32 |
| MCU_OSPI0_CSn1 | O | OSPI 片选 1 (低电平有效) | A33 |
| MCU_OSPI0_CSn2 | O | OSPI 片选 2 (低电平有效) | B34、C31 |
| MCU_OSPI0_CSn3 | O | OSPI 片选 3 (低电平有效) | C32、F31 |
| MCU_OSPI0_D0 | IO | OSPI 数据 0 | B33 |
| MCU_OSPI0_D1 | IO | OSPI 数据 1 | B32 |
| MCU_OSPI0_D2 | IO | OSPI 数据 2 | C33 |
| MCU_OSPI0_D3 | IO | OSPI 数据 3 | C35 |
| MCU_OSPI0_D4 | IO | OSPI 数据 4 | D33 |
| MCU_OSPI0_D5 | IO | OSPI 数据 5 | D34 |
| MCU_OSPI0_D6 | IO | OSPI 数据 6 | E34 |
| MCU_OSPI0_D7 | IO | OSPI 数据 7 | E33 |
| MCU_OSPI0_RESET_OUT0 | O | OSPI 复位 | B34、C31 |
| MCU_OSPI0_RESET_OUT1 | O | OSPI 复位 | C32、G33 |

表 5-109. MCU_OSPI1 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|------------------|----------|-------------------------|------------|
| MCU_OSPI1_CLK | O | OSPI 时钟 | F32 |
| MCU_OSPI1_DQS | I | OSPI 数据选通 (DQS) 或环回时钟输入 | F31 |
| MCU_OSPI1_LBCLKO | IO | OSPI 环回时钟输出 | C31 |
| MCU_OSPI1_CSn0 | O | OSPI 片选 0 (低电平有效) | G32 |
| MCU_OSPI1_CSn1 | O | OSPI 片选 1 (低电平有效) | G33 |
| MCU_OSPI1_D0 | IO | OSPI 数据 0 | E35 |
| MCU_OSPI1_D1 | IO | OSPI 数据 1 | D31 |
| MCU_OSPI1_D2 | IO | OSPI 数据 2 | G31 |
| MCU_OSPI1_D3 | IO | OSPI 数据 3 | F33 |

5.3.29 Hyperbus

5.3.29.1 MCU 域

表 5-110. MCU_HYPERBUS0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------------------|----------|------------------------|------------|
| MCU_HYPERBUS0_CK | O | Hyperbus 差分时钟 (正) | E32 |
| MCU_HYPERBUS0_CKn | O | Hyperbus 差分时钟 (负) | D32 |
| MCU_HYPERBUS0_INTn | I | Hyperbus 中断 (低电平有效) | C32、F31 |
| MCU_HYPERBUS0_RESETn | O | Hyperbus 复位 (低电平有效) 输出 | A33 |

表 5-110. MCU_HYPERBUS0 信号说明 (续)

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|------------------------|----------|---|-------------|
| MCU_HYPERBUS0_RESETO_n | I | Hyperbus 存储器中的 Hyperbus 复位状态指示器 (低电平有效) | B34、C31 |
| MCU_HYPERBUS0_RWDS | IO | Hyperbus 读写数据选通 | C34 |
| MCU_HYPERBUS0_WP_n | O | Hyperbus 写保护 (未使用) | B34、C32、G33 |
| MCU_HYPERBUS0_CS_n0 | O | Hyperbus 片选 0 | A32 |
| MCU_HYPERBUS0_CS_n1 | O | Hyperbus 片选 1 | B34、G33 |
| MCU_HYPERBUS0_DQ0 | IO | Hyperbus 数据 0 | B33 |
| MCU_HYPERBUS0_DQ1 | IO | Hyperbus 数据 1 | B32 |
| MCU_HYPERBUS0_DQ2 | IO | Hyperbus 数据 2 | C33 |
| MCU_HYPERBUS0_DQ3 | IO | Hyperbus 数据 3 | C35 |
| MCU_HYPERBUS0_DQ4 | IO | Hyperbus 数据 4 | D33 |
| MCU_HYPERBUS0_DQ5 | IO | Hyperbus 数据 5 | D34 |
| MCU_HYPERBUS0_DQ6 | IO | Hyperbus 数据 6 | E34 |
| MCU_HYPERBUS0_DQ7 | IO | Hyperbus 数据 7 | E33 |

5.3.30 仿真和调试

5.3.30.1 MAIN 域

表 5-111. JTAG 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|---------------|------------|
| EMU0 | IO | 仿真控制 0 | F35 |
| EMU1 | IO | 仿真控制 1 | H34 |
| TCK | I | JTAG 测试时钟输入 | G35 |
| TDI | I | JTAG 测试数据输入 | AL37 |
| TDO | OZ | JTAG 测试数据输出 | AL35 |
| TMS | I | JTAG 测试模式选择输入 | AL36 |
| TRST_n | I | JTAG 复位 | G37 |

表 5-112. 布线信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|------------|----------|---------|------------|
| TRC_CLK | O | 跟踪时钟 | AG36、AJ32 |
| TRC_CTL | O | 跟踪控制 | AJ33、AJ37 |
| TRC_DATA0 | O | 跟踪数据 0 | AF33、AJ34 |
| TRC_DATA1 | O | 跟踪数据 1 | AD36、AH33 |
| TRC_DATA2 | O | 跟踪数据 2 | AG33、AK37 |
| TRC_DATA3 | O | 跟踪数据 3 | AC33、AK36 |
| TRC_DATA4 | O | 跟踪数据 4 | AD37 |
| TRC_DATA5 | O | 跟踪数据 5 | AH38 |
| TRC_DATA6 | O | 跟踪数据 6 | AC37 |
| TRC_DATA7 | O | 跟踪数据 7 | AJ38 |
| TRC_DATA8 | O | 跟踪数据 8 | AC32 |
| TRC_DATA9 | O | 跟踪数据 9 | AE37 |
| TRC_DATA10 | O | 跟踪数据 10 | AK33 |
| TRC_DATA11 | O | 跟踪数据 11 | AF38 |

表 5-112. 布线信号说明 (续)

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|------------|----------|---------|------------|
| TRC_DATA12 | O | 跟踪数据 12 | AG37 |
| TRC_DATA13 | O | 跟踪数据 13 | AE36 |
| TRC_DATA14 | O | 跟踪数据 14 | AF37 |
| TRC_DATA15 | O | 跟踪数据 15 | AC36 |
| TRC_DATA16 | O | 跟踪数据 16 | AE38 |
| TRC_DATA17 | O | 跟踪数据 17 | AH37 |
| TRC_DATA18 | O | 跟踪数据 18 | AK34 |
| TRC_DATA19 | O | 跟踪数据 19 | AG38 |
| TRC_DATA20 | O | 跟踪数据 20 | AF36 |
| TRC_DATA21 | O | 跟踪数据 21 | AG34 |
| TRC_DATA22 | O | 跟踪数据 22 | AJ35 |
| TRC_DATA23 | O | 跟踪数据 23 | AH34 |
| TRC_DATA24 | O | 跟踪数据 24 | AE33 |
| TRC_DATA25 | O | 跟踪数据 25 | AL32 |

5.3.31 系统和其他

5.3.31.1 启动模式配置

表 5-113. Sysboot 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------------|----------|--------------|------------|
| BOOTMODE00 | I | 引导模式引脚 0 | B33 |
| BOOTMODE01 | I | 引导模式引脚 1 | B32 |
| BOOTMODE02 | I | 引导模式引脚 2 | D33 |
| BOOTMODE03 | I | 引导模式引脚 3 | D34 |
| BOOTMODE04 | I | 引导模式引脚 4 | M37 |
| BOOTMODE05 | I | 引导模式引脚 5 | M36 |
| BOOTMODE06 | I | 引导模式引脚 6 | N34 |
| BOOTMODE07 | I | 引导模式引脚 7 | M34 |
| MCU_BOOTMODE00 | I | MCU 引导模式引脚 0 | G38 |
| MCU_BOOTMODE01 | I | MCU 引导模式引脚 1 | H36 |
| MCU_BOOTMODE02 | I | MCU 引导模式引脚 2 | J38 |
| MCU_BOOTMODE03 | I | MCU 引导模式引脚 3 | H38 |
| MCU_BOOTMODE04 | I | MCU 引导模式引脚 4 | J34 |
| MCU_BOOTMODE05 | I | MCU 引导模式引脚 5 | J35 |
| MCU_BOOTMODE06 | I | MCU 引导模式引脚 6 | H37 |
| MCU_BOOTMODE07 | I | MCU 引导模式引脚 7 | K37 |
| MCU_BOOTMODE08 | I | MCU 引导模式引脚 8 | J37 |
| MCU_BOOTMODE09 | I | MCU 引导模式引脚 9 | K38 |

5.3.31.2 时钟

表 5-114. Clock0 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|---------------|----------|----------------------|------------|
| WKUP_LF_CLKIN | I | 低频 (32.768KHz) 振荡器输入 | M34 |

表 5-114. Clock0 信号说明 (续)

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|--------------|----------|---------|------------|
| WKUP_OSC0_XI | I | 高频振荡器输入 | T38 |
| WKUP_OSC0_XO | O | 高频振荡器输出 | U37 |

表 5-115. Clock1 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|---------|------------|
| OSC1_XI | I | 高频振荡器输入 | P38 |
| OSC1_XO | O | 高频振荡器输出 | N37 |

5.3.31.3 系统

表 5-116. MCU 系统信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-------------------|----------|---------------------------------|------------|
| MCU_CLKOUT0 | OZ | 以太网 PHY 的基准时钟输出 (50MHz 或 25MHz) | M38 |
| MCU_EXT_REFCLK0 | I | 外部系统时钟输入 | L33、M33 |
| MCU_OBSCLK0 | O | 观察时钟输出, 仅用于测试和调试目的 | H34、M38 |
| MCU_PORz | I | MCU 域冷复位 | K32 |
| MCU_RESETSTATz | O | MCU 域热复位状态输出 | F36 |
| MCU_RESETz | I | MCU 域热复位 | G36 |
| MCU_SAFETY_ERRORn | IO | MCU 域 ESM 的错误信号输出 | N36 |
| MCU_SYSCLKOUT0 | O | MCU 域系统时钟输出, 仅用于测试和调试目的 | L33 |

表 5-117. 系统信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-------------------|----------|--|------------|
| AUDIO_EXT_REFCLK0 | IO | 路由到 ATL 或 McASP 的外部时钟, 作为可选输入时钟源之一或作为 ATL 或 McASP 的输出时钟 | AJ34 |
| AUDIO_EXT_REFCLK1 | IO | 路由到 ATL 或 McASP 的外部时钟, 作为可选输入时钟源之一或作为 ATL 或 McASP 的输出时钟 | AH37 |
| EXTINTn | I | 外部中断 | AN35 |
| EXT_REFCLK1 | I | Main 域的外部时钟输入, 路由到计时器时钟多路复用器, 作为计时器/WDT 模块的可选输入时钟源之一, 或作为 MAIN_PLL2 (PER1 PLL) 的基准时钟 | AJ32 |
| GPMC0_FCLK_MUX | O | 通过多路复用器逻辑选择的 GPMC 功能时钟输出 | AF36 |
| OBSCLK0 | O | 观察时钟输出, 仅用于测试和调试目的 | AN37 |
| OBSCLK1 | O | 观察时钟输出, 仅用于测试和调试目的 | AG37 |
| PMIC_POWER_EN1 | O | MAIN 域电源的电源使能输出 | L38 |
| PMIC_WAKE0 | O | PMIC 唤醒 (低电平有效) | AJ34 |
| PMIC_WAKE1 | O | PMIC 唤醒 (低电平有效) | M33 |
| PORz | I | SoC PORz 复位信号 | P33 |
| RESETSTATz | O | Main 域热复位状态输出 | AL38 |
| RESET_REQz | I | Main 域外部热复位请求输入 | F34 |
| SOC_SAFETY_ERRORn | IO | Main 域 ESM 的错误信号输出 | AM34 |
| SYNC0_OUT | O | CPTS 时间戳发生器位 0 | AD36 |
| SYNC1_OUT | O | CPTS 时间戳发生器位 1 | AJ32 |
| SYNC2_OUT | O | CPTS 时间戳发生器位 2 | AD38 |
| SYNC3_OUT | O | CPTS 时间戳发生器位 3 | AD37 |

表 5-117. 系统信号说明 (续)

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-------------|----------|---|------------|
| SYSCCLKOUT0 | O | 主 PLL 控制器的 SYSCCLK0 输出 (6 分频), 仅用于测试和调试用途 | AR38 |

5.3.31.4 EFUSE

表 5-118. EFUSE 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|------------------|------------|
| VPP_CORE | PWR | MAIN 域电子保险丝的编程电压 | AA31 |
| VPP_MCU | PWR | MCU 域电子保险丝的编程电压 | L29 |

5.3.31.5 VMON

表 5-119. VMON 信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|------------------|----------|--|------------|
| VMON1_ER_VSYS | A | 电压监控器, 0.45V (+/-3%) 固定阈值。与外部精密分压器配合使用, 以监控更高的电压轨, 例如 PMIC 输入电源。 | K28 |
| VMON2_IR_VCPU | A | 建议在外部直接连接至 VDD_CPU | N27 |
| VMON3_IR_VEXT1P8 | A | 用外部电源的通用电压监控器, 1.8V 阈值。采用内部电阻分压器。 | J30 |
| VMON4_IR_VEXT1P8 | A | 用外部电源的通用电压监控器, 1.8V 阈值。采用内部电阻分压器。 | P28 |
| VMON5_IR_VEXT3P3 | A | 用外部电源的通用电压监控器, 3.3V 阈值。采用内部电阻分压器。 | R29 |

5.3.32 电源

表 5-120. 电源信号说明

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-------------------------------|----------|----------------|--|
| CAP_VDDSD0 ⁽¹⁾ | CAP | 外部电容器连接 | V29 |
| CAP_VDDSD0_MCU ⁽¹⁾ | CAP | 外部电容器连接 | L27 |
| CAP_VDDSD1_MCU ⁽¹⁾ | CAP | 外部电容器连接 | L25 |
| CAP_VDDSD2 ⁽¹⁾ | CAP | 外部电容器连接 | T29 |
| CAP_VDDSD2_MCU ⁽¹⁾ | CAP | 外部电容器连接 | L26 |
| CAP_VDDSD5 ⁽¹⁾ | CAP | 外部电容器连接 | P29 |
| VDDAR_CORE | PWR | 内核 RAM 电源 | AB27、AC24、AF15、 AF18、AF21、AG11、 AG28、T25 |
| VDDAR_CPU | PWR | CPU RAM 电源 | AB13、AC16、AC18、 AC20、AE12、M21、 N23、T15、U20、W14、 W21、Y11、Y19 |
| VDDAR_MCU | PWR | MCU RAM 电源 | M27、N24 |
| VDDA_0P8_DSITX | PWR | 用于 DSITX 的模拟电源 | AJ24 |
| VDDA_0P8_DSITX_C | PWR | DSITX 时钟电源 | AJ25 |
| VDDA_0P8_UFS | PWR | UFS 0.8V 电源 | AH11 |
| VDDA_0P8_USB | PWR | USB 0.8V 电源 | AK20 |
| VDDA_0P8_CSIRX2 | PWR | 用于 CSIRX 的模拟电源 | AJ28 |
| VDDA_0P8_CSIRX0_1 | PWR | 用于 CSIRX 的模拟电源 | AJ26、AK26 |

表 5-120. 电源信号说明 (续)

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|
| VDDA_0P8_DLL_MMC0 | PWR | MMC DLL 模拟电源 | AE9 |
| VDDA_0P8_PLL_DDR0 | PWR | DDR 去偏移 PLL 模拟电源 | U11 |
| VDDA_0P8_PLL_DDR1 | PWR | DDR 去偏移 PLL 模拟电源 | M14 |
| VDDA_0P8_PLL_DDR2 | PWR | DDR 去偏移 PLL 模拟电源 | N11 |
| VDDA_0P8_PLL_DDR3 | PWR | DDR 去偏移 PLL 模拟电源 | M18 |
| VDDA_0P8_SERDES2 | PWR | 串行器/解串器 0.8V 电源 | AJ20、AJ21 |
| VDDA_0P8_SERDES4 | PWR | 串行器/解串器 0.8V 电源 | AJ17、AJ18 |
| VDDA_0P8_SERDES0_1 | PWR | 串行器/解串器 0.8V 电源 | AJ12、AJ15、AK13、AK14 |
| VDDA_0P8_SERDES_C2 | PWR | 串行器/解串器 0.8V 时钟电源 | AG21、AH20 |
| VDDA_0P8_SERDES_C4 | PWR | 串行器/解串器 0.8V 时钟电源 | AG17、AH18 |
| VDDA_0P8_SERDES_C0_1 | PWR | 串行器/解串器 0.8V 时钟电源 | AH12、AH13、AH15、AH16 |
| VDDA_1P8_DSITX | PWR | 用于 DSITX 的模拟电源 | AH24、AH25 |
| VDDA_1P8_UFS | PWR | UFS 1.8V 电源 | AJ10 |
| VDDA_1P8_USB | PWR | USB 1.8V 电源 | AK21 |
| VDDA_1P8_CSIRX2 | PWR | 用于 CSIRX 的模拟电源 | AH29、AJ29 |
| VDDA_1P8_CSIRX0_1 | PWR | 用于 CSIRX 的模拟电源 | AH27、AH28 |
| VDDA_1P8_SERDES2 | PWR | 串行器/解串器 1.8V 电源 | AH21 |
| VDDA_1P8_SERDES4 | PWR | 串行器/解串器 1.8V 电源 | AH17 |
| VDDA_1P8_SERDES0_1 | PWR | 串行器/解串器 1.8V 电源 | AJ13、AJ14 |
| VDDA_1P8_SERDES2_4 | PWR | 串行器/解串器 1.8V 电源 | AJ23 |
| VDDA_3P3_USB | PWR | USB 3.3V 电源 | AJ19 |
| VDDA_ADC0 | PWR | ADC0 模拟电源 | M31 |
| VDDA_ADC1 | PWR | ADC1 模拟电源 | N30 |
| VDDA_MCU_PLLGRP0 | PWR | MCU PLL 组 0 的模拟电源 | M28 |
| VDDA_MCU_TEMP | PWR | MCU 温度传感器的模拟电源 | M26 |
| VDDA_OSC1 | PWR | HFOSC1 电源 | N29 |
| VDDA_PLLGRP0 | PWR | MAIN PLL 组 0 的模拟电源 | AA27 |
| VDDA_PLLGRP1 | PWR | MAIN PLL 组 1 的模拟电源 | Y28 |
| VDDA_PLLGRP2 | PWR | MAIN PLL 组 2 的模拟电源 | AG13 |
| VDDA_PLLGRP5 | PWR | MAIN PLL 组 5 的模拟电源 | V14 |
| VDDA_PLLGRP6 | PWR | MAIN PLL 组 6 的模拟电源 | R21 |
| VDDA_PLLGRP7 | PWR | MAIN PLL 组 7 的模拟电源 | P12 |
| VDDA_PLLGRP8 | PWR | MAIN PLL 组 8 的模拟电源 | P15 |
| VDDA_PLLGRP9 | PWR | MAIN PLL 组 9 的模拟电源 | Y26 |
| VDDA_PLLGRP10 | PWR | MAIN PLL 组 10 的模拟电源 | AG23 |
| VDDA_PLLGRP12 | PWR | MAIN PLL 组 12 的模拟电源 | AA23 |
| VDDA_PLLGRP13 | PWR | MAIN PLL 组 13 的模拟电源 | AB26 |
| VDDA_POR_WKUP | PWR | WKUP 域模拟电源 | N28 |
| VDDA_TEMP0 | PWR | 温度传感器 0 的模拟电源 | Y27 |
| VDDA_TEMP1 | PWR | 温度传感器 1 的模拟电源 | M12 |
| VDDA_TEMP2 | PWR | 温度传感器 2 的模拟电源 | W23 |

表 5-120. 电源信号说明 (续)

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|-------------|----------|----------------|--|
| VDDA_TEMP3 | PWR | 温度传感器 3 的模拟电源 | AE13 |
| VDDA_TEMP4 | PWR | 温度传感器 4 的模拟电源 | AD18 |
| VDDA_WKUP | PWR | WKUP 域的振荡器电源 | K31、L32 |
| VDDSHV0 | PWR | IO 电源 | V30、V32、W31 |
| VDDSHV0_MCU | PWR | IO 电源 | H29、J28、K29 |
| VDDSHV1_MCU | PWR | IO 电源 | H25、J24、K25 |
| VDDSHV2 | PWR | IO 电源 | T30、T32、U31 |
| VDDSHV2_MCU | PWR | IO 电源 | H27、J26、K27 |
| VDDSHV5 | PWR | IO 电源 | P31、R30、R31 |
| VDDS_DDR | PWR | DDR PHY IO 电源 | A31、AK1、B1、H11、H13、H15、H17、H19、H9、J10、J12、J14、J16、J18、J8、K11、K13、K15、K17、K19、K9、L10、L12、L14、L16、L18、M9、N10、N8、P9、R10、R8、T9、U10、U8 |
| VDDS_DDR_C0 | PWR | DDR 时钟的 IO 电源 | T10 |
| VDDS_DDR_C1 | PWR | DDR 时钟的 IO 电源 | L15 |
| VDDS_DDR_C2 | PWR | DDR 时钟的 IO 电源 | M10 |
| VDDS_DDR_C3 | PWR | DDR 时钟的 IO 电源 | L17 |
| VDDS_MMC0 | PWR | MMC0 PHY IO 电源 | AF9、AG10、AG8、AH9 |
| VDD_CORE | PWR | MAIN 域内核电源 | AA24、AA26、AA28、AA30、AB25、AB29、AB31、AC26、AC28、AC30、AD25、AD27、AD29、AD31、AE24、AE26、AE28、AE30、AE32、AF13、AF17、AF19、AF23、AF25、AF27、AF29、AF31、AG12、AG14、AG16、AG18、AG20、AG22、AG24、AG26、AG30、AG32、AH31、AJ30、M11、M13、M15、M17、M19、N12、N16、N18、P11、P17、P19、R12、R14、R16、R18、R24、R26、R28、T11、T13、T27、U12、U24、U26、U28、V25、V27、W24、W26、W28、W30、W32、Y25、Y29、Y31 |

表 5-120. 电源信号说明 (续)

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|---------------|----------|----------------|---|
| VDD_CPU | PWR | CPU 内核电源 | AA10、AA12、AA14、AA20、AA22、AA8、AB11、AB19、AB21、AB23、AB9、AC10、AC12、AC14、AC22、AD11、AD13、AD15、AD17、AD19、AD21、AD23、AD9、AE10、AE14、AE16、AE18、AE20、AE22、AF11、H21、H23、J20、J22、K21、K23、L20、L22、N20、N22、P21、R20、R22、T17、T19、T21、T23、U14、U22、V11、V13、V19、V21、V23、V9、W10、W12、W20、W22、W8、Y13、Y21、Y23、Y9 |
| VDD_MCU | PWR | MCU 内核电源 | L24、M23、M25、N26、P23、P25、P27 |
| VDD_MCU_WAKE1 | PWR | MCU 菊花链的内核电源 | L28 |
| VDD_WAKE0 | PWR | MAIN 域菊花链的内核电源 | U29 |

表 5-120. 电源信号说明 (续)

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|--------|--|
| VSS | GND | 接地 | A1、A10、A12、A15、 A2、A20、A23、A25、 A28、A34、A37、A5、 A7、AA11、AA13、 AA19、AA2、AA21、 AA25、AA29、AA34、 AA36、AA38、AA5、 AA9、AB1、AB10、 AB12、AB14、AB20、 AB22、AB24、AB28、 AB30、AB32、AB33、 AB35、AB37、AB5、 AB8、AC11、AC13、 AC15、AC17、AC19、 AC2、AC21、AC23、 AC25、AC27、AC29、 AC31、AC6、AC9、 AD1、AD10、AD12、 AD14、AD16、AD20、 AD22、AD24、AD26、 AD28、AD30、AD32、 AD35、AD4、AD8、 AE11、AE15、AE17、 AE19、AE2、AE21、 AE23、AE25、AE27、 AE29、AE31、AE5、 AF10、AF12、AF14、 AF16、AF20、AF22、 AF24、AF26、AF28、 AF3、AF30、AF32、 AF6、AF8、AG1、 AG15、AG19、AG25、 AG27、AG29、AG31、 AG4、AG7、AG9、 AH10、AH14、AH19、 AH2、AH22、AH23、 AH26、AH30、AH32、 AH35、AH5、AH8、 AJ11、AJ16、AJ22、 AJ27、AJ3、AJ31、 AJ6、AJ8、AJ9、AK10、 AK11、AK12、AK15、 AK16、AK17、AK18、 AK19、AK22、AK23、 AK24、AK25、AK27、 AK28、AK30、AK32、 AL1、AL10、AL12、 AL13、AL14、AL15、 AL16、AL17、AL18 |

表 5-120. 电源信号说明 (续)

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|--------|--|
| VSS (续) | GND | 接地 | AL19、AL21、AL26、AL29、AL31、AL4、AM11、AM13、AM15、AM18、AM20、AM23、AM25、AM27、AM3、AM30、AM32、AM38、AM6、AN1、AN10、AN12、AN14、AN16、AN19、AN22、AN25、AN28、AN31、AN34、AN4、AN7、AP12、AP15、AP18、AP21、AP24、AP27、AP3、AP30、AP33、AP36、AP6、AP9、AR1、AR10、AR13、AR16、AR19、AR22、AR25、AR28、AR31、AR34、AR37、AR4、AR7、AT12、AT15、AT18、AT21、AT24、AT27、AT3、AT30、AT33、AT36、AT6、AT9、AU1、AU10、AU13、AU16、AU19、AU22、AU25、AU28、AU31、AU34、AU37、AU38、AU4、AU7、AV1、AV11、AV14、AV17、AV2、AV20、AV23、AV26、AV29、AV32、AV35、AV5、AV8、B11、B13、B16、B19、B22、B24、B26、B29、B31、B38、B6、B9、C14、C17、C18、C2、C21、C27、C30、C4、C8、D10、D15、D20、D23、D28、D3、D35、D6、D7、E12、E13、E16、E19、E2、E22、E25、E26、E29、E31、E5、E9、F1、F11、F14、F17、F21、F24、F27、F30、F4、F7、F8、G15 |

表 5-120. 电源信号说明 (续)

| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|----------|----------|--------|---|
| VSS (续) | GND | 接地 | G18、G20、G28、G3、G6、H10、H16、H18、H2、H20、H22、H24、H26、H28、H30、H31、H5、H7、H8、J1、J11、J13、J15、J17、J19、J21、J23、J25、J27、J29、J32、J4、J9、K10、K12、K14、K16、K18、K2、K20、K22、K24、K26、K6、K8、L1、L11、L13、L19、L21、L23、L31、L5、L9、M16、M2、M20、M22、M24、M29、M30、M32、M5、M8、N15、N17、N19、N21、N25、N3、N31、N32、N38、N6、N9、P1、P10、P16、P18、P20、P22、P24、P26、P30、P32、P35、P37、P4、P7、P8、R11、R13、R15、R17、R19、R2、R23、R25、R27、R32、R34、R36、R38、R5、R9、T12、T14、T16、T18、T20、T22、T24、T26、T28、T3、T31、T33、T35、T37、T6、T8、U13、U19、U21、U23、U25、U27、U3、U30、U32、U34、U36、U38、U6、U9、V10、V12、V2、V20、V22、V24、V26、V28、V31、V33、V35、V37、V5、V8、W1 |
| VSS (续) | GND | 接地 | W11、W13、W19、W25、W27、W29、W34、W36、W38、W4、W7、W9、Y10、Y12、Y14、Y20、Y22、Y24、Y3、Y30、Y32、Y33、Y35、Y37、Y6、Y8 |

(1) 该引脚必须始终通过 $1\ \mu\text{F} \pm 10\%$ 电容器连接至 VSS。

5.4 引脚连接要求

本节介绍了具有特定连接要求的封装焊球和未使用封装焊球的连接要求。

备注

除非信号说明中另有说明，否则必须为所有电源焊球提供建议运行条件一节中指定的电压。

备注

需要补充说明的是，“保持未连接状态”或“无连接”(NC)表示这些器件焊球编号不能连接任何信号布线。

表 5-121 按焊球名称和焊球编号显示了特定信号的连接要求。

表 5-121. 连接要求

| 焊球编号 | 焊球名称 | 连接要求 |
|------|------------------|--|
| P38 | OSC1_XI | 这些焊球每一个均必须通过单独的外部拉电阻器连接到 VSS，以确保这些焊球会保持为有效的逻辑低电平（如果未使用）。 |
| T38 | WKUP_OSC0_XI | |
| G37 | TRSTN | |
| U1 | DDR0_DQS0P | |
| AA1 | DDR0_DQS1P | |
| AF1 | DDR0_DQS2P | |
| AJ1 | DDR0_DQS3P | |
| A16 | DDR1_DQS0P | |
| A13 | DDR1_DQS1P | |
| A8 | DDR1_DQS2P | |
| A3 | DDR1_DQS3P | |
| T1 | DDR2_DQS0P | |
| N1 | DDR2_DQS1P | |
| H1 | DDR2_DQS2P | |
| E1 | DDR2_DQS3P | |
| A18 | DDR3_DQS0P | |
| A21 | DDR3_DQS1P | |
| A26 | DDR3_DQS2P | |
| A29 | DDR3_DQS3P | |
| AC8 | DDR0_RET | |
| G8 | DDR1_RET | |
| L8 | DDR2_RET | |
| G27 | DDR3_RET | |
| K28 | VMON1_ER_VSYS | |
| N27 | VMON2_IR_VCPU | |
| J30 | VMON3_IR_VEXT1P8 | |
| P28 | VMON4_IR_VEXT1P8 | |
| R29 | VMON5_IR_VEXT3P3 | |

表 5-121. 连接要求 (续)

| 焊球编号 | 焊球名称 | 连接要求 |
|------|---------------|--|
| P36 | MCU_ADC0_AIN0 | 这些焊球每一个均可以通过单独的外部拉电阻器连接到 VSS，或者可以直接连接到 VSS，以确保这些焊球会保持为有效的逻辑低电平（如果未使用）。 |
| V36 | MCU_ADC0_AIN1 | |
| T34 | MCU_ADC0_AIN2 | |
| T36 | MCU_ADC0_AIN3 | |
| P34 | MCU_ADC0_AIN4 | |
| R37 | MCU_ADC0_AIN5 | |
| R33 | MCU_ADC0_AIN6 | |
| V38 | MCU_ADC0_AIN7 | |
| Y38 | MCU_ADC1_AIN0 | |
| Y34 | MCU_ADC1_AIN1 | |
| V34 | MCU_ADC1_AIN2 | |
| W37 | MCU_ADC1_AIN3 | |
| AA37 | MCU_ADC1_AIN4 | |
| W33 | MCU_ADC1_AIN5 | |
| U33 | MCU_ADC1_AIN6 | |
| Y36 | MCU_ADC1_AIN7 | |
| AN11 | SERDES0_REXT | |
| AL9 | SERDES1_REXT | |
| AL20 | SERDES2_REXT | |
| AM19 | SERDES4_REXT | |
| AM28 | CSI0_RXRCALIB | |
| AL28 | CSI1_RXRCALIB | |
| AM31 | CSI2_RXRCALIB | |
| AE8 | DDR0_CAL0 | |
| G14 | DDR1_CAL0 | |
| U7 | DDR2_CAL0 | |
| F18 | DDR3_CAL0 | |
| AM24 | DSI0_TXRCALIB | |
| AL22 | DSI1_TXRCALIB | |
| AN18 | USB0_RCALIB | |

表 5-121. 连接要求 (续)

| 焊球编号 | 焊球名称 | 连接要求 |
|------|---------------|---|
| G36 | MCU_RESETZ | 这些焊球每一个均必须通过单独的外部拉电阻器连接到相应的电源，以确保这些焊球保持为有效的逻辑高电平（如果未使用）。 |
| K32 | MCU_PORZ | |
| P33 | PORZ | |
| F34 | RESET_REQZ | |
| G35 | TCK | |
| AL36 | TMS | |
| G34 | MCU_I2C0_SDA | |
| M35 | MCU_I2C0_SCL | |
| N33 | WKUP_I2C0_SCL | |
| N35 | WKUP_I2C0_SDA | |
| AN36 | I2C0_SCL | |
| AP37 | I2C0_SDA | |
| AN35 | EXTINTN | |
| AL37 | TDI | |
| AL35 | TDO | |
| F35 | EMU0 | |
| H34 | EMU1 | |
| V1 | DDR0_DQS0N | |
| Y1 | DDR0_DQS1N | |
| AE1 | DDR0_DQS2N | |
| AH1 | DDR0_DQS3N | |
| A17 | DDR1_DQS0N | |
| A14 | DDR1_DQS1N | |
| A9 | DDR1_DQS2N | |
| A4 | DDR1_DQS3N | |
| R1 | DDR2_DQS0N | |
| M1 | DDR2_DQS1N | |
| G1 | DDR2_DQS2N | |
| D1 | DDR2_DQS3N | |
| A19 | DDR3_DQS0N | |
| A22 | DDR3_DQS1N | |
| A27 | DDR3_DQS2N | |
| A30 | DDR3_DQS3N | |
| R35 | MCU_ADC0_REFP | 如果未使用 MCU_ADCn 接口，则这些信号应连接到与 VDDA_ADCn 电源输入相同的电源。 |
| AA35 | MCU_ADC1_REFP | |
| U35 | MCU_ADC0_REFN | 如果未使用 MCU_ADCn 接口，则应将这些信号连接到 VSS。 |
| W35 | MCU_ADC1_REFN | |
| L29 | VPP_MCU | 如果未使用，这些焊球中的每一个都必须保持未连接状态。 |
| AA31 | VPP_CORE | |
| AJ7 | MMC0_CALPAD | |
| | DDR0_* | 必须始终按递增顺序使用 DDRSS0、DDRSS1、DDRSS2 和 DDRSS3。例如，使用单个 LPDDR 元件时，该元件必须连接到 DDR0_* 接口。当使用两个 LPDDR 元件时，它们必须连接到 DDR0_* 和 DDR1_* 接口，依此类推。 |
| | DDR1_* | |
| | DDR2_* | |
| | DDR3_* | |

表 5-122 显示了针对器件上的保留焊球编号的特定连接要求。

备注

需要补充说明的是，“保持未连接状态”或“无连接”(NC)表示这些器件焊球编号不能连接任何信号布线。

表 5-122. 保留焊球的特定连接要求 (AHP)

| 焊球编号 | 连接要求 |
|---|-----------------------|
| AF7/AK2/AK29/AK31/AL11/AL23/AL24/AL25/AL27/AL30/AM10/AM12/AM14/AM16/AM17/AM21/AM22/AM26/AM29/AM33/AM9/AN13/AN20/AN21/G17/G22/G30/H12/H14/H32/H33/J31/J33/K30/L30/N7/T7/Y7 | 保留。 这些焊球必须保持未连接状态。 |

6 规格

6.1 绝对最大额定值

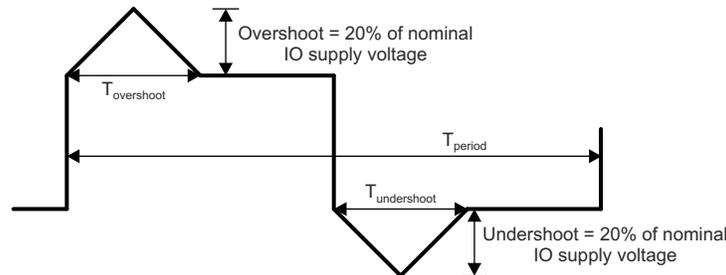
在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明) (1) (2)

| 参数 | | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|-----------------------|---|------|------------------------|-----|---|
| VDD_*(3) | 内核电源 | -0.3 | 1.05 | V | |
| VDDAR_*(3) | RAM 电源 | -0.3 | 1.05 | V | |
| VDDA_0P8_*(3) | 用于 0.8V 域的模拟电源 | -0.3 | 1.05 | V | |
| VDDA_1P8_*(3) | 用于 1.8V PHY 域的模拟电源 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA_3P3_USB | 用于 3.3V USB 域的模拟电源 | -0.3 | 3.8 | V | |
| VDDA_*(3) | 用于 1.8V PLL 和其他域的模拟电源 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDS_DDR_*(3) | DDR 接口电源 | -0.3 | 1.2 | V | |
| VDDS_MMC0 | MMC0 IO 电源 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDSHV*(3) | 双路电压 LVCMOS IO 电源 | 1.8V | -0.3 | 2.2 | V |
| | | 3.3V | -0.3 | 3.8 | V |
| VPP_CORE VPP MCU | 电子保险丝域电源电压范围 | -0.3 | 1.89 | V | |
| USB0_VBUS(9) | USB VBUS 比较器输入的电压范围 | -0.3 | 3.6 | V | |
| 所有失效防护 IO 引脚的稳态最大电压 | I2C0_SCL、 I2C0_SDA、 WKUP_I2C0_SCL、 WKUP_I2C0_SDA、 MCU_I2C0_SCL、 MCU_I2C0_SDA、 EXTINTn | -0.3 | 3.8 | V | |
| | MCU_PORz、 PORz | -0.3 | 3.8 | V | |
| 所有其他 IO 引脚的稳态最大电压(4) | VMON1_ER_VSYS(8)、 VMON3_IR_VEXT1P8、 VMON4_IR_VEXT1P8 | -0.3 | 2.2 | V | |
| | VMON2_IR_VCPU | -0.3 | 1.05 | V | |
| | VMON5_IR_VEXT3P3 | -0.3 | 3.8 | V | |
| | 所有其他 IO 引脚 | -0.3 | IO 电源电压 + 0.3 | V | |
| IO 引脚的瞬态过冲和下冲规格 | 20% 的 IO 电源电压在信号周期的 20% 以内 图 6-1 (请参阅 IO 瞬态电压范围) | | $0.2 \times VDD^{(7)}$ | V | |
| 闩锁性能, II 级 (125°C)(5) | 电流测试 | -100 | 100 | mA | |
| | 过压 (OV) 测试 | 不适用 | $1.5 \times VDD^{(7)}$ | V | |
| T _{STG} (6) | 贮存温度 | -55 | +150 | °C | |

- (1) 超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
- (2) 除非另有说明,否则所有电压值均以其关联的 VSS 或 VSSA_x 为基准。

- (3) **VDD_* 包括** : VDD_CORE、VDD_CPU、VDD_MCU、VDD_MCU_WAKE1、VDD_WAKE0
VDDAR_* 包括 : VDDAR_CORE、VDDAR_CPU、VDDAR_MCU
VDDA_0P8_* 包括 : VDDA_0P8_CSIRX0_1、VDDA_0P8_CSIRX2、VDDA_0P8_DLL_MMC0、VDDA_0P8_DSITX、VDDA_0P8_DSITX_C、VDDA_0P8_PLL_DDR0、VDDA_0P8_PLL_DDR1、VDDA_0P8_PLL_DDR2、VDDA_0P8_PLL_DDR3、VDDA_0P8_SERDES_C0_1、VDDA_0P8_SERDES_C2、VDDA_0P8_SERDES_C4、VDDA_0P8_SERDES0_1、VDDA_0P8_SERDES2、VDDA_0P8_SERDES4、VDDA_0P8_UFS、VDDA_0P8_USB
VDDA_1P8_* 包括 : VDDA_1P8_CSIRX0_1、VDDA_1P8_CSIRX2、VDDA_1P8_DSITX、VDDA_1P8_SERDES0_1、VDDA_1P8_SERDES2、VDDA_1P8_SERDES2_4、VDDA_1P8_SERDES4、VDDA_1P8_UFS、VDDA_1P8_USB
VDDA_* 包括 : VDDA_ADC0、VDDA_ADC1、VDDA_MCU_PLLGRP0、VDDA_MCU_TEMP、VDDA_OSC1、VDDA_PLLGRP0、VDDA_PLLGRP1、VDDA_PLLGRP10、VDDA_PLLGRP12、VDDA_PLLGRP13、VDDA_PLLGRP2、VDDA_PLLGRP5、VDDA_PLLGRP6、VDDA_PLLGRP7、VDDA_PLLGRP8、VDDA_PLLGRP9、VDDA_POR_WKUP、VDDA_TEMP0、VDDA_TEMP1、VDDA_TEMP2、VDDA_TEMP3、VDDA_TEMP4、VDDA_WKUP
VDDS_DDR_* 包括 : VDDS_DDR、VDDS_DDR_C0、VDDS_DDR_C1、VDDS_DDR_C2、VDDS_DDR_C3
VDDSHV* 包括 : VDDSHV0、VDDSHV0_MCU、VDDSHV1_MCU、VDDSHV2、VDDSHV2_MCU、VDDSHV5
- (4) 此参数适用于所有不具有失效防护功能的 IO 引脚，该要求适用于所有 IO 电源电压值。例如，如果施加到特定 IO 电源的电压为 0V，则由该电源供电的任何 IO 的有效输入电压范围将为 -0.3V 至 +0.3V。每当外设不是由用于为相应 IO 电源供电的相同电源供电时，都应特别注意。所连接的外设绝不能提供超出有效输入电压范围的电压（包括电源斜升和斜降序列），这一点很重要。
- (5) 对于电流脉冲注入：
 引脚应力符合 JEDEC JESD78E（II 级），并施加额定 I/O 引脚注入电流和钳位电压（最大推荐 I/O 电压的 1.5 倍和最大推荐 I/O 电压的负 0.5 倍）。
 对于过压性能：
 电源应力符合 JEDEC JESD78E（II 级）并施加额定电压注入。
- (6) 对于卷带包装，贮存温度范围为 [-10°C；+50°C]，最大相对湿度为 70%。TI 建议在使用前恢复到环境温度。
- (7) VDD 是 IO 相应电源引脚上的电压。
- (8) VMON_ER_VSYS 引脚提供了一种监测系统电源的方法。如需更多信息，请参阅[使用 VMON/POK 的系统电源监测设计指南](#)。
- (9) 需要使用外部电阻分压器来限制施加到该器件引脚的电压。如需更多信息，请参阅[USB VBUS 设计指南](#)。

失效防护 IO 终端的设计使其不依赖于相应的 IO 电源电压。这样便可在相应 IO 电源关闭时，将外部电压源连接到这些 IO 终端。I2C0_SCL、I2C0_SDA、I2C1_SCL、I2C1_SDA、DDR_FS_RESEn 和 NMI_n 是唯一的失效防护 IO 端子。所有其他 IO 终端都不具有失效防护功能，对其施加的电压应限制为绝对最大额定值中的“所有 IO 引脚的稳态最大电压”参数定义的值。



A. $T_{overshoot} + T_{undershoot} < T_{period}$ 的 20%

图 6-1. IO 瞬态电压范围

6.2 ESD 等级

| | | 值 | 单位 | |
|--------------------|------|---|----------------|------|
| V _(ESD) | 静电放电 | 人体放电模型 (HBM), 符合 AEC Q100-002 标准 ⁽¹⁾ | ±1000 | |
| | | 充电器件模型 (CDM), 符合 AEC Q100-011 标准 | 所有引脚 | ±250 |
| | | | 转角引脚 (A1、AJ29) | ±750 |

(1) AEC Q100-002 指示应当按照 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 规范执行 HBM 应力测试。

6.3 通电时间 (POH) 限制

| IP ⁽¹⁾ (2) (3) | 电压域 | 电压 (V) (最大值) | 频率 (MHz) (最大值) | T _j (°C) | POH |
|---------------------------|------|--------------|----------------|----------------------------------|--------|
| 全部 | 100% | 全部 | 所有支持的 OPP | 汽车: -40°C 至 125°C ⁽⁴⁾ | 20000 |
| 全部 | 100% | 全部 | 所有支持的 OPP | 扩展: -40°C 至 105°C | 100000 |
| 全部 | 100% | 全部 | 所有支持的 OPP | 商用: 0°C 至 90°C | 100000 |

- (1) 为方便起见, 下节中单独提供这些信息, 并且未扩展或修改适用于 TI 半导体产品的 TI 标准条款和条件下提供的保修范围。
- (2) 除非上表中另有说明, 否则器件在额定温度下支持所有电压域和工作条件
- (3) POH 是电压、温度和时间的函数。如果在较高电压和温度下使用, 实现相同可靠性的 POH 会减少。如要评估其他用例, 请联系您当地的 TI 代表。
- (4) 汽车曲线定义为 20000 小时通电时间, 此时结温如下所示: 5%@-40°C、65%@70°C、20%@110°C、10%@125°C。

6.4 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明)

| 电源名称 | 说明 | 最小值 ⁽¹⁾ | 标称值 | 最大值 ⁽¹⁾ | 单位 | |
|------------------------------|-------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|------|---|
| VDD_CORE | MAIN 域内核电源的启动/有效电压 | 0.76 ⁽¹⁾ | 0.8 | 0.84 ⁽¹⁾ | V | |
| VDD_MCU | MCUSS 内核电源的启动/有效电压 | 0.76 ⁽¹⁾ | 0.8 | 0.89 ⁽¹⁾ | V | |
| VDD_CPU | CPU 内核电源的启动电压, 在冷上电事件时施加 | 0.76 ⁽¹⁾ | 0.8 | 0.84 ⁽¹⁾ | V | |
| | CPU 内核电源的有效电压, 在软件中启用 AVS 模式后 | AVS ⁽³⁾ - 5% ⁽¹⁾ | AVS ⁽³⁾ | AVS ⁽³⁾ +5% ⁽¹⁾ | V | |
| VDD_CPU AVS 范围 | VDD_CPU 的 AVS 有效电压范围 | 0.6 | | 0.9 | V | |
| VDDAR_*(⁵) | RAM 电源 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | V | |
| VDDA_0P8_*(⁵) | 用于 0.8V 域的模拟电源 | 0.76 | 0.8 | 0.84 | V | |
| VDDA_1P8_*(⁵) | 用于 1.8V PHY 域的模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_3P3_USB(⁵) | 用于 3.3V USB 域的模拟电源 | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | |
| VDDA_*(⁵) | 用于 1.8V PLL 和其他域的模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_* | 所有 VDDA 输入的峰峰值噪声 | | | 25 | mV | |
| VDDS_DDR_*(⁵) | DDR 接口电源 | 1.06 | 1.1 | 1.15 | V | |
| VDDS_MMC0 | MMC0 IO 电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VPP_*(⁵) | 电子保险丝 ROM 编程电源 | 请参阅 (6) | 请参阅 (6) | 请参阅 (6) | V | |
| VDDSHV*(⁵) | 双路电压 LVCMOS IO 电源 | 1.8V 工作电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| | | 3.3V 工作电压 | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V |
| USB0_VBUS | USB VBUS 比较器输入的电压范围 | 0 | 请参阅 (4) | 3.46 | V | |
| USB0_ID | USB ID 输入的电压范围 | | 请参阅 (2) | | V | |
| VSS | 接地 | | 0 | | V | |
| T _j | 工作结温范围 | 汽车 | -40 | 125 | °C | |
| | | 扩展 | -40 | 105 | °C | |
| | | 商用级 | 0 | 90 | °C | |

- (1) 对于所有 VDD* 电源输入, 器件焊球上的电压在任何时间段绝不能低于最小值电压或高于最大值电压。该要求包括动态电压事件, 例如交流纹波、电压瞬变、电压骤降等。所有电源输入都需要满足该要求, 但应特别注意 VDD_CORE、VDD_MCU 和 VDD_CPU 域, 与其他电源轨相比, 这些域的瞬态电流需求更高。
- (2) 该端子连接到相应 USB PHY 中的模拟电路。相应电路在测量电压时提供已知电流, 以确定端子连接到 VSS 时相关电阻是否小于 10 Ω 或大于 100k Ω。对于 USB 主机操作, 该端子应接地, 对于 USB 外设操作, 则应保持开路, 并且始终不得连接至任何外部电压源。
- (3) AVS 电压取决于器件、电压域和 OPP。必须从 VTM_DEVINFO_VDn 读取它们。有关 VTM_DEVINFO_VDn 寄存器地址的信息, 请参阅器件 TRM 中的“电压和热管理器”部分。电源应在 VDD_CPU AVS 范围条目所示的范围内可调节。
- (4) 需要使用外部电阻分压器来限制施加到该器件引脚的电压。如需更多信息, 请参阅 [USB VBUS 设计指南](#)。
- (5) **VDD_* 包括:** VDD_CORE、VDD_CPU、VDD_MCU、VDD_MCU_WAKE1、VDD_WAKE0
VDDAR_* 包括: VDDAR_CORE、VDDAR_CPU、VDDAR_MCU

VDDA_0P8_* 包括 : VDDA_0P8_CSIRX0_1、VDDA_0P8_CSIRX2、VDDA_0P8_DLL_MMC0、VDDA_0P8_DSITX、VDDA_0P8_DSITX_C、VDDA_0P8_PLL_DDR0、VDDA_0P8_PLL_DDR1、VDDA_0P8_PLL_DDR2、VDDA_0P8_PLL_DDR3、VDDA_0P8_SERDES_C0_1、VDDA_0P8_SERDES_C2、VDDA_0P8_SERDES_C4、VDDA_0P8_SERDES0_1、VDDA_0P8_SERDES2、VDDA_0P8_SERDES4、VDDA_0P8_UFS、VDDA_0P8_USB

VDDA_1P8_* 包括 : VDDA_1P8_CSIRX0_1、VDDA_1P8_CSIRX2、VDDA_1P8_DSITX、VDDA_1P8_SERDES0_1、VDDA_1P8_SERDES2、VDDA_1P8_SERDES2_4、VDDA_1P8_SERDES4、VDDA_1P8_UFS、VDDA_1P8_USB

VDDA_* 包括 : VDDA_ADC0、VDDA_ADC1、VDDA_MCU_PLLGRP0、VDDA_MCU_TEMP、VDDA_OSC1、VDDA_PLLGRP0、VDDA_PLLGRP1、VDDA_PLLGRP10、VDDA_PLLGRP12、VDDA_PLLGRP13、VDDA_PLLGRP2、VDDA_PLLGRP5、VDDA_PLLGRP6、VDDA_PLLGRP7、VDDA_PLLGRP8、VDDA_PLLGRP9、VDDA_POR_WKUP、VDDA_TEMP0、VDDA_TEMP1、VDDA_TEMP2、VDDA_TEMP3、VDDA_TEMP4、VDDA_WKUP

VDDS_DDR_* 包括 : VDDS_DDR、VDDS_DDR_C0、VDDS_DDR_C1、VDDS_DDR_C2、VDDS_DDR_C3

VDDSHV* 包括 : VDDSHV0、VDDSHV0_MCU、VDDSHV1_MCU、VDDSHV2、VDDSHV2_MCU、VDDSHV5

VPP_* 包括 : VPP_CORE、VPP_MCU

- (6) 对于基于电子保险丝用法的 VPP 电源电压，请参阅 [OTP 电子保险丝编程的建议运行条件表](#)。

6.5 运行性能点

本节介绍了器件的运行条件。本节还包含处理器时钟和器件内核时钟的每个运行性能点 (OPP) 的说明。

表 6-1 描述了器件每个速度等级支持的最大频率。

表 6-1. 速度等级最大频率

| 器件 | 最大频率 (MHz) | | | | | | | | | |
|------------|------------|--------|----------|---------------|-----|--------|------|-------------------------------------|------|-------------------------|
| | A72SS0 | C71SS0 | R5FSS0/1 | MCU_ R5SS0 | GPU | CBASS0 | VPAC | VENCDEC | DMSC | LPDDR4 |
| AM69Ax...T | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 500 | 720 | 550 (960MP/s 或 480MP/s) (2) | 333 | 4266MT/s ⁽¹⁾ |

- (1) 最大 DDR 频率将根据系统中使用的特定存储器类型 (供应商) 以及根据 PCB 实现进行限制。TI 强烈建议所有设计的每个细节 (布线、间距、过孔/背钻、PCB 材料等) 都严格遵循 TI LPDDR4 EVM PCB 布局, 以便完全实现指定的时钟频率。有关详细信息, 请参阅 [Jacinto 7 LPDDR 电路板设计和布局布线指南](#)
- (2) 请参阅 [器件比较](#) 表以确定具体器件型号, 包括 1 个 VENCDEC 模块 (480MP/s) 或 2 个 VENCDEC 模块 (960MP/s)。

6.6 电气特性

备注

节 6.6.1 至节 6.6.8 中所述的接口或信号对应于多路复用模式 0 (主要功能) 中可用的接口或信号。

这些表中介绍的焊球上多路复用的所有接口或信号都具有相同的直流电气特性，除非多路复用涉及 PHY 和 GPIO 组合，在这种情况下，会为不同的复用模式 (功能) 指定不同的直流电气特性。

6.6.1 I2C 开漏失效防护 (I2C OD FS) 电气特性

在建议运行条件下测得 (除非另有说明)

| 参数 | | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|----|
| 1.8V 模式 | | | | | | |
| V _{IL} | 输入低电平阈值 | | | | 0.3 × VDDSHV ⁽¹⁾ | V |
| V _{ILSS} | 输入低电平阈值稳态 | | | | 0.3 × VDDSHV ⁽¹⁾ | V |
| V _{IH} | 输入高电平阈值 | | 0.7 × VDDSHV ⁽¹⁾ | | | V |
| V _{IHSS} | 输入高电平阈值稳态 | | 0.7 × VDDSHV ⁽¹⁾ | | | V |
| V _{HYS} | 输入迟滞电压 | | 0.1 × VDDSHV ⁽¹⁾ | | | mV |
| I _{IN} | 输入漏电流 | V _I = 1.8V 或 0V | | | ±10 | μA |
| V _{OL} | 输出低电平电压 | | | | 0.2 × VDDSHV ⁽¹⁾ | V |
| I _{OL} | 低电平输出电流 | V _{OL(MAX)} | 6 | | | mA |
| 3.3V 模式 | | | | | | |
| V _{IL} | 输入低电平阈值 | | | | 0.3 × VDDSHV ⁽¹⁾ | V |
| V _{ILSS} | 输入低电平阈值稳态 | | | | 0.25 × VDDSHV ⁽¹⁾ | V |
| V _{IH} | 输入高电平阈值 | | 0.7 × VDDSHV ⁽¹⁾ | | | V |
| V _{IHSS} | 输入高电平阈值稳态 | | 0.7 × VDDSHV ⁽¹⁾ | | | V |
| V _{HYS} | 输入迟滞电压 | | 0.05 × VDDSHV ⁽¹⁾ | | | mV |
| I _{IN} | 输入漏电流 | V _I = 3.3V 或 0V | | | ±10 | μA |
| V _{OL} | 输出低电平电压 | | | | 0.4 | V |
| I _{OL} | 低电平输出电流 | V _{OL(MAX)} | 6 | | | mA |

(1) VDDSHV 表示相应的电源。有关电源名称和相应焊球的更多信息，请参阅[引脚属性](#)的“电源”列。

6.6.2 失效防护复位 (FS 复位) 电气特性

在建议运行条件下测得 (除非另有说明)

| 参数 | | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-------------------|-----------|------|-----|-----|-----------------------------|----|
| V _{IL} | 输入低电平阈值 | | | | 0.3 × VDDSHV ⁽¹⁾ | V |
| V _{ILSS} | 输入低电平阈值稳态 | | | | 0.3 × VDDSHV ⁽¹⁾ | V |

在建议运行条件下测得 (除非另有说明)

| 参数 | | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----|----|
| V _{IH} | 输入高电平阈值 | | 0.7 × VDDSHV ⁽¹⁾ | | | V |
| V _{IHSS} | 输入高电平阈值稳态 | | 0.7 × VDDSHV ⁽¹⁾ | | | V |
| V _{HYS} | 输入迟滞电压 | | 200 | | | mV |
| I _{IN} | 输入漏电流 | V _I = 1.8V 或 0V | | | ±10 | μA |

(1) VDDSHV 表示相应的电源。有关电源名称和相应焊球的更多信息, 请参阅引脚属性的“电源”列。

6.6.3 HFOSC/LFOSC 电气特性

在建议的工作条件下测得 (除非另有说明)

| 参数 | | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|------------------|---------|------|---------------------------------|-----|---------------------------------|----|
| 高频振荡器 | | | | | | |
| V _{IH} | 输入高电平阈值 | | 0.65 × VDDSHV ⁽¹⁾ | | | V |
| V _{IL} | 输入低电平阈值 | | | | 0.35 × VDDSHV ⁽¹⁾ | V |
| V _{HYS} | 输入迟滞电压 | | | 49 | | mV |
| 低频振荡器 | | | | | | |
| V _{IH} | 输入高电平阈值 | | 0.65 × VDDA_WKUP ⁽¹⁾ | | | V |
| V _{IL} | 输入低电平阈值 | | | | 0.35 × VDDA_WKUP ⁽¹⁾ | V |
| V _{HYS} | 输入迟滞电压 | 工作模式 | | 85 | | mV |
| | | 旁路模式 | | 324 | | mV |

(1) VDDSHV 表示相应的电源。对于 WKUP_OSC0, 对应的电源为 VDDA_WKUP。对于 OSC1_XI, 对应的电源为 VDDS_OSC1。

6.6.4 eMMCPHY 电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明)

| 参数 | | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
|-------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|----|
| V _{IL} | 输入低电平阈值 | | | | 0.35 × VDDSHV ⁽¹⁾ | V |
| V _{ILSS} | 输入低电平阈值稳态 | | | | 0.20 | V |
| V _{IH} | 输入高电平阈值 | | 0.65 × VDDSHV ⁽¹⁾ | | | V |
| V _{IHSS} | 输入高电平阈值稳态 | | 1.4 | | | V |
| I _{IN} | 输入漏电流 | V _I = 1.8V 或 0V | | | ±10 | μA |
| I _{OZ} | 三态输出漏电流 | V _O = 1.8V 或 0V | | | ±10 | μA |
| R _{PU} | 上拉电阻器 | | 15 | 20 | 25 | kΩ |
| R _{PD} | 下拉电阻器 | | 15 | 20 | 25 | kΩ |
| V _{OL} | 输出低电平电压 | | | | 0.30 | V |
| V _{OH} | 输出高电平电压 | | VDDSHV - 0.30 ⁽¹⁾ | | | V |
| I _{OL} | 低电平输出电流 | V _{OL(MAX)} | 2 | | | mA |
| I _{OH} | 高电平输出电流 | V _{OH(MAX)} | 2 | | | mA |

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

| 参数 | | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
|-----------------|-------|------|-------|-----|-----|-----|
| SR _I | 输入压摆率 | | 5E +8 | | | V/s |

(1) VDDSHV 表示相应的电源 (vddshv8)。有关电源名称和相应焊球的更多信息，请参阅引脚属性的“电源”列。

6.6.5 SDIO 电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

| 参数 | | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
|-------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------------|----|
| 1.8V 模式 | | | | | | |
| V _{IL} | 输入低电平阈值 | | | | 0.58 | V |
| V _{ILSS} | 输入低电平阈值稳态 | | | | 0.58 | V |
| V _{IH} | 输入高电平阈值 | | 1.27 | | | V |
| V _{IHSS} | 输入高电平阈值稳态 | | 1.7 | | | V |
| V _{HYS} | 输入迟滞电压 | | 150 | | | mV |
| I _{IN} | 输入漏电流 | V _I = 1.8V 或 0V | | | ±10 | μA |
| R _{PU} | 上拉电阻器 | | 40 | 50 | 60 | kΩ |
| R _{PD} | 下拉电阻器 | | 40 | 50 | 60 | kΩ |
| V _{OL} | 输出低电平电压 | | | | 0.45 | V |
| V _{OH} | 输出高电平电压 | | VDDSHV-0.45 ⁽¹⁾ | | | V |
| I _{OL} | 低电平输出电流 | V _{OL(MAX)} | 4 | | | mA |
| I _{OH} | 高电平输出电流 | V _{OH(MAX)} | 4 | | | mA |
| 3.3V 模式 | | | | | | |
| V _{IL} | 输入低电平阈值 | | | | 0.25 × VDDSHV ⁽¹⁾ | V |
| V _{ILSS} | 输入低电平阈值稳态 | | | | 0.15 × VDDSHV ⁽¹⁾ | V |
| V _{IH} | 输入高电平阈值 | | 0.625 × VDDSHV ⁽¹⁾ | | | V |
| V _{IHSS} | 输入高电平阈值稳态 | | 0.625 × VDDSHV ⁽¹⁾ | | | V |
| V _{HYS} | 输入迟滞电压 | | 150 | | | mV |
| I _{IN} | 输入漏电流 | V _I = 1.8V 或 0V | | | ±10 | μA |
| R _{PU} | 上拉电阻器 | | 40 | 50 | 60 | kΩ |
| R _{PD} | 下拉电阻器 | | 40 | 50 | 60 | kΩ |
| V _{OL} | 输出低电平电压 | | | | 0.125 × VDDSHV ⁽¹⁾ | V |
| V _{OH} | 输出高电平电压 | | 0.75 × VDDSHV ⁽¹⁾ | | | V |
| I _{OL} | 低电平输出电流 | V _{OL(MAX)} | 6 | | | mA |
| I _{OH} | 高电平输出电流 | V _{OH(MAX)} | 10 | | | mA |

(1) VDDSHV 表示相应的电源 (vddshv8)。有关电源名称和相应焊球的更多信息，请参阅引脚属性的“电源”列。

6.6.6 CSI2/DSI D-PHY 电气特性

备注

CSI2/DSI DPHY 接口电气特性符合 MIPI D-PHY 规范 v1.2 (2014 年 8 月 1 日), 包括 ECN 和勘误表 (如适用)。

6.6.7 ADC12B 电气特性

在建议的工作条件下测得 (除非另有说明)

| 参数 | | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----|--|---------|--------------------|
| 模拟输入 | | | | | | |
| $V_{MCU_ADC0/1_AIN[7:0]}$ | 满量程输入范围 | | VSS | $VDDA_ADC0/1$ | | V |
| DNL | 微分非线性 | | -1 | 0.5 | 4 | LSB |
| INL | 积分非线性 | | | ± 1 | ± 4 | LSB |
| $LSB_{GAIN-ERROR}$ | 增益误差 | | | ± 2 | | LSB |
| $LSB_{OFFSET-ERROR}$ | 偏移量误差 | | | ± 2 | | LSB |
| C_{IN} | 输入采样电容 | | | 5.5 | | pF |
| SNR | 信噪比 | 输入信号: -0.5dB 满量程的 200kHz 正弦波 | | 70 | | dB |
| THD | 总谐波失真 | 输入信号: -0.5dB 满量程的 200kHz 正弦波 | | 73 | | dB |
| SFDR | 无杂散动态范围 | 输入信号: -0.5dB 满量程的 200kHz 正弦波 | | 76 | | dB |
| $SNR_{(PLUS)}$ | 信噪比和失真 | 输入信号: -0.5dB 满量程的 200kHz 正弦波 | | 69 | | dB |
| $R_{MCU_ADC0/1_AIN[0:7]}$ | MCU_ADC0/1_AIN[7:0] 的输入阻抗 | f = 输入信频率 | | $[1/((65.97 \times 10^{-12}) \times f_{SMPL_CLK})]$ | | Ω |
| I_{IN} | 输入漏电流 | MCU_ADC0/1_AIN[7:0] = VSS | | | -10 | μA |
| | | MCU_ADC0/1_AIN[7:0] = VDDA_ADC0/1 | | | 24 | μA |
| 采样动态 | | | | | | |
| F_{SMPL_CLK} | SMPL_CLK 频率 | | | 60 | | MHz |
| t_C | 转换时间 | | | 13 | | ADC0/1 SMPL_CLK 周期 |
| t_{ACQ} | 采集时间 | | 2 | | 257 | ADC0/1 SMPL_CLK 周期 |
| T_R | 采样率 | ADC0/1 SMPL_CLK = 60MHz | | 4 | | MSPS |
| CCISO | 通道间隔离 | | | 100 | | dB |
| 通用输入模式 ⁽¹⁾ | | | | | | |

在建议的工作条件下测得 (除非另有说明)

| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-------------------|-----------|----------------------------|-----|--------------------|----|
| V _{IL} | 输入低电平阈值 | | | 0.35 × VDDA_ADC0/1 | V |
| V _{ILSS} | 输入高电平阈值稳态 | | | 0.35 × VDDA_ADC0/1 | V |
| V _{IH} | 输入高电平阈值 | 0.65 × VDDA_ADC0/1 | | | V |
| V _{IHSS} | 输入高电平阈值稳态 | 0.65 × VDDA_ADC0/1 | | | V |
| V _{HYS} | 输入迟滞电压 | 200 | | | mV |
| I _{IN} | 输入漏电流 | V _I = 1.8V 或 0V | | 6 | μA |

(1) MCU_ADC0/1 可配置为以通用输入模式运行, 其中所有 MCU_ADC0/1_AIN[7:0] 输入均通过 ADC0/1_CTRL 寄存器 (gpi_mode_en = 1) 全局启用, 以作为数字输入运行。

6.6.8 LVCMOS 电气特性

在建议的工作条件下测得 (除非另有说明)

| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-------------------|---------|----------------------------|-----|---------------------------|----|
| 1.8V 模式 | | | | | |
| V _{IL} | 输入低电压 | | | 0.35 × VDD ⁽¹⁾ | V |
| V _{ILSS} | 输入低电压稳态 | | | 0.3 × VDD ⁽¹⁾ | V |
| V _{IH} | 输入高电压 | 0.65 × VDD ⁽¹⁾ | | | V |
| V _{IHSS} | 输入高电压稳态 | 0.85 × VDD ⁽¹⁾ | | | V |
| V _{HYS} | 输入迟滞电压 | 150 | | | mV |
| I _{IN} | 输入漏电流。 | V _I = 1.8V 或 0V | | ±10 | μA |
| R _{PU} | 上拉电阻器 | 15 | 22 | 30 | kΩ |
| R _{PD} | 下拉电阻器 | 15 | 22 | 30 | kΩ |
| V _{OL} | 输出低电压 | | | 0.45 | V |
| V _{OH} | 输出高电压 | VDD ⁽¹⁾ - 0.45 | | | V |
| I _{OL} | 低电平输出电流 | V _{OL(MAX)} | 3 | | mA |
| I _{OH} | 高电平输出电流 | V _{OH(MIN)} | 3 | | mA |
| 3.3V 模式 | | | | | |
| V _{IL} | 输入低电压 | | | 0.8 | V |
| V _{ILSS} | 输入低电压稳态 | | | 0.6 | V |
| V _{IH} | 输入高电压 | 2.0 | | | V |
| V _{IHSS} | 输入高电压稳态 | 2.0 | | | V |
| V _{HYS} | 输入迟滞电压 | 150 | | | mV |
| I _{IN} | 输入漏电流。 | V _I = 3.3V 或 0V | | ±10 | μA |
| R _{PU} | 上拉电阻器 | 15 | 22 | 30 | kΩ |
| R _{PD} | 下拉电阻器 | 15 | 22 | 30 | kΩ |
| V _{OL} | 输出低电压 | | | 0.4 | V |
| V _{OH} | 输出高电压 | 2.4 | | | V |
| I _{OL} | 低电平输出电流 | V _{OL(MAX)} | 5 | | mA |

在建议的工作条件下测得 (除非另有说明)

| 参数 | | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-----------------|---------|----------------------|-----|-----|-----|----|
| I _{OH} | 高电平输出电流 | V _{OH(MIN)} | 6 | | | mA |

(1) VDD 表示相应的电源。有关电源名称和相应焊球的更多信息，请参阅引脚属性的“电源”列。

6.6.9 USB2PHY 电气特性

备注

USB0 和 USB1 电气特性符合 2000 年 4 月 27 日发布的通用串行总线修订版 2.0 规范，包括适用的 ECN 和勘误表。

6.6.10 串行器/解串器 2-L-PHY/4-L-PHY 电气特性

备注

PCIe 接口符合 2017 年 9 月 27 日 PCI Express® 基本规范 4.0 版中规定的电气参数。

如表 6-2 4-L-PHY 串行器/解串器 REFCLK 电气特性中的参数 V_{REFCLK_TERM} 所述，在输入模式下使用该器件并启用内部终端时，该器件对串行器/解串器 REFCLK 施加了额外的限制。默认情况下会启用内部终端，但在应用超过限值（由 V_{REFCLK_TERM} 定义）的基准时钟信号之前必须禁用内部终端。在源极侧应始终启用外部终端。

表 6-2. 4-L-PHY 串行器/解串器 REFCLK 电气特性

仅在启用内部终端后适用。在建议的工作条件下测得 (除非另有说明)

| 参数 | | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|--------------------------|-------------------------|-----|-----|------|----|
| V _{REFCLK_TERM} | 启用内部终端后位于基准时钟引脚上的单端电压阈值 | | | 450 | mV |
| R _{TERM} | 内部端接 | 40 | 50 | 62.5 | Ω |

备注

串行器/解串器 USB 接口符合 2013 年 7 月 26 日通用串行总线 3.1 规范 1.0 版本中定义的 USB3.1 超高速发送器和接收器标准化电气参数。

备注

SGMII 接口电气特性符合 IEEE802.3 第 70 条规定的 1000BASE-KX 标准。

备注

SGMII 2.5G/XAUI 接口电气特性符合 IEEE802.3 第 47 条。

备注

QSGMII 接口电气特性符合 QSGMII 规范 1.2 版。

备注

USXGMII 支持第 72-7 条和附录 69B 中的 IEEE 802.3 TX 和 RX 电气特性。它不支持 10GBase-KR 自动协商 (第 73 条) 和链路训练 (第 72 条)。

USXGMII 不需要 IEEE 802.3 表 72-7 和 72-8, 因为这些表与训练 (第 72-6 条) 相关, 而 USXGMII 不需要该训练。

应使用 BER 扫描来设置前游标、主游标和后游标。

备注

XFI 接口电气特性符合 INF-8077_XFP_XFI_10Gbps_1X 规范 4.5 版 (2005 年 8 月 31 日) 的要求。

备注

UFS 接口电气特性符合 MIPI M-PHY 规范 v3.1 (2014 年 2 月 17 日)。

备注

DP 接口电气特性符合 VESA DisplayPort (DP) 标准 v1.4 (2016 年 2 月 23 日)。

备注

eDP 接口电气特性符合 VESA 嵌入式 DisplayPort (eDP) 标准 v1.4b (2015 年 10 月 23 日)。

6.6.13 DDR0 电气特性

备注

DDR 接口与符合 JESD209-4B 标准的 LPDDR4 SDRAM 器件兼容。

6.7 一次性可编程 (OTP) 电子保险丝的 VPP 规格

本节说明了对 OTP 电子保险丝进行编程所需的运行条件, 且仅适用于高安全性器件。

6.7.1 OTP 电子保险丝编程的建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明)

| 参数 | 说明 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
|----------|--|----------------------------|-----|------|----|
| VDD_CORE | OTP 运行期间内核域的电源电压范围 | 请参阅 建议运行条件 | | | V |
| VDD_MCU | OTP 运行期间内核域的电源电压范围 | 请参阅 建议运行条件 | | | V |
| VDD_CPU | OTP 运行期间内核域的电源电压范围 ; (BOOT 电压) | 请参阅 建议运行条件 | | | V |
| VPP_CORE | 在没有硬件支持对电子保险丝 ROM 进行编程的情况下正常运行期间电子保险丝 ROM 域的电源电压范围 | NC ⁽²⁾ | | | V |
| | 在有硬件支持对电子保险丝 ROM 进行编程的情况下正常运行期间电子保险丝 ROM 域的电源电压范围 | 0 | | | V |
| | OTP 编程期间电子保险丝 ROM 域的电源电压范围 ⁽¹⁾ | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |

6.7.1 OTP 电子保险丝编程的建议运行条件 (续)

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明)

| 参数 | 说明 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
|---------------------|--|------|-------------------|--------|-----|
| VPP_MCU | 在没有硬件支持对电子保险丝 ROM 进行编程的情况下正常运行期间电子保险丝 ROM 域的电源电压范围 | | NC ⁽²⁾ | | V |
| | 在有硬件支持对电子保险丝 ROM 进行编程的情况下正常运行期间电子保险丝 ROM 域的电源电压范围 | | 0 | | V |
| | OTP 编程期间电子保险丝 ROM 域的电源电压范围 ⁽¹⁾ | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| SR _(VPP) | VPP 上电压摆率 | | | 6E + 4 | V/s |

(1) 电源电压范围包括直流误差和峰峰值噪声。

(2) NC 表示无连接。

6.7.2 硬件要求

对 OTP 电子保险丝中的密钥进行编程时, 必须满足以下硬件要求:

- 当不对 OTP 寄存器进行编程时, VPP_CORE 和 VPP_MCU 电源必须禁用。
- 在执行正确的器件上电序列后, VPP_CORE 和 VPP_MCU 电源必须斜升 (有关更多详细信息, 请参阅 [电源时序控制](#))。

6.7.3 编程序列

OTP 电子保险丝的编程序列:

- 按照上电时序为电路板加电。上电和正常运行期间, VPP_CORE 和 VPP_MCU 端子上不应施加电压。
- 加载对电子保险丝进行编程所需的 OTP 写入软件 (请联系您当地的 TI 代表以获取 OTP 软件包)。
- 根据 [节 6.7.1](#) 中的规格在 VPP_CORE 和 VPP_MCU 端子上施加电压。
- 运行对 OTP 寄存器进行编程的软件。
- 验证 OTP 寄存器的内容后, 移除 VPP_CORE 和 VPP_MCU 端子上的电压。

6.7.4 对硬件保修的影响

您同意使用安全密钥对 TI 器件进行电子熔断会永久改变它们。您确认, 由于程序序列不正确或中止或者您省略了某个序列步骤等, 电子保险丝可能会发生故障。此外, 如果量产密钥的错误代码校正检查失败, 或者映像未使用当前有效量产密钥进行签名和选择性加密, 则 TI 器件可能无法安全启动。这些类型的情况将导致 TI 器件无法运行, TI 将无法确认在尝试使用电子保险丝之前 TI 器件是否符合其规格。因此, 对于客户错误进行电子熔断的任何 TI 器件, TI 不承担任何责任 (保修责任或其他责任)。

6.8 热阻特性

本节提供了该器件上使用的热阻特性。

出于可靠性和可操作性方面的考虑，器件的最高结温必须达到或低于[建议运行条件](#)中确定的 T_J 值。

6.8.1 ALY 封装的热阻特性

建议在处于最坏的器件功耗情况下执行系统级热仿真。

| 编号 | 参数 | 说明 | ALY 封装 | |
|-----|------------------------|---------|---------------------------------------|----------------------------|
| | | | $^{\circ}\text{C}/\text{W}^{(1) (3)}$ | 气流 (m/s) ⁽²⁾ |
| T1 | $R_{\Theta \text{JC}}$ | 结点到外壳 | 0.11 | 不适用 |
| T2 | $R_{\Theta \text{JB}}$ | 结点到电路板 | 1.6 | 不适用 |
| T3 | $R_{\Theta \text{JA}}$ | 结点到环境空气 | 8.3 | 0 |
| T4 | | 结至流动空气 | 4.7 | 1 |
| T5 | | | 3.9 | 2 |
| T7 | Ψ_{JT} | 结至封装顶部 | 0.1 | 0 |
| T8 | | | 0.1 | 1 |
| T9 | | | 0.1 | 2 |
| T11 | Ψ_{JB} | 结点到电路板 | 1.3 | 0 |
| T12 | | | 1.1 | 1 |
| T13 | | | 1.0 | 2 |

(1) 以上值基于 JEDEC 定义的 2S2P 系统（基于 JEDEC 定义的 1S0P 系统的 Θ_{JC} [R $_{\Theta \text{JC}}$] 值除外），将随环境和应用的变化而更改。有关更多信息，请参阅以下 EIA/JEDEC 标准：

- JESD51-2, *Integrated Circuits Thermal Test Method Environment Conditions - Natural Convection (Still Air)*
- JESD51-3, *Low Effective Thermal Conductivity Test Board for Leaded Surface Mount Packages*
- JESD51-6, *Integrated Circuit Thermal Test Method Environmental Conditions - Forced Convection (Moving Air)*
- JESD51-7, *High Effective Thermal Conductivity Test Board for Leaded Surface Mount Packages*
- JESD51-9, *Test Boards for Area Array Surface Mount Packages*

(2) m/s = 米/秒。

(3) $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ = 摄氏度/瓦。

6.9 温度传感器特性

本节总结了电压和温度模块 (VTM) 片上温度传感器特性。

出于可靠性和可操作性方面的考虑，器件的最高结温必须达到或低于[建议运行条件](#)中确定的 T_J 值。

表 6-3. VTM 裸片温度传感器特性

| 参数 | | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-----------|-------------|---------------|-----|-----|-----|----|
| T_{acc} | VTM 温度传感器精度 | -40°C 至 110°C | -5 | | 5 | °C |
| | | 110°C 至 125°C | -2 | | 2 | °C |

6.10 时序和开关特性

备注

当相关 PADCONFIG 寄存器中的 DRV_STR (驱动强度) 控制被设置为默认的 “0h - 标称 (推荐) ” 值时，本节介绍的时序有效。

6.10.1 时序参数和信息

时序和开关特性中使用的时序参数符号是根据 JEDEC 标准 100 创建的。为了缩短符号，表 6-4 中缩写了一些引脚名称和其他相关术语：

表 6-4. 时序参数下标

| 符号 | 参数 |
|-------|---------------|
| c | 周期时间 (周期) |
| d | 延迟时间 |
| dis | 禁用时间 |
| en | 启用时间 |
| h | 保持时间 |
| su | 建立时间 |
| START | 起始位 |
| t | 转换时间 |
| v | 有效时间 |
| W | 脉冲持续时间 (宽度) |
| X | 未知、改变或者不用考虑级别 |
| F | 下降时间 |
| H | 高 |
| L | 低 |
| R | 上升时间 |
| V | 有效 |
| IV | 无效 |
| AE | 有效边沿 |
| FE | 第一个边沿 |
| LE | 最后一个边沿 |
| Z | 高阻抗 |

6.10.2 电源时序控制

本节介绍了确保器件正常运行所需的电源时序控制。该器件可使用隔离式或组合式 MCU 和 Main 配电网络 (PDN) 运行。建议根据隔离式和组合式 MCU 与 Main PDN 使用两个不同的初级电源序列。此外，该器件可在仅 MCU 或 DDR 保持或 GPIO 保持低功耗模式下运行。这里显示了进入和退出低功耗模式所需的两个不同器件电源序列。

本节中使用的电源名称仅适用于此器件，并与“信号说明”一节中给出的名称相一致。Jacinto 7™ 处理器系列中的不同器件之间可能使用通用电源名称。在不同器件上，这些通用电源名称将具有非常相似的功能（可能不完全相同）。

所示的所有电源序列时序控制图都将使用以下术语：

- 初级 = 所有电压域在关断和完全运行状态之间的基本电源序列。
- $V_{OPR\ MIN}$ = 确保实现“建议运行条件”中指定的功能的最低工作电压电平
- 斜升 = 从关断状态到 $V_{opr\ min}$ 的电压电源转换时间的起始点。
- 斜降 = 从 V_{opr} 到关断状态的电压电源转换时间的起始点。
- Supply_“n” = 相似电源的多个实例（即 $VDDSHVn = VDDSHV0、VDDSHV1、VDDSHV2 \dots VDDSHV6$ ）。
- Supply_“xxx” = 用于不同信号类型的类似电源的多个实例（即 $VDDA_1P8_xxx = VDDA_1P8_DSITX、VDDA_1P8_USB、VDDA_0P8_DSITX、VDDA_0P8_USB$ 等）。
- 时间戳 = “T#” 标记，带有说明和大致的经历时间，仅供一般参考。具体的时序转换取决于 PDN 设计（有关详细信息，请参阅 PDN 用户指南）。

6.10.2.1 电源压摆率要求

为了维持内部 ESD 保护器件的安全工作范围，TI 建议将电源的最大压摆率限制为小于 $100\text{mV}/\mu\text{s}$ ，如图 6-2 所示。例如，1.8V 电源的斜坡时间应 $> 18\ \mu\text{s}$ ，以确保压摆率 $< 100\text{mV}/\mu\text{s}$ 。

图 6-2 介绍了器件中的电源压摆率要求。

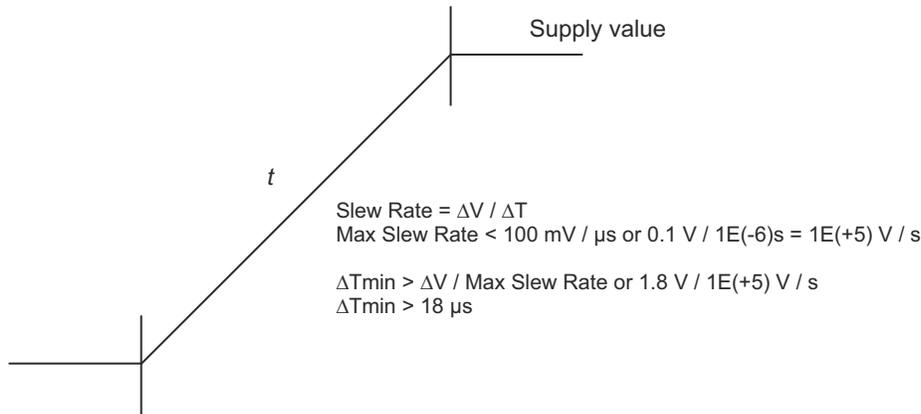
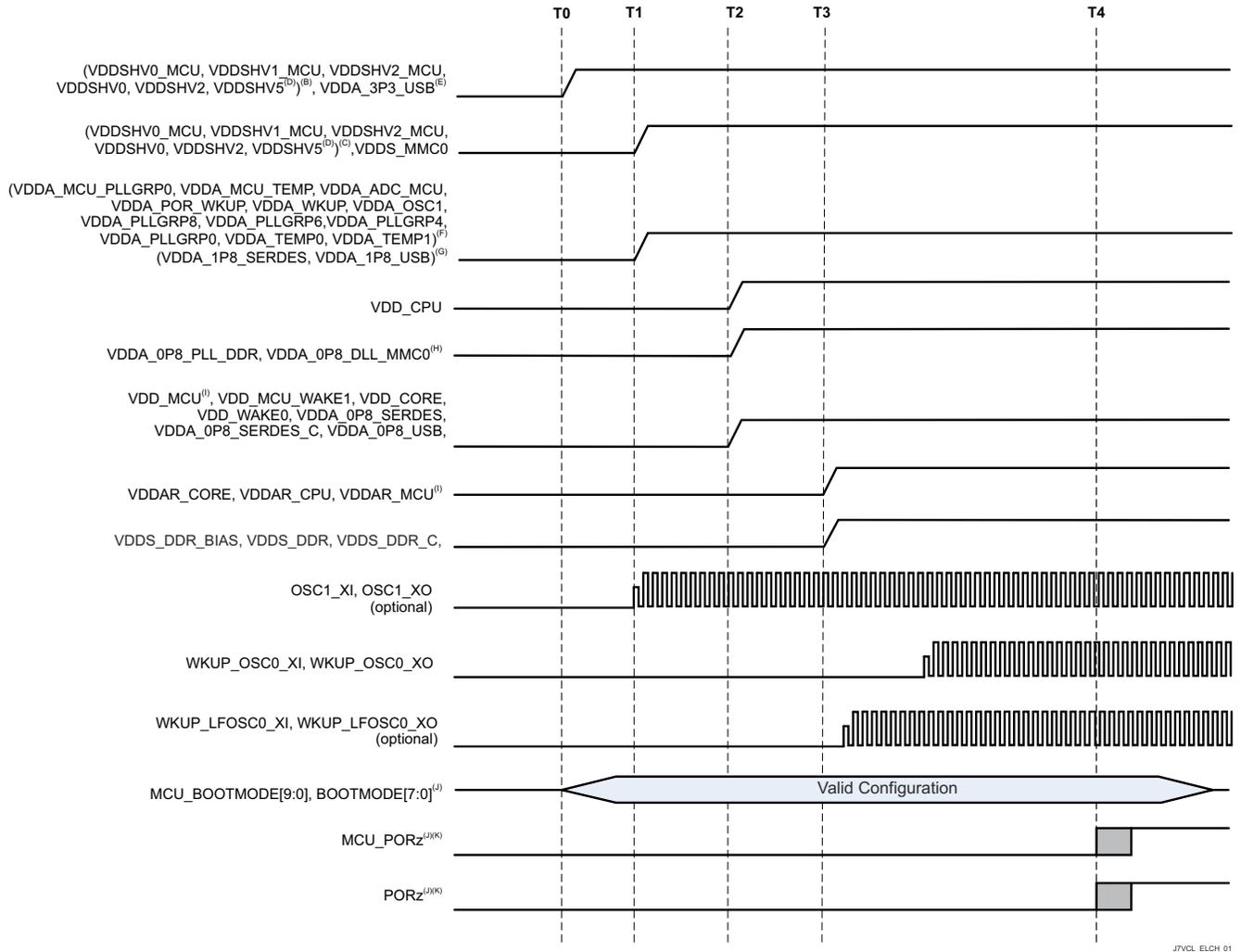


图 6-2. 电源电压转换时间和压摆率

6.10.2.2 组合式 MCU 域和 Main 域上电时序

节 6.10.2.2 介绍了当类似的 MCU 和 Main 电压域组合到公共电源轨时的初级上电时序。将 MCU 和 Main 电压域组合可减少电源轨和电源的总数量，同时使 MCU 和 Main 处理器子系统依赖公共电源轨运行，从而简化 PDN 设计。



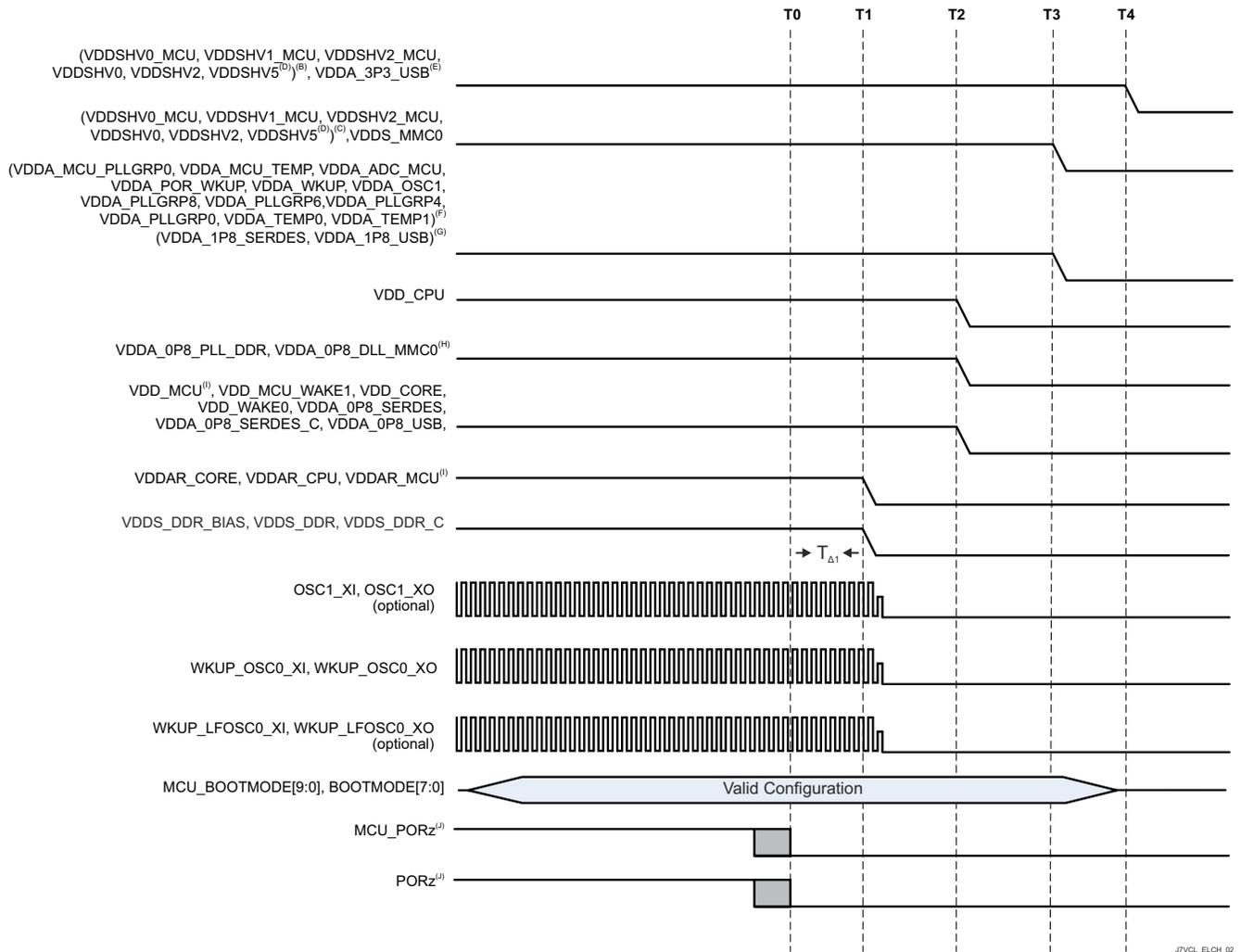
- A. 时间戳标记：
- T0 - 3.3V 电压开始斜升至 $V_{OPR\ MIN}$ 。(0ms)
 - T1 - 1.8V 电压开始斜升至 $V_{OPR\ MIN}$ 。(2ms)
 - T2 - 低电压内核电源开始斜升至 $V_{OPR\ MIN}$ 。(3ms)
 - T3 - 低电压 RAM 阵列电压开始斜升至 $V_{OPR\ MIN}$ 。(4ms)
 - T4 - OSC1 保持稳定，PORz/MCU_PORz 置为无效以从复位状态释放处理器。(13ms)
- B. 任何 MCU 或 Main 双电压 IO 电源 (VDDSHVn_MCU 或 VDDSHVn) 由 3.3V 电压供电以支持 3.3V 数字接口。由于 PDN 设计使用具有不同开通和斜升延时的不同电源，因此少数电源在 T0 和 T1 之间的启动时间可能会有所不同。
- C. 任何 MCU 或 Main 双电压 IO 电源 (VDDSHVn_MCU 或 VDDSHVn) 由 1.8V 电压供电以支持 1.8V 数字接口。使用 eMMC 存储器时，由于 PDN 设计将电源与 VDD_MMC0 分组在一起，因此 Main 1.8V 电源的斜升电压可能与 T3 相一致。
- D. VDDSHV5 支持 SD 存储卡的 MMC1 信号。如果需要实现合规的高速 SD 卡运行，则需要独立的双电压 (3.3V/1.8V) 电源和电源轨。斜升至 3.3V 的开始时间与所示的其他 3.3V 域相同。如果不需要 SD 卡或可以接受具有固定 3.3V 工作电压的标准数据速率，则可以将域与数字 IO 3.3V 电源轨分组在一起。如果 SD 卡能够在固定 1.8V 的电压下运行，则可以将域与数字 IO 1.8V 电源轨分组在一起。

- E. VDDA_3P3_USB 是用于 USB 2.0 差分接口信号传输的 3.3V 模拟域。建议使用低噪声模拟电源来提供最佳信号完整性，以确保 USB 数据眼罩合规性。斜升至 3.3V 的开始时间与所示的其他 3.3V 域相同。如果不需要 USB 接口或可以容忍数据位错误，则可以直接或通过电源滤波器将域与 3.3V 数字 IO 电源轨分组在一起。
- F. VDDA_1P8_<clk/pll/ana> 是 1.8V 模拟域，支持需要使用低噪声电源以实现最佳性能的时钟振荡器、PLL 和模拟电路。不建议将数字 VDDSHVn_MCU 和 VDDSHVn IO 域组合在一起，因为高频开关噪声会对时钟、PLL 和 DLL 信号的抖动性能产生负面影响。应避免组合模拟 VDDA_1p8_<phy> 域，但如果分组在一起，则需要进行直立式铁氧体磁珠电源滤波。
- G. VDDA_1P8_<phy> 是 1.8V 模拟域，支持多个串行 PHY 接口。建议使用低噪声模拟电源来提最佳信号完整性、接口性能和规格符合性。如果不需要这些接口中的任何一个，可以容忍数据位错误或不合规运行，则可以直接或通过直立式电源滤波器将域与数字 IO 1.8V 电源轨分组在一起。
- H. VDDA_0P8_<dll/pll> 是 0.8V 模拟域，支持需要使用低噪声电源以实现最佳性能的 PLL 和 DLL 电路。不建议将这些域与任何其他 0.8V 域组合在一起，因为高频开关噪声会对 PLL 和 DLL 信号的抖动性能产生负面影响。
- I. VDD_MCU 是一个具有宽工作电压范围的数字电压域，因此可将其与 VDDAR_MCU 域或与 VDD_CORE 分组在一起；对于“组合式 MCU 和 Main 域上电时序”，VDD_MCU 可与 VDD_CORE 分组在一起，而 VDDAR_MCU 可与 VDDAR_CPU 和 VDDAR_CORE 分组在一起。如果 VDD_MCU 与 VDD_CORE 分组在一起，则 VDD_MCU 必须从 T2 处 VDD_CORE 为 0.8V 的公共电压资源斜升。如果 VDD_MCU 未与 VDD_CORE 分组在一起，则 VDD_MCU 必须在 T2 之前斜升。在任一种情况下，VDDAR 电源都必须在 T3 处斜升。
- J. 在所示的最短建立时间和保持时间内，在上电序列期间将 MCU_PORz 和 PORz 置为高电平有效，从而将 MCU_BOOTMODEn (参考 MCU_VDDSHV0) 和 BOOTMODEn (参考 VDDSHV2) 设置锁存到寄存器中。
- K. 从晶体振荡器电路通电 (T1 处的 VDDA_OSC1) 直至达到稳定时钟频率所需的最短时间取决于晶体振荡器、电容器参数和 PCB 寄生值。此处显示的是由 (T4 - T1) 时间戳定义的 10ms 保守时间。根据客户的时钟电路 (即晶体振荡器或时钟发生器) 和 PCB 设计，这一时间可以减少。

图 6-3. 组合式 MCU 域和 Main 域，初级上电序列

6.10.2.3 组合式 MCU 域和 Main 域下电时序 - 选项 1

图 6-4 介绍了选项 1 的器件下电时序。



A. 时间戳标记：

- T0 - MCU_PORz 和 PORz 置为低电平有效，用于将所有处理器资源置于安全状态。(0ms)
- T1 - 主 DDR、SRAM 内核和 SRAM CPU 电源开始斜降。(0.5ms)
- T2 - 低电压内核电源开始电源斜降。(2.5ms)
- T3 - 1.8V 电压开始电源斜降。(3.0ms)
- T4 - 3.3V 电压开始电源斜降。(3.5ms)

B. 任何 MCU 或 Main 双电压 IO 域 (VDDSHVn_MCU 或 VDDSHVn) 由 3.3V 电压供电以支持 3.3V 数字接口。

C. 任何 MCU 或 Main 双电压 IO 域 (VDDSHVn_MCU 或 VDDSHVn) 由 1.8V 电压供电以支持 1.8V 数字接口。

D. VDDSHV5 支持 SD 存储卡的 MMC1 信号。需要使用双电压 (3.3V/1.8V) 电源轨以实现合规的高速 SD 卡运行。如果不需要 SD 卡或可以接受具有固定 3.3V 工作电压的标准数据速率，则可以将域与数字 IO 3.3V 电源轨分组在一起。如果 SD 卡能够在固定 1.8V 的电压下运行，则可以将域与数字 IO 1.8V 电源轨分组在一起。

E. VDDA_3P3_USB 是用于 USB 2.0 差分接口信号传输的 3.3V 模拟域。建议使用低噪声模拟电源来提供最佳信号完整性，以确保 USB 数据眼罩合规性。如果不需要 USB 接口或可以容忍数据位错误，则可直接或通过电源滤波器将域与 3.3V 数字 IO 电源轨分组在一起。

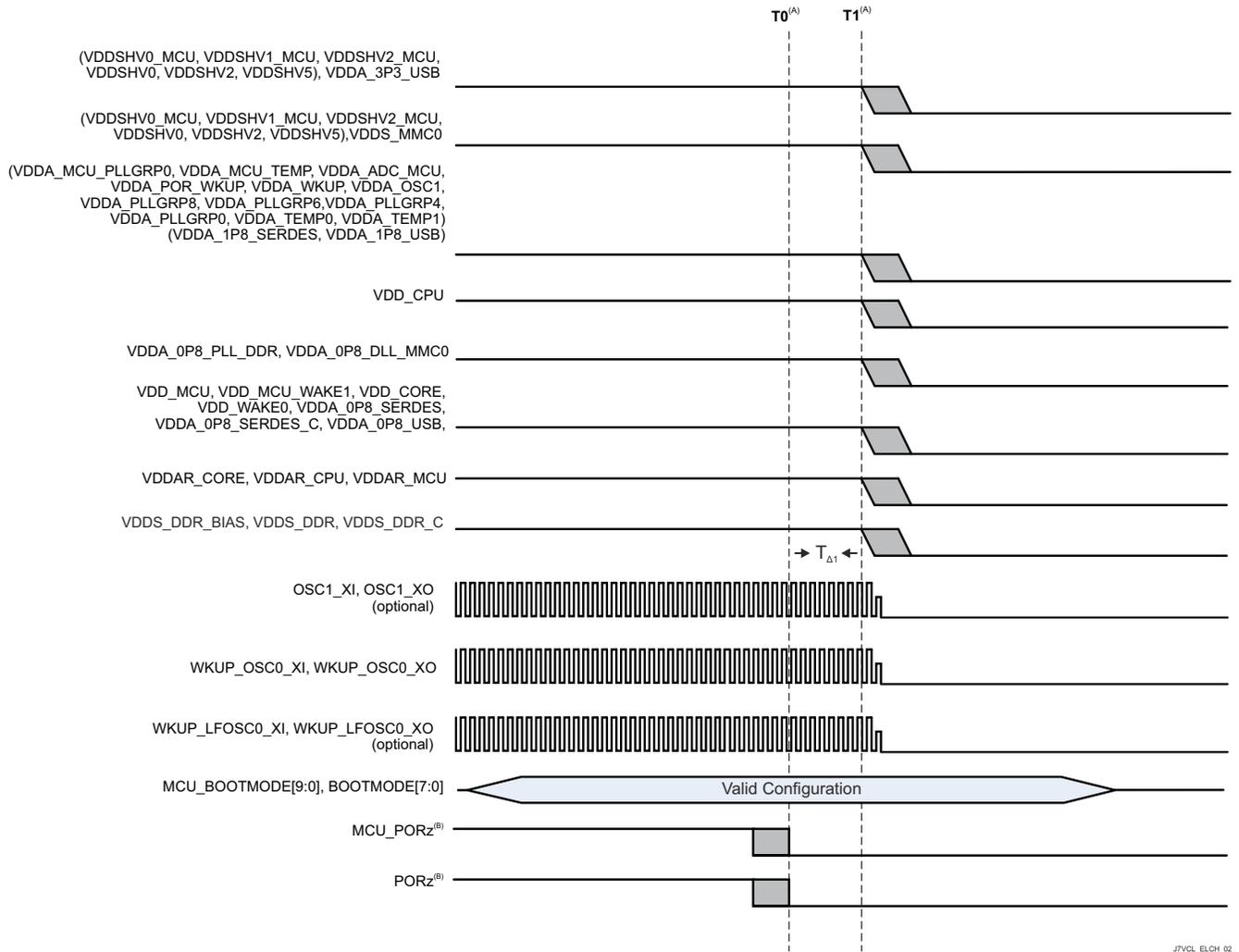
F. VDDA_1P8_<clk/pll/ana> 是 1.8V 模拟域，支持需要使用低噪声电源以实现最佳性能的时钟振荡器、PLL 和模拟电路。不建议将数字 VDDSHVn_MCU 和 VDDSHVn IO 域组合在一起，因为高频开关噪声会对时钟、PLL 和 DLL 信号的抖动性能产生负面影响。应避免组合模拟 VDDA_1p8_<phy> 域，但如果分组在一起，则需要进行直立式铁氧体磁珠电源滤波。

- G. VDDA_1P8_<phy> 是 1.8V 模拟域，支持多个串行 PHY 接口。建议使用低噪声模拟电源来提最佳信号完整性、接口性能和规格符合性。如果不需要这些接口中的任何一个，可以容忍数据位错误或违规运行，则可以直接或通过直列式电源滤波器将域与数字 IO 1.8V 电源轨分组在一起。
- H. VDDA_0P8_<dll/pll> 是 0.8V 模拟域，支持需要使用低噪声电源以实现最佳性能的 PLL 和 DLL 电路。不建议将这些域与任何其他 0.8V 域组合在一起，因为高频开关噪声会对 PLL 和 DLL 信号的抖动性能产生负面影响。
- I. MCU_PORz 和 PORz 必须置为低电平有效 (至少 $T_{\Delta 1} = 200 \mu s$)，以确保 SoC 资源在任何电压开始斜降之前进入安全状态。

图 6-4. 组合式 MCU 域和 Main 域，初级下电时序 - 选项 1

组合式 MCU 域和 Main 域下电时序 - 选项 2

图 6-5 介绍了选项 2 的器件下电时序。



A. 时间戳标记：

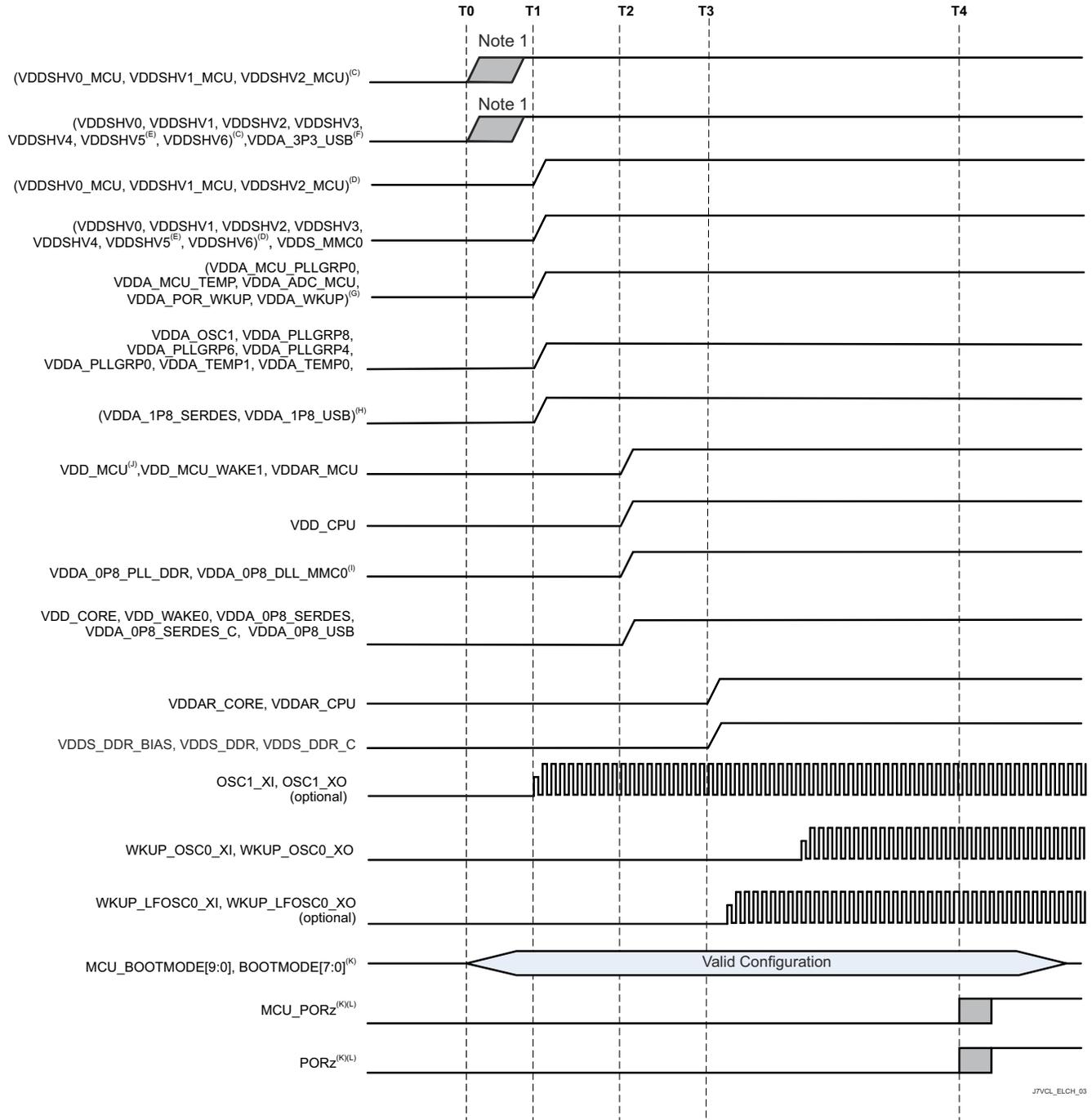
- T0 - MCU_PORz 和 PORz 置为低电平有效，用于将所有处理器资源置于安全状态。(0ms)
- T1 - 所有电源开始斜降。(0.2ms)

B. MCU_PORz 和 PORz 必须置为低电平有效 (至少 $T_{\Delta 1} = 200 \mu s$)，以确保 SoC 资源在任何电压开始斜降之前进入安全状态。

图 6-5. 组合式 MCU 域和 Main 域，初级下电时序 - 选项 2

6.10.2.4 隔离式 MCU 域和 Main 域上电时序

隔离式 MCU 域和 Main 电压域可使 SoC 的 MCU 和 Main 处理器子系统独立运行。SoC 的 PDN 设计可能需要支持独立的 MCU 和 Main 处理器功能，这有 2 个原因。首先要提供灵活性以启用 SoC 低功耗模式，这种模式可以在不需要处理器运行时显著降低 SoC 功耗。其次要实现稳健性，以便在发生影响 MCU 和 Main 处理器子系统的单个故障时确保无干扰 (FFI)，这一点在将 SoC 的 MCU 用作系统安全监控处理器时特别有用。所需的额外 PDN 电源轨数量取决于不同 MCU IO 信令电压电平的数量。如果仅使用 1.8V IO 信令，则只需要 2 个额外的电源轨。如果同时需要 1.8V 和 3.3V IO 信令，则可能需要 4 个额外的电源轨。



A. 时间戳标记：

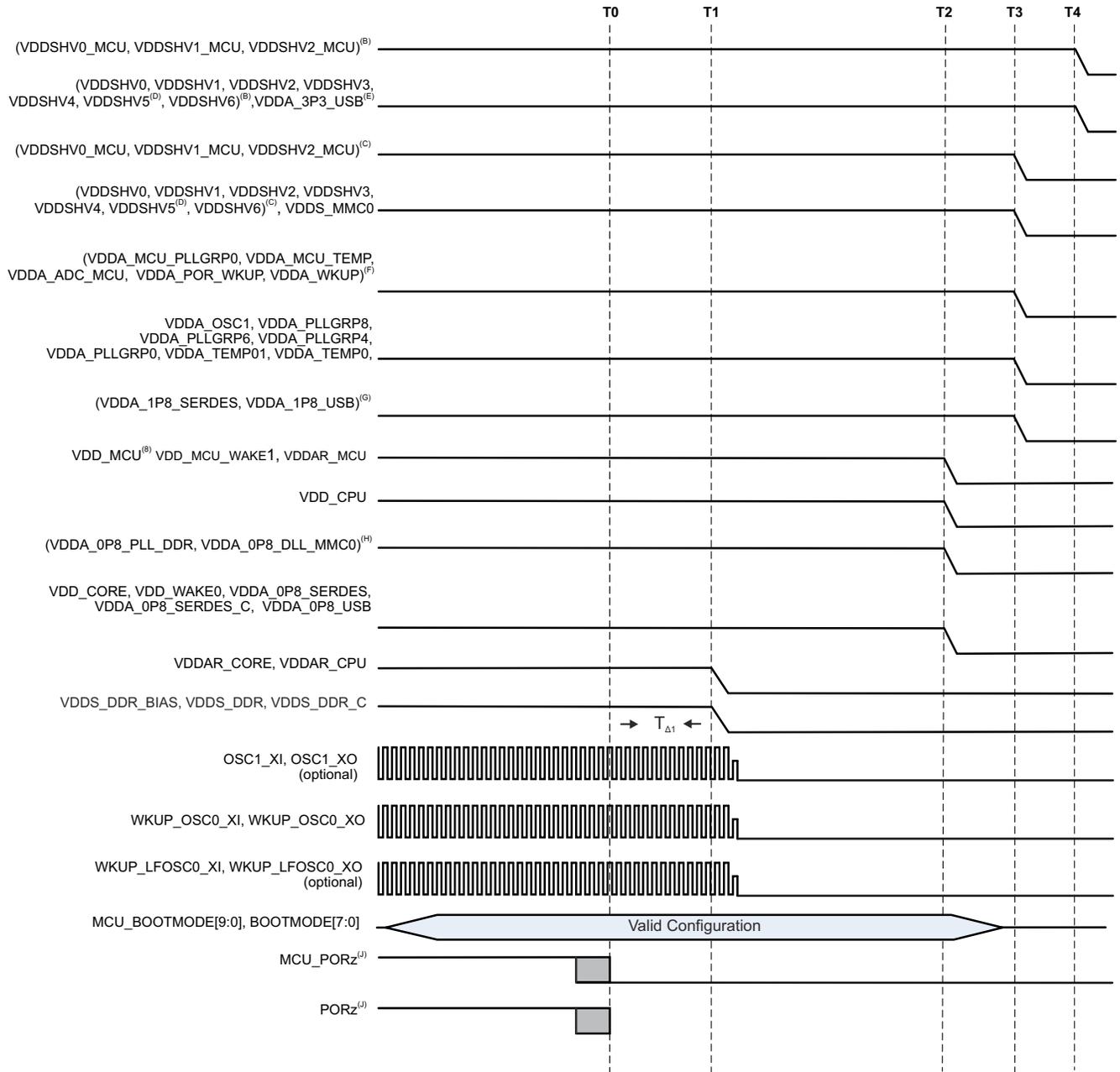
- T0 - 所有 3.3V 电压开始电源斜升至 $V_{OPR\ MIN}$ 。(0ms)

- T1 - 所有 1.8V 电压开始电源斜升至 $V_{OPR\ MIN}$ 。(2ms)
 - T2 - 所有内核电压开始电源斜升至 $V_{OPR\ MIN}$ 。(3ms)
 - T3 - 所有 RAM 阵列电压开始电源斜升至 $V_{OPR\ MIN}$ 。(4ms)
 - T4 - OSC1 保持稳定, PORz/MCU_PORz 置为无效以从复位状态释放处理器。(13ms)
- B. 任何 MCU 或 Main 双电压 IO 电源 (VDDSHVn_MCU 或 VDDSHVn) 由 3.3V 电压供电以支持 3.3V 数字接口。由于 PDN 设计使用具有不同开通和斜升延时的不同电源, 因此少数电源在 T0 和 T1 之间的启动时间可能会有所不同。
- C. 任何 MCU 或 Main 双电压 IO 电源 (VDDSHVn_MCU 或 VDDSHVn) 由 1.8V 电压供电以支持 1.8V 数字接口。使用 eMMC 存储器时, 由于 PDN 设计将电源与 VDD_MMC0 组合在一起, 因此 Main 1.8V 电源的延迟启动时间可能与 T3 相一致。
- D. VDDSHV5 支持 SD 存储卡的 MMC1 信号。如果需要实现合规的 UHS-I SD 卡运行, 则需要独立的双电压 (3.3V/1.8V) 电源和电源轨。斜升至 3.3V 的开始时间与所示的其他 3.3V 域相同。如果不需要 SD 卡或可以接受具有固定 3.3V 工作电压的标准数据速率, 则可以将电源与数字 IO 3.3V 电源轨组合在一起。如果 SD 卡能够在固定 1.8V 的电压下运行, 则可以将电源与数字 IO 1.8V 电源轨组合在一起。
- E. VDDA_3P3_USB 是用于 USB 2.0 差分接口信号传输的 3.3V 模拟电源。建议使用低噪声模拟电源来提供最佳信号完整性, 以确保 USB 数据眼罩合规性。斜升至 3.3V 的开始时间与所示的其他 3.3V 域相同。如果不需要 USB 接口或可以容忍数据位错误, 则可以直接或通过电源滤波器将电源与 3.3V 数字 IO 电源轨组合在一起。
- F. VDDA_1P8_<clk/pll/ana> 是 1.8V 模拟域, 支持需要使用低噪声电源实现最佳性能的时钟振荡器、PLL 和模拟电路。不建议将数字 VDDSHVn_MCU 和 VDDSHVn IO 域组合在一起, 因为高频开关噪声会对时钟、PLL 和 DLL 信号的抖动性能产生负面影响。应避免组合模拟 VDDA_1p8_<phy> 域, 但如果组合在一起, 则需要进行内嵌式铁氧体磁珠电源滤波。
- G. VDDA_1P8_<phy> 是 1.8V 模拟域, 支持多个串行 PHY 接口。建议使用低噪声模拟电源来提供最佳信号完整性、接口性能和规格符合性。如果不需要这些接口中的任何一个, 可以容忍数据位错误或不合规运行, 则可以直接或通过内嵌式电源滤波器将域与数字 IO 1.8V 电源轨组合在一起。
- H. VDDA_0P8_<dll/pll> 是 0.8V 模拟域, 支持需要使用低噪声电源以实现最佳性能的 PLL 和 DLL 电路。不建议将这些域与任何其他 0.8V 域组合在一起, 因为高频开关噪声会对 PLL 和 DLL 信号的抖动性能产生负面影响。
- I. VDD_MCU 是一个具有宽工作电压范围的数字电压域, 因此可将其与 VDDAR_MCU 域或 VDD_CORE 组合在一起; 对于“隔离式 MCU 和 Main 域上电时序”, VDD_MCU 可与 VDDAR_MCU 组合在一起; VDD_MCU 必须在 T2 前斜升。如果 VDDAR_MCU 未与 VDD_MCU 组合在一起, 则 VDDAR_MCU 必须在 T3 处斜升。
- J. 在所示的最短建立时间和保持时间内, 在上电序列期间将 MCU_PORz 和 PORz 置为高电平有效, 从而将 MCU_BOOTMODEn (参考 MCU_VDDSHV0) 和 BOOTMODEn (参考 VDDSHV2) 设置锁存到寄存器中。
- K. 从晶体振荡器电路通电 (T1 处的 VDDA_OSC1) 直至达到稳定时钟频率所需的最短时间取决于晶体振荡器、电容器参数和 PCB 寄生值。此处显示的是由 (T4 - T1) 时间戳定义的 10ms 保守时间。根据客户的时钟电路 (即晶体振荡器或时钟发生器) 和 PCB 设计, 这一时间可以减少。

图 6-6. 隔离式 MCU 域和 Main 域, 初级上电序列

6.10.2.5 隔离式 MCU 域和 Main 域下电时序 - 选项 1

图 6-7 介绍了选项 1 的器件下电时序。



J7VCL_ELCH_04

A. 时间戳标记：

- T0 - MCU_PORz 和 PORz 置为低电平有效，用于将所有处理器资源置于安全状态。(0ms)
- T1 - 主 DDR、SRAM 内核和 SRAM CPU 电源域开始斜降。(0.5ms)
- T2 - 所有内核电压开始电源斜降。(2.5ms)
- T3 - 所有 1.8V 电压开始电源斜降。(3.0ms)
- T4 - 所有 3.3V 电压开始电源斜降。(3.5ms)

B. 任何 MCU 或 Main 双电压 IO 域 (VDDSHVn_MCU 或 VDDSHVn) 由 3.3V 电压供电以支持 3.3V 数字接口。

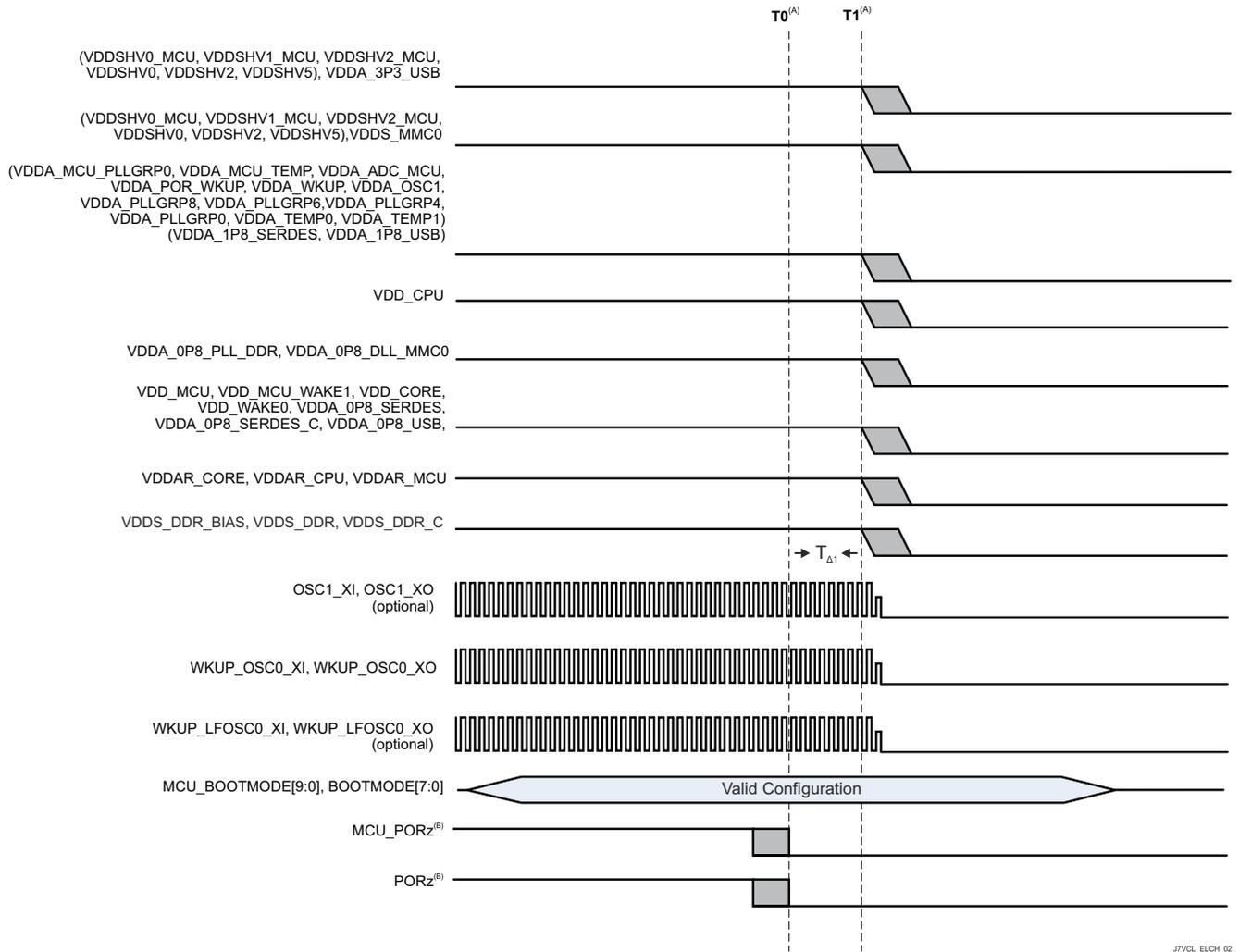
C. 任何 MCU 或 Main 双电压 IO 电源 (VDDSHVn_MCU 或 VDDSHVn) 由 1.8V 电压供电以支持 1.8V 数字接口。使用 eMMC 存储器时，由于 PDN 设计将电源与 VDD_MMC0 组合在一起，因此 Main 1.8V 电源的斜降电压可能与 T1 相一致。

- D. VDDSHV5 支持 SD 存储卡的 MMC1 信号。需要使用双电压 (3.3V/1.8V) 电源轨以实现合规的高速 SD 卡运行。如果需要实现合规的高速 SD 卡运行,则需要独立的双电压 (3.3V/1.8V) 电源和电源轨。从 3.3V/1.8V 斜降的开始时间与所示的其他 3.3V 域相同。如果不需要 SD 卡或可以接受具有固定 3.3V 工作电压的标准数据速率,则可以将域与数字 IO 3.3V 电源轨分组在一起。如果 SD 卡能够在固定 1.8V 的电压下运行,则可以将域与数字 IO 1.8V 电源轨分组在一起。
- E. VDDA_3P3_USB 是用于 USB 2.0 差分接口信号传输的 3.3V 模拟域。建议使用低噪声模拟电源来提供最佳信号完整性,以确保 USB 数据眼罩合规性。从 3.3V 斜降的开始时间与所示的其他 3.3V 域相同。如果不需要 USB 接口或可以容忍数据位错误,则可以直接或通过电源滤波器将域与 3.3V 数字 IO 电源轨分组在一起。
- F. VDDA_1P8_<clk/pll/ana> 是 1.8V 模拟域,支持需要使用低噪声电源以实现最佳性能的时钟振荡器、PLL 和模拟电路。不建议将数字 VDDSHVn_MCU 和 VDDSHVn IO 域组合在一起,因为高频开关噪声会对时钟、PLL 和 DLL 信号的抖动性能产生负面影响。应避免组合模拟 VDDA_1p8_<phy> 域,但如果分组在一起,则需要进行直列式铁氧体磁珠电源滤波。
- G. VDDA_1P8_<phy> 是 1.8V 模拟域,支持多个串行 PHY 接口。建议使用低噪声模拟电源来提最佳信号完整性、接口性能和规格符合性。如果不需要这些接口中的任何一个,可以容忍数据位错误或不合规运行,则可以直接或通过直列式电源滤波器将域与数字 IO 1.8V 电源轨分组在一起。
- H. VDDA_0P8_<dll/pll> 是 0.8V 模拟域,支持需要使用低噪声电源以实现最佳性能的 PLL 和 DLL 电路。不建议将这些域与任何其他 0.8V 域组合在一起,因为高频开关噪声会对 PLL 和 DLL 信号的抖动性能产生负面影响。
- I. MCU_PORz 和 PORz 必须置为低电平有效 (至少 $T_{\Delta 1} = 200 \mu s$),以确保 SoC 资源在任何电压开始斜降之前进入安全状态。

图 6-7. 隔离式 MCU 域和 Main 域,初级下电时序 - 选项 1

隔离式 MCU 域和 Main 域下电时序 - 选项 2

图 6-8 介绍了选项 2 的器件下电时序。



A. 时间戳标记：

- T0 - MCU_PORz 和 PORz 置为低电平有效，用于将所有处理器资源置于安全状态。(0ms)
- T1 - 所有电源开始斜降。(0.2ms)

B. MCU_PORz 和 PORz 必须置为低电平有效 (至少 $T_{\Delta 1} = 200 \mu s$)，以确保 SoC 资源在任何电压开始斜降之前进入安全状态。

图 6-8. 隔离式 MCU 域和 Main 域，初级下电时序 - 选项 2

6.10.2.6 独立的 MCU 域和 Main 域，仅 MCU 时序的进入和退出

进入仅 MCU 状态是通过执行断电序列实现的，保持通电的 4 个 MCU 域除外。退出仅 MCU 状态是通过执行上电序列实现的，4 个 MCU 域在整个序列中保持通电状态。

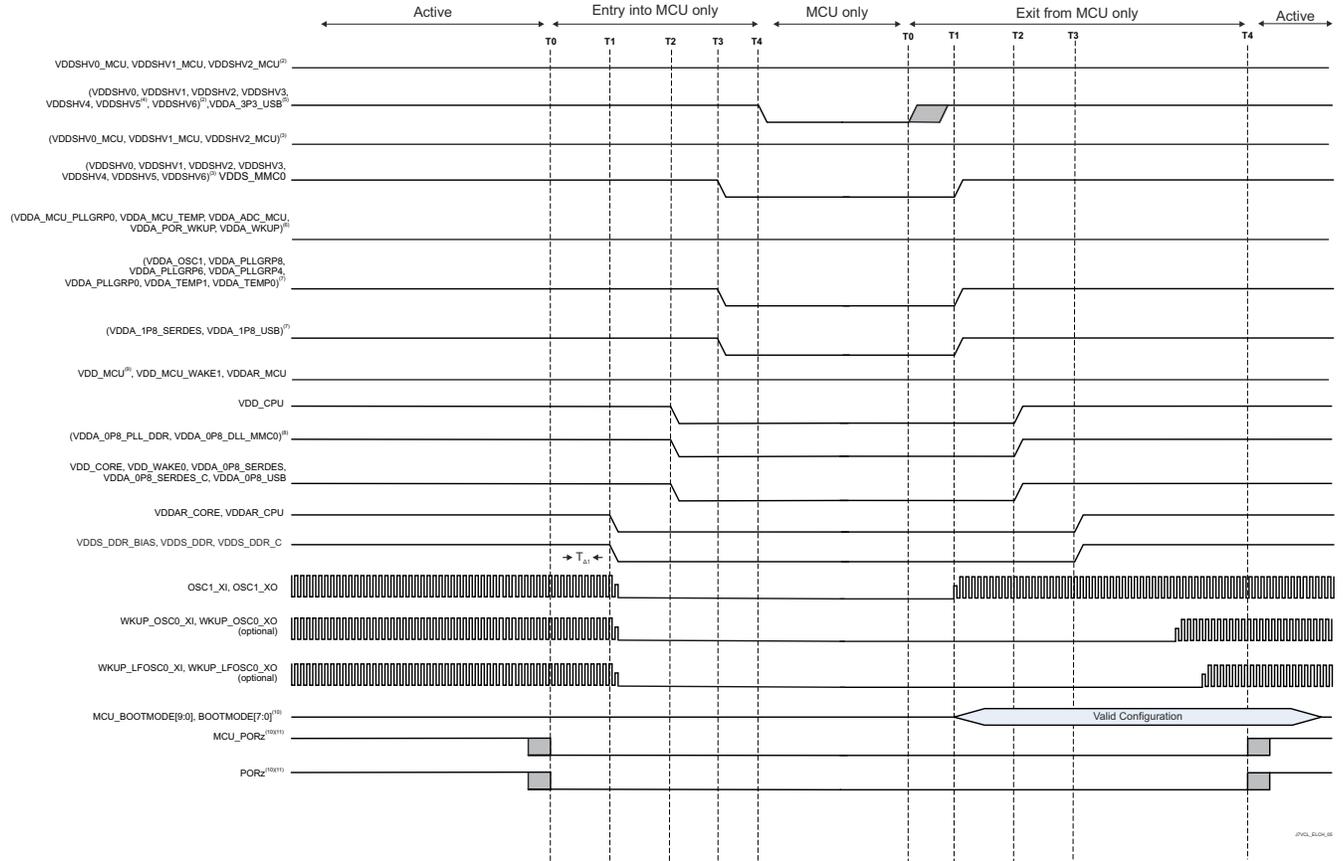


图 6-9. 独立的 MCU 域和 Main 域，仅 MCU 时序的进入和退出

6.10.2.7 独立的 MCU 域和 Main 域，DDR 保持状态的进入和退出

进入 DDR 保持状态是通过执行断电序列实现的，保持通电的 4 个 DDR 域除外。退出 DDR 保持状态是通过执行上电序列实现的，3 个 DDR 域在整个序列中保持通电状态。

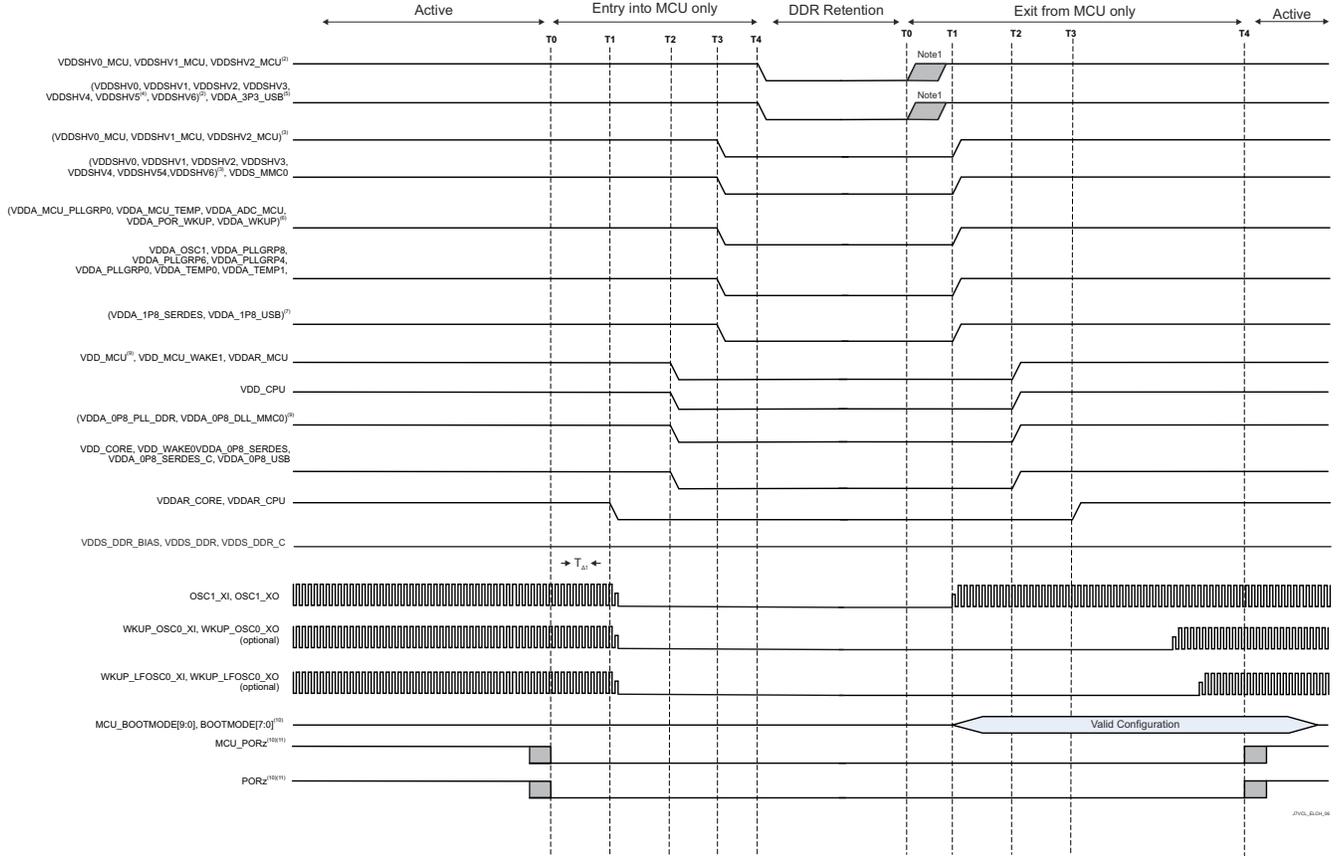


图 6-10. 独立的 MCU 域和 Main 域，DDR 保持状态的进入和退出

6.10.2.8 独立的 MCU 域和 Main 域，GPIO 保持时序的进入和退出

进入 GPIO 保持状态是通过执行断电序列实现的，保持通电的 2 个或 4 个唤醒域除外。退出 GPIO 保持状态是通过执行上电序列实现的，2 个或 4 个唤醒 DDR 域在整个序列中保持通电状态。

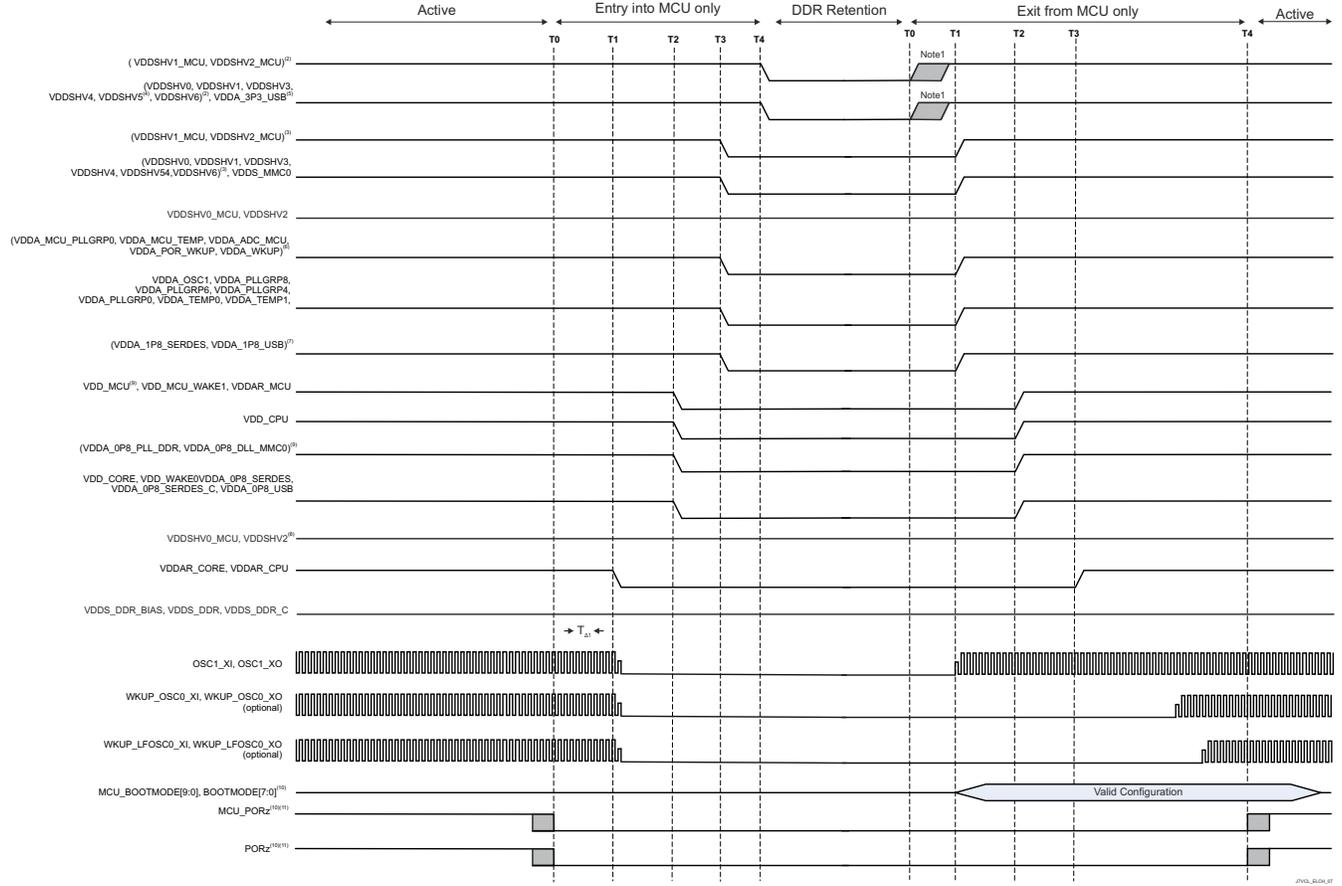


图 6-11. 独立的 MCU 域和 Main 域，GPIO 保持时序的进入和退出

6.10.3 系统时序

如需进一步详细了解子系统多路复用信号的特性和其他说明信息，请参阅[信号说明](#)中的相应小节。

6.10.3.1 复位时序

本节中提供的表和图定义了复位相关信号的时序条件、时序要求和开关特性。

表 6-5. 复位时序条件

| 参数 | | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----------------|--------|---------------------------|--------|------|
| 输入条件 | | | | |
| SR _i | 输入压摆率 | VDD ⁽¹⁾ = 1.8V | 0.0018 | V/ns |
| | | VDD ⁽¹⁾ = 3.3V | 0.0033 | V/ns |
| 输出条件 | | | | |
| C _L | 输出负载电容 | | 30 | pF |

(1) VDD 表示相应的电源。有关电源名称和相应焊球的更多信息，请参阅[引脚属性表](#)的“电源”列。

表 6-6. MCU_PORz 时序要求

请参阅[图 6-12](#)

| 编号 | | 保持时间, 在所有 MCU 域电源有效之后 MCU_PORz 在上电时有效 (低电平) (使用外部晶体) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|------|--|--|-------------------------|---------|-----|----|
| RST1 | $t_{h}(\text{MCUD_SUPPLIES_VALID} - \text{MCU_PORz})$ | 保持时间, 在所有 MCU 域电源 ⁽¹⁾ 有效且外部时钟稳定之后 MCU_PORz 在上电时有效 (低电平) (使用外部 LVCMOS 振荡器) | N + 1200 ⁽²⁾ | 9500000 | | ns |
| RST2 | | 最小脉冲宽度, 在上电之后 MCU_PORz 为低电平 (不移除电源或系统基准时钟 MCU_OSC0_XI/XO) | 1200 | | | ns |
| RST3 | $t_{w}(\text{MCU_PORzL})$ | | 1200 | | | ns |

(1) 有关 MCU 域电源的定义，请参阅[组合式 MCU 域和 Main 域上电时序](#)。

(2) N = 振荡器启动时间

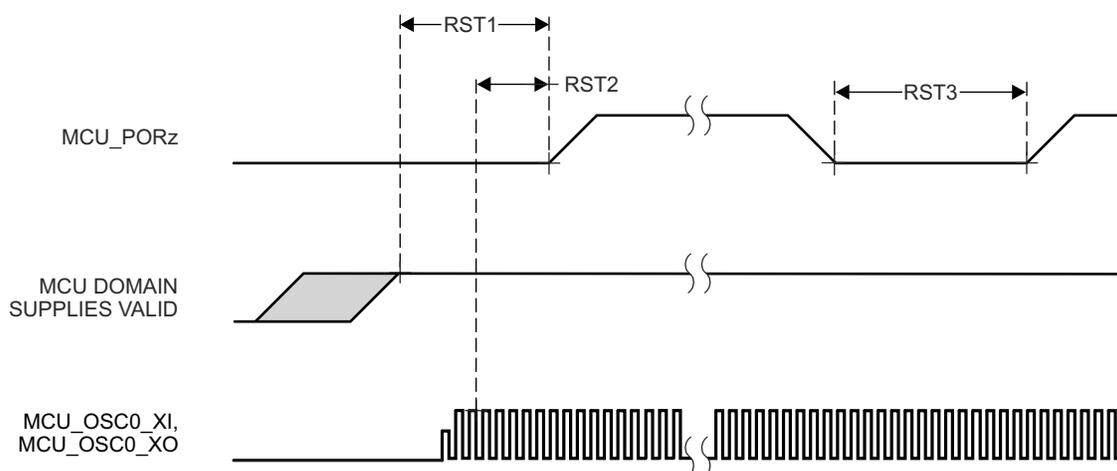


图 6-12. MCU_PORz 时序要求

表 6-7. PORz 时序要求

请参阅图 6-13

| 编号 | | | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|------|--|--|------|-----|----|
| RST4 | $t_{h(MAIND_SUPPLIES_VALID - PORz)}$ | 保持时间, 在所有 MAIN 域电源 ⁽¹⁾ 有效之后 PORz 在上电时有效 (低电平) | 1200 | | ns |
| RST5 | $t_{w(PORzL)}$ | 最小脉冲宽度, 在上电之后 PORz 为低电平 | 1200 | | ns |

(1) 有关 MAIN 域电源的定义, 请参阅组合式 MCU 域和 Main 域上电时序。

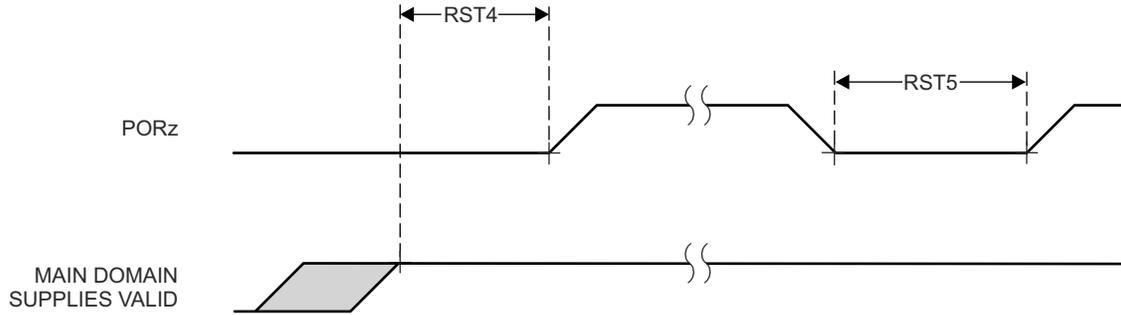


图 6-13. PORz 时序要求

表 6-8. MCU_PORz 启动 ; MCU_PORz_OUT、PORz_OUT、MCU_RESESTATz 和 RESESTATz 开关特性

请参阅图 6-14

| 编号 | 参数 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------|-------------------------------------|---------|-------------------|-----|----|
| RST6 | $t_{d(MCU_PORzL-MCU_PORz_OUTL)}$ | | 0 | | ns |
| RST7 | $t_{d(MCU_PORzH-MCU_PORz_OUTH)}$ | | 0 | | ns |
| RST8 | $t_{d(MCU_PORzL-PORz_OUTL)}$ | | 0 | | ns |
| RST9 | $t_{d(MCU_PORzH-PORz_OUTH)}$ | | 1500 | | ns |
| RST10 | $t_{d(MCU_PORzL-MCU_RESESTATzL)}$ | | 0 | | ns |
| RST11 | $t_{d(MCU_PORzH-MCU_RESESTATzH)}$ | POST 旁路 | $12000 * S^{(1)}$ | | ns |
| RST12 | $t_{d(MCU_PORzL-RESESTATzL)}$ | | 0 | | ns |
| RST13 | $t_{d(MCU_PORzH-RESESTATzH)}$ | | $14500 * S^{(1)}$ | | ns |
| RST14 | $t_{w(MCU_PORz_OUTL)}$ | | 1200 | | ns |
| RST15 | $t_{w(PORz_OUTL)}$ | | 2550 | | ns |
| RST16 | $t_{w(MCU_RESESTATzL)}$ | | $3900 * S^{(1)}$ | | ns |
| RST17 | $t_{w(RESESTATzL)}$ | | $2650 * S^{(1)}$ | | ns |

(1) $S = MCU_OSC0_XI/XO$ 时钟周期。

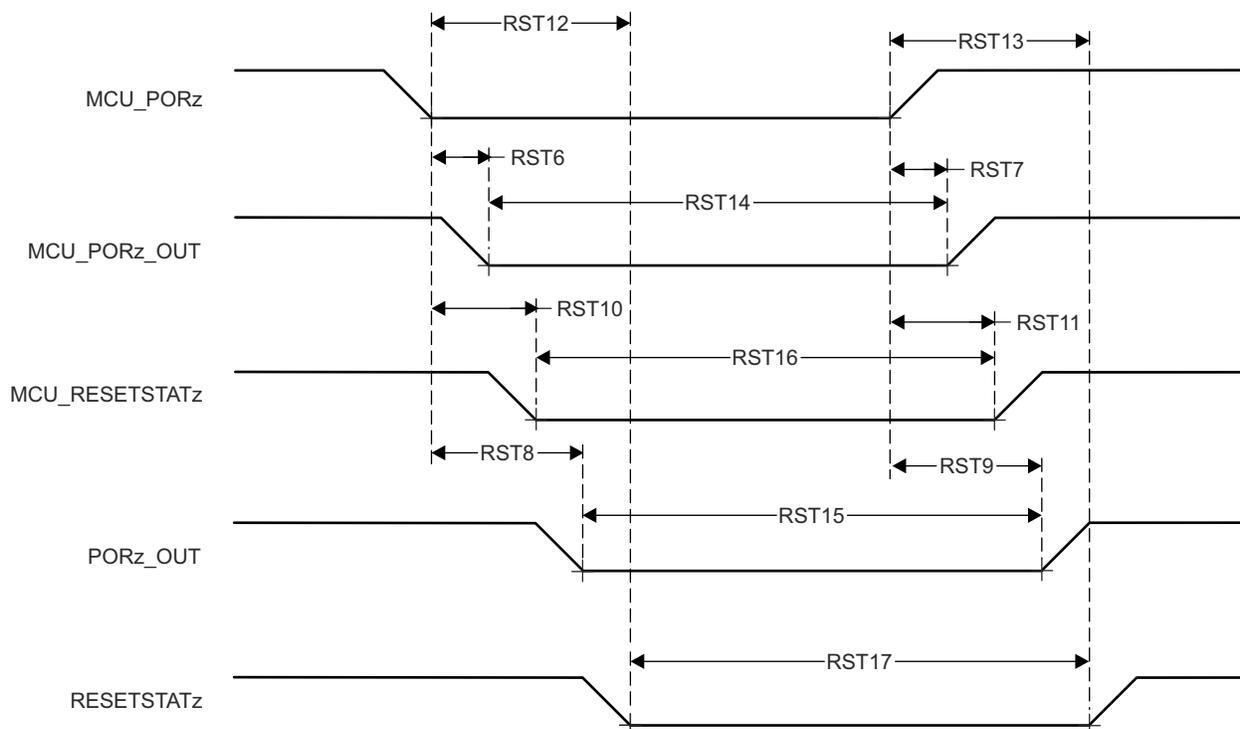


图 6-14. MCU_PORz 启动 ; MCU_PORz_OUT、PORz_OUT、MCU_RESETSTATz 和 RESETSTATz 开关特性

表 6-9. PORz 启动 ; PORz_OUT 和 RESETSTATz 开关特性

请参阅图 6-15

| 编号 | 参数 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------|----------------------------|---|------------------------|-----|----|
| RST18 | $t_{d(PORzL-PORz_OUTL)}$ | POR_RST_ISO_DONE_Z 的软件控制 | $T^{(1)}$ | | |
| | | CTRLMMR_WKUP_POR_RST_CTRL[0].POR_RST_ISO_DONE_Z = 0 | 0 | | ns |
| RST19 | $t_{d(PORzH-PORz_OUTH)}$ | | 1300 | | ns |
| RST20 | $t_{d(PORzL-RESETSTATzL)}$ | | $T^{(1)}$ | | |
| | | CTRLMMR_WKUP_POR_RST_CTRL[0].POR_RST_ISO_DONE_Z = 0 | 0 | | ns |
| RST21 | $t_{d(PORzH-RESETSTATzH)}$ | | 14500*S ⁽²⁾ | | ns |

- (1) T = 复位隔离时间 (取决于软件)。
 (2) S = MCU_OSC0_XI/XO 时钟周期。

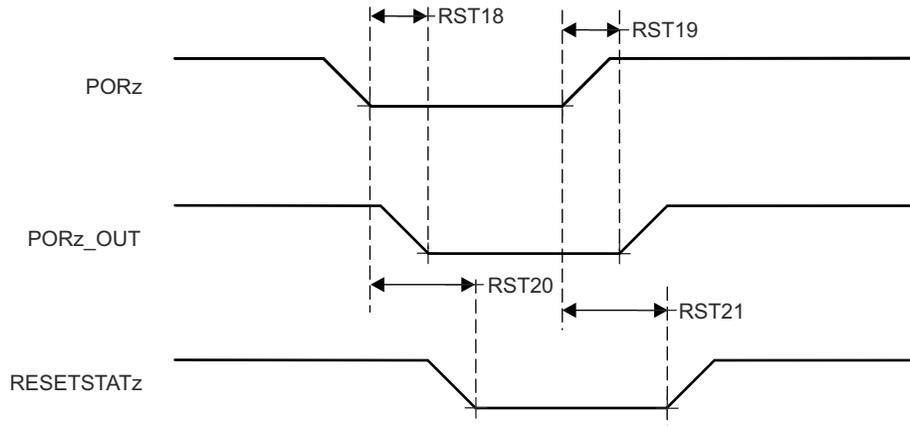


图 6-15. PORz 启动 ; PORz_OUT 和 RESETSTATz 开关特性

表 6-10. MCU_RESEZt 时序要求

请参阅图 6-16

| 编号 | 参数 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------|------|-----|----|
| RST22 | $t_{w(MCU_RESEZt)}$ ⁽¹⁾ | 最小脉冲宽度, MCU_RESEZt 有效 (低电平) | 1200 | | ns |

(1) 仅当所有电源有效且 MCU_PORz 已在指定时间内置为有效后, MCU_RESEZt 的时序才有效。

表 6-11. MCU_RESEZt 启动 ; MCU_RESEZSTATz 和 RESETSTATz 开关特性

请参阅图 6-16

| 编号 | 参数 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------|--|---|-----------------------|-----|----|
| RST23 | $t_{d(MCU_RESEZtL-MCU_RESEZSTATzL)}$ | 延迟时间, MCU_RESEZt 有效 (低电平) 到 MCU_RESEZSTATz 有效 (低电平) | 800 | | ns |
| RST24 | $t_{d(MCU_RESEZtH-MCU_RESEZSTATzH)}$ | 延迟时间, MCU_RESEZt 无效 (高电平) 到 MCU_RESEZSTATz 无效 (高电平) | 3900*S ⁽¹⁾ | | ns |
| RST25 | $t_{d(MCU_RESEZtL-RESETSTATzL)}$ | 延迟时间, MCU_RESEZt 有效 (低电平) 到 RESETSTATz 有效 (低电平) | 800 | | ns |
| RST26 | $t_{d(MCU_RESEZtH-RESETSTATzH)}$ | 延迟时间, MCU_RESEZt 无效 (高电平) 到 RESETSTATz 无效 (高电平) | 3900*S ⁽¹⁾ | | ns |

(1) S = MCU_OSC0_XI/XO 时钟周期。

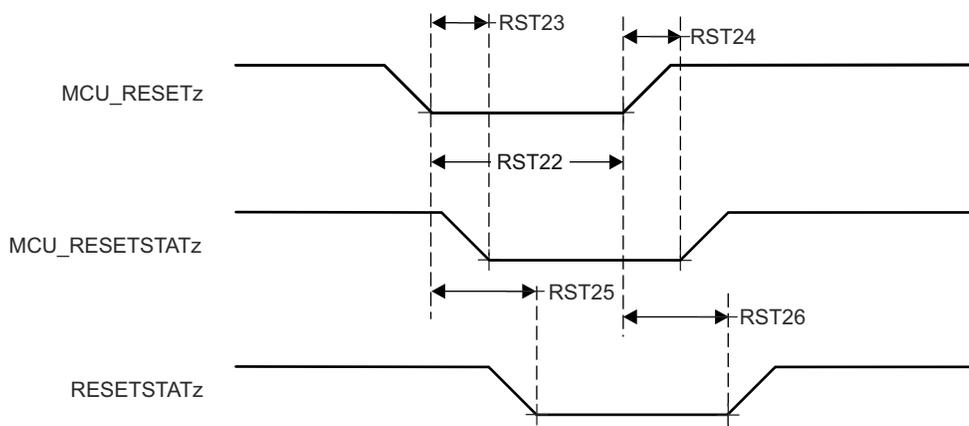


图 6-16. MCU_RESEZt 启动 ; MCU_RESEZSTATz 和 RESETSTATz 时序要求和开关特性

表 6-12. RESET_REQz 时序要求

请参阅图 6-17

| 编号 | 参数 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------|------|-----|----|
| RST27 | $t_{w(RESSET_REQzL)}$ ⁽¹⁾ | 最小脉冲宽度, RESET_REQz 有效 (低电平) | 1200 | | ns |

(1) 仅当所有电源有效且 MCU_PORz 已在指定时间内置为有效后, RESET_REQz 的时序才有效。

表 6-13. RESET_REQz 启动 ; RESETSTATz 开关特性

请参阅图 6-17

| 编号 | 参数 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------|-------------------------------------|---|-----------------------|-----|----|
| RST28 | $t_{d(RESSET_REQzL-RESSETSTATzL)}$ | SOC_WARMRST_ISO_DONE_Z 的软件控制 | T ⁽¹⁾ | | |
| | | CTRLMMR_WKUP_MAIN_WARM_RST_CTRL[0].SOC_WARMRST_ISO_DONE_Z = 0 | 740 | | ns |
| RST29 | $t_{d(RESSET_REQzH-RESSETSTATzH)}$ | 延迟时间, RESET_REQz 无效 (高电平) 到 RESETSTATz 无效 (高电平) | 2650*S ⁽²⁾ | | ns |

- (1) T = 复位隔离时间 (取决于软件)。
 (2) S = MCU_OSC0_XI/XO 时钟周期。

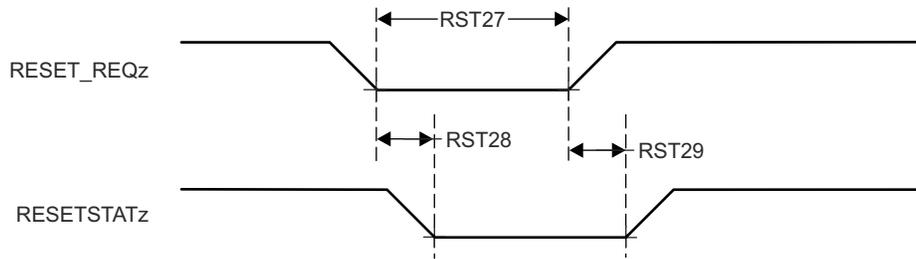


图 6-17. RESET_REQz 启动 ; RESETSTATz 时序要求和开关特性

表 6-14. EMUx 时序要求

请参阅图 6-18

| 编号 | | | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------|--------------------------|--------------------------------------|-------------|-----|----|
| RST30 | $t_{su}(EMUx-MCU_PORz)$ | 建立时间, MCU_PORz 无效 (高电平) 之前的 EMU[1:0] | $3*S^{(1)}$ | | ns |
| RST31 | $t_h(MCU_PORz - EMUx)$ | 保持时间, MCU_PORz 无效 (高电平) 之后的 EMU[1:0] | 10 | | ns |

(1) S = MCU_OSC0_XI/XO 时钟周期。

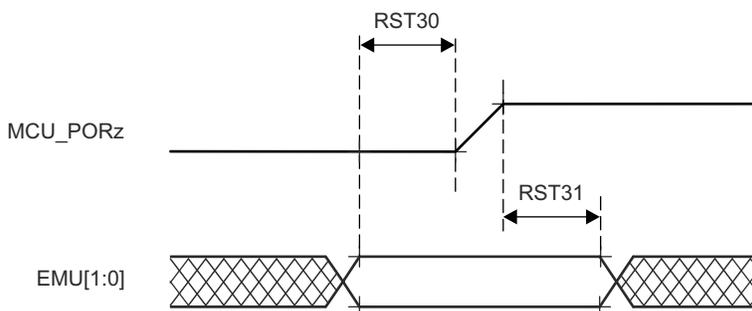


图 6-18. EMUx 时序要求

表 6-15. MCU_BOOTMODE 时序要求

请参阅图 6-19

| 编号 | | | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------|--|--|-------------|-----|----|
| RST32 | $t_{su}(MCU_BOOTMODE-MCU_PORz_OUT)$ | 建立时间, 在 MCU_PORz_OUT 高电平之前 MCU_BOOTMODE[09:00] | $3*S^{(1)}$ | | ns |
| RST33 | $t_h(MCU_PORz_OUT - MCU_BOOTMODE)$ | 保持时间, 在 MCU_PORz_OUT 高电平之后 MCU_BOOTMODE[09:00] | 0 | | ns |

(1) S = MCU_OSC0_XI/XO 时钟周期。

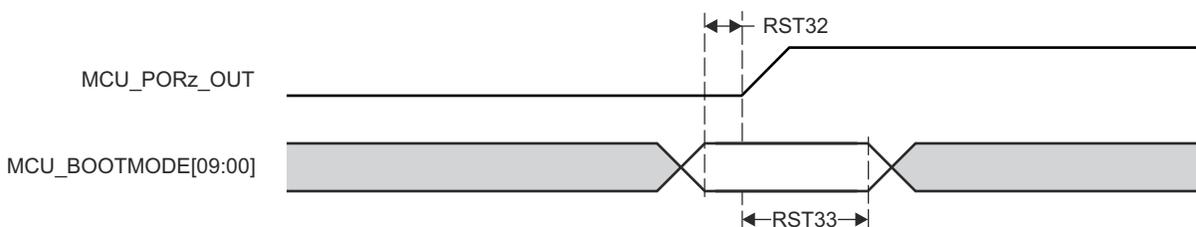


图 6-19. MCU_BOOTMODE 时序要求

表 6-16. BOOTMODE 时序要求

请参阅图 6-20

| 编号 | | | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----|----|
| RST34 | $t_{su}(\text{BOOTMODE-PORz_OUT})$ | 建立时间，在 PORz_OUT 高电平之前 BOOTMODE[7:0] | $3 \cdot S^{(1)}$ | | ns |
| RST35 | $t_h(\text{PORz_OUT - BOOTMODE})$ | 保持时间，在 PORz_OUT 高电平之后 BOOTMODE[7:0] | 0 | | ns |

(1) S = MCU_OSC0_XI/XO 时钟周期。

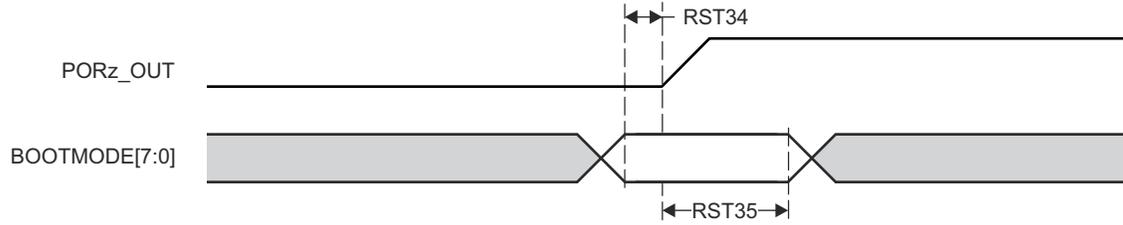


图 6-20. BOOTMODE 时序要求

6.10.3.2 安全信号时序

本节中提供的表和图定义了 MCU_SAFETY_ERRORn 和 SOC_SAFETY_ERRORn 的时序条件、开关特性。

表 6-17. 错误信号时序条件

| 参数 | | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----------------|--------|-----|-----|------|
| 输入条件 | | | | |
| SR _I | 输入压摆率 | 0.5 | 2 | V/ns |
| 输出条件 | | | | |
| C _L | 输出负载电容 | 3 | 30 | pF |

表 6-18. MCU_SAFETY_ERRORn 开关特性

请参阅图 6-21

| 编号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------|--|-----------------------|-----|----|
| SFTY1 | $t_{w(\text{MCU_SAFETY_ERRORn})}$ 最小脉冲宽度, MCU_SAFETY_ERRORn 有效 (禁用 PWM 模式) | $P \cdot R^{(1) (2)}$ | | ns |
| SFTY2 | $t_{d(\text{ERROR_CONDITION-MCU_SAFETY_ERRORnL})}$ 延迟时间, 错误条件到 MCU_SAFETY_ERRORn 有效 | $50 \cdot P^{(1)}$ | | ns |

(1) P = ESM 功能时钟 (MCU_SYSCLK0 /6)。

(2) R = 错误引脚计数器预加载寄存器计数值。

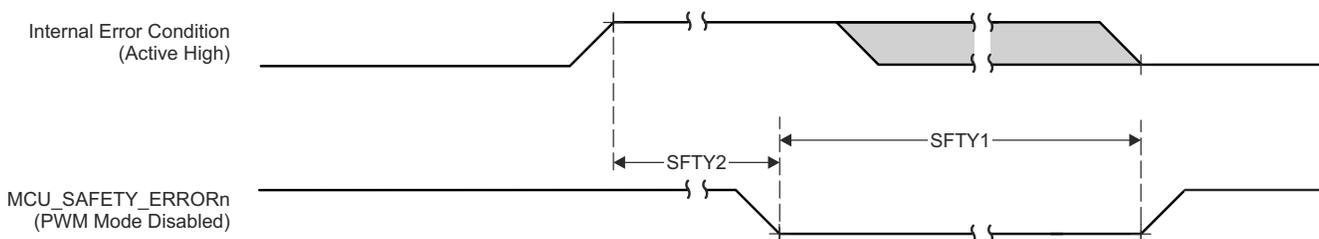


图 6-21. MCU_SAFETY_ERRORn 开关特性

表 6-19. SOC_SAFETY_ERRORn 开关特性

请参阅图 6-22

| 编号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------|--|-----------------------|-----|----|
| SFTY3 | $t_{w(\text{SOC_SAFETY_ERRORn})}$ 最小脉冲宽度, SOC_SAFETY_ERRORn 有效 (禁用 PWM 模式) | $P \cdot R^{(1) (2)}$ | | ns |
| SFTY4 | $t_{d(\text{ERROR_CONDITION-SOC_SAFETY_ERRORnL})}$ 延迟时间, 错误条件到 SOC_SAFETY_ERRORn 有效 | $50 \cdot P^{(1)}$ | | ns |

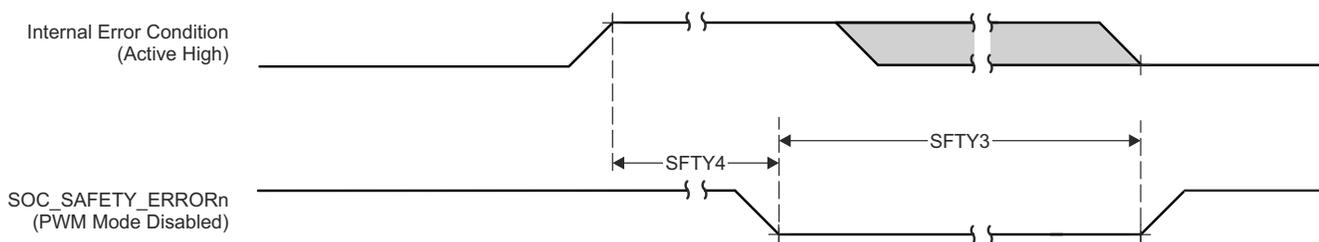


图 6-22. SOC_SAFETY_ERRORn 开关特性

6.10.3.3 时钟时序

本节中提供的表和图定义了时钟信号的时序条件、时序要求和开关特性。

表 6-20. 时钟时序条件

| 参数 | | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----------------|--------|-----|-----|------|
| 输入条件 | | | | |
| SR _I | 输入压摆率 | 0.5 | 2 | V/ns |
| 输出条件 | | | | |
| C _L | 输出负载电容 | 3 | 30 | pF |

表 6-21. 时钟时序要求

请参阅图 6-23

| 编号 | 参数 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| CLK1 | t _c (EXT_REFCLK1) | 最小周期时间, EXT_REFCLK1 | 10 | | ns |
| CLK2 | t _w (EXT_REFCLK1H) | 最小脉冲持续时间, EXT_REFCLK1 高电平 | E*0.45 ⁽¹⁾ | E*0.55 ⁽¹⁾ | ns |
| CLK3 | t _w (EXT_REFCLK1L) | 最小脉冲持续时间, EXT_REFCLK1 低电平 | E*0.45 ⁽¹⁾ | E*0.55 ⁽¹⁾ | ns |

(1) E = EXT_REFCLK1 周期时间。

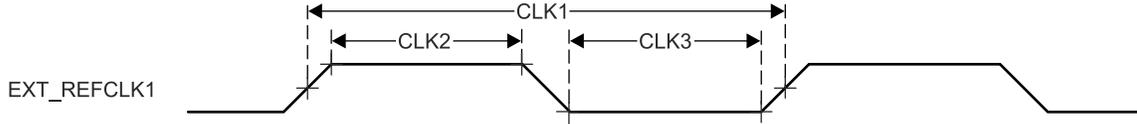


图 6-23. 时钟时序要求

表 6-22. 时钟开关特性

请参阅图 6-24

| 编号 | 参数 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------|------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----|
| CLK4 | t _c (SYSCLKOUT0) | 最小周期时间, SYSCLKOUT0 | 8 | | ns |
| CLK5 | t _w (SYSCLKOUT0H) | 最小脉冲持续时间, SYSCLKOUT0 高电平 | A*0.4 ⁽¹⁾ | A*0.6 ⁽¹⁾ | ns |
| CLK6 | t _w (SYSCLKOUT0L) | 最小脉冲持续时间, SYSCLKOUT0 低电平 | A*0.4 ⁽¹⁾ | A*0.6 ⁽¹⁾ | ns |
| CLK7 | t _c (OBSCLK0) | 最小周期时间, OBSCLK0 | 5 | | ns |
| CLK8 | t _w (OBSCLK0H) | 最小脉冲持续时间, OBSCLK0 高电平 | B*0.4 ⁽²⁾ | B*0.6 ⁽²⁾ | ns |
| CLK9 | t _w (OBSCLK0L) | 最小脉冲持续时间, OBSCLK0 低电平 | B*0.4 ⁽²⁾ | B*0.6 ⁽²⁾ | ns |
| CLK10 | t _c (CLKOUT0) | 最小周期时间, CLKOUT0 | 20 | | ns |
| CLK11 | t _w (CLKOUT0H) | 最小脉冲持续时间, CLKOUT0 高电平 | C*0.4 ⁽³⁾ | C*0.6 ⁽³⁾ | ns |
| CLK12 | t _w (CLKOUT0L) | 最小脉冲持续时间, CLKOUT0 低电平 | C*0.4 ⁽³⁾ | C*0.6 ⁽³⁾ | ns |

(1) A = SYSCLKOUT0 周期时间。

(2) B = OBSCLK0 周期时间。

(3) C = CLKOUT0 周期时间。

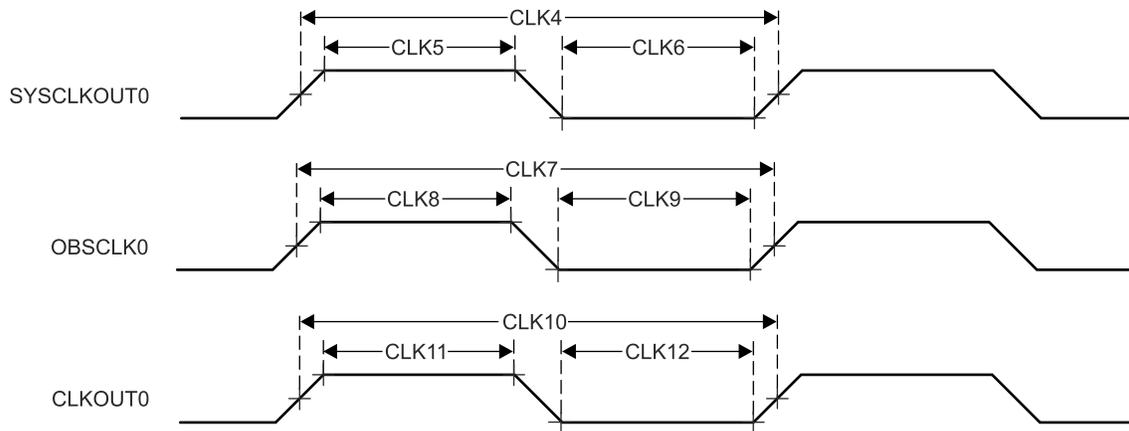


图 6-24. 时钟开关特性

6.10.4 时钟规格

6.10.4.1 输入和输出时钟/振荡器

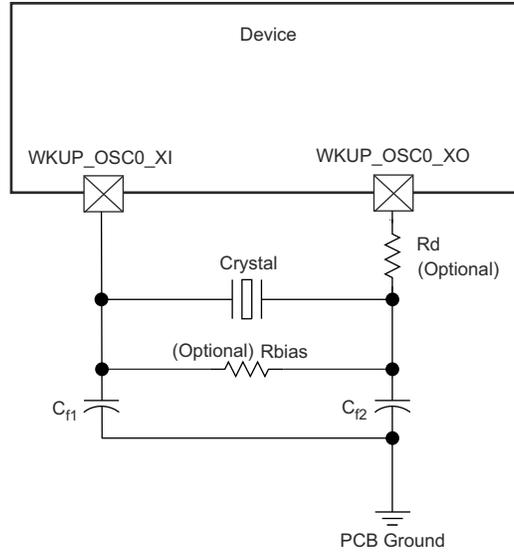
需要使用各种外部时钟输入/输出来驱动器件。这些输入时钟信号总结如下：

- 高频振荡器输入
 - OSC1_XO/OSC1_XI - 连接到内部振荡器的外部主晶体接口引脚，该振荡器用作基准时钟源。为 MCU 域和 MAIN 域内的 PLL 提供基准时钟。此高频振荡器用于向 MCASP 提供音频时钟频率。
 - WKUP_OSC0_XO/WKUP_OSC0_XI - 连接到内部振荡器的外部主晶体接口引脚，该振荡器用作基准时钟源。为 WKUP 和 MAIN 域内的 PLL 提供基准时钟。
- 低频数字输入
 - WKUP_LF_CLKIN - 低频 32k 数字时钟输入，可选择源自于外部 PMIC 或其他时钟源。该 SoC 不支持 LFOSC 晶体输入。
- 通用时钟输入
 - MCU_EXT_REFCLK0 - 可选外部系统时钟输入 (MCU 域)。
 - EXT_REFCLK1 - 可选外部系统时钟输入 (MAIN 域)。
- 外设时钟 - 请参阅外设特定时钟的“信号说明”

有关输入时钟接口的详细信息，请参阅器件 TRM 的器件配置一章中的时钟一节。

6.10.4.1.1 WKUP_OSC0 内部振荡器时钟源

图 6-25 展示了建议的晶体电路。用于实现振荡器电路的所有分立元件应尽可能靠近 WKUP_OSC0_XI 和 WKUP_OSC0_XO 引脚放置。



J7ES_WKUP_OSC0_INT_02

图 6-25. WKUP_OSC0 晶体实现

晶体必须处于基本工作模式并且并联谐振。表 6-23 总结了所需的电气约束。

表 6-23. WKUP_OSC0 晶体电气特性

| 参数 | | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|--|-----------|----------|----|
| F_{xtal} | 晶体并联谐振频率 | 19.2、20、24、25、26、27 | | | MHz | |
| F_{xtal} | 晶体频率稳定性和容差 | 未使用以太网 RGMII 和 RMII | | ± 100 | ppm | |
| | | RGMII 和 RMII 使用衍生的时钟 | | ± 50 | | |
| $C_{L1+PCBX1}$ | $C_{L1} + C_{PCBX1}$ 电容 | 12 | | 24 | pF | |
| $C_{L2+PCBX0}$ | $C_{L2} + C_{PCBX0}$ 电容 | 12 | | 24 | pF | |
| C_L | 晶体负载电容 | 6 | | 12 | pF | |
| C_{shunt} | 晶体电路并联电容 | 19.2MHz、20MHz | $ESR_{xtal} \leq 30\Omega$ | | 7 | pF |
| | | | $30\Omega < ESR_{xtal} \leq 80\Omega$ | | 5 | pF |
| | | | $80\Omega < ESR_{xtal} \leq 100\Omega$ | | 3 | pF |
| | | 24MHz | $ESR_{xtal} \leq 30\Omega$ | | 7 | pF |
| | | | $30\Omega < ESR_{xtal} \leq 60\Omega$ | | 5 | pF |
| | | | $60\Omega < ESR_{xtal} \leq 80\Omega$ | | 3 | pF |
| | | | 不支持： $80\Omega \leq ESR_{xtal}$ | | - | |
| | | 25MHz | $ESR_{xtal} \leq 30\Omega$ | | 7 | pF |
| | | | $30\Omega < ESR_{xtal} \leq 50\Omega$ | | 5 | pF |
| | | | $50\Omega < ESR_{xtal} \leq 80\Omega$ | | 3 | pF |
| | | | 不支持： $80\Omega \leq ESR_{xtal}$ | | - | |
| | | 26MHz、27MHz | $ESR_{xtal} \leq 30\Omega$ | | 7 | pF |
| $30\Omega < ESR_{xtal} \leq 50\Omega$ | | | 5 | pF | | |
| 不支持： $50\Omega \leq ESR_{xtal}$ | | | - | | | |
| ESR_{xtal} | 晶体有效串联电阻 | | | (1) | Ω | |

(1) 晶体的最大 ESR 是晶体频率和并联电容的函数。请参阅 C_{shunt} 参数。

选择晶体时，系统设计必须根据最坏情况和系统预期寿命来考虑温度和老化特性。

表 6-24 详细说明了振荡器的开关特性和输入时钟的要求。

表 6-24. WKUP_OSC0 开关特性 - 晶体模式

| 参数 | | 封装 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|------------|-------------|-----|-----|--------------------|-------|----|
| C_{X1} | XI 电容 | ALY | | | 2.241 | pF |
| C_{X0} | XO 电容 | ALY | | | 2.210 | pF |
| C_{X1X0} | XI 至 XO 互电容 | ALY | | | 0.01 | pF |
| t_s | 启动时间 | | | 9.5 ⁽¹⁾ | | ms |

(1) TI 强烈建议每个客户向谐振器/晶体供应商提交器件样品以便于进行验证。供应商有办法确定多大的负载电容器能够最好地调节他们的谐振器/晶振，从而使微控制器能够在温度/电压极值范围内实现最佳启动和运行。

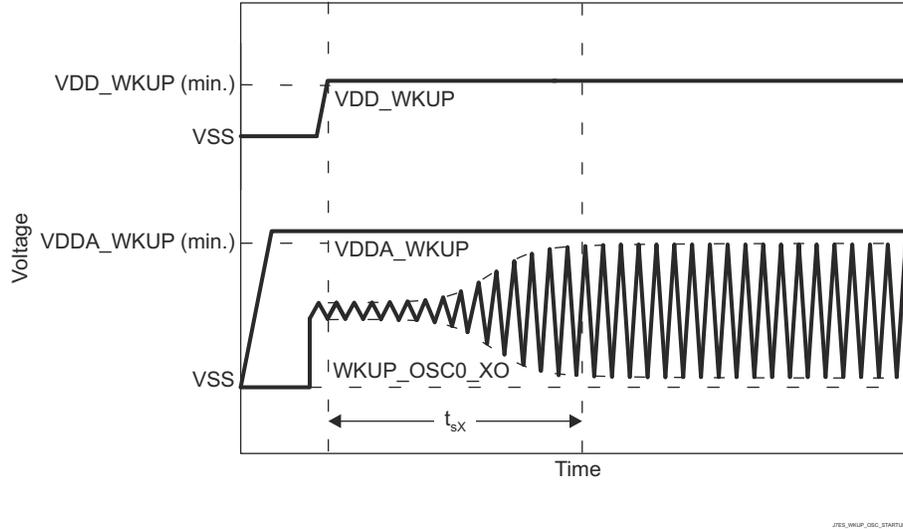


图 6-26. WKUP_OSC0 启动时间

6.10.4.1.1.1 负载电容

晶体电路的设计必须能够向晶体施加适当的容性负载，如晶体制造商所定义的。该电路的容性负载 C_L 是分立式电容器 C_{L1} 、 C_{L2} 以及一些寄生电容的组合。将晶体电路元件到 WKUP_OSC0_XI 和 WKUP_OSC0_XO 的 PCB 信号引线具有接地寄生电容、 C_{PCBXI} 和 C_{PCBXO} ，PCB 设计人员应该能够提取每条信号引线的寄生电容。WKUP_OSC0 电路和器件封装具有组合的接地寄生电容、 C_{PCBXI} 和 C_{PCBXO} ，表 6-24 定义了这些寄生电容值。

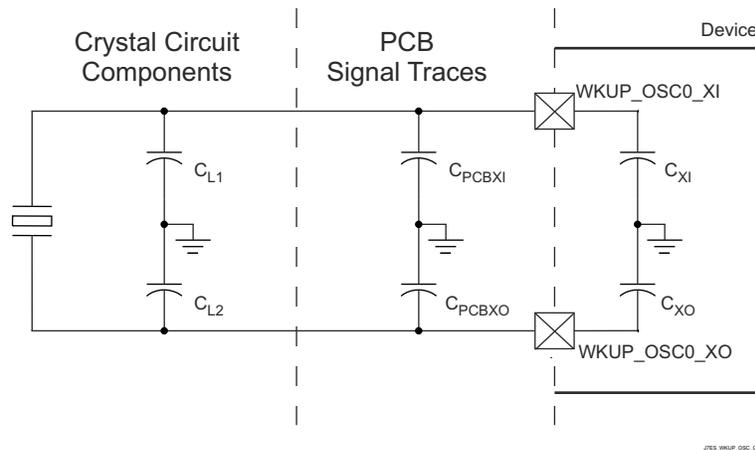


图 6-27. 负载电容

在选择图 6-25 中的负载电容器 C_{L1} 和 C_{L2} 时应满足以下公式。公式中的 C_L 是晶体制造商指定的负载。

$$C_L = [(C_{L1} + C_{PCBXI} + C_{XI}) \times (C_{L2} + C_{PCBXO} + C_{XO})] / [(C_{L1} + C_{PCBXI} + C_{XI}) + (C_{L2} + C_{PCBXO} + C_{XO})]$$

要确定 C_{L1} 和 C_{L2} 的值，请将容性负载值 C_L 乘以 2。使用该结果，减去 $C_{PCBXI} + C_{XI}$ 的组合值可确定 C_{L1} 的值，减去 $C_{PCBXO} + C_{XO}$ 的组合值可确定 C_{L2} 的值。例如，如果 $C_L = 10\text{pF}$ ， $C_{PCBXI} = 2.9\text{pF}$ ， $C_{XI} = 0.5\text{pF}$ ， $C_{PCBXO} = 3.7\text{pF}$ ， $C_{XO} = 0.5\text{pF}$ ，则 C_{L1} 的值 = $[(2C_L) - (C_{PCBXI} + C_{XI})] = [(2 \times 10\text{pF}) - 2.9\text{pF} - 0.5\text{pF}] = 16.6\text{pF}$ ， $C_{L2} = [(2C_L) - (C_{PCBXO} + C_{XO})] = [(2 \times 10\text{pF}) - 3.7\text{pF} - 0.5\text{pF}] = 15.8\text{pF}$

6.10.4.1.1.2 并联电容

晶体电路的设计还必须使其不超过表 6-23 中定义的 WKUP_OSC0 工作条件的最大并联电容。晶体电路的并联电容 C_{shunt} 是晶体并联电容和寄生作用的组合。将晶体电路组件连接到 WKUP_OSC0 的 PCB 信号引线彼此之间存

在互寄生电容 $C_{PCBXIXO}$ ，PCB 设计人员应该能够提取这些信号引线之间的互寄生电容。器件封装还具有互寄生电容 C_{XIXO} ，表 6-24 定义了该互寄生电容值。

PCB 布线的设计应尽量减消 XI 和 XO 信号引线之间的互电容。这通常是通过使信号引线较短并且使其不相互靠近来实现的。当布局要求这些信号靠近布线时，还可以通过在这些信号之间放置接地引线来尽可能减小互电容。在选择晶体时，应尽量减小 PCB 上的互电容以提供尽可能大的裕度，这一点非常重要。

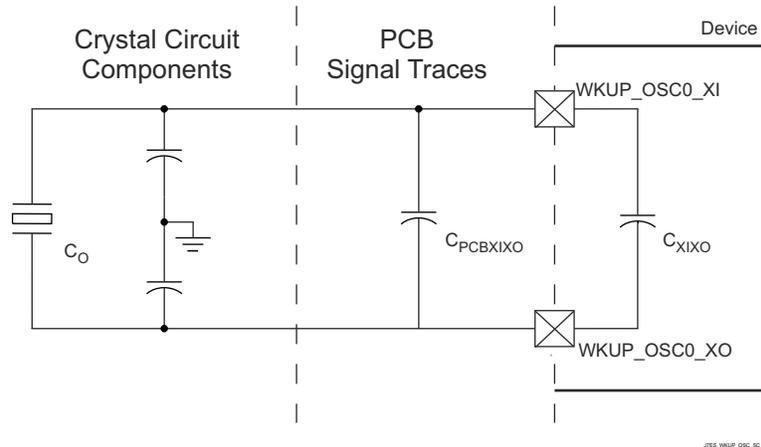


图 6-28. 并联电容

应选择满足以下公式的晶体。公式中的 C_0 是晶体制造商指定的最大并联电容。

$$C_{\text{shunt}} \geq C_0 + C_{PCBXIXO} + C_{XIXO}$$

例如，当所使用的晶体为 25MHz， $ESR = 30\Omega$ ， $C_{PCBXIXO} = 0.04\text{pF}$ ， $C_{XIXO} = 0.01\text{pF}$ ，晶体的并联电容小于或等于 6.95pF 时，应满足该公式。

6.10.4.1.2 WKUP_OSC0 LVCMOS 数字时钟源

图 6-29 展示了当 WKUP_OSC0_XI 连接到 1.8V LVCMOS 方波数字时钟源时建议的振荡器连接。

备注

当振荡器上电时，WKUP_OSC0_XI 上不允许出现直流稳态情况，这是因为 WKUP_OSC0_XI 在内部交流耦合到比较器，当向输入施加直流时，该比较器可能会进入未知状态。因此，只要 WKUP_OSC0_XI 不在不同逻辑状态之间切换，应用软件就应该使 WKUP_OSC0 断电。

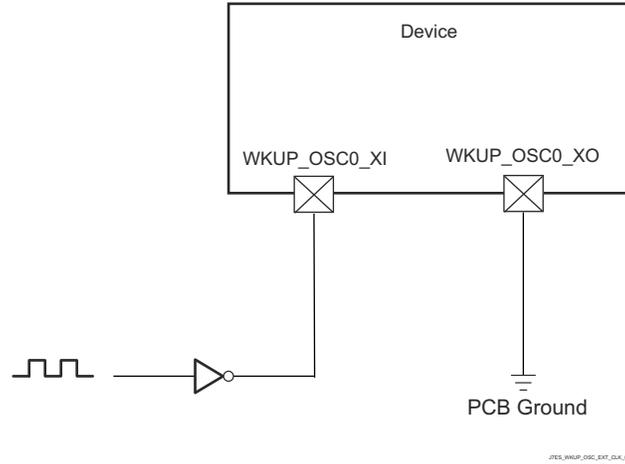


图 6-29. 1.8V LVC MOS 兼容时钟输入

6.10.4.1.3 辅助 OSC1 内部振荡器时钟源

图 6-30 展示了建议的晶体电路。用于实现振荡器电路的所有分立式元件应尽可能靠近 OSC1_XI 和 OSC1_XO 引脚放置。

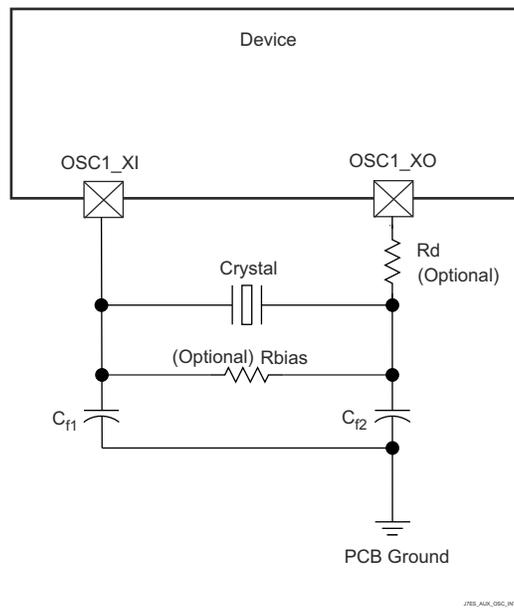


图 6-30. OSC1 晶体实现

晶体必须处于基本工作模式并且并联谐振。表 6-25 总结了所需的电气约束。

表 6-25. OSC1 晶体电气特性

| 参数 | | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|-------------------------|---|--|-----------|----------|----|
| F_{xtal} | 晶体并联谐振频率 | 19.2 | | 27 | MHz | |
| F_{xtal} | 晶体频率稳定性和容差 | 未使用以太网 RGMII 和 RMII | | ± 100 | ppm | |
| | | RGMII 和 RMII 使用衍生的时钟 | | ± 50 | | |
| $C_{L1+PCBXI}$ | $C_{L1} + C_{PCBXI}$ 电容 | 12 | | 24 | pF | |
| $C_{L2+PCBXO}$ | $C_{L2} + C_{PCBXO}$ 电容 | 12 | | 24 | pF | |
| C_L | 晶体负载电容 | 6 | | 12 | pF | |
| C_{shunt} | 晶体电路并联电容 | $19.2\text{MHz} < F_{xtal} \leq 20\text{MHz}$ | $ESR_{xtal} \leq 30\ \Omega$ | | 7 | pF |
| | | | $30\ \Omega < ESR_{xtal} \leq 80\ \Omega$ | | 5 | pF |
| | | | $80\ \Omega < ESR_{xtal} \leq 100\ \Omega$ | | 3 | pF |
| | | $20\text{MHz} < F_{xtal} \leq 24.576\text{MHz}$ | $ESR_{xtal} \leq 30\ \Omega$ | | 7 | pF |
| | | | $30\ \Omega \leq ESR_{xtal} \leq 60\ \Omega$ | | 5 | pF |
| | | | $60\ \Omega < ESR_{xtal} \leq 80\ \Omega$ | | 3 | pF |
| | | | 不支持: $80\ \Omega \leq ESR_{xtal}$ | | - | |
| | | $24.576\text{MHz} < F_{xtal} \leq 25\text{MHz}$ | $ESR_{xtal} \leq 30\ \Omega$ | | 7 | pF |
| | | | $30\ \Omega < ESR_{xtal} \leq 50\ \Omega$ | | 5 | pF |
| | | | $50\ \Omega < ESR_{xtal} \leq 80\ \Omega$ | | 3 | pF |
| | | | 不支持: $80\ \Omega \leq ESR_{xtal}$ | | - | |
| | | $25\text{MHz} < F_{xtal} \leq 27\text{MHz}$ | $ESR_{xtal} \leq 30\ \Omega$ | | 7 | pF |
| $30\ \Omega < ESR_{xtal} \leq 50\ \Omega$ | | | 5 | pF | | |
| 不支持: $50\ \Omega \leq ESR_{xtal}$ | | | - | | | |
| ESR_{xtal} | 晶体有效串联电阻 | | | 100 | Ω | |

选择晶体时，系统设计必须根据最坏情况和系统预期寿命来考虑温度和老化特性。

表 6-26 详细说明了振荡器的开关特性和输入时钟的要求。

表 6-26. OSC1 开关特性 - 晶体模式

| 参数 | | 封装 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|------------|-------------|-----|-----|--------------------|-------|----|
| C_{XI} | XI 电容 | ALY | | | 1.989 | pF |
| C_{XO} | XO 电容 | ALY | | | 1.971 | pF |
| C_{XIXO} | XI 至 XO 互电容 | ALY | | | 0.01 | pF |
| t_s | 启动时间 | | | 9.5 ⁽¹⁾ | | ms |

- (1) TI 强烈建议每个客户向谐振器/晶体供应商提交器件样品以便于进行验证。供应商有办法确定多大的负载电容器能够最好地调节他们的谐振器/晶振，从而使微控制器能够在温度/电压极值范围内实现最佳启动和运行。

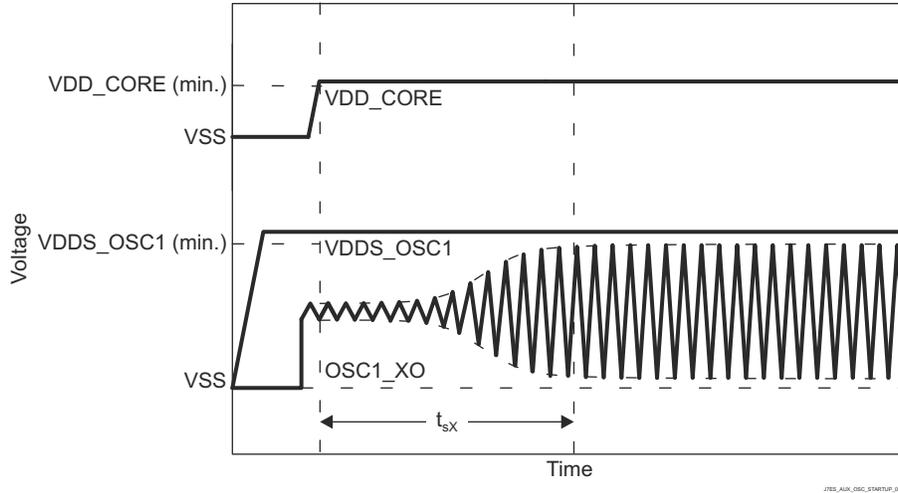


图 6-31. OSC1 启动时间

6.10.4.1.3.1 负载电容

晶体电路的设计必须能够向晶体施加适当的容性负载，如晶体制造商所定义的。该电路的容性负载 C_L 是分立式电容器 C_{L1} 、 C_{L2} 以及一些寄生电容的组合。将晶体电路元件到 $OSC1_{XI}$ 和 $OSC1_{XO}$ 的 PCB 信号引线具有接地寄生电容、 C_{PCBXI} 和 C_{PCBXO} ，PCB 设计人员应该能够提取每条信号引线的寄生电容。 $OSC1$ 电路和器件封装具有组合的接地寄生电容、 C_{PCBXI} 和 C_{PCBXO} ，表 6-26 定义了这些寄生电容值。

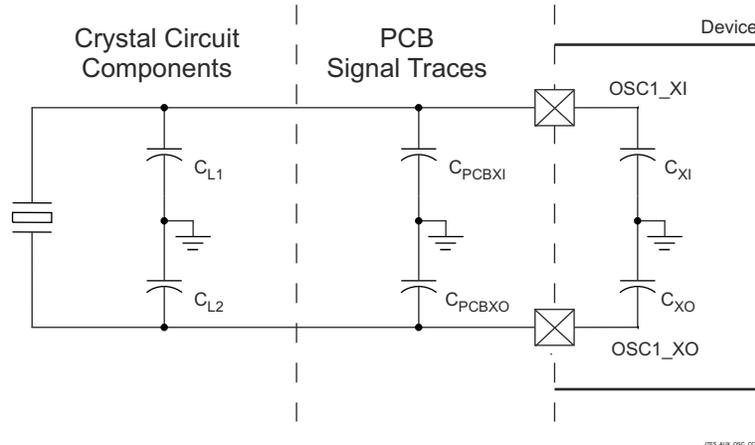


图 6-32. 负载电容

在选择图 6-30 中的负载电容器 C_{L1} 和 C_{L2} 时应满足以下公式。公式中的 C_L 是晶体制造商指定的负载。

$$C_L = [(C_{L1} + C_{PCBXI} + C_{XI}) \times (C_{L2} + C_{PCBXO} + C_{XO})] / [(C_{L1} + C_{PCBXI} + C_{XI}) + (C_{L2} + C_{PCBXO} + C_{XO})]$$

要确定 C_{L1} 和 C_{L2} 的值，请将容性负载值 C_L 乘以 2。使用该结果，减去 $C_{PCBXI} + C_{XI}$ 的组合值可确定 C_{L1} 的值，减去 $C_{PCBXO} + C_{XO}$ 的组合值可确定 C_{L2} 的值。例如，如果 $C_L = 10\text{pF}$ ， $C_{PCBXI} = 2.9\text{pF}$ ， $C_{XI} = 0.5\text{pF}$ ， $C_{PCBXO} = 3.7\text{pF}$ ， $C_{XO} = 0.5\text{pF}$ ，则 C_{L1} 的值 = $[(2C_L) - (C_{PCBXI} + C_{XI})] = [(2 \times 10\text{pF}) - 2.9\text{pF} - 0.5\text{pF}] = 16.6\text{pF}$ ， $C_{L2} = [(2C_L) - (C_{PCBXO} + C_{XO})] = [(2 \times 10\text{pF}) - 3.7\text{pF} - 0.5\text{pF}] = 15.8\text{pF}$

6.10.4.1.3.2 并联电容

晶体电路的设计还必须使其不超过表 6-25 中定义的 $OSC1$ 工作条件的最大并联电容。晶体电路的并联电容 C_{shunt} 是晶体并联电容和寄生作用的组合。将晶体电路组件连接到 $OSC1$ 的 PCB 信号引线彼此之间存在互寄生电容

$C_{PCBXIXO}$, PCB 设计人员应该能够提取这些信号引线之间的互寄生电容。器件封装还具有互寄生电容 C_{XIXO} , 表 6-26 定义了该互寄生电容值。

PCB 布线的设计应尽量减消 XI 和 XO 信号引线之间的互电容。这通常是通过使信号引线较短并且使其不相互靠近来实现的。当布局要求这些信号靠近布线时, 还可以通过在这些信号之间放置接地引线来尽可能减小互电容。在选择晶体时, 应尽量减小 PCB 上的互电容以提供尽可能大的裕度, 这一点非常重要。

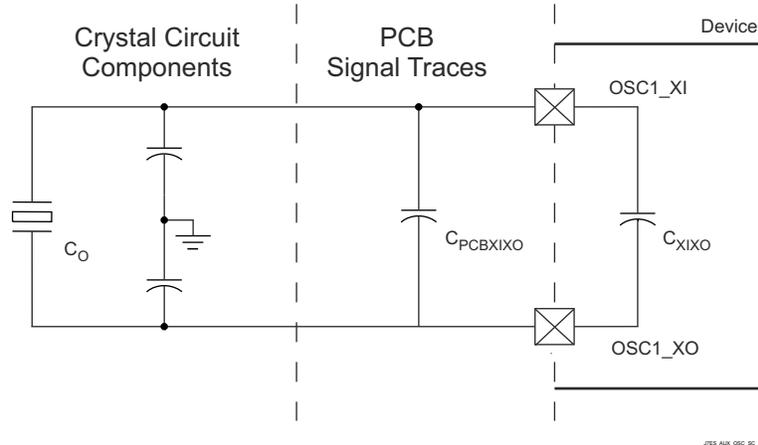


图 6-33. 并联电容

应选择满足以下公式的晶体。公式中的 C_0 是晶体制造商指定的最大并联电容。

$$C_{\text{shunt}} \geq C_0 + C_{PCBXIXO} + C_{XIXO}$$

例如, 当所使用的晶体为 25MHz, $ESR = 30\Omega$, $C_{PCBXIXO} = 0.04\text{pF}$, $C_{XIXO} = 0.01\text{pF}$, 晶体的并联电容小于或等于 6.95pF 时, 应满足该公式。

6.10.4.1.4 辅助 OSC1 LVCMOS 数字时钟源

图 6-34 展示了当 OSC1 连接到 1.8V LVCMOS 方波数字时钟源时建议的振荡器连接。

备注

当振荡器上电时, OSC1_XI 上不允许出现直流稳态情况, 这是因为 OSC1_XI 在内部交流耦合到比较器, 当向输入施加直流时, 该比较器可能会进入未知状态。因此, 只要 OSC1_XI 不在不同逻辑状态之间切换, 应用软件就应该使 OSC1 断电。

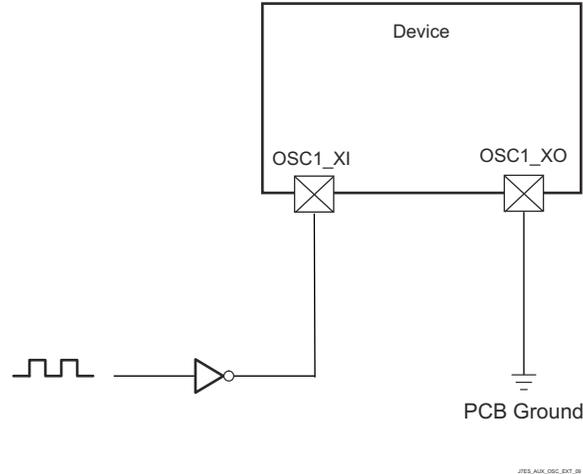


图 6-34. 1.8V LVCMOS 兼容时钟输入

6.10.4.1.5 未使用辅助 OSC1

图 6-35 展示了未使用 OSC1 时建议的振荡器连接。OSC1_XI 必须通过外部拉电阻器 (R_{pd}) 连接到 VSS，以确保在该输入未使用时保持在有效的低电平，因为内部下拉电阻器在默认情况下被禁用。

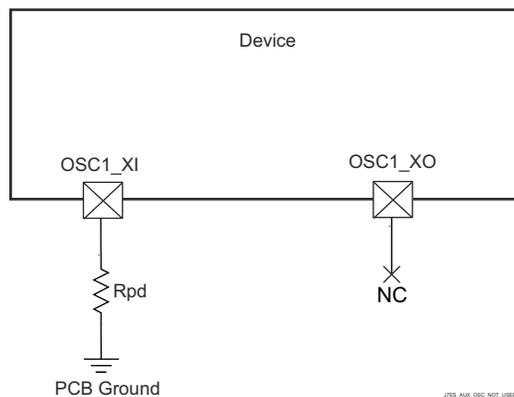


图 6-35. 未使用 OSC1

6.10.4.2 输出时钟

该器件提供多个系统时钟输出。这些输出时钟总结如下：

- **MCU_CLKOUT0**
 - 以太网 PHY 的基准时钟输出 (50MHz 或 25MHz)
- **MCU_SYSCCLKOUT0**
 - MCU_SYSCCLK0 进行 4 分频后作为 LVCMOS 时钟信号 (MCU_SYSCCLKOUT0) 从器件发出。此信号可被用来测试主芯片时钟是否正常工作。此信号不应用作电路板上外部器件的时钟源。
- **MCU_OBSCLK0**
 - 在时钟输出 MCU_OBSCLK0 上，可观察振荡器和 PLL 时钟以进行测试和调试。此信号不应用作电路板上外部器件的时钟源。
- **SYSCCLKOUT0**
 - SYSCCLK0 进行 4 分频后作为 LVCMOS 时钟信号 (SYSCCLKOUT0) 从器件发出。此信号可被用来测试主芯片时钟是否正常工作。此信号不应用作电路板上外部器件的时钟源。
- **CLKOUT**
 - 以太网 PHY 的基准时钟输出 (50MHz)

- **OBSCLK[1:0]**
 - 在时钟输出 OBSCLK0/1 上，可观察振荡器和 PLL 时钟以进行测试和调试。

6.10.4.3 PLL

由内部稳压器向锁相环电路 (PLL) 供电，这些稳压器从片外电源获取电力。

在 WKUP 和 MCU 域中，该器件内总共有三个 PLL：

- MCU_PLL0 (MCU R5FSS PLL) + WKUP_PLLCTRL0
- MCU_PLL1 (MCU 外设 PLL)
- MCU_PLL2 (MCU CPSW PLL)

在 MAIN 域中，该器件内总共有 20 个 PLL：

- PLL0 (主 PLL) + PLLCTRL0
- PLL1 (PER0 PLL)
- PLL2 (PER1 PLL)
- PLL3 (CPSW9G PLL)
- PLL4 (AUDIO0 PLL)
- PLL5 (VIDEO PLL)
- PLL6 (GPU PLL)
- PLL7 (C7x PLL)
- PLL8 (ARM0 PLL)
- PLL12 (DDR PLL)
- PLL13 (C66 PLL)
- PLL14 (R5F PLL)
- PLL15 (AUDIO1 PLL)
- PLL16 (DSS PLL0)
- PLL17 (DSS PLL1)
- PLL18 (DSS PLL2)
- PLL19 (DSS PLL3)
- PLL23 (DSS PLL7)
- PLL24 (MLB PLL)
- PLL25 (VISION PLL)

备注

如需更多信息，请参阅：

- 器件 TRM 中的 *器件配置/时钟/PLL* 一节。
- 器件 TRM 中的 *外设/显示子系统概述* 一节。

备注

如器件 TRM 中的 *器件配置* 一章所述，输入基准时钟 (OSC1_XI/OSC1_XO) 由 PLL 控制器指定，锁定时间由 PLL 控制器确保。

6.10.4.4 模块和外设时钟频率

节 6.10.5 (*外设* 一节) 介绍了与器件外设时钟相关的最大频率。

有关每个模块的时钟结构的更多详细信息，请参阅器件 TRM 中的 *器件配置* 一章。

6.10.5 外设

6.10.5.1 ATL

该器件包含 ATL 模块，可用于音频的异步采样速率转换。ATL 计算两个时基（例如音频同步）之间的误差，并可选择使用通过软件窃取周期来生成一个平均时钟。

备注

有关 ATL 更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *音频跟踪逻辑 (ATL)* 一节。

表 6-27 表示 ATL 时序条件。

表 6-27. ATL 时序条件

| 参数 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|-----------------|--------|----------|-----|----|------|
| 输入条件 | | | | | |
| SR _i | 输入压摆率 | 外部基准 CLK | 0.5 | 5 | V/ns |
| 输出条件 | | | | | |
| C _L | 输出负载电容 | 内部基准 CLK | 1 | 10 | pF |

节 6.10.5.1.1、节 6.10.5.1.2、节 6.10.5.1.3 和节 6.10.5.1.4 说明了 ATL 的时序要求和开关特性。

6.10.5.1.1 ATL_PCLK 时序要求

| 编号 | 参数 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|----|-----------------------|---------------------|----------|-------------------------------|----|
| D1 | t _{c(pclk)} | 周期时间，ATL_PCLK | 外部基准 CLK | 5 | ns |
| D2 | t _{w(pclkL)} | 脉冲持续时间，ATL_PCLK 低电平 | 外部基准 CLK | 0.45 × M ⁽¹⁾ + 2.5 | ns |
| D3 | t _{w(pclkH)} | 脉冲持续时间，ATL_PCLK 高电平 | 外部基准 CLK | 0.45 × M ⁽¹⁾ + 2.5 | ns |

(1) M = ATL_CLK[x] 周期

6.10.5.1.2 ATL_AWS[x] 时序要求

| 编号 | 参数 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|----|----------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------|----|
| D4 | t _{c(aws)} | 周期时间，ATL_AWS[x] ⁽³⁾ | 外部基准 CLK | 2 × M ⁽¹⁾ | ns |
| D5 | t _{w(awsL)} | 脉冲持续时间，ATL_AWS[x] ⁽³⁾ 低电平 | 外部基准 CLK | 0.45 × A ⁽²⁾ + 2.5 | ns |
| D6 | t _{w(awsH)} | 脉冲持续时间，ATL_AWS[x] ⁽³⁾ 高电平 | 外部基准 CLK | 0.45 × A ⁽²⁾ + 2.5 | ns |

(1) M = ATL_CLK[x] 周期

(2) A = ATL_AWS[x] 周期

(3) x = 0 至 3

6.10.5.1.3 ATL_BWS[x] 时序要求

| 编号 | 参数 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|----|----------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------|----|
| D7 | t _{c(bws)} | 周期时间，ATL_BWS[x] ⁽³⁾ | 外部基准时钟 | 2 × M ⁽¹⁾ | ns |
| D8 | t _{w(bwsL)} | 脉冲持续时间，ATL_BWS[x] 低电平 ⁽³⁾ | 外部基准时钟 | 0.45 × B ⁽²⁾ + 2.5 | ns |
| D9 | t _{w(bwsH)} | 脉冲持续时间，ATL_BWS[x] 高电平 ⁽³⁾ | 外部基准时钟 | 0.45 × B ⁽²⁾ + 2.5 | ns |

(1) M = ATL_CLK[x] 周期

(2) B = ATL_BWS[x] 周期

(3) x = 0 至 3

6.10.5.1.4 ATCLK[x] 开关特性

| 编号 | 参数 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----|-----------------------|------------------------------|----------|-----|----|
| D10 | t _{c(atclk)} | 周期时间，ATCLK[x] ⁽³⁾ | 内部基准 CLK | 20 | ns |

| 编号 | 参数 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----|-----------------|-------------------------------------|----------|---------------------------------------|----|
| D11 | $t_{w(atclkL)}$ | 脉冲持续时间, ATCLK[x] 低电平 ⁽³⁾ | 内部基准 CLK | $0.45 \times P^{(2)} - M^{(1)} - 0.3$ | ns |
| D12 | $t_{w(atclkH)}$ | 脉冲持续时间, ATCLK[x] 高电平 ⁽³⁾ | 内部基准 CLK | $0.45 \times P^{(2)} - M^{(1)} - 0.3$ | ns |

- (1) M = ATL_CLK[x] 周期
- (2) P = ATCLK[x] 周期
- (3) x = 0 至 3

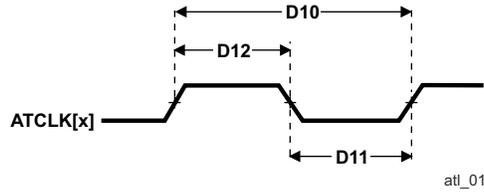


图 6-36. ATCLK[x] 时序

6.10.5.2 CPSW2G

如需进一步详细了解器件千兆位以太网 MAC 的特性和其他说明信息，请参阅[信号说明](#)和[详细说明](#)中的相应小节。

6.10.5.2.1 CPSW2G MDIO 接口时序

表 6-28 表示 CPSW2G 时序条件。

表 6-28. CPSW2G MDIO 时序条件

| 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----------------|---------|-----|-----|------|
| 输入条件 | | | | |
| SR _I | 输入信号压摆率 | 0.9 | 3.6 | V/ns |
| 输出条件 | | | | |
| C _L | 输出负载电容 | 10 | 470 | pF |

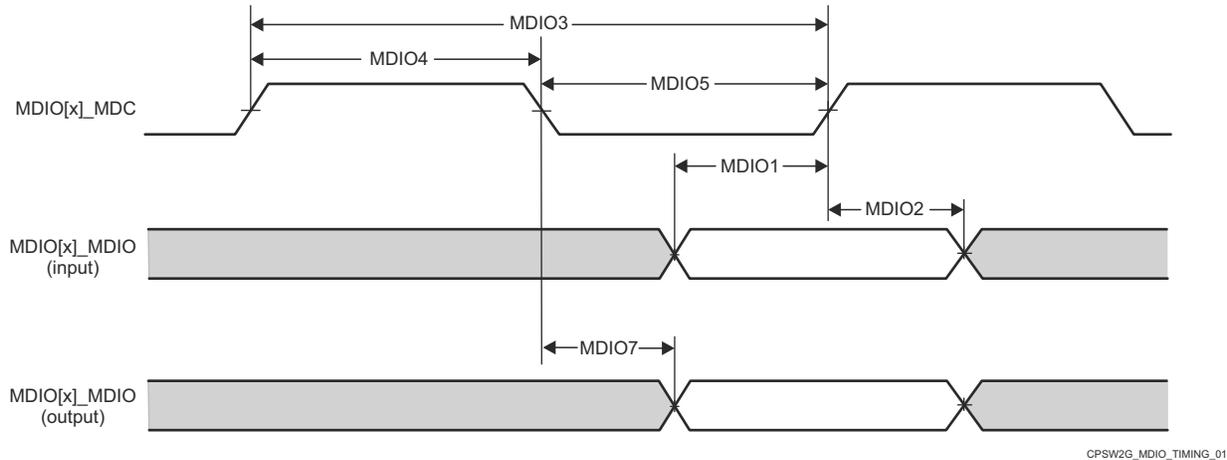
表 6-29、表 6-30 和图 6-37 说明了 MDIO 的时序要求。

表 6-29. CPSW2G MDIO 时序要求

| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------|-----------------------------|--|-----|-----|----|
| MDIO1 | t _{su(mdioV-mdcH)} | 建立时间，在 MDIO[x]_MDC 高电平之前 MDIO[x]_MDIO 有效 | 90 | | ns |
| MDIO2 | t _{h(mdcH-mdioV)} | 保持时间，在 MDIO[x]_MDC 高电平之后 MDIO[x]_MDIO 有效 | 0 | | ns |

表 6-30. CPSW2G MDIO 开关特性

| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------|----------------------------|---------------------------------------|------|-----|----|
| MDIO3 | t _{c(mdc)} | 周期时间，MDIO[x]_MDC | 400 | | ns |
| MDIO4 | t _{w(mdcH)} | 脉冲持续时间，MDIO[x]_MDC 高电平 | 160 | | ns |
| MDIO5 | t _{w(mdcL)} | 脉冲持续时间，MDIO[x]_MDC 低电平 | 160 | | ns |
| MDIO7 | t _{d(mdcL-mdioV)} | 延迟时间，MDIO[x]_MDC 低电平到 MDIO[x]_MDIO 有效 | -150 | 150 | ns |



CPSW2G_MDIO_TIMING_01

备注

在 MCU 域中，x = 0

图 6-37. CPSW2G MDIO 时序要求和开关特性

6.10.5.2.2 CPSW2G RMII 时序

表 6-31、节 6.10.5.2.2.1、节 6.10.5.2.2.2 和节 6.10.5.2.2.3 说明了 CPSW2G RMII 的时序条件、要求和开关特性。

表 6-31. CPSW2G RMII 时序条件

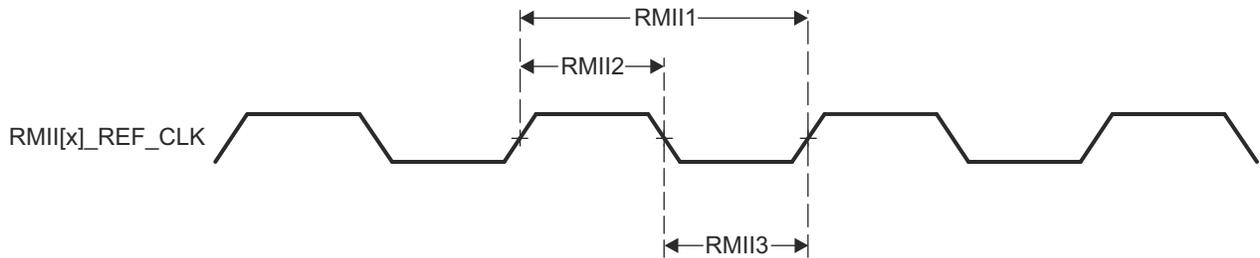
| 参数 | | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|-----------------|---------|---------------------------|-------|------|------|
| 输入条件 | | | | | |
| SR _I | 输入信号压摆率 | VDD ⁽¹⁾ = 1.8V | 0.108 | 0.54 | V/ns |
| | | VDD ⁽¹⁾ = 3.3V | 0.4 | 1.2 | V/ns |
| 输出条件 | | | | | |
| C _L | 输出负载电容 | 3 | 25 | pF | |

(1) VDD 表示相应的电源。有关电源名称和相应焊球的更多信息，请参阅引脚属性的“电源”列

6.10.5.2.2.1 CPSW2G RMII[x]_REF_CLK 时序要求 - RMII 模式

请参阅图 6-38

| 编号 | 参数 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------|--------------------------|-----------------------------|--------|-----|----|
| RMII1 | t _{c(ref_clk)} | 周期时间, RMII[x]_REF_CLK | 19.999 | 20 | ns |
| RMII2 | t _{w(ref_clkH)} | 脉冲持续时间, RMII[x]_REF_CLK 高电平 | 7 | 13 | ns |
| RMII3 | t _{w(ref_clkL)} | 脉冲持续时间, RMII[x]_REF_CLK 低电平 | 7 | 13 | ns |



A. 在 MCU 域中, x = 1。

图 6-38. CPSW2G RMII[x]_REFCLK 时序要求 - RMII 模式

6.10.5.2.2.2 CPSW2G RMII[x]_RXD[1:0]、RMII[x]_CRS_DV 和 RMII[x]_RX_ER 时序要求 - RMII 模式

| 编号 | 参数 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------|-----------------------------------|---|-----|-----|----|
| RMII4 | t _{su(rxdV-ref_clkH)} | 建立时间, 在 RMII[x]_REF_CLK 上升沿之前 RMII[x]_RXD[1:0] 有效 | 4 | | ns |
| | t _{su(crs_dvV-ref_clkH)} | 建立时间, 在 RMII[x]_REF_CLK 上升沿之前 RMII[x]_CRS_DV 有效 | 4 | | ns |
| | t _{su(rx_erV-ref_clkH)} | 建立时间, 在 RMII[x]_REF_CLK 上升沿之前 RMII[x]_RX_ER 有效 | 4 | | ns |
| RMII5 | t _{h(ref_clkH-rxdV)} | 保持时间, 在 RMII[x]_REF_CLK 上升沿之后 RMII[x]_RXD[1:0] 有效 | 2 | | ns |
| | t _{h(ref_clkH-crs_dvV)} | 保持时间, 在 RMII[x]_REF_CLK 上升沿之后 RMII[x]_CRS_DV 有效 | 2 | | ns |
| | t _{h(ref_clkH-rx_erV)} | 保持时间, 在 RMII[x]_REF_CLK 上升沿之后 RMII[x]_RX_ER 有效 | 2 | | ns |

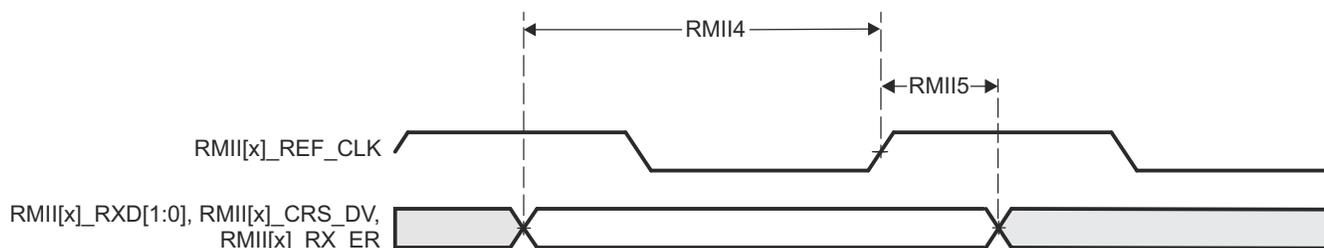


图 6-39. CPSW2G RMII[x]_RXD[1:0]、RMII[x]_CRS_DV、RMII[x]_RX_ER 时序要求 - RMII 模式

节 6.10.5.2.2.3 和图 6-40 说明了 CPSW2G RMII 发送模式的开关特性。

6.10.5.2.2.3 CPSW2G RMII[x]_TXD[1:0] 和 RMII[x]_TX_EN 开关特性 - RMII 模式

请参阅图 6-40

| 编号 | 参数 | | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------|-----------------------------------|--|-----|-----|----|
| RMII6 | $t_{d(\text{ref_clkH-txdV})}$ | 延迟时间, RMII[x]_REF_CLK 上升沿到 RMII[x]_TXD[1:0] 有效 | 2 | 10 | ns |
| | $t_{d(\text{ref_clkH-tx_enV})}$ | 延迟时间, RMII[x]_REF_CLK 上升沿到 RMII[x]_TX_EN 有效 | 2 | 10 | ns |

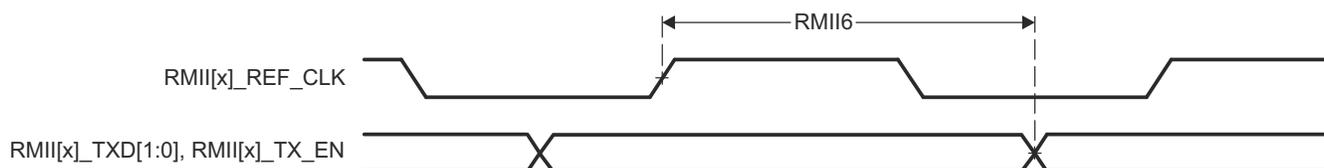


图 6-40. RMII[x]_TXD[1:0] 和 RMII[x]_TX_EN 开关特性 - RMII 模式

6.10.5.2.3 CPSW2G RGMII 时序

节 6.10.5.2.3.1、节 6.10.5.2.3.2 和图 6-42 说明了 RGMII 在接收操作中的时序要求。

有关更多信息, 请参阅器件 TRM 的外设一章中的千兆位以太网 MAC (MCU_CPSW0) 一节。

表 6-32. CPSW2G RGMII 时序条件

| 参数 | | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|------------------------------------|----------------|---|------|--------|
| 输入条件 | | | | |
| SR _i | 输入压摆率 | VDD ⁽¹⁾ = 1.8V | 1.44 | 5 V/ns |
| | | VDD ⁽¹⁾ = 3.3V | 2.64 | 5 V/ns |
| 输出条件 | | | | |
| C _L | 输出负载电容 | 2 | 20 | pF |
| PCB 连接要求 | | | | |
| $t_d(\text{Trace Mismatch Delay})$ | 所有引线之间的传播延迟不匹配 | RGMII[x]_RXC、 RGMII[x]_RD[3:0]、 RGMII[x]_RX_CTL | 50 | ps |
| | | RGMII[x]_TXC、 RGMII[x]_TD[3:0]、 RGMII[x]_TX_CTL | 50 | ps |

(1) VDD 表示相应的电源。有关电源名称和相应焊球的详细信息, 请参阅引脚属性的“电源”列。

6.10.5.2.3.1 RGMII[x]_RXC 时序要求 - RGMII 模式

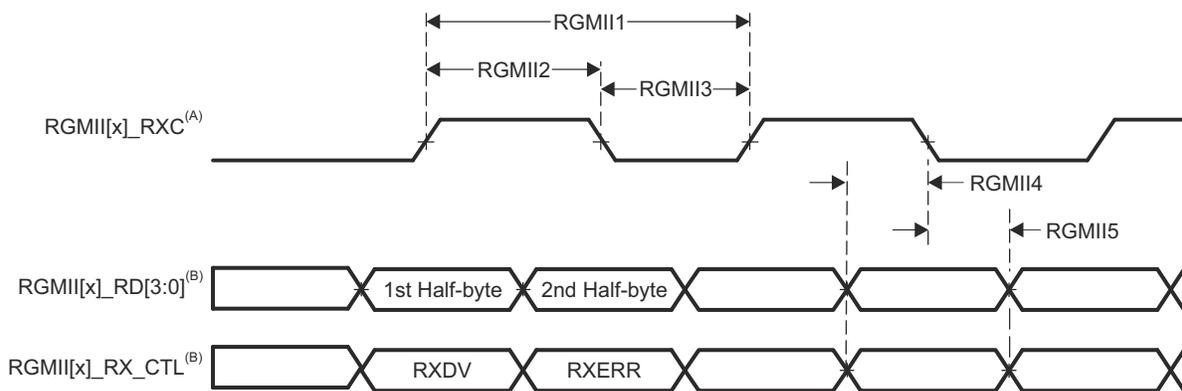
请参阅图 6-41

| 编号 | | | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|--------|---------------|--------------------------|----------|-----|-----|----|
| RGMII1 | $t_{c(rx)}$ | 周期时间, RGMII[x]_RXC | 10Mbps | 360 | 440 | ns |
| | | | 100Mbps | 36 | 44 | ns |
| | | | 1000Mbps | 7.2 | 8.8 | ns |
| RGMII2 | $t_{w(rxch)}$ | 脉冲持续时间, RGMII[x]_RXC 高电平 | 10Mbps | 160 | 240 | ns |
| | | | 100Mbps | 16 | 24 | ns |
| | | | 1000Mbps | 3.6 | 4.4 | ns |
| RGMII3 | $t_{w(rxcl)}$ | 脉冲持续时间, RGMII[x]_RXC 低电平 | 10Mbps | 160 | 240 | ns |
| | | | 100Mbps | 16 | 24 | ns |
| | | | 1000Mbps | 3.6 | 4.4 | ns |

6.10.5.2.3.2 RGMII[x]_RD[3:0] 和 RGMII[x]_RCTL 的 CPSW2G 时序要求 - RGMII 模式

请参阅图 6-41

| 编号 | | | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|--------|-------------------------|---|----------|-----|-----|----|
| RGMII4 | $t_{su(rdV-rxcV)}$ | 建立时间, 在 RGMII[x]_RXC 转换之前 RGMII[x]_RD[3:0] 有效 | 10Mbps | 1 | | ns |
| | | | 100Mbps | 1 | | ns |
| | | | 1000Mbps | 1 | | ns |
| RGMII4 | $t_{su(rx_ctlV-rxcV)}$ | 建立时间, 在 RGMII[x]_RXC 转换之前 RGMII[x]_RX_CTL 有效 | 10Mbps | 1 | | ns |
| | | | 100Mbps | 1 | | ns |
| | | | 1000Mbps | 1 | | ns |
| RGMII5 | $t_{h(rxV-rdV)}$ | 保持时间, 在 RGMII[x]_RXC 转换之后 RGMII[x]_RD[3:0] 有效 | 10Mbps | 1 | | ns |
| | | | 100Mbps | 1 | | ns |
| | | | 1000Mbps | 1 | | ns |
| RGMII5 | $t_{h(rxV-rx_ctlV)}$ | 保持时间, 在 RGMII[x]_RXC 转换之后 RGMII[x]_RX_CTL 有效 | 10Mbps | 1 | | ns |
| | | | 100Mbps | 1 | | ns |
| | | | 1000Mbps | 1 | | ns |



- A. RGMII_RXC 必须相对于数据引脚和控制引脚进行外部延迟。
- B. 使用时钟的两个边沿接收数据和控制信息。RGMII_RXD[3:0] 在 RGMII_RXC 的上升沿传输数据位 3-0, 在 RGMII_RXC 的下降沿传输数据位 7-4。类似地, RGMII_RXCTL 在 RGMII_RXC 的上升沿传输 RXDV, 在 RGMII_RXC 的下降沿传输 RXERR。

图 6-41. CPSW2G 接收接口时序, RGMII 运行模式

节 6.10.5.2.3.3 和节 6.10.5.2.3.4 说明了 10Mbps、100Mbps 和 1000Mbps RGMII 发送模式下的开关特性。

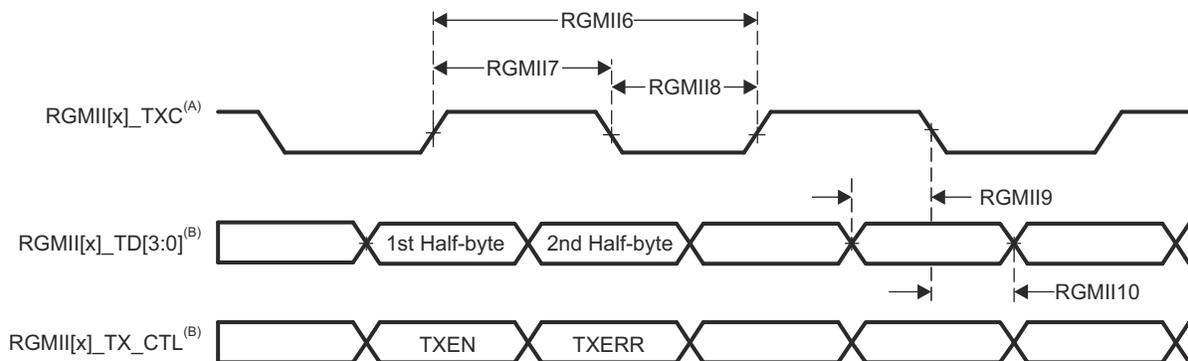
6.10.5.2.3.3 CPSW2G RGMII[x]_TXC 开关特性 - RGMII 模式

| 编号 | 参数 | | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|--------|--------------|--------------------------|----------|-----|-----|----|
| RGMII6 | $t_{c(tc)}$ | 周期时间, RGMII[x]_TXC | 10Mbps | 360 | 440 | ns |
| | | | 100Mbps | 36 | 44 | ns |
| | | | 1000Mbps | 7.2 | 8.8 | ns |
| RGMII7 | $t_{w(tcH)}$ | 脉冲持续时间, RGMII[x]_TXC 高电平 | 10Mbps | 160 | 240 | ns |
| | | | 100Mbps | 16 | 24 | ns |
| | | | 1000Mbps | 3.6 | 4.4 | ns |
| RGMII8 | $t_{w(tcL)}$ | 脉冲持续时间, RGMII[x]_TXC 低电平 | 10Mbps | 160 | 240 | ns |
| | | | 100Mbps | 16 | 24 | ns |
| | | | 1000Mbps | 3.6 | 4.4 | ns |

6.10.5.2.3.4 RGMII[x]_TD[3:0] 和 RGMII[x]_TX_CTL 开关特性 - RGMII 模式

请参阅图 6-42

| 编号 | 参数 | | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---------|-------------------------|---|----------|-----|-----|----|
| RGMII9 | $t_{osu(tdV-txcV)}$ | 输出建立时间, RGMII[x]_TD[3:0] 有效到 RGMII[x]_TXC 转换 | 10Mbps | 1.2 | | ns |
| | | | 100Mbps | 1.2 | | ns |
| | | | 1000Mbps | 1.2 | | ns |
| RGMII9 | $t_{osu(tx_ctlV-txcV)}$ | 输出建立时间, RGMII[x]_TX_CTL 有效到 RGMII[x]_TXC 转换 | 10Mbps | 1.2 | | ns |
| | | | 100Mbps | 1.2 | | ns |
| | | | 1000Mbps | 1.2 | | ns |
| RGMII10 | $t_{oh(tdV-txcV)}$ | 输出保持时间, 在 RGMII[x]_TXC 转换之后 RGMII[x]_TD[3:0] 有效 | 10Mbps | 1.2 | | ns |
| | | | 100Mbps | 1.2 | | ns |
| | | | 1000Mbps | 1.2 | | ns |
| RGMII10 | $t_{oh(tx_ctlV-txcV)}$ | 输出保持时间, 在 RGMII[x]_TXC 转换之后 RGMII[x]_TX_CTL 有效 | 10Mbps | 1.2 | | ns |
| | | | 100Mbps | 1.2 | | ns |
| | | | 1000Mbps | 1.2 | | ns |



- A. TXC 在驱动至 RGMII[x]_TXC 引脚之前会在内部延迟。该内部延迟始终启用。
- B. 使用时钟的两个边沿接收数据和控制信息。RGMII_TD[3:0] 在 RGMII_TXC 的上升沿传输数据位 3-0, 在 RGMII_TXC 的下降沿传输数据位 7-4。类似地, RGMII_TX_CTL 在 RGMII_TXC 的上升沿传输 TXDV, 在 RGMII_TXC 的下降沿传输 RTXERR。

图 6-42. CPSW2G 发送接口时序 - RGMII 模式

6.10.5.3 CSI-2

备注

有关更多信息，请参阅器件 TRM 中的“摄像头流媒体接口接收器 (CSI_RX_IF)”一节。

CSI_RX_IF 处理来自外部图像传感器的像素数据和来自存储器的数据。它是以下多媒体应用程序的关键组件：照相机取景器、视频录制和静态图像捕获。

CSI_RX_IF 具有一个符合 MIPI D-PHY RX 规范 v1.2 和 MIPI CSI-2 规范 v1.3 的第一串行接口 (CSI-2 端口)，具有 4 个差分数据通道和 1 个差分时钟通道，以同步模式双倍数据速率运行。有关时序详细信息，请参阅规范。

- 每个通道的速率为 2.5Gbps (1.25GHz)。

6.10.5.4 DDRSS

如需进一步详细了解器件 LPDDR4 存储器接口的特性和其他说明信息，请参阅[信号说明](#)和[详细说明](#)中的相应小节。

该器件具有用于连接 LPDDR4 的专用接口，支持符合 JEDEC JESD209-4B 标准且具有以下特性的 LPDDR4 SDRAM 器件：

- 连接到外部 SDRAM 存储器的 32 位数据路径
- 存储器器件容量：通过两个片选引脚提供多达 8GB 地址空间 (每列 4GB)
- 不支持字节模式 LPDDR4 存储器或具有超过 17 行地址位的存储器

表 6-33 和图 6-43 说明了 DDRSS 的开关特性。

表 6-33. DDRSS 的开关特性

| 编号 | 参数 | DDR 类型 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|----|--|--------|--------|-------|----|
| 1 | $t_{c(DDR_CKP/DDR_CKN)}$ 周期时间, DDR0_CKP 和 DDR0_CKN | LPDDR4 | 0.4681 | 3.003 | ns |

1. 最大 DDR 频率将根据系统中使用的特定存储器类型 (供应商) 以及根据 PCB 实现进行限制。TI 强烈建议所有设计的每个细节 (布线、间距、过孔/背钻、PCB 材料等) 都严格遵循 TI LPDDR4 EVM PCB 布局，以便完全实现指定的时钟频率。有关详细信息，请参阅 Jacinto 7 DDR 电路板设计和布局布线指南。

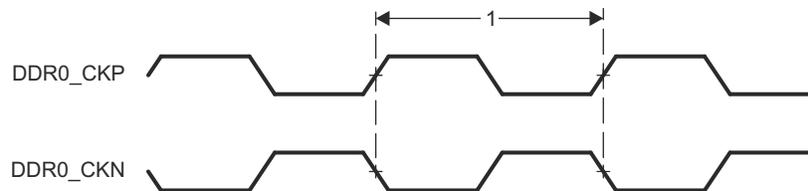


图 6-43. DDRSS 存储器接口时钟时序

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的[存储器控制器](#)一章中的 *DDR 子系统 (DDRSS)* 一节。

6.10.5.5 DSS

如需进一步详细了解器件显示子系统 - 视频输出端口的特性和其他说明信息，请参阅[信号说明](#)和[详细说明](#)中的相应小节。

表 6-34 表示 DPI 时序条件。

表 6-34. DPI 时序条件

| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----------------------|------|------|------|
| 输入条件 | | | |
| SR _I 输入压摆率 | 1.44 | 26.4 | V/ns |
| 输出条件 | | | |

表 6-34. DPI 时序条件 (续)

| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|------------------------------|----------------|-----|----|----|
| C_L | 输出负载电容 | 1.5 | 5 | pF |
| PCB 连接要求 | | | | |
| t_d (Trace Mismatch Delay) | 所有引线之间的传播延迟不匹配 | 100 | ps | |

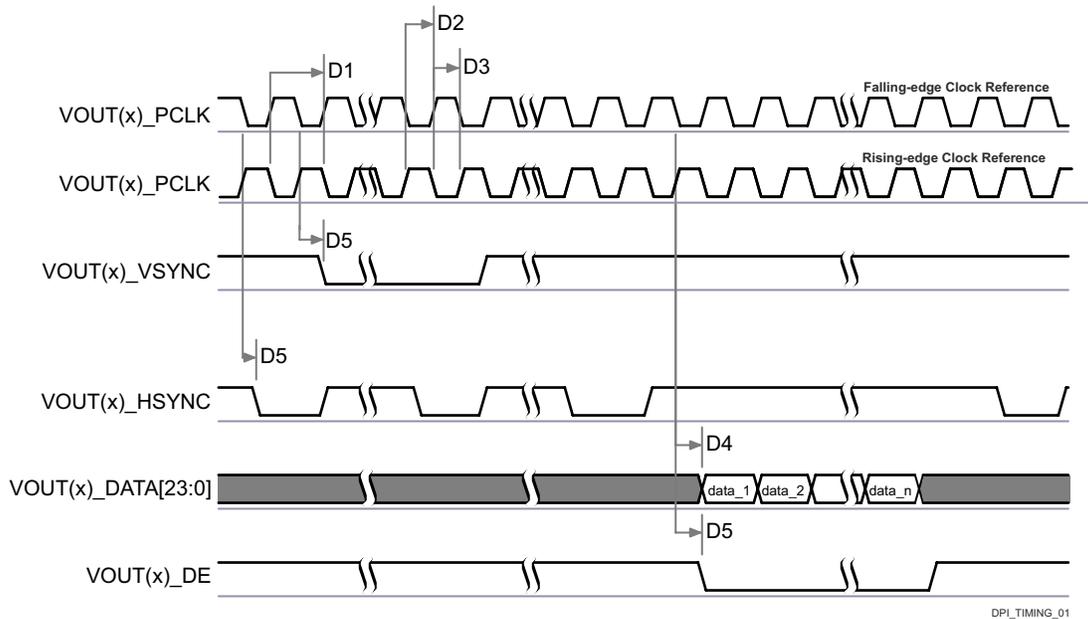
表 6-35、表 6-36、图 6-44 和图 6-45 假设在建议运行条件和电气特性条件下进行测试。

表 6-35. DPI 视频输出开关特性

| 编号 ⁽²⁾ | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | | |
|-------------------|-----------------------------|---|-----|------------------------|------|----|
| D1 | $t_{c(\text{pclk})}$ | 周期时间, $VOUT(x)_PCLK$ | | 6.06 | ns | |
| D2 | $t_{w(\text{pclkL})}$ | 脉冲持续时间, $VOUT(x)_PCLK$ 低电平 | | $0.475 \times P^{(1)}$ | ns | |
| D3 | $t_{w(\text{pclkH})}$ | 脉冲持续时间, $VOUT(x)_PCLK$ 高电平 | | $0.475 \times P^{(1)}$ | ns | |
| D4 | $t_{d(\text{pclkV-dataV})}$ | 延迟时间, $VOUT(x)_PCLK$ 转换到 $VOUT(x)_DATA[23:0]$ 转换 | | -0.68 | 1.78 | ns |
| D5 | $t_{d(\text{pclkV-ctrlL})}$ | 延迟时间, $VOUT(x)_PCLK$ 转换到控制信号 $VOUT(x)_VSYNC$ 、 $VOUT(x)_HSYNC$ 、 $VOUT(x)_DE$ 下降沿 | | -0.68 | 1.78 | ns |

(1) P = 输出 $VOUT(x)_PCLK$ 周期 (以 ns 为单位)。

(2) $VOUT(x)$ 中的 x = 1 或 2



- 数据置为有效的配置可以在像素时钟的下降沿或上升沿进行编程。
- $VOUT(x)_HSYNC$ 和 $VOUT(x)_VSYNC$ 的极性和脉冲宽度是可编程的, 请参阅器件 TRM 的外设一章中的显示子系统 (DSS) 一节。
- $VOUT(x)_PCLK$ 频率是可配置的, 请参阅器件 TRM 的外设一章中的显示子系统一节。
- $VOUT(x)$ 中的 x = 1 或 2。

图 6-44. DPI 视频输出

表 6-36. DPI 外部像素时钟时序要求

| 编号 ⁽²⁾ | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-----|----|
| D6 | $t_{c(extpclk)}$ | 周期时间, VOUT(x)_EXTPCLKIN | 6.06 | | ns |
| D7 | $t_{w(extpclkL)}$ | 脉冲持续时间, VOUT(x)_EXTPCLKIN 低电平 | $0.45 \times P^{(1)}$ | | ns |
| D8 | $t_{w(extpclkH)}$ | 脉冲持续时间, VOUT(x)_EXTPCLKIN 高电平 | $0.45 \times P^{(1)}$ | | ns |

(1) P = 输出 VOUT(x)_PCLK 周期 (以 ns 为单位)。

(2) VOUT(x) 中的 x = 1 或 2

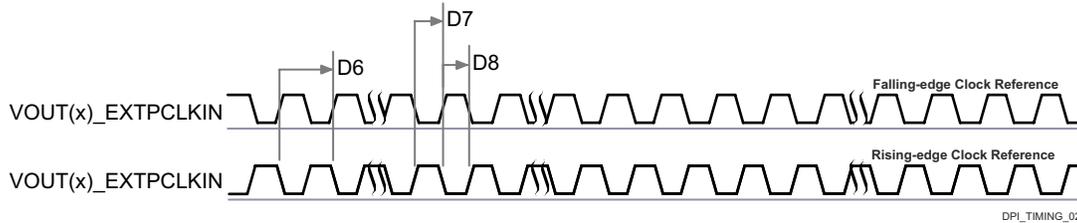


图 6-45. DPI 外部像素时钟输入

有关更多信息, 请参阅器件 TRM 的外设一章中的显示子系统 (DSS) 和外设一节。

6.10.5.6 eCAP

器件 ECAP 支持的特性包括：

- 32 位时基计数器
- 4 事件时间戳寄存器 (每个 32 位)
- 独立边沿极性选择, 最多选择四个序列化时间戳捕获事件
- 4 个捕获事件中任意一个均有对应的中断功能
- 输入捕获信号预分频 (1 至 16)
- 支持不同的捕获模式 (单次捕获、连续模式捕获、绝对时间戳捕获或差分模式时间戳捕获)

表 6-37 表示 ECAP 时序条件。

表 6-37. ECAP 时序条件

| 参数 | | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|--------|--------|-----|-----|------|
| 输入条件 | | | | |
| SR_i | 输入压摆率 | 1 | 4 | V/ns |
| 输出条件 | | | | |
| C_L | 输出负载电容 | 2 | 7 | pF |

节 6.10.5.6.1 和节 6.10.5.6.2 说明了 eCAP 的时序和开关特性 (请参阅图 6-46 和图 6-47)。

6.10.5.6.1 eCAP 的时序要求

| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|------|--------------|------------------|----------------|-----|----|
| CAP1 | $t_{w(cap)}$ | 脉冲持续时间, CAP (异步) | $2 + 2P^{(1)}$ | | ns |

(1) P = sysclk



图 6-46. eCAP 输入时序

6.10.5.6.2 eCAP 的开关特性

| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|------|----------------------|--------------|-------------------------|-----|----|
| CAP2 | $t_{w(\text{apwm})}$ | 脉冲持续时间, APWM | - 2 + 2P ⁽¹⁾ | | ns |

(1) $P = \text{sysclk}$

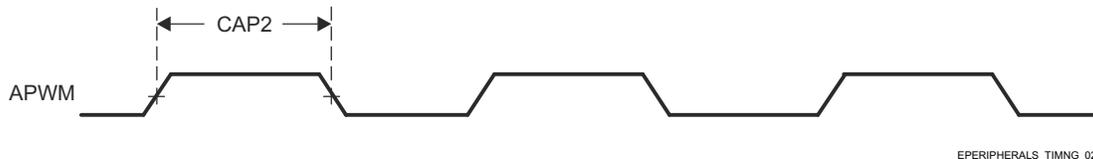


图 6-47. eCAP 输出时序

有关更多信息, 请参阅器件 TRM 的外设一章中的增强型捕获 (ECAP) 模块一节。

6.10.5.7 EPWM

器件 EPWM 支持的特性包括：

- 专用 16 位时基计数器具有周期和频率控制功能
- 两个独立 PWM 输出可用于不同配置 (单边沿运行模式、双边沿对称运行模式或一个独立 PWM 输出 + 双边沿非对称运行模式)
- 在故障条件下可以对 PWM 信号进行异步覆盖控制
- 针对相对于其他 EPWM 模块的滞后或超前操作支持可编程相位控制
- 在生成死区时可以进行独立上升沿和下降沿延迟控制
- 锁存和未锁存故障条件下均支持可编程跳闸区分配
- 可通过事件触发 CPU 中断和 ADC 转换启动

表 6-38 表示 EPWM 时序条件。

表 6-38. EPWM 时序条件

| 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------------|--------|-----|-----|------|
| 输入条件 | | | | |
| SR_i | 输入压摆率 | 1 | 4 | V/ns |
| 输出条件 | | | | |
| C_L | 输出负载电容 | 2 | 7 | pF |

节 6.10.5.7.2 和节 6.10.5.7.1 说明了 eHRPWM 的时序和开关特性 (请参阅图 6-49、图 6-50、图 6-51 和图 6-48)。

6.10.5.7.1 eHRPWM 的时序要求

| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----|----|
| PWM6 | $t_{w(\text{synci})}$ | 脉冲持续时间, EHRPWM_SYNCI | 2 + 2P ⁽¹⁾ | | ns |

| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|------|-------------|---------------------------|----------------|-----|----|
| PWM7 | $t_{w(tz)}$ | 脉冲持续时间, EHRPWM_TZn_IN 低电平 | $2 + 3P^{(1)}$ | | ns |

(1) $P = \text{sysclk}$

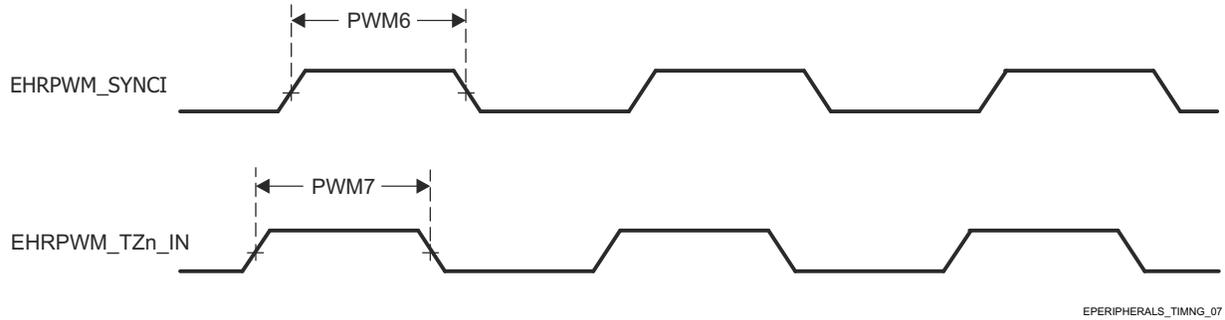


图 6-48. ePWM_SYNCI 和 ePWM_TZn_IN 输出时序

有关更多信息, 请参阅器件 TRM 的外设一章中的摄像头子系统一节。

6.10.5.7.2 eHRPWM 的开关特性

| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|------|------------------|---|-------------|-----|----|
| PWM1 | $t_{w(pwm)}$ | 脉冲持续时间, EHRPWM_A/B 高电平或低电平 | $P-3^{(1)}$ | | ns |
| PWM2 | $t_{w(syncout)}$ | 脉冲持续时间, EHRPWM_SYNCO | $P-3^{(1)}$ | | ns |
| PWM3 | $t_d(tzL-pwmV)$ | 延迟时间, EHRPWM_TZn_IN 下降沿到 EHRPWM_A/B 有效 | | 11 | ns |
| PWM4 | $t_d(tzL-pwmZ)$ | 延迟时间, EHRPWM_TZn_IN 下降沿到 EHRPWM_A/B 高阻态 | | 11 | ns |

| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|------|--------------|------------------------|--------------------|-----|----|
| PWM5 | $t_{w(soc)}$ | 脉冲持续时间, EHRPWM_SOC A/B | P-3 ⁽¹⁾ | | ns |

(1) P = sysclk

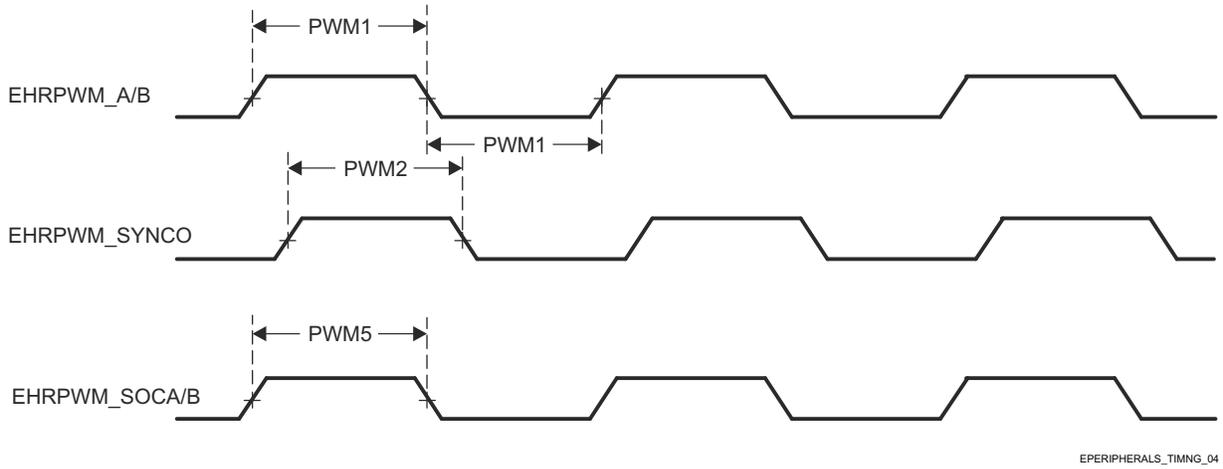


图 6-49. EPWM_A/B_out、ePWM_SYNCO 和 ePWM_SOC A/B 输入时序

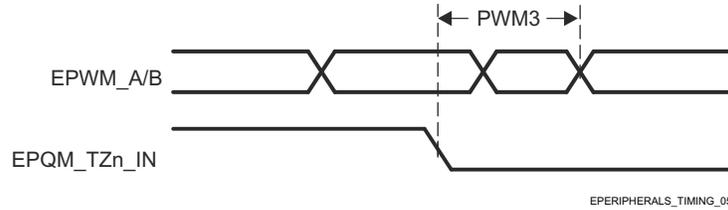


图 6-50. EPWM_A/B 和 ePWM_TZn_IN 强制高电平/低电平输入时序

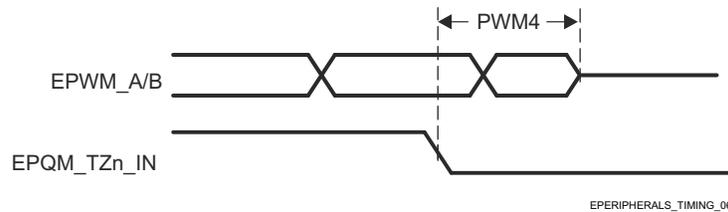


图 6-51. EPWM_A/B 和 ePWM_TZn_IN 高阻态输入时序

6.10.5.8 eQEP

器件 eQEP 支持的特性包括：

- 输入同步
- 三级/六级数字噪声滤波器
- 正交解码器单元
- 用于位置测量的位置计数器和控制单元
- 用于低速测量的正交边沿捕获单元
- 用于速度/频率测量的单位时基
- 用于检测失速的看门狗计时器

表 6-39 表示 EQEP 时序条件。

表 6-39. EQEP 时序条件

| 参数 | | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----------------|--------|-----|-----|------|
| 输入条件 | | | | |
| SR _i | 输入压摆率 | 1 | 4 | V/ns |
| 输出条件 | | | | |
| C _L | 输出负载电容 | 2 | 7 | pF |

节 6.10.5.8.1 和节 6.10.5.8.2 说明了 eQEP 的时序要求和开关特性 (请参阅图 6-52)。

6.10.5.8.1 eQEP 的时序要求

| 编号 | 参数 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----|----|
| QEP1 | t _{w(qep)} | 脉冲持续时间, QEP_A/B | 2 + 2P ⁽¹⁾ | | ns |
| QEP2 | t _{w(qepiH)} | 脉冲持续时间, QEP_I 高电平 | 2 + 2P ⁽¹⁾ | | ns |
| QEP3 | t _{w(qepiL)} | 脉冲持续时间, QEP_I 低电平 | 2 + 2P ⁽¹⁾ | | ns |
| QEP4 | t _{w(qepsH)} | 脉冲持续时间, QEP_S 高电平 | 2 + 2P ⁽¹⁾ | | ns |
| QEP5 | t _{w(qepsL)} | 脉冲持续时间, QEP_S 低电平 | 2 + 2P ⁽¹⁾ | | ns |

(1) P = sysclk

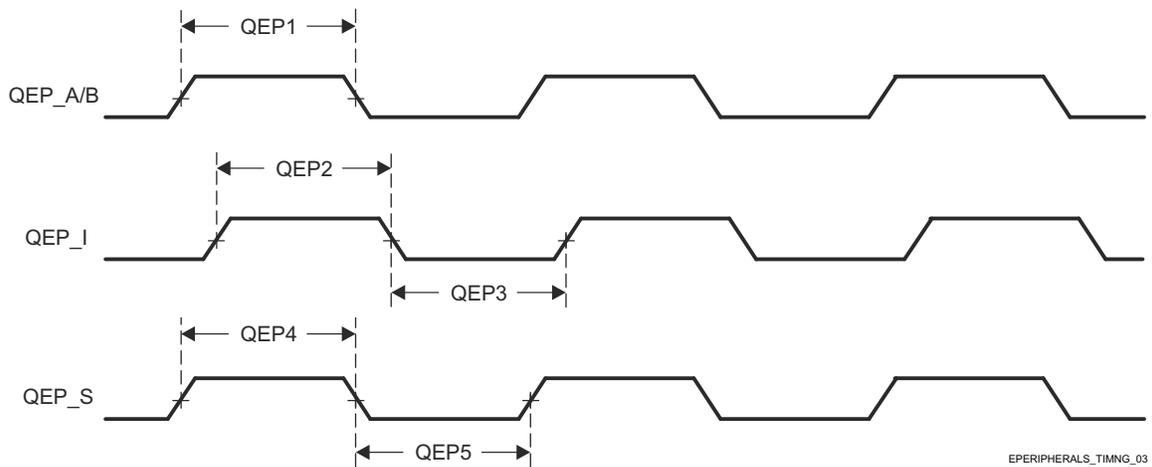


图 6-52. eQEP 输入时序

6.10.5.8.2 eQEP 的开关特性

| 编号 | 参数 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|------|--------------------------|------------------|-----|-----|----|
| QEP6 | t _{d(QEP-CNTR)} | 延迟时间, 外部时钟到计数器增量 | | 24 | ns |

有关更多信息, 请参阅器件 TRM 的外设一章中的增强型正交编码器脉冲 (EQEP) 模块一节。

6.10.5.9 GPIO

如需进一步详细了解器件 GPIO 的特性和其他说明信息, 请参阅特定于器件的技术参考手册 (TRM) 以及本数据表的信号说明中的相应小节。

表 6-40、节 6.10.5.9.1 和节 6.10.5.9.2 说明了 GPIO 的时序条件、要求和开关特性。

表 6-40. GPIO 时序条件

| 参数 | 缓冲器类型 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|------|-------|-----|-----|----|
| 输入条件 | | | | |

表 6-40. GPIO 时序条件 (续)

| 参数 | | 缓冲器类型 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----------------|--------|--|--------|------|------|
| SR _i | 输入压摆率 | LVC MOS (VDD ⁽¹⁾ = 1.8V) | 0.0018 | 6.6 | V/ns |
| | | LVC MOS (VDD ⁽¹⁾ = 3.3V) | 0.0033 | 6.6 | V/ns |
| | | I2C OD FS (VDD ⁽¹⁾ = 1.8V) | 0.0018 | 6.6 | V/ns |
| | | I2C OD FS (VDD ⁽¹⁾ = 3.3V) | 0.0033 | 0.08 | V/ns |
| 输出条件 | | | | | |
| C _L | 输出负载电容 | LVC MOS | 3 | 10 | pF |
| | | I2C OD FS | 3 | 100 | pF |

(1) VDD 表示相应的电源。有关电源名称和相应焊球的详细信息，请参阅[引脚属性](#)表的“电源”列。

6.10.5.9.1 GPIO 时序要求

| 编号 | 参数 | | 缓冲器类型 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------|-------------------------|-----|----|
| GPIO1 | t _w (gpio_in) | 脉冲宽度, GPIO _n _x | 1.8 V | 2P + 2.6 ⁽¹⁾ | | ns |
| | | | 3.3V | 2P + 3.4 ⁽¹⁾ | | ns |

(1) P = 功能时钟周期 (以 ns 为单位)。

6.10.5.9.2 GPIO 开关特性

| 编号 | 参数 | | 缓冲器类型 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------|---------------------------|-------------|---------|-------------------------------|-----|----|
| GPIO3 | t _w (GPIO_OUT) | 最小输出脉冲宽度 | LVC MOS | - 3.6 + 0.975P ⁽¹⁾ | | ns |
| GPIO4 | t _w (GPIO_OUT) | 最小输出脉冲宽度低电平 | I2C 开漏 | 160 | | ns |
| GPIO5 | t _w (GPIO_OUT) | 最小输出脉冲宽度高电平 | I2C 开漏 | 60 | | ns |

(1) P = 功能时钟周期 (以 ns 为单位)。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的[通用接口 \(GPIO\)](#)一节。

6.10.5.10 GPMC

如需进一步详细了解器件通用存储器控制器的特性和其他说明信息，请参阅[信号说明](#)和[详细说明](#)中的相应小节。

表 6-41 表示 GPMC 时序条件。

备注

本节中提供的 IO 时序适用于 GPMC0 的所有信号组合。然而，只有当使用单个 IOSET 内的信号时，时序才对 GPMC0 有效。[GPMC0_IOSET](#)、[GPMC0_IOSET](#) 表对 IOSET 进行了定义。

表 6-41. GPMC 时序条件

| 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|------------------------------|-----------|-------------|-----|------|----|
| 输入条件 | | | | | |
| SR _i | 输入压摆率 | 1.65 | 4 | V/ns | |
| 输出条件 | | | | | |
| C _L | 输出负载电容 | 5 | 20 | pF | |
| PCB 连接要求 | | | | | |
| t _d (Trace Delay) | 每条引线的传播延迟 | 133MHz 同步模式 | 140 | 360 | ps |
| | | 所有其他模式 | 140 | 720 | |

表 6-41. GPMC 时序条件 (续)

| 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|------------------------------|--------------|-----|-----|----|
| t_d (Trace Mismatch Delay) | 所有布线之间的传播不匹配 | | 200 | ps |

6.10.5.10.1 GPMC 和 NOR 闪存 - 同步模式

节 6.10.5.10.1.1 和节 6.10.5.10.1.2 假设在下列建议运行条件和电气特性条件下进行测试 (请参阅图 6-53 至图 6-57)。

6.10.5.10.1.1 GPMC 和 NOR 闪存时序要求 - 同步模式

| 编号 | 参数 | 说明 ⁽²⁾ | 模式 ⁽³⁾ | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----|----------------------|---|--|-----------------------|-----|-----------------------|-----|----|
| | | | | 100MHz ⁽⁴⁾ | | 133MHz ⁽⁴⁾ | | |
| F12 | $t_{su}(dV-clkH)$ | 建立时间, 在输出时钟 GPMC_CLK 高电平之前输入数据 GPMC_AD[15:0] 有效 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | 1.81 | | 1.11 | | ns |
| | | | not_div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | 1.06 | | | | ns |
| F13 | $t_h(clkH-dV)$ | 保持时间, 在输出时钟 GPMC_CLK 高电平之后输入数据 GPMC_AD[15:0] 有效 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | 1.78 | | 2.28 | | ns |
| | | | not_div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | 1.78 | | | | ns |
| F21 | $t_{su}(waitV-clkH)$ | 建立时间, 在输出时钟 GPMC_CLK 高电平之前输入等待 GPMC_WAIT[j] 有效 ⁽¹⁾ | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | 1.81 | | 1.11 | | ns |
| | | | not_div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | 1.06 | | | | ns |
| F22 | $t_h(clkH-waitV)$ | 保持时间, 在输出时钟 GPMC_CLK 高电平之后输入等待 GPMC_WAIT[j] 有效 ⁽¹⁾ | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | 1.78 | | 2.28 | | ns |
| | | | not_div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | 1.78 | | | | ns |

(1) 在 GPMC_WAIT[j] 中, j 等于 0、1、2 或 3。

(2) 等待监视支持仅限于 WaitMonitoringTime 值 > 0。有关等待监视功能的完整说明, 请参阅器件 TRM 中的通用存储器控制器 (GPMC) 一节。

(3) 对于 div_by_1_mode :

- GPMC_CONFIG1_i 寄存器 : GPMCFCLKDIVIDER = 0h :
 - GPMC_CLK 频率 = GPMC_FCLK 频率
- GPMC_CONFIG1_i 寄存器 : GPMCFCLKDIVIDER = 1h 至 3h :
 - GPMC_CLK 频率 = GPMC_FCLK 频率 / (2 至 4)
- CTRLMMR_GPMC_CLKSEL[1-0] CLK_SEL = 01 = PER1_PLL_CLKOUT/3 = 300/3 = 100MHz
- 对于 TIMEPARAGRANULARITY_X1 :
 - GPMC_CONFIG1_i 寄存器 : TIMEPARAGRANULARITY = 0h = x1 延迟 (影响 RD/WRCYCLETIME、RD/WRACCESTIME、PAGEBURSTACCESTIME、CSONTIME、CSR/DWROFFTIME、ADVONTIME、ADV RD/WROFFTIME、OEONTIME、OEOFFTIME、WEONTIME、WEOFFTIME、CYCLE2CYCLEDELAY、BUSTURNAROUND、TIMEOUTSTARTVALUE、WRDATAONADMUXBUS)

(4) 对于 100MHz :

- CTRLMMR_GPMC_CLKSEL[1-0] CLK_SEL = 01 = MAIN_PLL2_HSDIV1_CLKOUT / 3

对于 133MHz :

- CTRLMMR_GPMC_CLKSEL[1-0] CLK_SEL = 00 = MAIN_PLL0_HSDIV3_CLKOUT

6.10.5.10.1.2 GPMC 和 NOR 闪存开关特性 - 同步模式

| 编号 ⁽²⁾ | 参数 | 说明 | 模式 ⁽¹⁹⁾ | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------------------|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----|
| | | | | 100 MHz ⁽²⁰⁾ | | 133 MHz ⁽²⁰⁾ | | |
| F0 | tc(clk) | 周期, 输出时钟 GPMC_CLK ⁽¹⁸⁾ | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | 10 | | 7.52 | | ns |
| F1 | t _w (clkH) | 典型脉冲持续时间, 输出时钟 GPMC_CLK 高电平 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | 0.475*P ⁽¹⁵⁾ - 0.3 | | 0.475*P ⁽¹⁵⁾ - 0.3 | | ns |
| F1 | t _w (clkL) | 典型脉冲持续时间, 输出时钟 GPMC_CLK 低电平 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | 0.475*P ⁽¹⁵⁾ - 0.3 | | 0.475*P ⁽¹⁵⁾ - 0.3 | | ns |
| F2 | t _d (clkH-csnV) | 延迟时间, 输出时钟 GPMC_CLK 上升沿到输出片选 GPMC_CS _n [i] 转换 ⁽¹⁴⁾ | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 ; 无 extra_delay | F ⁽⁶⁾ - 2.2 | F+3.75 | F ⁽⁶⁾ - 2.2 | F ⁽⁶⁾ + 3.75 | ns |
| F3 | t _d (clkH-CS _n [i]V) | 延迟时间, 输出时钟 GPMC_CLK 上升沿到输出片选 GPMC_CS _n [i] 无效 ⁽¹⁴⁾ | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 ; 无 extra_delay | E ⁽⁵⁾ - 2.2 | E ⁽⁵⁾ + 3.75 | E ⁽⁵⁾ - 2.2 | E ⁽⁵⁾ + 3.75 | ns |
| F4 | t _d (aV-clk) | 延迟时间, 输出地址 GPMC_A[27:1] 有效到输出时钟 GPMC_CLK 第一个边沿 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | B ⁽²⁾ -2.3 | B ⁽²⁾ +4.5 | B ⁽²⁾ -2.3 | B ⁽²⁾ +4.5 | ns |
| F5 | t _d (clkH-aV) | 延迟时间, 输出时钟 GPMC_CLK 上升沿到输出地址 GPMC_A[27:1] 无效 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | -2.3 | 4.5 | -2.3 | 4.5 | ns |
| F6 | t _d (be[x]nV-clk) | 延迟时间, 输出低字节使能和命令锁存使能 GPMC_BE0 _n _CLE、输出高字节使能 GPMC_BE1 _n 有效到输出时钟 GPMC_CLK 第一个边沿 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | B ⁽²⁾ -2.3 | B ⁽²⁾ +1.9 | B ⁽²⁾ -2.3 | B ⁽²⁾ +1.9 | ns |
| F7 | t _d (clkH-be[x]nV) | 延迟时间, 输出时钟 GPMC_CLK 上升沿到输出低字节使能和命令锁存使能 GPMC_BE0 _n _CLE、输出高字节使能 GPMC_BE1 _n 有效 ⁽¹¹⁾ | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | D ⁽⁴⁾ -2.3 | D ⁽⁴⁾ +1.9 | D ⁽⁴⁾ -2.3 | D ⁽⁴⁾ +1.9 | ns |
| F7 | t _d (clkL-be[x]nV) | 延迟时间, GPMC_CLK 下降沿到 GPMC_BE0 _n _CLE、GPMC_BE1 _n 无效 ⁽¹²⁾ | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | D ⁽⁴⁾ -2.3 | D ⁽⁴⁾ +1.9 | D ⁽⁴⁾ -2.3 | D ⁽⁴⁾ +1.9 | ns |
| F7 | t _d (clkL-be[x]nV) | 延迟时间, GPMC_CLK 下降沿到 GPMC_BE0 _n _CLE、GPMC_BE1 _n 无效 ⁽¹³⁾ | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | D ⁽⁴⁾ -2.3 | D ⁽⁴⁾ +1.9 | D ⁽⁴⁾ -2.3 | D ⁽⁴⁾ +1.9 | ns |
| F8 | t _d (clkH-advn) | 延迟时间, 输出时钟 GPMC_CLK 上升沿到输出地址有效和地址锁存使能 GPMC_ADV _n _ALE 转换 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 ; 无 extra_delay | G ⁽⁷⁾ -2.3 | G ⁽⁷⁾ +4.5 | G ⁽⁷⁾ -2.3 | G ⁽⁷⁾ +4.5 | ns |

| 编号 ⁽²⁾ | 参数 | 说明 | 模式 ⁽¹⁹⁾ | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------------------|------------------------------|--|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----|
| | | | | 100 MHz ⁽²⁰⁾ | | 133 MHz ⁽²⁰⁾ | | |
| F9 | t _d (clkH-advnIV) | 延迟时间，输出时钟 GPMC_CLK 上升沿到输出地址有效和地址锁存使能 GPMC_ADVn_ALE 无效 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 ; 无 extra_delay | D ⁽⁴⁾ -2.3 | D ⁽⁴⁾ +4.5 | D ⁽⁴⁾ -2.3 | D ⁽⁴⁾ +4.5 | ns |
| F10 | t _d (clkH-oen) | 延迟时间，输出时钟 GPMC_CLK 上升沿到输出使能 GPMC_OEn_REn 转换 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 ; 无 extra_delay | H ⁽⁸⁾ -2.3 | H ⁽⁸⁾ +3.5 | H ⁽⁸⁾ -2.3 | H ⁽⁸⁾ +3.5 | ns |
| F11 | t _d (clkH-oenIV) | 延迟时间，输出时钟 GPMC_CLK 上升沿到输出使能 GPMC_OEn_REn 无效 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 ; 无 extra_delay | E ⁽⁸⁾ -2.3 | E ⁽⁸⁾ +3.5 | E ⁽⁸⁾ -2.3 | E ⁽⁸⁾ +3.5 | ns |
| F14 | t _d (clkH-wen) | 延迟时间，输出时钟 GPMC_CLK 上升沿到输出写入使能 GPMC_WEn 转换 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 ; 无 extra_delay | I ⁽⁹⁾ -2.3 | I ⁽⁹⁾ +4.5 | I ⁽⁹⁾ -2.3 | I ⁽⁹⁾ +4.5 | ns |
| F15 | t _d (clkH-do) | 延迟时间，输出时钟 GPMC_CLK 上升沿到输出数据 GPMC_AD[15:0] 转换 ⁽¹¹⁾ | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | J ⁽¹⁰⁾ -2.3 | J ⁽¹⁰⁾ +2.7 | J ⁽¹⁰⁾ -2.3 | J ⁽¹⁰⁾ +2.7 | ns |
| F15 | t _d (clkL-do) | 延迟时间，GPMC_CLK 下降沿到 GPMC_AD[15:0] 数据总线转换 ⁽¹²⁾ | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | J ⁽¹⁰⁾ -2.3 | J ⁽¹⁰⁾ +2.7 | J ⁽¹⁰⁾ -2.3 | J ⁽¹⁰⁾ +2.7 | ns |
| F15 | t _d (clkL-do) | 延迟时间，GPMC_CLK 下降沿到 GPMC_AD[15:0] 数据总线转换 ⁽¹³⁾ | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | J ⁽¹⁰⁾ -2.3 | J ⁽¹⁰⁾ +2.7 | J ⁽¹⁰⁾ -2.3 | J ⁽¹⁰⁾ +2.7 | ns |
| F17 | t _d (clkH-be[x]n) | 延迟时间，输出时钟 GPMC_CLK 上升沿到输出低字节使能和命令锁存使能 GPMC_BE0n_CLE 转换 ⁽¹¹⁾ | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | J ⁽¹⁰⁾ -2.3 | J ⁽¹⁰⁾ +1.9 | J ⁽¹⁰⁾ -2.3 | J ⁽¹⁰⁾ +1.9 | ns |
| F17 | t _d (clkL-be[x]n) | 延迟时间，GPMC_CLK 下降沿到 GPMC_BE0n_CLE、GPMC_BE1n 转换 ⁽¹²⁾ | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | J ⁽¹⁰⁾ -2.3 | J ⁽¹⁰⁾ +1.9 | J ⁽¹⁰⁾ -2.3 | J ⁽¹⁰⁾ +1.9 | ns |
| F17 | t _d (clkL-be[x]n) | 延迟时间，GPMC_CLK 下降沿到 GPMC_BE0n_CLE、GPMC_BE1n 转换 ⁽¹³⁾ | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | J ⁽¹⁰⁾ -2.3 | J ⁽¹⁰⁾ +1.9 | J ⁽¹⁰⁾ -2.3 | J ⁽¹⁰⁾ +1.9 | ns |
| F18 | t _w (csnV) | 脉冲持续时间，输出片选 GPMC_CSn[i] 低电平 ⁽¹⁴⁾ | 读取 | A ⁽¹⁾ | | A ⁽¹⁾ | | ns |
| | | | 写入 | A ⁽¹⁾ | | A ⁽¹⁾ | | ns |
| F19 | t _w (be[x]nV) | 脉冲持续时间，输出低字节使能和命令锁存使能 GPMC_BE0n_CLE、输出高字节使能 GPMC_BE1n 低电平 | 读取 | C ⁽³⁾ | | C ⁽³⁾ | | ns |
| | | | 写入 | C ⁽³⁾ | | C ⁽³⁾ | | ns |
| F20 | t _w (advnV) | 脉冲持续时间，输出地址有效和地址锁存使能 GPMC_ADVn_ALE 低电平 | 读取 | K ⁽¹⁶⁾ | | K ⁽¹⁶⁾ | | ns |
| | | | 写入 | K ⁽¹⁶⁾ | | K ⁽¹⁶⁾ | | ns |

- (1) 对于单次读取：A = (CSRdOffTime - CSOnTime) × (TimeParaGranularity + 1) × GPMC_FCLK⁽¹⁷⁾
 对于突发读取：A = (CSRdOffTime - CSOnTime + (n - 1) × PageBurstAccessTime) × (TimeParaGranularity + 1) × GPMC_FCLK⁽¹⁷⁾
 对于突发写入：A = (CSWrOffTime - CSOnTime + (n - 1) × PageBurstAccessTime) × (TimeParaGranularity + 1) × GPMC_FCLK⁽¹⁷⁾
 n 是页面突发访问编号。
- (2) B = ClkActivationTime × GPMC_FCLK⁽¹⁷⁾

- (3) 对于单次读取: $C = \text{RdCycleTime} \times (\text{TimeParaGranularity} + 1) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 对于突发读取: $C = (\text{RdCycleTime} + (n - 1) \times \text{PageBurstAccessTime}) \times (\text{TimeParaGranularity} + 1) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 对于突发写入: $C = (\text{WrCycleTime} + (n - 1) \times \text{PageBurstAccessTime}) \times (\text{TimeParaGranularity} + 1) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 n 是页面突发访问编号。
- (4) 对于单次读取: $D = (\text{RdCycleTime} - \text{AccessTime}) \times (\text{TimeParaGranularity} + 1) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 对于突发读取: $D = (\text{RdCycleTime} - \text{AccessTime}) \times (\text{TimeParaGranularity} + 1) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 对于突发写入: $D = (\text{WrCycleTime} - \text{AccessTime}) \times (\text{TimeParaGranularity} + 1) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
- (5) 对于单次读取: $E = (\text{CSRdOffTime} - \text{AccessTime}) \times (\text{TimeParaGranularity} + 1) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 对于突发读取: $E = (\text{CSRdOffTime} - \text{AccessTime}) \times (\text{TimeParaGranularity} + 1) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 对于突发写入: $E = (\text{CSWrOffTime} - \text{AccessTime}) \times (\text{TimeParaGranularity} + 1) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
- (6) 对于 csn 下降沿 (CS 激活):
- 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 0$:
 - $F = 0.5 \times \text{CSEExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 1$:
 - 如果 (ClkActivationTime 和 CSOnTime 为奇数) 或 (ClkActivationTime 和 CSOnTime 为偶数), 则 $F = 0.5 \times \text{CSEExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 否则 $F = (1 + 0.5 \times \text{CSEExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 2$:
 - 如果 ((CSOnTime - ClkActivationTime) 是 3 的倍数), 则 $F = 0.5 \times \text{CSEExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 ((CSOnTime - ClkActivationTime - 1) 是 3 的倍数), 则 $F = (1 + 0.5 \times \text{CSEExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 ((CSOnTime - ClkActivationTime - 2) 是 3 的倍数), 则 $F = (2 + 0.5 \times \text{CSEExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
- (7) 对于 ADV 下降沿 (ADV 激活):
- 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 0$:
 - $G = 0.5 \times \text{ADVExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 1$:
 - 如果 (ClkActivationTime 和 ADVOnTime 为奇数) 或 (ClkActivationTime 和 ADVOnTime 为偶数), 则 $G = 0.5 \times \text{ADVExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 否则 $G = (1 + 0.5 \times \text{ADVExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 2$:
 - 如果 (ADVOnTime - ClkActivationTime) 是 3 的倍数, 则 $G = 0.5 \times \text{ADVExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 (ADVOnTime - ClkActivationTime - 1) 是 3 的倍数, 则 $G = (1 + 0.5 \times \text{ADVExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 (ADVOnTime - ClkActivationTime - 2) 是 3 的倍数, 则 $G = (2 + 0.5 \times \text{ADVExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$

对于读取模式下的 ADV 上升沿 (ADV 停用):

- 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 0$:
 - $G = 0.5 \times \text{ADVExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
- 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 1$:
 - 如果 (ClkActivationTime 和 ADVRdOffTime 为奇数) 或 (ClkActivationTime 和 ADVRdOffTime 为偶数), 则 $G = 0.5 \times \text{ADVExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 否则 $G = (1 + 0.5 \times \text{ADVExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
- 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 2$:
 - 如果 (ADVRdOffTime - ClkActivationTime) 是 3 的倍数, 则 $G = 0.5 \times \text{ADVExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 (ADVRdOffTime - ClkActivationTime - 1) 是 3 的倍数, 则 $G = (1 + 0.5 \times \text{ADVExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 (ADVRdOffTime - ClkActivationTime - 2) 是 3 的倍数, 则 $G = (2 + 0.5 \times \text{ADVExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$

对于写入模式下的 ADV 上升沿 (ADV 停用):

- 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 0$:
 - $G = 0.5 \times \text{ADVExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
- 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 1$:
 - 如果 (ClkActivationTime 和 ADVWrOffTime 为奇数) 或 (ClkActivationTime 和 ADVWrOffTime 为偶数), 则 $G = 0.5 \times \text{ADVExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 否则 $G = (1 + 0.5 \times \text{ADVExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
- 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 2$:

- 如果 $(\text{ADVWrOffTime} - \text{ClkActivationTime})$ 是 3 的倍数), 则 $G = 0.5 \times \text{ADVExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
- 如果 $(\text{ADVWrOffTime} - \text{ClkActivationTime} - 1)$ 是 3 的倍数), 则 $G = (1 + 0.5 \times \text{ADVExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
- 如果 $(\text{ADVWrOffTime} - \text{ClkActivationTime} - 2)$ 是 3 的倍数), 则 $G = (2 + 0.5 \times \text{ADVExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$

(8) 对于 OE 下降沿 (OE 激活) 和 IO DIR 上升沿 (数据总线输入方向):

- 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 0$:
 - $H = 0.5 \times \text{OEExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
- 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 1$:
 - 如果 $(\text{ClkActivationTime}$ 和 OEOnTime 为奇数) 或 $(\text{ClkActivationTime}$ 和 OEOnTime 为偶数), 则 $H = 0.5 \times \text{OEExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 否则 $H = (1 + 0.5 \times \text{OEExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
- 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 2$:
 - 如果 $(\text{OEOnTime} - \text{ClkActivationTime})$ 是 3 的倍数), 则 $H = 0.5 \times \text{OEExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 $(\text{OEOnTime} - \text{ClkActivationTime} - 1)$ 是 3 的倍数), 则 $H = (1 + 0.5 \times \text{OEExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 $(\text{OEOnTime} - \text{ClkActivationTime} - 2)$ 是 3 的倍数), 则 $H = (2 + 0.5 \times \text{OEExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$

对于 OE 上升沿 (OE 停用):

- 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 0$:
 - $H = 0.5 \times \text{OEExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
- 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 1$:
 - 如果 $(\text{ClkActivationTime}$ 和 OEOffTime 为奇数) 或 $(\text{ClkActivationTime}$ 和 OEOffTime 为偶数), 则 $H = 0.5 \times \text{OEExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 否则 $H = (1 + 0.5 \times \text{OEExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
- 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 2$:
 - 如果 $(\text{OEOffTime} - \text{ClkActivationTime})$ 是 3 的倍数), 则 $H = 0.5 \times \text{OEExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 $(\text{OEOffTime} - \text{ClkActivationTime} - 1)$ 是 3 的倍数), 则 $H = (1 + 0.5 \times \text{OEExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 $(\text{OEOffTime} - \text{ClkActivationTime} - 2)$ 是 3 的倍数), 则 $H = (2 + 0.5 \times \text{OEExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$

(9) 对于 WE 下降沿 (WE 激活):

- 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 0$:
 - $I = 0.5 \times \text{WEExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
- 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 1$:
 - 如果 $(\text{ClkActivationTime}$ 和 WEOnTime 为奇数) 或 $(\text{ClkActivationTime}$ 和 WEOnTime 为偶数), 则 $I = 0.5 \times \text{WEExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 否则 $I = (1 + 0.5 \times \text{WEExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
- 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 2$:
 - 如果 $(\text{WEOnTime} - \text{ClkActivationTime})$ 是 3 的倍数), 则 $I = 0.5 \times \text{WEExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 $(\text{WEOnTime} - \text{ClkActivationTime} - 1)$ 是 3 的倍数), 则 $I = (1 + 0.5 \times \text{WEExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 $(\text{WEOnTime} - \text{ClkActivationTime} - 2)$ 是 3 的倍数), 则 $I = (2 + 0.5 \times \text{WEExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$

对于 WE 上升沿 (WE 停用):

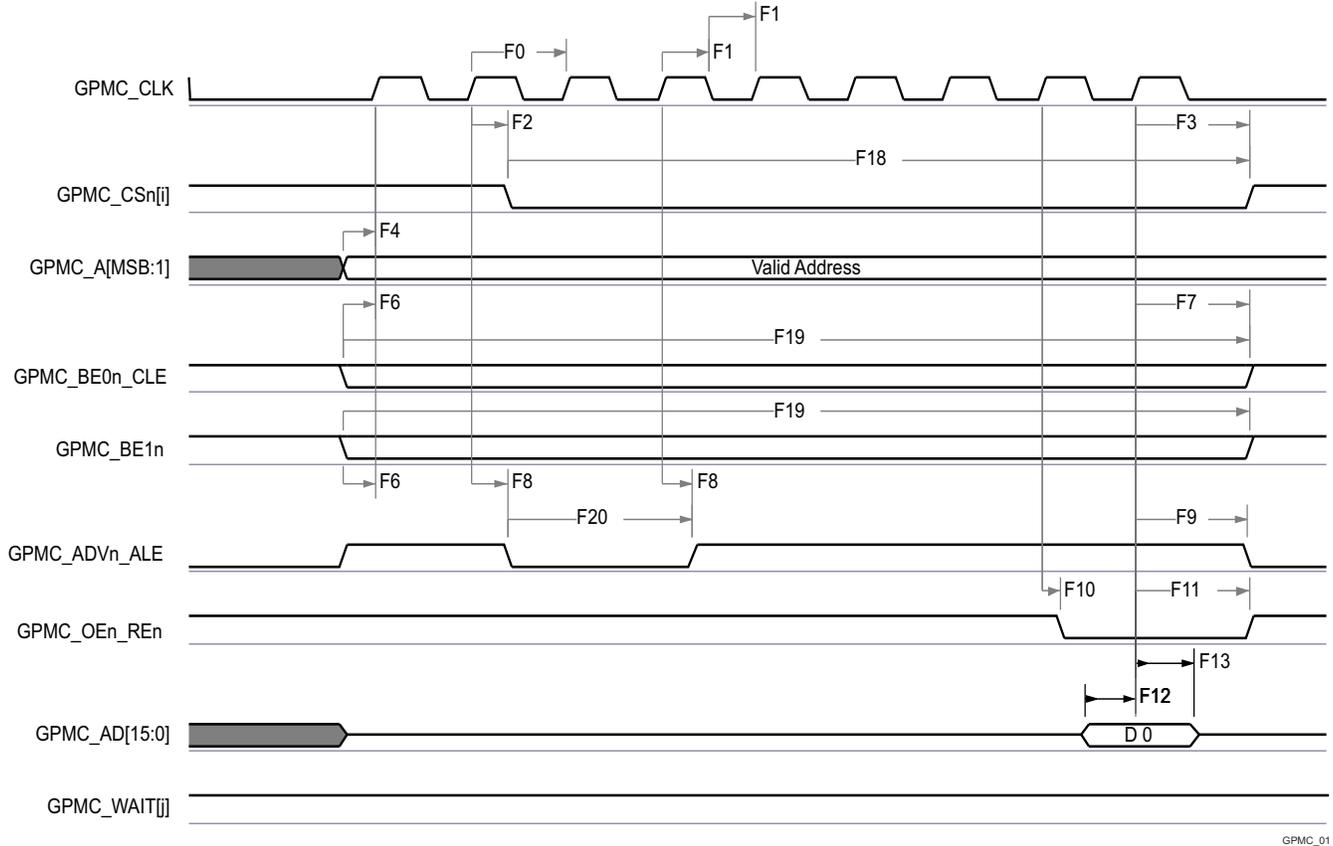
- 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 0$:
 - $I = 0.5 \times \text{WEExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
- 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 1$:
 - 如果 $(\text{ClkActivationTime}$ 和 WEOffTime 为奇数) 或 $(\text{ClkActivationTime}$ 和 WEOffTime 为偶数), 则 $I = 0.5 \times \text{WEExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 否则 $I = (1 + 0.5 \times \text{WEExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
- 如果 $\text{GPMCFCLKDIVIDER} = 2$:
 - 如果 $(\text{WEOffTime} - \text{ClkActivationTime})$ 是 3 的倍数), 则 $I = 0.5 \times \text{WEExtraDelay} \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 $(\text{WEOffTime} - \text{ClkActivationTime} - 1)$ 是 3 的倍数), 则 $I = (1 + 0.5 \times \text{WEExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
 - 如果 $(\text{WEOffTime} - \text{ClkActivationTime} - 2)$ 是 3 的倍数), 则 $I = (2 + 0.5 \times \text{WEExtraDelay}) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$

(10) $J = \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$

(11) 对于 CLK DIV 1 模式, 仅限第一次传输。

(12) 半周期; 对于 CLK DIV 1 模式, 针对初始传输后的所有数据。

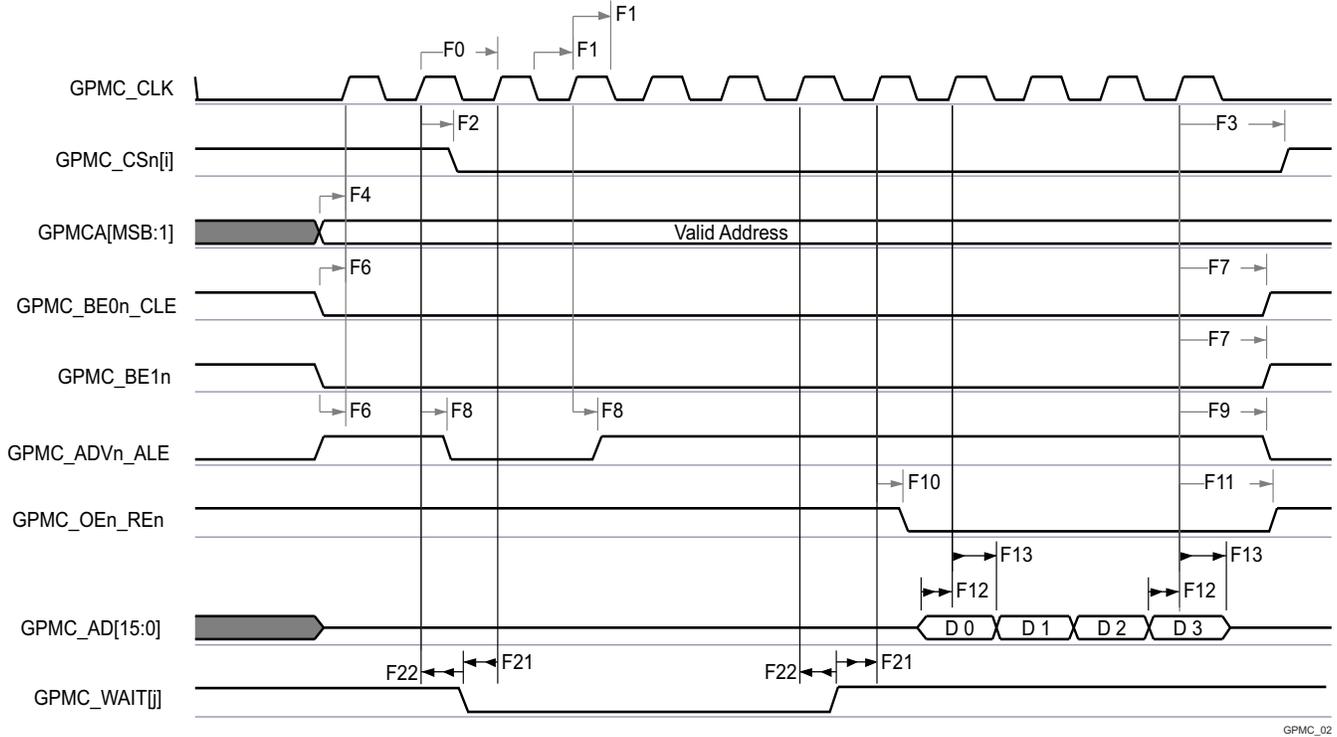
- (13) GPMC_CLKOUT 的半个周期；对于 CLK DIV 1 模式以外的模式，针对所有数据。GPMC_CLKOUT 从 GPMC_FCLK 进行分频。
- (14) 在 GPMC_CS*n*[*i*] 中，*i* 等于 0、1、2 或 3。在 GPMC_WAIT[*j*] 中，*j* 等于 0、1、2 或 3。
- (15) P = 以 ns 为单位的 GPMC_CLK 周期
- (16) 对于读取： $K = (\text{ADVRdOffTime} - \text{ADVOnTime}) \times (\text{TimeParaGranularity} + 1) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
对于写入： $K = (\text{ADVWrOffTime} - \text{ADVOnTime}) \times (\text{TimeParaGranularity} + 1) \times \text{GPMC_FCLK}^{(17)}$
- (17) GPMC_FCLK 是通用存储器控制器内部功能时钟周期（以 ns 为单位）。
- (18) 与 GPMC_CLK 输出时钟相关的最大和最小频率可在 GPMC 模块中通过设置 GPMC_CONFIG1_*i* 配置寄存器位字段 GPMCFCLKDIVIDER 进行编程。
- (19) 对于 div_by_1_mode：
- GPMC_CONFIG1_*i* 寄存器：GPMCFCLKDIVIDER = 0h：
 - GPMC_CLK 频率 = GPMC_FCLK 频率
 - CTRLMMR_GPMC_CLKSEL[1-0] CLK_SEL = 01 = PER1_PLL_CLKOUT/3 = 300/3 = 100 MHz
 - GPMC_CONFIG1_*i* 寄存器：TIMEPARAGRANULARITY = 0h = x1 延迟（影响 RD/WRCYCLETIME、RD/WRACCESSTIME、PAGEBURSTACCESSTIME、CSONTIME、CSRWD/WROFFTIME、ADVONTIME、ADVRD/WROFFTIME、OEONTIME、OEOFFTIME、WEONTIME、WEOFFTIME、CYCLE2CYCLEDELAY、BUSTURNAROUND、TIMEOUTSTARTVALUE、WRDATAONADMUXBUS）
- 对于无 extra_delay 的情况：
- GPMC_CONFIG2_*i* 寄存器：CSEXTRADELAY = 0h = CS*n* 时序控制信号不延迟
 - GPMC_CONFIG4_*i* 寄存器：WEEXTRADELAY = 0h = nWE 时序控制信号不延迟
 - GPMC_CONFIG4_*i* 寄存器：OEEXTRADELAY = 0h = nOE 时序控制信号不延迟
 - GPMC_CONFIG3_*i* 寄存器：ADVEXTRADELAY = 0h = nADV 时序控制信号不延迟
- (20) 对于 100MHz：
- CTRLMMR_GPMC_CLKSEL[1-0] CLK_SEL = 01 = MAIN_PLL2_HSDIV1_CLKOUT / 3
- 对于 133MHz：
- CTRLMMR_GPMC_CLKSEL[1-0] CLK_SEL = 00 = MAIN_PLL0_HSDIV3_CLKOUT



GPMC_01

- A. 在 GPMC_CSn[i] 中, i 等于 0、1、2 或 3。
- B. 在 GPMC_WAIT[j] 中, j 等于 0、1、2 或 3。

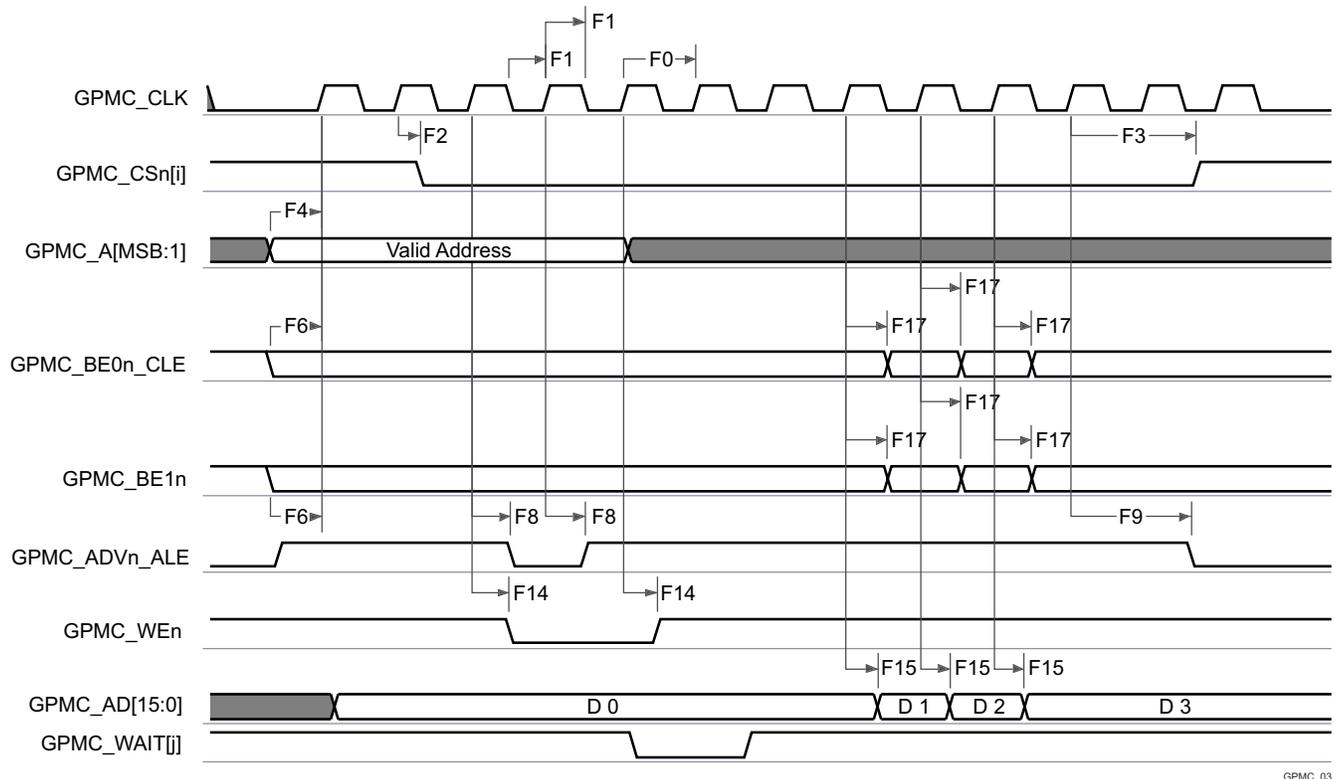
图 6-53. GPMC 和 NOR 闪存 - 同步单次读取 (GPMCFCLKDIVIDER = 0)



GPMC_02

- A. 在 GPMC_CS[n][i] 中, i 等于 0、1、2 或 3。
- B. 在 GPMC_WAIT[j] 中, j 等于 0、1、2 或 3。

图 6-54. GPMC 和 NOR 闪存 - 同步突发读取 - 4x16 位 (GPMCFCLKDIVIDER = 0)

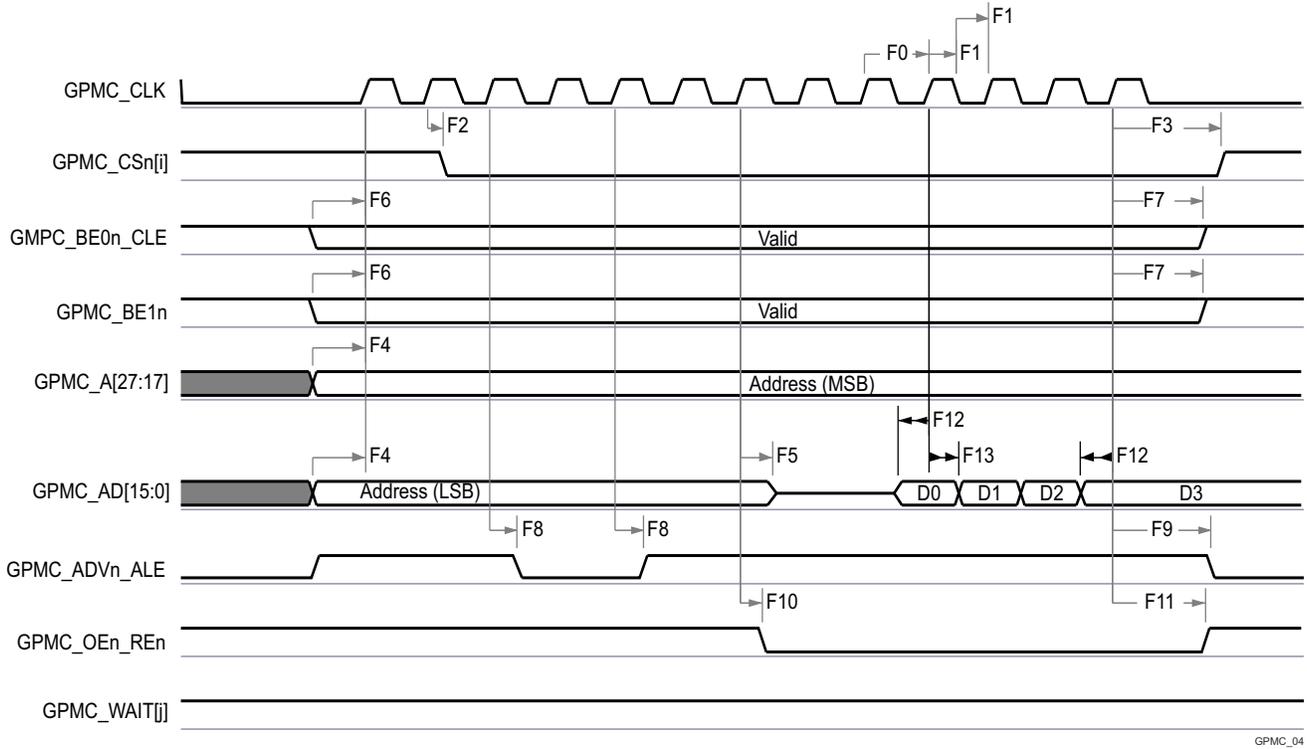


GPMC_03

- A. 在 GPMC_CS[n][i] 中, i 等于 0、1、2 或 3。

B. 在 GPMC_WAIT[j] 中, j 等于 0、1、2 或 3。

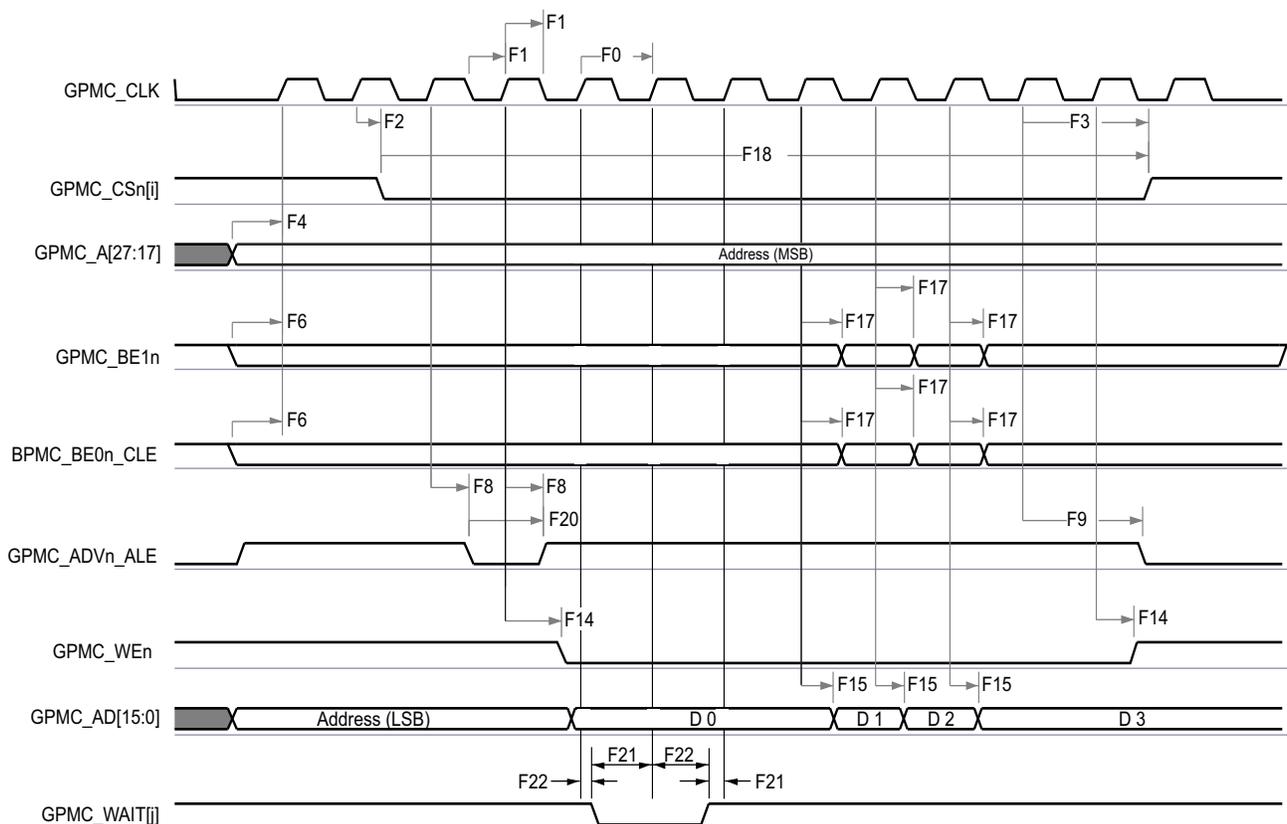
图 6-55. GPMC 和 NOR 闪存 - 同步突发写入 (GPMCFCLKDIVIDER = 0)



GPMC_04

- A. 在 GPMC_CSn[i] 中, i 等于 0、1、2 或 3。
B. 在 GPMC_WAIT[j] 中, j 等于 0、1、2 或 3。

图 6-56. GPMC 和多路复用 NOR 闪存 - 同步突发读取



GPMC_05

- A. 在 GPMC_CS[n] 中, i 等于 0、1、2 或 3。
B. 在 GPMC_WAIT[j] 中, j 等于 0、1、2 或 3。

图 6-57. GPMC 和多路复用 NOR 闪存 - 同步突发写入

6.10.5.10.2 GPMC 和 NOR 闪存 - 异步模式

节 6.10.5.10.2.1 和节 6.10.5.10.2.2 假设在建议运行条件和电气特性条件下进行测试 (请参阅图 6-58 至图 6-63)。

6.10.5.10.2.1 GPMC 和 NOR 闪存时序要求 - 异步模式

| 编号 | | | 模式 ⁽⁷⁾ | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---------------------|-----------------------------|--------------|--|-----|------------------|----|
| FA5 ⁽¹⁾ | $t_{\text{acc}(d)}$ | 数据访问时间 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X 1 | | H ⁽⁵⁾ | ns |
| FA20 ⁽²⁾ | $t_{\text{acc1-pgmode}(d)}$ | 页面模式连续数据访问时间 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X 1 | | P ⁽⁴⁾ | ns |
| FA21 ⁽³⁾ | $t_{\text{acc2-pgmode}(d)}$ | 页面模式首个数据访问时间 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X 1 | | H ⁽⁵⁾ | ns |

- (1) FA5 参数说明了在内部对输入数据进行采样所需的时间。该参数以 GPMC 功能时钟周期数表示。从读取周期开始到 FA5 功能时钟周期结束后, 输入数据通过有效功能时钟边沿在内部采样。FA5 值必须存储在 AccessTime 寄存器位字段内。
(2) FA20 参数说明了在内部对连续输入页面数据进行采样所需的时间。该参数以 GPMC 功能时钟周期数表示。每次访问输入页面数据后, 下一个输入页面数据将在 FA20 功能时钟周期后通过有效功能时钟边沿进行内部采样。FA20 值必须存储在 PageBurstAccessTime 寄存器位字段中。

- (3) FA21 参数说明了在内部对首个输入页面数据进行采样所需的时间。该参数以 GPMC 功能时钟周期数表示。从读取周期开始到 FA21 功能时钟周期结束后，首个输入页面数据通过有效功能时钟边沿在内部采样。FA21 值必须存储在 AccessTime 寄存器位字段内。
- (4) $P = \text{PageBurstAccessTime} \times (\text{TimeParaGranularity} + 1) \times \text{GPMC_FCLK}^{(6)}$
- (5) $H = \text{AccessTime} \times (\text{TimeParaGranularity} + 1) \times \text{GPMC_FCLK}^{(6)}$
- (6) GPMC_FCLK 是通用存储器控制器内部功能时钟周期 (以 ns 为单位)。
- (7) 对于 div_by_1_mode :
- GPMC_CONFIG1_i 寄存器 : GPMCFCLKDIVIDER = 0h :
 - GPMC_CLK 频率 = GPMC_FCLK 频率
 - CTRLMMR_GPMC_CLKSEL[1-0] CLK_SEL = 00 = CPSWHSIDIV_CLKOUT3 = 2000/15 = 133.33MHz
 - GPMC_CONFIG1_i 寄存器 : TIMEPARAGRANULARITY = 0h = x1 延迟 (影响 RD/WRCYCLETIME、RD/WRACCESSTIME、PAGEBURSTACCESSTIME、CSONTIME、CSRWD/WROFFTIME、ADVONTIME、ADV RD/WROFFTIME、OEONTIME、OEOFFTIME、WEONTIME、WEOFFTIME、CYCLE2CYCLEDELAY、BUSTURNAROUND、TIMEOUTSTARTVALUE、WRDATAONADMUXBUS)

6.10.5.10.2.2 GPMC 和 NOR 闪存开关特性 - 异步模式

| 编号 | 参数 | 说明 | 模式 ⁽¹⁵⁾ | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|------|--|---|--|--------------------------|--------------------------|----|
| | | | | 133 MHz ⁽¹⁶⁾ | | |
| FA0 | $t_{w(\text{be}[\text{x}]\text{nV})}$ | 脉冲持续时间, 输出低字节使能和命令锁存使能 GPMC_BE0n_CLE、输出高字节使能 GPMC_BE1n 有效时间 | 读取 | | N ⁽¹²⁾ | ns |
| | | | 写入 | | N ⁽¹²⁾ | |
| FA1 | $t_{w(\text{csnV})}$ | 脉冲持续时间, 输出片选 GPMC_CS <i>n</i> [<i>j</i>] ⁽¹³⁾ 低电平 | 读取 | | A ⁽¹⁾ | ns |
| | | | 写入 | | A ⁽¹⁾ | |
| FA3 | $t_{d(\text{csnV-advnIV})}$ | 延迟时间, 输出片选 GPMC_CS <i>n</i> [<i>j</i>] ⁽¹³⁾ 有效到输出地址有效和地址锁存使能 GPMC_ADV <i>n</i> _ALE 无效 | 读取 | B ⁽²⁾ - 2.55 | B ⁽²⁾ + 2.65 | ns |
| | | | 写入 | B ⁽²⁾ - 2.55 | B ⁽²⁾ + 2.65 | |
| FA4 | $t_{d(\text{csnV-oenIV})}$ | 延迟时间, 输出片选 GPMC_CS <i>n</i> [<i>j</i>] ⁽¹³⁾ 有效到输出使能 GPMC_OEn_RE <i>n</i> 无效 (单次读取) | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | C ⁽³⁾ - 2.55 | C ⁽³⁾ + 2.65 | ns |
| FA9 | $t_{d(\text{aV-csnV})}$ | 延迟时间, 输出地址 GPMC_A[27:1] 有效到输出片选 GPMC_CS <i>n</i> [<i>j</i>] ⁽¹³⁾ 有效 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | J ⁽⁹⁾ - 2.55 | J ⁽⁹⁾ + 2.65 | ns |
| FA10 | $t_{d(\text{be}[\text{x}]\text{nV-csnV})}$ | 延迟时间, 输出低字节使能和命令锁存使能 GPMC_BE0n_CLE、输出高字节使能 GPMC_BE1n 有效到输出片选 GPMC_CS <i>n</i> [<i>j</i>] ⁽¹³⁾ 有效 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | J ⁽⁹⁾ - 2.55 | J ⁽⁹⁾ + 2.65 | ns |
| FA12 | $t_{d(\text{csnV-advnV})}$ | 延迟时间, 输出片选 GPMC_CS <i>n</i> [<i>j</i>] ⁽¹³⁾ 有效到输出地址有效和地址锁存使能 GPMC_ADV <i>n</i> _ALE 有效 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | K ⁽¹⁰⁾ - 2.55 | K ⁽¹⁰⁾ + 2.65 | ns |
| FA13 | $t_{d(\text{csnV-oenV})}$ | 延迟时间, 输出片选 GPMC_CS <i>n</i> [<i>j</i>] ⁽¹³⁾ 有效到输出使能 GPMC_OEn_RE <i>n</i> 有效 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | L ⁽¹¹⁾ - 2.55 | L ⁽¹¹⁾ + 2.65 | ns |
| FA16 | $t_{w(\text{aIV})}$ | 脉冲持续时间, 输出地址 GPMC_A[26:1] 在 2 次连续读取和写入访问之间无效 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | G ⁽⁷⁾ | | ns |
| FA18 | $t_{d(\text{csnV-oenIV})}$ | 延迟时间, 输出片选 GPMC_CS <i>n</i> [<i>j</i>] ⁽¹³⁾ 有效到输出使能 GPMC_OEn_RE <i>n</i> 无效 (突发读取) | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | I ⁽⁸⁾ - 2.55 | I ⁽⁸⁾ + 2.65 | ns |

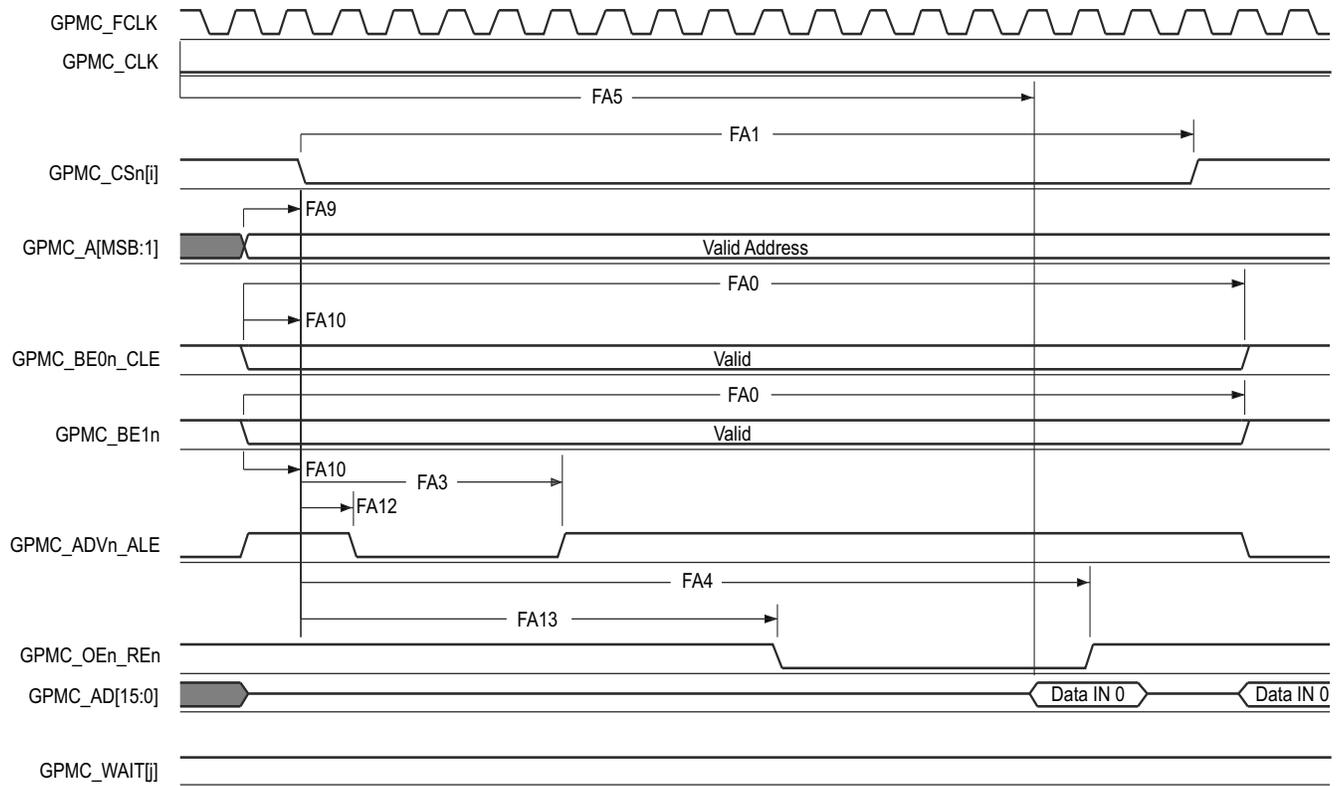
| 编号 | 参数 | 说明 | 模式 ⁽¹⁵⁾ | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|------|---------------------|---|--|---|-----|----|
| | | | | 133 MHz ⁽¹⁶⁾ | | |
| FA20 | $t_{w(av)}$ | 脉冲持续时间, 输出地址 GPMC_A[27:1] 有效 - 第 2、3、4 次访问 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | D ⁽⁴⁾ | | ns |
| FA25 | $t_{d(csnV-wenV)}$ | 延迟时间, 输出片选 GPMC_CS <i>n</i> [<i>i</i>] ⁽¹³⁾ 有效到输出写入使能 GPMC_WEn 有效 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | E ⁽⁵⁾ - 2.55 E ⁽⁵⁾ + 2.65 | | ns |
| FA27 | $t_{d(csnV-wenIV)}$ | 延迟时间, 输出片选 GPMC_CS <i>n</i> [<i>i</i>] ⁽¹³⁾ 有效到输出写入使能 GPMC_WEn 无效 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | F ⁽⁶⁾ - 2.55 F ⁽⁶⁾ + 2.65 | | ns |
| FA28 | $t_{d(wenV-dV)}$ | 延迟时间, 输出写入使能 GPMC_WEn 有效到输出数据 GPMC_AD[15:0] 有效 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | 2.65 | | ns |
| FA29 | $t_{d(dV-csnV)}$ | 延迟时间, 输出数据 GPMC_AD[15:0] 有效到输出片选 GPMC_CS <i>n</i> [<i>i</i>] ⁽¹³⁾ 有效 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | J ⁽⁹⁾ - 2.55 J ⁽⁹⁾ + 2.65 | | ns |
| FA37 | $t_{d(oenV-aIV)}$ | 延迟时间, 输出使能 GPMC_OEn_REn 有效到输出地址 GPMC_AD[15:0] 阶段结束 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | 2.65 | | ns |

- (1) 对于单次读取: $A = (CSRdOffTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
 对于单次写入: $A = (CSWrOffTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
 对于突发读取: $A = (CSRdOffTime - CSOnTime + (n - 1) \times PageBurstAccessTime) \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
 对于突发写入: $A = (CSWrOffTime - CSOnTime + (n - 1) \times PageBurstAccessTime) \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
 n 是页面突发访问编号
- (2) 对于读取: $B = ((ADVrdOffTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (ADVExtraDelay - CSEExtraDelay)) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
 对于写入: $B = ((ADVwrOffTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (ADVExtraDelay - CSEExtraDelay)) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
- (3) $C = ((OEOffTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (OEExtraDelay - CSEExtraDelay)) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
- (4) $D = PageBurstAccessTime \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
- (5) $E = ((WEOnTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (WEExtraDelay - CSEExtraDelay)) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
- (6) $F = ((WEOffTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (WEExtraDelay - CSEExtraDelay)) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
- (7) $G = Cycle2CycleDelay \times GPMC_FCLK^{(14)}$
- (8) $I = ((OEOffTime + (n - 1) \times PageBurstAccessTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (OEExtraDelay - CSEExtraDelay)) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
- (9) $J = (CSOnTime \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times CSEExtraDelay) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
- (10) $K = ((ADVOnTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (ADVExtraDelay - CSEExtraDelay)) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
- (11) $L = ((OEOnTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (OEExtraDelay - CSEExtraDelay)) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
- (12) 对于单次读取: $N = RdCycleTime \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
 对于单次写入: $N = WrCycleTime \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
 对于突发读取: $N = (RdCycleTime + (n - 1) \times PageBurstAccessTime) \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
 对于突发写入: $N = (WrCycleTime + (n - 1) \times PageBurstAccessTime) \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
- (13) 在 GPMC_CS*n*[*i*] 中, i 等于 0、1、2 或 3。
- (14) GPMC_FCLK 是通用存储器控制器内部功能时钟周期 (以 ns 为单位)。
- (15) 对于 div_by_1_mode :
- GPMC_CONFIG1_i 寄存器: GPMCFCLKDIVIDER = 0h :
 - GPMC_CLK 频率 = GPMC_FCLK 频率
 - CTRLMMR_GPMC_CLKSEL[1-0] CLK_SEL = 00 = CPSWHS DIV_CLKOUT3 = 2000/15 = 133.33MHz
 - GPMC_CONFIG1_i 寄存器: TIMEPARAGRANULARITY = 0h = x1 延迟 (影响 RD/WRCYCLETIME、RD/WRACCESSTIME、PAGEBURSTACCESSTIME、CSONTIME、CSRd/WROFFTIME、ADVONTIME、ADVrd/WROFFTIME、OEONTIME、

OEOFFTIME、WEONTIME、WEOFFTIME、CYCLE2CYCLEDELAY、BUSTURNAROUND、TIMEOUTSTARTVALUE、WRDATAONADMUXBUS)

(16) 对于 133MHz :

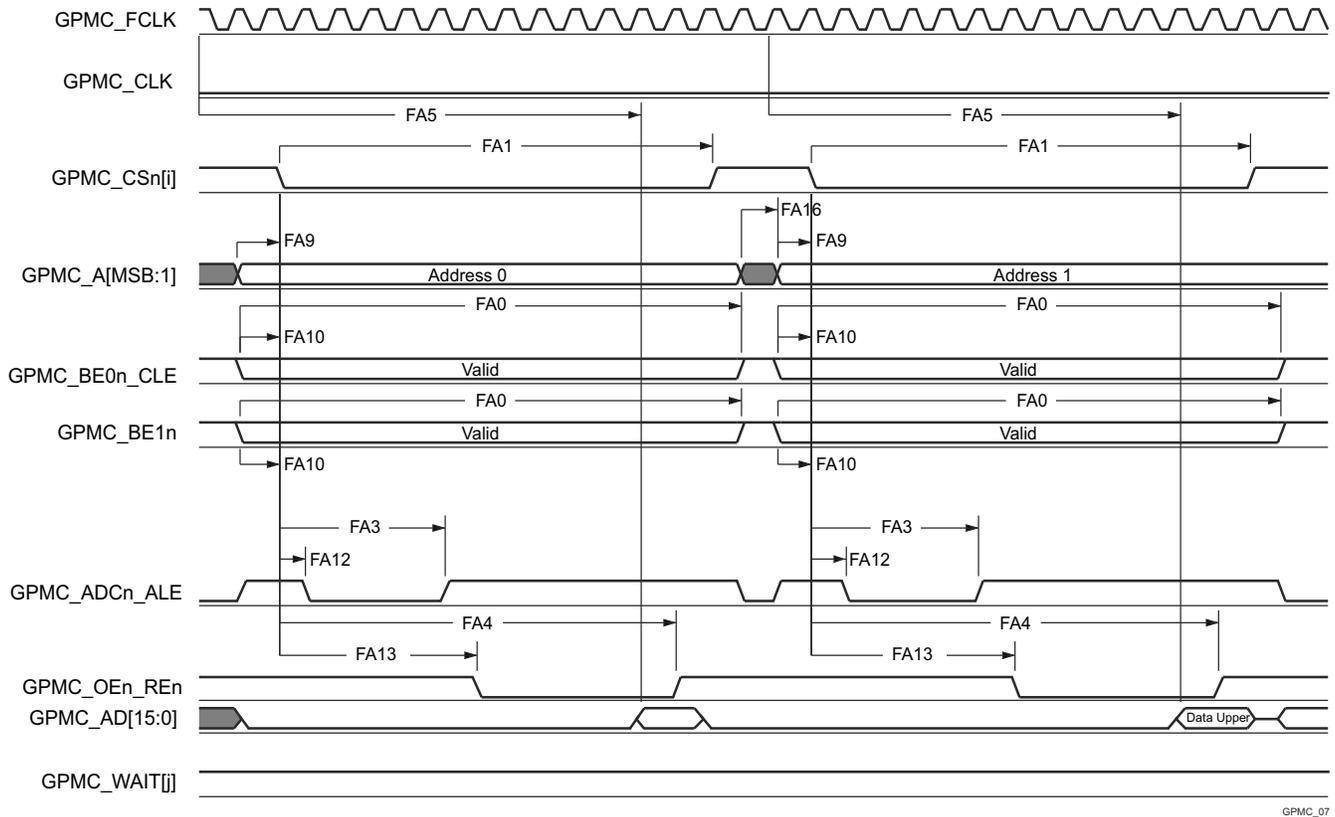
- CTRLMMR_GPMC_CLKSEL[1-0] CLK_SEL = 00 = MAIN_PLL0_HSDIV3_CLKOUT



GPMC_06

- 在 GPMC_CSn[i] 中, i 等于 0、1、2 或 3。在 GPMC_WAIT[j] 中, j 等于 0、1、2 或 3。
- FA5 参数说明了在内部对输入数据进行采样所需的时间。该参数以 GPMC 功能时钟周期数表示。从读取周期开始到 FA5 功能时钟周期结束后, 输入数据将通过有效功能时钟边沿在内部采样。FA5 值必须存储在 AccessTime 寄存器位字段内。
- GPMC_FCLK 是内部时钟 (GPMC 功能时钟), 不从外部提供。

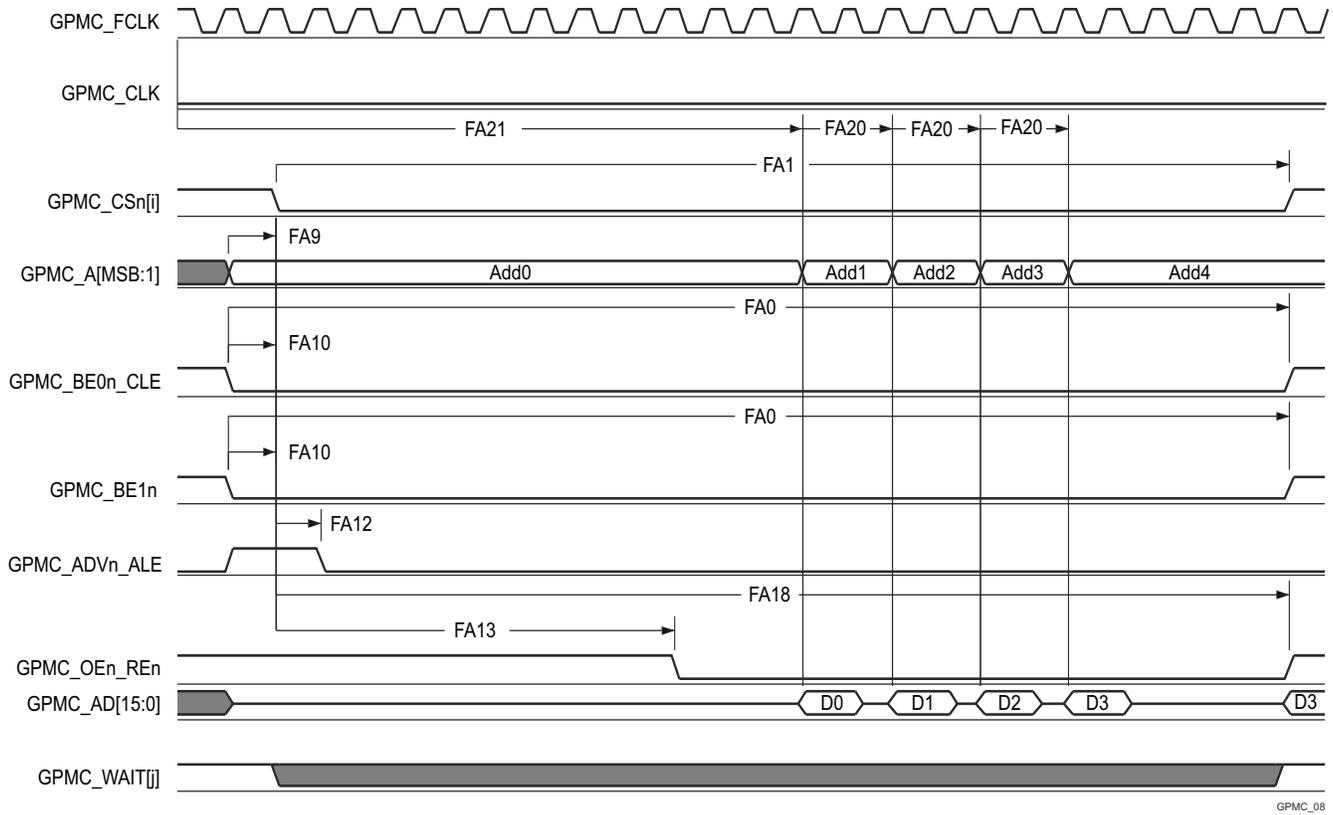
图 6-58. GPMC 和 NOR 闪存 - 异步读取 - 单字



GPMC_07

- 在 GPMC_CS*n*[*i*] 中, *i* 等于 0、1、2 或 3。在 GPMC_WAIT[j] 中, *j* 等于 0、1、2 或 3。
- FA5 参数说明了在内部对输入数据进行采样所需的时间。该参数以 GPMC 功能时钟周期数表示。从读取周期开始到 FA5 功能时钟周期结束后, 输入数据将通过有效功能时钟边沿在内部采样。FA5 值必须存储在 AccessTime 寄存器位字段内。
- GPMC_FCLK 是内部时钟 (GPMC 功能时钟), 不从外部提供。

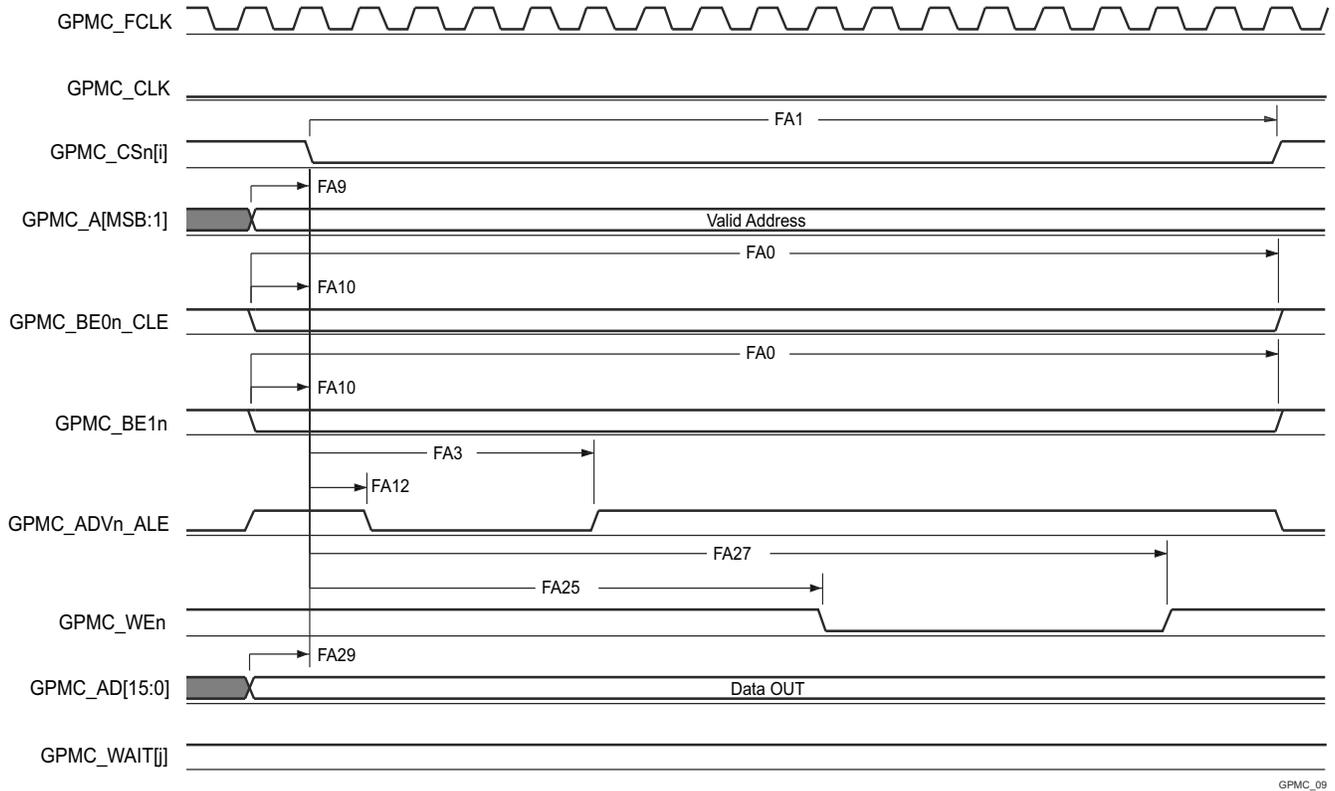
图 6-59. GPMC 和 NOR 闪存 - 异步读取 - 32 位



GPMC_08

- 在 GPMC_CS[n] 中, i 等于 0、1、2 或 3。在 GPMC_WAIT[j] 中, j 等于 0、1、2 或 3。
- FA21 参数说明了在内部对首个输入页面数据进行采样所需的时间。该参数以 GPMC 功能时钟周期数表示。从读取周期开始到 FA21 功能时钟周期结束后, 首个输入页面数据将通过有效功能时钟边沿在内部采样。FA21 计算结果必须存储在 AccessTime 寄存器位字段内。
- FA20 参数说明了在内部对连续输入页面数据进行采样所需的时间。该参数以 GPMC 功能时钟周期数表示。每次访问输入页面数据后, 下一个输入页面数据将在 FA20 功能时钟周期后通过有效功能时钟边沿进行内部采样。FA20 也是连续输入页面数据 (不包括第一个输入页面数据) 的寻址阶段的持续时间。FA20 值必须存储在 PageBurstAccessTime 寄存器位字段中。
- GPMC_FCLK 是内部时钟 (GPMC 功能时钟), 不从外部提供。

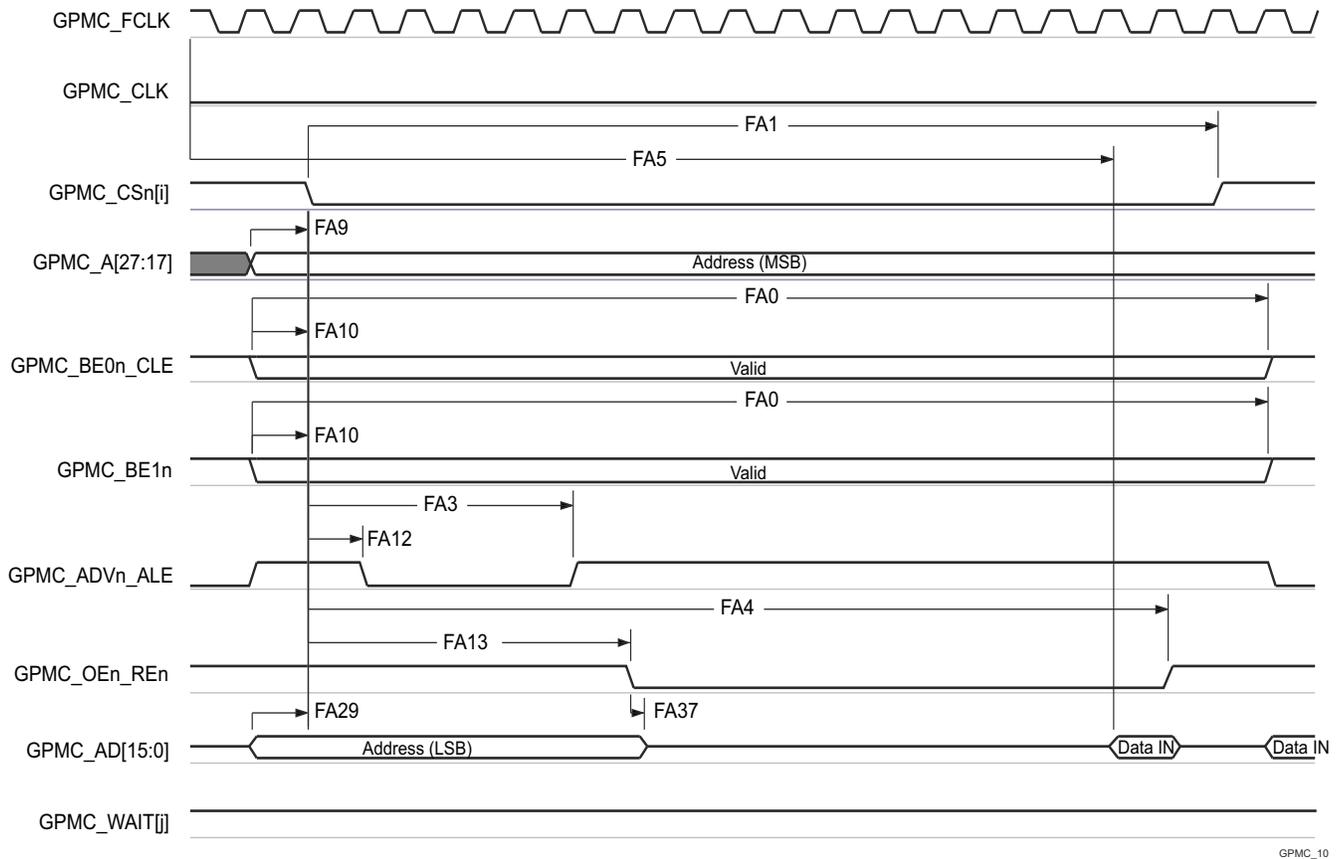
图 6-60. GPMC 和 NOR 闪存 - 异步读取 - 页面模式 4x16 位



GPMC_09

A. 在 GPMC_CS*n*[*i*] 中, *i* 等于 0、1、2 或 3。在 GPMC_WAIT[*j*] 中, *j* 等于 0、1、2 或 3。

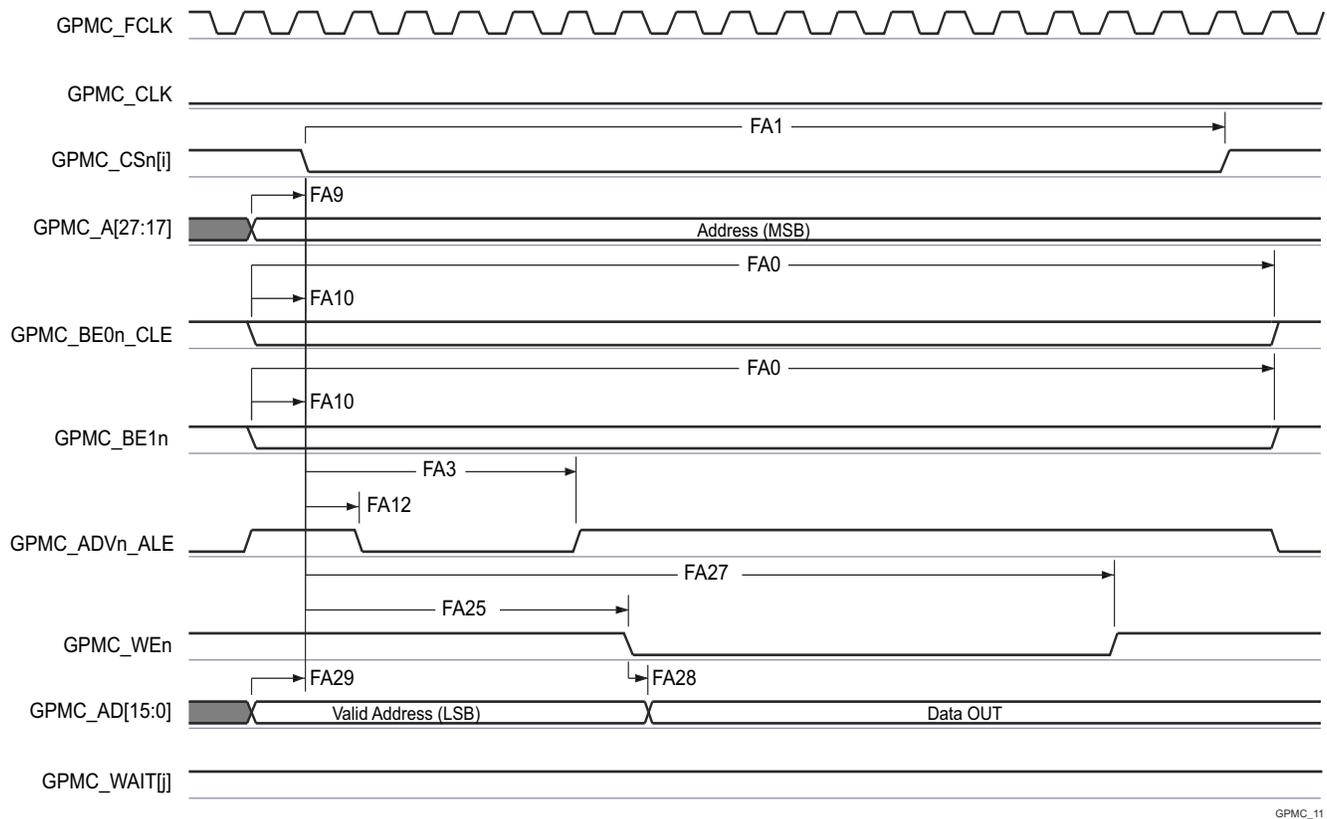
图 6-61. GPMC 和 NOR 闪存 - 异步写入 - 单字



GPMC_10

- A. 在 GPMC_CSn[i] 中, i 等于 0、1、2 或 3。在 GPMC_WAIT[j] 中, j 等于 0、1、2 或 3。
- B. FA5 参数说明了在内部对输入数据进行采样所需的时间。该参数以 GPMC 功能时钟周期数表示。从读取周期开始到 FA5 功能时钟周期结束后, 输入数据将通过有效功能时钟边沿在内部采样。FA5 值必须存储在 AccessTime 寄存器位字段内。
- C. GPMC_FCLK 是内部时钟 (GPMC 功能时钟), 不从外部提供。

图 6-62. GPMC 和多路复用 NOR 闪存 - 异步读取 - 单字



GPMC_11

A. 在 GPMC_CSn[i] 中, i 等于 0、1、2 或 3。在 GPMC_WAIT[j] 中, j 等于 0、1、2 或 3。

图 6-63. GPMC 和多路复用 NOR 闪存 - 异步写入 - 单字

6.10.5.10.3 GPMC 和 NAND 闪存 - 异步模式

节 6.10.5.10.3.1 和节 6.10.5.10.3.2 假设在建议运行条件和电气特性条件下进行测试 (请参阅图 6-64 至图 6-67) 。

6.10.5.10.3.1 GPMC 和 NAND 闪存时序要求 - 异步模式

| 编号 | 参数 | 模式 ⁽⁴⁾ | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|----------------------|--|--|------------------------|------------------|----|
| | | | 133 MHz ⁽⁵⁾ | | |
| GNF12 ⁽¹⁾ | $t_{acc(d)}$ 访问时间, 输入数据 GPMC_AD[15:0] ⁽³⁾ | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | | J ⁽²⁾ | ns |

(1) GNF12 参数说明了在内部对输入数据进行采样所需的时间。该参数以 GPMC 功能时钟周期数表示。从读取周期开始到 GNF12 功能时钟周期结束后, 输入数据通过有效功能时钟边沿在内部采样。GNF12 值必须存储在 AccessTime 寄存器位字段内。

(2) $J = AccessTime \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC_FCLK$ ⁽³⁾

(3) GPMC_FCLK 是通用存储器控制器内部功能时钟周期 (以 ns 为单位) 。

(4) 对于 div_by_1_mode :

- GPMC_CONFIG1_i 寄存器 : GPMCFCLKDIVIDER = 0h :
 - GPMC_CLK 频率 = GPMC_FCLK 频率
- CTRLMMR_GPMC_CLKSEL[1-0] CLK_SEL = 00 = CPSWHSIDIV_CLKOUT3 = 2000/15 = 133.33MHz
- GPMC_CONFIG1_i 寄存器 : TIMEPARAGRANULARITY = 0h = x1 延迟 (影响 RD/WRCYCLETIME、RD/WRACCESSTIME、PAGEBURSTACCESSTIME、CSONTIME、CSRWD/WROFFTIME、ADVONTIME、ADVRD/WROFFTIME、OEONTIME、OEOFFTIME、WEONTIME、WEOFFTIME、CYCLE2CYCLEDELAY、BUSTURNAROUND、TIMEOUTSTARTVALUE、WRDATAONADMUXBUS)

(5) 对于 133MHz :

- CTRLMMR_GPMC_CLKSEL[1-0] CLK_SEL = 00 = MAIN_PLL0_HSDIV3_CLKOUT

6.10.5.10.3.2 GPMC 和 NAND 闪存开关特性 - 异步模式

| 编号 | 参数 | 模式 ⁽¹⁵⁾ | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|------|---|--|-------------------------|------------------------|----|
| | | | 133 MHz ⁽¹⁶⁾ | | |
| GNF0 | $t_{w(wenV)}$ 脉冲持续时间, 输出写入使能 GPMC_WEn 有效 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | A ⁽¹⁾ | | ns |
| GNF1 | $t_{d(csnV-wenV)}$ 延迟时间, 输出片选 GPMC_CSn[j] ⁽¹³⁾ 有效到输出写入使能 GPMC_WEn 有效 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | B ⁽²⁾ - 2.55 | B ⁽²⁾⁺ 2.65 | ns |
| GNF2 | $t_{w(cleH-wenV)}$ 延迟时间, 输出低字节使能和命令锁存使能 GPMC_BE0n_CLE 高电平到输出写入使能 GPMC_WEn 有效 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | C ⁽³⁾ - 2.55 | C ⁽³⁾⁺ 2.65 | ns |
| GNF3 | $t_{w(wenV-dV)}$ 延迟时间, 输出数据 GPMC_AD[15:0] 有效到输出写入使能 GPMC_WEn 有效 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | D ⁽⁴⁾ - 2.55 | D ⁽⁴⁾⁺ 2.65 | ns |
| GNF4 | $t_{w(wenIV-dIV)}$ 延迟时间, 输出写入使能 GPMC_WEn 无效到输出数据 GPMC_AD[15:0] 无效 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | E ⁽⁵⁾ - 2.55 | E ⁽⁵⁾⁺ 2.65 | ns |
| GNF5 | $t_{w(wenIV-cleIV)}$ 延迟时间, 输出写入使能 GPMC_WEn 无效到输出低字节使能和命令锁存使能 GPMC_BE0n_CLE 无效 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | F ⁽⁶⁾ - 2.55 | F ⁽⁶⁾⁺ 2.65 | ns |

| 编号 | 参数 | 模式 ⁽¹⁵⁾ | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------|---|--|--------------------------|-------------------------|----|
| | | | 133 MHz ⁽¹⁶⁾ | | |
| GNF6 | $t_{w(wenIV-CSn[i]V)}$ 延迟时间, 输出写入使能 GPMC_WEn 无效到输出片选 GPMC_CS <i>n</i> [<i>i</i>] ⁽¹³⁾ 无效 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | G ⁽⁷⁾ - 2.55 | G ⁽⁷⁾⁺ 2.65 | ns |
| GNF7 | $t_{w(aleH-wenV)}$ 延迟时间, 输出地址有效和地址锁存使能 GPMC_ADV <i>n</i> _ALE 高电平到输出写入使能 GPMC_WEn 有效 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | C ⁽³⁾ - 2.55 | C ⁽³⁾⁺ 2.65 | ns |
| GNF8 | $t_{w(wenIV-aleIV)}$ 延迟时间, 输出写入使能 GPMC_WEn 无效到输出地址有效和地址锁存使能 GPMC_ADV <i>n</i> _ALE 无效 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | F ⁽⁶⁾ - 2.55 | F ⁽⁶⁾⁺ 2.65 | ns |
| GNF9 | $t_{c(wen)}$ 周期时间, 写入 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | | H ⁽⁸⁾ | ns |
| GNF10 | $t_{d(csnV-oenV)}$ 延迟时间, 输出片选 GPMC_CS <i>n</i> [<i>i</i>] ⁽¹³⁾ 有效到输出使能 GPMC_OEn_RE <i>n</i> 有效 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | I ⁽⁹⁾ - 2.55 | I ⁽⁹⁾⁺ 2.65 | ns |
| GNF13 | $t_{w(oenV)}$ 脉冲持续时间, 输出使能 GPMC_OEn_RE <i>n</i> 有效 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | | K ⁽¹⁰⁾ | ns |
| GNF14 | $t_{c(oen)}$ 周期时间, 读取 | div_by_1_mode ; GPMC_FCLK_MUX ; TIMEPARAGRANULARITY_X1 | | L ⁽¹¹⁾ | ns |
| GNF15 | $t_{w(oenIV-CSn[i]V)}$ 延迟时间, 输出使能 GPMC_OEn_RE <i>n</i> 无效到输出片选 GPMC_CS <i>n</i> [<i>i</i>] ⁽¹³⁾ 无效 | div_by_1_mode ; | M ⁽¹²⁾ - 2.55 | M ⁽¹²⁾⁺ 2.65 | ns |

- (1) $A = (WEOffTime - WEOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
(2) $B = ((WEOnTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (WEEExtraDelay - CSEExtraDelay)) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
(3) $C = ((WEOnTime - ADVOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (WEEExtraDelay - ADVExtraDelay)) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
(4) $D = (WEOnTime \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times WEEExtraDelay) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
(5) $E = ((WrCycleTime - WEOffTime) \times (TimeParaGranularity + 1) - 0.5 \times WEEExtraDelay) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
(6) $F = ((ADVWrOffTime - WEOffTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (ADVExtraDelay - WEEExtraDelay)) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
(7) $G = ((CSWrOffTime - WEOffTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (CSEExtraDelay - WEEExtraDelay)) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
(8) $H = WrCycleTime \times (1 + TimeParaGranularity) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
(9) $I = ((OEOnTime - CSOnTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (OEEExtraDelay - CSEExtraDelay)) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
(10) $K = (OEOffTime - OEOnTime) \times (1 + TimeParaGranularity) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
(11) $L = RdCycleTime \times (1 + TimeParaGranularity) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
(12) $M = ((CSRdOffTime - OEOffTime) \times (TimeParaGranularity + 1) + 0.5 \times (CSEExtraDelay - OEEExtraDelay)) \times GPMC_FCLK^{(14)}$
(13) 在 GPMC_CS*n*[*i*] 中, *i* 等于 0、1、2 或 3。
(14) GPMC_FCLK 是通用存储器控制器内部功能时钟周期 (以 ns 为单位)。
(15) 对于 div_by_1_mode :

- GPMC_CONFIG1_i 寄存器 : GPMCFCLKDIVIDER = 0h :
 - GPMC_CLK 频率 = GPMC_FCLK 频率

对于 GPMC_FCLK_MUX :

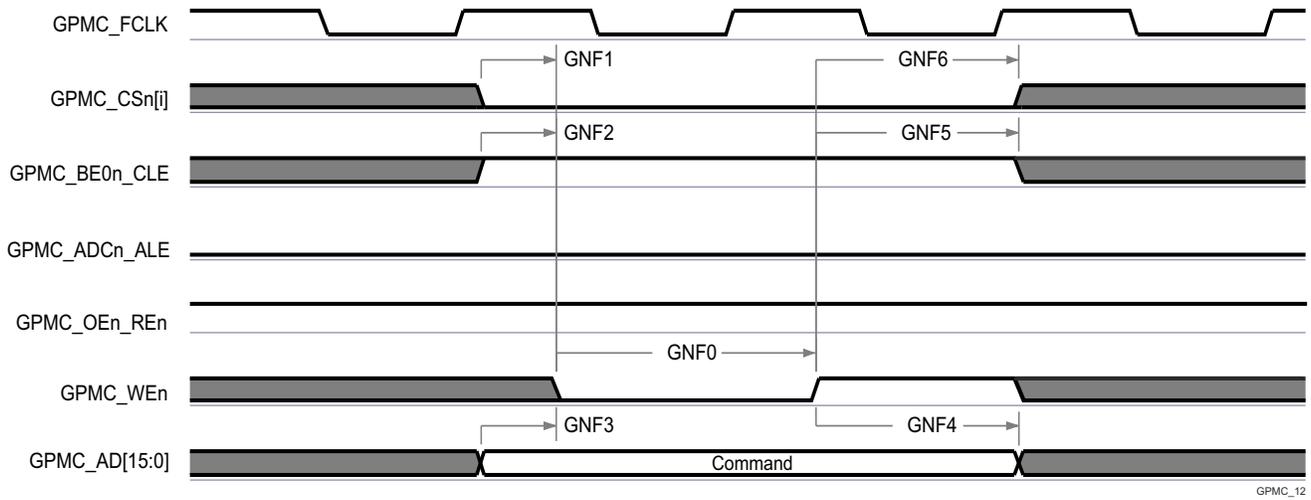
- CTRLMMR_GPMC_CLKSEL[1-0] CLK_SEL = 00 = CPSWHSIDIV_CLKOUT3 = 2000/15 = 133.33MHz

对于 TIMEPARAGRANULARITY_X1 :

- GPMC_CONFIG1_i 寄存器 : TIMEPARAGRANULARITY = 0h = x1 延迟 (影响 RD/WRCYCLETIME、RD/WRACCESSTIME、PAGEBURSTACCESSTIME、CSONTIME、CSRd/WROFFTIME、ADVONTIME、ADVrd/WROFFTIME、OEONTIME、OEOffTIME、WEONTIME、WEOffTIME、CYCLE2CYCLEDELAY、BUSTURNAROUND、TIMEOUTSTARTVALUE、WRDATAONADMUXBUS)

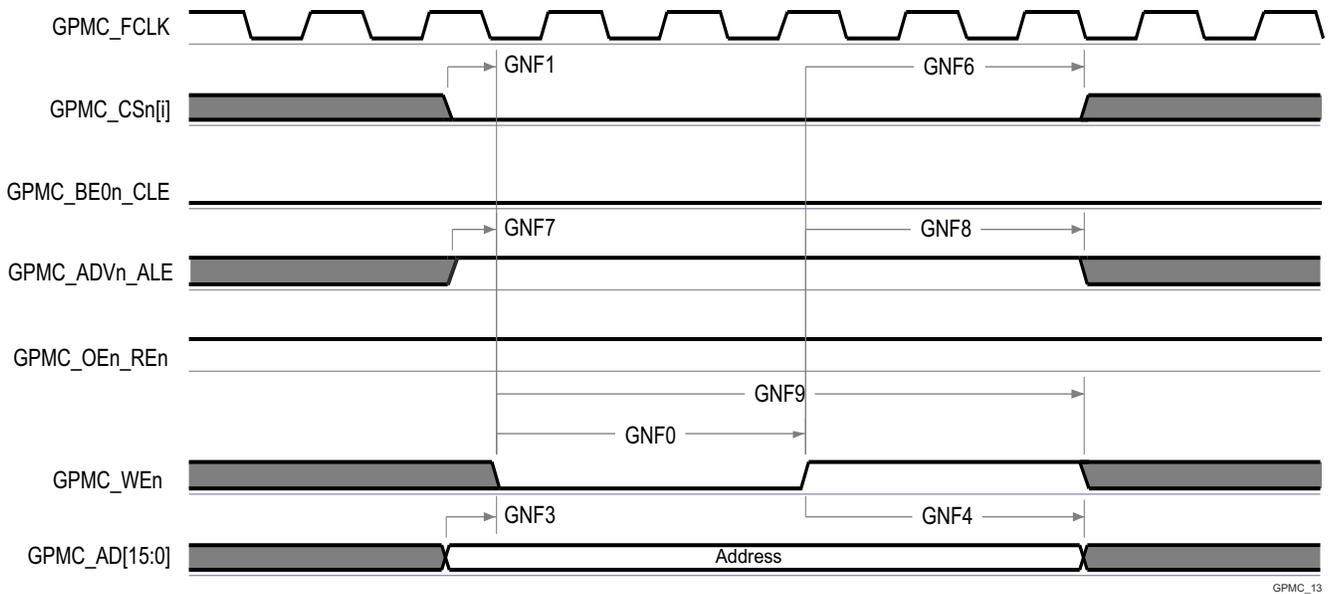
- (16) 对于 133MHz :

- CTRLMMR_GPMC_CLKSEL[1-0] CLK_SEL = 00 = MAIN_PLL0_HSDIV3_CLKOUT



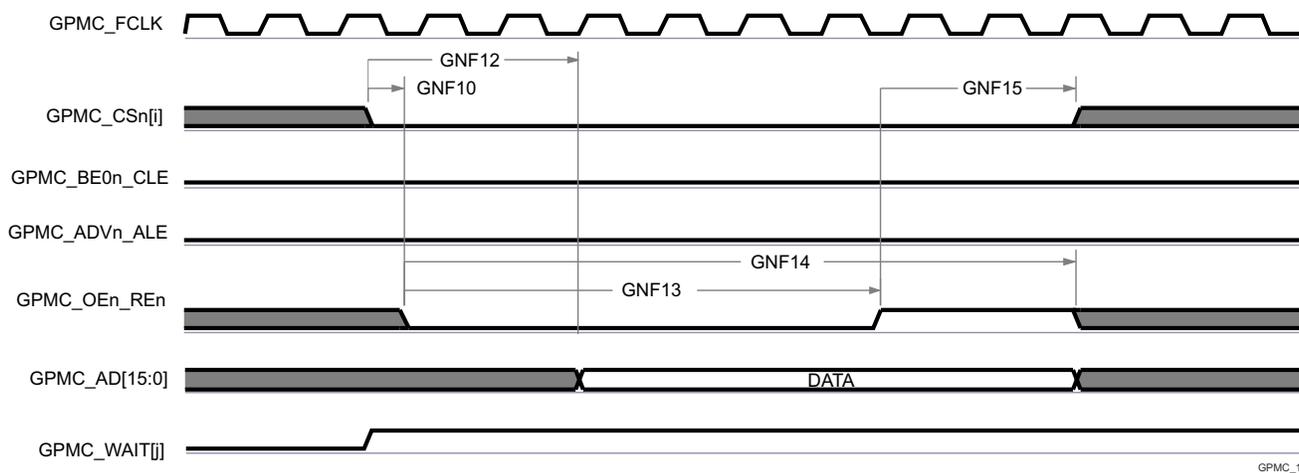
A. 在 GPMC_CSn[i] 中, i 等于 0、1、2 或 3。

图 6-64. GPMC 和 NAND 闪存 - 命令锁存周期



A. 在 GPMC_CSn[i] 中, i 等于 0、1、2 或 3。

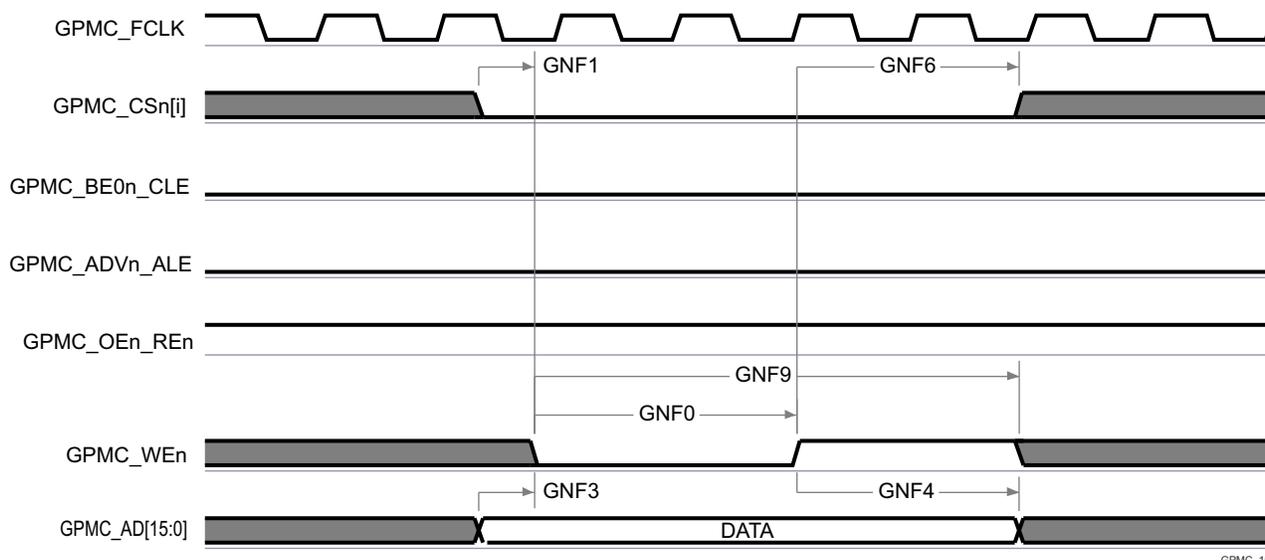
图 6-65. GPMC 和 NAND 闪存 - 地址锁存周期



GPMC_14

- A. GNF12 参数说明了在内部对输入数据进行采样所需的时间。该参数以 GPMC 功能时钟周期数表示。从读取周期开始到 GNF12 功能时钟周期结束后，输入数据将通过有效功能时钟边沿在内部采样。GNF12 值必须存储在 AccessTime 寄存器位字段内。
- B. GPMC_FCLK 是内部时钟（GPMC 功能时钟），不从外部提供。
- C. 在 GPMC_CSn[i] 中，i 等于 0、1、2 或 3。在 GPMC_WAIT[j] 中，j 等于 0、1、2 或 3。

图 6-66. GPMC 和 NAND 闪存 - 数据读取周期



GPMC_15

- A. 在 GPMC_CSn[i] 中，i 等于 0、1、2 或 3。

图 6-67. GPMC 和 NAND 闪存 - 数据写入周期

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的增强型脉宽调制 (EPWM) 模块一节。

6.10.5.10.4 GPMC0 IOSET

表 6-42 说明了与 GPMC0 搭配使用的具体信号分组 (IOSET)。

表 6-42. GPMC0 IOSET

| 信号 | IOSET1 | | IOSET2 | |
|-------------|----------------|-------|------------|-------|
| | 焊球名称 | 多路复用器 | 焊球名称 | 多路复用器 |
| GPMC0_WAIT2 | MDIO0_MDC | 8 | MDIO0_MDC | 8 |
| GPMC0_BE1n | PRG1_PRU0_GPO0 | 8 | RGMI16_RD1 | 8 |

表 6-42. GPMC0 IOSET (续)

| 信号 | IOSET1 | | IOSET2 | |
|----------------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| | 焊球名称 | 多路复用器 | 焊球名称 | 多路复用器 |
| GPMC0_WAIT0 | PRG1_PRU0_GPO1 | 8 | PRG1_PRU0_GPO1 | 8 |
| GPMC0_WAIT1 | PRG1_PRU0_GPO2 | 8 | PRG1_PRU0_GPO2 | 8 |
| GPMC0_DIR | PRG1_PRU0_GPO3 | 8 | PRG1_PRU0_GPO3 | 8 |
| GPMC0_CSn2 | PRG1_PRU0_GPO4 | 8 | PRG1_PRU0_GPO4 | 8 |
| GPMC0_WEn | PRG1_PRU0_GPO5 | 8 | PRG1_PRU0_GPO5 | 8 |
| GPMC0_CSn3 | PRG1_PRU0_GPO6 | 8 | PRG1_PRU0_GPO6 | 8 |
| GPMC0_OEn_REn | PRG1_PRU0_GPO8 | 8 | PRG1_PRU0_GPO8 | 8 |
| GPMC0_ADVn_ALE | PRG1_PRU0_GPO9 | 8 | PRG1_PRU0_GPO9 | 8 |
| GPMC0_BE0n_CLE | PRG1_PRU0_GPO10 | 8 | PRG1_PRU0_GPO10 | 8 |
| GPMC0_WPn | PRG1_PRU1_GPO5 | 8 | PRG1_PRU1_GPO5 | 8 |
| GPMC0_CSn1 | PRG1_PRU1_GPO8 | 8 | PRG1_PRU1_GPO8 | 8 |
| GPMC0_CSn0 | PRG1_PRU1_GPO9 | 8 | PRG1_PRU1_GPO9 | 8 |
| GPMC0_CLKOUT | PRG1_PRU1_GPO10 | 8 | PRG1_PRU1_GPO10 | 8 |
| GPMC0_AD0 | PRG0_PRU0_GPO5 | 8 | PRG0_PRU0_GPO5 | 8 |
| GPMC0_AD1 | PRG0_PRU0_GPO7 | 8 | PRG0_PRU0_GPO7 | 8 |
| GPMC0_AD2 | PRG0_PRU0_GPO8 | 8 | PRG0_PRU0_GPO8 | 8 |
| GPMC0_AD3 | PRG0_PRU0_GPO9 | 8 | PRG0_PRU0_GPO9 | 8 |
| GPMC0_AD4 | PRG0_PRU0_GPO10 | 8 | PRG0_PRU0_GPO10 | 8 |
| GPMC0_AD5 | PRG0_PRU0_GPO17 | 8 | PRG0_PRU0_GPO17 | 8 |
| GPMC0_AD6 | PRG0_PRU0_GPO18 | 8 | PRG0_PRU0_GPO18 | 8 |
| GPMC0_AD7 | PRG0_PRU0_GPO19 | 8 | PRG0_PRU0_GPO19 | 8 |
| GPMC0_AD8 | PRG0_PRU1_GPO5 | 8 | PRG0_PRU1_GPO5 | 8 |
| GPMC0_AD9 | PRG0_PRU1_GPO7 | 8 | PRG0_PRU1_GPO7 | 8 |
| GPMC0_AD10 | PRG0_PRU1_GPO8 | 8 | PRG0_PRU1_GPO8 | 8 |
| GPMC0_AD11 | PRG0_PRU1_GPO9 | 8 | PRG0_PRU1_GPO9 | 8 |
| GPMC0_AD12 | PRG0_PRU1_GPO10 | 8 | PRG0_PRU1_GPO10 | 8 |
| GPMC0_AD13 | PRG0_PRU1_GPO17 | 8 | PRG0_PRU1_GPO17 | 8 |
| GPMC0_AD14 | PRG0_PRU1_GPO18 | 8 | PRG0_PRU1_GPO18 | 8 |
| GPMC0_AD15 | PRG0_PRU1_GPO19 | 8 | PRG0_PRU1_GPO19 | 8 |
| GPMC0_A0 | PRG0_MDIO0_MDC | 8 | PRG0_MDIO0_MDC | 8 |
| GPMC0_A1 | RGMII5_TX_CTL | 8 | RGMII5_TX_CTL | 8 |
| GPMC0_A2 | RGMII5_RX_CTL | 8 | RGMII5_RX_CTL | 8 |
| GPMC0_A3 | RGMII5_TD3 | 8 | RGMII5_TD3 | 8 |
| GPMC0_A4 | RGMII5_TD2 | 8 | RGMII5_TD2 | 8 |
| GPMC0_A5 | RGMII5_TD1 | 8 | RGMII5_TD1 | 8 |
| GPMC0_A6 | RGMII5_TD0 | 8 | RGMII5_TD0 | 8 |
| GPMC0_A7 | RGMII5_TXC | 8 | RGMII5_TXC | 8 |
| GPMC0_A8 | RGMII5_RXC | 8 | RGMII5_RXC | 8 |
| GPMC0_A9 | RGMII5_RD3 | 8 | RGMII5_RD3 | 8 |
| GPMC0_A10 | RGMII5_RD2 | 8 | RGMII5_RD2 | 8 |
| GPMC0_A11 | RGMII5_RD1 | 8 | RGMII5_RD1 | 8 |
| GPMC0_A12 | RGMII5_RD0 | 8 | RGMII5_RD0 | 8 |
| GPMC0_A13 | RGMII6_TX_CTL | 8 | RGMII6_TX_CTL | 8 |
| GPMC0_A14 | RGMII6_RX_CTL | 8 | RGMII6_RX_CTL | 8 |

表 6-42. GPMC0 IOSET (续)

| 信号 | IOSET1 | | IOSET2 | |
|-------------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| | 焊球名称 | 多路复用器 | 焊球名称 | 多路复用器 |
| GPMC0_A15 | RGMII6_TD3 | 8 | RGMII6_TD3 | 8 |
| GPMC0_A16 | RGMII6_TD2 | 8 | RGMII6_TD2 | 8 |
| GPMC0_A17 | RGMII6_TD1 | 8 | RGMII6_TD1 | 8 |
| GPMC0_A18 | RGMII6_TD0 | 8 | RGMII6_TD0 | 8 |
| GPMC0_A19 | RGMII6_TXC | 8 | RGMII6_TXC | 8 |
| GPMC0_A20 | RGMII6_RXC | 8 | RGMII6_RXC | 8 |
| GPMC0_A21 | RGMII6_RD3 | 8 | RGMII6_RD3 | 8 |
| GPMC0_A22 | RGMII6_RD2 | 8 | RGMII6_RD2 | 8 |
| GPMC0_A23 | PRG0_PRU1_GPO2 | 8 | PRG0_PRU1_GPO2 | 8 |
| GPMC0_A24 | PRG0_PRU1_GPO4 | 8 | PRG0_PRU1_GPO4 | 8 |
| GPMC0_A25 | PRG0_PRU1_GPO6 | 8 | PRG0_PRU1_GPO6 | 8 |
| GPMC0_A26 | PRG0_PRU1_GPO11 | 8 | PRG0_PRU1_GPO11 | 8 |
| GPMC0_A27 | PRG0_MDIO0_MDIO | 8 | PRG0_MDIO0_MDIO | 8 |
| GPMC0_WAIT3 | MDIO0_MDIO | 8 | MDIO0_MDIO | 8 |

6.10.5.11 HyperBus

如需进一步详细了解器件 HyperBus 的特性和其他说明信息，请参阅[信号说明](#)和[详细说明](#)中的相应小节。

节 6.10.5.11、节 6.10.5.11.2 和节 6.10.5.11.3 假设在建议运行条件和电气特性条件下进行测试（请参阅图 6-68、图 6-69 和图 6-70）。

表 6-43 表示 HyperBus 时序条件。

表 6-43. HyperBus 时序条件

| 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----------------|--------|-----|-----|------|
| 输入条件 | | | | |
| SR _i | 输入压摆率 | 2 | 5 | V/ns |
| 输出条件 | | | | |
| C _L | 输出负载电容 | 1.5 | 8 | pF |

6.10.5.11.1 HyperBus 的时序要求

| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|----|------------------------------|------------------------|--------|-----|----|
| D1 | t _w (RESETn) | 脉冲宽度，RESETn | 200 | | ns |
| D2 | t _w (csL) | 脉冲宽度，芯片选择 | 1000 | | ns |
| D3 | t _d (RESETnH-csL) | 延迟时间，RESETn 无效到 CSn 有效 | 200.34 | | ns |
| D4 | t _d (csL-RWDSL) | 延迟时间，CSn 有效到 RWDS 下降 | 115 | | ns |

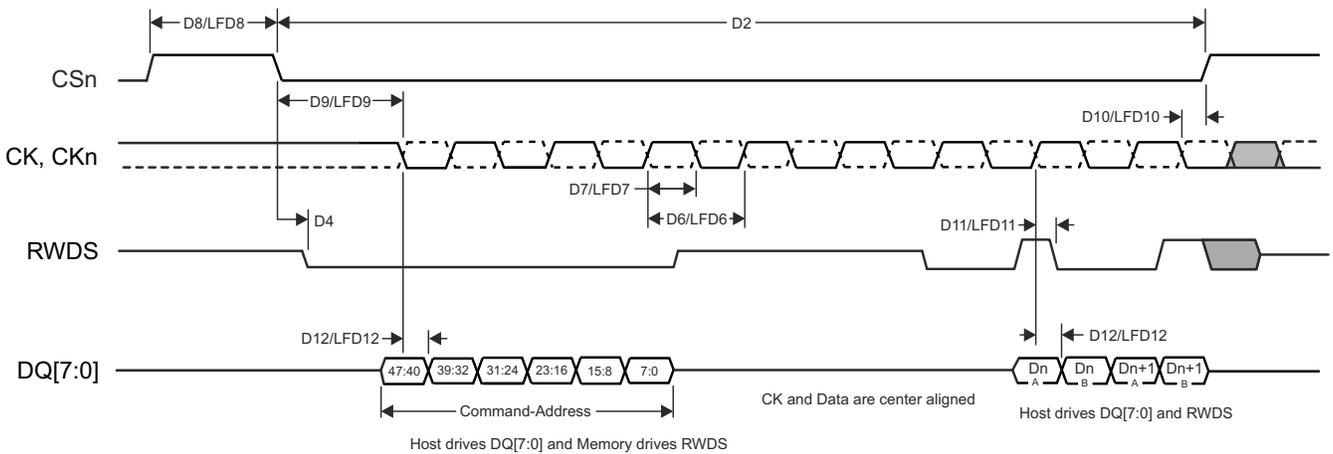
6.10.5.11.2 HyperBus 166MHz 开关特性

| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----|-------------------------------|------------------------------------|-------|-------|----|
| D5 | t _{skn} (rwdsX-dV) | 输入偏移，RWDS 转换到 D0:D7 有效 | -0.46 | 0.46 | ns |
| D6 | t _c (clk/clkn) | CLK 周期，CLK/CLKn | 6 | | ns |
| D7 | t _w (clk/clkn) | 脉冲宽度，CLK/CLKn | 2.7 | | ns |
| D8 | t _w (csIV) | 脉冲宽度，操作之间 CS0 无效 | 6 | | ns |
| D9 | t _d (clkH-csL) | 延迟时间，CS0 有效到 CLK 上升/CLKn 下降 | | -3.34 | ns |
| D10 | t _d (clkL[LE]-csH) | 延迟时间，最后一个 CLK 下降沿/CLKn 上升沿到 CS0 无效 | 0.41 | | ns |

| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----|------------------------------|------------------------|------|------|----|
| D11 | $t_{d(\text{clkX-rwdsV})}$ | 延迟时间, CLK 转换到 RWDS 有效 | 1.01 | 2.08 | ns |
| D12 | $t_{d(\text{clkX-d}[0:7]V)}$ | 延迟时间, CLK 转换到 D0:D7 有效 | 0.84 | 2.17 | ns |

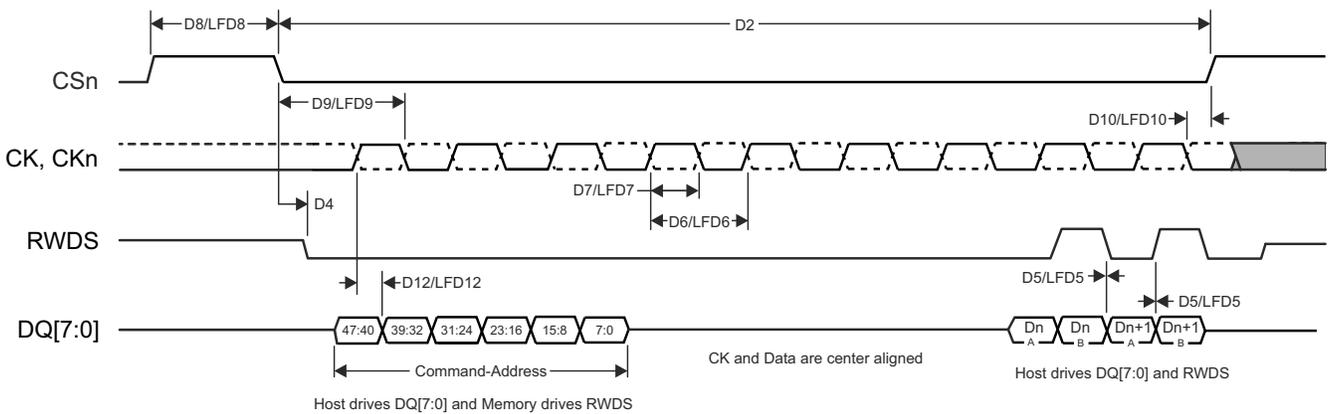
6.10.5.11.3 HyperBus 100MHz 开关特性

| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------|------------------------------|----------------------------|-------|-------|----|
| LFD5 | $t_{skn(\text{rwdsX-dV})}$ | 输入偏斜, RWDS 转换到 D0:D7 有效 | -0.81 | 0.81 | ns |
| LFD6 | $t_{c(\text{clk})}$ | CLK 周期, CLK | 10 | | ns |
| LFD7 | $t_{w(\text{clk})}$ | 脉冲宽度, CLK | 4.75 | | ns |
| LFD8 | $t_{w(\text{csiV})}$ | 脉冲宽度, 操作之间 CS0 无效 | 10 | | ns |
| LFD9 | $t_{d(\text{clkH-csL})}$ | 延迟时间, CS0 有效到 CLK 上升 | | -3.51 | ns |
| LFD10 | $t_{d(\text{clkL}[LE]-csH)}$ | 延迟时间, 最后一个 CLK 下降沿到 CS0 无效 | 0.51 | | ns |
| LFD11 | $t_{d(\text{clkX-rwdsV})}$ | 延迟时间, CLK 转换到 RWDS 有效 | 1.51 | 3.49 | ns |
| LFD12 | $t_{d(\text{clkX-d}[0:7]V)}$ | 延迟时间, CLK 转换到 D0:D7 有效 | 1.34 | 3.66 | ns |



HYPERBUS_TIMING_01

图 6-68. HyperBus 时序图 - 发送器模式



HYPERBUS_TIMING_02

图 6-69. HyperBus 时序图 - 接收器模式

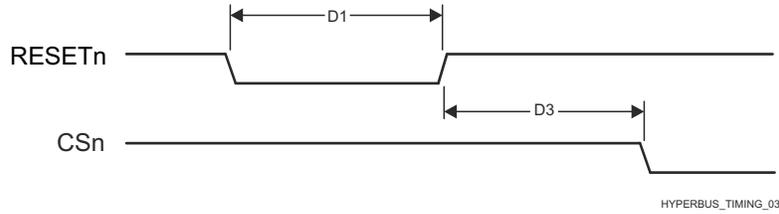


图 6-70. HyperBus 时序图 - 复位

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *HyperBus* 接口一节。

6.10.5.12 I2C

该器件包含若干多控制器内部集成电路 (I2C) 控制器。每个 I2C 控制器均设计为符合 Philips I2C-bus™ 规范版本 2.1。然而，器件 IO 缓冲器并不完全符合 I2C 电气规范。一些 I2C 实例使用 LVCMOS 缓冲器类型，而其他实例使用 I2S OD FS 缓冲器类型。请参阅“引脚属性”表，以确定用于此器件上每个 I2C 实例的 IO 缓冲器类型。下面按照 IO 缓冲器类型介绍了支持的 I2C 速度和例外情况：

- 使用 LVCMOS 缓冲器类型的 I2C 实例
 - 速度：
 - 标准模式 (最高 100kb/s)
 - 1.8V
 - 3.3V
 - 快速模式 (最高 400kb/s)
 - 1.8V
 - 3.3V
 - 例外情况：
 - 与这些端口关联的 IO 不符合 I2C 规范中定义的下陷时间要求，因为它们是通过性能更高的 LVCMOS 推挽 IO 实现的，这些 IO 旨在支持无法通过 I2C 兼容 IO 实现的其他信号功能。这些端口上使用的 LVCMOS IO 的连接方式可以对开漏输出进行仿真。该仿真是通过强制实现恒定低电平输出并禁用输出缓冲器进入高阻态来实现的。
 - I2C 规范定义了大小为 ($V_{DD_{max}} + 0.5V$) 的最大输入电压 V_{IH} ，这超出了器件 IO 的绝对最大额定值。系统的设计必须确保 I2C 信号始终不会超过本数据表的绝对最大额定值一节中定义的限值。
- 使用 I2C OD FS 缓冲器类型的 I2C 实例
 - 速度：
 - 标准模式 (最高 100kb/s)
 - 1.8V
 - 3.3V
 - 快速模式 (最高 400kb/s)
 - 1.8V
 - 3.3V
 - Hs 模式 (最高 3.4Mb/s)
 - 1.8V
 - 例外情况：
 - 与这些端口关联的 IO 并未设计为在 3.3V 下运行时支持 Hs 模式。因此，Hs 模式的运行电压限制为 1.8V。
 - 连接到这些端口的 I2C 信号的上升和下降时间不得超过 0.08V/ns (或 8E+7V/s) 的压摆率。该限制比 I2C 规范中定义的最小下降时间限制更严格。因此，可能需要向 I2C 信号添加额外的电容，以延长上升和下降时间，使其压摆率不超过 0.08V/ns。
 - I2C 规范定义了大小为 ($V_{DD_{max}} + 0.5V$) 的最大输入电压 V_{IH} ，这超出了器件 IO 的绝对最大额定值。系统的设计必须确保 I2C 信号始终不会超过本数据表的绝对最大额定值一节中定义的限值。

备注

I2C3、I2C4 和 I2C6 具有一个或多个信号，这些信号可以多路复用到多个引脚。本节中定义的时序要求和开关特性仅对名为 IOSET 的特定引脚组合有效。SysConfig-PinMux 工具中定义了该接口的有效引脚组合或 IOSET。

有关时序详细信息，请参阅 Philips I2C 总线规范版本 2.1。

如需进一步详细了解器件内部集成电路的特性和其他说明信息，请参阅节 5.3 和 详细说明 中的相应小节。

6.10.5.13 I3C

如需进一步详细了解器件内部集成电路的特性和其他说明信息，请参阅信号说明和 详细说明 中的相应小节。

表 6-44、表 6-45、图 6-71、表 6-46 和图 6-72 假设在建议运行条件和电气特性条件下进行测试。

表 6-44. I3C 开漏时序条件

| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----------------------|--------|-----|------|
| 输入条件 | | | |
| SR _I 输入压摆率 | 0.2276 | 5 | V/ns |
| 输出条件 | | | |
| C _L 输出负载电容 | | 50 | pF |

表 6-45. I3C 开漏时序参数

| 编号 | 参数 | 说明 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----|------------------------|------------------------|------------|--|---------|----|
| D1 | t _{LOW_OD} | SCL 时钟的低电平周期 | 控制器 | 200 | | ns |
| | t _{DIG_OD_L} | | | t _{LOW_OD} MIN + t _{FDA_OD} MIN | | ns |
| D2 | t _{HIGH} | SCL 时钟的高周期 | 控制器 | | 41 | ns |
| | t _{DIG_H} | | | t _{HIGH} + t _{CF} | | ns |
| D3 | t _{FDA_OD} | SDA 信号的下降时间 | 控制器、目标 | t _{CF} | 12 | ns |
| D4 | t _{SU_OD} | 开漏模式期间的 SDA 数据建立时间 | 控制器、目标 | 3 | | ns |
| D5 | t _{CAS} | 启动 (S) 条件后的时钟 | 控制器、ENTAS0 | 38.4 | 1000 | ns |
| | | | 控制器、ENTAS1 | 38.4 | 100000 | ns |
| | | | 控制器、ENTAS2 | 38.4 | 2000000 | ns |
| | | | 控制器、ENTAS3 | 38.4 | 5000000 | ns |
| D6 | t _{CBP} | 停止 (P) 条件前的时钟 | 控制器 | t _{CAS} MIN / 2 | | ns |
| D7 | t _{MMOVERLAP} | 切换期间当前控制器到辅助控制器的重叠时间 | 控制器 | t _{DIG_OD_L} min | | ns |
| D8 | t _{AVAL} | 总线可用条件 | 控制器 | 1000 | | ns |
| D9 | t _{IDLE} | 总线空闲条件 | 控制器 | 1000000 | | ns |
| D10 | t _{MMLOCK} | 新控制器不将 SDA 驱动为低电平的时间间隔 | 控制器 | t _{AVAL} min | | ns |

1. 这大约等于 t_{LOWmin} + t_{DS_ODmin} + t_{rDA_ODtyp} + t_{SU_Odmin}。
2. 当 SDA 已经高于 V_{IH} 时，控制器可以使用较短的低电平周期（如果控制器知道这是安全的）。
3. 基于 t_{SPIKE}，上升和下降时间以及互连。
4. 当旧 I2C 器件可以安全地看到信号和/或考虑了互连（例如：短总线）时，可能会超过该最大高电平周期。
5. 在 I2C 器件需要看到“启动”的旧总线上，t_{CAS} 最小值进一步受到限制。
6. 不支持可选 ENTASx CCCs 的目标应使用为 ENTAS3 显示的 t_{CAS} 最大值。
7. 在具有 Fm 旧 I2C 器件的混合总线上，t_{AVAL} 比 Fm 总线空闲条件时间 (t_{BUF}) 短 300ns。

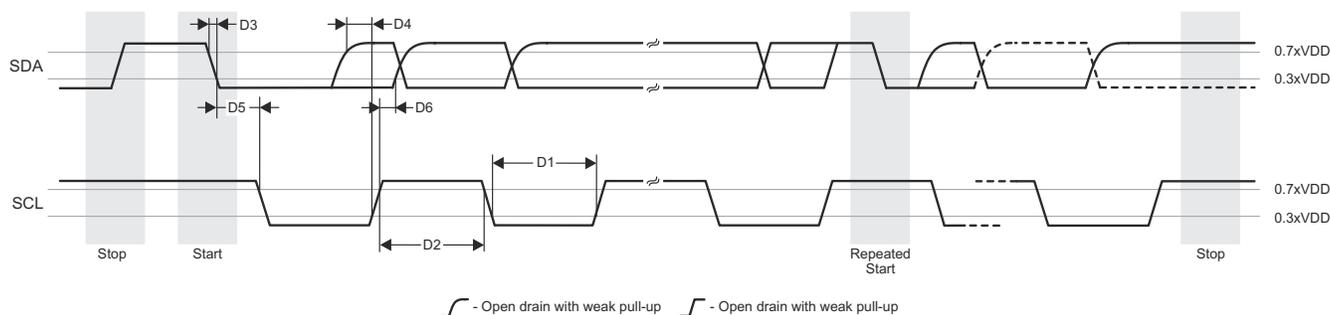


图 6-71. I3C 开漏时序

表 6-46. SDR 和 HDR-DDR 模式的 I3C 推挽时序参数

| 编号 | 参数 | 说明 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----|---------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------|--------|----|
| D1 | f_{SCL} | SCL 时钟周期 | 控制器 | 80 | 100000 | ns |
| D2 | t_{LOW} | SCL 时钟低电平周期 | 控制器 | 24 | | ns |
| | t_{DIG_L} | | | 32 | | ns |
| D3 | t_{HIGH_MIXED} | 混合总线的 SCL 时钟高电平周期 (不支持混合总线拓扑) | 控制器 | 24 | | ns |
| | $t_{DIG_H_MIXED}$ | | | 32 | 45 | ns |
| D4 | t_{HIGH} | SCL 时钟高周期 | 控制器 | 24 | | ns |
| | t_{DIG_H} | | | 32 | | ns |
| D5 | t_{SCO} | 目标的时钟输入至数据输出时间 | 目标 | 12 | | ns |
| D6 | t_{CR} | SCL 时钟上升时间 | 控制器 | $150 \times 1 / f_{SCL}$ | 60 | ns |
| D7 | t_{CF} | SCL 时钟下降时间 | 控制器 | $150 \times 1 / f_{SCL}$ | 60 | ns |
| D8 | t_{HD_PP} | 推挽模式下的 SDA 信号数据保持时间 | 控制器 | $t_{CR} + 3$ 和 $t_{CF} + 3$ | | ns |
| | | | 目标 | 0 | | ns |
| D9 | t_{SU_PP} | 推挽模式下的 SDA 信号数据建立时间 | 控制器、目标 | 3 | | ns |
| D10 | t_{CASr} | 重复启动 (Sr) 后的时钟 | 控制器 | $t_{CAS\ MIN}$ | | ns |
| D11 | t_{CBSr} | 重复启动 (Sr) 前的时钟 | 控制器 | $t_{CAS\ MIN} / 2$ | | ns |

- $f_{SCL} = 1 / (t_{DIG_L} + t_{DIG_H})$
- t_{DIG_L} 和 t_{DIG_H} 是在使用 V_{IL} 和 V_{IH} 的 I3C 总线接收器端看到的时钟低电平和高电平周期。
- 当与混合总线上的 I3C 器件通信时，必须限制 $t_{DIG_H_MIXED}$ 周期以确保 I2C 器件不会将 I3C 信令解释为有效的 I2C 信令。
- 由于两个边沿均被使用，因此需要针对相应的边沿满足保持时间： $t_{CF} + 3$ 表示下降沿时钟， $t_{CR} + 3$ 表示上升沿时钟。
- 时钟频率最小 0.01MHz，最大 12.5MHz

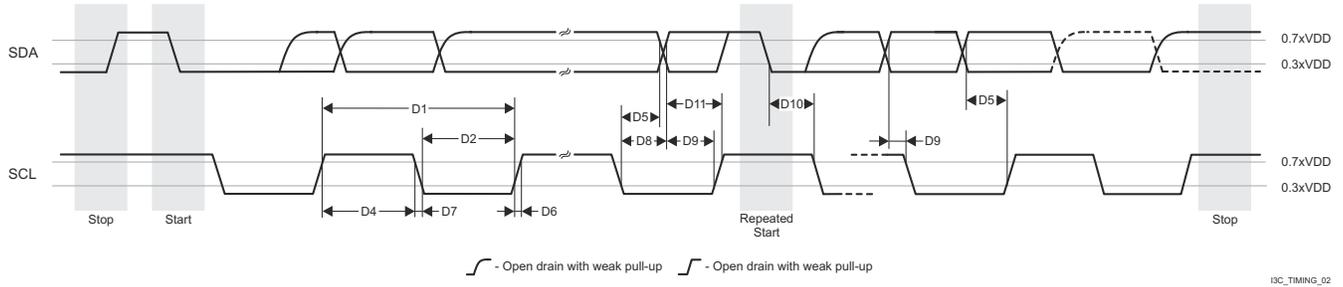


图 6-72. I3C 推挽时序 (SDR 和 HDR-DDR 模式)

6.10.5.14 MCAN

如需进一步详细了解器件控制器局域网接口的特性和其他说明信息，请参阅[信号说明](#)和[详细说明](#)中的相应小节。

备注

器件具有多个 MCAN 模块。MCANn 是应用于 MCAN 信号名称的通用前缀，其中 n 代表特定的 MCAN 模块。

表 6-47. MCAN 时序条件

| 参数 | | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----------------|--------|-----|-----|------|
| 输入条件 | | | | |
| SR _i | 输入压摆率 | 2 | 15 | V/ns |
| 输出条件 | | | | |
| C _L | 输出负载电容 | 5 | 20 | pF |

表 6-48. MCAN 开关特性

| 编号 | 参数 | | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------|--------------------------|--|-----|-----|----|
| MCAN1 | t _d (MCAN_TX) | 延迟时间，发送移位寄存器到 MCANn_TX 引脚 ⁽¹⁾ | | 10 | ns |
| MCAN2 | t _d (MCAN_RX) | 延迟时间，MCANn_RX 引脚到接收移位寄存器 ⁽¹⁾ | | 10 | ns |

(1) n 在 MCANn_* 中为 [0:13]，在 MCU_MCANn_* 中为 [0:1]

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的[控制器局域网 \(MCAN\)](#)一节。

6.10.5.15 MCASP

如需进一步详细了解器件多通道音频串行端口的特性和其他说明信息，请参阅[信号说明](#)和[详细说明](#)中的相应小节。

表 6-50 和图 6-73 说明了 MCASP0 至 MCASP11 的时序要求。

表 6-49 表示 MCASP 时序条件。

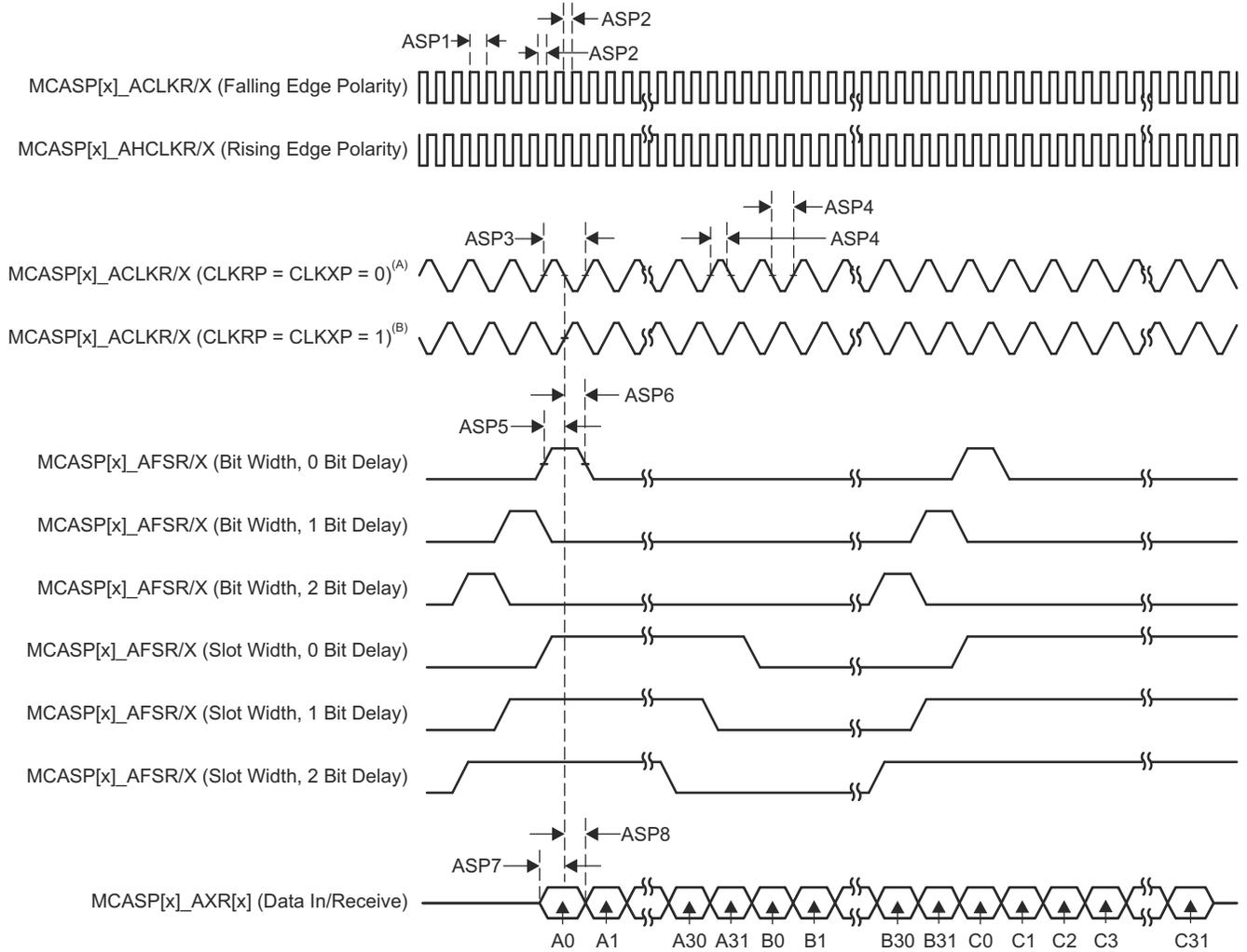
表 6-49. MCASP 时序条件

| 参数 | | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---------------------------------------|----------------|-----|------|------|
| 输入条件 | | | | |
| SR _I | 输入压摆率 | 0.7 | 5 | V/ns |
| 输出条件 | | | | |
| C _L | 输出负载电容 | 1 | 10 | pF |
| PCB 连接要求 | | | | |
| t _d (Trace Delay) | 每条引线的传播延迟 | 100 | 1100 | ps |
| t _d (Trace Mismatch Delay) | 所有布线之间的传播延迟不匹配 | | 100 | ps |

表 6-50. MCASP 时序要求

| 编号 | | | 模式 ⁽¹⁾ | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|-----|----|
| ASP1 | t _c (AHCLKRX) | 周期时间, MCASP[x]_AHCLKR/X | | 15.26 | | ns |
| ASP2 | t _w (AHCLKRX) | 脉冲持续时间, MCASP[x]_AHCLKR/X 高电平或低电平 | | 0.5P ⁽²⁾ - 1.53 | | ns |
| ASP3 | t _c (ACLKRX) | 周期时间, MCASP[x]_ACLKR/X | | 15.26 | | ns |
| ASP4 | t _w (ACLKRX) | 脉冲持续时间, MCASP[x]_ACLKR/X 高电平或低电平 | | 0.5R ⁽³⁾ - 1.53 | | ns |
| ASP5 | t _{su} (AFSRX-ACLKRX) | 建立时间, 在 MCASP[x]_ACLKR/X 之前 MCASP[x]_AFSR/X 输入有效 | ACLKR/X 内部 | 12.3 | | ns |
| | | | ACLKR/X 外部输入/输出 | 4 | | |
| ASP6 | t _h (ACLKRX-AFSRX) | 保持时间, 在 MCASP[x]_ACLKR/X 之后 MCASP[x]_AFSR/X 输入有效 | ACLKR/X 内部 | -1 | | ns |
| | | | ACLKR/X 外部输入/输出 | 1.6 | | |
| ASP7 | t _{su} (AXR-ACLKRX) | 建立时间, 在 MCASP[x]_ACLKR/X 之前 MCASP[x]_AXR 输入有效 | ACLKR/X 内部 | 12.3 | | ns |
| | | | ACLKR/X 外部输入/输出 | 4 | | |
| ASP8 | t _h (ACLKRX-AXR) | 保持时间, 在 MCASP[x]_ACLKR/X 之后 MCASP[x]_AXR 输入有效 | ACLKR/X 内部 | -1 | | ns |
| | | | ACLKR/X 外部输入/输出 | 1.6 | | |

- (1) ACLKR 内部: ACLKRCTL.CLKRM=1, PDIR.ACLKR = 1
 ACLKR 外部输入: ACLKRCTL.CLKRM=0, PDIR.ACLKR=0
 ACLKR 外部输出: ACLKRCTL.CLKRM=0, PDIR.ACLKR=1
 ACLKX 外部: ACLKXCTL.CLKXM=1, PDIR.ACLKX = 1
 ACLKX 外部输入: ACLKXCTL.CLKXM=0, PDIR.ACLKX=0
 ACLKX 外部输出: ACLKXCTL.CLKXM=0, PDIR.ACLKX=1
- (2) P = AHCLKR/X 周期 (以 ns 为单位)。
- (3) R = ACLKR/X 周期 (以 ns 为单位)。



- A. 当 $CLKRP = CLKXP = 0$ 时，MCASP 发送器配置为上升沿（移出数据），MCASP 接收器配置为下降沿（移入数据）。
- B. 当 $CLKRP = CLKXP = 1$ 时，MCASP 发送器配置为下降沿（移出数据），MCASP 接收器配置为上升沿（移入数据）。

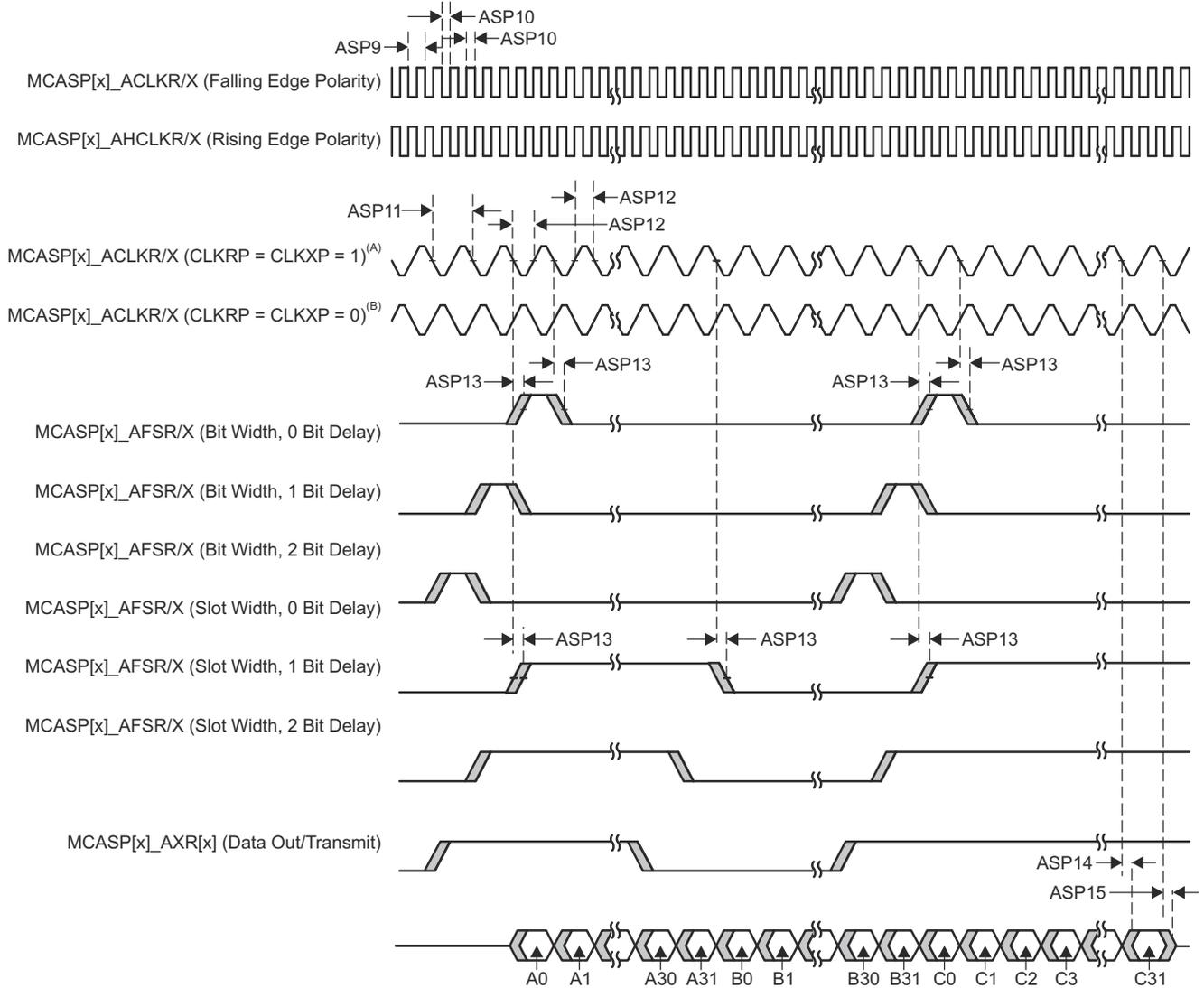
图 6-73. MCASP 输入时序

表 6-51 和图 6-74 说明了 MCASP0 至 MCASP11 在建议运行条件下的开关特性。

表 6-51. MCASP 开关特性

| 编号 | 参数 | 说明 | 模式 ⁽¹⁾ | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------|-----------------------|---|-------------------|------------------|-------|----|
| ASP9 | $t_{c(AHCLKRX)}$ | 周期时间, MCASP[x]_AHCLKR/X | | 20 | | ns |
| ASP10 | $t_{w(AHCLKRX)}$ | 脉冲持续时间, MCASP[x]_AHCLKR/X 高电平或低电平 | | $0.5P^{(2)} - 2$ | | ns |
| ASP11 | $t_{c(ACLKRX)}$ | 周期时间, MCASP[x]_ACLKR/X | | 20 | | ns |
| ASP12 | $t_{w(ACLKRX)}$ | 脉冲持续时间, MCASP[x]_ACLKR/X 高电平或低电平 | | $0.5R^{(3)} - 2$ | | ns |
| ASP13 | $t_{d(ACLKRX-AFSRX)}$ | 延迟时间, MCASP[x]_ACLKR/X 发送边沿到 MCASP[x]_AFSR/X 输出有效 | ACLKR/X 内部 | 0 | 7.25 | ns |
| | | | ACLKR/X 外部输入/输出 | -15.28 | 12.84 | |
| ASP14 | $t_{d(ACLKX-AXR)}$ | 延迟时间, MCASP[x]_ACLKX 发送边沿到 MCASP[x]_AXR 输出有效 | ACLKR/X 内部 | 0 | 7.25 | ns |
| | | | ACLKR/X 外部输入/输出 | -15.28 | 12.84 | |
| ASP15 | $t_{dis(ACLKX-AXR)}$ | 禁用时间, MCASP[x]_ACLKX 发送边沿到 MCASP[x]_AXR 输出高阻抗 | ACLKR/X 内部 | 0 | 7.25 | ns |
| | | | ACLKR/X 外部输入/输出 | -14.9 | 14 | |

- (1) ACLKR 内部: ACLKRCTL.CLKRM=1, PDIR.ACLKR = 1
 ACLKR 外部输入: ACLKRCTL.CLKRM=0, PDIR.ACLKR=0
 ACLKR 外部输出: ACLKRCTL.CLKRM=0, PDIR.ACLKR=1
 ACLKX 外部: ACLKXCTL.CLKXM=1, PDIR.ACLKX = 1
 ACLKX 外部输入: ACLKXCTL.CLKXM=0, PDIR.ACLKX=0
 ACLKX 外部输出: ACLKXCTL.CLKXM=0, PDIR.ACLKX=1
- (2) P = AHCLKR/X 周期 (以 ns 为单位)。
- (3) R = ACLKR/X 周期 (以 ns 为单位)。



- A. 当 $CLKRP = CLKXP = 1$ 时，MCASP 发送器配置为下降沿（移出数据），MCASP 接收器配置为上升沿（移入数据）。
- B. 当 $CLKRP = CLKXP = 0$ 时，MCASP 发送器配置为上升沿（移出数据），MCASP 接收器配置为下降沿（移入数据）。

图 6-74. MCASP 输出时序

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的多通道音频串行端口 (MCASP) 一节。

6.10.5.16 MCSPI

如需进一步详细了解器件串行端口接口的特性和其他说明信息，请参阅[信号说明](#)和[详细说明](#)中的相应小节。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的[外设](#)一章中的[多通道串行外设接口 \(MCSPI\)](#)一节。

表 6-52 表示 MCSPI 时序条件。

备注

本节中提供的 IO 时序适用于 MCU_SPI0 和 MCU_SPI1 的所有信号组合。然而，只有当使用单个 IOSET 内的信号时，时序才对 MCU_SPI0 和 MCU_SPI1 有效。表 6-57 和表 6-58 表对 IOSET 进行了定义。

表 6-52. MCSPI 时序条件

| 参数 | | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|-----------------|--------|----------|-----|------|----|
| 输入条件 | | | | | |
| SR _I | 输入压摆率 | 2 | 8.5 | V/ns | |
| 输出条件 | | | | | |
| C _L | 输出负载电容 | CLK | 6 | 24 | pF |
| | | D[x]、CSi | 6 | 12 | pF |

6.10.5.16.1 MCSPI - 控制器模式

表 6-53、图 6-75、表 6-54 和图 6-76 说明了 MCSPI 的时序要求和开关特性 - 控制器模式。

表 6-53. MCSPI 时序要求 — 控制器模式

请参阅图 6-75

| 编号 | 参数 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|----|
| SM4 | t _{su(misoV-spickV)} | 建立时间，在 SPI_CLK 有效边沿之前 SPI_D[x] 有效 | 2.9 | | ns |
| SM5 | t _{h(spickV-misoV)} | 保持时间，在 SPI_CLK 有效边沿之后 SPI_D[x] 有效 | 2 | | ns |

表 6-54. MCSPI 开关特性 - 控制器模式

请参阅图 6-76

| 编号 | 参数 | 描述 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----|------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-----|----|
| SM1 | t _{c(spick)} | 周期时间，SPI_CLK | | 20 | | ns |
| SM2 | t _{w(spickL)} | 脉冲持续时间，SPI_CLK 低电平 | | 0.5P - 1 ⁽¹⁾ | | ns |
| SM3 | t _{w(spickH)} | 脉冲持续时间，SPI_CLK 高电平 | | 0.5P - 1 ⁽¹⁾ | | ns |
| SM6 | t _{d(spickV-simoV)} | 延迟时间，SPI_CLK 有效边沿到 SPI_D[x] 转换 | | -2 | 2 | ns |
| SM7 | t _{d(csV-simoV)} | 延迟时间，SPI_CSi 有效边沿到 SPI_D[x] 转换 | | 5 | | ns |
| SM8 | t _{d(csV-spick)} | 延迟时间，SPI_CSi 有效到 SPI_CLK 第一个边沿 | PHA = 0 ⁽²⁾ | B - 4 ⁽³⁾ | | ns |
| | | | PHA = 1 ⁽²⁾ | A - 4 ⁽⁴⁾ | | ns |
| SM9 | t _{d(spickV-csV)} | 延迟时间，SPI_CLK 最后一个边沿到 SPI_CSi 无效 | PHA = 0 ⁽²⁾ | A - 4 ⁽⁴⁾ | | ns |
| | | | PHA = 1 ⁽²⁾ | B - 4 ⁽³⁾ | | ns |

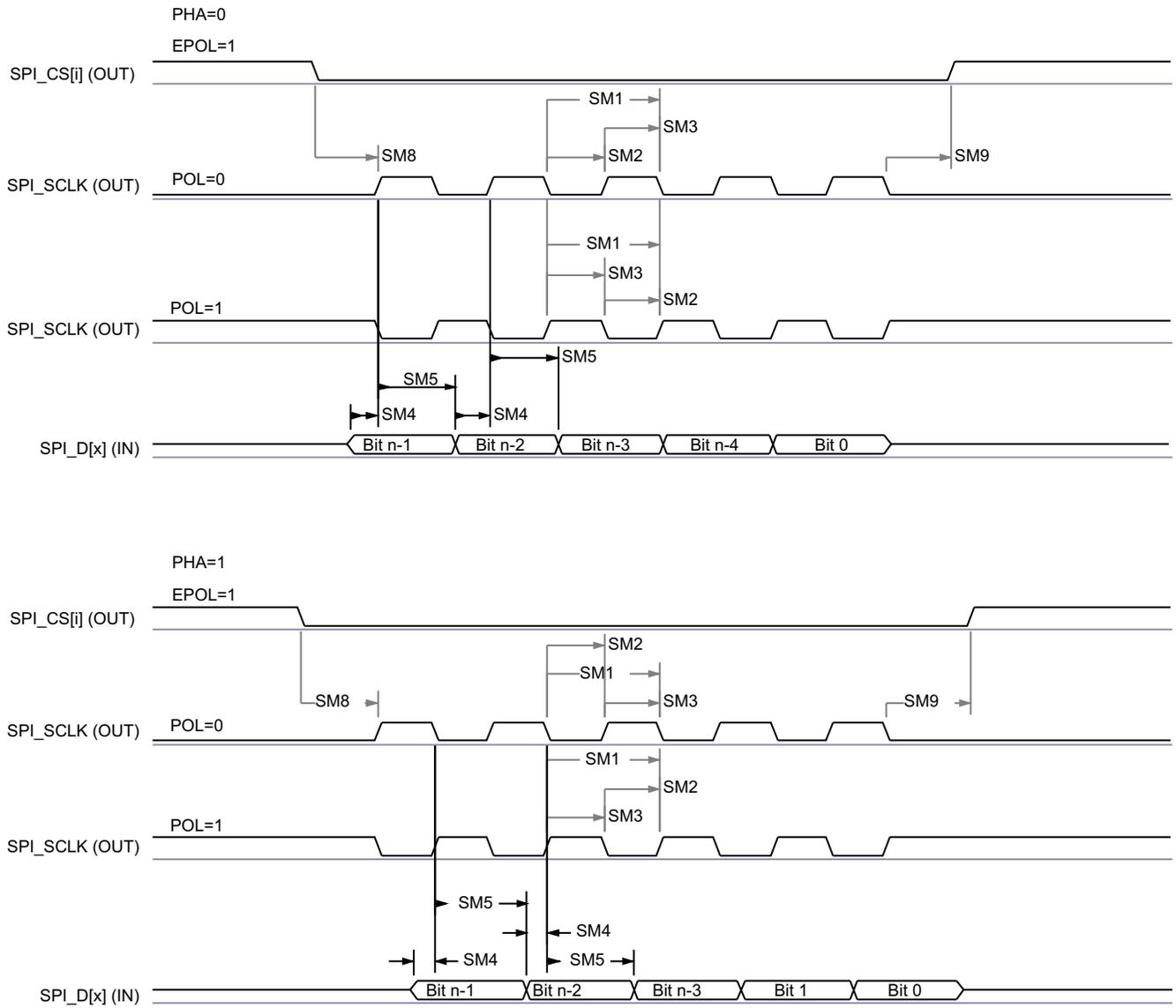
(1) P = SPI_CLK 周期 (以 ns 为单位)

(2) SPI_CLK 相位可通过 MCSPI_CHCONF_0/1/2/3 寄存器的 PHA 位进行编程

(3) B = (TCS + 0.5) * TSPICKREF，其中 TCS 是 MCSPI_CHCONF_0/1/2/3 寄存器的位字段且 Fratio = 偶数 >= 2。

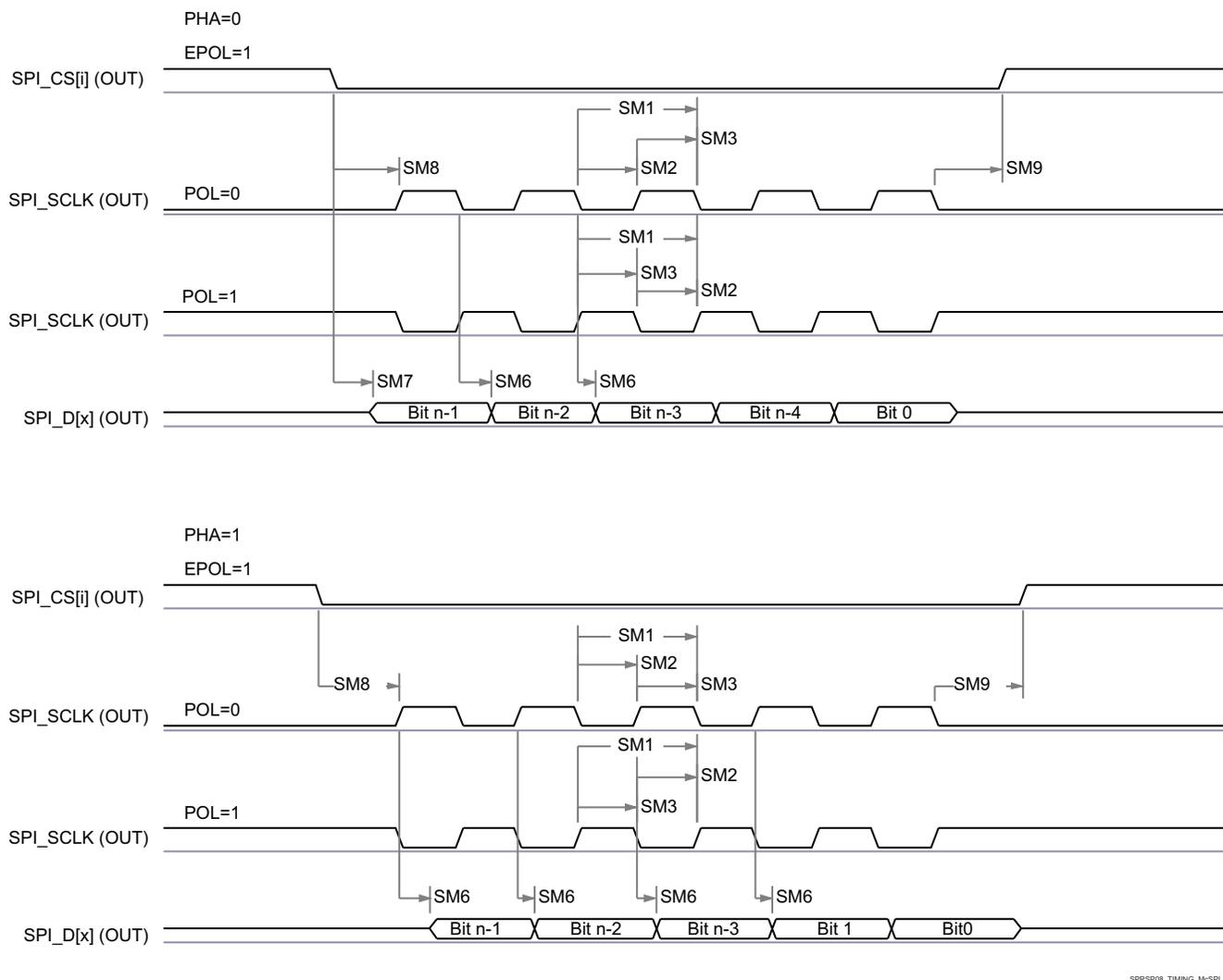
(4) 当 P = 20.8ns 时，A = (TCS + 1) * TSPICKREF，其中 TCS 是 MCSPI_CHCONF_0/1/2/3 寄存器的位字段。

当 P > 20.8ns 时，A = (TCS + 0.5) * Fratio * TSPICKREF，其中 TCS 是 MCSPI_CHCONF_0/1/2/3 寄存器的位字段。



SPRSP08_TIMING_McSPI_02

图 6-75. SPI 控制器模式接收时序



SPRSP08_TIMING_McSPI_01

图 6-76. MCSPI 控制器模式发送时序

6.10.5.16.2 MCSPI - 外设模式

表 6-55、表 6-56、图 6-77 和图 6-78 说明了 MCSPI 的时序要求和开关特性 - 外设模式。

表 6-55. MCSPI 时序要求 - 外设模式

| 编号 | 参数 | 说明 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----|------------------------|-------------------------------------|----|----------------------|-----|----|
| SS1 | $t_{c(spclk)}$ | 周期时间, SPI_CLK | | 20 | | ns |
| SS2 | $t_{w(spclkL)}$ | 脉冲持续时间, SPI_CLK 低电平 | | 0.45P ⁽¹⁾ | | ns |
| SS3 | $t_{w(spclkH)}$ | 脉冲持续时间, SPI_CLK 高电平 | | 0.45P ⁽¹⁾ | | ns |
| SS4 | $t_{su(simoV-spickV)}$ | 建立时间, 在 SPI_CLK 有效边沿之前 SPI_D[x] 有效 | | 5 | | ns |
| SS5 | $t_{h(spickV-simoV)}$ | 保持时间, 在 SPI_CLK 有效边沿之后 SPI_D[x] 有效 | | 5 | | ns |
| SS8 | $t_{su(csV-spickV)}$ | 建立时间, 在 SPI_CLK 第一个边沿之前 SPI_CSi 有效 | | 5 | | ns |
| SS9 | $t_{h(spickV-csV)}$ | 保持时间, 在 SPI_CLK 最后一个边沿之后 SPI_CSi 有效 | | 5 | | ns |

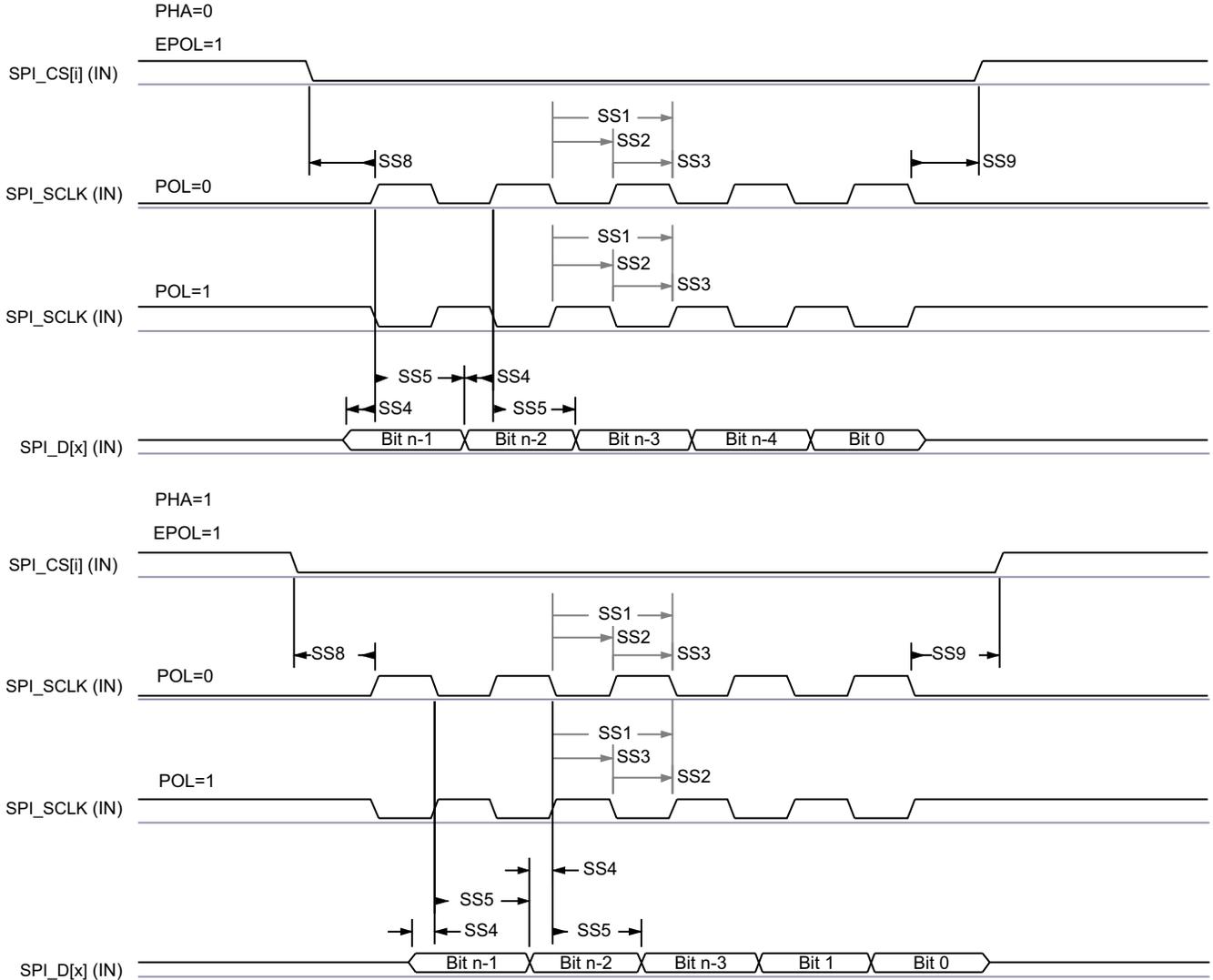
表 6-56. MCSPI 开关特性 - 外设模式

| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----|-----------------------|---------------------------------|-----|-------|----|
| SS6 | $t_{d(spickV-somiV)}$ | 延迟时间, SPI_CLK 有效边沿到 SPI_D[x] 转换 | 2 | 17.12 | ns |

表 6-56. MCSPI 开关特性 - 外设模式 (续)

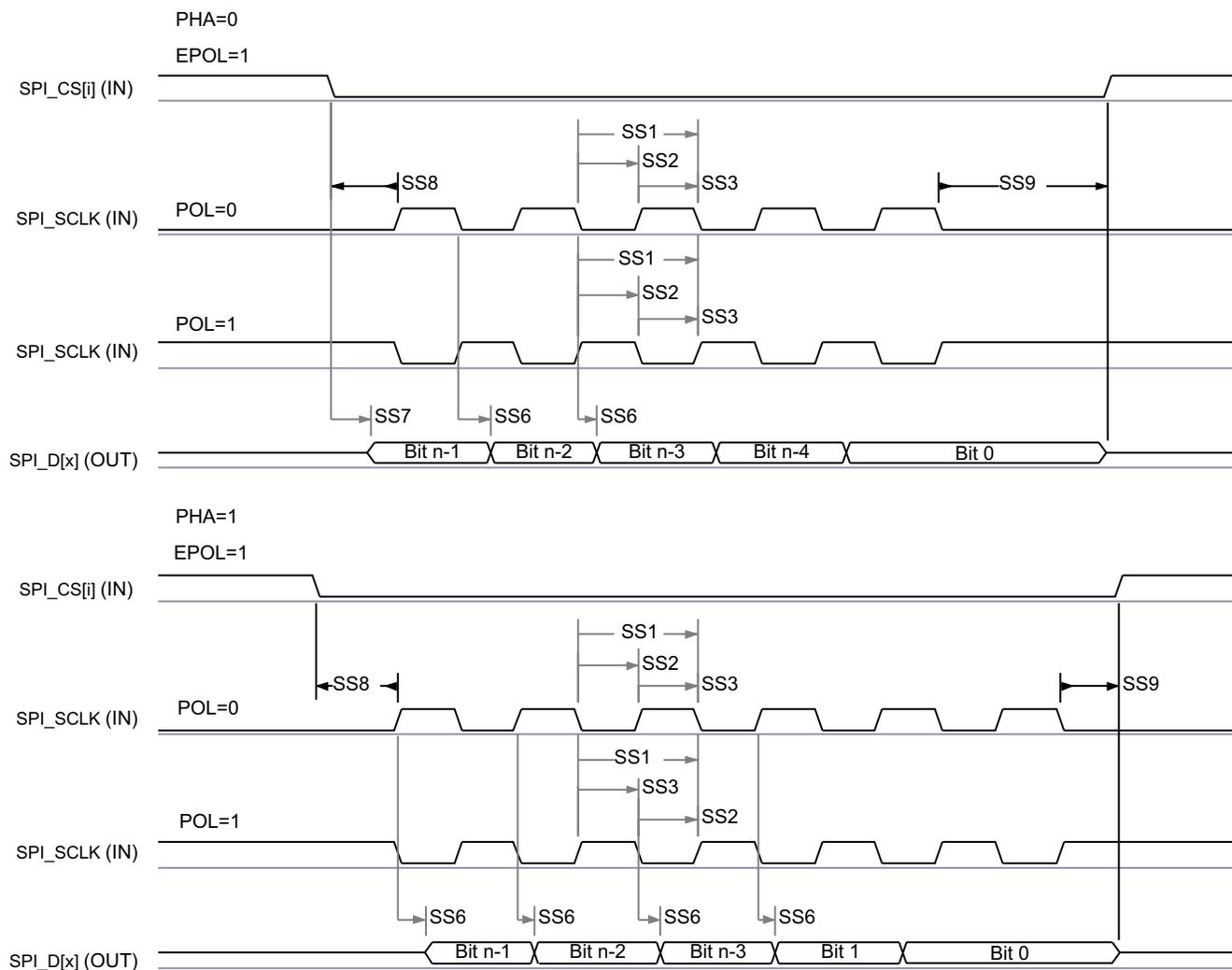
| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----|---------------------|---------------------------------|-------|-----|----|
| SS7 | $t_{sk(csV-somIV)}$ | 延迟时间, SPI_CSi 有效边沿到 SPI_D[x] 转换 | 20.95 | | ns |

(1) P = SPI_CLK 周期 (以 ns 为单位)。



SPRSP08_TIMING_McSPI_04

图 6-77. SPI 外设模式接收时序



SPRSP08_TIMING_McSPI_03

图 6-78. MCSPI 外设模式发送时序

表 6-57 和 表 6-58 说明了与 MCU_SPI0 和 MCU_SPI1 搭配使用的具体信号分组 (IOSET)。

表 6-57. MCU_SPI0 IOSET

| 信号 | IOSET1 | | IOSET2 | |
|--------------|----------------|-------|---------------|-------|
| | 焊球名称 | 多路复用器 | 焊球名称 | 多路复用器 |
| MCU_SPI0_CLK | MCU_SPI0_CLK | 0 | MCU_SPI0_CLK | 0 |
| MCU_SPI0_D0 | MCU_SPI0_D0 | 0 | MCU_SPI0_D0 | 0 |
| MCU_SPI0_D1 | MCU_SPI0_D1 | 0 | MCU_SPI0_D1 | 0 |
| MCU_SPI0_CS0 | MCU_SPI0_CS0 | 0 | MCU_SPI0_CS0 | 0 |
| MCU_SPI0_CS1 | MCU_OSPI1_D3 | 5 | WKUP_GPIO0_12 | 1 |
| MCU_SPI0_CS2 | MCU_OSPI1_CSn1 | 5 | WKUP_GPIO0_14 | 1 |

表 6-58. MCU_SPI1 IOSET

| 信号 | IOSET1 | | IOSET2 | |
|--------------|--------------|-------|---------------|-------|
| | 焊球名称 | 多路复用器 | 焊球名称 | 多路复用器 |
| MCU_SPI1_CLK | MCU_SPI1_CLK | 0 | MCU_SPI1_CLK | 0 |
| MCU_SPI1_D0 | MCU_SPI1_D0 | 0 | MCU_SPI1_D0 | 0 |
| MCU_SPI1_D1 | MCU_SPI1_D1 | 0 | MCU_SPI1_D1 | 0 |
| MCU_SPI1_CS0 | MCU_SPI1_CS0 | 0 | MCU_SPI1_CS0 | 0 |
| MCU_SPI1_CS1 | MCU_OSPI1_D1 | 5 | WKUP_GPIO0_13 | 1 |
| MCU_SPI1_CS2 | MCU_OSPI1_D2 | 5 | WKUP_GPIO0_15 | 1 |

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的多通道串行外设接口 (MCSPI) 一节。

6.10.5.17 MMCSDB

MMCSDB 主机控制器提供用于连接嵌入式多媒体卡 (MMC)、安全数字 (SD) 和安全数字 IO (SDIO) 器件的接口。MMCSDB 主机控制器在传输级别处理 MMC/SD/SDIO 协议、数据打包、添加循环冗余校验 (CRC)、开始/结束位插入以及语法正确性检查。

有关 MMCSDB 接口的更多详细信息，请参阅

信号说明和详细说明中相应的 MMC0、MMC1 和 MMC2 小节。

备注

某些工作模式需要对 MMC DLL 延迟设置进行软件配置，如表 6-59 和表 6-71 所示。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的多媒体卡/安全数字 (MMCSDB) 接口一节。

6.10.5.17.1 MMC0 - eMMC 接口

MMC0 接口符合 JEDEC eMMC 电气标准 v5.1 (JESD84-B51)，支持以下 eMMC 应用：

- 传统速度
- 高速 SDR
- 高速 DDR
- 高速 HS200
- 高速 HS400

表 6-59 展示了 MMC0 时序模式所需的 DLL 软件配置设置。

表 6-59. 所有时序模式的 MMC0 DLL 延迟映射

| 寄存器名称 | | MMCSD0_MMC_SSCFG_PHY_CTRL_x_REG | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|---------------------------------|----------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | x = 1 | x = 4 | | | | x = 5 | | | |
| 位字段 | | [1] | [31:24] | [20] | [15:12] | [8] | [4:0] | [17:16] | [10:8] | [2:0] |
| 位字段名称 | | ENDLL | STRBSEL | OTAPDLYENA | OTAPDLYSEL | ITAPDLYENA | ITAPDLYSEL | SELDLYTXCLK SELDLYRXCLK | FRQSEL | CLKBUFSEL |
| 模式 | 说明 | 启用 DLL | 选通 延迟 | 输出 延迟 启用 | 输出 延迟 值 | 输入 延迟 启用 | 输入 延迟 值 | DLL/ 延迟链 选择 | DLL 基准 频率 | 延迟 缓冲器 持续时间 |
| 旧 SDR | 8 位 PHY 工作 1.8V, 25MHz | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 不适用 ⁽¹⁾ | 0x1 | 0x10 | 0x1 或 0x3 ⁽²⁾ | 不适用 ⁽³⁾ | 0x7 |
| 高速 SDR | 8 位 PHY 工作 1.8V, 50MHz | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 不适用 ⁽¹⁾ | 0x1 | 0xA | 0x1 或 0x3 ⁽²⁾ | 不适用 ⁽³⁾ | 0x7 |
| 高速 DDR | 8 位 PHY 工作 1.8V, 50MHz | 0x1 | 0x0 | 0x1 | 0x6 | 0x1 | 调优 ⁽⁵⁾ | 0x0 | 0x4 | 不适用 ⁽⁴⁾ |
| HS200 | 8 位 PHY 工作 1.8V, 200MHz | 0x1 | 0x0 | 0x1 | 0x8 | 0x1 | 调优 ⁽⁵⁾ | 0x0 | 0x0 | 不适用 ⁽⁴⁾ |
| HS400 | 8 位 PHY 工作 1.8V, 200MHz | 0x1 | 0x66 | 0x1 | 0x5 | 0x1 | 调优 ⁽⁵⁾ | 0x0 | 0x0 | 不适用 ⁽⁴⁾ |

- (1) 不适用意味着当以半周期时序运行（此模式强制要求）时，该寄存器字段无功能。
(2) 当以半周期时序运行（此模式强制要求）时，SELDLYTXCLK 位不起作用。
(3) 不适用意味着当 ENDLL 设为 0x0 时，该寄存器字段不起作用。
(4) 不适用意味着当 ENDLL 设为 0x1 时，该寄存器字段不起作用。
(5) 调优意味着此模式需要使用调优算法来确定适当输入时序

表 6-60 展示了 MMC0 的时序条件。

表 6-60. MMC0 时序条件

| 参数 | | | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|------|------|------|
| 输入条件 | | | | | |
| SR _i | 输入压摆率 | 旧 SDR | 0.14 | 1.44 | V/ns |
| | | 高速 SDR | 0.3 | 0.90 | V/ns |
| | | 高速 DDR (CMD) | 0.3 | 0.90 | V/ns |
| | | 高速 DDR (DAT[7:0]) | 0.45 | 0.90 | V/ns |
| 输出条件 | | | | | |
| C _L | 输出负载电容 | HS200、HS400 | 1 | 6 | pF |
| | | 所有其他模式 | 1 | 12 | pF |
| PCB 连接要求 | | | | | |
| t _d (Trace Delay) | 每条引线的传播延迟 | 所有模式 | 134 | 756 | ps |
| t _d (Trace Mismatch Delay) | 所有布线之间的传播延迟不匹配 | 旧 SDR、高速 SDR、高速 DDR | | 100 | ps |
| | | HS200、HS400 | | 8 | ps |

6.10.5.17.1.1 旧 SDR 模式

表 6-61、图 6-79、表 6-62 和图 6-80 展示了 MMC0 的时序要求和开关特性 - 旧 SDR 模式。

表 6-61. MMC0 时序要求 - 旧 SDR 模式

请参阅图 6-79

| 编号 | | | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------|---------------------|---|-----|-----|----|
| LSDR1 | $t_{su}(cmdV-clkH)$ | 建立时间, 在 MMC0_CLK 上升沿之前 MMC0_CMD 有效 | 2.5 | | ns |
| LSDR2 | $t_h(clkH-cmdV)$ | 保持时间, 在 MMC0_CLK 上升沿之后 MMC0_CMD 有效 | 6.5 | | ns |
| LSDR3 | $t_{su}(dV-clkH)$ | 建立时间, 在 MMC0_CLK 上升沿之前 MMC0_DAT[7:0] 有效 | 2.5 | | ns |
| LSDR4 | $t_h(clkH-dV)$ | 保持时间, 在 MMC0_CLK 上升沿之后 MMC0_DAT[7:0] 有效 | 6.5 | | ns |

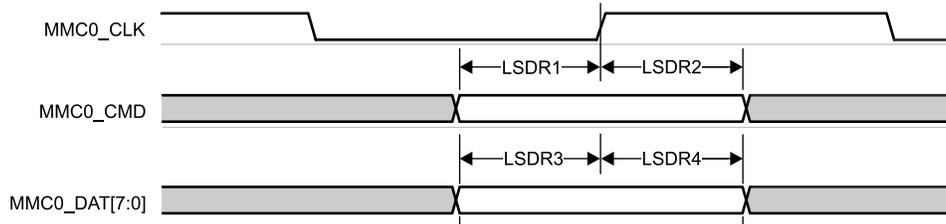


图 6-79. MMC0 - 旧 SDR - 接收模式

表 6-62. MMC0 开关特性 - 旧 SDR 模式

请参阅图 6-80

| 编号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------|------------------|------|------|-----|
| | $f_{op}(clk)$ | | 25 | MHz |
| LSDR5 | $t_c(clk)$ | | 40 | ns |
| LSDR6 | $t_w(clkH)$ | | 18.7 | ns |
| LSDR7 | $t_w(clkL)$ | | 18.7 | ns |
| LSDR8 | $t_d(clkL-cmdV)$ | -3.2 | 3.8 | ns |
| LSDR9 | $t_d(clkL-dV)$ | -3.2 | 3.8 | ns |

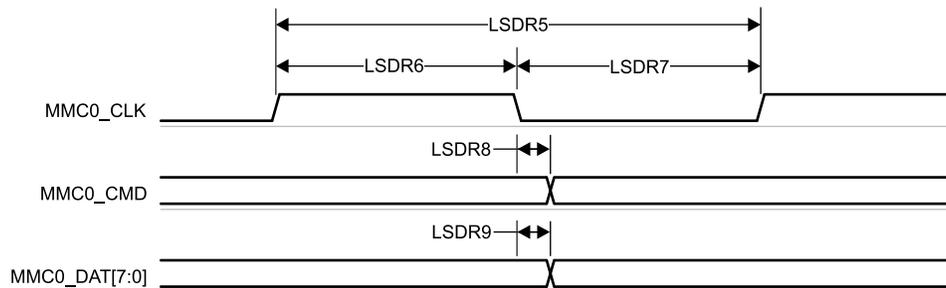


图 6-80. MMC0 - 旧 SDR - 发送模式

6.10.5.17.1.2 高速 SDR 模式

表 6-63、图 6-81、表 6-64 和图 6-82 展示了 MMC0 的时序要求和开关特性 - 高速 SDR 模式。

表 6-63. MMC0 时序要求 - 高速 SDR 模式

请参阅图 6-81

| 编号 | | | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|--------|---------------------|---|------|-----|----|
| HSSDR1 | $t_{su(cmdV-clkH)}$ | 建立时间, 在 MMC0_CLK 上升沿之前 MMC0_CMD 有效 | 2.99 | | ns |
| HSSDR2 | $t_{h(clkH-cmdV)}$ | 保持时间, 在 MMC0_CLK 上升沿之后 MMC0_CMD 有效 | 2.67 | | ns |
| HSSDR3 | $t_{su(dV-clkH)}$ | 建立时间, 在 MMC0_CLK 上升沿之前 MMC0_DAT[7:0] 有效 | 2.99 | | ns |
| HSSDR4 | $t_{h(clkH-dV)}$ | 保持时间, 在 MMC0_CLK 上升沿之后 MMC0_DAT[7:0] 有效 | 2.67 | | ns |

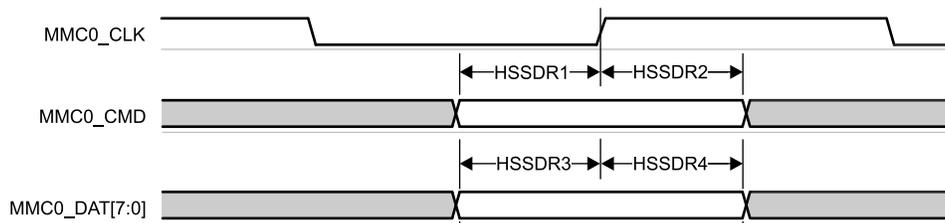


图 6-81. MMC0 - 高速 SDR 模式 - 接收模式

表 6-64. MMC0 开关特性 - 高速 SDR 模式

请参阅图 6-82

| 编号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|--------|--------------------|------|-----|-----|
| | $f_{op(clk)}$ | | 50 | MHz |
| HSSDR5 | $t_{c(clk)}$ | 20 | | ns |
| HSSDR6 | $t_{w(clkH)}$ | 9.2 | | ns |
| HSSDR7 | $t_{w(clkL)}$ | 9.2 | | ns |
| HSSDR8 | $t_{d(clkL-cmdV)}$ | -3.2 | 3.8 | ns |
| HSSDR9 | $t_{d(clkL-dV)}$ | -3.2 | 3.8 | ns |

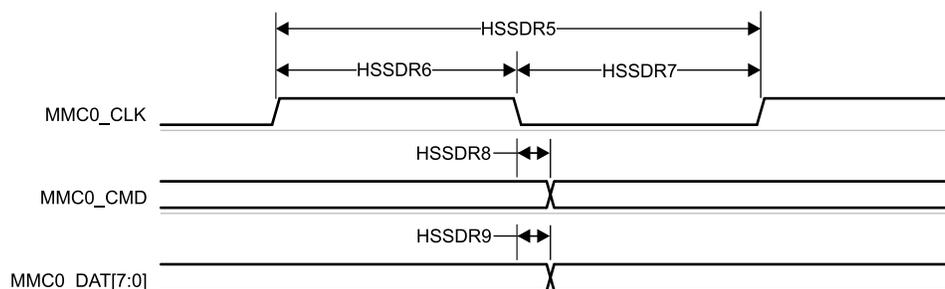


图 6-82. MMC0 - 高速 SDR 模式 - 发送模式

6.10.5.17.1.3 高速 DDR 模式

表 6-65、图 6-83、表 6-66 和图 6-84 说明了 MMC0 的时序要求和开关特性 - 高速 DDR 模式。

表 6-65. MMC0 时序要求 - 高速 DDR 模式

请参阅图 6-83

| 编号 | | | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|--------|---------------------|--|------|-----|----|
| HSDDR1 | $t_{su}(cmdV-clkH)$ | 建立时间, 在 MMC0_CLK 上升沿之前 MMC0_CMD 有效 | 3.79 | | ns |
| HSDDR2 | $t_h(clkH-cmdV)$ | 保持时间, 在 MMC0_CLK 上升沿之后 MMC0_CMD 有效 | 2.67 | | ns |
| HSDDR3 | $t_{su}(dV-clkV)$ | 建立时间, 在 MMC0_CLK 转换之前 MMC0_DAT[7:0] 有效 | 0.74 | | ns |
| HSDDR4 | $t_h(clkV-dV)$ | 保持时间, 在 MMC0_CLK 转换之后 MMC0_DAT[7:0] 有效 | 1.67 | | ns |

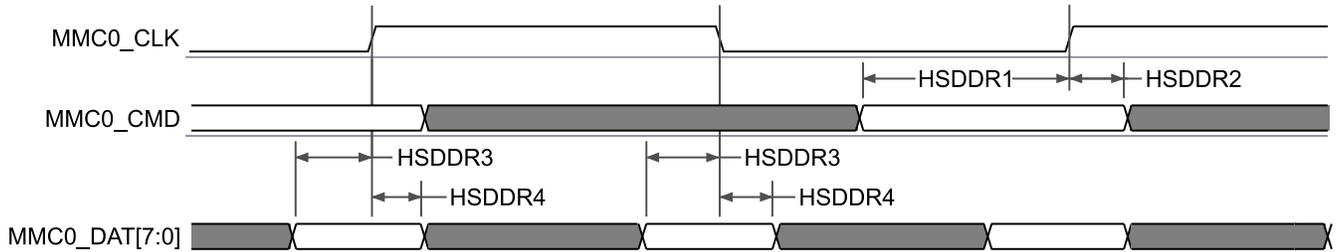


图 6-83. MMC0 - 高速 DDR 模式 - 接收模式

表 6-66. MMC0 开关特性 - 高速 DDR 模式

请参阅图 6-84

| 编号 | 参数 | | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|--------|------------------|-------------------------------------|-----|------|-----|
| | $f_{op}(clk)$ | 工作频率, MMC0_CLK | | 50 | MHz |
| HSDDR5 | $t_c(clk)$ | 周期时间, MMC0_CLK | 20 | | ns |
| HSDDR6 | $t_w(clkH)$ | 脉冲持续时间, MMC0_CLK 高电平 | 9.2 | | ns |
| HSDDR7 | $t_w(clkL)$ | 脉冲持续时间, MMC0_CLK 低电平 | 9.2 | | ns |
| HSDDR8 | $t_d(clkH-cmdV)$ | 延迟时间, MMC0_CLK 上升沿到 MMC0_CMD 转换 | 3.4 | 9.8 | ns |
| HSDDR9 | $t_d(clkV-dV)$ | 延迟时间, MMC0_CLK 转换到 MMC0_DAT[7:0] 转换 | 2.9 | 6.85 | ns |

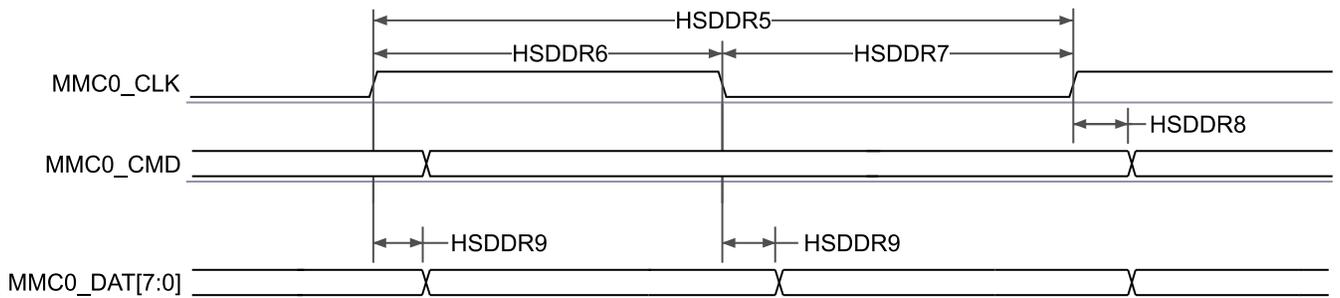


图 6-84. MMC0 - 高速 DDR 模式 - 发送模式

6.10.5.17.1.4 HS200 模式

表 6-67、图 6-85、表 6-68 和 图 6-86 展示了 MMC0 - HS200 模式下的时序要求和切换特性。

表 6-67. MMC0 时序要求 - HS200 模式

请参阅图 6-85

| 编号 | 参数 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|--------|-----------|-----------------------------------|--------------------|-----|----|
| HS2004 | t_{DWW} | 输入数据有效窗口、MMC0_CMD 和 MMC0_DAT[7:0] | 2.0 ⁽¹⁾ | | ns |

- (1) 此参数定义了主机所需的最小数据有效窗口，任何提供给主机的数据有效窗口大于此值时，均可确保主机能够捕获有效数据。此参数定义的值小于针对任何在 HS200 模式下运行的 eMMC 器件定义的最小可能数据有效窗口。

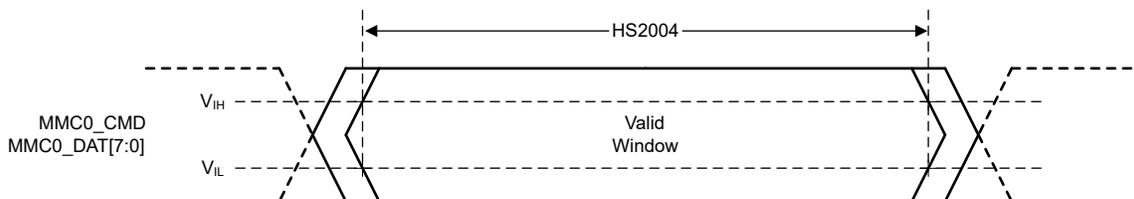


图 6-85. MMC0 - HS200 - 接收模式

表 6-68. MMC0 开关特性 - HS200 模式

请参阅图 6-86

| 编号 | 参数 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|--------|------------------|--------------------------------------|------|------|-----|
| | $f_{op}(clk)$ | 工作频率, MMC0_CLK | | 200 | MHz |
| HS2005 | $t_c(clk)$ | 周期时间, MMC0_CLK | 5 | | ns |
| HS2006 | $t_w(clkH)$ | 脉冲持续时间, MMC0_CLK 高电平 | 2.08 | | ns |
| HS2007 | $t_w(clkL)$ | 脉冲持续时间, MMC0_CLK 低电平 | 2.08 | | ns |
| HS2008 | $t_d(clkL-cmdV)$ | 延迟时间, MMC0_CLK 上升沿到 MMC0_CMD 转换 | 0.99 | 3.16 | ns |
| HS2009 | $t_d(clkL-dV)$ | 延迟时间, MMC0_CLK 上升沿到 MMC0_DAT[7:0] 转换 | 0.99 | 3.16 | ns |

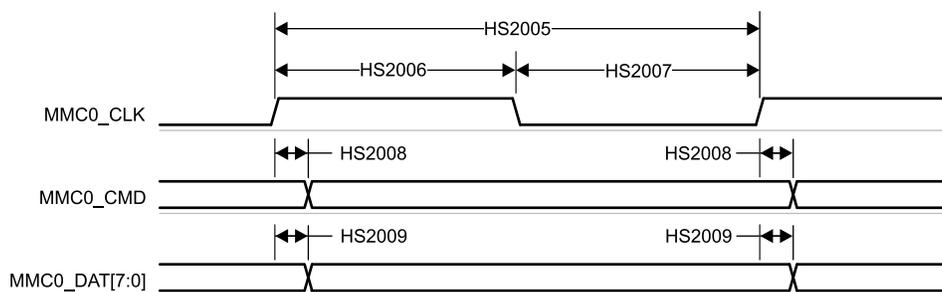


图 6-86. MMC0 - HS200 模式 - 发送模式

6.10.5.17.1.5 HS400 模式

表 6-69、图 6-87、表 6-70 和 图 6-88 说明了 MMC0 的开关特性 - HS400 模式。

表 6-69. MMC0 时序要求 - HS400 模式

请参阅图 6-87

| 编号 | 参数 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|--------|----------------|------------------------------|------|-----|----|
| HS4000 | t_{DSMPW} | 脉冲宽度, MMC0_DS | 1.95 | | ns |
| HS4001 | t_{RQ_DAT} | 输入偏斜, MMC0_DS 到 MMC0_DAT 有效 | | 475 | ps |
| HS4002 | t_{RQH_DAT} | 输入偏斜保持, MMC0_DAT 无效到 MMC0_DS | | 475 | ps |

表 6-69. MMC0 时序要求 - HS400 模式 (续)

请参阅图 6-87

| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|--------|----------------|------------------------------|-----|-----|----|
| HS4003 | t_{RQ_CMD} | 输入偏斜, MMC0_DS 到 MMC0_CMD 有效 | | 475 | ps |
| HS4004 | t_{RQH_CMD} | 输入偏斜保持, MMC0_CMD 无效到 MMC0_DS | | 475 | ps |

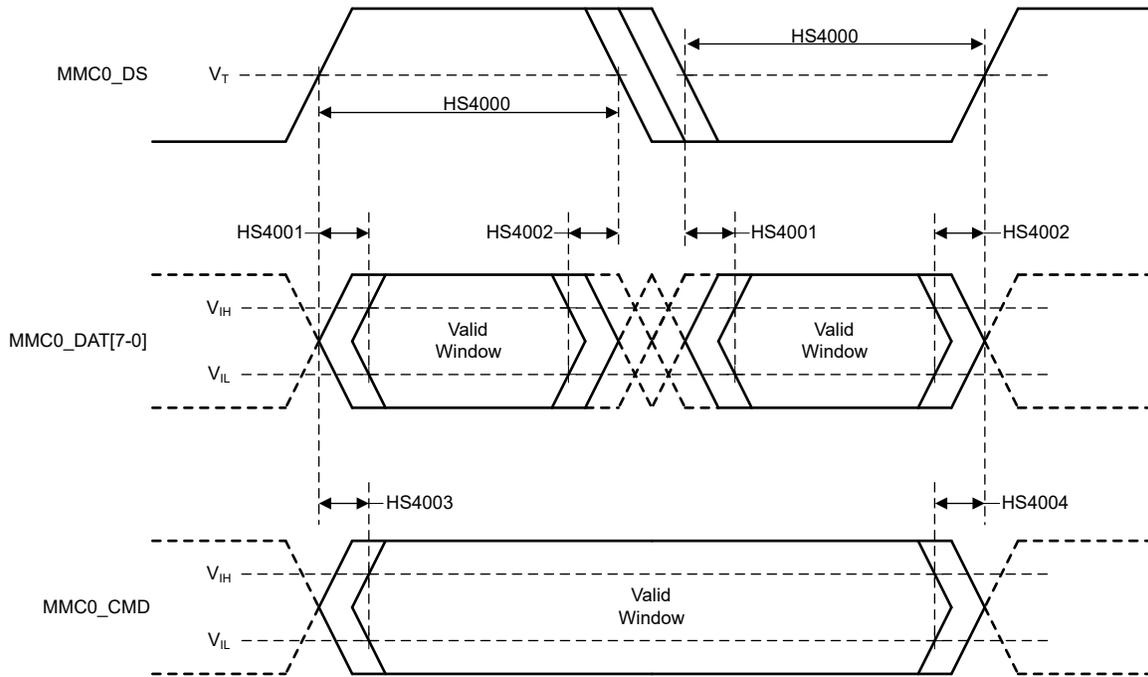


图 6-87. MMC0 - HS400 - 接收模式

表 6-70. MMC0 开关特性 - HS400 模式

请参阅图 6-88

| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|--------|----------------------|---|------|-----|-----|
| | $f_{op}(clk)$ | 工作频率, MMC0_CLK | | 200 | MHz |
| HS4005 | $t_{c}(clk)$ | 周期时间, MMC0_CLK | 5 | | ns |
| HS4006 | $t_{w}(clkH)$ | 脉冲持续时间, MMC0_CLK 高电平 | 2.23 | | ns |
| HS4007 | $t_{w}(clkL)$ | 脉冲持续时间, MMC0_CLK 低电平 | 2.23 | | ns |
| HS4008 | $t_{osu}(cmdV-clkH)$ | 输出建立时间, MMC0_CMD 有效到 MMC0_CLK 上升边沿 ⁽¹⁾ | 2.54 | | ns |
| HS4009 | $t_{osu}(dV-clk)$ | 输出建立时间, MMC0_DAT[7:0] 有效到 MMC0_CLK 上升或下降边沿 ⁽¹⁾ | 0.63 | | ns |
| HS4010 | $t_{oh}(clkH-cmdIV)$ | 输出保持时间, MMC0_CLK 上升边沿到 MMC0_CMD 转换 ⁽²⁾ | 0.98 | | ns |
| HS4011 | $t_{oh}(clk-dIV)$ | 输出保持时间, MMC0_CLK 上升或下降边沿到 MMC0_DAT[7:0] 无效 ⁽²⁾ | 0.72 | | ns |

- (1) 此参数定义了提供给所连接器件的输出建立时间。该时间相对于下一个捕获时钟边沿。此参数的时序基准是从 DAT 或 CMD 信号转换的 $1/2 V_s$ 到 CLK 信号转换的 $1/2 V_s$ 。eMMC 标准定义了从 DAT 或 CMD 信号转换的 V_{IL} 或 V_{IH} 到 CLK 信号转换的 $1/2 V_s$ 的建立时序基准。因此,系统设计人员在设计 PCB 时必须考虑 DAT 信号压摆率的影响,并确保 DAT 信号从 $1/2 V_s$ 转换到 V_{IL} 或 V_{IH} 所需的时间不会减小建立时间裕度。
- (2) 此参数定义了提供给所连接器件的输出保持时间。该时间相对于上一个启动时钟边沿。此参数的时序基准是从 CLK 信号转换的 $1/2 V_s$ 到 DAT 或 CMD 信号转换的 $1/2 V_s$ 。eMMC 标准定义了从 CLK 信号转换的 $1/2 V_s$ 到 DAT 或 CMD 信号转换的 V_{IL} 或 V_{IH} 的保持时间基准。因此,系统设计人员在设计 PCB 时必须考虑 DAT 信号压摆率的影响,并确保 DAT 信号从 V_{IL} 或 V_{IH} 转换到 $1/2 V_s$ 所需的时间不会减小保持时间裕度。

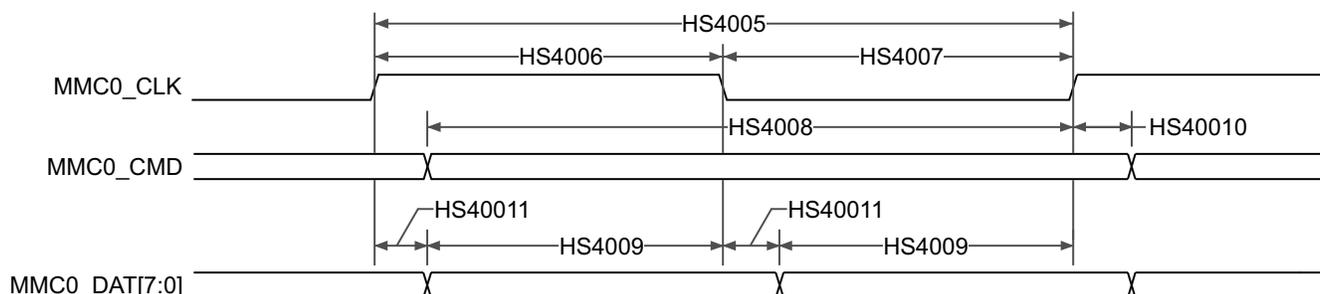


图 6-88. eMMC 接口 - HS400 模式 - 发送器模式

6.10.5.17.2 MMC1 - SD/SDIO 接口

MMC1 接口符合 SD 主机控制器标准规范 4.10 和 SD 物理层规范 v3.01 以及 SDIO 规范 v3.00，并支持以下 SD 卡应用：

- 默认速度
- 高速
- UHS - I SDR12
- UHS - I SDR25
- UHS - I SDR50
- UHS - I SDR104
- UHS - I DDR50

表 6-71 提供了 MMC1/2 时序模式所需的 DLL 软件配置设置。

表 6-71. 所有时序模式的 MMC1 DLL 延迟映射

| 寄存器名称 | | MMCSD1_MMC_SSCFG_PHY_CTRL_4_REG | | | |
|--------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|-------------------|
| 位字段 | | [20] | [15:12] | [8] | [4:0] |
| 位字段名称 | | OTAPDLYENA | OTAPDLYSEL | ITAPDLYENA | ITAPDLYSEL |
| 模式 | 说明 | 延迟启用 | 延迟值 | 输入延迟启用 | 输入延迟值 |
| 默认速度 | 4 位 PHY 工作 3.3V, 25MHz | NA ⁽¹⁾ | 不适用 ⁽¹⁾ | 0x0 | 0x0 |
| 高速 | 4 位 PHY 工作 3.3V, 50MHz | NA ⁽¹⁾ | 不适用 ⁽¹⁾ | 0x0 | 0x0 |
| UHS-I SDR12 | 4 位 PHY 工作 1.8V, 25MHz | 0x1 | 0xF | 0x0 | 0x0 |
| UHS-I SDR25 | 4 位 PHY 工作 1.8V, 50MHz | 0x1 | 0xF | 0x0 | 0x0 |
| UHS-I SDR50 | 4 位 PHY 工作 1.8V, 100MHz | 0x1 | 0xC | 0x1 | 调优 ⁽²⁾ |
| UHS-I DDR50 | 4 位 PHY 工作 1.8V, 50MHz | 0x1 | 0xC | 0x1 | 调优 ⁽²⁾ |
| UHS-I SDR104 | 4 位 PHY 工作 1.8V 200MHz | 0x1 | 0x5 | 0x1 | 调优 ⁽²⁾ |

(1) 不适用意味着当以半周期时序运行（此模式强制要求）时，该寄存器字段无功能。

(2) 调优意味着此模式需要使用调优算法来确定适当输入时序

表 6-72 展示了 MMC1 的时序条件。

表 6-72. MMC1 时序条件

| 参数 | | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|------|------|
| 输入条件 | | | | | |
| SR _i | 输入压摆率 | 默认速度, 高速 | 0.69 | 2.06 | V/ns |
| | | UHS-I SDR12、UHS-I SDR25 | 0.34 | 1.34 | V/ns |
| | | USH-1 DDR50 | 1.00 | 2.00 | V/ns |
| 输出条件 | | | | | |
| C _L | 输出负载电容 | 所有模式 | 1 | 10 | pF |
| PCB 连接要求 | | | | | |
| t _d (Trace Delay) | 每条引线的传播延迟 | UHS - I DDR50 | 240.03 | 1134 | ps |
| | | 所有其他模式 | 126 | 1386 | ps |
| t _d (Trace Mismatch Delay) | 所有布线之间的传播延迟不匹配 | UHS - I DDR50 | | 20 | ps |
| | | UHS - I SDR104 | | 8 | ps |
| | | 所有其他模式 | | 100 | ps |

6.10.5.17.2.1 默认速度模式

表 6-73、图 6-89、表 6-74 和图 6-90 说明了 MMC1/2 的时序要求和开关特性 - 默认速度模式。

表 6-73. MMC1/2 时序要求 - 默认速度模式

请参阅图 6-89

| 编号 | | | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----|---------------------|---|------|-----|----|
| DS1 | $t_{su}(cmdV-clkH)$ | 建立时间, 在 MMC[x]_CLK 上升沿之前 MMC[x]_CMD 有效 | 2.15 | | ns |
| DS2 | $t_h(clkH-cmdV)$ | 保持时间, 在 MMC[x]_CLK 上升沿之后 MMC[x]_CMD 有效 | 4.56 | | ns |
| DS3 | $t_{su}(dV-clkH)$ | 建立时间, 在 MMC[x]_CLK 上升沿之前 MMC[x]_DAT[3:0] 有效 | 2.15 | | ns |
| DS4 | $t_h(clkH-dV)$ | 保持时间, 在 MMC[x]_CLK 上升沿之后 MMC[x]_DAT[3:0] 有效 | 4.56 | | ns |

A. 对于 MMC1 和 MMC2, x = 1、2

B. 对于 MMC1 和 MMC2, x = 1、2

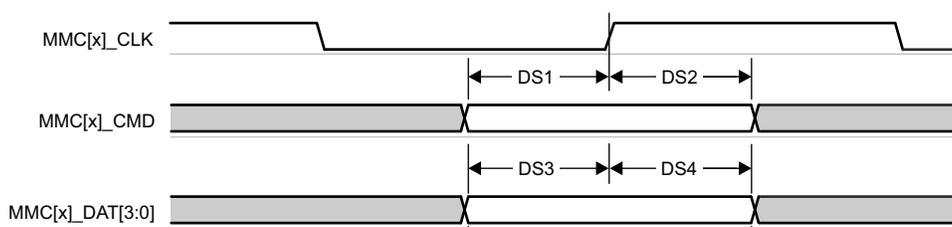


图 6-89. MMC1/2 - 默认速度 - 接收模式

表 6-74. MMC1/2 开关特性 - 默认速度模式

请参阅图 6-90

| 编号 | 参数 | | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----|------------------|--|-------|------|-----|
| | $f_{op}(clk)$ | 工作频率, MMC[x]_CLK | | 25 | MHz |
| DS5 | $t_c(clk)$ | 周期时间, MMC[x]_CLK | 40 | | ns |
| DS6 | $t_w(clkH)$ | 脉冲持续时间, MMC[x]_CLK 高电平 | 18.7 | | ns |
| DS7 | $t_w(clkL)$ | 脉冲持续时间, MMC[x]_CLK 低电平 | 18.7 | | ns |
| DS8 | $t_d(clkL-cmdV)$ | 延迟时间, MMC[x]_CLK 下降沿到 MMC[x]_CMD 转换 | -3.53 | 3.53 | ns |
| DS9 | $t_d(clkL-dV)$ | 延迟时间, MMC[x]_CLK 下降沿到 MMC[x]_DAT[3:0] 转换 | -3.53 | 3.53 | ns |

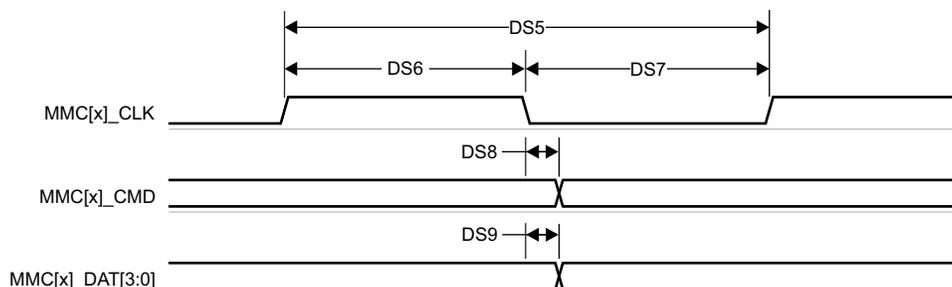


图 6-90. MMC1/2 - 默认速度 - 发送模式

6.10.5.17.2.2 高速模式

表 6-75、图 6-91、表 6-76 和图 6-92 说明了 MMC1/2 的时序要求和开关特性 - 高速模式。

表 6-75. MMC1/2 时序要求 - 高速模式

请参阅图 6-91

| 编号 | | | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----|---------------------|---|------|-----|----|
| HS1 | $t_{su}(cmdV-clkH)$ | 建立时间, 在 MMC[x]_CLK 上升沿之前 MMC[x]_CMD 有效 | 2.15 | | ns |
| HS2 | $t_h(clkH-cmdV)$ | 保持时间, 在 MMC[x]_CLK 上升沿之后 MMC[x]_CMD 有效 | 2.26 | | ns |
| HS3 | $t_{su}(dV-clkH)$ | 建立时间, 在 MMC[x]_CLK 上升沿之前 MMC[x]_DAT[3:0] 有效 | 2.15 | | ns |
| HS4 | $t_h(clkH-dV)$ | 保持时间, 在 MMC[x]_CLK 上升沿之后 MMC[x]_DAT[3:0] 有效 | 2.26 | | ns |

- A. 对于 MMC1 和 MMC2, x = 1、2
- B. 对于 MMC1 和 MMC2, x = 1、2

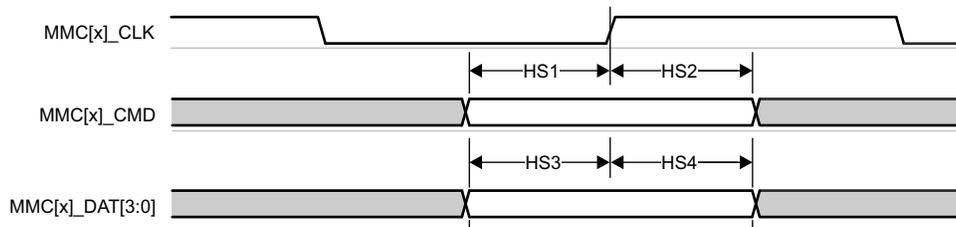


图 6-91. MMC1/2 - 高速 - 接收模式

表 6-76. MMC1/2 开关特性 - 高速模式

请参阅图 6-92

| 编号 | 参数 | | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----|------------------|--|-------|------|-----|
| | $f_{op}(clk)$ | 工作频率, MMC[x]_CLK | | 50 | MHz |
| HS5 | $t_c(clk)$ | 周期时间, MMC[x]_CLK | 20 | | ns |
| HS6 | $t_w(clkH)$ | 脉冲持续时间, MMC[x]_CLK 高电平 | 9.2 | | ns |
| HS7 | $t_w(clkL)$ | 脉冲持续时间, MMC[x]_CLK 低电平 | 9.2 | | ns |
| HS8 | $t_d(clkL-cmdV)$ | 延迟时间, MMC[x]_CLK 下降沿到 MMC[x]_CMD 转换 | -2.07 | 2.07 | ns |
| HS9 | $t_d(clkL-dV)$ | 延迟时间, MMC[x]_CLK 下降沿到 MMC[x]_DAT[3:0] 转换 | -2.07 | 2.07 | ns |

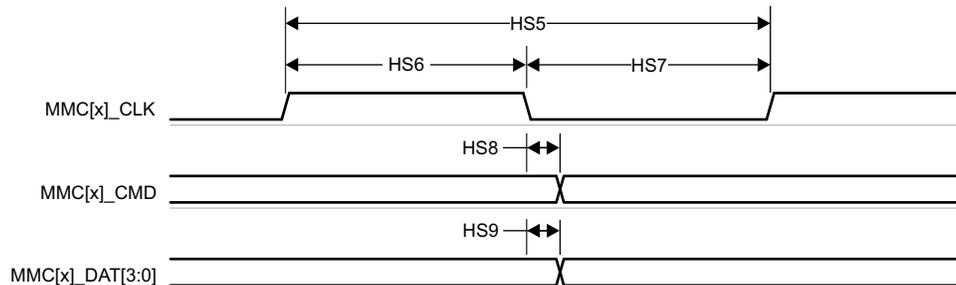


图 6-92. MMC1/2 - 高速 - 发送模式

6.10.5.17.2.3 UHS-I SDR12 模式

表 6-77、图 6-93、表 6-78 和图 6-94 说明了 MMC1/2 的时序要求和开关特性 - UHS-I SDR12 模式。

表 6-77. MMC1/2 时序要求 - UHS-I SDR12 模式

请参阅图 6-93

| 编号 | 参数 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|--------|---------------------|---|------|-----|----|
| SDR121 | $t_{su}(cmdV-clkH)$ | 建立时间, 在 MMC[x]_CLK 上升沿之前 MMC[x]_CMD 有效 | 5.46 | | ns |
| SDR122 | $t_h(clkH-cmdV)$ | 保持时间, 在 MMC[x]_CLK 上升沿之后 MMC[x]_CMD 有效 | 1.67 | | ns |
| SDR123 | $t_{su}(dV-clkH)$ | 建立时间, 在 MMC[x]_CLK 上升沿之前 MMC[x]_DAT[3:0] 有效 | 5.46 | | ns |
| SDR124 | $t_h(clkH-dV)$ | 保持时间, 在 MMC[x]_CLK 上升沿之后 MMC[x]_DAT[3:0] 有效 | 1.67 | | ns |

A. 对于 MMC1 和 MMC2, x = 1、2

B. 对于 MMC1 和 MMC2, x = 1、2

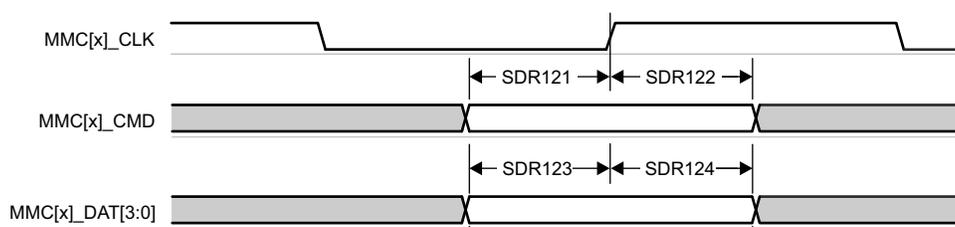


图 6-93. MMC1/2 - UHS-I SDR12 - 接收模式

表 6-78. MMC1/2 开关特性 - UHS-I SDR12 模式

请参阅图 6-94

| 编号 | 参数 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|--------|------------------|--|------|-------|-----|
| | $f_{op}(clk)$ | 工作频率, MMC[x]_CLK | | 25 | MHz |
| SDR125 | $t_c(clk)$ | 周期时间, MMC[x]_CLK | 40 | | ns |
| SDR126 | $t_w(clkH)$ | 脉冲持续时间, MMC[x]_CLK 高电平 | 18.7 | | ns |
| SDR127 | $t_w(clkL)$ | 脉冲持续时间, MMC[x]_CLK 低电平 | 18.7 | | ns |
| SDR128 | $t_d(clkH-cmdV)$ | 延迟时间, MMC[x]_CLK 上升沿到 MMC[x]_CMD 转换 | 1.2 | 13.55 | ns |
| SDR129 | $t_d(clkH-dV)$ | 延迟时间, MMC[x]_CLK 上升沿到 MMC[x]_DAT[3:0] 转换 | 1.2 | 13.55 | ns |

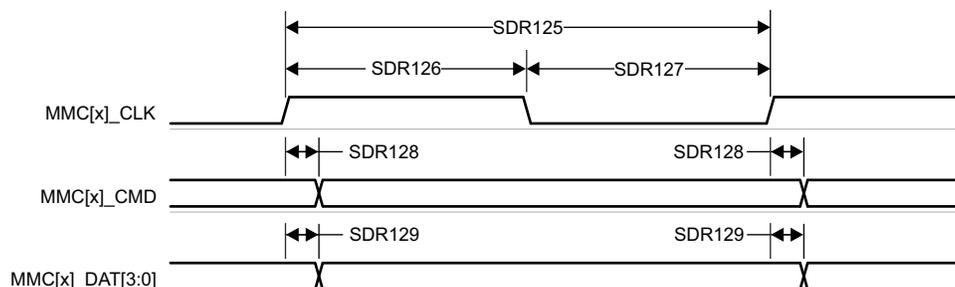


图 6-94. MMC1/2 - UHS-I SDR12 - 发送模式

6.10.5.17.2.4 UHS-I SDR25 模式

表 6-79、图 6-95、表 6-80 和图 6-96 说明了 MMC1/2 的时序要求和开关特性 - UHS-I SDR25 模式。

表 6-79. MMC1/2 时序要求 - UHS-I SDR25 模式

请参阅图 6-95

| 编号 | 参数 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|--------|---------------------|---|------|-----|----|
| SDR251 | $t_{su(cmdV-clkH)}$ | 建立时间, 在 MMC[x]_CLK 上升沿之前 MMC[x]_CMD 有效 | 2.1 | | ns |
| SDR252 | $t_h(clkH-cmdV)$ | 保持时间, 在 MMC[x]_CLK 上升沿之后 MMC[x]_CMD 有效 | 1.67 | | ns |
| SDR253 | $t_{su(dV-clkH)}$ | 建立时间, 在 MMC[x]_CLK 上升沿之前 MMC[x]_DAT[3:0] 有效 | 2.1 | | ns |
| SDR254 | $t_h(clkH-dV)$ | 保持时间, 在 MMC[x]_CLK 上升沿之后 MMC[x]_DAT[3:0] 有效 | 1.67 | | ns |

- A. 对于 MMC1 和 MMC2, x = 1、2
- B. 对于 MMC1 和 MMC2, x = 1、2

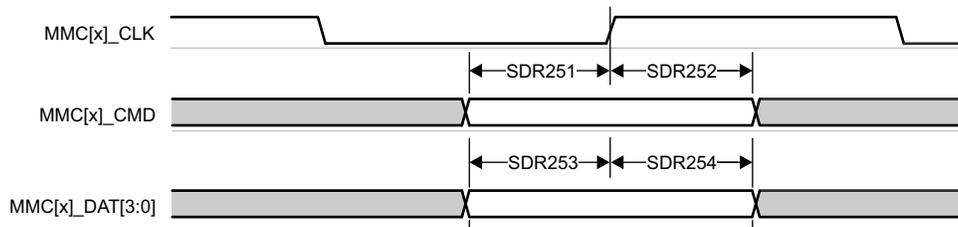


图 6-95. MMC1/2 - UHS-I SDR25 - 接收模式

表 6-80. MMC1/2 开关特性 - UHS-I SDR25 模式

请参阅图 6-96

| 编号 | 参数 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|--------|------------------|--|-----|------|-----|
| | $f_{op}(clk)$ | 工作频率, MMC[x]_CLK | | 50 | MHz |
| SDR255 | $t_c(clk)$ | 周期时间, MMC[x]_CLK | 20 | | ns |
| SDR256 | $t_w(clkH)$ | 脉冲持续时间, MMC[x]_CLK 高电平 | 9.2 | | ns |
| SDR257 | $t_w(clkL)$ | 脉冲持续时间, MMC[x]_CLK 低电平 | 9.2 | | ns |
| SDR258 | $t_d(clkH-cmdV)$ | 延迟时间, MMC[x]_CLK 上升沿到 MMC[x]_CMD 转换 | 2.4 | 9.37 | ns |
| SDR259 | $t_d(clkH-dV)$ | 延迟时间, MMC[x]_CLK 上升沿到 MMC[x]_DAT[3:0] 转换 | 2.4 | 9.37 | ns |

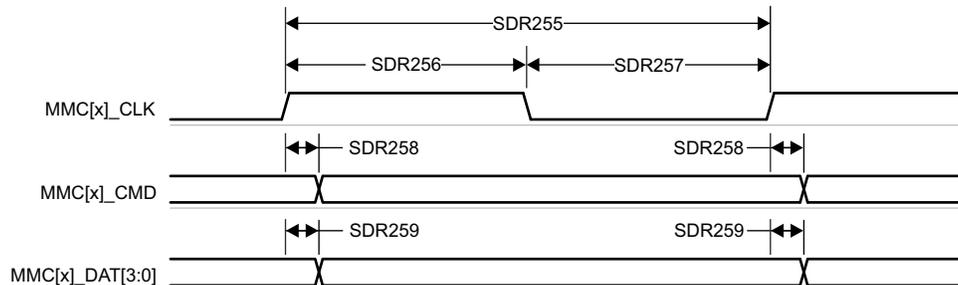


图 6-96. MMC1/2 - UHS-I SDR25 - 发送模式

6.10.5.17.2.5 UHS-I SDR50 模式

表 6-81 和图 6-97 说明了 MMC1/2 的开关特性 - UHS-I SDR50 模式。

表 6-81. MMC1/2 开关特性 - UHS-I SDR50 模式

请参阅图 6-97

| 编号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|--------|--------------------|--|-----|---------|
| | $f_{op}(clk)$ | 工作频率, MMC[x]_CLK | | 100 MHz |
| SDR505 | $t_{c}(clk)$ | 周期时间, MMC[x]_CLK | | 10 ns |
| SDR506 | $t_{w}(clkH)$ | 脉冲持续时间, MMC[x]_CLK 高电平 | | 4.45 ns |
| SDR507 | $t_{w}(clkL)$ | 脉冲持续时间, MMC[x]_CLK 低电平 | | 4.45 ns |
| SDR508 | $t_{d}(clkH-cmdV)$ | 延迟时间, MMC[x]_CLK 上升沿到 MMC[x]_CMD 转换 | | 1.2 ns |
| SDR509 | $t_{d}(clkH-dV)$ | 延迟时间, MMC[x]_CLK 上升沿到 MMC[x]_DAT[3:0] 转换 | | 1.2 ns |

A. 对于 MMC1 和 MMC2, $x = 1、2$

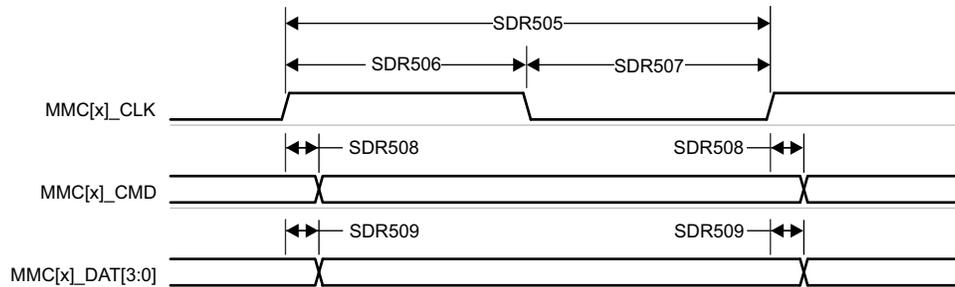


图 6-97. MMC1/2 - UHS-I SDR50 - 发送模式

6.10.5.17.2.6 UHS-I DDR50 模式

表 6-82 和图 6-98 说明了 MMC1/2 的开关特性 - UHS-I DDR50 模式。

表 6-82. MMC1/2 开关特性 - UHS-I DDR50 模式

请参阅图 6-98

| 编号 | 参数 | | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|--------|------------------|---|------|------|-----|
| | $f_{op}(clk)$ | 工作频率, MMC[x]_CLK | | 50 | MHz |
| DDR505 | $t_c(clk)$ | 周期时间, MMC[x]_CLK | 20 | | ns |
| DDR506 | $t_w(clkH)$ | 脉冲持续时间, MMC[x]_CLK 高电平 | 9.2 | | ns |
| DDR507 | $t_w(clkL)$ | 脉冲持续时间, MMC[x]_CLK 低电平 | 9.2 | | ns |
| DDR508 | $t_d(clkH-cmdV)$ | 延迟时间, MMC[x]_CLK 上升沿到 MMC[x]_CMD 转换 | 1.12 | 3.46 | ns |
| DDR509 | $t_d(clk-dV)$ | 延迟时间, MMC[x]_CLK 转换到 MMC[x]_DAT[3:0] 转换 | 1.12 | 6.12 | ns |

A. 对于 MMC1 和 MMC2, x = 1、2

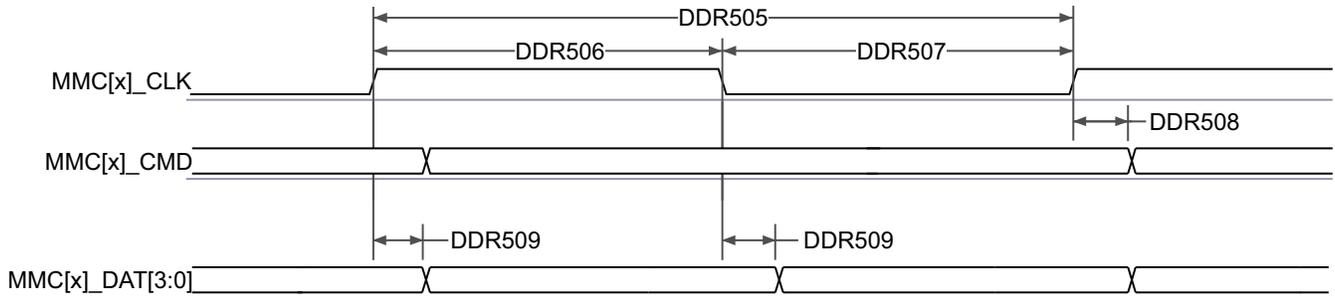


图 6-98. MMC1/2 - UHS-I DDR50 - 发送模式

6.10.5.17.2.7 UHS-I SDR104 模式

表 6-83 和图 6-99 说明了 MMC1/2 的开关特性 - UHS-I SDR104 模式。

表 6-83. MMC1/2 开关特性 - UHS-I SDR104 模式

请参阅图 6-99

| 编号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---------|------------------|--|-----|-----------------|
| | $f_{op}(clk)$ | 工作频率, MMC[x]_CLK | | 200 MHz |
| SDR1045 | $t_c(clk)$ | 周期时间, MMC[x]_CLK | | 5 ns |
| SDR1046 | $t_w(clkH)$ | 脉冲持续时间, MMC[x]_CLK 高电平 | | 2.12 ns |
| SDR1047 | $t_w(clkL)$ | 脉冲持续时间, MMC[x]_CLK 低电平 | | 2.12 ns |
| SDR1048 | $t_d(clkH-cmdV)$ | 延迟时间, MMC[x]_CLK 上升沿到 MMC[x]_CMD 转换 | | 1.07 3.21 ns |
| SDR1049 | $t_d(clkH-dV)$ | 延迟时间, MMC[x]_CLK 上升沿到 MMC[x]_DAT[3:0] 转换 | | 1.07 3.21 ns |

A. 对于 MMC1 和 MMC2, $x = 1, 2$

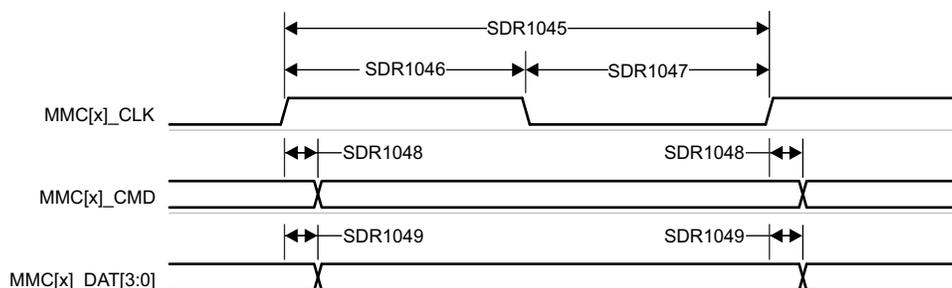


图 6-99. MMC1/2 - UHS-I SDR104 - 发送模式

6.10.5.18 CPTS

表 6-84 表示 CPTS 时序条件。

表 6-84. CPTS 时序条件

| 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------------|--------|-----|-----|------|
| 输入条件 | | | | |
| SR_i | 输入压摆率 | 0.5 | 5 | V/ns |
| 输出条件 | | | | |
| C_L | 输出负载电容 | 2 | 10 | pF |

节 6.10.5.18.1、节 6.10.5.18.2、图 6-100 和图 6-101 说明了 CPTS 接口的时序要求和开关特性。

6.10.5.18.1 CPTS 时序要求

请参阅图 6-100

| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|----|-------------------|--------------------------------------|------------------|-----|----|
| T1 | $t_w(HWnTSPUSHH)$ | 脉冲持续时间, HWnTSPUSH ⁽²⁾ 高电平 | $12P + 2^{(1)}$ | | ns |
| T2 | $t_w(HWnTSPUSHL)$ | 脉冲持续时间, HWnTSPUSH ⁽²⁾ 低电平 | $12P + 2^{(1)}$ | | ns |
| T3 | $t_c(RFT_CLK)$ | 周期时间, RFT_CLK | 5 | 8 | ns |
| T4 | $t_w(RFT_CLKH)$ | 脉冲持续时间, RFT_CLK 高电平 | $0.45 * T^{(3)}$ | | ns |
| T5 | $t_w(RFT_CLKL)$ | 脉冲持续时间, RFT_CLK 低电平 | $0.45 * T^{(3)}$ | | ns |

(1) P = 功能时钟周期 (以 ns 为单位)。

(2) 在 HWnTSPUSH 中, $n = 1$ 至 2。

(3) $T = \text{RFT_CLK}$ 周期时间 (以 ns 为单位)。

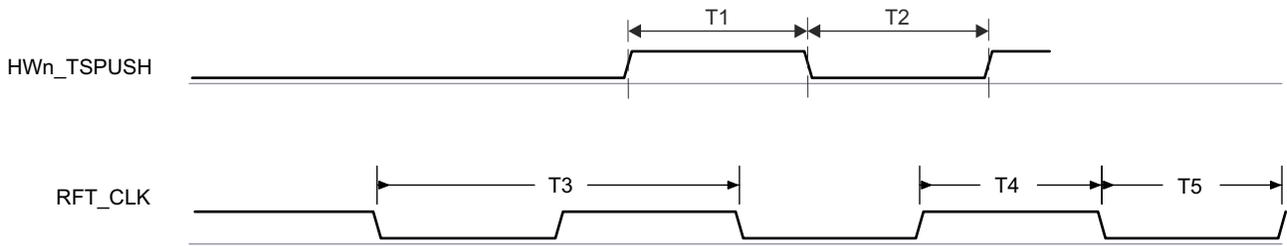


图 6-100. CPTS 时序要求

6.10.5.18.2 CPTS 开关特性

请参阅图 6-101

| 编号 | 参数 | 源 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----|---------------------------|---------------------|-----------------|-----|----|
| T6 | $t_w(\text{TS_COMPH})$ | 脉冲持续时间, TS_COMP 高电平 | $36P - 2^{(1)}$ | | ns |
| T7 | $t_w(\text{TS_COMPL})$ | 脉冲持续时间, TS_COMP 低电平 | $36P - 2^{(1)}$ | | ns |
| T8 | $t_w(\text{TS_SYNCH})$ | 脉冲持续时间, TS_SYNC 高电平 | $36P - 2^{(1)}$ | | ns |
| T9 | $t_w(\text{TS_SYNCL})$ | 脉冲持续时间, TS_SYNC 低电平 | $36P - 2^{(1)}$ | | ns |
| T10 | $t_w(\text{SYNCn_OUTH})$ | TS_SYNC | $36P - 2^{(1)}$ | | ns |
| | | TS_GENF | $5P - 2^{(1)}$ | | ns |
| T11 | $t_w(\text{SYNCn_OUTL})$ | TS_SYNC | $36P - 2^{(1)}$ | | ns |
| | | TS_GENF | $5P - 2^{(1)}$ | | ns |

(1) $P =$ 功能时钟周期 (以 ns 为单位)。

(2) 在 SYNCn_OUT 中, $n = 0$ 至 3

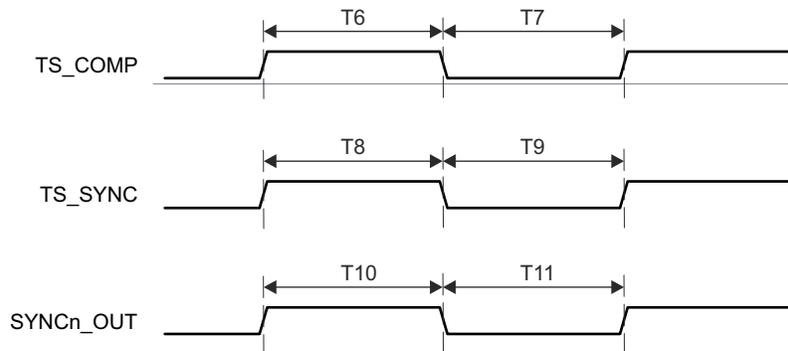


图 6-101. CPTS 开关特性

有关更多信息, 请参阅器件 TRM 的数据移动架构 (DMA) 一章中的导航器子系统 (NAVSS) 一节。

6.10.5.19 OSPI

如需进一步详细了解器件八路串行外设接口的特性和其他说明信息, 请参阅信号说明和详细说明中的相应小节。

表 6-85 表示 OSPI 时序条件。

表 6-85. OSPI 时序条件

| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|------|-----|-----|----|
| 输入条件 | | | |

表 6-85. OSPI 时序条件 (续)

| 参数 | | | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| SR _i | 输入压摆率 | 3.3V, 所有模式 | 2 | 6 | V/ns |
| | | 1.8V, 具有 DQS 的 PHY 数据训练 DDR | 0.75 | 6 | V/ns |
| | | 1.8V, 所有其他模式 | 1 | 6 | V/ns |
| 输出条件 | | | | | |
| C _L | 输出负载电容 | 所有模式 | 3 | 10 | pF |
| PCB 连接要求 | | | | | |
| t _d (Trace Delay) | 传播延迟 OSPI_CLK 布线 | 无环回； 内部焊盘环回 | | 450 | ps |
| | 传播延迟 OSPI_LBCLKO 布线 | 外部电路板环回 | 2*L-30 ⁽²⁾ | 2*L+30 ⁽²⁾ | ps |
| | 传播延迟 OSPI_DQS 布线 | DQS | L-30 ⁽²⁾ | L+30 ⁽²⁾ | ps |
| t _d (Trace Mismatch Delay) | 传播延迟不匹配 OSPI_D[i:0] ⁽¹⁾ 、OSPI_CS _n 相对于 OSPI_CLK | 所有模式 | | 60 | ps |

(1) 对于 OSPI0, D[i:0] 中的 i = 0 至 7；对于 OSPI1, [i:0] 中的 i = 3

(2) L = OSPI_CLK 布线的传播延迟

6.10.5.19.1 OSPI0/1 PHY 模式

6.10.5.19.1.1 具有 PHY 数据训练的 OSPI0/1

读取和写入数据有效窗口将因工艺、电压、温度和工作频率的变化而发生变化。可以实现数据训练方法，以动态配置最优读取和写入时序。实现数据训练可以在特定工艺、电压和频率工作条件下的温度范围内实现正常运行，同时实现更高的工作频率。

由于数据传输和接收时序参数会根据运行条件进行动态调整，因此未针对数据训练用例定义这些参数。

表 6-86 定义了具有数据训练的 OSPI0/1 所需的 DLL 延迟。表 6-87、图 6-102、图 6-103、表 6-88、图 6-104 和图 6-105 展示了具有数据训练的 OSPI0/1 的时序要求和开关特性。

表 6-86. 用于 PHY 数据训练的 OSPI0/1 DLL 延迟映射

| 模式 | OSPI_PHY_CONFIGURATION_REG 位字段 | 延迟值 |
|-----------|--------------------------------|-----|
| 发送 | | |
| 所有模式 | PHY_CONFIG_TX_DLL_DELAY_FLD | (1) |
| 接收 | | |
| 所有模式 | PHY_CONFIG_RX_DLL_DELAY_FLD | (2) |

(1) 发送由训练软件确定的 DLL 延迟值

(2) 接收由训练软件确定的 DLL 延迟值

表 6-87. OSPI0 时序要求 - PHY 数据训练

请参阅图 6-102 和图 6-103

| 编号 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----------|---|------------------------|-----|----|
| O15 | 建立时间，在有效 OSPI0_DQS 边沿之前 OSPI0_D[7:0] 有效 | (1) | | ns |
| O16 | 保持时间，在有效 OSPI0_DQS 边沿之后 OSPI0_D[7:0] 有效 | (1) | | ns |
| O21 | 建立时间，在有效 OSPI0_DQS 边沿之前 OSPI0_D[7:0] 有效 | (1) | | ns |
| O22 | 保持时间，在有效 OSPI0_DQS 边沿之后 OSPI0_D[7:0] 有效 | (1) | | ns |
| t_{DvW} | 数据有效窗口 (O15 + O16) | 1.8V, 具有 DQS 的 DDR | 1.4 | ns |
| | 数据有效窗口 (O21 + O22) | 1.8V, 具有内部 PHY 环回的 SDR | 1.7 | ns |

(1) 当使用数据训练查找合适的的数据有效窗口时，未定义 OSPI0/1_D[7:0] 输入的最小建立和保持时间要求。 t_{DvW} 参数定义了所需的最小数据无效窗口。提供此参数来代替最小建立和最小保持时间，必须使用它来检查与所连接器件提供的的数据有效窗口的兼容性。

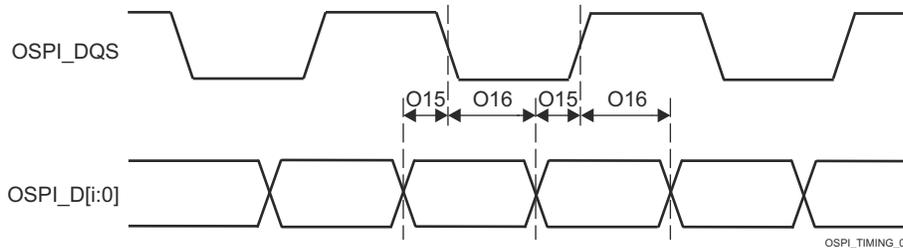


图 6-102. OSPI0/1 时序要求 - PHY 数据训练，具有 DQS 的 DDR

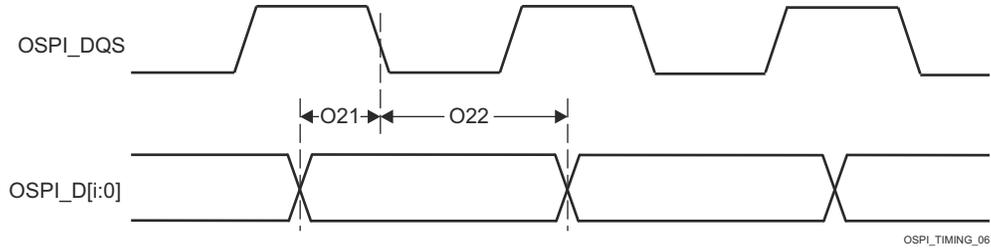


图 6-103. OSPI0/1 时序要求 - PHY 数据训练，具有内部 PHY 环回的 SDR

表 6-88. OSPI0/1 开关特性 - PHY 数据训练

请参阅图 6-104 和图 6-105

| 编号 | 参数 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----|-------------------------|-----------|--|--|----|
| O1 | $t_{c(\text{CLK})}$ | 1.8V, DDR | 6.0 | 6.0 | ns |
| O7 | | 1.8V, SDR | 6.0 | 6.0 | ns |
| O2 | $t_{w(\text{CLKL})}$ | DDR | $((0.475P^{(1)}) - 0.3)$ | | ns |
| O8 | | SDR | | | |
| O3 | $t_{w(\text{CLKH})}$ | DDR | $((0.475P^{(1)}) - 0.3)$ | | ns |
| O9 | | SDR | | | |
| O4 | $t_{d(\text{CSn-CLK})}$ | DDR | $((0.475P^{(1)}) + (0.975M^{(2)}R^{(4)}) + (0.028TD^{(5)} - 1))$ | $((0.525P^{(1)}) + (1.025M^{(2)}R^{(4)}) + (0.055TD^{(5)} + 1))$ | ns |
| O10 | | SDR | | | |
| O5 | $t_{d(\text{CLK-CSn})}$ | DDR | $((0.475P^{(1)}) + (0.975N^{(3)}R^{(4)}) - (0.055TD^{(5)} - 1))$ | $((0.525P^{(1)}) + (1.025N^{(3)}R^{(4)}) - (0.028TD^{(5)} + 1))$ | ns |
| O11 | | SDR | | | |
| O6 | $t_{d(\text{CLK-D})}$ | DDR | (6) | (6) | ns |
| O12 | | SDR | | | |
| | t_{DIVW} | DDR | 数据无效窗口 (O6 最大值 - 最小值) | | ns |
| | | SDR | 数据无效窗口 (O12 最大值 - 最小值) | | |

- (1) $P = \text{SCLK 周期时间 (以 ns 为单位)} = \text{OSPI0_CLK 周期时间 (以 ns 为单位)}$
- (2) $M = \text{OSPI_DEV_DELAY_REG[D_INIT_FLD]}$
- (3) $N = \text{OSPI_DEV_DELAY_REG[D_AFTER_FLD]}$
- (4) $R = \text{基准时钟周期时间 (以 ns 为单位)}$
- (5) $TD = \text{PHY_CONFIG_TX_DLL_DELAY_FLD}$
- (6) 当使用数据训练查找合适的窗口时，不定义 OSPI0_D[7:0] 输出的最小和最大延迟时间。 t_{DIVW} 参数定义了最大数据无效窗口。提供此参数来代替最小和最大延迟时间，必须使用它来检查与所连接器件的数据有效窗口要求的兼容性。

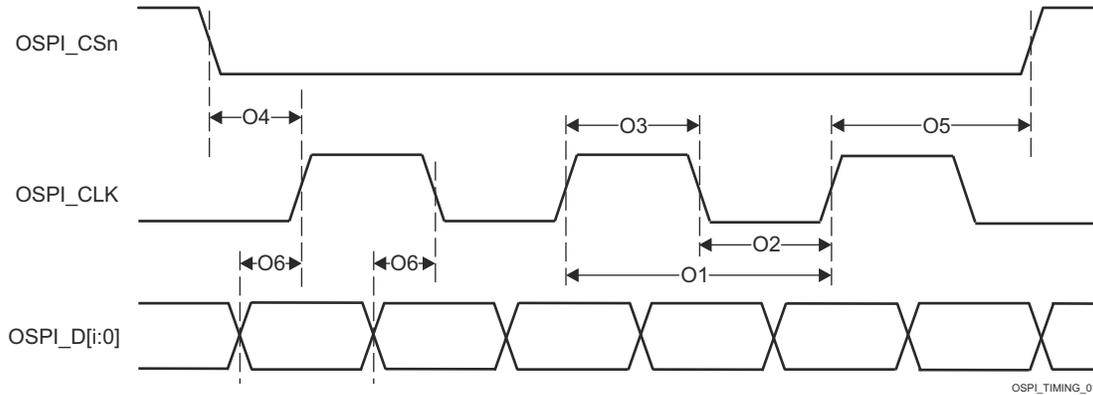


图 6-104. OSPI0/1 开关特性 - PHY DDR 数据训练

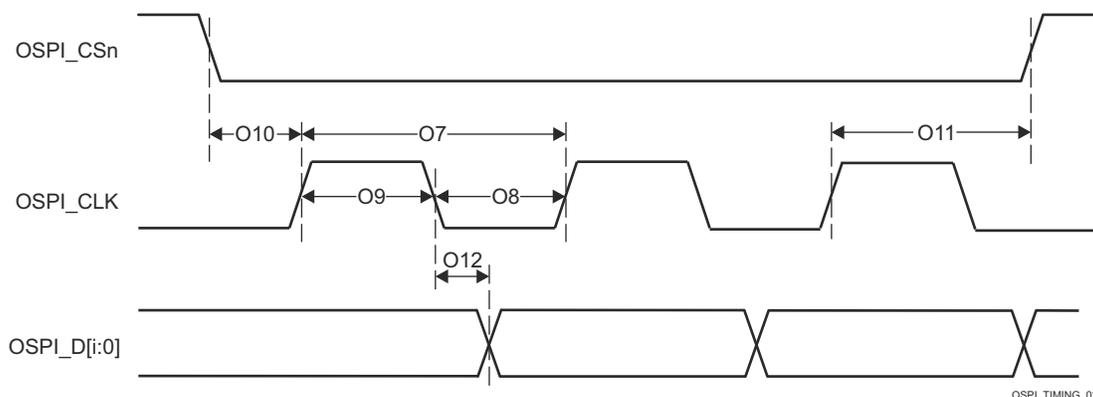


图 6-105. OSPI0/1 开关特性 - PHY SDR 数据训练

6.10.5.19.1.2 无数据训练的 OSPI

备注

本节中提供的 I/O 时序仅适用于未实施数据培训的情况。此外，按本节的表 6-89 所述配置了相应的 DLL 延迟时，I/O 时序仅对某些 OSPI 使用模式有效。

节 6.10.5.19.1.2.4、节 6.10.5.19.1.2.2、节 6.10.5.19.1.2 和节 6.10.5.19.1.2 说明了 OSPI DDR 和 SDR 模式的开关特性。

6.10.5.19.1.2.1 OSPI 时序要求 - SDR 模式

表 6-89. OSPI DLL 延迟映射 - SDR 时序模式

| 模式 | OSPI_PHY_CONFIGURATION_REG 位字段 | 延迟值 |
|------|--------------------------------|-----|
| 所有模式 | PHY_CONFIG_TX_DLL_DELAY_FLD | 0x0 |
| | PHY_CONFIG_RX_DLL_DELAY_FLD | 0x0 |

表 6-90. OSPI 时序要求 - SDR 模式

| 编号 | 参数 | 说明 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----|-------------------|---|--------------|-----|-----|----|
| O21 | $t_{su}(D-LBCLK)$ | 建立时间，在有效 LBCLK 输入 (DQS) 边沿之前 D[i:0] 有效 ⁽¹⁾ | 1.8V，外部电路板环回 | 0.6 | | ns |
| | | | 3.3V，外部电路板环回 | 0.9 | | ns |
| O22 | $t_h(LBCLK-D)$ | 保持时间，在有效 LBCLK 输入 (DQS) 边沿之后 D[i:0] 有效 ⁽¹⁾ | 1.8V，外部电路板环回 | 1.7 | | ns |
| | | | 3.3V，外部电路板环回 | 2 | | ns |

(1) 对于 OSPI0，[i:0] 中的 i = 7，对于 OSPI1，[i:0] 中的 i = 3

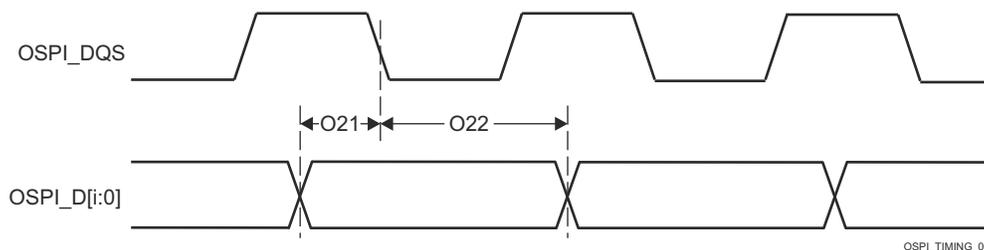


图 6-106. OSPI 时序要求 - SDR，外部环回时钟

6.10.5.19.1.2.2 OSPI 开关特性 - SDR 模式

| 编号 | 参数 | 说明 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----|------------------|--|------|---|---|----|
| O7 | $t_{c(CLK)}$ | 周期时间, CLK | 1.8V | 7 | | ns |
| | | | 3.3V | 7.5 | | ns |
| O8 | $t_{w(CLKL)}$ | 脉冲持续时间, CLK 低电平 | | $((0.475P^{(1)}) - 0.3)$ | | ns |
| O9 | | 脉冲持续时间, CLK 高电平 | | $((0.475P^{(1)}) - 0.3)$ | | ns |
| O10 | $t_{d(CSn-CLK)}$ | 延迟时间, CSn 有效边沿到 CLK 上升沿 | 1.8V | $((0.475P^{(1)}) + (0.975M^{(2)R(4)}) + (0.028TD^{(5)}) - 1)$ | $((0.525P^{(1)}) + (1.025M^{(2)R(4)}) + (0.055TD^{(5)}) - 1)$ | ns |
| | | | 3.3V | $((0.475P^{(1)}) + (0.975M^{(2)R(4)}) + (0.028TD^{(5)}) - 1)$ | $((0.525P^{(1)}) + (1.025M^{(2)R(4)}) + (0.055TD^{(5)}) - 1)$ | ns |
| O11 | $t_{d(CLK-CSn)}$ | 延迟时间, CLK 上升沿到 CSn 无效边沿 | 1.8V | $((0.475P^{(1)}) + (0.975N^{(3)R(4)}) - (0.055TD^{(5)}) - 1)$ | $((0.525P^{(1)}) + (1.025N^{(3)R(4)}) - (0.028TD^{(5)}) + 1)$ | ns |
| | | | 3.3V | $((0.475P^{(1)}) + (0.975N^{(3)R(4)}) - (0.055TD^{(5)}) - 1)$ | $((0.525P^{(1)}) + (1.025N^{(3)R(4)}) - (0.028TD^{(5)}) + 1)$ | ns |
| O12 | $t_{d(CLK-D)}$ | 延迟时间, CLK 有效边沿到 D[i:0] 转换 ⁽⁶⁾ | 1.8V | -1.16 | 1.25 | ns |
| | | | 3.3V | -1.33 | 1.51 | ns |

- (1) P = CLK 周期时间 = SCLK 周期
- (2) M = OSPI_DEV_DELAY_REG[D_INIT_FLD]
- (3) N = OSPI_DEV_DELAY_REG[D_AFTER_FLD]
- (4) R = refclk
- (5) TD = PHY_CONFIG_TX_DLL_DELAY_FLD
- (6) 对于 OSPI0, [i:0] 中的 i = 7, 对于 OSPI1, [i:0] 中的 i = 3

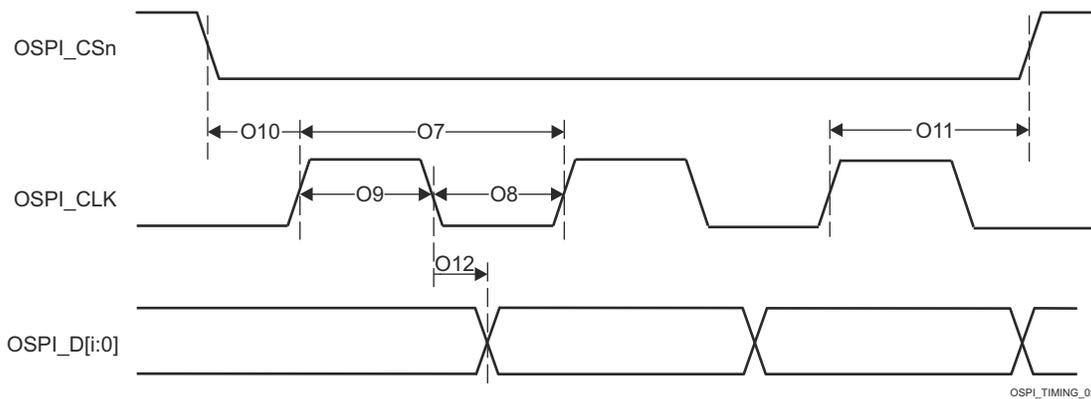


图 6-107. OSPI 开关特性 - SDR

节 6.10.5.19.1.2.3、节 6.10.5.19.1.2.1、节 6.10.5.19.1.2.2、节 6.10.5.19.1.2.2 和图 6-106 说明了 OSPI DDR 和 SDR 模式的时序要求。

6.10.5.19.1.2.3 OSPI 时序要求 - DDR 模式

表 6-91. OSPI DLL 延迟映射 - DDR 时序模式

| 模式 | OSPI_PHY_CONFIGURATION_REG 位字段 | OSPI0 | OSPI1 |
|----------------|-----------------------------------|-------|-------|
| | | 延迟值 | |
| 发送 | | | |
| 1.8V | PHY_CONFIG_TX_DLL_DELAY_FLD | 0x54 | 0x54 |
| 3.3V | PHY_CONFIG_TX_DLL_DELAY_FLD | 0x55 | 0x5C |
| RECEIVE | | | |
| 1.8V, DQS | PHY_CONFIG_RX_DLL_DELAY_FLD | 0x23 | 0x29 |
| 3.3V, DQS | PHY_CONFIG_RX_DLL_DELAY_FLD | 0x47 | 0x42 |
| 所有其他模式 | PHY_CONFIG_RX_DLL_DELAY_FLD | 0x0 | 0x0 |

表 6-92. OSPI 时序要求 - DDR 模式

| 编号 | 参数 | 说明 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----|-------------------|---|---------------|---------------------|-----|----|
| O15 | $t_{su}(D-LBCLK)$ | 建立时间, 在有效 LBCLK (DQS) 边沿之前 D[i:0] 有效 ⁽¹⁾ | 1.8V, 外部电路板环回 | 0.52 | | ns |
| | | | 3.3V, 外部电路板环回 | 1.97 | | ns |
| O16 | $t_h(LBCLK-D)$ | 保持时间, 在有效 LBCLK (DQS) 边沿之后 D[i:0] 有效 ⁽¹⁾ | 1.8V, 外部电路板环回 | 1.24 ⁽²⁾ | | ns |
| | | | 3.3V, 外部电路板环回 | 1.44 ⁽²⁾ | | ns |
| O17 | $t_{su}(D-DQS)$ | 建立时间, DQS 边沿到 D[i:0] 转换 ⁽¹⁾ | 1.8V, DQS | -0.46 | | ns |
| | | | 3.3V, DQS | -0.66 | | ns |
| O18 | $t_h(DQS-D)$ | 保持时间, DQS 边沿到 D[i:0] 转换 ⁽¹⁾ | 1.8V, DQS | 3.59 | | ns |
| | | | 3.3V, DQS | 8.89 | | ns |

(1) 对于 OSPI0, [i:0] 中的 $i = 7$, 对于 OSPI1, [i:0] 中的 $i = 3$

(2) 此保持时间要求大于典型闪存器件提供的保持时间。因此, SoC 和闪存器件之间的布线长度必须足够长, 以确保满足 SoC 的保持时间。有关更多详细信息, 请参阅 [OSPI 和 QSPI 电路板设计和布局指南](#)。

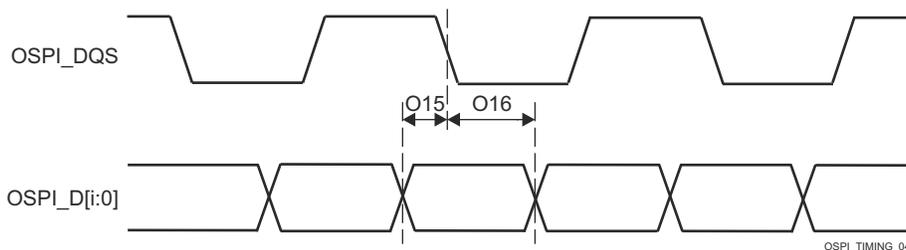


图 6-108. OSPI 时序要求 - DDR、外部环回时钟和 DQS

6.10.5.19.1.2.4 OSPI 开关特性 - PHY DDR 模式

| 编号 | 参数 | 说明 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|----|--------------------|-----------------|------|--------------------------|-----|----|
| O1 | $t_c(\text{CLK})$ | 周期时间, CLK | 1.8V | 19 | | ns |
| | | | 3.3V | 19 | | ns |
| O2 | $t_w(\text{CLKL})$ | 脉冲持续时间, CLK 低电平 | | $((0.475P^{(1)}) - 0.3)$ | | ns |
| O3 | $t_w(\text{CLKH})$ | 脉冲持续时间, CLK 高电平 | | $((0.475P^{(1)}) - 0.3)$ | | ns |

| 编号 | 参数 | 说明 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|----|-------------------------|--|--|---|-------|----|
| O4 | $t_{d(\text{CLK-CSn})}$ | 延迟时间, CSn 有效边沿到 CLK 上升沿 | 1.8V | $((0.475P^{(1)}) + (0.975M^{(2)R(4)}) + (0.028TD^{(5)} - 1)) + ((0.525P^{(1)}) + (1.025M^{(2)R(4)}) + (0.055TD^{(5)} - 1))$ | ns | |
| | | | 3.3V | $((0.475P^{(1)}) + (0.975M^{(2)R(4)}) + (0.028TD^{(5)} - 1)) + ((0.525P^{(1)}) + (1.025M^{(2)R(4)}) + (0.055TD^{(5)} - 1))$ | ns | |
| O5 | $t_{d(\text{CLK-CSn})}$ | 延迟时间, CLK 上升沿到 CSn 无效边沿 | 1.8V | $((0.475P^{(1)}) + (0.975N^{(3)R(4)}) + (0.055TD^{(5)} - 1)) + ((0.525P^{(1)}) + (1.025N^{(3)R(4)}) + (0.028TD^{(5)} - 1))$ | ns | |
| | | | 3.3V, OSPI0 DDR TX ; 3.3V, OSPI1 DDR TX | $((0.475P^{(1)}) + (0.975N^{(3)R(4)}) + (0.055TD^{(5)} - 1)) + ((0.525P^{(1)}) + (1.025N^{(3)R(4)}) + (0.028TD^{(5)} - 1))$ | ns | |
| O6 | $t_{d(\text{CLK-D})}$ | 延迟时间, CLK 有效边沿到 D[i:0] 转换 ⁽⁶⁾ | 1.8V, OSPI0 DDR TX ; 1.8V, OSPI1 DDR TX | -7.71 | -1.56 | ns |
| | | | 3.3V, OSPI0 DDR TX ; 3.3V, OSPI1 DDR TX | -7.71 | -1.56 | ns |

- (1) P = CLK 周期时间 = SCLK 周期
- (2) M = OSPI_DEV_DELAY_REG[D_INIT_FLD]
- (3) N = OSPI_DEV_DELAY_REG[D_AFTER_FLD]
- (4) R = 基准时钟周期时间 (以 ns 为单位)
- (5) TD = PHY_CONFIG_TX_DLL_DELAY_FLD
- (6) 对于 OSPI0, [i:0] 中的 i = 7, 对于 OSPI1, [i:0] 中的 i = 3

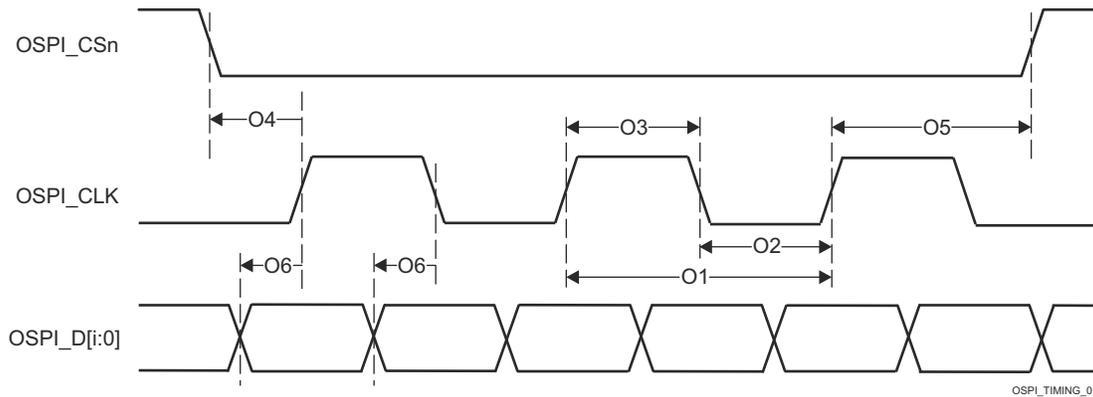


图 6-109. OSPI 开关特性 - DDR

6.10.5.19.2 OSPI0/1 Tap 模式

6.10.5.19.2.1 OSPI0 Tap SDR 时序

表 6-93、图 6-110、表 6-94 和图 6-111 说明了 OSPI0 的时序要求和开关特性 - Tap SDR 模式。

表 6-93. OSPI0/1 时序要求 - Tap SDR 模式

请参阅图 6-110

| 编号 | | | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----|-----------------|---|-----|---|-----|----|
| O19 | $t_{su}(D-CLK)$ | 建立时间，在有效 OSPI0/1_CLK 边沿之前 OSPI0/1_D[7:0] 有效 | 无环回 | (15.4 - (0.975T ⁽¹⁾ R ⁽²⁾)) | | ns |
| O20 | $t_{h}(CLK-D)$ | 保持时间，在有效 OSPI0/1_CLK 边沿之后 OSPI0/1_D[7:0] 有效 | 无环回 | (- 5.2 + (0.975T ⁽¹⁾ R ⁽²⁾)) | | ns |

(1) T = OSPI_RD_DATA_CAPTURE_REG[DELAY_FLD]

(2) R = 基准时钟周期时间 (以 ns 为单位)

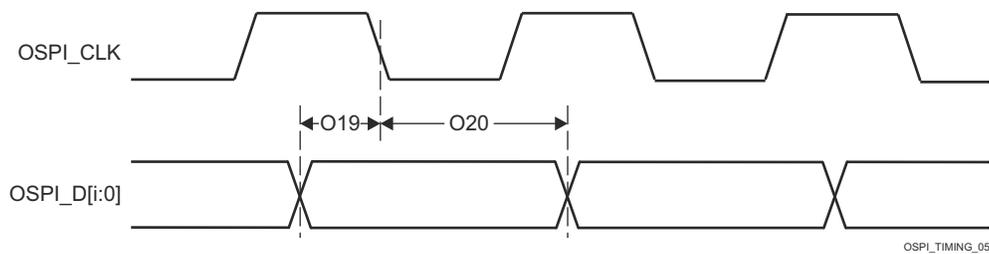


图 6-110. OSPI0/1 时序要求 - Tap SDR , 无环回

表 6-94. OSPI0/1 开关特性 - Tap SDR 模式

请参阅图 6-111

| 编号 | 参数 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----|-------------------------|--|--|--|----|
| O7 | $t_{c}(\text{CLK})$ | 周期时间, OSPI0/1_CLK | 20 | | ns |
| O8 | $t_{w}(\text{CLKL})$ | 脉冲持续时间, OSPI0/1_CLK 低电平 | $((0.475P^{(1)}) - 0.3)$ | | ns |
| O9 | $t_{w}(\text{CLKH})$ | 脉冲持续时间, OSPI0/1_CLK 高电平 | $((0.475P^{(1)}) - 0.3)$ | | ns |
| O10 | $t_{d}(\text{CSn-CLK})$ | 延迟时间, OSPI0/1_CSn[3:0] 有效边沿到 OSPI0/1_CLK 上升沿 | $((0.475P^{(1)}) + (0.975M^{(2)}R^{(4)} - 1))$ | $((0.525P^{(1)}) + (1.025M^{(2)}R^{(4)} + 1))$ | ns |
| O11 | $t_{d}(\text{CLK-CSn})$ | 延迟时间, OSPI0/1_CLK 上升沿到 OSPI0/1_CSn[3:0] 无效边沿 | $((0.475P^{(1)}) + (0.975N^{(3)}R^{(4)} - 1))$ | $((0.525P^{(1)}) + (1.025N^{(3)}R^{(4)} + 1))$ | ns |
| O12 | $t_{d}(\text{CLK-D})$ | 延迟时间, OSPI0/1_CLK 有效边沿到 OSPI0/1_D[7:0] 转换 | -2 | 2 | ns |

- (1) P = CLK 周期时间 = SCLK 周期 (以 ns 为单位)
- (2) M = OSPI_DEV_DELAY_REG[D_INIT_FLD]
- (3) N = OSPI_DEV_DELAY_REG[D_AFTER_FLD]
- (4) R = 基准时钟周期时间 (以 ns 为单位)

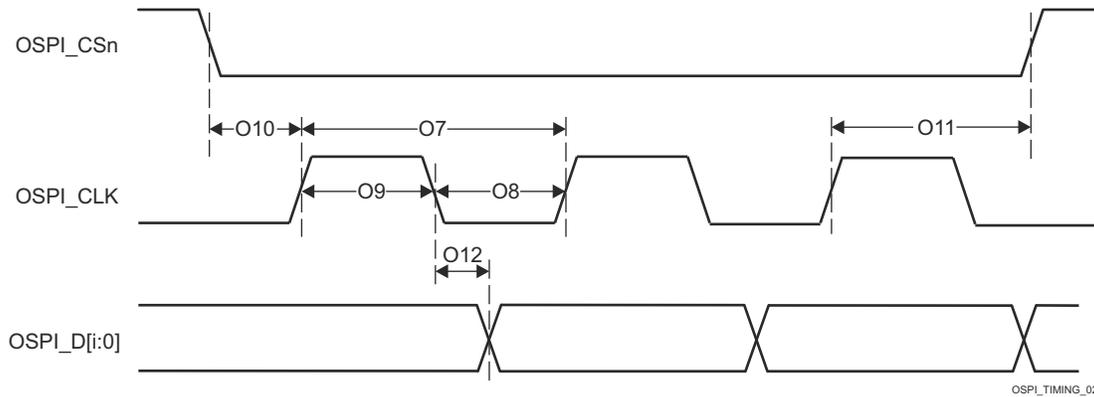


图 6-111. OSPI0/1 开关特性 - Tap SDR , 无环回

6.10.5.19.2.2 OSPI0 Tap DDR 时序

表 6-95、图 6-112、表 6-96 和图 6-113 展示了 OSPI0 的时序要求和开关特性 - Tap DDR 模式。

表 6-95. OSPI0/1 时序要求 - Tap DDR 模式

请参阅图 6-112

| 编号 | | | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----|-----------------|---|-----|--|-----|----|
| O13 | $t_{su}(D-CLK)$ | 建立时间，在有效 OSPI0/1_CLK 边沿之前 OSPI0/1_D[7:0] 有效 | 无环回 | (17.04 - (0.975T ⁽¹⁾ R ⁽²⁾)) | | ns |
| O14 | $t_h(CLK-D)$ | 保持时间，在有效 OSPI0/1_CLK 边沿之后 OSPI0/1_D[7:0] 有效 | 无环回 | (- 3.16 + (0.975T ⁽¹⁾ R ⁽²⁾)) | | ns |

(1) T = OSPI_RD_DATA_CAPTURE_REG[DELAY_FLD]

(2) R = 基准时钟周期时间 (以 ns 为单位)

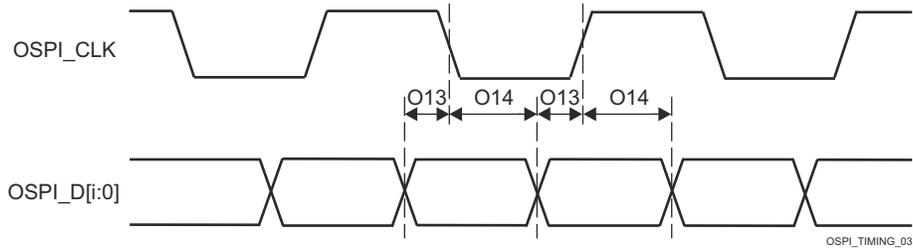


图 6-112. OSPI0/1 时序要求 - Tap DDR，无环回

表 6-96. OSPI0/1 开关特性 - Tap DDR 模式

请参阅图 6-113

| 编号 | 参数 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|----|-------------------------|--|--|---|----|
| O1 | $t_{c}(\text{CLK})$ | 周期时间, OSPI0/1_CLK | 40 | | ns |
| O2 | $t_{w}(\text{CLKL})$ | 脉冲持续时间, OSPI0/1_CLK 低电平 | $((0.475P^{(1)}) - 0.3)$ | | ns |
| O3 | $t_{w}(\text{CLKH})$ | 脉冲持续时间, OSPI0/1_CLK 高电平 | $((0.475P^{(1)}) - 0.3)$ | | ns |
| O4 | $t_{d}(\text{CSn-CLK})$ | 延迟时间, OSPI0/1_CSn[3:0] 有效边沿到 OSPI0/1_CLK 上升沿 | $((0.475P^{(1)}) + ((0.975M^{(2)}R^{(4)}) - 1))$ | $((0.525P^{(1)}) + (1.025M^{(2)}R^{(4)}) + 1)$ | ns |
| O5 | $t_{d}(\text{CLK-CSn})$ | 延迟时间, OSPI0/1_CLK 上升沿到 OSPI0/1_CSn[3:0] 无效边沿 | $((0.475P^{(1)}) + (0.975N^{(3)}R^{(4)}) - 1)$ | $((0.525P^{(1)}) + (1.025N^{(3)}R^{(4)}) + 1)$ | ns |
| O6 | $t_{d}(\text{CLK-D})$ | 延迟时间, OSPI0/1_CLK 有效边沿到 OSPI0/1_D[7:0] 转换 | $(-5.04 + (0.975(T^{(5)} + 1)R^{(4)}) - (0.525P^{(1)}))$ | $(3.64 + (1.025(T^{(5)} + 1)R^{(4)}) - (0.475P^{(1)}))$ | ns |

- (1) P = CLK 周期时间 = SCLK 周期 (以 ns 为单位)
- (2) M = OSPI_DEV_DELAY_REG[D_INIT_FLD]
- (3) N = OSPI_DEV_DELAY_REG[D_AFTER_FLD]
- (4) R = 基准时钟周期时间 (以 ns 为单位)
- (5) T = OSPI_RD_DATA_CAPTURE_REG[DDR_READ_DELAY_FLD]

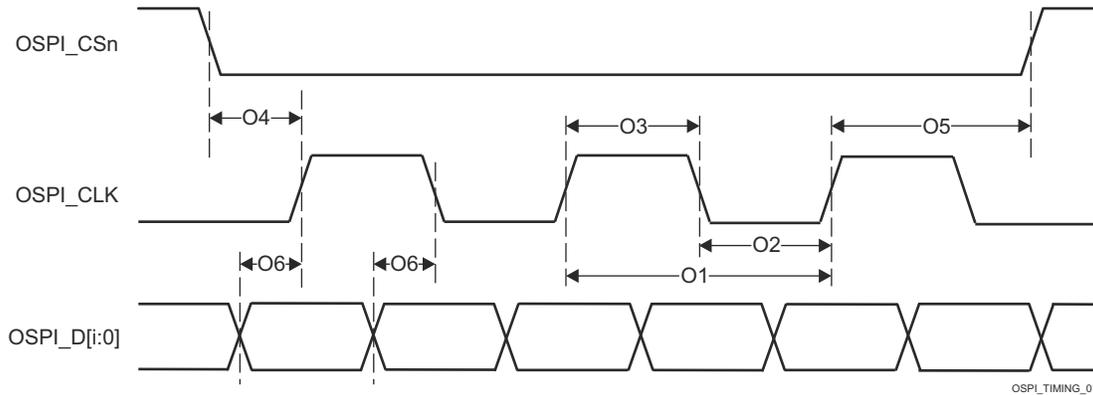


图 6-113. OSPI0/1 开关特性 - Tap DDR, 无环回

6.10.5.20 OLDI

6.10.5.20.1 OLDI 开关特性

| 编号 | 参数 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|----|----------------------------|--------|-------|-------|----|
| O1 | LVDS 低电平到高电平转换时间最大值 | IOSET1 | 0.18 | 0.5 | ns |
| O2 | LVDS 高电平到低电平转换时间最大值 | IOSET1 | 0.18 | 0.5 | ns |
| O3 | 发送器输出位宽最小值 | IOSET1 | 1 | 1 | UI |
| O4 | 发送器脉冲位置 - 归一化 | IOSET1 | 0.25 | 0.75 | ns |
| O5 | 位 7:0 脉冲位置上的发送器脉冲位置变化 | IOSET1 | -0.06 | 0.06 | ns |
| O6 | TxOut 通道间偏斜 | IOSET1 | | 110 | ns |
| O7 | 发送器周期间抖动 | IOSET1 | 0.028 | 0.035 | ns |
| O8 | 输入总抖动容差 (包括数据到时钟偏斜、脉冲位置变化) | IOSET1 | | 0.25 | ns |

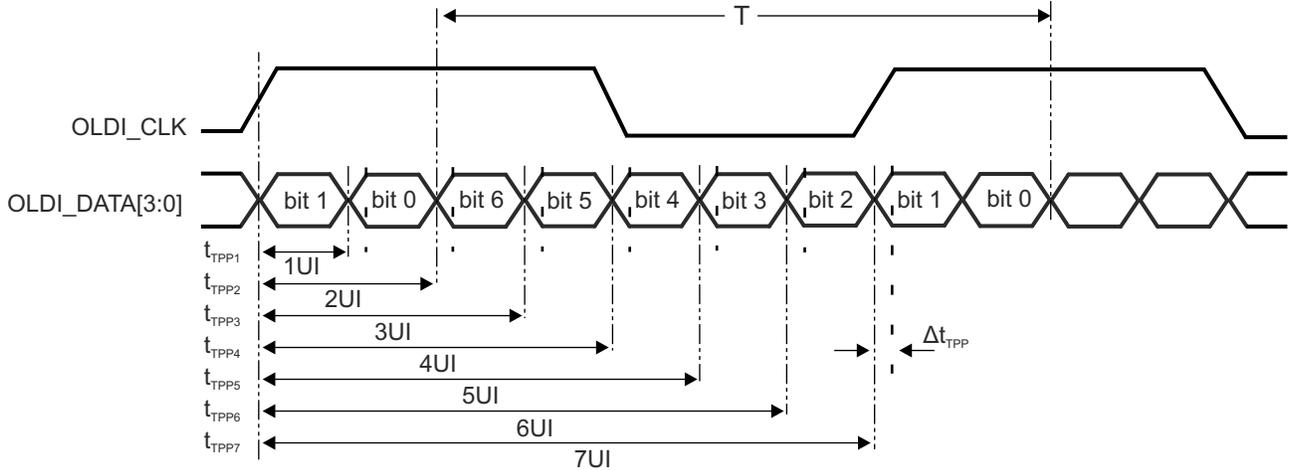


图 6-114. OLDI 发送器脉冲位置

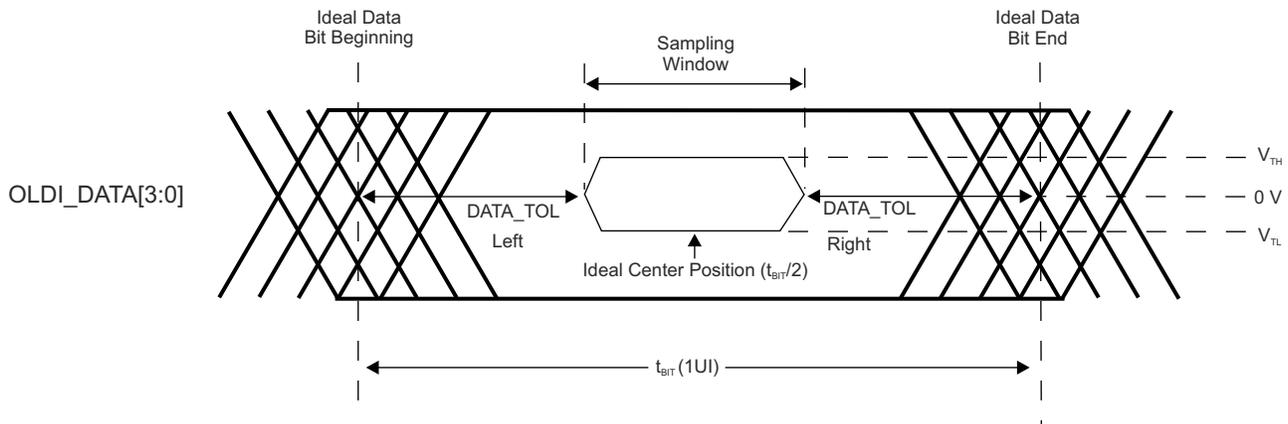


图 6-115. OLDI 数据输出抖动

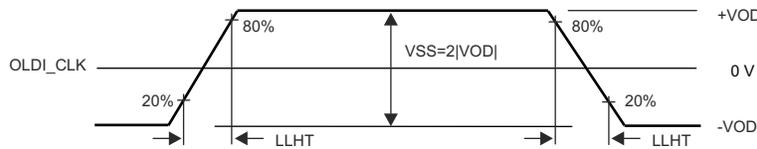


图 6-116. LVDS 输出转换次数

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的显示子系统 (DSS) 和外设一节。

6.10.5.21 PCIe

PCI-Express 子系统符合 PCIe® 基础规范修订版 4.0。有关时序详细信息，请参阅规范。

如需进一步详细了解器件外设组件快速互连的特性和其他说明信息，请参阅[信号说明](#)和[详细说明](#)中的相应小节。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的外设组件快速互连 (PCIe) 子系统一节。

6.10.5.22 计时器

如需进一步详细了解器件计时器的特性和其他说明信息，请参阅[信号说明](#)和[详细说明](#)中的相应小节。

表 6-97 表示计时器时序条件。

表 6-97. 计时器时序条件

| 参数 | 说明 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----------------|--------|-----|-----|-----|------|
| 输入条件 | | | | | |
| SR _i | 输入压摆率 | 捕获 | 0.5 | 5 | V/ns |
| 输出条件 | | | | | |
| C _L | 输出负载电容 | PWM | 2 | 10 | pF |

节 6.10.5.22.1、节 6.10.5.22.2 和图 6-117 说明了计时器的时序和开关特性。

6.10.5.22.1 计时器的时序要求

| 编号 | 参数 | 说明 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|----|-----------------------|-------------|----|-------------------------|-----|----|
| T1 | t _{w(TINPH)} | 脉冲持续时间, 高电平 | 捕获 | 2.5 + 4P ⁽¹⁾ | | ns |
| T2 | t _{w(TINPL)} | 脉冲持续时间, 低电平 | 捕获 | 2.5 + 4P ⁽¹⁾ | | ns |

(1) P = 功能时钟周期 (以 ns 为单位)。

6.10.5.22.2 计时器的开关特性

| 编号 | 参数 | 说明 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|----|-----------------------|-------------|-----|--------------------------|-----|----|
| T3 | t _{w(TOUTH)} | 脉冲持续时间, 高电平 | PWM | -2.5 + 4P ⁽¹⁾ | | ns |
| T4 | t _{w(TOURL)} | 脉冲持续时间, 低电平 | PWM | -2.5 + 4P ⁽¹⁾ | | ns |

(1) P = 功能时钟周期 (以 ns 为单位)。

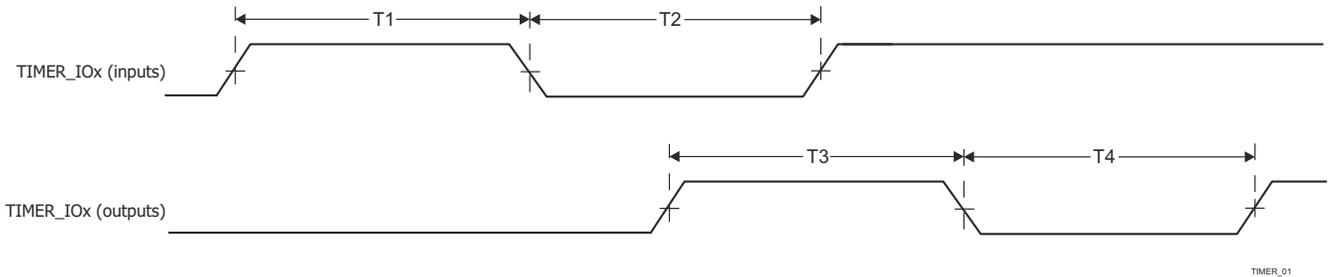


图 6-117. 计时器时序

有关更多信息, 请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *计时器* 一节。

6.10.5.23 UART

如需进一步详细了解器件通用异步接收器/发送器的特性和其他说明信息, 请参阅 [信号说明](#) 和 [详细说明](#) 中的相应小节。

表 6-98 表示 UART 时序条件。

表 6-98. UART 时序条件

| 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----------------|-------|-----|-----|------|
| 输入条件 | | | | |
| SR _i | 输入压摆率 | 0.5 | 5 | V/ns |
| 输出条件 | | | | |

表 6-98. UART 时序条件 (续)

| 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------|--------|-----|-------------------|----|
| C_L | 输出负载电容 | 1 | 30 ⁽¹⁾ | pF |

(1) 该值表示绝对最大负载电容。随着 UART 波特率的增加, 可能需要将负载电容减小到小于此最大限制的值, 以便为连接的器件提供足够的时序裕度。输出上升/下降时间随着容性负载的增加而增加, 这会减少数据对所连接器件的接收器有效的的时间。因此, 了解连接器件在工作波特率下所需的最短数据有效时间非常重要。然后使用器件 IBIS 模型来验证 UART 信号上的实际负载电容是否不会将上升/下降时间增加到超出所连接器件的最小数据有效时间的点。

节 6.10.5.23.1、节 6.10.5.23.2 和图 6-118 说明了 UART 接口的时序要求和开关特性。

6.10.5.23.1 UART 的时序要求

| 编号 | 参数 | 说明 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|----|----------------------|--------------------|----|-----------------------------|-----------------------------|----|
| 4 | $t_{w(\text{rxd})}$ | 脉冲宽度, 接收数据位高电平或低电平 | | 0.95U ⁽¹⁾ (2) | 1.05U ⁽¹⁾ (2) | ns |
| 5 | $t_{w(\text{rxdS})}$ | 脉冲宽度, 接收开始位低电平 | | 0.95U ⁽¹⁾ (2) | | ns |

(1) $U = \text{UART 波特时间} = 1/\text{编程波特率}$

(2) 该值定义了数据有效时间, 其中要求输入电压高于 V_{IH} 或低于 V_{IL} 。

6.10.5.23.2 UART 开关特性

| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|----|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------|
| | $f_{(\text{baud})}$ | 最大可编程波特率 | | 12 | Mbps |
| 2 | $t_{w(\text{TX})}$ | 脉冲宽度, 发送数据位高电平或低电平 | $U - 2$ ⁽¹⁾ | $U + 2$ ⁽¹⁾ | ns |
| 3 | $t_{w(\text{RTS})}$ | 脉冲宽度, 发送起始位高电平或低电平 | $U - 2$ ⁽¹⁾ | | ns |

(1) $U = \text{UART 波特时间} = 1/\text{编程波特率}$

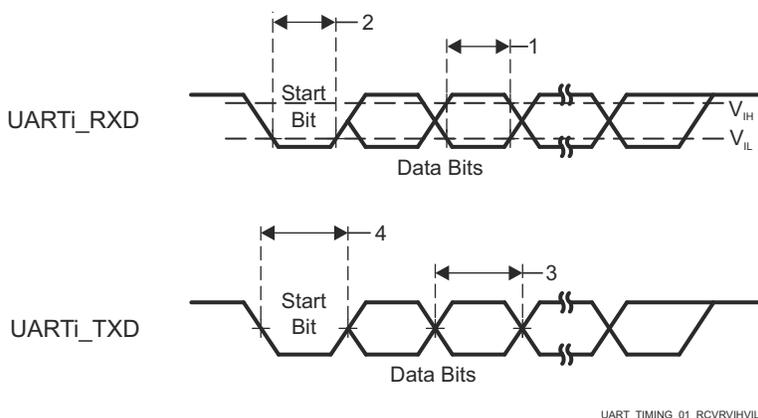


图 6-118. UART 时序

有关更多信息, 请参阅器件 TRM 的外设一章中的通用异步接收器/发送器 (UART) 一节。

6.10.5.24 USB

USB 2.0 子系统符合通用串行总线 (USB) 规范修订版 2.0。有关时序详细信息, 请参阅规范。

USB 3.1 GEN1 双角色设备子系统符合通用串行总线 (USB) 3.1 规范修订版 1.0 的要求。有关时序详细信息, 请参阅规范。

如需进一步详细了解器件通用串行总线子系统 (USB) 的特性和其他说明信息, 请参阅信号说明和详细说明中的相应小节。

6.10.6 仿真和调试

6.10.6.1 迹线

备注

DEBUG0 有一个或多个可以多路复用到多个引脚的信号。本节中定义的时序要求和开关特性仅对名为 IOSET 的特定引脚组合有效。[SysConfig-PinMux 工具](#)中定义了该接口的有效引脚组合或 IOSET。

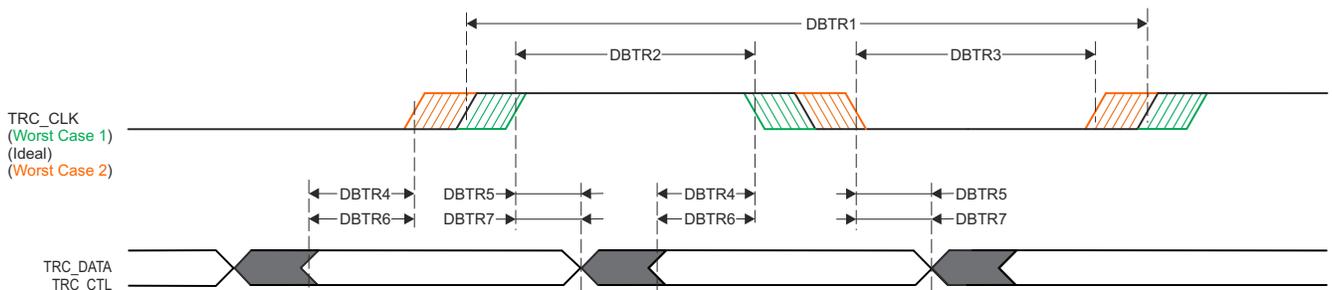
表 6-99. 布线时序条件

| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|------------------------------|----------------|-----|------|
| 输出条件 | | | |
| C_L | 输出负载电容 | 2 | 5 pF |
| PCB 连接要求 | | | |
| $t_d(\text{Trace Mismatch})$ | 所有布线之间的传播延迟不匹配 | 200 | ps |

表 6-100 和图 6-119 假设在建议运行条件和电气特性条件下进行测试。

表 6-100. 布线开关特性

| 编号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------|----|
| 1.8V 模式 | | | | |
| DBTR1 | $t_c(\text{TRC_CLK})$ | TRC_CLK 周期时间 | 6.50 | ns |
| DBTR2 | $t_w(\text{TRC_CLKH})$ | 脉冲宽度, TRC_CLK 高电平 | 2.50 | ns |
| DBTR3 | $t_w(\text{TRC_CLKL})$ | 脉冲宽度, TRC_CLK 低电平 | 2.50 | ns |
| DBTR4 | $t_{osu}(\text{TRC_DATAV-TRC_CLK})$ | 输出建立时间, TRC_DATA 到 TRC_CLK 边沿有效的的时间 | 0.81 | ns |
| DBTR5 | $t_{oh}(\text{TRC_CLK-TRC_DATAI})$ | 输出保持时间, TRC_CLK 边沿到 TRC_DATA 无效 | 0.81 | ns |
| DBTR6 | $t_{osu}(\text{TRC_CTLV-TRC_CLK})$ | 输出建立时间, TRC_CTL 到 TRC_CLK 边沿有效的的时间 | 0.81 | ns |
| DBTR7 | $t_{oh}(\text{TRC_CLK-TRC_CTLI})$ | 输出保持时间, TRC_CLK 边沿到 TRC_CTL 无效 | 0.81 | ns |
| 3.3V 模式 | | | | |
| DBTR1 | $t_c(\text{TRC_CLK})$ | TRC_CLK 周期时间 | 9.75 | ns |
| DBTR2 | $t_w(\text{TRC_CLKH})$ | 脉冲宽度, TRC_CLK 高电平 | 4.13 | ns |
| DBTR3 | $t_w(\text{TRC_CLKL})$ | 脉冲宽度, TRC_CLK 低电平 | 4.13 | ns |
| DBTR4 | $t_{osu}(\text{TRC_DATAV-TRC_CLK})$ | 输出建立时间, TRC_DATA 到 TRC_CLK 边沿有效的的时间 | 1.22 | ns |
| DBTR5 | $t_{oh}(\text{TRC_CLK-TRC_DATAI})$ | 输出保持时间, TRC_CLK 边沿到 TRC_DATA 无效 | 1.22 | ns |
| DBTR6 | $t_{osu}(\text{TRC_CTLV-TRC_CLK})$ | 输出建立时间, TRC_CTL 到 TRC_CLK 边沿有效的的时间 | 1.22 | ns |
| DBTR7 | $t_{oh}(\text{TRC_CLK-TRC_CTLI})$ | 输出保持时间, TRC_CLK 边沿到 TRC_CTL 无效 | 1.22 | ns |



SPRSP08_Debug_01

图 6-119. 布线开关特性

6.10.6.2 JTAG

如需进一步详细了解器件 IEEE 1149.1 标准测试访问端口的特性和其他说明信息，请参阅[信号说明](#)和[详细说明](#)中的相应小节。

备注

JTAG 信号拆分到器件上的两个 IO 电源域中。仅当两个 IO 电源域在相同的电压下运行并且电平转换器未插入到信号路径中时，本节中定义的时序参数才适用。在不同的电压下运行两个 IO 电源域时，以下时序参数的值未定义，因为当一些器件 IO 缓冲器在 1.8V 电压下运行，而另一些在 3.3V 电压下运行时，通过这些 IO 缓冲器的传播延迟会有所不同。这实际上降低了超出本节中所定义的值时序裕度。当两个 IO 电源域在不同电压下运行时，JTAG 接口仍应该能正常工作，但前提是系统设计人员实施了适当的电平转换器，并降低了工作频率以适应在不同电压下运行的电平转换器和 IO 缓冲器插入的额外延迟。

表 6-101. JTAG 时序条件

| 参数 | | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---------------------------------------|----------------|------|---------------------|------|
| 输入条件 | | | | |
| SR _i | 输入压摆率 | 0.50 | 2.00 | V/ns |
| 输出条件 | | | | |
| C _L | 输出负载电容 | 5 | 15 | pF |
| PCB 连接要求 | | | | |
| t _d (Trace Delay) | 每条引线的传播延迟 | 83.5 | 1000 ⁽¹⁾ | ps |
| t _d (Trace Mismatch Delay) | 所有布线之间的传播延迟不匹配 | | 100 | ps |

(1) 与 JTAG 信号引线相关的最大传播延迟对最大 TCK 工作频率有显著的影响。可以将跟踪延迟增加到超过该值，但必须降低 TCK 的工作频率以解决额外的跟踪延迟。

6.10.6.2.1 JTAG 电气数据和时序

节 6.10.6.2.1.1 节 6.10.6.2.1.2 和图 6-120 假设在建议运行条件和电气特性条件下进行测试。

6.10.6.2.1.1 JTAG 时序要求

请参阅图 6-120

| 编号 | 参数 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|----|---------------------------|-----------------------------|---------------------|-----|----|
| J1 | t _c (TCK) | 最小周期时间, TCK | 46.5 ⁽¹⁾ | | ns |
| J2 | t _w (TCKH) | 最小脉冲宽度, TCK 高电平 | 18.6 ⁽²⁾ | | ns |
| J3 | t _w (TCKL) | 最小脉冲宽度, TCK 低电平 | 18.6 ⁽²⁾ | | ns |
| J4 | t _{su} (TDI-TCK) | 最小输入建立时间, TDI 有效到 TCK 高电平 | 4.5 | | ns |
| | t _{su} (TMS-TCK) | 最小输入建立时间, TMS 有效到 TCK 高电平 | 4.5 | | ns |
| J5 | t _h (TCK-TDI) | 最小输入保持时间, 从 TCK 高电平到 TDI 有效 | 2 | | ns |
| | t _h (TCK-TMS) | 最小输入保持时间, 从 TCK 高电平到 TMS 有效 | 2 | | ns |

(1) 最大 TCK 工作频率假定所连接的调试器具有以下时序要求和开关特性。如果调试器超出任何这些假设，则必须降低 TCK 的工作频率以提供适当的时序裕度。

- 相对于 TCK 上升沿的最小 TDO 建立时间为 4.6 ns
- 相对于 TCK 下降沿, TDI 和 TMS 输出延迟范围为 -16.5 ns 至 14.0 ns

(2) P = TCK 周期时间 (以 ns 为单位)

6.10.6.2.1.2 JTAG 开关特性

请参阅图 6-120

| 编号 | 参数 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|----|----------------------------|-------------------------|-----|-----|----|
| J6 | t _d (TCKL-TDOI) | 最小延迟时间, TCK 低电平到 TDO 无效 | 0 | | ns |

请参阅图 6-120

| 编号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|----|--|-----|-----|----|
| J7 | $t_d(\text{TCKL-TDOV})$ 最大延迟时间, TCK 低电平到 TDO 有效 | | 12 | ns |

- JTAG 信号拆分到器件上的两个 IO 电源域中。仅当两个 IO 电源域在相同的电压下运行时, 此表中定义的时序参数才适用。在不同的电压下运行两个 IO 电源域时, 这些时序参数的值未定义, 因为当一些器件 IO 缓冲器在 1.8V 电压下运行, 而另一些在 3.3V 电压下运行时, 通过这些 IO 缓冲器的传播延迟会有所不同。这实际上降低了超出此表中所定义的值时序裕度。当两个 IO 电源域在不同电压下运行时, JTAG 接口仍应该能正常工作, 但前提是系统设计人员实施了适当的电平转换器, 并降低了工作频率以适应在不同电压下运行的电平转换器和 IO 缓冲器插入的额外延迟。

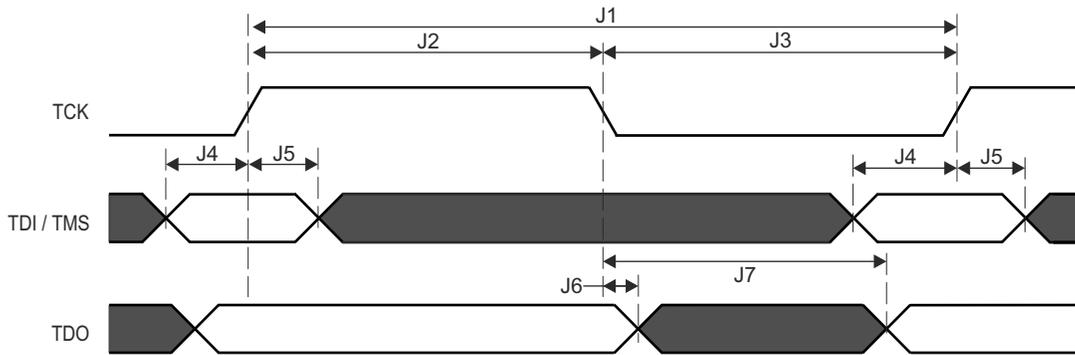


图 6-120. JTAG 时序要求和开关特性

7 详细说明

7.1 概述

AM69、AM69A 处理器系列基于不断发展的 Jacinto 7 架构，面向 ADAS 和自动驾驶车辆 (AV) 应用，基于 TI 十多年领航 ADAS 处理器市场所积累的广泛市场知识而构建。AM69、AM69A 以业界卓越的功耗/性能比为传统和深度学习算法提供高性能计算，并具有很高的系统集成度，从而使集中式 ECU 或独立传感器中支持多种传感器模式的高级汽车平台实现可扩展性和更低的成本。关键内核包括具有标量和矢量内核的下一代 DSP、专用深度学习和传统算法加速器、用于通用计算的最新 Arm 和 GPU 处理器、集成式下一代成像子系统 (ISP)、视频编解码器、以太网集线器以及隔离式 MCU 岛。所有这些都由汽车级安全硬件加速器提供保护。

备注

有关超集器件片上系统 (SoC) 的特性、子系统和架构的更多信息，请参阅器件 TRM。

7.2 功能方框图

图 7-1 是器件的功能方框图。

备注

要了解 TI 软件开发套件 (SDK) 目前支持哪些器件功能，请参阅 [AM69 软件构建表 \(PROCESSOR-SDK-AM69\)](#) 和 [AM69A 软件构建表 \(PROCESSOR-SDK-AM69A\)](#)。

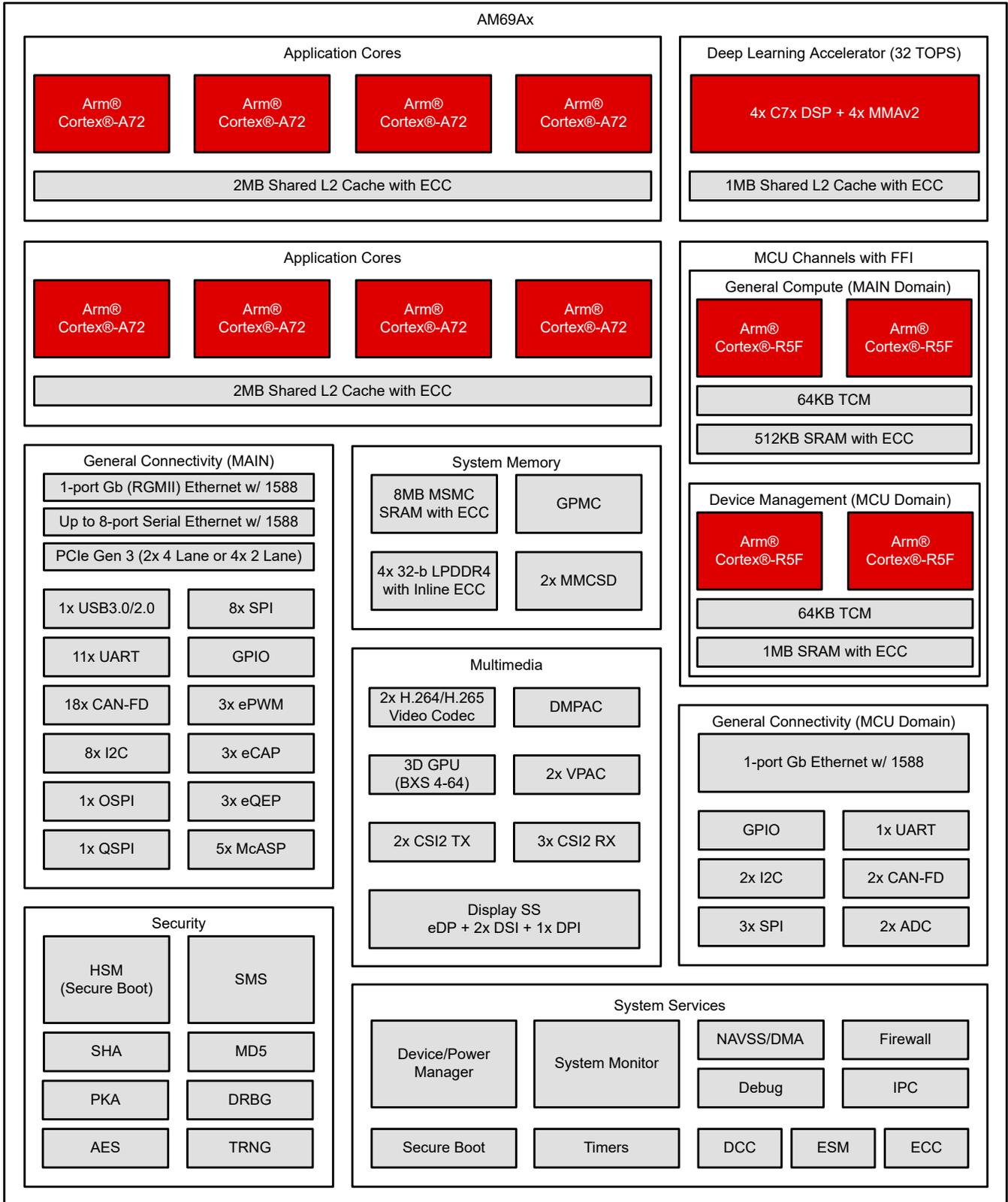


图 7-1. 功能方框图

7.3 处理器子系统

7.3.1 Arm Cortex-A72

该器件实现了一个集成在计算集群内部以及其他模块中的双核 Arm® Cortex®-A72 MPU。Cortex-A72 内核是通用处理器，可用于运行客户应用程序。

A72SS 基于 Arm Cortex-A72 MPCore (A72 集群) 构建，后者由 Arm 提供并由 TI 配置。该处理器基于对称多处理器 (SMP) 架构，因此可提供高性能以及出色的电源管理和调试功能。

A72 处理器是一款多发射乱序超标量执行引擎，具有集成的 L1 指令和数据高速缓存，与 Armv8-A 架构兼容。Armv8-A 架构提供了许多新功能。这些新功能包括 64 位数据处理、扩展虚拟寻址和 64 位通用寄存器。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的 *处理器和加速器* 一章中的 *双 A72 MPU 子系统* 一节。

7.3.2 Arm Cortex-R5F

MCU_ARMSS 是 Arm® Cortex®-R5F 处理器的双核实现，配置为进行分离/锁定操作。它还包括附带的存储器 (L1 高速缓存和紧密耦合存储器)、标准 Arm® CoreSight™ 调试和布线架构、集成式矢量中断管理器 (VIM)、ECC 聚合器以及支持协议转换和地址转换的各种包装器，以便于集成到 SoC。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的 *处理器和加速器* 一章中的 *双 R5F MCU 子系统* 一节。

7.3.3 DSP C71x

TMS320C71x 是下一代定点和浮点 DSP 平台。C71x DSP 是德州仪器 (TI) DSP 系列中的新内核。C71x DSP 支持矢量信号处理，与 C6x DSP 系列相比，能够在执行各种通用信号处理任务时显著提升 DSP 处理能力。此外，C71x 还提供多种专用函数，可将目标功能加快 30 倍以上。除了扩展矢量处理能力外，新型 C71x 内核还集成了高级技术，可提高控制代码效率并简化编程，例如分支预测、受保护的流水线、精确异常和虚拟存储器管理。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的 *处理器和加速器* 一章中的 *C71x DSP 子系统* 一节。

7.4 加速器和协处理器

7.4.1 GPU

图形处理单元 (GPU) 可以加快三维 (3D) 和二维 (2D) 图形和计算应用的速度。

GPU 模块是一种可扩展架构，能够高效地同时处理多种不同的工作负载：

- 3D 图形工作负载，其中涉及顶点数据和像素数据处理以渲染 3D 场景。
- 2D 图形工作负载，其中涉及像素数据处理以渲染 2D 对象。
- 计算应用工作负载，其中涉及通用数据处理。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的 *处理器和加速器* 一章中的 *图形加速器 (GPU)* 一节。

7.4.2 VPAC

视觉预处理加速器 (VPAC) 是一组常见的视觉基元功能，用于执行存储器到存储器 (M2M) 像素数据处理任务，例如：色彩处理和增强、噪声滤波、宽动态范围 (WDR) 处理、镜头失真校正、用于去扭曲的像素重映射、动态缩放生成、动态金字塔生成。VPAC 从主 SoC 处理器 (ARM、DSP 等) 卸载这些常见任务，以便这些 CPU 可用于差异化的高级算法。VPAC 用于通过在时分复用模式下工作来支持多个摄像头。VPAC 可用作视觉处理的前端，执行帧/标度的准备以供 SoC 内的其他视觉加速器或处理器内核进行进一步的处理。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的 *处理器和加速器* 一章中的 *视觉预处理加速器 (VPAC)* 一节。

7.4.3 DMPAC

深度和运动感知加速器 (DMPAC) 是一种高能效的硬件加速器，可根据摄像头输入计算密集立体深度图 (深度) 和密集光流矢量 (运动)。

基于图像/视频传感器的环境感知 (也称为“场景理解”) 是汽车、工业和消费电子领域许多新兴应用的核心。通常情况下，这涉及通过分析一个或多个相关输入视频流，检测场景中的所有物体及其相对于观察者或汽车的 3D 位置和运动。为执行这些任务，需使用各种计算机视觉算法。

从图像中获取 3D 深度的一种非常可靠的方法是在立体环境中使用两个摄像头，这两个摄像头具有已知的相对位置和摄像头参数。通过分析从两个不同的摄像头方位/视角捕获的同一场景的两幅图像，即可找出图像中每个像素位置之间的差异。这称为立体视差图。根据每个像素的视差值，可以通过三角测量算法获取其所属物体/空间的 3D 位置。

另一方面，通过分析单个摄像头在两个不同时间实例 (即视频中的两个时间帧) 捕获的两个图像，可以确定过去帧中的每个像素在未来帧中移动到的位置。这称为光流矢量。每个像素位置的光流矢量可用于获取场景的 3D 结构、识别移动物体并确定其相对运动速度和方向。

DMPAC 专用于上述图像处理任务。立体和光流处理分为两个顶级子块：密集光流 (DOF) 引擎和立体视差引擎 (SDE)。DOF 和 SDE 块共享一个通用的共享本地存储器、DMA、外部消息传递和控制基础结构。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的 *处理器和加速器* 一章中的 *深度和运动感知加速器 (DMPAC)* 一节。

7.5 其他子系统

7.5.1 MSMC

多核共享存储器控制器 (MSMC) 构成计算集群 (COMPUTE_CLUSTER0) 的核心, 可提供与所有连接的处理元件和系统其余部分之间的高带宽资源访问。MSMC 用作计算集群的数据移动主干。

有关更多信息, 请参阅器件 TRM 的 [器件配置](#) 一章中的 [多核共享存储器控制器 \(MSMC\)](#) 一节。

7.5.2 NAVSS

7.5.2.1 NAVSS0

主 SoC 导航器子系统 (NAVSS0) 包含 DMA/队列管理组件: UDMA 和环形加速器 (UDMASS)、外设 (模块子系统 [MODSS])、虚拟化转换 (VirtSS) 和北桥 (NBSS)。

7.5.2.2 MCU_NAVSS

MCU 导航器子系统 (MCU NAVSS) 具有主 NAVSS 模块子集, 并在 MCU 域中实例化。

MCU 导航器子系统包含 DMA/队列管理组件: UDMA 和环形加速器 (UDMASS) 以及外设 (模块子系统 [MODSS])。

有关更多信息, 请参阅器件 TRM 中的 [主导航器子系统 \(NAVSS\)](#) 和 [MCU 导航器子系统 \(MCU NAVSS\)](#) 两节。

7.5.3 PDMA 控制器

外设 DMA 是一种简单的 DMA, 其架构专为满足外设的数据传输需求而设计, 外设使用通过标准非相干总线结构访问的存储器映射寄存器来执行数据传输。PDMA 模块旨在靠近一个或多个需要外部 DMA 进行数据移动的外设, 其架构旨在通过使用 VBUSP 接口并仅支持静态配置的传输请求 (TR) 操作来降低成本。

PDMA 仅负责执行与外设本身交互的数据移动事务。从给定外设读取的数据由 PDMA 源通道打包到 PSI-L 数据流中, 然后将其发送到远程对等 UDMA-P 目标通道, 然后由该通道将数据移动到存储器中。同样, 远程 UDMA-P 源通道从存储器中获取数据, 并通过 PSI-L 将其传输到对等 PDMA 目标通道, 然后由 PSI-L 执行对外设的写入操作。

PDMA 架构特意采用异构结构 (UDMA-P + PDMA), 以适当调整系统中每个点的数据传输复杂性, 以满足传入或传出的任何内容的要求。外设通常基于 FIFO, 不需要超出其 FIFO 尺寸要求的多维传输, 因此 PDMA 传输引擎保持简单, 仅具有几个维度 (通常用于样本大小和 FIFO 深度)、硬编码地址映射和简单的触发功能。

PDMA 内提供多个源通道和目标通道, 允许同时进行多个传输操作。DMA 控制器维护每个通道的状态信息, 并在通道之间采用轮询调度以共享底层 DMA 硬件。

有关更多信息, 请参阅器件 TRM 的 [DMA 控制器](#) 一章中的 [PDMA 控制器](#) 一节。

7.5.4 电源

该器件需要 6 种电源类型和 1 种内部 LDO 连接类型, 请参阅 [电源信号说明](#)

- 数字 IO 电压
- 数字低电压
- 数字 AVS 电压
- 模拟 PHY 和 CLK 电压
- 模拟低电压
- 电子保险丝编程电压
- LDO 大容量滤波电容器

常见的器件电源输入类型可以分组到电源轨中。所有电源轨都必须由专门设计用于支持最严格的电源电压规格和总负载电流需求的电源提供。已定义的两个建议配电网 (PDN) 可以组合或隔离 MCU 域和 Main 域 (请参阅 [电源映射](#))。

在某些系统中可能不需要一些电源输入。在这种情况下，除了 VPP_CORE 和 VPP_MCU 外，所有未使用的电源输入都必须连接到具有适当电压电平的有效电源轨，以确保器件可靠性（请参阅[建议运行条件](#)）。以下示例可供参考：

1. 如果未使用“MCU 岛”安全监测器或“仅 MCU”低功耗处理，则可以将 VDD_MCU 电源与具有兼容工作电压规格的 VDD_CORE 电源组合起来。
2. 如果不需要 UHS-I SD 卡或 USB2.0 接口，则可以将 VDDSHV5（MMC1 接口）和 VDDA_USB_3P3（USB PHY 接口）与 VDD_IO_3V3 数字 IO 电源轨组合起来。
3. 如果使用通用器件类型，则不需要电子保险丝编程电压 VPP_CORE 和 VPP_MCU，而应使其保持未连接状态。

7.5.5 外设

7.5.5.1 ADC

模数转换器 (ADC) 模块包含一个单通道 12 位 ADC。这个 ADC 可以复用为 8 个模拟输入（通道）中的任何一个。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 [模数转换器 \(ADC\)](#) 一节。

7.5.5.2 ATL

HD Radio™ 应用会使用音频跟踪逻辑 (ATL) 使数字音频输出与基带时钟同步。通常情况下，同样的这一 IP 也可用于跟踪两个基准信号之间的误差（例如帧同步），并生成调制时钟输出（使用软件控制的周期窃取），使其平均达到某个所需的频率。此过程可用作异步采样率转换算法的硬件辅助。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 [音频跟踪逻辑 \(ATL\)](#) 一节。

7.5.5.3 CSI

7.5.5.3.1 摄像头流媒体接口接收器 (CSI_RX_IF) 和 MIPI DPHY 接收器 (DPHY_RX)

通过集成 CSI_RX_IF 模块，该器件可以将视频输入从多个摄像头流式传输到图像处理加速器 (VPAC) 或内部存储器。也可以通过发送器 CSI (CSI_TX_IF) 重新发送视频输入以用于调试和测试。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 [摄像头流媒体接口 \(CSI\)](#) 一节。

7.5.5.3.2 摄像头流媒体接口发送器 (CSI_TX_IF)

通过集成 CSI_TX_IF 模块，该器件可从存储器流式传出视频数据，或从 CSI 接收器重新发送视频数据作为可选循环输出以用于诊断、调试和测试。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 [摄像头流媒体接口 \(CSI\)](#) 一节。

7.5.5.4 CPSW2G

双端口千兆位以太网 MAC (MCU_CPSW0) 子系统为器件提供以太网数据包通信，并按类似的方式配置为以太网交换机。MCU_CPSW0 具有简化千兆位媒体独立接口 (RGMII)、简化媒体独立接口 (RMII) 以及用于物理层器件 (PHY) 管理的管理数据输入/输出 (MDIO) 接口。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 [千兆位以太网交换机 \(CPSW0\)](#) 一节。

7.5.5.5 CPSW9G

9 端口千兆位以太网交换机 (CPSW0) 子系统为器件提供以太网数据包通信，并可配置为以太网交换机。CPSW0 具有串行千兆位媒体独立接口 (SGMII)、简化千兆位媒体独立接口 (RGMII)、简化媒体独立接口 (RMII) 以及用于物理层器件 (PHY) 管理的管理数据输入/输出 (MDIO) 接口。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 [千兆位以太网交换机 \(MCU_CPSW0\)](#) 一节。

7.5.5.6 DCC

双时钟比较器 (DCC) 用于确定应用程序执行期间时钟信号的精度。具体而言, DCC 旨在检测相对于预期时钟频率的漂移。可以根据每个应用程序的计算结果对所需精度进行编程。DCC 使用另一个输入时钟作为基准来测量可选时钟源的频率。

有关更多信息, 请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *双时钟比较器 (DCC)* 一节。

7.5.5.7 DDRSS

此器件中的 DDR 子系统包含 DDR 控制器、DDR PHY 和包装器逻辑, 用于将这些块集成到器件中。DDR 子系统被称为 DDRSS0, 用于提供与外部 SDRAM 器件的接口, 这些器件可用于存储程序或数据。DDRSS0 通过 MSMC 访问, 而不是直接通过系统互连访问。

有关更多信息, 请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *DDR 子系统 (DDRSS)* 一节。

7.5.5.8 DSS

DSS 是一个灵活的合成型显示子系统, 支持多个高分辨率显示输出。此系统由一个显示控制器 (DISPC) 和一个帧缓冲器解压缩内核 (FBDC) 组成。DISPC 对于其每个显示输出均支持多层混合和透明度。DISPC 还支持具有缩放功能的回写流水线, 旨在实现存储器到存储器的合成和/或捕获用于以太网视频编码的显示输出。

有关更多信息, 请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *显示子系统 (DSS)* 一节。

7.5.5.8.1 DSI

MIPI DSI v1.3.1 控制器 (DSITX) 采用了 MIPI DSI 1.3 标准所需的流仲裁和低级协议层功能。它在单链路配置中支持最多 4 个 2.5Gbps D-PHY 数据通道, 并按具体用例 (1、2、3 或 4 通道) 处理字节通道映射。附带的 DSI (物理层) D-PHY 模块 (DPHYTX) 采用一个四通道 MIPI D-PHY 发送器来提供视频输出连接功能。

有关更多信息, 请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *显示子系统 (DSS)* 和 *显示外设* 一节。

7.5.5.8.2 eDP

符合 VESA DP1.4/eDP1.4 标准的发送器主机控制器 (EDP) 可以通过 4 通道配套串行器/解串器模块输出多达 4 个视频流 (通过多流传输/MST) 和一个音频流。它提供高达 25.92Gbps 的应用带宽。一个附加的 eDP (物理层) 辅助 PHY (AUXPHY) 模块实现了一个双端接差分对, 从而满足在长 (15m) 电缆上实现 1Mbps 数据速率的需求。

有关更多信息, 请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *显示子系统 (DSS)* 和 *显示外设* 一节。

7.5.5.9 eCAP

增强型捕捉 (ECAP) 模块可用于:

- 音频输入的采样速率测量
- 测量旋转机械的速度 (例如, 通过霍尔传感器感应齿状链轮)
- 位置传感器脉冲之间的持续时间测量
- 脉冲序列信号的周期和占空比测量
- 解码来自占空比编码电流/电压传感器的电流或电压振幅

有关更多信息, 请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *增强型捕获 (ECAP) 模块* 一节。

7.5.5.10 EPWM

有效的 PWM 外设必须能够以最小的 CPU 开销或干预生成复杂的脉冲宽度波形。该外设需要高度可编程且非常灵活, 同时易于理解和使用。此处介绍的 EPWM 单元通过在每个 PWM 通道的基础上分配所有需要的计时和控制资源来满足这些要求。避免了交叉耦合或资源共享; 相反, EPWM 由具有独立资源的较小单通道模块构建而成, 并且可以根据需要一起运行以形成系统。该模块化方法形成了正交架构, 并提供了更透明的外设结构视图, 帮助用户快速了解其运行原理。

在进一步的说明中, 信号或模块名称中的字母 x 用于指示器件上的通用 EPWM 实例。例如, 输出信号 EPWMxA 和 EPWMxB 指来自 EPWM_x 实例的输出信号。因此, EPWM1A 和 EPWM1B 属于 EPWM1, EPWM2A 和 EPWM2B 属于 EPWM2, 依此类推。

此外，EPWM 集成允许将该同步方案扩展至捕获外设模块 (ECAP)。模块的数量取决于器件并基于目标应用需求。模块也可以独立运行。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *增强型脉宽调制 (EPWM) 模块* 一节。

7.5.5.11 ELM

错误定位模块 (ELM) 与 GPMC 一起使用。读取 NAND 闪存页面时动态生成并存储在 GPMC 寄存器中的伴随多项式被传递到 ELM。然后，主机处理器可以通过翻转 ELM 错误位置输出指向的位来纠正数据块。

从 NAND 闪存读取数据时，需要进行一定程度的纠错。对于没有内部校正功能的 NAND 模块 (有时称为裸 NAND)，校正过程由存储器控制器执行。ELM 还可用于支持并行 NOR 闪存或 NAND 闪存。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *错误定位模块 (ELM)* 一节。

7.5.5.12 ESM

错误信令模块 (ESM) 将整个器件中的安全相关事件和/或错误聚合到一个位置。它可以向处理器发出低优先级和高优先级中断信号，以处理安全事件和/或操纵 I/O 错误引脚，向外部硬件发出已发生错误的信号。因此，外部控制器能够使器件复位或使系统保持在安全、已知的状态。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *错误信令模块 (ESM)* 一节。

7.5.5.13 eQEP

增强型正交编码器脉冲 (EQEP) 外设用于与线性或旋转增量编码器进行直接连接，以便获取高性能运动和位置控制系统中使用的旋转机器的位置、方向和速度信息。增量编码器的盘上刻有单轨槽图案。这些槽形成暗线和亮线交替的图案。盘计数定义为每转出现的暗线/亮线对的数量 (每转线数)。通常，添加第二个轨道，每转一次生成一个信号 (索引信号: QEPI)，可用于指示绝对位置。编码器制造商使用不同的术语 (例如索引、标记、初始位置和零基准) 来标识索引脉冲。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块* 一节。

7.5.5.14 GPIO

通用输入/输出 (GPIO) 外设提供专用的通用引脚，可以配置为输入或输出。当配置为输出时，用户可以对内部寄存器进行写入来控制输出引脚上驱动的状态。当配置为输入时，用户可以通过读取内部寄存器的状态来获取输入的状态。

此外，GPIO 外设可以在不同的中断/事件生成模式下产生主机 CPU 中断和 DMA 同步事件。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *通用接口 (GPIO)* 一节。

7.5.5.15 GPMC

通用存储器控制器是一个统一的存储器控制器，专用于与外部存储器器件连接，例如：

- 类似 SRAM 的异步存储器和应用特定集成电路 (ASIC) 器件
- 异步、同步和页面模式 (仅在非多路复用模式下可用) 突发 NOR 闪存器件
- NAND 闪存
- 伪 SRAM 器件

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *通用存储器控制器 (GPMC)* 一节。

7.5.5.16 Hyperbus

Hyperbus 模块是器件闪存子系统 (FSS) 的一部分。

Hyperbus 模块是一种引脚数较少的存储器接口，可提供较高的读取/写入性能。Hyperbus 模块连接至 hyperbus 存储器 (HyperFlash 或 HyperRAM)，并使用简单的 hyperbus 协议执行读取和写入事务。

该器件中有一个 Hyperbus™ 模块。Hyperbus 模块包括一个 Hyperbus 存储器控制器 (HBMC)。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *Hyperbus 接口* 一节。

7.5.5.17 I2C

该器件包含 10 个多主内部集成电路 (I2C) 控制器，每个控制器都在 Arm 或数字信号处理器 (DSP) 等本地主机 (LH) 和通过 I2C 串行总线连接的任何 I2C 总线兼容型器件之间提供一个接口。连接到 I2C 总线的外部元件可以通过 2 线 I2C 接口以串行方式向 LH 设备发送和从其接收高达 8 位的数据。

每个多主 I2C 模块均可配置为处理器或控制器 I2C 兼容型器件。

WKUP_I2C0、MCU_I2C0、I2C0 和 I2C1 控制器具有专用的 I2C 兼容型开漏缓冲器，并支持高速模式 (在 1.8V 模式下高达 3.4Mbps，在 3.3V 模式下高达 400kbps)。MCU_I2C1、I2C2、I2C3、I2C4、I2C5 和 I2C6 控制器与标准 LVCMOS I/O 进行多路复用，连接后对开漏进行仿真，并支持快速模式 (在 1.8V/3.3V 模式下高达 400kbps)。通过将 LVCMOS 缓冲器配置为输出高阻态，而不是在发送逻辑 1 时驱动为高电平，可实现 I2C 仿真。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *内部集成电路 (I2C)* 一节。

7.5.5.18 I3C

该器件包含三个改进型内部集成电路 (I3C) 控制器，每个控制器都在 Arm 等本地主机 (LH) 和通过 I3C 串行总线连接的任何 I3C 总线兼容型器件之间提供一个接口。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *改进型内部集成电路 (I3C) 接口* 一节。

7.5.5.19 MCAN

控制器局域网 (CAN) 是一种串行通信协议，用于有效地为分布式实时控制提供支持。CAN 具有较高的抗电气干扰能力。在 CAN 网络中，许多较短的信息会广播到整个网络，从而在系统的每个节点中提供数据一致性。

MCAN 模块支持传统 CAN 和 CAN FD (具有灵活数据速率的 CAN) 规范。CAN FD 特性可实现高吞吐量和增加每个数据帧的有效负载。传统 CAN 和 CAN FD 器件可以在同一网络中共存，不会发生任何冲突。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *模块化控制器局域网 (MCAN)* 一节。

7.5.5.20 MCASP

MCASP 作为通用音频串行端口的功能针对各种音频应用的要求进行了优化。MCASP 模块可以在发送和接收模式下运行。MCASP 对于时分多路复用 (TDM) 流、IC 间音频 (I2S) 协议接收和发送以及元件间数字音频接口传输 (DIT) 非常有用。MCASP 可以灵活地无缝连接到 Sony/Philips 数字接口 (S/PDIF) 传输物理层元件。

尽管 MCASP 模块本身不支持元件间数字音频接口接收 (DIR) 模式 (即 S/PDIF 流接收)，但 MCASP 接收器的特定 TDM 模式实现允许轻松连接到外部 DIR 元件 (例如，S/PDIF 到 I2S 格式转换器)。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *多通道音频串行端口 (MCASP)* 一节。

7.5.5.21 MCRC 控制器

VBUSM CRC 控制器是一个用于执行 CRC (循环冗余校验) 以验证存储系统完整性的模块。当存储器中的内容被读入 MCRC 控制器时，一个信号代表得到了内存内容。MCRC 控制器的职责是为一组数据计算签名，然后将计算出的签名值与预先确定的良好签名值进行比较。MCRC 控制器提供四个通道对多个存储器并行执行 CRC 计算，并且可以在任何存储器系统上使用。通道 1 也可置于数据跟踪模式，在此模式中，MCRC 控制器压缩通过 CPU 读取数据总线读取的数据。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的 *处理器间通信* 一章中的 *MCRC 控制器* 一节。

7.5.5.22 MCSPI

MCSPI 模块是多通道发送/接收、控制器/处理器同步串行总线。

该器件中共有十一个 MCSPI 模块。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *多通道串行外设接口 (MCSPI)* 一节。

7.5.5.23 MMC/SD

MMCSDB 主机控制器提供用于连接 eMMC 5.1 (嵌入式多媒体卡)、SD 4.10 (安全数字) 和 SDIO 4.0 (安全数字 IO) 器件的接口。MMCSDB 主机控制器在传输级别处理 MMC/SD/SDIO 协议、数据打包、添加循环冗余校验 (CRC)、开始/结束位插入以及语法正确性检查。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *多媒体卡/安全数字 (MMC/SD) 接口* 一节。

7.5.5.24 OSPI

八路串行外设接口 (OSPI) 模块是一种串行外设接口 (SPI) 模块，允许对外部闪存器件进行单路、双路、四路或八路读取和写入访问。该模块具有存储器映射寄存器接口，可提供直接存储器接口用于从外部闪存器件访问数据，从而简化软件要求。

OSPI 模块用于以存储器映射直接模式 (例如处理器希望直接从外部闪存执行代码) 传输数据或以间接模式传输数据，其中模块设置为静默执行某些请求的操作，通过中断或状态寄存器发出完成信号。对于间接操作，数据通过内部 SRAM 在系统存储器和外部闪存之间传输，器件控制器以低延迟系统速度加载该内部 SRAM 以进行写入，卸载以进行读取。中断或状态寄存器用于识别应使用用户可编程配置寄存器访问该 SRAM 的特定时间。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *八路串行外设接口 (OSPI)* 一节。

7.5.5.25 PCIe

外围组件快速互连 (PCIe) 子系统围绕多通道双模 PCIe 控制器构建而成，可为背板和印刷线路板上的串行链路提供低引脚数、高可靠性和每通道高达 8.0Gbps 的高速数据传输速率。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *外设组件快速互连 (PCIe) 子系统* 一节。

7.5.5.26 串行器/解串器

串行器/解串器的目标是将器件 (SoC) 并行数据转换为可通过高速电气接口输出的串行数据。在相反的方向上，串行器/解串器将高速串行数据转换为可由器件处理的并行数据。为此，串行器/解串器包含各种功能块来处理外部模拟接口以及内部数字逻辑。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *串行器/解串器 (SerDes)* 一节。

7.5.5.27 WWDT

窗口化看门狗计时器为操作系统和基准代码提供计时器功能。该模块包含几个计数器，这些计数器定义了操作系统内进行调度时所需的时基。该模块与 RTI 模块一起实施，但仅支持 WWDT。

此模块专为满足 OSEK (“Offene Systeme und deren Schnittstellen für die Elektronik im Kraftfahrzeug” ，即 “汽车电子类开放系统和对应接口”) 以及符合 OSEK/Time 标准的操作系统的要求而设计。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *实时中断 (RTI) 模块* 一节。

7.5.5.28 计时器

所有计时器均包含特定功能，可为操作系统生成精确的节拍中断。

每个计时器均可根据多个不同的独立时钟进行计时。时钟源的选择在 MCU_CTRL_MMR0/CTRL_MMR0 的寄存器中进行。

在 MCU 域中，器件提供 10 个计时器引脚用作 MCU 计时器捕捉输入或 MCU 计时器 PWM 输出。为了提供最大的灵活性，这 10 个引脚可以用于 MCU_TIMER0 至 MCU_TIMER9 的任意实例。系统级多路复用器用于控制每个 MCU_TIMER[9-0] 输出的捕捉源引脚和每个 MCU_TIMER_IO[1-0] PWM 输出的 MCU_TIMER[9-0] 源。

在 MAIN 域中，器件提供 8 个计时器引脚用作计时器捕捉输入或计时器 PWM 输出。为实现最大灵活性，这 8 个引脚可以用于 TIMER0 至 TIMER19 的任意实例。系统级多路复用器用于控制每个 TIMER[19-0] 的捕捉源引脚和每个 TIMER_IO[7-0] PWM 输出的 TIMER[19-0] 源。

可以选择将每个域中的每个奇数计时器实例与同一域中之前的偶数计时器实例进行级联，从而形成一个 64 位计时器。例如，TIMER1 可以级联到 TIMER0，MCU_TIMER1 可以级联到 MCU_TIMER0，以此类推。

级联后，TIMER_i 充当 TIMER_{i+1} 的 32 位预分频器，MCU_TIMER_n 也充当 MCU_TIMER_{n+1} 的 32 位预分频器。必须配置 TIMER_i/MCU_TIMER_n 以所需速率生成 PWM 输出边沿，从而使 TIMER_{i+1}/MCU_TIMER_{n+1} 计数器递增。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *计时器* 一节。

7.5.5.29 UART

UART 是一种利用 DMA 通过主机 CPU 进行数据传输或中断轮询的处理器外设。该器件中共有十二个 UART 模块。当使用 48MHz 功能时钟时，所有 UART 模块都支持 IrDA 和 CIR 模式。每个 UART 均可用于配置和与多个外部外围器件的数据交换或器件之间的处理器间通信。

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *通用同步/异步接收器/发送器 (UART)* 一节。

7.5.5.30 USB

与早期版本的 USB 总线类似，USB 3.0 为通用电缆总线，支持主机设备与多种可同时访问的外设之间的数据交换。

该器件支持两个相同的 USB 子系统：

- USB3SS0 是具有片上 SS (USB3.0) PHY 和 HS/FS/LS (1) (USB2.0) PHY 的 SuperSpeed (SS) USB 3.0 双角色设备 (DRD) 子系统
- USB3SS1 是具有片上 SS (USB3.0) PHY 和 HS/FS/LS (USB2.0) PHY 的 SuperSpeed (SS) USB 3.0 双角色设备 (DRD) 子系统

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *通用串行总线 (USB) 子系统* 一节。

7.5.5.31 UFS

通用闪存存储 (UFS) 接口是基于标准的串行接口引擎。

该器件中有一个 UFS 模块：UFS0。此 UFS 模块包含一个带有集成 M-PHY 的 UFS 2.1 主机控制器 (HC)。

此 UFS 模块符合表 7-1 中列出的标准。

表 7-1. UFS 标准

| 文档 | 版本 | 说明 |
|------------|---------------------|----------------------------------|
| JESD220-1A | v1.1 | 通用闪存存储 (UFS) 统一存储器扩展 |
| JESD220-2 | v1.0 | 通用闪存存储 (UFS) 卡扩展 |
| JESD220C | v2.1, 2016 年 3 月 | 通用闪存存储 (UFS) |
| JESD223-1B | v1.1A | 通用闪存存储主机控制器接口 (UFSHCI) 统一存储器扩展 |
| JESD223C | v2.1, 2016 年 3 月 | 通用闪存存储主机控制器接口 (UFSHCI) |
| JESD224 | 2013 年 3 月 | 通用闪存存储 (UFS) 测试 |
| | 2001 年 11 月 | 联邦信息处理标准 (FIPS) 197 高级加密标准 (AES) |
| | v3.1, 2014 年 | MIPI® 联盟 M-PHY 规范 |
| | v1.60, 2013 年 | MIPI 联盟统一协议 (UniProSM) 规范 |
| | 修订版 24, 2010 年 8 月 | 小型计算机系统接口 (SCSI) 块命令 - 3 |
| | 修订版 27, 2010 年 10 月 | SCSI 主命令 - 4 |

有关更多信息，请参阅器件 TRM 的外设一章中的 *通用闪存存储 (UFS) 接口* 一节。

8 应用、实施和布局

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规格，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定各元件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计是否能够实现，以确保系统功能。

9 器件连接和布局基本准则

9.1 电源去耦和大容量电容

9.1.1 配电网络实施指南

使用 [TPS6594133A-Q1 PMIC](#) 和双通道 [HCPS](#) 转换器为 [Jacinto™ J7 SoC](#) 系列器件供电并隔离电源组用户指南为配电网络的成功实施提供指导。这包括 [PCB 叠层](#) 指导以及优化去耦电容器的选择和放置的指导。TI 仅支持遵循此应用报告中所包含的电路板设计指南的设计。

9.2 外部振荡器

有关外部振荡器的更多信息，请参阅[时钟规格](#)。

9.3 JTAG 和 EMU

德州仪器 (TI) 支持各种扩展开发系统 (XDS) JTAG 控制器，除了 JTAG 支持之外，还提供各种调试功能。[XDS 目标连接指南](#)中提供了有关此信息的摘要。

更多有关 EMU 布线的建议，请参阅[仿真和跟踪接头技术参考手册](#)。

9.4 复位

该器件包括四个外部复位引脚 (MCU_PORz、MCU_RESEZ、PORz 和 RESET_REQz) 和两个复位状态引脚 (MCU_RESESTATz 和 RESESTATz)。这些引脚可由外部电源正常电路或电源管理 IC (PMIC) 驱动。在整个上电阶段，MCU_PORz 和 Main PORz 引脚应保持低电平有效，直到所有电源以及 HFOSC0 时钟达到稳定状态。

所有 MCU 域复位充当整个器件的控制器复位，而 Main 域复位仅复位 Main 域 (MCU 域的复位与所有 Main 域复位隔离)。

9.5 未使用的引脚

有关未使用的引脚的更多信息，请参阅[引脚连接要求](#)。

9.6 Jacinto™ 7 器件硬件设计指南

“[Jacinto™ 7 器件硬件设计指南](#)”文档说明了 [Jacinto™ 7](#) 系列处理器的硬件系统设计注意事项。此设计指南旨在为应用硬件开发提供帮助。

10 外设和接口的相关设计信息

10.1 LPDDR4 电路板设计和布局布线指南

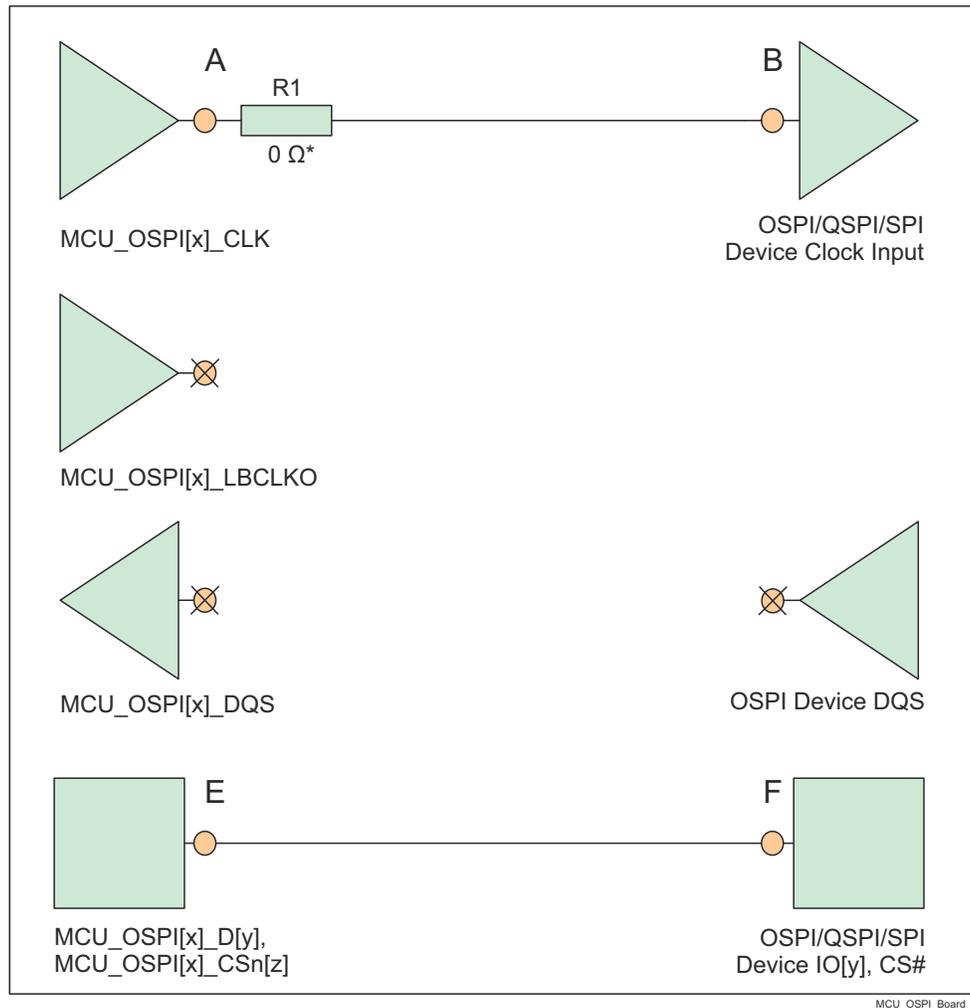
[Jacinto 7 DDR 电路板设计和布局布线指南](#) 旨在为所有设计人员简化 LPDDR4 系统的实现，并将要求提炼为一组布局 and 布线规则，使设计人员能够针对 TI 支持的拓扑成功实施稳健的设计。TI 仅支持遵循本文档中的指南并使用 LPDDR4 存储器的电路板设计。

10.2 OSPI 和 QSPI 电路板设计和布局指南

以下各节详细介绍了在进行 OSPI 和 QSPI 接口布线时必须遵守的布线指南。

10.2.1 无环回和内部焊盘环回

- MCU_OSPI[x]_CLK 输出信号必须连接到闪存器件的 CLK 输引脚
- 从 MCU_OSPI[x]_CLK 信号到闪存器件的信号传播延迟必须 < 450ps (带状线约为 7cm，微带线约为 8cm)
- 建议将 50Ω PCB 布线与串联端接一起使用，如图 10-1 所示
- 传播延迟和匹配：
 - A 到 B < 450ps
 - 匹配偏斜：< 60ps



* 尽可能靠近 MCU_OSPI[x]_CLK 引脚的 0Ω 电阻器 (R1) 是用于微调 (如果需要) 的占位元件。

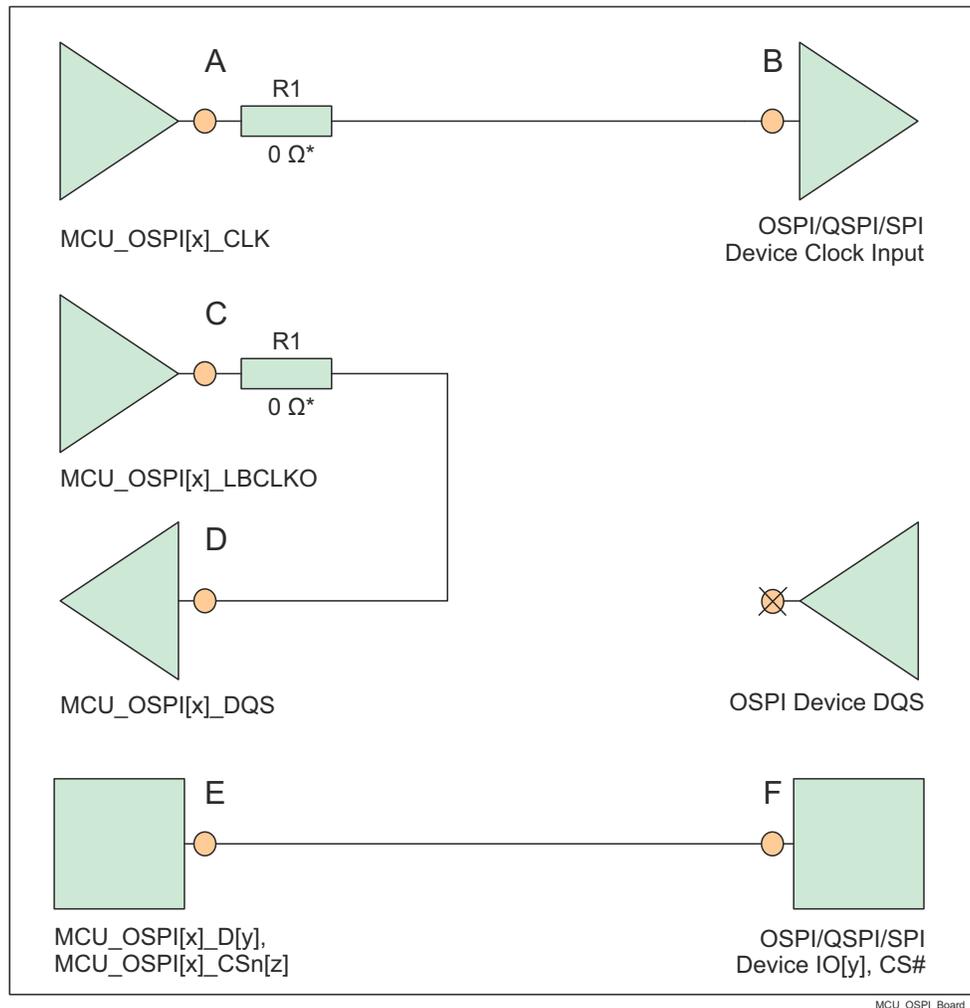
图 10-1. OSPI 接口概要原理图

10.2.2 外部电路板环回

- MCU_OSPI[x]_CLK 输出信号必须连接到闪存器件的 CLK 输入脚
- MCU_OSPI[x]_LBCLKO 输出信号必须环回到 MCU_OSPI[x]_DQS 输入
- 从 MCU_OSPI[x]_CLK 引脚到闪存器件 CLK 输入引脚 (A 到 B) 的信号传播延迟应约等于从 MCU_OSPI[x]_LBCLKO 引脚到 MCU_OSPI[x]_DQS 引脚的信号传播延迟的一半, 即 (C 到 D) / 2。请参阅以下注意事项
- 从 MCU_OSPI[x]_CLK 引脚到闪存器件 CLK 输入引脚 (A 到 B) 的信号传播延迟必须约等于闪存器件和 SoC 器件 (E 到 F 或 F 到 E) 之间控制和数据信号的信号传播延迟
- 建议将 50 Ω PCB 布线与串联端接一起使用, 如图 10-2 所示
- 传播延迟和匹配:
 - A 到 B = E 到 F = (C 到 D) / 2
 - 匹配偏移: < 60ps

备注

OSPI 电路板环回保持时间要求 (在 OSPI 中进行了介绍) 大于典型闪存器件提供的保持时间。因此, 可以缩短 MCU_OSPI[x]_LBCLKO 引脚到 MCU_OSPI[x]_DQS 引脚 (C 到 D) 的长度以进行补偿。

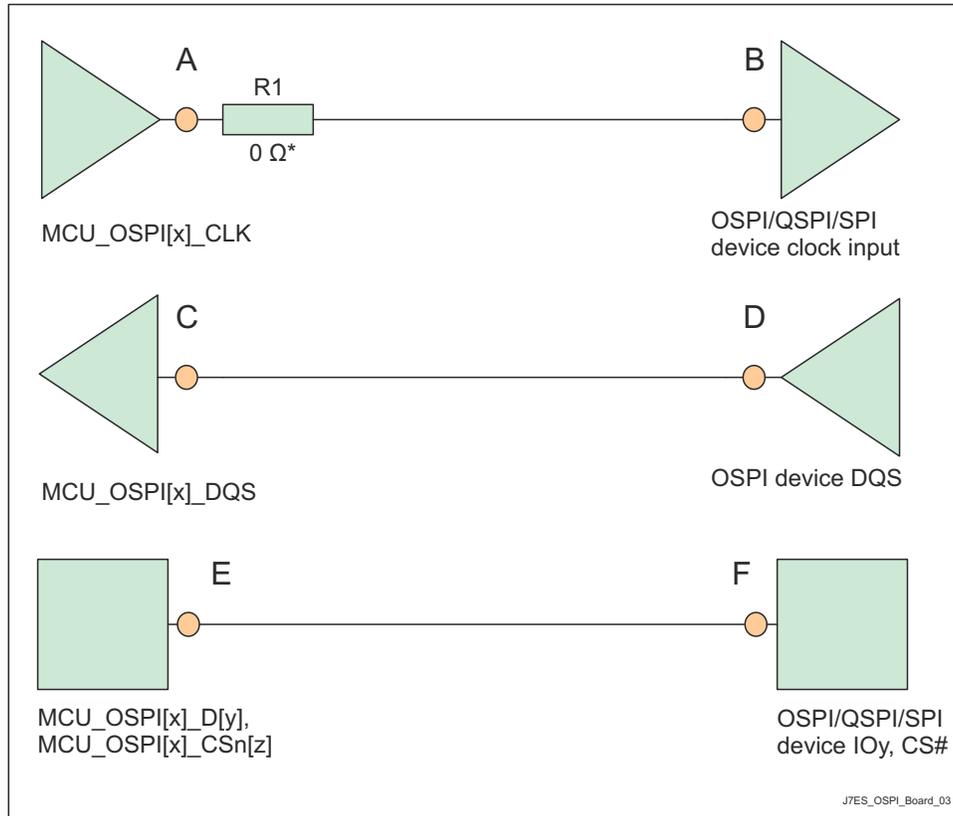


* 尽可能靠近 MCU_OSPI[x]_CLK 和 MCU_OSPI[x]_LBCLKO 引脚的 0 Ω 电阻器 (R1) 是用于微调 (如果需要) 的占位元件。

图 10-2. OSPI 接口概要原理图

10.2.3 DQS (仅适用于八路闪存器件)

- MCU_OSPI[x]_CLK 输出信号必须连接到闪存器件的 CLK 输入脚
- 闪存器件的 DQS 引脚必须连接到 MCU_OSPI[x]_DQS 信号
- 从 MCU_OSPI[x]_CLK 引脚到闪存器件 CLK 输入引脚 (A 到 B) 的信号传播延迟应约等于从 MCU_OSPI[x]_DQS 引脚到 DQS 输出引脚 (C 到 D) 的信号传播延迟
- 建议将 50 Ω PCB 布线与串联端接一起使用, 如图 10-3 所示
- 传播延迟和匹配:
 - A 到 B = C 到 D
 - 匹配偏斜: < 60ps



* 尽可能靠近 MCU_OSPI[x]_CLK 引脚的 0 Ω 电阻器 (R1) 是用于微调 (如果需要) 的占位元件。

图 10-3. OSPI 接口概要原理图

10.3 USB VBUS 设计指南

USB 3.1 规范允许 VBUS 电压在正常运行时高达 5.5V, 在支持“电力输送”附录时高达 20V。一些汽车应用要求最大电压为 30V。

该器件要求使用外部电阻分压器按比例缩小 VBUS 信号电压 (如图 10-4 所示), 这限制了施加到实际器件引脚 (USB0_VBUS) 的电压。这些外部电阻器的容差应等于或小于 1%, 齐纳二极管在 5V 时的漏电流应小于 100nA。⁽¹⁾

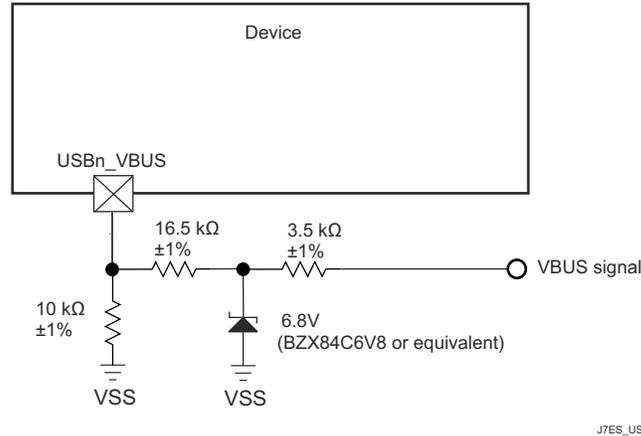


图 10-4. USB VBUS 检测分压器/钳位电路

USB0_VBUS 引脚可被视为失效防护引脚，因为在器件断电时施加 VBUS 的情况下，图 10-4 中的外部电路会限制实际器件引脚的输入电流。

10.4 使用 VMON/POK 的系统电源监测设计指南

VMON1_ER_VSYS 引脚提供了一种监测系统电源的方法。该系统电源通常是用于整个系统的单个预稳压电源。监测该电源的方法是将该电源供电的外部分压器电路的输出电压与内部电压基准进行比较，当施加到 VMON1_ER_VSYS 的电压降至内部基准电压以下时，将触发电源故障事件。在选择用于实现外部电阻分压器电路的元件值时，系统设计人员可确定实际系统电源电压跳闸点。在设计电阻分压器电路时，必须了解导致系统电源监测跳闸点可变性的各种因素，这一点很重要。首先要考虑的是 VMON1_ER_VSYS 输入阈值的初始精度，其标称值为 0.45V，变化为 $\pm 3\%$ 。建议使用具有相似热系数的精度为 1% 的电阻器来实现电阻分压器。这可更大程度地减小电阻值容差导致的可变性。还必须考虑与 VMON1_ER_VSYS 相关的输入漏电流，因为任何流入引脚的电流都会在分压器输出上产生负载误差。当施加 0.45V 电压时，VMON1_ER_VSYS 输入漏电流范围可能为 10nA 至 2.5 μ A。

备注

电阻分压器的设计应确保在正常运行条件下，其输出电压绝不超过[建议运行条件](#)中定义的最大值。

图 10-5 给出了一个示例，其中系统电源的标称电压为 5V，最大触发阈值为 5V - 10% 或 4.5V。

对于此示例，必须在选择电阻值时了解哪些变量会影响最大触发阈值，这一点很重要。显然，在尝试设计一个在系统电源下降 10% 之前不会跳闸的分压器时，需要考虑 VMON1_ER_VSYS 输入阈值为 0.45V + 3% 的器件。还需要考虑电阻器容差和输入漏电流的影响，但这些因素对最大触发点的影响可能并不明显。在选择会产生最大触发电压的元件值时，系统设计人员必须考虑以下情况：R1 的值为 1% 低、R2 的值为 1% 高，再加上 VMON1_ER_VSYS 引脚的输入漏电流为 2.5 μ A。当实现 R1 = 4.81k Ω 且 R2 = 40.2k Ω 的电阻分压器时，结果是最大触发阈值为 4.523V。

一旦选择了满足上述最大触发电压的元件值，系统设计人员就可以通过计算施加的电压来确定最小触发电压，该电压可在 R1 的值为 1% 高、R2 的值为 1% 低且输入漏电流为 10nA 或零时产生 0.45V - 3% 的输出电压。使用零输入漏电流和上面给出的电阻器值，结果为最小触发阈值 4.008V。

该示例演示了一个范围为 4.008V 至 4.523V 的系统电源电压跳闸点。当 VMON1_ER_VSYS 输入漏电流为 2.5 μ A 时，该范围中约 250mV 是通过 $\pm 3\%$ 的 VMON1_ER_VSYS 输入阈值精度引入的，约 150mV 是通过 $\pm 1\%$ 的电阻容差引入的，约 100mV 是通过负载误差引入的。

当系统电源为 4.5V 时，该示例中选择的电阻值会通过电阻分压器产生大约 100 μ A 的偏置电流。通过将流经电阻分压器的偏置电流增大至大约 1mA，可将上述 100mV 的负载误差降低至大约 10mV。因此，系统设计人员在选择元件值时需要考虑电阻分压器偏置电流与负载误差之间的关系。

由于 VMON1_ER_VSYS 具有极小的迟滞和对瞬态的高带宽响应，系统设计人员还应考虑在分压器输出端实现噪声滤波器。这可通过在 R1 上安装一个电容器来实现，如图 10-5 所示。然而，系统设计人员必须根据系统电源噪声和对瞬态事件的预期响应来确定此滤波器的响应时间。

图 10-5 给出了一个示例，其中系统电源的标称电压为 5V，所需的触发阈值为 -10% 或 4.5V。

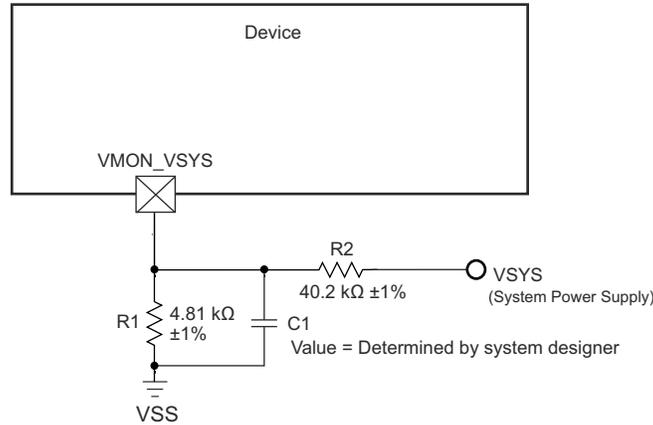


图 10-5. 系统电源监测分压器电路

VMON2_IR_VCPU 引脚提供了一种监测 VDD_CPU 电源的方法。TI 建议在外部将 VMON2_IR_VCPU 引脚连接到尽可能靠近电路板上 VDD_CPU 引脚的位置。具有 VMON6_IR_VEXT0P8 的 SoC 可以选择监测其他域，例如 VDD_CORE 或 VDD_MCU。同样，这些信号应尽可能靠近电路板上的 VDD_CORE 或 VDD_MCU 引脚。

VMON3_IR_VEXT1P8 和 VMON4_IR_VEXT1P8 引脚提供了一种监测外部 1.8V 电源的方法。VMON5_IR_VEXT3P3 引脚提供了一种监测外部 3.3V 电源的方法。SoC 内部实施了一个具有软件控制功能的内部电阻分压器。软件可以对这个内部电阻分压器进行编程，以创建适当的欠压和过压中断。这些引脚不应由外部电阻分压器供电。如果监测的电压需要调整，请务必在连接到监测引脚之前缓冲分压电压。

10.5 高速差分信号布线指南

高速接口布局布线指南提供了如何为高速差分信号成功布线的指导。其中包括 PCB 堆叠和材料指导以及布线偏移、长度和间距限制。TI 仅支持遵循此应用报告中所包含的电路板设计指南的设计。

10.6 散热解决方案指导

DSP 和 ARM 应用处理器热设计指南为包含此器件的系统设计提供了如何成功实施散热解决方案的指导。本文档提供了与散热解决方案相关的常见术语和方法的背景信息。TI 仅支持遵循此应用报告中所包含的系统设计指南的设计。

11 器件和文档支持

TI 提供大量的开发工具。下面列出了用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案的工具和软件。

11.1 器件命名规则

为了指明产品开发周期所处的阶段，TI 为所有微处理器 (MPU) 和支持工具的器件型号分配了前缀。每个器件都具有以下三个前缀中的其中一个：X、P 或 null (无前缀) (例如，AM69A98ATGGHAALYR)。德州仪器 (TI) 为其支持工具推荐使用三种可能的前缀指示符中的两个：TMDX 和 TMDS。这些前缀代表了产品开发的发展阶段，即从工程原型 (TMDX) 直到完全合格的生产器件和工具 (TMDS)。

器件开发进化流程：

X 试验器件不一定代表最终器件的电气规格，并且可能不使用生产封装流程。

P 原型器件不一定是最终的器件芯片，并且不一定符合最终电气规格。

无 完全合格的器件芯片量产版本。

支持工具开发演变流程：

TMDX 还未经德州仪器 (TI) 完整内部质量测试的开发支持产品。

TMDS 完全合格的开发支持产品。

X 和 P 器件和 TMDX 开发支持工具在供货时附带如下免责条款：

“开发中的产品用于内部评估用途。”

生产器件和 TMDS 开发支持工具已进行完全特性描述，并且器件的质量和可靠性已经完全论证。TI 的标准保修证书对该器件适用。

预测显示原型器件 (X 或者 P) 的故障率大于标准生产器件。由于这些器件的预期最终使用故障率仍未确定，故德州仪器 (TI) 建议请勿将这些器件用于任何生产系统。请仅使用合格的生产器件。

如需 ALY 封装类型的 AM69、AM69A 器件的可订购器件型号，请参阅本文档的“封装选项附录”、访问 TI 网站 (ti.com) 或联系您的 TI 销售代表。

11.1.1 标准封装编号法

备注

某些器件的器件封装顶部的表面可能有一个圆形标识，该标识是生产测试过程中产生的。此外，一些器件的封装基板颜色也可能因基板制造商的原因而有所不同。这些差异只在表面显示，不会影响可靠性。

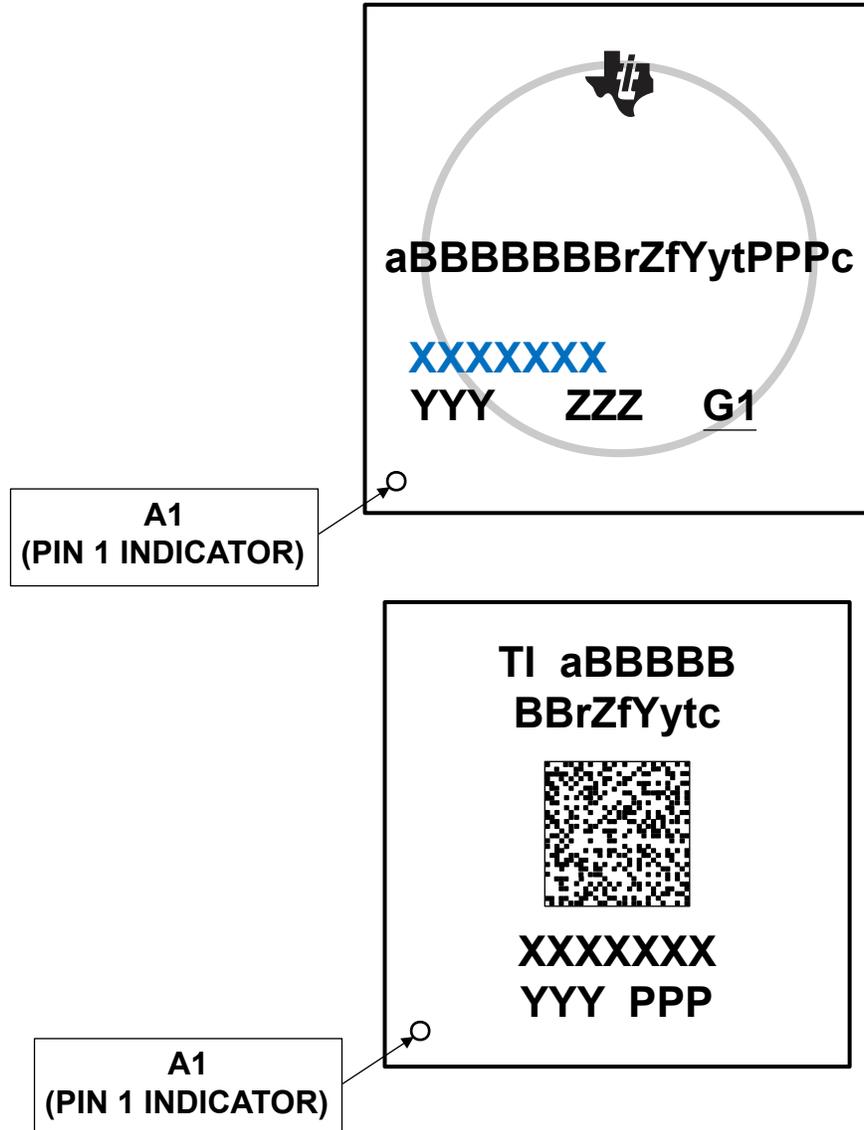


图 11-1. 印刷器件参考

11.1.2 器件命名约定

备注

符号或器件型号中的空白将折叠显示，以防字符间存在间隙。

表 11-1. 命名规则说明

| 字段参数 | 字段说明 | 值 | 说明 |
|---|------------------------------------|-------------------|---|
| a | 器件演变阶段 | X | 原型 |
| | | P | 预量产 (生产测试流程, 无可靠性数据) |
| | | 空白 ⁽¹⁾ | 量产 |
| BBBBBBB | 基本生产器件型号 | AM69A98 | 请参阅 器件比较 |
| | | AM69A78 | |
| | | AM6958 | |
| r | 器件修订版本 | A | SR1.0 |
| Z | 器件速度等级 | T | 请参阅 速度等级最大频率 。 |
| | | 其他 | 其他速度等级 |
| f | 特性 (请参阅 器件比较) | G | 基本, 无额外特性 |
| Y | 功能安全 ⁽³⁾ | G | 非功能安全 |
| y | 安全性 | G | 非安全 |
| | | 其他 | 安全 |
| t | 温度 ⁽²⁾ | A | - 40°C 至 105°C - 扩展工业级 (请参阅 建议运行条件) |
| | | H | 0°C 至 95°C - 商用 (请参阅 建议运行条件) |
| | | I | - 40°C 至 125°C - 汽车 (请参阅 建议运行条件) |
| PPP | 封装符号 | ALY | ALY FCBGA-N1414 (31mm x 31mm) 封装 (量产数据) |
| c | 包装符号 | 空白 | 托盘 |
| | | R | 卷带包装 |
| Q1 | 汽车符号 | Q1 | 通过汽车认证 (Q100) |
| | | 空白 ⁽¹⁾ | 标准 |
|  | 2D 条形码 | 不确定 | 可选 2D 条形码, 提供其他器件信息 |
| | | 空白 | |
| XXXXXXX | | | 批次追踪代码 (LTC) |
| YYY | | | 生产代码; 仅供 TI 使用 |
| ZZZ | | | 生产代码; 仅供 TI 使用 |
| O | | | 引脚 1 符号 |
| G1 | | | ECAT - 环保封装符号 |

(1) 符号或器件型号中的空白将折叠显示，以防字符间存在间隙。

(2) 适用于器件最高结温。

(3) 此器件系列不支持功能安全，如果对此特性感兴趣，请参阅 [TDA4VH 器件系列](#)。

11.2 工具与软件

以下产品支持面向 AM69、AM69A 平台的开发工作：

开发工具

Code Composer Studio™ 集成开发环境 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) 是支持 TI 微控制器和嵌入式处理器产品系列的开发环境。Code Composer Studio 包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。它包含了用于优化的 C/C++ 编译器、源代码编辑器、工程编译环境、调试器、分析工具以及多种其他功能。直观的 IDE 提供了一个单一用户界面，可帮助用户完成应用开发流程的每个步骤。熟悉的工具和界面让用户能够比以往更快地上手。Code Composer Studio 将 Eclipse 软件框架的优势和 TI 高级嵌入式调试功能相结合，为嵌入式开发人员提供了一种极具吸引力且功能丰富的开发环境。

引脚多路复用工具 引脚多路复用实用程序是一款软件工具，可提供图形用户界面，用于配置引脚多路复用设置、解决冲突并指定 TI MPU 的 I/O 电池特性。结果采用 C 头文件/代码文件的形式输出，可导入软件开发套件 (SDK) 或用于配置客户的定制软件。引脚多路复用实用程序版本 4 添加了自动选择可满足输入要求的多路复用器配置的功能。

有关处理器平台开发支持工具的完整列表，请访问德州仪器 (TI) 网站 www.ti.com.cn。有关价格和供货情况的信息，请联系最近的 TI 现场销售办事处或授权分销商。

11.3 文档支持

要接收文档更新通知，请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

11.4 支持资源

TI E2E™ 中文支持论坛 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

11.5 商标

eMMC™ is a trademark of MultiMediaCard Association.

Jacinto™, C7000™, Code Composer Studio™, and TI E2E™ are trademarks of Texas Instruments.

CoreSight™ is a trademark of Arm Limited (or its subsidiaries) in the US and/or elsewhere.

Arm® and Cortex® are registered trademarks of Arm Limited (or its subsidiaries) in the US and/or elsewhere.

PCI-Express® is a registered trademark of PCI-SIG.

安全数字® is a registered trademark of SD Card Association.

MIPI® is a registered trademark of MIPI Alliance, Inc.

所有商标均为其各自所有者的财产。

11.6 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

11.7 术语表

TI 术语表

本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

12 修订历史记录

| Changes from DECEMBER 13, 2024 to SEPTEMBER 16, 2025 (from Revision D (DECEMBER 2024) to Revision E (SEPTEMBER 2025)) | | Page |
|---|--|------|
| • 通篇：删除了 "AND" 27mm × 27mm MECH 封装信息、相关支持数据和任何相关的器件特定 GPN (AM69A94、AM6954) 内容..... | | 1 |
| • (器件比较)：每个 GPN 添加了 JTAG 用户 ID 寄存器位字段 [WKUP_CTRL_MMR_CFG0_JTAG_USER_ID[31:16] "DEVICE_ID"] 和关联的 DEVICE_ID 位字段值；并添加/更改了相关脚注..... | | 6 |
| • (引脚图)：添加了“ALY”封装引脚图..... | | 9 |
| • (EPWM0 信号说明)：更新了 EHRPWM0_SYNCO 说明..... | | 115 |
| • (EPWM3 信号说明)：更新了 EHRPWM3_SYNCO 说明..... | | 116 |
| • (VMON 信号说明)：更新/更改了 VMON2_IR_VCPU 信号名称的说明..... | | 133 |
| • (建议运行条件)：添加了 VPP_*、eFuse ROM 编程电源行，以及关联的脚注..... | | 146 |
| • (SERDES 电气特性)：更新了“USXGMII 支持……”注释..... | | 154 |
| • 添加了 VDD_CPU 行..... | | 155 |
| • 更新了 VPP_CORE 和 VPP_MCU 行..... | | 155 |
| • (对硬件保修的影响)：更新/更改了段落、包括“因此，TI 没有……”句子..... | | 156 |
| • (组合式 MCU 域和 Main 域下电时序 - 选项 1：) 添加了“选项 1”..... | | 163 |
| • (组合式 MCU 域和 Main 域下电时序 - 选项 2：) 添加了“选项 2”一节 (新)..... | | 163 |
| • (隔离式 MCU 域和 Main 域下电时序 - 选项 1)：添加了“选项 1”..... | | 168 |
| • (隔离式 MCU 域和 Main 域下电时序 - 选项 2)：添加了“选项 2”一节 (新)..... | | 168 |
| • (系统时序)：删除了“系统时序条件”表并将其移至下方部分：复位、安全信号和时钟时序..... | | 174 |
| • (复位时序)：添加了复位时序条件表以定义特定于复位输入和输出的条件..... | | 174 |
| • (系统时序)：添加了时序条件表..... | | 182 |
| • (系统时序)：添加了时序条件表..... | | 183 |
| • (GPIO)：更新/更改了 GPIO 时序条件表并添加了相关脚注..... | | 209 |
| • (I2C)：添加了 IOSET 注释，该注释说明了与有效引脚组合相关的时序限制..... | | 236 |
| • (所有时序模式的 MMC0 DLL 延迟映射)：更新/更改了 MMCS0_MMC_SSCFG_PHY_CTRL_5_REG 中旧 SDR、高速 SDR 以及高速 DDR 和 HS200 与 HS400 模式的 FRQSEL ([10:8]) 值和 CLKBUFSEL ([2:0]) 值，并添加了相关的脚注。..... | | 249 |
| • (HS200 模式)：添加了“MMC0 时序要求参数信息..... | | 254 |
| • (所有时序模式的 MMC1 DLL 延迟映射)：更新/更改了“…CTRL_4_REG”的寄存器名称..... | | 256 |
| • (所有时序模式的 MMC1 DLL 延迟映射)：更新/更改了默认速度和高速模式的 OTAPDLYENA 和 OTAPDLYSEL 值，并更改了 UHS-I DDR50 模式的 ITAPDLYSEL 值..... | | 256 |
| • (所有时序模式的 MMC1 DLL 延迟映射)：删除了 CLKBUFSEL 列，因为此“…CTRL_5_REG”寄存器位字段不起任何作用..... | | 256 |
| • (I2C)：添加了 IOSET 注释，该注释说明了与有效引脚组合相关的时序限制..... | | 281 |

13 机械、封装和可订购信息

13.1 封装信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

| Orderable part number | Status (1) | Material type (2) | Package Pins | Package qty Carrier | RoHS (3) | Lead finish/ Ball material (4) | MSL rating/ Peak reflow (5) | Op temp (°C) | Part marking (6) |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|
| AM6958ATGGHAALYR | Active | Production | FCBGA (ALY) 1414 | 200 LARGE T&R | Yes | Call TI | Level-3-250C-168 HR | -40 to 105 | AM6958A TGGHAALY 259 |
| AM69A78ATGGHAALYR | Active | Production | FCBGA (ALY) 1414 | 200 LARGE T&R | Yes | Call TI | Level-3-250C-168 HR | -40 to 105 | AM69A78A TGGHAALY 259 |
| AM69A98ATGGHAALYR | Active | Production | FCBGA (ALY) 1414 | 200 LARGE T&R | Yes | Call TI | Level-3-250C-168 HR | -40 to 105 | AM69A98A TGGHAALY 259 |
| AM69A98ATGGHAALYR.B | Active | Production | FCBGA (ALY) 1414 | 200 LARGE T&R | Yes | Call TI | Level-3-250C-168 HR | -40 to 105 | AM69A98A TGGHAALY 259 |

(1) **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

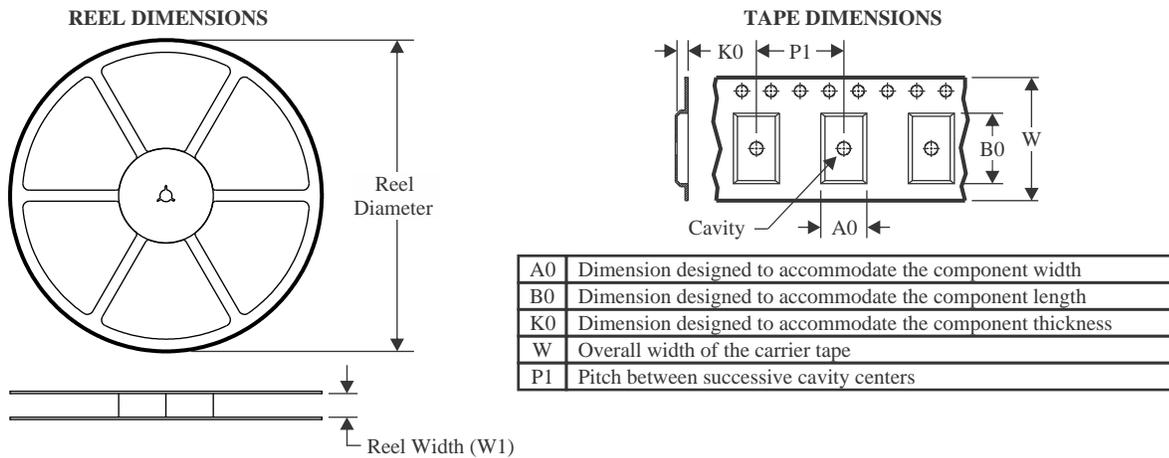
Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative

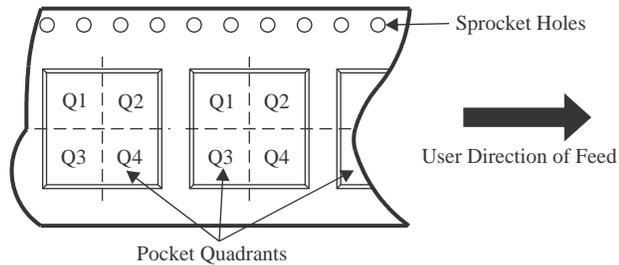
and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

TAPE AND REEL INFORMATION

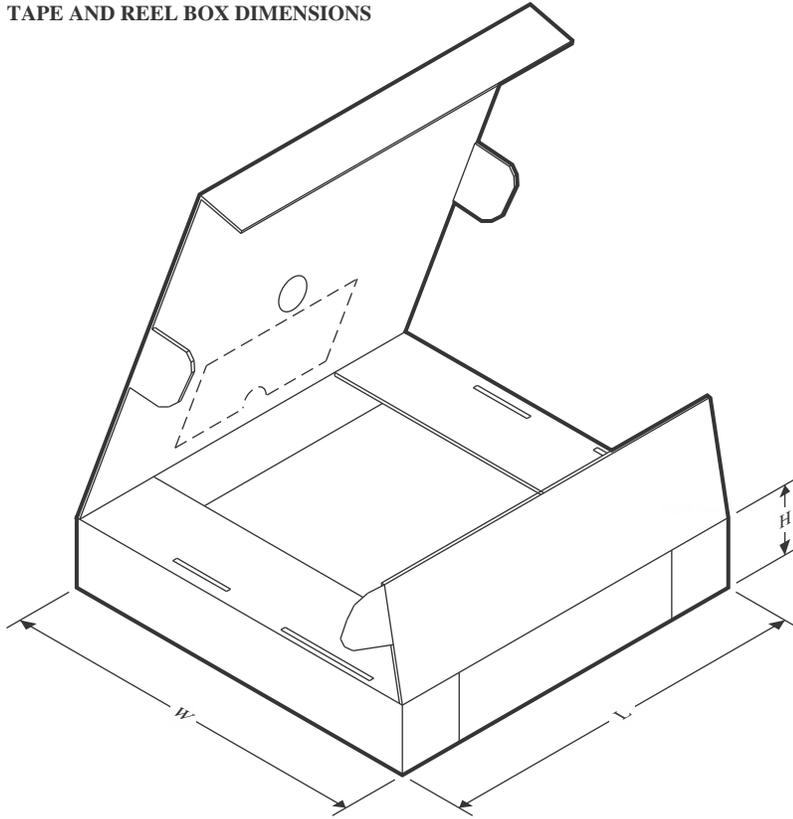


QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE



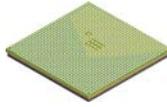
*All dimensions are nominal

| Device | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ | Reel Diameter (mm) | Reel Width W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 Quadrant |
|-------------------|--------------|-----------------|------|-----|--------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------------|
| AM6958ATGGHAALYR | FCBGA | ALY | 1414 | 200 | 330.0 | 44.4 | 31.4 | 31.4 | 4.0 | 36.0 | 16.0 | Q1 |
| AM69A78ATGGHAALYR | FCBGA | ALY | 1414 | 200 | 330.0 | 44.4 | 31.4 | 31.4 | 4.0 | 36.0 | 16.0 | Q1 |
| AM69A98ATGGHAALYR | FCBGA | ALY | 1414 | 200 | 330.0 | 44.4 | 31.4 | 31.4 | 4.0 | 36.0 | 16.0 | Q1 |

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS


*All dimensions are nominal

| Device | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
|-------------------|--------------|-----------------|------|-----|-------------|------------|-------------|
| AM6958ATGGHAALYR | FCBGA | ALY | 1414 | 200 | 336.6 | 336.6 | 53.2 |
| AM69A78ATGGHAALYR | FCBGA | ALY | 1414 | 200 | 336.6 | 336.6 | 53.2 |
| AM69A98ATGGHAALYR | FCBGA | ALY | 1414 | 200 | 336.6 | 336.6 | 53.2 |

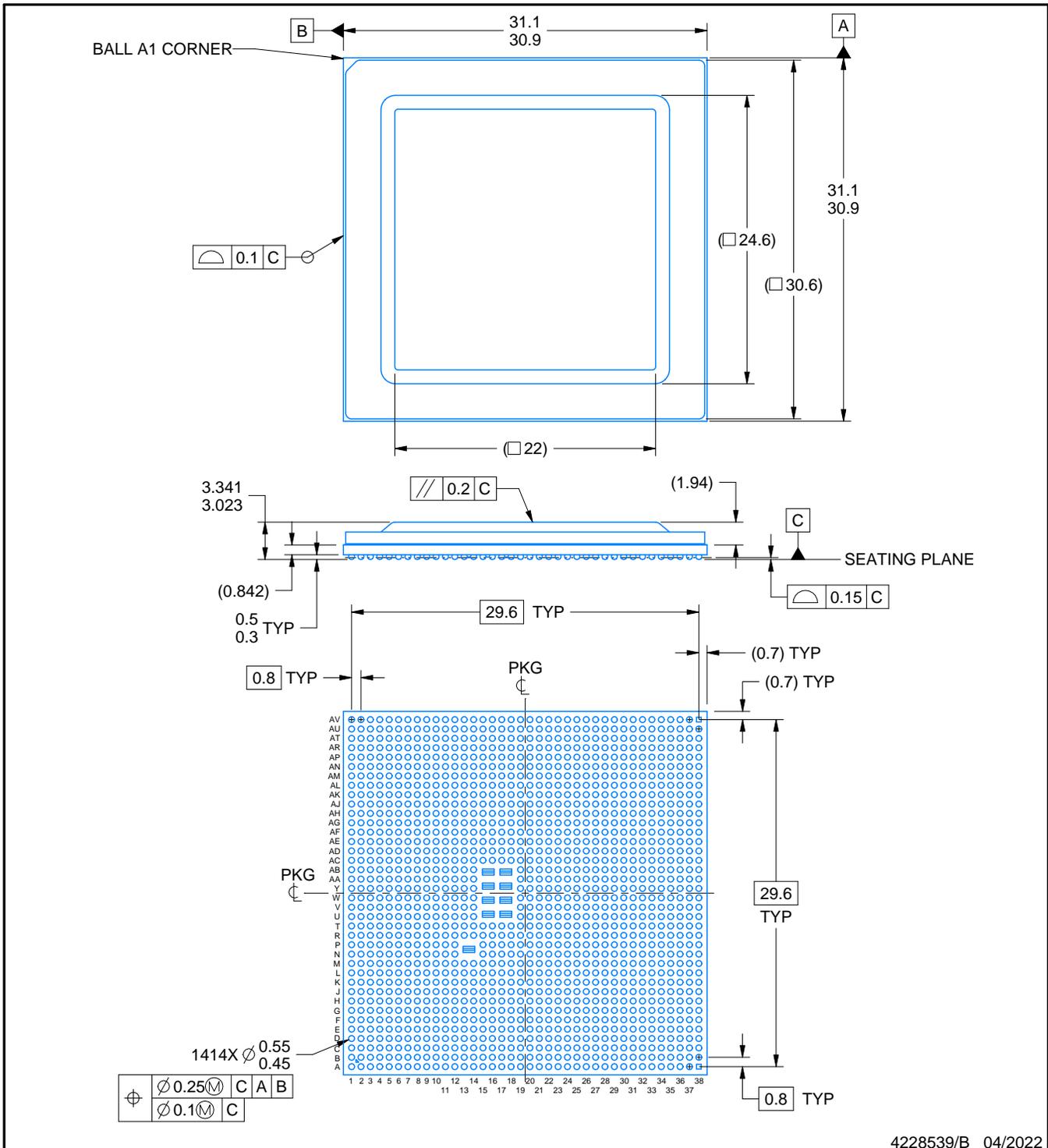


PACKAGE OUTLINE

ALY1414A

FCBGA - 3.341 mm max height

BALL GRID ARRAY



NOTES:

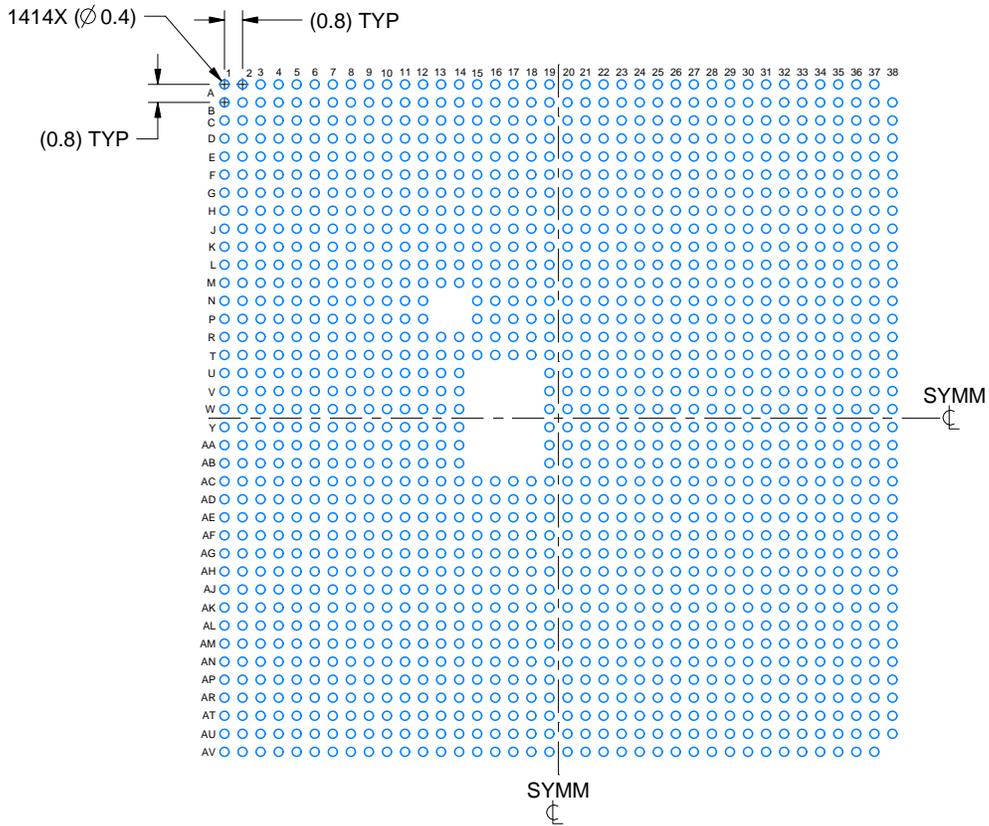
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

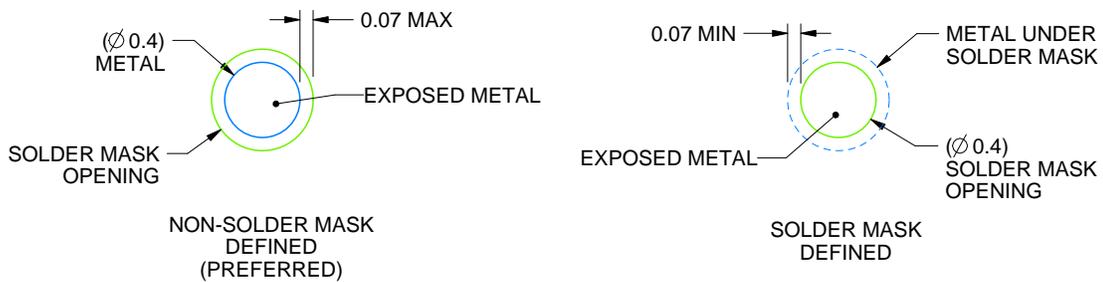
ALY1414A

FCBGA - 3.341 mm max height

BALL GRID ARRAY



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:3X



SOLDER MASK DETAILS
NOT TO SCALE

4228539/B 04/2022

NOTES: (continued)

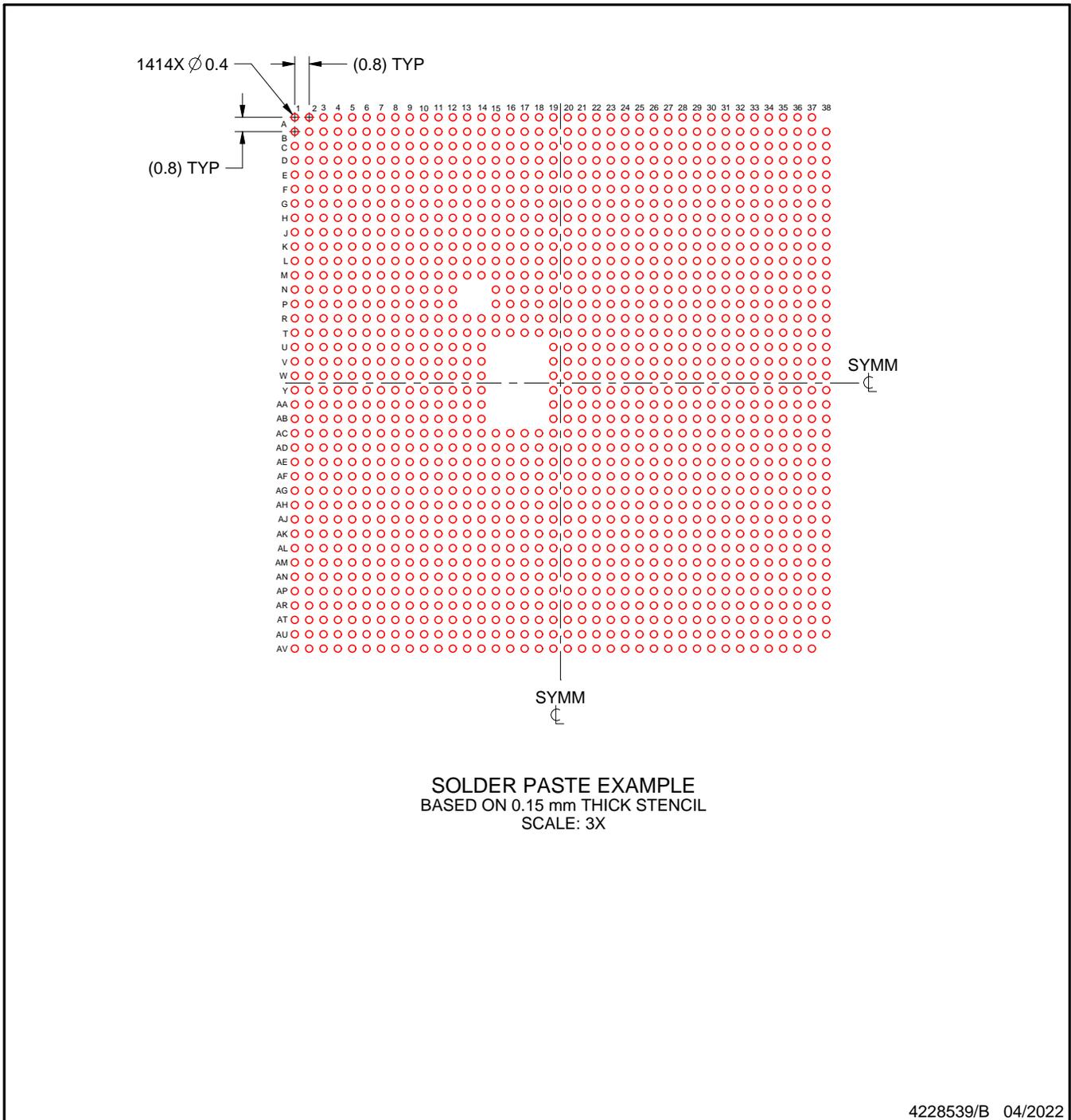
- Final dimensions may vary due to manufacturing tolerance considerations and also routing constraints. For more information, see Texas Instruments literature number SPRU811 (www.ti.com/lit/spru811).

EXAMPLE STENCIL DESIGN

ALY1414A

FCBGA - 3.341 mm max height

BALL GRID ARRAY



NOTES: (continued)

4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2025，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月